Automation PC 810

Anwenderhandbuch

Version: **1.60 (April 2016)**
Bestellnr.: **MAAPC800-GER**

Alle Angaben entsprechen dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt der Erstellung bzw. der Drucklegung des Handbuches. Inhaltliche Änderungen dieses Handbuches behalten wir uns ohne Ankündigung vor. Die Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H. haftet nicht für technische oder drucktechnische Fehler und Mängel in diesem Handbuch. Außerdem übernimmt die Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H. keine Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt auf Lieferung, Leistung und Nutzung dieses Materials zurückzuführen sind. Wir weisen darauf hin, dass die in diesem Dokument verwendeten Soft- und Hardwarebezeichnungen und Markennamen der jeweiligen Firmen dem allgemeinen warenzeichen-, marken- oder patentrechtlichen Schutz unterliegen.

Kapitel 1: Allgemeines

Kapitel 2: Technische Daten

Kapitel 3: Inbetriebnahme

Kapitel 4: Software

Kapitel 5: Normen und Zulassungen

Kapitel 6: Zubehör

Kapitel 7: Wartung / Instandhaltung

Anhang A

Kapitel 1 Allgemeines 14

1 Handbuchhistorie 14
2 Sicherheitshinweise 20
2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung 20
2.2 Schutz vor elektrostatischen Entladungen 20
2.2.1 Verpackung 20
2.2.2 Vorschriften für die ESD- gerechte Handhabung 20
2.3 Vorschriften und Maßnahmen 20
2.4 Transport und Lagerung 21
2.5 Montage 21
2.6 Betrieb 21
2.6.1 Schutz gegen Berühren elektrischer Teile 21
2.6.2 Umgebungsbedingungen - Staub, Feuchtigkeit, aggressive Gase 21
2.6.3 Programme, Viren und schädliche Programme 22
2.7 Umweltgerechte Entsorgung 22
2.7.1 Werkstofftrennung 22
3 Gestaltung von Sicherheitshinweisen 23
4 Richtlinien 23
5 Übersicht 24

Kapitel 2 Technische Daten 28

1 Einleitung 28
1.1 Features 29
1.2 Aufbau / Konfiguration 29
1.3 Konfiguration - Grundsystem 30
1.4 Konfiguration - optionale Komponenten 31
2 Gesamtgerät 32
2.1 Temperaturangaben 32
2.1.1 Maximale Umgebungstemperatur 33
2.1.2 Minimale Umgebungstemperatur 38
2.1.3 Temperaturüberwachung 38
2.1.4 Temperatursensorpositionen 39
2.2 Luftfeuchtigkeitsangaben 40
2.3 Leistungshaushalt 41
2.3.1 Blockschaltbild Spannungsversorgung 41
2.3.2 Leistungskalkulation mit 5PC810.SX01-00 Revision ≥ D0 42
2.3.3 Leistungskalkulation mit 5PC810.SX01-00 Revision < D0 43
2.3.4 Leistungskalkulation mit 5PC810.SX02-00 Revision ≥ D0 44
2.3.5 Leistungskalkulation mit 5PC810.SX02-00 Revision < D0 45
2.3.6 Leistungskalkulation mit 5PC810.SX03-00 46
2.3.7 Leistungskalkulation mit 5PC810.SX05-00 47
2.4 Serialnummernaufkleber 48
2.5 Blockschaltbilder 50
2.5.1 Systemeinheit 5PC810.SX01-00 + Buseinheit 5PC810.BX01-00 50
2.5.2 Systemeinheit 5PC810.SX01-00 + Buseinheit 5PC810.BX01-01 51
2.5.3 Systemeinheit 5PC810.SX02-00 + Buseinheit 5PC810.BX02-00 52
2.5.4 Systemeinheit 5PC810.SX02-00 + Buseinheit 5PC810.BX02-01 53
2.5.5 Systemeinheit 5PC810.SX03-00 + Buseinheit 5PC810.BX03-00 54
2.5.6 Systemeinheit 5PC810.SX05-00 + Buseinheit 5PC810.BX05-00 55
2.5.7 Systemeinheit 5PC810.SX05-00 + Buseinheit 5PC810.BX05-01 56
2.5.8 Systemeinheit 5PC810.SX05-00 + Buseinheit 5PC810.BX05-02 57
2.6 Geräteschnittstellen und Einschübe 58
2.6.1 Spannungsversorgung +24 VDC 58
2.6.2 Serielle Schnittstelle COM1 59
2.6.3 Serielle Schnittstelle COM2 59
2.6.4 Monitor / Panel Anschluss - SDL (Smart Display Link / DVI) 60
2.6.5 Ethernet 1 (ETH1) 62

2.6.6 Ethernet 2 (ETH2)....63
2.6.7 USB Schnittstellen (USB1, 2, 3, 4, 5)....64
2.6.8 MIC, Line IN, Line OUT....65
2.6.9 Add-on Schnittstellensteckplatz....65
2.6.10 Add-on USV Steckplatz....66
2.6.11 AP Link Steckplatz....66
2.6.12 Card Slot Steckplatz (PCI / PCIe)....67
2.6.13 Status LEDs....69
2.6.14 CMOS Profile Schalter....69
2.6.15 Power Taster....70
2.6.16 Reset Taster....70
2.6.17 Batterie....71
2.6.18 Hardware Security Key (Dongle)....72
2.6.19 CompactFlash Slot 1....73
2.6.20 CompactFlash Slot 2....73
2.6.21 Slide-in Slot 1....74
2.6.22 Slide-in Slot 2....74
2.6.23 Slide-in compact Slot....75
3 Einzelkomponenten....76
3.1 Systemeinheiten....76
3.1.1 5PC810.SX01-00....76
3.1.2 5PC810.SX02-00....83
3.1.3 5PC810.SX03-00....90
3.1.4 5PC810.SX05-00....97
3.2 Buseinheiten....103
3.2.1 Allgemeines....103
3.2.2 Bestelldaten....104
3.2.3 Technische Daten....104
3.3 CPU Boards 945GME....106
3.3.1 Allgemeines....106
3.3.2 Bestelldaten....106
3.3.3 Technische Daten 5PC800.B945-0x....107
3.3.4 Technische Daten 5PC800.B945-1x....107
3.4 Kühlkörper....109
3.4.1 Bestelldaten....109
3.4.2 Technische Daten....109
3.5 Hauptspeicher....111
3.5.1 Allgemeines....111
3.5.2 Bestelldaten....111
3.5.3 Technische Daten....111
3.6 Laufwerke....112
3.6.1 5AC801.HDDI-00....112
3.6.2 5AC801.HDDI-01....114
3.6.3 5AC801.HDDI-02....116
3.6.4 5AC801.HDDI-03....118
3.6.5 5AC801.HDDI-04....120
3.6.6 5AC801.SSDI-00....122
3.6.7 5AC801.SSDI-01....126
3.6.8 5AC801.SSDI-02....128
3.6.9 5AC801.SSDI-03....130
3.6.10 5AC801.SSDI-04....133
3.6.11 5AC801.SSDI-05....136
3.6.12 5MMSSD.0060-00....139
3.6.13 5MMSSD.0060-01....141
3.6.14 5MMSSD.0128-01....144
3.6.15 5MMSSD.0180-00....147
3.6.16 5MMSSD.0256-00....149

3.6.17 5AC801.ADAS-00....152
3.6.18 5AC801.HDDS-00....153
3.6.19 5AC801.DVDS-00....155
3.6.20 5AC801.DVRS-00....157
3.6.21 5ACPCI.RAIC-01....160
3.6.22 5ACPCI.RAIC-02....163
3.6.23 5ACPCI.RAIC-03....165
3.6.24 5ACPCI.RAIC-04....168
3.6.25 5ACPCI.RAIC-05....170
3.6.26 5ACPCI.RAIC-06....173
3.6.27 5MMHDD.0250-00....176
3.6.28 5MMHDD.0500-00....178
3.7 Lüfter Kit....180
3.7.1 5PC810.FA01-00....180
3.7.2 5PC810.FA02-01....181
3.7.3 5PC810.FA03-00....182
3.7.4 5PC810.FA05-00....183
3.8 AP Link Steckkarten....185
3.8.1 5AC801.SDL0-00....185
3.8.2 5AC801.RDYR-00....188
3.9 Ready Relais....189
3.9.1 5AC801.RDYR-01....189
3.9.2 Allgemeines....189
3.9.3 Bestelldaten....189
3.9.4 Pinbelegung....189
3.9.5 Lieferumfang....190
3.10 Schnittstellenoptionen (IF Option)....191
3.10.1 Allgemeines....191
3.10.2 5AC600.CANI-00....191
3.10.3 5AC600.485I-00....194

Kapitel 3 Inbetriebnahme....197

1 Montage....197
1.1 Vorgehensweise....197
1.2 Wichtige Informationen zur Montage....197
1.3 Einbaulagen....198
1.3.1 Einbaulage - senkrecht....198
1.3.2 Einbaulage - waagrecht....198
1.4 Luftzirkulationsabstände....199
2 Anschluss von Kabeln....200
3 Erdungskonzept....201
4 Allgemeine Anleitung zur Vorgehensweise bei Temperaturtests....201
4.1 Vorgehensweise....201
4.2 Auswertung der Temperaturen unter Windows Betriebssystemen....202
4.2.1 Auswertung mit dem B&R Control Center....202
4.2.2 Auswertung mit dem BurnIn Tool von Passmark....202
4.3 Auswertung der Temperaturen unter Nicht- Windows Betriebssystemen....204
4.4 Auswertung der Messergebnisse....204
5 Anschlussbeispiele....206
5.1 Auswahl der Displayeinheiten....206
5.2 Ein Automation Panel 900 über DVI onboard....207
5.2.1 Voraussetzung Grundsystem....207
5.2.2 Linkbaugruppe....207
5.2.3 Kabel....207
5.2.4 Mögliche Automation Panel Geräte, Auflösungen und Segmentlängen....208
5.2.5 BIOS Einstellungen....208
5.3 Ein Automation Panel 900 über SDL onboard....209

5.3.1 Voraussetzung Grundsystem....209
5.3.2 Linkbaugruppe....209
5.3.3 Kabel....209
5.3.4 BIOS Einstellungen....210
5.4 Ein Automation Panel 800 über SDL onboard....211
5.4.1 Voraussetzung Grundsystem....211
5.4.2 Kabel....211
5.4.3 BIOS Einstellungen....212
5.5 Ein AP900 und ein AP800 über SDL onboard....213
5.5.1 Voraussetzung Grundsystem....213
5.5.2 Linkbaugruppe....213
5.5.3 Kabel....213
5.5.4 BIOS Einstellungen....214
5.6 Vier Automation Panel 900 über SDL onboard....215
5.6.1 Voraussetzung Grundsystem....215
5.6.2 Linkbaugruppen....215
5.6.3 Kabel....216
5.6.4 BIOS Einstellungen....217
5.7 Ein Automation Panel 900 über SDL AP Link....218
5.7.1 Voraussetzung Grundsystem....218
5.7.2 Linkbaugruppe....218
5.7.3 Kabel....218
5.7.4 BIOS Einstellungen....219
5.8 Vier Automation Panel 900 über SDL AP Link....220
5.8.1 Voraussetzung Grundsystem....220
5.8.2 Linkbaugruppe....221
5.8.3 Kabel....221
5.8.4 BIOS Einstellungen....222
5.9 Zwei Automation Panel 900 über SDL onboard und SDL AP Link....223
5.9.1 Voraussetzung Grundsystem....223
5.9.2 Linkbaugruppe....223
5.9.3 Kabel....224
5.9.4 BIOS Einstellungen....224
5.10 Acht Automation Panel 900 über SDL onboard und SDL AP Link....226
5.10.1 Voraussetzung Grundsystem....226
5.10.2 Linkbaugruppe....227
5.10.3 Kabel....227
5.10.4 BIOS Einstellungen....228
5.11 Sechs AP900 und zwei AP800 über SDL onboard und SDL AP Link....229
5.11.1 Voraussetzung Grundsystem....229
5.11.2 Linkbaugruppe....230
5.11.3 Kabel....230
5.11.4 BIOS Einstellungen....231
6 Anschluss von USB Peripheriegeräten....232
6.1 Lokal am APC810....232
6.2 Remote am Automation Panel 900 über DVI....233
6.3 Remote am Automation Panel 800 / 900 über SDL....233
7 Konfiguration eines SATA RAID Verbundes....234
7.1 Create RAID Set....235
7.2 Create RAID Set - Striped....235
7.3 Create RAID Set - Mirrored....236
7.4 Delete RAID Set....236
7.5 Rebuild Mirrored Set....237
7.6 Resolve Conflicts....237
7.7 Low Level Format....238
8 Bekannte Probleme / Eigenheiten....239
8.1 Probleme / Eigenheiten des ersten Fertigungsloses....239

8.2 Probleme / Eigenheiten nachfolgender Fertigungslose ... 239

Kapitel 4 Software ... 241

1 BIOS Optionen ... 241
1.1 Allgemeines ... 241
1.2 BIOS Setup und Startvorgang ... 241
1.2.1 BIOS Setup Tasten ... 243
1.3 Main ... 244
1.4 Advanced ... 245
1.4.1 ACPI Configuration ... 246
1.4.2 PCI Configuration ... 247
1.4.3 PCI Express Configuration ... 250
1.4.4 Graphics Configuration ... 252
1.4.5 CPU Configuration ... 254
1.4.6 Chipset Configuration ... 255
1.4.7 I/O Interface Configuration ... 256
1.4.8 Clock Configuration ... 257
1.4.9 IDE Configuration ... 257
1.4.10 USB Configuration ... 263
1.4.11 Keyboard/Mouse Configuration ... 264
1.4.12 Remote Access Configuration ... 265
1.4.13 CPU Board Monitor ... 267
1.4.14 Baseboard/Panel Features ... 268
1.5 Boot ... 272
1.6 Security ... 274
1.6.1 Hard Disk Security User Password ... 275
1.6.2 Hard Disk Security Master Password ... 275
1.7 Power ... 276
1.8 Exit ... 277
1.9 BIOS Defaulteinstellungen ... 278
1.9.1 Main ... 278
1.9.2 Advanced ... 278
1.9.3 Boot ... 283
1.9.4 Security ... 283
1.9.5 Power ... 283
1.10 BIOS Fehlersignale (Beep Codes) ... 284
1.11 Ressourcenaufteilung ... 285
1.11.1 RAM-Adressbelegung ... 285
1.11.2 I/O-Adressbelegung ... 285
1.11.3 Interrupt- Zuweisungen in PIC Mode ... 285
1.11.4 Interrupt- Zuweisungen in APIC Mode ... 286
2 Upgradeinformationen ... 290
2.1 BIOS Upgrade ... 290
2.1.1 Was muss ich wissen? ... 290
2.1.2 Vorgangsweise mit MS-DOS ... 291
2.2 Firmwareupgrade ... 293
2.2.1 Vorgangsweise ... 293
2.2.2 Mögliche Upgradeprobleme und Softwareabhängigkeiten (für V1.00) ... 294
2.3 MS-DOS Bootdiskette erstellen unter Windows XP ... 296
2.4 So erstellen Sie einen bootfähigen USB Memory Stick für B&R Upgrade Files ... 298
2.4.1 Was wird benötigt ... 298
2.4.2 Vorgangsweise ... 298
2.4.3 Woher bekomme ich MS-DOS? ... 298
2.5 So erstellen Sie eine bootfähige CompactFlash Karte für B&R Upgrade Files ... 299
2.5.1 Was wird benötigt? ... 299
2.5.2 Vorgangsweise ... 299
2.5.3 Woher bekomme ich MS-DOS? ... 299

2.6 Upgradeprobleme ... 299
3 Microsoft DOS ... 300
3.1 Bestelldaten ... 300
3.2 Bekannte Probleme ... 300
3.3 Auflösungen und Farbtiefe ... 300
4 Windows XP Professional ... 301
4.1 Allgemeines ... 301
4.2 Bestelldaten ... 301
4.3 Übersicht ... 302
4.4 Installation ... 302
4.4.1 Installation auf PCI SATA RAID Controller - 5ACPCI.RAIC-03, 5ACPCI.RAIC-05, 5ACPCI.RAIC-06. 302
4.4.2 Besonderheit 5PCI Slot Variante ... 303
4.5 Treiber ... 304
5 Windows 7 ... 305
5.1 Allgemeines ... 305
5.2 Bestelldaten ... 305
5.3 Übersicht ... 305
5.4 Installation ... 306
5.4.1 Installation auf PCI SATA RAID Controller - 5ACPCI.RAIC-03, 5ACPCI.RAIC-05, 5ACPCI.RAIC-06. 306
5.4.2 Besonderheit 5PCI Slot Variante ... 306
5.5 Eigenheiten, Einschränkungen ... 307
5.6 Treiber ... 307
6 Windows XP Embedded ... 308
6.1 Allgemeines ... 308
6.2 Bestelldaten ... 308
6.3 Übersicht ... 308
6.4 Features mit FP2007 (Feature Pack 2007) ... 308
6.5 Installation ... 308
6.6 Treiber ... 309
6.6.1 Touchscreentreiber ... 309
7 Windows Embedded Standard 2009 ... 310
7.1 Allgemeines ... 310
7.2 Bestelldaten ... 310
7.3 Übersicht ... 310
7.4 Features mit WES2009 (Windows Embedded Standard 2009) ... 310
7.5 Installation ... 311
7.6 Treiber ... 311
7.6.1 Touch Screen Treiber ... 311
7.7 Unterstützte Displayauflösungen ... 311
8 Windows Embedded Standard 7 ... 312
8.1 Allgemeines ... 312
8.2 Bestelldaten ... 312
8.3 Übersicht ... 312
8.4 Features mit WES7 (Windows Embedded Standard 7) ... 312
8.5 Installation ... 313
8.6 Treiber ... 313
8.6.1 Touch Screen Treiber ... 313
8.7 Unterstützte Displayauflösungen ... 314
9 Windows CE ... 315
9.1 Allgemeines ... 315
9.2 Bestelldaten ... 315
9.3 Übersicht ... 315
9.4 Features Windows CE 6.0 ... 315
9.5 Was wird benötigt ... 316
9.6 Installation ... 316
9.7 B&R Embedded OS Installer ... 316
10 Automation Runtime ... 317

10.1 Allgemeines ... 317
10.2 Bestelldaten ... 317
10.3 Automation Runtime Windows (ARwin) ... 317
10.4 Automation Runtime Embedded (ARemb) ... 318
10.5 Technology Guarding ... 318
11 B&R Automation Device Interface (ADI) - Control Center ... 319
11.1 Funktionen ... 319
11.2 Installation ... 320
11.3 SDL Equalizer Einstellung ... 321
11.4 USV Parametrierung ... 322
11.4.1 Installation des USV Dienstes für die B&R Add-on USV ... 322
11.4.2 Statuswerte der USV anzeigen ... 323
11.4.3 Batterieeinstellungen der USV bearbeiten ... 323
11.4.4 Batterieeinstellungen der USV aktualisieren ... 324
11.4.5 Batterieeinstellungen der USV sichern ... 325
11.4.6 Systemeinstellungen der USV konfigurieren ... 325
11.4.7 Weitere USV Einstellungen ändern ... 327
11.4.8 Ablauf bei einem Powerfail ... 328
12 B&R Automation Device Interface (ADI) Development Kit ... 329
13 B&R Automation Device Interface (ADI) .NET SDK ... 331
14 B&R Key Editor ... 333
15 B&R KCF Editor ... 335
16 HMI Service Center ... 336
16.1 5SWUTI.0001-000 ... 336
16.1.1 Allgemeines ... 336
16.1.2 Bestelldaten ... 336

Kapitel 5 Normen und Zulassungen ... 337
1 Richtlinien und Erklärungen ... 337
1.1 CE-Kennzeichnung ... 337
1.2 EMV-Richtlinie ... 337
2 Zulassungen ... 338
2.1 UL-Zulassung ... 338
2.2 Zulassungen für die Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen ... 338
2.2.1 UL Haz. Loc. Zulassung ... 338
2.2.2 ATEX Zulassung ... 338
2.2.3 Anforderungen zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen ... 339
2.3 GOST-R ... 340
2.4 GL-Zulassung (Germanischer Lloyd) ... 340

Kapitel 6 Zubehör ... 343
1 Ersatz CMOS Batterien ... 343
1.1 0AC201.91 / 4A0006.00-000 ... 343
1.1.1 Allgemeines ... 343
1.1.2 Bestelldaten ... 343
1.1.3 Technische Daten ... 343
2 Spannungsversorgungsstecker ... 345
2.1 0TB103.9x ... 345
2.1.1 Allgemeines ... 345
2.1.2 Bestelldaten ... 345
2.1.3 Technische Daten ... 345
3 Ersatz Lüfterfilter ... 346
3.1 Allgemeines ... 346
3.2 Bestelldaten ... 346
4 DVI - Monitor Adapter ... 347
4.1 5AC900.1000-00 ... 347
4.2 Allgemeines ... 347

4.3 Bestelldaten ... 347
5 CompactFlash-Karten ... 348
5.1 Allgemeines ... 348
5.2 Grundlagen ... 348
5.2.1 Flashtechnologie ... 348
5.2.2 Wear Leveling ... 348
5.2.3 Fehlerkorrektur ECC ... 348
5.2.4 S.M.A.R.T. -Support ... 349
5.2.5 Maximale Zuverlässigkeit ... 349
5.3 5CFCRD.xxxx-06 ... 350
5.3.1 Allgemeines ... 350
5.3.2 Bestelldaten ... 350
5.3.3 Technische Daten ... 351
5.3.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm ... 354
5.3.5 Abmessungen ... 355
5.3.6 Benchmark ... 356
5.4 5CFCRD.xxxx-04 ... 357
5.4.1 Allgemeines ... 357
5.4.2 Bestelldaten ... 357
5.4.3 Technische Daten ... 357
5.4.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm ... 359
5.4.5 Abmessungen ... 359
5.4.6 Benchmark ... 360
5.5 5CFCRD.xxxx-03 ... 361
5.5.1 Allgemeines ... 361
5.5.2 Bestelldaten ... 361
5.5.3 Technische Daten ... 361
5.5.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm ... 363
5.5.5 Abmessungen ... 363
5.6 Bekannte Probleme / Eigenheiten ... 364
6 USB Media Drive ... 365
6.1 5MD900.USB2-01 ... 365
6.1.1 Allgemeines ... 365
6.1.2 Bestelldaten ... 365
6.1.3 Schnittstellen ... 365
6.1.4 Technische Daten ... 365
6.1.5 Abmessungen ... 367
6.1.6 Abmessungen mit Frontklappe ... 368
6.1.7 Einbau in Wanddurchbrüche ... 368
6.1.8 Lieferumfang ... 368
6.1.9 Montage ... 368
6.2 5MD900.USB2-02 ... 370
6.2.1 Allgemeines ... 370
6.2.2 Bestelldaten ... 370
6.2.3 Schnittstellen ... 370
6.2.4 Technische Daten ... 370
6.2.5 Abmessungen ... 372
6.2.6 Abmessungen mit Frontklappe ... 372
6.2.7 Einbau in Wanddurchbrüche ... 373
6.2.8 Lieferumfang ... 373
6.2.9 Montage ... 373
6.3 5A5003.03 ... 374
6.3.1 Allgemeines ... 374
6.3.2 Bestelldaten ... 374
6.3.3 Technische Daten ... 374
6.3.4 Abmessungen ... 374
6.3.5 Lieferumfang ... 374

6.3.6 Montage....375
7 USB Memory Sticks....376
7.1 5MMUSB.2048-00....376
7.1.1 Allgemeines....376
7.1.2 Bestelldaten....376
7.1.3 Technische Daten....376
7.1.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm....377
7.2 5MMUSB.xxxx-01....378
7.2.1 Allgemeines....378
7.2.2 Bestelldaten....378
7.2.3 Technische Daten....378
7.2.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm....379
8 Unterbrechungsfreie Stromversorgung....380
8.1 Features....380
8.2 Was wird benötigt....380
8.3 5AC600.UPSI-00....381
8.3.1 Allgemeines....381
8.3.2 Bestelldaten....381
8.3.3 Technische Daten....381
8.3.4 Montage....381
8.4 5AC600.UPSB-00....383
8.4.1 Allgemeines....383
8.4.2 Bestelldaten....383
8.4.3 Technische Daten....383
8.4.4 Lebensdauer....384
8.4.5 Tiefentladezyklen....384
8.4.6 Abmessungen....385
8.4.7 Bohrschablone....385
8.4.8 Montagevorschriften....385
8.5 5CAUPS.00xx-00....386
8.5.1 Allgemeines....386
8.5.2 Bestelldaten....386
8.5.3 Technische Daten....386
8.6 5AC600.UPSF-00....387
8.6.1 Allgemeines....387
8.6.2 Bestelldaten....387
8.7 5AC600.UPSF-01....387
8.7.1 Allgemeines....387
8.7.2 Bestelldaten....387
9 Netzfilter....388
9.1 5AC804.MFLT-00....388
9.1.1 Allgemeines....388
9.1.2 Bestelldaten....388
9.1.3 Technische Daten....388
9.1.4 Abmessungen....389
9.1.5 Bohrschablone....389
9.1.6 Anschluss an das Endgerät....389
10 PCI Einsteckkarten....390
10.1 5ACPCI.ETH1-01....390
10.1.1 Allgemeines....390
10.1.2 Bestelldaten....390
10.1.3 Technische Daten....390
10.1.4 Treibersupport....391
10.1.5 Abmessungen....392
10.2 5ACPCI.ETH3-01....393
10.2.1 Allgemeines....393
10.2.2 Bestelldaten....393

10.2.3 Technische Daten ... 393
10.2.4 Treibersupport ... 394
10.2.5 Abmessungen ... 395
11 Kabel ... 396
11.1 DVI-Kabel ... 396
11.1.1 5CADVI.0xxx-00 ... 396
11.2 SDL-Kabel ... 399
11.2.1 5CASDL.0xxx-00 ... 399
11.3 SDL-Kabel mit 45°-Stecker ... 402
11.3.1 5CASDL.0xxx-01 ... 402
11.4 SDL-Kabel flex ... 405
11.4.1 5CASDL.0xxx-03 ... 405
11.5 SDL-Kabel flex mit Extender ... 408
11.5.1 5CASDL.0xx0-13 ... 408
11.6 USB-Kabel ... 412
11.6.1 5CAUSB.00xx-00 ... 412
11.7 RS232-Kabel ... 413
11.7.1 9A0014.xx ... 413
11.8 Versorgungskabel intern ... 415
11.8.1 5CAMSC.0001-00 ... 415
12 HDD Ersatzdiskablage ... 416
12.1 5AC801.FRAM-00 ... 416
12.1.1 Allgemeines ... 416
12.1.2 Bestelldaten ... 416
12.1.3 Technische Daten ... 416
12.1.4 Abmessungen ... 417

Kapitel 7 Wartung / Instandhaltung ... 418

1 Batteriewechsel ... 418
1.1 Batteriestatusermittlung ... 418
1.2 Vorgangsweise ... 418
2 CompactFlash Tausch ... 420
3 Slide-in compact Laufwerkseinbau bzw. -tausch ... 421
3.1 Vorgangsweise ... 421
4 Slide-in Slot Laufwerkseinbau bzw. -tausch ... 422
4.1 Vorgangsweise ... 422
5 Slide-in compact Adapter Montage ... 423
5.1 Vorgangsweise ... 423
6 Lüfter Kit Einbau / Tausch ... 425
6.1 Vorgangsweise ... 425
7 Montage des USV Moduls ... 427
7.1 Montage ohne montiertem Add-on Schnittstellenmodul ... 427
7.1.1 APC810 1 Card Slot ... 427
7.1.2 APC810 2 und 3 Card Slot ... 429
7.1.3 APC810 5 Card Slot ... 431
7.2 Montage mit montiertem Add-on Schnittstellenmodul ... 433
7.2.1 APC810 1 Card Slot ... 433
7.2.2 APC810 2 und 3 Card Slot ... 435
7.2.3 APC810 5 Card Slot ... 437
8 Montage des USV Sicherungs Kit an der Batterieeinheit ... 439
8.1 Vorgangsweise ... 439
9 Seitendeckeldemontage ... 441
9.1 APC810 mit 1 Card Slot ... 441
9.2 APC810 mit 2 und 3 Card Slot ... 441
9.3 APC810 mit 5 Card Slot ... 442
10 AP Link Montage ... 443
10.1 Vorgangsweise ... 443

11 Tauschen einer PCI SATA RAID Hard Disk bei RAID 1 444
11.1 Vorgangsweise 444
12 Montage der HDD Ersatzdiskablage 446
12.1 Vorgangsweise 446
13 Montage des Ready Relais /2 am Add-on USV Steckplatz 447
13.1 Vorgangsweise 447

Anhang A 449

1 Maintenance Controller Extended (MTCX) 449
1.1 Temperaturüberwachung Lüfterregelung 449
2 Anschluss eines externen Verbrauchers an das Basisboard 451

Kapitel 1 • Allgemeines

1 Handbuchhistorie

Version	Datum	Änderung
0.10 Preliminary	20.11.2007	• Erste Version
0.20 Preliminary	11.01.2008	• Textänderung beim Systemeinheitenkurztext • Textänderung auf 945GME (statt 945GM) • 256 MB Hauptspeicher entfernt. • 5AC801.ADAS-00 und 5AC801.HDDS-00 ergänzt. • Zubehör ergänzt. • Ready Relais 5AC801.RDYR-00, SATA RAID Controller, Lüfter Kit, IF Optionen, Ersatz Luftfilter ergänzt. • BIOS Beschreibung ergänzt.
0.30 Preliminary	31.01.2008	• Fehler bei der Konfiguration behoben. • BIOS Defaultprofile ergänzt. • Namensänderung von APC810 auf APC800 und Best. Nr. Änderung. • Technische Daten des Gesamtgerätes ergänzt. • Anschlussbeispiele ergänzt. • Probleme und Eigenheiten des ersten Fertigungsloses ergänzt.
0.40 Preliminary	11.04.2008	• Probleme und Eigenheiten des ersten Fertigungsloses überarbeitet. • Abschnitt "Temperatursensorpositionen" in "Anhang A" ergänzt. • Abschnitt "Temperaturangaben" auf Seite 32 ergänzt. • Systemeinheit mit 1 Card Slot ergänzt. • Inhaltliche Änderungen (speziell im Kapitel Wartung / Instandhaltung). • BIOS Beschreibung für die Version 1.10 überarbeitet.
0.41 Preliminary	09.05.2008	• Grafikkorrekturen bei „Umgebungstemperaturen mit und ohne Lüfter Kit“. • Maßangaben des 1 und 2 Card Slot Gesamtgerätes um den Kühlkörper 5AC801.HS00-01 erweitert. • Abschnitt Leistungshaushalt ergänzt. • Serialnummernaufkleberinformationen ergänzt. • Abschnitt Automation PC 810 mit Windows XP Professional und Windows XP Embedded ergänzt. • Abschnitt Automation Device Interface (ADI) erweitert. • 5 Card Slot Variante ergänzt. • Bohrschablonen um 5 Card Slot Variante erweitert. • Abschnitt "Anschluss von USB Peripheriegeräten" auf Seite 232 ergänzt. • Indexerweiterung
0.42 Preliminary	29.05.2008	• Informationen zur Einbaulage (senkrecht, waagrecht) in 3 "Inbetriebnahme". • Umgebungstemperaturangaben mit und ohne Lüfter Kit bzgl. Einbaulage (senkrecht, waagrecht) erweitert. • Fehlerkorrektur (Bestellnummern Lüfter Kits) in Abbildung Abb. 2 "Konfiguration - optionale Komponenten" auf Seite 31. • Fehlerkorrektur (Pinbelegung) in Tabelle Tab. 18 "Spannungsversorgungsanschluss Power 24 VDC" auf Seite 58. • Slide-in Slot 2 Beschreibung überarbeitet. • Slide-in DVD Brenner 5AC801.DVRS-00 ergänzt. • Lüfter Kit für die 5 Card Slot Variante (5PC810.FA05-00) ergänzt. • Echtzeituhr (RTC) Angaben ergänzt.
1.00	10.07.2008	• Korrektur einiger Rechtschreib- und Grammatikfehler. • Blockschaltbilder aller Systemeinheiten in Abhängigkeit der Buseinheit ergänzt ("Blockschaltbilder" auf Seite 50). • Beschreibung des Add-on Schnittstellenmoduls 5AC600.485I-00 erweitert.

Tabelle 1: Handbuchhistorie

Version	Datum	Änderung
1.10	12.09.2008	• Korrektur einiger Rechtschreib- und Grammatikfehler. • Werte des Einschaltstroms geändert (wegen neuem Netzteil). • PCI Ethernetkarten 5ACPCI.ETH1-01und 5ACPCI.ETH3-01 ergänzt. • Stromaufnahme von bisher 1..5A auf 1..6A geändert. • Manual auf den maximalen Wert von 130W angepasst. • Neues Kapitel „Normen und Zulassungen” hinzugefügt. • Luftfeuchtigkeitsangaben ergänzt "Luftfeuchtigkeitsangaben" auf Seite 40. • User ID näher beschrieben. • Best.Nr. für Windows XP mit SP3 5SWWXP.0600-ENG, 5SWWXP.0600-GER, 5SWWXP.0600-MUL ergänzt. • Minimale Umgebungstemperaturangaben hinzugefügt. • Versorgungskabel intern 5CAMSC.0001-00 (für externen Verbraucher am PCI Steckplatz) ergänzt. • Konfiguration eines SATA RAID Controllers von Kapitel Software nach Kapitel Inbetriebnahme verschoben. • Fehlerkorrektur bei 5PC810.FA05-00 (siehe "5PC810.FA05-00" auf Seite 183). • BIOS Einstellungen geändert (neue BIOS Version). • Information zur Erstellung einer MS-DOS Startdiskette ergänzt. • Information zur Erstellung eines bootbaren USB Memory Sticks ergänzt. • Beschreibung B&R Key Editor ergänzt. • Ergänzung HMI Treiber & Utilities DVD. • Beschreibung für den Betrieb als RS485 Schnittstelle des Add-on RS232/422/485 Interface Moduls überarbeitet. • Ergänzung ADI Control Center. • Ergänzung Glossar. • Ergänzung Seitendeckeldemonatge 5PC810.SX01-00 und 5PC810.SX05-00. • Ergänzung zur Montage des USV Moduls (mit und ohne Add-on Schnittstellenmodul). • Fehlerkorrektur des 3-phasigen Netzteils 40A (0PS340.1) bei den Bestellnummern. • Ergänzung 5 Card Slot Buseinheit. • Korrektur einiger Temperatur-Luftfeuchtediagramme. • Ergänzung Add-on Schnittstellensteckplatz. • Beschreibung "Anschluss eines externen Verbrauchers an das Basisboard" auf Seite 451 ergänzt. • Beschreibung "AP Link Montage" auf Seite 443 ergänzt. • Korrektur der Sicherung der Versorgungsspannung von 10A auf 15A auf Seite "Spannungsversorgung +24 VDC" auf Seite 58. • Ergänzung der CMOS Profil Schalterstellung 2 auf Seite "CMOS Profile Schalter" auf Seite 69. • Korrektur der Lebensdauer und der Umdrehungsgeschwindigkeit des Lüfter Kits 5PC810.FA01-00. • Ergänzung Temperaturüberwachung Lüfterregelung siehe "Temperaturüberwachung Lüfterregelung" auf Seite 449.

Tabelle 1: Handbuchhistorie

Version	Datum	Änderung
1.20	14.10.2009	• Topologiegrafik ergänzt. • Korrektur der maximalen Umgebungstemperatur der Systemeinheit 5AC800.B945-02 in der Abbildung auf Seite Maximale Umgebungstemperatur ohne Lüfter Kit. • Beschreibung des CMOS Battery Status in Tabelle Tab. 216 "945GME Baseboard Monitor Einstellmöglichkeiten" auf Seite 270 geändert. • HDD Ersatzablage zum Zubehör auf Seite "5AC801.FRAM-00" auf Seite 416 sowie deren Montage zum 7 "Wartung / Instandhaltung" ergänzt. • Fehler in Abbildungs- und Tabellenverzeichnis behoben. • Fehler im Temperatur Luftfeuchtediagramm von SATA RAID Hard Disk - 5ACPCI.RAIC-03 und SATA RAID Hard Disk - 5ACPCI.RAIC-04 behoben. • ADI Development Kit geändert. • Tabelle für die maximale Umgebungstemperatur für die Kühlkörper 5AC801.HS00-00 > Rev. D0 und 5AC801.HS00-01 > Rev. D0 hinzugefügt. • PCIE Port (ETH2) und PCIE Port (ETH1) BIOS-Beschreibung ergänzt. • 9S0000.08-010, 9S0000.08-020, 9S0000.09-090 abgekündigt. • Informationen zum Firmwareupgrade aktualisiert. • CMOS-Profil 3 (5PC820.SX01-00) hinzugefügt - nähere Informationen zum CMOS-Profil sind im APC820 Anwenderhandbuch nachzulesen. • Abschnitt "Umweltgerechte Entsorgung" in 1 "Allgemeines" ergänzt. • Neuen Lüfter Kit 5PC810.FA02-01 APC810 2 Slot hinzugefügt. • PCI Bus Typ bei den Buseinheiten hinzugefügt. • BIOS Defaulteinstellungen für FDC/LPT/COM Ports ergänzt. • Lieferumfang des USB Memory Sticks entfernt. • Bild der Silicon Systems CompactFlash aktualisiert. • L2 Cache des CPU Boards 5PC800.B945-00 korrigiert - besitzt 2 MB L2 Cache • B&R CompactFlash Karten ergänzt. • Technische Daten der Silicon Systems CFs überarbeitet. • Abschnitt 1.11 "Ressourcenaufteilung" auf Seite 285 ergänzt. • Abschnitt 4.4.1 "Installation auf PCI SATA RAID Controller - 5ACPCI.RAIC-03, 5ACPCI.RAIC-05, 5ACPCI.RAIC-06" auf Seite 302 ergänzt. • Neue "5AC801.SSDI-00" auf Seite 122 ergänzt. • BIOS-Einstellungen auf Version V1.14 aktualisiert. • Die Tabellen „CPU Board Softwarestände“ und „Automation Panel Link Softwarestände“ aus dem Abschnitt "BIOS Upgrade" wurden entfernt. • Abmessungen der Slide-in und Slide-in compact Geräte geändert - jetztige Abmessungen beziehen sich auf die gesamte Mechanik der Geräte. • Mechanische Eigenschaften zu den Produkten 5AC801.DVDS-00 und 5AC801.DVRS-00 ergänzt. • Betriebssyteme 5SWWXP.0500-GER, 5SWWXP.0500-ENG und 5SWWXP.0500-MUL ergänzt. • Abschnitt 9.4 „Erzeugung eines bootbaren (bootable) USB Memory Sticks“ entfernt. • Im 4 "Software" die Abschnitte "BIOS Upgrade", "Firmwareupgrade" und "MS-DOS Bootdiskette erstellen unter Windows XP" in den Abschnitt 2 "Upgradeinformationen" verschoben und aktualisiert. • Im 4 "Software" den Abschnitt "So erstellen Sie einen bootfähigen USB Memory Stick für B&R Upgrade Files" auf Seite 298 ergänzt. • Im 4 "Software" den Abschnitt 2.5 "So erstellen Sie eine bootfähige CompactFlash Karte für B&R Upgrade Files" auf Seite 299 ergänzt. • Angaben zu den möglichen Auflösungen in den Technischen Daten der CPU Boards ergänzt. • Abschnitt 1.10 "BIOS Fehlersignale (Beep Codes)" auf Seite 284 im 4 "Software" ergänzt. • Installationstext von Windows XP Professional geändert. • Abschnitt "Temperatursensorpositionen" geändert. • Informationen zu B&R Key Editor aktualisiert. • Abschnitt 3 "Microsoft DOS" auf Seite 300 ergänzt. • Chipset der Technischen Daten des CPU Board im Abschnitt "CPU Boards 945GME" auf Seite 106 korrigiert. • Tabelle Abb. X "5AC801.ADAS-00 - Technical data" auf Seite korrigiert. • Information auf Seite "Buslänge und Kabeltyp RS422" auf Seite 195 ergänzt. • Tabelle Tab. 188 "Linkbaugruppen" auf Seite 230 korrigiert. • Hex-Bereich in der Tabelle Tab. 244 "RAM-Adressbelegung" auf Seite 285 ergänzt. • Ersatz CMOS Batterien 0AC201.9 durch 0AC201.91 ersetzt. • CPU Board 5PC800.B945-05 ergänzt. • Abschnitt 2.2 "Luftfeuchtigkeitsangaben" auf Seite 40 überarbeitet.

Tabelle 1: Handbuchhistorie

Version	Datum	Änderung
1.30	12.07.2010	• Die Systemeinheit 5PC810.SX03-00, die Buseinheit 5PC810.BX03-00, den Lüfter Kit 5PC810.FA03-00 und den Ersatzlüfter 5AC801.FA03-00 ergänzt. • Abschnitt 7 "Windows Embedded Standard 2009" auf Seite 310 ergänzt. • Abschnitt 11 "B&R Automation Device Interface (ADI) - Control Center" auf Seite 319 aktualisiert. • 5 "Normen und Zulassungen" auf Seite 337 überarbeitet. • B&R CompactFlash 16 GByte (5CFCRD.016G-04) ergänzt. • Abschnitt "Bekannte Probleme / Eigenheiten" auf Seite 239 wurde um einen Punkt erweitert. • Abschnitt "Kabel" auf Seite 396 im 6 "Zubehör" ergänzt. • B&R ID Codes der Systemeinheiten ergänzt. • Anschnitt 9 "Windows CE" auf Seite 315 ergänzt. • B&R USB Memory Stick im 6 "Zubehör" auf Seite 343 ergänzt. • CPU Boards 5PC800.B945-10, 5PC800.B945-11, 5PC800.B945-12, 5PC800.B945-13, 5PC800.B945-14 wurden ergänzt. • Technisches Datum „Remanente Variablen für AR (Automation Runtime) im Power Fail Mode“ bei den APC810 Systemeinheiten ergänzt.
1.31	14.11.2010	• Ready Relais 5AC801.RDYR-01 im 6 "Zubehör" ergänzt. • Abschnitt 13 "Montage des Ready Relais /2 am Add-on USV Steckplatz" auf Seite 447 im 7 "Wartung / Instandhaltung" ergänzt.
1.32	02.11.2010	• "5AC801.HDDI-03" auf Seite 118 ergänzt. • "5ACPCI.RAIC-05" auf Seite 170 ergänzt. • "5MMHDD.0250-00" auf Seite 176 ergänzt. • Abbildung "Konfiguration - optionale Komponenten" auf Seite 31 überarbeitet. • 5AC801.HDDI-03, 5ACPCI.RAIC-05 und 5MMHDD.0250-00 im Abschnitt 2.1 "Temperaturangaben" und in Abschnitt 2.2 "Luftfeuchtigkeitsangaben" auf Seite 40 ergänzt.
1.33	20.05.2011	• Abschnitte "Windows Embedded Standard 7" auf Seite 312, "B&R Automation Device Interface (ADI) .NET SDK" auf Seite 331, "Automation Runtime" auf Seite 317 und "B&R Automation Runtime Dongle" ergänzt. • BIOS Version aktualisiert (1.14 -> 1.17). • Abschnitte "B&R Automation Device Interface (ADI) - Control Center" auf Seite 319, "B&R Key Editor" auf Seite 333, HMI Drivers & Utilities DVD und "B&R Automation Device Interface (ADI) Development Kit" auf Seite 329 überarbeitet. • Buseinheit 5PC810.BX05-02 ergänzt. • Chipset Information "CPU Boards 945GME" auf Seite 106 korrigiert. • Abbildung "Konfiguration - optionale Komponenten" auf Seite 31 überarbeitet.
1.34	11.07.2011	• USB 5 in Überschrift ergänzt ("USB Schnittstellen (USB1, 2, 3, 4, 5)" auf Seite 64). • 5AC801.HDDI-03 in Tabelle Tab. 44 "Slide-in compact Slot" auf Seite 75 ergänzt. • Tabelleneintrag „Ladedauer bei Low Battery“ in Tabelle Abb. X "5AC600.UPSB-00 - Technical data" auf Seite ergänzt. • Abschnitte "B&R Automation Device Interface (ADI) - Control Center" auf Seite 319, "B&R Automation Device Interface (ADI) Development Kit" auf Seite 329 und "B&R Automation Device Interface (ADI) .NET SDK" auf Seite 331 überarbeitet. • Information zu „Besonderheiten 5PCI Slot Variante“ bei "Windows XP Professional" auf Seite 301 und "Windows 7" auf Seite 305 ergänzt. • Information zu „Windows XP Mode“ in Abschnitt "Features mit WES7 (Windows Embedded Standard 7)" auf Seite 312 korrigiert. • Verweis auf die externe USV 24 VDC in Abschnitt "Unterbrechungsfreie Stromversorgung" auf Seite 380 überarbeitet.
1.40	23.01.2012	• Abschnitt "CompactFlash-Karten" wurde überarbeitet. • Abschnitt "B&R Automation Device Interface (ADI) Development Kit" in 4 "Software" verschoben. • Abschnitt "Temperatursensorpositionen" in 2 "Technische Daten" verschoben. • Der Anschitt Bohrschablonen im Kapitel Inbetriebnahme wurde entfernt und die Bohrschablonen im 2 "Technische Daten", Abschnitt 2 "Gesamtgerät" auf Seite 32 bei den Systemeinheiten ergänzt. • Abschnitt "Anschlussbeispiele" auf Seite 206 wurde überarbeitet. • "Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung" aus Abschnitt "AP Link Steckkarten" auf Seite 185 entfernt. • Neue CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx-06 wurden im 6 "Zubehör" ergänzt - die CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx-04 wurden abgekündigt. • Abschnitt "B&R Automation Runtime Dongle" entfernt, die Bestelldaten wurden im Abschnitt "Automation Runtime" auf Seite 317 ergänzt. • BIOS Version aktualisiert (1.17 -> 1.18). • Gesamtes Handbuch gemäß den aktuellen Formatierungsvorgaben überarbeitet.
1.41	25.06.2012	• Die Informationen zum Automation Device Interface und Key Editor wurden aktualisiert. • Im Abschnitt "Card Slot Steckplatz (PCI / PCIe)" auf Seite 67 wurden Informationen zur Verwendung mit 64-Bit PCI Karten ergänzt. • Der Abschnitt "Kabellängen und Auflösungen bei SDL-Übertragung" auf Seite 61 wurde ergänzt. • Informationen zu der "PCI to PCI Bridge" wurden in 3.2.3 "Technische Daten" der Buseinheiten ergänzt. • Informationen zu der "PCIe to SATA Bridge" wurde im Abschnitt "Slide-in Slot 2" auf Seite 74 ergänzt. • Das Ready Relais 5AC801.RDYR-01 wurde auf Seite Ready Relais verschoben.

Tabelle 1: Handbuchhistorie

Version	Datum	Änderung
1.45	01.10.2012	• Der Abschnitt "Gestaltung von Sicherheitshinweisen" auf Seite 23 wurde geändert - der Beschreibungstext für "Vorsicht" und "Warnung" wurde ausgetauscht. • SSD Laufwerke "5AC801.SSDI-01" auf Seite 126 und "5AC801.SSDI-02" auf Seite 128 wurden ergänzt. • Der Abschnitt "Allgemeine Anleitung zur Vorgehensweise bei Temperaturtests" auf Seite 201 wurde ergänzt. • Windows 7 Service Pack 1 wurde ergänzt (siehe "Windows 7" auf Seite 305). • Windows Embedded Standard 7 Service Pack 1 wurde ergänzt (siehe "Windows Embedded Standard 7" auf Seite 312). • Das "B&R Automation Device Interface (ADI) - Control Center" auf Seite 319 wurde aktualisiert. • Das "B&R Automation Device Interface (ADI) Development Kit" auf Seite 329 wurde auf Version 3.40 aktualisiert. • Das "B&R Automation Device Interface (ADI) .NET SDK" auf Seite 331 wurde auf Version 1.80 aktualisiert. • Der "B&R Key Editor" auf Seite 333 wurde auf Version 3.30 aktualisiert. • Die Technischen Daten der CPU Boards wurden aktualisiert - siehe "CPU Boards 945GME" auf Seite 106.
1.46	21.11.2012	• Die B&R CompactFlash Karte 5CFCRD.032G-06 wurde ergänzt, siehe "5CFCRD.xxxx-06" auf Seite 350. • Die Technischen Daten der USV Kabel wurden überarbeitet, siehe "5CAUPS.00xx-00" auf Seite 386.
1.47	14.03.2013	• Folgende Laufwerke wurden ergänzt: "5AC801.HDDI-04" auf Seite 120, "5ACPCI.RAIC-06" auf Seite 173,"5MMHDD.0500-00" auf Seite 178. • Die Bestelldaten der Systemeinheiten "5PC810.SX01-00" auf Seite 76, "5PC810.SX02-00" auf Seite 83, "5PC810.SX03-00" auf Seite 90 und "5PC810.SX05-00" auf Seite 97 wurden überarbeitet. • Die allgemeinen Informationen der Laufwerke "5ACPCI.RAIC-01" auf Seite 160, "5ACPCI.RAIC-05" auf Seite 170 sowie "5MMHDD.0250-00" auf Seite 176 wurden überarbeitet. • Korrektur einiger Rechtschreib- und Grammatikfehler
1.48	15.05.2013	• 5 "Normen und Zulassungen" auf Seite 337 wurde überarbeitet. • Bei den technischen Daten der Einzelkomponenten wurden die Zertifizierungen überarbeitet. • Der Netzfilter "5AC804.MFLT-00" auf Seite 388 wurde ergänzt. • Das Add-on Sicherungs Kit "5AC600.UPSF-00" auf Seite 387 und die Ersatz Sicherungen "5AC600.UPSF-01" auf Seite 387 für die USV Batterieeinheit wurden ergänzt. • Das Slide-in compact Laufwerk "5AC801.SSDI-03" auf Seite 130 wurde ergänzt. • Die Ersatz SSDs "5MMSSD.0060-00" auf Seite 139, "5MMSSD.0060-01" auf Seite 141 und "5MMSSD.0180-00" auf Seite 147 wurden ergänzt.
1.50	19.08.2013	• Der USB Memory Stick 5MMUSB.4096-01 wurde ergänzt, siehe "USB Memory Sticks" auf Seite 376. • Das Slide-in compact Laufwerk "5AC801.SSDI-04" auf Seite 133 wurde ergänzt. • Die Ersatz SSD "5MMSSD.0128-01" auf Seite 144 wurde ergänzt. • Das Anzugsdrehmoment der Fixierschrauben im Abschnitt "Kabel" auf Seite 396 wurde ergänzt. • Die Abschnitte "B&R Automation Device Interface (ADI) Development Kit" auf Seite 329 und "B&R Automation Device Interface (ADI) .NET SDK" auf Seite 331 wurden aktualisiert. • Die Beschreibungen der Ready Relais "5AC801.RDYR-00" auf Seite 188 und "5AC801.RDYR-01" auf Seite 189 wurden überarbeitet.
1.55	06.02.2014	• Die Beschreibung "Montage des USV Moduls" auf Seite 427 wurde überarbeitet. • Das Slide-in compact Laufwerk "5AC801.SSDI-05" auf Seite 136 wurde ergänzt. • Die Ersatz SSD "5MMSSD.0256-00" auf Seite 149 wurde ergänzt. • Die technischen Daten sowie die Temperatur-Luftfeuchtediagramme der SSDs "5AC801.SSDI-04" auf Seite 133 und "5MMSSD.0128-01" auf Seite 144 wurden erweitert. • Die Information zur Abkündigung für den Support des Betriebssystems "Windows XP Professional" auf Seite 301 wurde hinzugefügt. • Das "B&R Automation Device Interface (ADI) - Control Center" auf Seite 319 wurde aktualisiert. • Das "B&R Automation Device Interface (ADI) Development Kit" auf Seite 329 wurde aktualisiert. • Das "B&R Automation Device Interface (ADI) .NET SDK" auf Seite 331 wurde aktualisiert. • Der "B&R Key Editor" auf Seite 333 wurde auf Version 3.40 aktualisiert. • Die "GL-Zulassung (Germanischer Lloyd)" auf Seite 340 in Kapitel 5 wurden aktualisiert. • Die Abschnitte Kabellängen und Auflösungen wurden erweitert, siehe "Monitor / Panel Anschluss - SDL (Smart Display Link / DVI)" auf Seite 60. • Die GOST-R Zertifizierung wurde bei den Technischen Daten ergänzt. • Der Abschnitt "GOST-R" auf Seite 340 wurde ergänzt.

Tabelle 1: Handbuchhistorie

Version	Datum	Änderung
1.56	17.02.2014	• Der Abschnitt "Bekannte Probleme / Eigenheiten" auf Seite 239 wurde überarbeitet und erweitert. • Der Abschnitt Anschlussbeispiele wurde aktualisiert.
1.57	22.10.2014	• Die Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit wurde bei folgenden Laufwerken in den Technischen Daten korrigiert: "5AC801.SSDI-03" auf Seite 130, "5AC801.SSDI-04" auf Seite 133, "5AC801.SSDI-05" auf Seite 136, "5MMSSD.0060-01" auf Seite 141, "5MMSSD.0128-01" auf Seite 144, "5MMSSD.0256-00" auf Seite 149. • Die Pinbelegung des Spannungsversorgungssteckers wurde geändert, siehe "Spannungsversorgung +24 VDC" auf Seite 58. • Die neuen Revisionen der CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx-06 wurden ergänzt, siehe "5CFCRD.xxxx-06" auf Seite 350. • Das "B&R Automation Device Interface (ADI) Development Kit" auf Seite 329 wurde aktualisiert. • Das "B&R Automation Device Interface (ADI) .NET SDK" auf Seite 331 wurde aktualisiert. • Der "B&R Key Editor" auf Seite 333 wurde auf Version 3.40 aktualisiert.
1.58	12.03.2015	• Der Abschnitt Sicherheitshinweise wurde aktualisiert, siehe "Montage" auf Seite 21. • Die "Maximale Umgebungstemperatur ohne Lüfter Kit" und die Maximale Umgebungstemperatur mit Lüfter Kit wurden erweitert. • Die "Luftfeuchtigkeitsangaben" auf Seite 40 wurden erweitert. • Die Pinbelegung des Monitor / Panel Anschlusses wurde überarbeitet, siehe "Monitor / Panel Anschluss - SDL (Smart Display Link / DVI)" auf Seite 60. • Die Pinbelegung des Ready Relais 5AC801.RDYR.00 wurde überarbeitet, siehe "5AC801.RDYR-00" auf Seite 188. • Die Pinbelegung des Ready Relais 5AC801.RDYR.01 wurde überarbeitet, siehe "5AC801.RDYR-01" auf Seite 189. • Der Abschnitt "Automation Runtime" auf Seite 317 wurde aktualisiert.
1.60	04.04.2016	• Das SDL-Kabel 5CASDL.0008-00 wurde ergänzt, siehe "SDL-Kabel" auf Seite 399. • Die Laufwerke "5AC801.HDDI-04" auf Seite 120 und "5MMHDD.0500-00" auf Seite 178 wurden aktualisiert. • Neue Revisionen der Laufwerke "5AC801.SSDI-03", "5AC801.SSDI-04", "5AC801.SSDI-05", "5MMSSD.0060-01", "5MMSSD.0128-01" und "5MMSSD.0256-00" wurden dokumentiert. • Der SATA RAID Controller "5ACPCI.RAIC-06" auf Seite 173 wurde aktualisiert. • Der "B&R KCF Editor" auf Seite 335 wurde ergänzt. • Das "HMI Service Center" auf Seite 336 (5SWUTI.0001-000) wurde ergänzt. • Die "Luftfeuchtigkeitsangaben" auf Seite 40 wurden aktualisiert. • Aktualisierung des Kapitel 5 "Normen und Zulassungen". • Der Technology Guard (HID) 0TG1000.02 wurde ergänzt, siehe "Automation Runtime" auf Seite 317. • Die HMI Drivers & Utilities DVD 5SWHMI.0000-00 wurde entfernt. • Der "B&R Key Editor" auf Seite 333 wurde auf Version 3.60 aktualisiert. • Der Abschnitt "B&R Automation Device Interface (ADI) - Control Center" auf Seite 319 wurde aktualisiert. • Die Übersicht von "Windows 7" und "Windows Embedded Standard 7" wurde überarbeitet. • Der Abschnitt "Spannungsversorgung +24 VDC" auf Seite 58 wurde aktualisiert.

Tabelle 1: Handbuchhistorie

2 Sicherheitshinweise

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Speicherprogrammierbare Steuerungen (wie z.B. RPS, SPS, PLC usw.), Bedien- und Beobachtungsgeräte (wie z.B. Industrie PC‘s, Power Panels, Mobile Panels usw.) wie auch die Unterbrechungsfreie Stromversorgung von B&R sind für den gewöhnlichen Einsatz in der Industrie entworfen, entwickelt und hergestellt worden. Diese wurden nicht entworfen, entwickelt und hergestellt für einen Gebrauch, der verhängnisvolle Risiken oder Gefahren birgt, die ohne Sicherstellung außergewöhnlich hoher Sicherheitsmaßnahmen zu Tod, Verletzung, schweren physischen Beeinträchtigungen oder anderweitigem Verlust führen können. Solche stellen insbesondere die Verwendung bei der Überwachung von Kernreaktionen in Kernkraftwerken, von Flugleitsystemen, bei der Flugsicherung, bei der Steuerung von Massentransportmitteln, bei medizinischen Lebenserhaltungssystemen, und Steuerung von Waffensystemen dar.

2.2 Schutz vor elektrostatischen Entladungen

Elektrische Baugruppen, die durch elektrostatische Entladungen (ESD) beschädigt werden können, sind entsprechend zu handhaben.

2.2.1 Verpackung

- **Elektrische Baugruppen mit Gehäuse**
  … benötigen keine spezielle ESD- Verpackung, sie sind aber korrekt zu handhaben (siehe "Elektrische Baugruppen mit Gehäuse").
- **Elektrische Baugruppen ohne Gehäuse**
  … sind durch ESD- taugliche Verpackungen geschützt.

2.2.2 Vorschriften für die ESD- gerechte Handhabung

Elektrische Baugruppen mit Gehäuse

- Kontakte von Steckverbindern von angeschlossenen Kabeln nicht berühren.
- Kontaktzungen von Leiterplatten nicht berühren.

Elektrische Baugruppen ohne Gehäuse

Zusätzlich zu "Elektrische Baugruppen mit Gehäuse" gilt

- Alle Personen, die elektrische Baugruppen handhaben, sowie Geräte, in die elektrische Baugruppen eingebaut werden, müssen geerdet sein.
- Baugruppen dürfen nur an den Schmalseiten oder an der Frontplatte berührt werden.
- Baugruppen immer auf geeigneten Unterlagen (ESD- Verpackung, leitfähiger Schaumstoff, etc.) ablegen. Metallische Oberflächen sind keine geeigneten Ablageflächen!
- Elektrostatische Entladungen auf die Baugruppen (z.B. durch aufgeladene Kunststoffe) sind zu vermeiden.
- Zu Monitoren oder Fernsehgeräten muss ein Mindestabstand von 10 cm eingehalten werden.
- Messgeräte und -vorrichtungen müssen geerdet werden.
- Messspitzen von potenzialfreien Messgeräten sind vor der Messung kurzzeitig an geeigneten geerdeten Oberflächen zu entladen.

Einzelbauteile

- ESD- Schutzmaßnahmen für Einzelbauteile sind bei B&R durchgängig verwirklicht (leitfähige Fußböden, Schuhe, Armbänder, etc.).
- Die erhöhten ESD- Schutzmaßnahmen für Einzelbauteile sind für das Handling von B&R Produkten bei unseren Kunden nicht erforderlich.

2.3 Vorschriften und Maßnahmen

Elektronische Geräte sind grundsätzlich nicht ausfallsicher. Bei Ausfall der Speicherprogrammierbaren Steuerung, des Bedien- oder Steuerungsgerätes bzw. einer Unterbrechungsfreien Stromversorgung ist der Anwender selbst dafür verantwortlich, dass angeschlossene Geräte, wie z.B. Motoren in einen sicheren Zustand gebracht werden.

Sowohl beim Einsatz von Speicherprogrammierbaren Steuerungen als auch beim Einsatz von Bedien- und Beobachtungsgeräten als Steuerungssystem in Verbindung mit einer Soft-PLC (z.B. B&R Automation Runtime oder vergleichbare Produkte) bzw. einer Slot-PLC (z.B. B&R LS251 oder vergleichbare Produkte) sind die für die industriellen Steuerungen geltenden Sicherheitsmaßnahmen (Absicherung durch Schutzeinrichtungen wie z.B. Not-Aus etc.) gemäß den jeweils zutreffenden nationalen bzw. internationalen Vorschriften zu beachten. Dies gilt auch für alle weiteren angeschlossenen Geräte wie z.B. Antriebe.

Alle Arbeiten wie Installation, Inbetriebnahme und Service dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal ausgeführt werden. Qualifiziertes Fachpersonal sind Personen, die mit Transport, Aufstellung, Montage, Inbetriebnahme und Betrieb des Produktes vertraut sind und über die ihrer Tätigkeit entsprechenden Qualifikationen verfügen (z. B. IEC 60364). Nationale Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten.
Die Sicherheitshinweise, die Angaben zu den Anschlussbedingungen (Typenschild und Dokumentation) und die in den technischen Daten angegebenen Grenzwerte sind vor der Installation und Inbetriebnahme sorgfältig durchzulesen und unbedingt einzuhalten.

2.4 Transport und Lagerung

Bei Transport und Lagerung müssen die Geräte vor unzulässigen Beanspruchungen (mechanische Belastung, Temperatur, Feuchtigkeit, aggressive Atmosphäre) geschützt werden.

2.5 Montage

- Die Geräte sind nicht gebrauchsfertig und müssen zur Einhaltung der EMV-Grenzwerte entsprechend den Anforderungen dieser Dokumentation montiert und verdrahtet werden.
- Die Montage muss entsprechend der Dokumentation mit geeigneten Einrichtungen und Werkzeugen erfolgen.
- Die Montage der Geräte darf nur in spannungsfreiem Zustand und durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen. Der Schaltschrank ist zuvor spannungsfrei zu schalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern.
- Die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen, sowie die national geltenden Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten.
- Die elektrische Installation ist nach den einschlägigen Vorschriften durchzuführen (z. B. Leitungsquerschnitt, Absicherung, Schutzleiteranbindung).

2.6 Betrieb

2.6.1 Schutz gegen Berühren elektrischer Teile

Zum Betrieb der Speicherprogrammierbaren Steuerungen sowie der Bedien- und Beobachtungsgeräte und der Unterbrechungsfreien Stromversorgung ist es notwendig, dass bestimmte Teile unter gefährlichen Spannungen von über 42 VDC stehen. Werden solche Teile berührt, kann es zu einem lebensgefährlichen elektrischen Schlag kommen. Es besteht die Gefahr von Tod oder schweren gesundheitlichen oder materiellen Schäden.

Vor dem Einschalten der Speicherprogrammierbaren Steuerungen, der Bedien- und Beobachtungsgeräte sowie der Unterbrechungsfreien Stromversorgung muss sichergestellt sein, dass das Gehäuse ordnungsgemäß mit Erdpotential (PE-Schiene) verbunden ist. Die Erdverbindungen müssen auch angebracht werden, wenn das Bedien- und Beobachtungsgerät sowie die Unterbrechungsfreie Stromversorgung nur für Versuchszwecke angeschlossen oder nur kurzzeitig betrieben wird!

Vor dem Einschalten sind spannungsführende Teile sicher abzudecken. Während des Betriebes müssen alle Abdeckungen geschlossen gehalten werden.

2.6.2 Umgebungsbedingungen - Staub, Feuchtigkeit, aggressive Gase

Der Einsatz von Bedien- und Beobachtungsgeräten (wie z.B. Industrie PC‘s, Power Panels, Mobile Panels usw.) und Unterbrechungsfreien Stromversorgungen in staubbelasteter Umgebung ist zu vermeiden. Es kann dabei zu Staubablagerungen kommen, die das Gerät in dessen Funktion beeinflussen, insbesondere bei Systemen mit aktiver Kühlung (Lüfter), kann dadurch u.U. keine ausreichende Kühlung mehr gewährleistet werden.

Treten in der Umgebung aggressive Gase auf, können diese ebenso zu Funktionsstörungen führen. In Verbindung mit hoher Temperatur und Luftfeuchtigkeit setzen aggressive Gase - beispielsweise mit Schwefel-, Stickstoff- und Chlorbestandteilen - chemische Prozesse in Gang, welche sehr schnell elektronische Bauteile beeinträchtigen bzw. schädigen können. Ein Anzeichen für aggressive Gase sind geschwärzte Kupferoberflächen und Kabelenden in vorhandenen Installationen.

Bei Betrieb in Räumen mit funktionsgefährdendem Staub- und Feuchtigkeitsniederschlag sind Bedien- und Beobachtungsgeräte, wie Automation Panel oder Power Panel bei vorschriftsmäßigem Einbau (z.B. Wanddurchbruch) frontseitig gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit geschützt. Rückseitig jedoch müssen alle Geräte gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit geschützt werden bzw. der Staubniederschlag ist in geeigneten Zeitabständen zu entfernen.

2.6.3 Programme, Viren und schädliche Programme

Jeder Datenaustausch bzw. jede Installation von Software mittels Datenträger (z.B. Diskette, CD-ROM, USB Memory Stick, usw.) oder über Netzwerke sowie Internet stellt eine potentielle Gefährdung für das System dar. Es liegt in der Eigenverantwortung des Anwenders diese Gefahren abzuwenden und durch entsprechende Maßnahmen wie z.B. Virenschutzprogramme, Firewalls, usw. abzusichern sowie nur Software aus vertrauenswürdigen Quellen einzusetzen.

2.7 Umweltgerechte Entsorgung

Alle speicherprogrammierbaren Steuerungen sowie die Bedien- und Beobachtungsgeräte und die Unterbrechungsfreien Stromversorgungen von B&R sind so konstruiert, dass sie die Umwelt so gering wie möglich belasten.

2.7.1 Werkstofftrennung

Damit die Geräte einem umweltgerechten Recycling-Prozess zugeführt werden können, ist es notwendig, die verschiedenen Werkstoffe voneinander zu trennen.

Bestandteil	Entsorgung
Speicherprogrammierbare Steuerungen Bedien- und Beobachtungsgeräte Unterbrechungsfreie Stromversorgung Batterien & Akkumulatoren Kabel	Elektronik Recycling
Karton/Papier Verpackung	Papier-/Kartonage Recycling
Plastik Verpackungsmaterial	Plastik Recycling

Tabelle 2: Umweltgerechte Werkstofftrennung

Die Entsorgung muss gemäß den jeweils gültigen gesetzlichen Regelungen erfolgen.

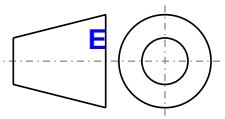
3 Gestaltung von Sicherheitshinweisen

Die Sicherheitshinweise werden im vorliegenden Handbuch wie folgt gestaltet:

Sicherheitshinweis	Beschreibung
Gefahr!	Bei Missachtung der Sicherheitsvorschriften und -hinweise besteht Todesgefahr.
Warnung!	Bei Missachtung der Sicherheitsvorschriften und -hinweise besteht die Gefahr schwerer Verletzungen oder großer Sachschäden.
Vorsicht!	Bei Missachtung der Sicherheitsvorschriften und -hinweise besteht die Gefahr von Verletzungen oder Sachschäden.
Information:	Wichtige Angaben zur Vermeidung von Fehlfunktionen.

Tabelle 3: Beschreibung der verwendeten Sicherheitshinweise

4 Richtlinien



Für alle Bemaßungszeichnungen (z.B. Abmessungszeichnungen, etc.) sind die europäischen Bemaßungsnormen gültig.

Alle Abmessungen in mm.

Sofern nicht anders angegeben, sind folgende Allgemeintoleranzen gültig:

Nennmaßbereich	Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768 mittel
bis 6 mm	± 0,1 mm
über 6 bis 30 mm	± 0,2 mm
über 30 bis 120 mm	± 0,3 mm
über 120 bis 400 mm	± 0,5 mm
über 400 bis 1000 mm	± 0,8 mm

Tabelle 4: Nennmaßbereiche

5 Übersicht

Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung	Seite
	Automation Panel Link Steckkarten	
5AC801.RDYR-00	Ready Relais für APC810	188
5AC801.SDL0-00	Smart Display Link/DVI-D Transmitter	185
	Batterien	
0AC201.91	Lithium Batterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle Hereby we declare that the Lithium cells contained in this shipmentqualify as „partly regulated“. Handle with care. If the package is damaged, inspect cells, repack intact cells and protect cells against short circuits. For emergencyinformation, call RENATA SA at + 41 61 319 28 27	343
4A0006.00-000	Lithiumbatterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle	343
	Buseinheiten	
5PC810.BX01-00	APC810 Bus, 1 PCI	104
5PC810.BX01-01	APC810 Bus, 1 PCI Express (x4)	104
5PC810.BX02-00	APC810 Bus, 2 PCI	104
5PC810.BX02-01	APC810 Bus, 1 PCI, 1 PCI Express (x4)	104
5PC810.BX03-00	APC810 Bus, 2 PCI, 1 PCI Express (x4)	104
5PC810.BX05-00	APC810 Bus, 4 PCI, 1 PCI Express (x1)	104
5PC810.BX05-01	APC810 Bus, 2 PCI, 3 PCI Express (x1)	104
5PC810.BX05-02	APC810 Bus, 5 PCI	104
	CPU Boards	
5PC800.B945-00	Intel Core Duo L2400 CPU Board, 1,66 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111B.	106
5PC800.B945-01	Intel Core2 Duo L7400 CPU Board, 1,5 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111B.	106
5PC800.B945-02	Intel Core2 Duo U7500 CPU Board, 1,06 GHz, Dual-Core, 533 MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RT-L8111B.	106
5PC800.B945-03	Intel Celeron M 423 CPU Board, 1,06 GHz, Single-Core, 533 MHz FSB, 1 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111B.	106
5PC800.B945-04	Intel Core2 Duo T7400 CPU Board, 2,16 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RT-L8111B.	106
5PC800.B945-05	Intel Atom N270 CPU Board, 1,6 GHz, Single-Core, 533 MHz FSB, 512 kByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	106
5PC800.B945-10	Intel Core Duo L2400 CPU Board, 1,66 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	106
5PC800.B945-11	Intel Core2 Duo L7400 CPU Board, 1,5 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	106
5PC800.B945-12	Intel Core2 Duo U7500 CPU Board, 1,06 GHz, Dual-Core, 533 MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RT-L8111C.	106
5PC800.B945-13	Intel Celeron M 423 CPU Board, 1,06 GHz, Single-Core, 533 MHz FSB, 1 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	106
5PC800.B945-14	Intel Core2 Duo T7400 CPU Board, 2,16 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RT-L8111C.	106
	CompactFlash	
5CFCRD.016G-06	CompactFlash 16 GByte B&R (SLC) ≤ Rev. D0	350
5CFCRD.032G-06	CompactFlash 32 GByte B&R (SLC) ≤ Rev. C0	350
5CFCRD.0512-06	CompactFlash 512 MByte B&R (SLC) ≤ Rev. E0	350
5CFCRD.1024-06	CompactFlash 1 GByte B&R (SLC) ≤ Rev. E0	350
5CFCRD.2048-06	CompactFlash 2 GByte B&R (SLC) ≤ Rev. E0	350
5CFCRD.4096-06	CompactFlash 4 GByte B&R (SLC) ≤ Rev. E0	350
5CFCRD.8192-06	CompactFlash 8 GByte B&R (SLC) ≤ Rev. E0	350
	CompactFlash-Karten	
5CFCRD.0064-03	CompactFlash 64 MByte Western Digital (SLC)	361
5CFCRD.0128-03	CompactFlash 128 MByte Western Digital (SLC)	361
5CFCRD.016G-04	CompactFlash 16 GByte B&R (SLC)	357
5CFCRD.0256-03	CompactFlash 256 MByte Western Digital (SLC)	361
5CFCRD.0512-03	CompactFlash 512 MByte Western Digital (SLC)	361
5CFCRD.0512-04	CompactFlash 512 MByte B&R (SLC)	357
5CFCRD.1024-03	CompactFlash 1 GByte Western Digital (SLC)	361
5CFCRD.1024-04	CompactFlash 1 GByte B&R (SLC)	357
5CFCRD.2048-03	CompactFlash 2 GByte Western Digital (SLC)	361
5CFCRD.2048-04	CompactFlash 2 GByte B&R (SLC)	357
5CFCRD.4096-03	CompactFlash 4 GByte Western Digital (SLC)	361
5CFCRD.4096-04	CompactFlash 4 GByte B&R (SLC)	357
5CFCRD.8192-03	CompactFlash 8 GByte Western Digital (SLC)	361
5CFCRD.8192-04	CompactFlash 8 GByte B&R (SLC)	357
	DVI-Kabel	
5CADVI.0018-00	DVI-D Kabel - 1,8 m	396
5CADVI.0050-00	DVI-D Kabel - 5 m	396
5CADVI.0100-00	DVI-D Kabel - 10 m	396
	Feldklemmen	
0TB103.9	Stecker 24 VDC - 3-polig female - Schraubklemme 3,31 mm²	345
0TB103.91	Stecker 24 VDC - 3-polig female - Federzugklemme 3,31 mm²	345

Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung	Seite
	Hauptspeicher	
5MMDDR.0512-01	SO-DIMM DDR2 RAM 512 MByte PC2-5300	111
5MMDDR.1024-01	SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MByte PC2-5300	111
5MMDDR.2048-01	SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MByte PC2-5300	111
	Kühlkörper	
5AC801.HS00-00	APC810 Kühlkörper für CPU Boards mit Dual Core Prozessoren L2400, L7400, U7500 und Celeron M 423.	109
5AC801.HS00-01	APC810 Kühlkörper für CPU Boards mit Dual Core Prozessor T7400, T9400 und P8400.	109
5AC801.HS00-02	APC810 Kühlkörper für CPU Board mit Atom Prozessor N270.	109
	Laufwerke	
5AC801.ADAS-00	SATA Hard Disk Adapter zum Betrieb einer Slide-in compact Hard Disk in einem Slide-in Slot.	152
5AC801.DVDS-00	DVD-ROM SATA Laufwerk, Slide-in.	155
5AC801.DVRS-00	DVD-R/RW DVD+R/RW SATA Laufwerk, Slide-in.	157
5AC801.HDDI-00	40 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	112
5AC801.HDDI-01	80 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.	114
5AC801.HDDI-02	160 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	116
5AC801.HDDI-03	250 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	118
5AC801.HDDI-04	500 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	120
5AC801.HDDS-00	40 GByte SATA Hard Disk, Slide-in; 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	153
5AC801.SSDI-00	32 GByte SATA SSD (SLC), Slide-in compact.	122
5AC801.SSDI-01	60 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.	126
5AC801.SSDI-02	180 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.	128
5AC801.SSDI-03	60 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.	130
5AC801.SSDI-04	128 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.	133
5AC801.SSDI-05	256 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.	136
5ACPCI.RAIC-01	PCI RAID System SATA 2x 60 GByte Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.	160
5ACPCI.RAIC-02	60 GByte SATA Hard Disk Ersatzteil für 5ACPCI.RAIC-01 Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.	163
5ACPCI.RAIC-03	PCI RAID System SATA 2x 160 GByte; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.	165
5ACPCI.RAIC-04	160 GByte SATA Hard Disk Ersatzteil für 5ACPCI.RAIC-03; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.	168
5ACPCI.RAIC-05	PCI RAID System SATA 2x 250 GByte; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	170
5ACPCI.RAIC-06	PCI RAID System 2x 500 GByte - SATA	173
5MMHDD.0250-00	250 GByte SATA Hard Disk Ersatzteil für 5AC801.HDDI-03 und 5ACPCI.RAIC-05; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	176
5MMHDD.0500-00	500 GByte Hard Disk - SATA	178
5MMSSD.0060-00	60 GByte SSD MLC - Intel - SATA	139
5MMSSD.0060-01	60 GByte SSD MLC - Intel - SATA	141
5MMSSD.0128-01	128 GByte SSD MLC - Toshiba - SATA	144
5MMSSD.0180-00	180 GByte SSD MLC - Intel - SATA	147
5MMSSD.0256-00	256 GByte SSD MLC - Toshiba - SATA	149
	Lüfter Kit	
5PC810.FA01-00	APC810 Lüfterkit für Systemeinheit 5PC810.SX01-00.	180
5PC810.FA02-00	APC810 Lüfterkit für Systemeinheit 5PC810.SX02-00	181
5PC810.FA02-01	APC810 Lüfterkit für Systemeinheit 5PC810.SX02-00 ab Revision D0.	181
5PC810.FA03-00	APC810 Lüfterkit für Systemeinheit 5PC810.SX03-00.	183
5PC810.FA05-00	APC810 Lüfterkit für Systemeinheit 5PC810.SX05-00.	184
	MS-DOS	
9S0000.01-010	OEM Microsoft MS-DOS 6.22, Deutsch Disketten, Lieferung nur in Verbindung mit einem neuen PC.	300
9S0000.01-020	OEM Microsoft MS-DOS 6.22, Englisch Disketten, Lieferung nur in Verbindung mit einem neuen PC.	300
	RS232-Kabel	
9A0014.02	RS232 Verlängerungskabel zum Betrieb einer abgesetzten Displayeinheit mit Touch Screen, 1,8 m.	413
9A0014.05	RS232 Verlängerungskabel zum Betrieb einer abgesetzten Displayeinheit mit Touch Screen, 5 m.	413
9A0014.10	RS232 Verlängerungskabel zum Betrieb einer abgesetzten Displayeinheit mit Touch Screen, 10 m.	413
	SDL-Kabel	
5CASDL.0008-00	SDL Kabel - 0,8 m	399
5CASDL.0018-00	SDL Kabel - 1,8 m	399
5CASDL.0050-00	SDL Kabel - 5 m	399
5CASDL.0100-00	SDL Kabel - 10 m	399
5CASDL.0150-00	SDL Kabel - 15 m	399
5CASDL.0200-00	SDL Kabel - 20 m	399
5CASDL.0250-00	SDL Kabel - 25 m	399
5CASDL.0300-00	SDL Kabel - 30 m	399
	SDL-Kabel 45°-Anschluss	
5CASDL.0018-01	SDL Kabel - 45 Grad Anschluss - 1,8 m	402
5CASDL.0050-01	SDL Kabel - 45 Grad Anschluss - 5 m	402
5CASDL.0100-01	SDL Kabel - 45 Grad Anschluss - 10 m	402
5CASDL.0150-01	SDL Kabel - 45 Grad Anschluss - 15 m	402
	SDL-Kabel flex	
5CASDL.0018-03	SDL Kabel flex - 1,8 m	405
5CASDL.0050-03	SDL Kabel flex - 5 m	405

Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung	Seite
5CASDL.0100-03	SDL Kabel flex - 10 m	405
5CASDL.0150-03	SDL Kabel flex - 15 m	405
5CASDL.0200-03	SDL Kabel flex - 20 m	405
5CASDL.0250-03	SDL Kabel flex - 25 m	405
5CASDL.0300-03	SDL Kabel flex - 30 m	405
5CASDL.0300-13	SDL Kabel flex mit Extender - 30 m	408
5CASDL.0400-13	SDL Kabel flex mit Extender - 40 m	408
5CASDL.0430-13	SDL Kabel flex mit Extender - 43 m	408
	Serialadapter	
5AC600.485I-00	RS232/422/485 Interface; zum Einbau in einen APC620, APC810 oder PPC700.	194
5AC600.CANI-00	CAN Interface; Zum Einbau in einen APC620, APC810 oder PPC700.	191
	Sonstiges	
5AC900.1000-00	Adapter DVI (Stift) auf CRT (Buchse). Zum Anschluss eines Standard-Monitors an eine DVI-I Schnittstelle.	347
	Systemeinheiten	
5PC810.SX01-00	APC810 Systemeinheit 1 Slot (PCI Express, PCI, abhängig vom Bus); 1 Slide-in compact Steckplatz; Smart Display Link/DVI/Monitor, 2x RS232, 5x USB 2.0, 2x ETH 10/100/1000, 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzug- klemme 0TB103.91 gesondert bestellen)	76
5PC810.SX02-00	APC810 Systemeinheit 2 Slots (PCI Ex- press, PCI, abhängig vom Bus); 1 Slot für Automation Panel Link Transmitter; 1 Slide-in compact und 1 Slide-in Steckplatz; Smart Display Link/ DVI/Monitor, 2x RS232, 5x USB 2.0, 2x ETH 10/100/1000, 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Feder- zugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen)	83
5PC810.SX03-00	APC810 Systemeinheit 3 Slots (PCI Ex- press, PCI, abhängig vom Bus); 1 Slot für Automation Panel Link Transmitter; 1 Slide-in compact und 1 Slide-in Steckplatz; Smart Display Link/DVI/Monitor, 2x RS232, 5x USB 2.0, 2x ETH 10/100/1000, AC97 Sound, 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen)	90
5PC810.SX05-00	APC810 Systemeinheit 5 Slots (PCI Ex- press, PCI, abhängig vom Bus); 1 Slot für Automation Panel Link Transmitter; 1 Slide-in compact und 2 Slide-in Steckplätze; Smart Display Link/DVI/ Monitor, 2x RS232, 5x USB 2.0, 2x ETH 10/100/1000, 24 VDC Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzug- klemme 0TB103.91 gesondert bestellen)	97
	Technology Guard	
0TG1000.01	Technology Guard (MSD) wird in der USB Geräteklasse MSD (Mass Storage Device) zur Verfügung gestellt	317
0TG1000.02	Technology Guard (HID) wird in der USB Geräteklasse HID (Human Interface Device) zur Verfügung gestellt, Automation Runtime unterstützt HID ab der Version D4.09.	317
1TG4600.10-5	Automation Runtime Windows TG Lizenz	317
1TG4601.06-5	Automation Runtime Embedded TG Lizenz	317
	USB Zubehör	
5A5003.03	Frontklappe für Laufwerke - 5A5003.02 - 5MD900.USB2	374
5MD900.USB2-01	USB 2.0 Laufwerkskombination, bestehend aus DVD-R/RW DVD+R/RW, FDD, CompactFlash Slot (Typ II), USB Anschluss (Typ A frontseitig, Typ B rückseitig); 24 VDC, (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen)	365
5MD900.USB2-02	USB 2.0 Laufwerkskombination - DVD-R/RW DVD+R/RW - CompactFlash Slot	370
5MMUSB.2048-00	USB 2.0 Memory Stick, 2048 MByte	376
5MMUSB.2048-01	USB 2.0 Memory Stick, 2048 MByte, B&R	378
5MMUSB.4096-01	USB 2.0 Memory Stick, 4096 MByte, B&R	378
	USB-Kabel	
5CAUSB.0018-00	USB 2.0 Verbindungskabel - Typ A - Typ B Stecker - 1,8 m	412
5CAUSB.0050-00	USB 2.0 Verbindungskabel - Typ A - Typ B Stecker - 5 m	412
	Unterbrechungsfreie Stromversorgung	
5AC600.UPSB-00	Batterieeinheit 5Ah; für APC620, APC810 oder PPC800 USV.	383
5AC600.UPSF-00	USV Sicherungs Kit für Batterieeinheit 5AC600.UPSB-00 bis Revision D0.	387
5AC600.UPSF-01	USV Sicherung, 5 Stück	387
5AC600.UPSI-00	USV Modul für APC620, APC810, PPC800; für Systemeinheiten 5PC600.SX01-00 (ab Rev. H0), 5PC600.SX02-00 (ab Rev. G0), 5PC600.SX02-01 (ab Rev. H0), 5PC600.SX05-00 (ab Rev. F0), 5PC600.SX05-01 (ab Rev. F0), 5PC600.SF03-00 (ab Rev. A0), 5PC810.SX*. 5PC820.1505-00, 5PC820.1906-00. Kabel (5CAUPS.0005-00 bzw. 5CAUPS.0030-00) und Batterieeinheit (5AC600.UPSB-00) sind separat zu bestellen.	381
5CAUPS.0005-00	USV Kabel 0,5 m; für USV 5AC600.UPSI-00.	386
5CAUPS.0030-00	USV Kabel - 3 m. - Für 5AC600.IUPS-00	386
	Windows 7 Professional/Ultimate	
5SWWI7.0100-ENG	Windows 7 Professional - 32-Bit - Englisch - DVD	305
5SWWI7.0100-GER	Windows 7 Professional - 32-Bit - Deutsch - DVD	305
5SWWI7.0200-ENG	Windows 7 Professional - 64-Bit - Englisch - DVD	305
5SWWI7.0200-GER	Windows 7 Professional - 64-Bit - Deutsch - DVD	305
5SWWI7.0300-MUL	Windows 7 Professional - 32-Bit - Multilanguage - DVD	305
5SWWI7.0400-MUL	Windows 7 Ultimate - 64-Bit - Multilanguage - DVD	305
5SWWI7.1100-ENG	Windows 7 Professional SP1 - 32-Bit - Englisch - DVD	305
5SWWI7.1100-GER	Windows 7 Professional SP1 - 32-Bit - Deutsch - DVD	305
5SWWI7.1200-ENG	Windows 7 Professional SP1 - 64-Bit - Englisch - DVD	305
5SWWI7.1200-GER	Windows 7 Professional SP1 - 64-Bit - Deutsch - DVD	305
5SWWI7.1300-MUL	Windows 7 Ultimate SP1 - 32-Bit - Multilanguage - DVD	305
5SWWI7.1400-MUL	Windows 7 Ultimate SP1 - 64-Bit - Multilanguage - DVD	305
	Windows CE 6.0	
5SWWCE.0826-ENG	Microsoft OEM Windows CE 6.0 Professional, Englisch; für APC810 mit 945GME Chipsatz; CompactFlash separat bestellen (mind. 128 MByte).	315
	Windows Embedded Standard 2009	
5SWWXP.0726-ENG	Microsoft OEM Windows Embedded Standard 2009, Englisch; für APC810 mit 945GME Chipsatz; Compact-Flash separat bestellen (mind. 1 GByte).	310

Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung	Seite
	Windows Embedded Standard 7	
5SWWI7.1526-ENG	Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 32-Bit, Service Pack 1, Englisch; für APC810 mit 945GME Chipsatz; CompactFlash separat bestellen (mind. 16 GByte).	312
5SWWI7.1626-ENG	Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 64-Bit, Service Pack 1, Englisch; für APC810 mit 945GME Chipsatz; CompactFlash separat bestellen (mind. 16 GByte).	312
5SWWI7.1726-MUL	Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 Premium 32-Bit, Service Pack 1, Multilanguage; für APC810 mit 945GME Chipsatz; CompactFlash separat bestellen (mind. 16 GByte).	312
5SWWI7.1826-MUL	Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 Premium 64-Bit, Service Pack 1, Multilanguage; für APC810 mit 945GME Chipsatz; CompactFlash separat bestellen (mind. 16 GByte).	312
	Windows XP Embedded	
5SWWXP.0426-ENG	Microsoft OEM Windows XP Embedded Feature Pack 2007, Englisch; für APC810 mit 945GME Chipsatz; CompactFlash separat bestellen (mind. 512 MByte).	308
	Windows XP Professional	
5SWWXP.0500-ENG	Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 2c, CD, Englisch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	301
5SWWXP.0500-GER	Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 2c, CD, Deutsch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	301
5SWWXP.0500-MUL	Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 2c, CD, Multilanguage. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	301
5SWWXP.0600-ENG	Windows XP Professional SP3 - Englisch - CD	301
5SWWXP.0600-GER	Windows XP Professional SP3 - Deutsch - CD	301
5SWWXP.0600-MUL	Windows XP Professional SP3 - Multilanguage - CD	301
	Zubehör	
5AC801.FA01-00	APC810 Ersatz Lüfterfilter für 5PC810.SX01-00; 5 Stk.	346
5AC801.FA02-00	APC810 Ersatz Lüfterfilter für 5PC810.SX02-00; 5 Stk.	346
5AC801.FA03-00	APC810 Ersatz Lüfterfilter für 5PC810.SX03-00; 5 Stk.	346
5AC801.FA05-00	APC810 Ersatz Lüfterfilter für 5PC810.SX05-00; 5 Stk.	346
5AC801.FRAM-00	APC810 SATA Hard Disk Ersatzablage	416
5AC801.RDYR-01	Ready Relais für APC810 für die Montage an einem Add-on USV Steckplatz	189
5AC804.MFLT-00	Netzfilter	388
5ACPCI.ETH1-01	PCI Ethernet Card 1x 10/100	390
5ACPCI.ETH3-01	PCI Ethernet Card 3x 10/100	393
5CAMSC.0001-00	Versorgungskabel intern	415
5SWUTI.0001-000	HMI Service Center USB Stick - Hardwarediagnosesoftware - Für APC810/PPC800 - Für APC910/PPC900 - Für APC2100/PPC2100 - Für APC51x/PP500 - Für Automation Panel 800/900	336

Kapitel 2 • Technische Daten

1 Einleitung

Der APC810 ist die konsequente Weiterentwicklung der APC620 Produktreihe. Basierend auf neuester Intel® Core™2 Duo Technologie bietet der APC810 höchste Performance für alle Anwendungen, bei denen es auf maximale Rechenleistung ankommt.

Der APC810 spart Platz im Schaltschrank. Frontseitig verbergen sich geschützt hinter einer Klappe Einschübe für Laufwerke (DVD, Hard Disk) sowie zwei CompactFlash Slots. Durch die modulare Einschubtechnik können die Laufwerke sehr einfach vom Anwender getauscht werden. Alle Anschlüsse und Schnittstellen sind auf der Gehäuseoberseite angeordnet. Die Bautiefe wird nicht durch hervorstehende Stecker vergrößert. Der APC810 bietet mit den unterschiedlichen Baugrößen mit einem, zwei, drei oder fünf Card Slots (für PCI bzw. PCI Express Steckkarten) die optimale Bauform für jede Einbausituation - passgenau und ohne kostbaren Platz im Schaltschrank zu verschwenden.

1.1 Features

- Neueste Prozessortechnologien - Core Duo, Core 2 Duo, Celeron M und Atom N270
- Bis zu 3 GB Hauptspeicher (Dual Channel Memory Support)
- 2 CompactFlash Steckplätze (Typ I)
- 1, 2, 3 oder 5 Card Slot Steckplätze (für PCI / PCI Express (PCIe) Karten)
- SATA Laufwerke (Slide-in bzw. Slide-in compact Steckplätze)
- 5x USB 2.0
- 2x Ethernet 10/100/1000 MBit Schnittstellen
- 2x RS232 Schnittstelle, modemfähig
- 24 VDC Versorgungsspannung
- Lüfterloser Betrieb[1)]
- BIOS (AMI)
- Echtzeituhr, RTC (batteriegepuffert)
- SRAM 512 kByte (batteriegepuffert)
- Anschluss verschiedenster Anzeigegeräte am „Monitor/Panel“ Videoausgang (Unterstützung von RGB, DVI und SDL - Smart Display Link - Signalen)
- 2’ter Grafikstrang mit Einbau der optionalen AP Link Steckkarte
- Einfacher Slide-in Laufwerkstausch (SATA Hot Plug fähig)
- Optionaler Einbau des Add-on USV Modules
- Optionale CAN Schnittstelle
- Optionale RS232/422/485 Schnittstelle
- Optionaler RAID Controller (benötigt einen freien PCI Slot)

1.2 Aufbau / Konfiguration

Es ist möglich das APC810 System individuell, je nach Einsatzbedingungen und Anforderungen zusammenzustellen.

Für den Betrieb sind folgende Einzelkomponenten zwingend erforderlich:

- Systemeinheit
- Buseinheit
- CPU Board
- Kühlkörper
- Hauptspeicher
- Laufwerk (Massenspeicher wie z.B. CompactFlash Karte oder Hard Disk) für das Betriebssystem
- Software

1) Abhängig von der Gerätezusammenstellung und der Umgebungstemperatur.

1.3 Konfiguration - Grundsystem

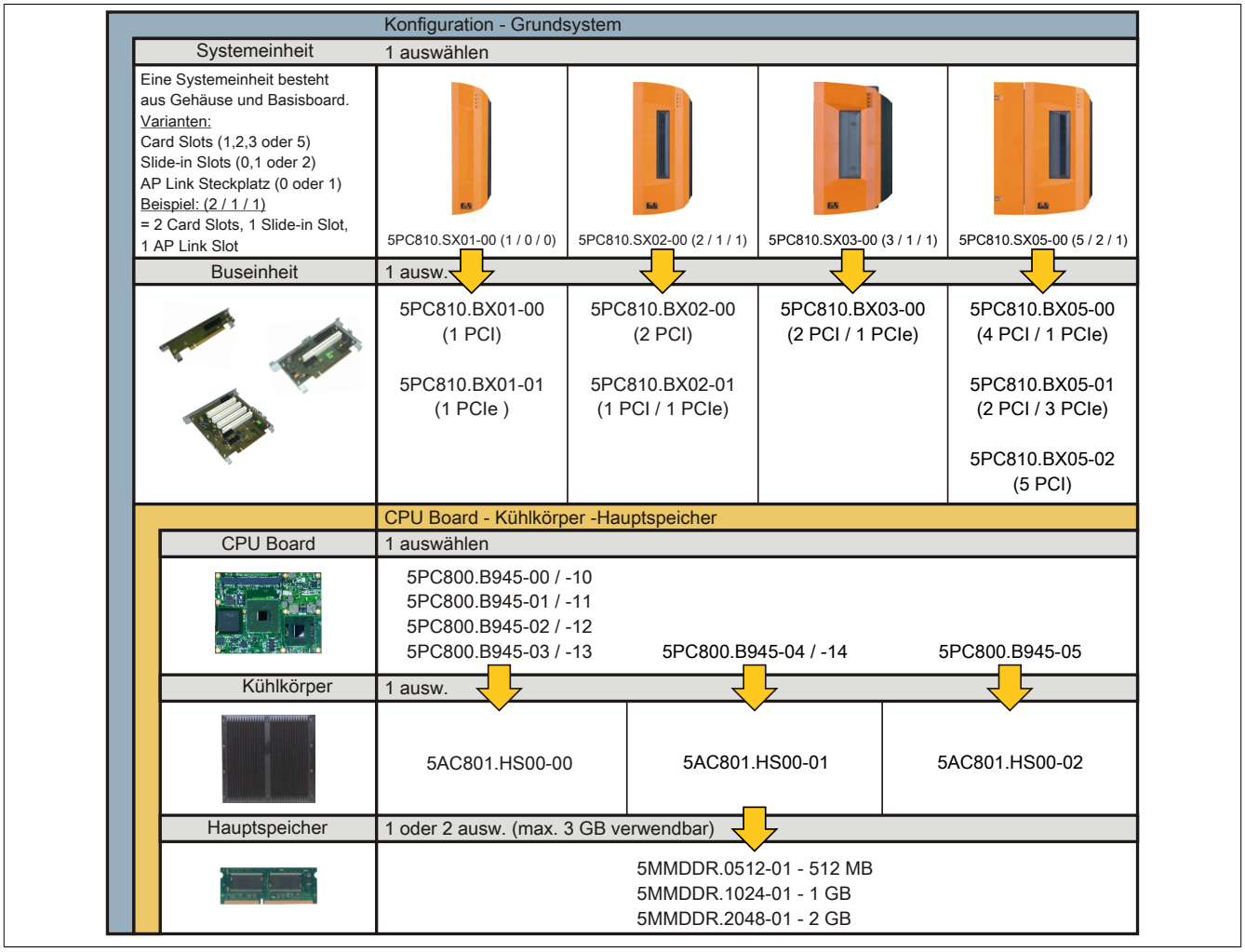


Abbildung 1: Konfiguration - Grundsystem

1.4 Konfiguration - optionale Komponenten

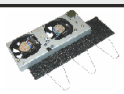
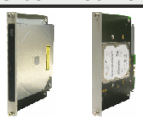
Konfiguration - Laufwerke, Software, Zubehör				
Systemeinheiten	1 auswählen			
Eine Systemeinheit besteht aus Gehäuse und Basisboard. Varianten: Card Slots (1,2,3 oder 5) Slide-in Slots (0,1 oder 2) AP Link Steckplatz (0 oder 1) Beispiel: (2 / 1 / 1) = 2 Card Slots, 1 Slide-in Slot, 1 AP Link Slot	 5PC810.SX01-00 (1 / 0 / 0)	 5PC810.SX02-00 (2 / 1 / 1)	 5PC810.SX03-00 (3 / 1 / 1)	 5PC810.SX05-00 (5 / 2 / 1)
Lüfter Kit	1 auswählen			
	5PC801.FA01-00	5PC801.FA02-01	5PC801.FA03-00	5PC801.FA05-00
Slide-in compact Laufwerk	1 auswählen			
	5AC801.HDDI-00 (40 GByte) 5AC801.HDDI-04 (500 GByte)		5AC801.SSDI-03 (60 GByte) 5AC801.SSDI-04 (128 GByte) 5AC801.SSDI-05 (256 GByte)	
CompactFlash	1 oder 2 auswählen			
	5CFCRD.0512-06, 5CFCRD.1024-06, 5CFCRD.2048-06, 5CFCRD.4096-06, 5CFCRD.8192-06, 5CFCRD.016G-06, 5CFCRD.032G-06		5CFCRD.0064-03, 5CFCRD.0128-03, 5CFCRD.0256-03, 5CFCRD.0512-03, 5CFCRD.1024-03, 5CFCRD.2048-03, 5CFCRD.4096-03, 5CFCRD.8192-03	
Slide-in Laufwerk	nicht möglich	1 möglich		2 möglich
		5AC801.HDDS-00 (40 GByte) 5AC801.DVDS- (DVD Laufwerk) 5AC801.ADAS-00 (Adapter) 5AC801.DVRS-00 (DVD Brenner)		
AP Link Steckkarte		1 auswählen		
		5AC801.SDL0-00 (für 2'ten Grafikstrang) 5AC801.RDYR-00 (Ready Relais)		
RAID System	1 auswählen			
	5ACPCI.RAIC-06 (2x 500 GByte, belegt 1 PCI Slot) 5MMHDD.0500-00 (Ersatz SATA-HDD 500 GByte)			
Schnittstellenoption	1 auswählen			
	5AC600.CANI-00 (CAN) 5AC600.485I-00 (kombinierte RS232/RS422/RS485)			
USV Modul + Batterie	1 auswählen			
	5AC600.UPSI-00 (Add-on USV Modul) + 5AC600.UPSB-00 (USV Batterieeinheit) Verbindungskabel: 5CAUPS.0005-00 (0,5 Meter) oder 5CAUPS.0030-00 (3 Meter)			
Feldklemmen	1 auswählen			
	0TB103.9 (Schraubklemme) 0TB103.91 (Federzugklemme)			
Software	1 auswählen			
Windows xp, Windows 7, Windows xp Embedded, Windows Embedded Standard 2009, Windows Embedded Standard 7, Windows CE, Automation Runtime	**Windows XP** 5SWWXP.0500-ENG 5SWWXP.0500-GER 5SWWXP.0500-MUL 5SWWXP.0600-ENG 5SWWXP.0600-GER 5SWWXP.0600-MUL **Windows CE** 5SWWCE.0826-ENG **Windows 7** 5SWWI7.1200-ENG 5SWWI7.1200-GER 5SWWI7.1400-MUL	**Windows Embedded Standard 2009** 5SWWXP.0726-ENG **Windows Embedded Standard 7** 5SWWI7.1526-ENG 5SWWI7.1626-ENG 5SWWI7.1726-MUL 5SWWI7.1826-MUL **Windows XP Embedded** 5SWWXP.0426-ENG 5SWWI7.1100-ENG 5SWWI7.1100-GER 5SWWI7.1300-MUL	**Automation Runtime** 1TG4600.10-5 1TG4601.06-5 0TG1000.01 0TG1000.02 **Microsoft DOS** 9S0000.01-010 9S0000.01-020	

Abbildung 2: Konfiguration - optionale Komponenten

2 Gesamtgerät

2.1 Temperaturangaben

Aufgrund der Möglichkeit, CPU Boards mit verschiedensten Komponenten wie Laufwerke, Hauptspeicher, Zusatzsteckkarten, usw. in Abhängigkeit von Systemeinheit und Lüfter Kit zu kombinieren, bieten die nachfolgenden Tabellen bedingt durch diese Komponenten, einen Überblick zur Bestimmung der aus diesem Zusammenspiel resultierenden, maximal möglichen Umgebungstemperaturen.

Information:

Die maximal angegebenen Umgebungstemperaturen wurden unter worst-case Bedingungen für den Betrieb mit und ohne Lüfter Kit ermittelt. Erfahrungswerte zeigen, dass bei typischen Anwendungen unter z.B. Microsoft Windows höhere Umgebungstemperaturen erzielt werden können. Die diesbezügliche Prüfung und Bewertung hat individuell vom Anwender vor Ort zu erfolgen (Auslesen der Temperaturen im BIOS oder mittels B&R Control Center).

Information zu den worst-case Bedingungen

- Thermal Analysis Tool (TAT V2.02) von Intel zur Simulation von 100% Prozessorauslastung
- BurnIn Testtool (BurnIn V4.0 Pro von Passmark Software) zur Simulation der 100%igen Schnittstellenauslastung mittels Loopback Adaptern (Serielle Schnittstellen, Add-on und Slide-in Laufwerke, USB Schnittstellen, Audioausgänge)
- Maximaler Ausbau und Leistungsverbrauch des Systems

Was muss bei der Ermittlung der maximalen Umgebungstemperatur beachtet werden?

- Betrieb der Ethernetschnittstellen (ETH1/ETH2) im 10/100 MBit oder 1 GBit Modus
- Betrieb des Gesamtgerätes mit oder ohne Lüfter Kit
- Revision des verwendeten Kühlkörpers

2.1.1 Maximale Umgebungstemperatur

2.1.1.1 Maximale Umgebungstemperatur ohne Lüfter Kit

Information:

- **Unterscheidung der ETH2 Schnittstelle in bis 100 MBit bzw. bis 1 GBit Betrieb**
- **Betrieb ohne Lüfter Kit ist NUR in senkrechter Einbaulage erlaubt (siehe "Einbaulagen" auf Seite 198).**
- **Die Angaben in der folgenden Tabelle gelten nur für Systemeinheiten mit den Kühlkörpern 5AC801.HS00-00 < Rev. D0 und 5AC801.HS00-01 < Rev. D0.**

	Alle Temperaturangaben in Grad Celsius (°C) bei 500 m ü. NN. Herabsenkung (Derating) der maximalen Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 m ü. NN.	ETH1: bis 100 MBit Betrieb ETH2: bis 100 MBit Betrieb						ETH1: bis 100 MBit Betrieb ETH2: bis 1 GBit Betrieb							
		L2400 5PC800.B945-00	L7400 5PC800.B945-01	U7500 5PC800.B945-02	M 423 5PC800.B945-03	T7400 5PC800.B945-04		L2400 5PC800.B945-00	L7400 5PC800.B945-01	U7500 5PC800.B945-02	M 423 5PC800.B945-03	T7400 5PC800.B945-04		Temperaturgrenzen	Sensor(en) im Bereich
	Maximale Umgebungstemperatur	**35**	**35**	**35**	**45**	**-**		**30**	**30**	**30**	**40**	**-**			
	Was kann noch bei max. Umgebungstemperatur betrieben werden, oder gibt es eine Einschränkung?														
Slide-in compact Laufwerke	On-Board CompactFlash[1)]	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			80	I/O
	5AC801.HDDI-00	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			80	
	5AC801.HDDI-01	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			80	
	5AC801.HDDI-02	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			80	
	5AC801.HDDI-03	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			60	
	5AC801.HDDI-04	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			60	
	5AC801.SSDI-00	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			70	
	5AC801.SSDI-01	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			70	
	5AC801.SSDI-02	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			70	
	5AC801.SSDI-03 ≤ Rev. C0	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			70	
	5AC801.SSDI-03 ≥ Rev. D0	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			80	
	5AC801.SSDI-04 ≤ Rev. C0	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			70	
	5AC801.SSDI-04 ≥ Rev. D0	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			80	
	5AC801.SSDI-05	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			80	
Slide-in Laufwerke	5AC801.HDDS-00	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			80	Slide-in Laufwerk
	5AC801.DVDS-00	✓	✓	✓	40			✓	✓	✓	✓			50	
	5AC801.DVRS-00	✓	✓	✓	40			✓	✓	✓	✓			50	
Hauptspeicher	5MMDDR.0512-01	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			-	-
	5MMDDR.1024-01	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			-	
	5MMDDR.2048-01	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			-	
Systemeinheiten	5PC810.SX01-00	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			80	Netzteil
	5PC810.SX02-00	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			80	
	5PC810.SX03-00	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			80	
	5PC810.SX05-00	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			80	
Zusatzsteckkarten Schnittstellen / AP Link	5AC600.CANI-00	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			-	-
	5AC600.485I-00	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			-	
	5AC801.SDL0-00	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			-	
	5AC801.RDYR-00	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			-	
	5ACPCI.RAIC-01 (24 Stunden/ Standard)	30/ ✓	30/ ✓	30/ ✓	30/ 40			✓	✓	✓	30/ ✓			-	
	5ACPCI.RAIC-03 (24 Stunden/ Standard)	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			-	
	5ACPCI.RAIC-05 (24 Stunden/ Standard)	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			-	
	5ACPCI.RAIC-06 (24 Stunden/ Standard)	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			-	

1) Nur in Verbindung mit einer bei B&R erhältlichen und mit dem Gerät kompatiblen CompactFlash Karte möglich.

Tabelle 5: Umgebungstemperatur ohne Lüfter

Information:

- **Unterscheidung zwischen bis 100 MBit und bis 1 GBit Betrieb von ETH1 und ETH2.**
- **Betrieb ohne Lüfter Kit ist NUR in senkrechter Einbaulage erlaubt (siehe "Einbaulagen" auf Seite 198).**
- **Die Angaben in der folgenden Tabelle gelten nur für Systemeinheiten mit den Kühlkörpern 5AC801.HS00-00 ≥ Rev. D0 und 5AC801.HS00-01 ≥ Rev. D0.**

	Alle Temperaturangaben in Grad Celsius (°C) bei 500 m ü. NN. Herabsenkung (Derating) der maximalen Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 m ü. NN.	ETH1: bis 100 MBit Betrieb ETH2: bis 100 MBit Betrieb						ETH1: bis 100 MBit Betrieb ETH2: bis 1 GBit Betrieb							
		L2400 5PC800.B945-00	L7400 5PC800.B945-01	U7500 5PC800.B945-02	M 423 5PC800.B945-03	T7400 5PC800.B945-04		L2400 5PC800.B945-00	L7400 5PC800.B945-01	U7500 5PC800.B945-02	M 423 5PC800.B945-03	T7400 5PC800.B945-04		Temperaturgrenzen	Sensor(en) im Bereich
	Maximale Umgebungstemperatur	**35**	**35**	**45**	**45**	**-**		**30**	**30**	**40**	**40**	**-**			
	Was kann noch bei max. Umgebungstemperatur betrieben werden, oder gibt es eine Einschränkung?														
Slide-in compact Laufwerke	On-Board CompactFlash[1)]	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			80	I/O
	5AC801.HDDI-00	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			80	
	5AC801.HDDI-01	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			80	
	5AC801.HDDI-02	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			80	
	5AC801.HDDI-03	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			60	
	5AC801.HDDI-04	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			60	
	5AC801.SSDI-00	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			70	
	5AC801.SSDI-01	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			70	
	5AC801.SSDI-02	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			70	
	5AC801.SSDI-03 ≤ Rev. C0	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			70	
	5AC801.SSDI-03 ≥ Rev. D0	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			80	
	5AC801.SSDI-04 ≤ Rev. C0	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			70	
	5AC801.SSDI-04 ≥ Rev. D0	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			80	
	5AC801.SSDI-05	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			80	
Slide-in Laufwerke	5AC801.HDDS-00	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			80	Slide-in Laufwerk
	5AC801.DVDS-00	✓	✓	40	40			✓	✓	✓	✓			50	
	5AC801.DVRS-00	✓	✓	40	40			✓	✓	✓	✓			50	
Hauptspeicher	5MMDDR.0512-01	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			-	-
	5MMDDR.1024-01	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			-	
	5MMDDR.2048-01	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			-	
Systemeinheiten	5PC810.SX01-00	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			80	Netzteil
	5PC810.SX02-00	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			80	
	5PC810.SX03-00	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			80	
	5PC810.SX05-00	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			80	
Zusatzsteckkarten Schnittstellen / AP Link	5AC600.CANI-00	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			-	-
	5AC600.485I-00	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			-	
	5AC801.SDL0-00	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			-	
	5AC801.RDYR-00	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			-	
	5ACPCI.RAIC-01 (24 Stunden/ Standard)	30/ ✓	30/ ✓	30/ ✓	30/ 40			✓	✓	✓	30/ ✓			-	
	5ACPCI.RAIC-03 (24 Stunden/ Standard)	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			-	
	5ACPCI.RAIC-05 (24 Stunden/ Standard)	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			-	
	5ACPCI.RAIC-06 (24 Stunden/ Standard)	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			-	

1) Nur in Verbindung mit einer bei B&R erhältlichen und mit dem Gerät kompatiblen CompactFlash Karte möglich.

Tabelle 6: Umgebungstemperatur ohne Lüfter

Information:

- **KEINE Unterscheidung zwischen bis 100 MBit und bis 1 GBit Betrieb von ETH1 und ETH2.**
- **Betrieb ohne Lüfter Kit ist NUR in senkrechter Einbaulage erlaubt (1.3 "Einbaulagen" auf Seite 198).**
- **Die Angaben in der folgenden Tabelle gelten nur für Systemeinheiten mit den Kühlkörpern 5AC801.HS00-00 ≥ Rev. D0 und 5AC801.HS00-01 ≥ Rev. D0 und das CPU Board 5PC800.B945-05 mit Kühlkörper 5AC801.HS00-02.**

	Alle Temperaturangaben in Grad Celsius (°C) bei 500 m ü. NN. Herabsenkung (Derating) der maximalen Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 m ü. NN.	L2400 5PC800.B945-10	L7400 5PC800.B945-11	U7500 5PC800.B945-12	M 423 5PC800.B945-13	T7400 5PC800.B945-14	N270 5PC800.B945-05	Temperaturgrenzen	Sensor(en) im Bereich
	Maximale Umgebungstemperatur	**35**	**35**	**45**	**45**	**-**	**50**		
	Was kann noch bei max. Umgebungstemperatur betrieben werden, oder gibt es eine Einschränkung?								
Slide-in compact Laufwerke	On-Board CompactFlash[1)]	✓	✓	✓	✓		✓	80	I/O
	5AC801.HDDI-00	✓	✓	✓	✓		✓	80	
	5AC801.HDDI-01	✓	✓	✓	✓		✓	80	
	5AC801.HDDI-02	✓	✓	✓	✓		✓	80	
	5AC801.HDDI-03	✓	✓	✓	✓		45	60	
	5AC801.HDDI-04	✓	✓	✓	✓		45	60	
	5AC801.SSDI-00	✓	✓	✓	✓		✓	70	
	5AC801.SSDI-01	✓	✓	✓	✓		✓	70	
	5AC801.SSDI-02	✓	✓	✓	✓		✓	70	
	5AC801.SSDI-03 ≤ Rev. C0	✓	✓	✓	✓		✓	70	
	5AC801.SSDI-03 ≥ Rev. D0	✓	✓	✓	✓		✓	80	
	5AC801.SSDI-04 ≤ Rev. C0	✓	✓	✓	✓		✓	70	
	5AC801.SSDI-04 ≥ Rev. D0	✓	✓	✓	✓		✓	80	
	5AC801.SSDI-05	✓	✓	✓	✓		✓	80	
Slide-in Laufwerke	5AC801.HDDS-00	✓	✓	✓	✓		✓	80	Slide-in Laufwerk
	5AC801.DVDS-00	✓	✓	40	40		40	50	
	5AC801.DVRS-00	✓	✓	40	40		40	50	
Hauptspeicher	5MMDDR.0512-01	✓	✓	✓	✓		✓	-	-
	5MMDDR.1024-01	✓	✓	✓	✓		✓	-	
	5MMDDR.2048-01	✓	✓	✓	✓		✓	-	
Systemeinheiten	5PC810.SX01-00	✓	✓	✓	✓		✓	80	Netzteil
	5PC810.SX02-00	✓	✓	✓	✓		✓	80	
	5PC810.SX03-00	✓	✓	✓	✓		✓	80	
	5PC810.SX05-00	✓	✓	✓	✓		✓	80	
Zusatzsteckkarten Schnittstellen / AP Link	5AC600.CANI-00	✓	✓	✓	✓		✓	-	-
	5AC600.485I-00	✓	✓	✓	✓		✓	-	
	5AC801.SDL0-00	✓	✓	✓	✓		✓	-	
	5AC801.RDYR-00	✓	✓	✓	✓		✓	-	
	5ACPCI.RAIC-01 (24 Stunden/ Standard)	30/✓	30/✓	30/✓	30/ 40		30/ 40	-	
	5ACPCI.RAIC-03 (24 Stunden/ Standard)	✓	✓	✓	✓		✓	-	
	5ACPCI.RAIC-05 (24 Stunden/ Standard)	✓	✓	✓	✓		45	-	
	5ACPCI.RAIC-06 (24 Stunden/ Standard)	✓	✓	✓	✓		45	-	

1) Nur in Verbindung mit einer bei B&R erhältlichen und mit dem Gerät kompatiblen CompactFlash Karte möglich.

Tabelle 7: Umgebungstemperatur ohne Lüfter

2.1.1.2 Maximale Umgebungstemperatur mit Lüfter Kit

Information:

- **Unterscheidung zwischen bis 100 MBit und bis 1 GBit Betrieb von ETH1 und ETH2.**
- **Senkrechte wie auch waagrechte (minus 5°C) Einbaulage erlaubt (siehe "Einbaulagen" auf Seite 198).**

		ETH1: bis 100 MBit Betrieb ETH2: bis 100 MBit Betrieb						ETH1: bis 100 MBit Betrieb ETH2: bis 1 GBit Betrieb							
	Alle Temperaturangaben in Grad Celsius (°C) bei 500 m ü. NN. Herabsenkung (Derating) der maximalen Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 m ü. NN.	L2400 5PC800.B945-00	L7400 5PC800.B945-01	U7500 5PC800.B945-02	M 423 5PC800.B945-03	T7400 5PC800.B945-04		L2400 5PC800.B945-00	L7400 5PC800.B945-01	U7500 5PC800.B945-02	M 423 5PC800.B945-03	T7400 5PC800.B945-04		Temperaturgrenzen	Sensor(en) im Bereich
	Maximale Umgebungstemperatur	**55**	**55**	**55**	**55**	**55**		**50**	**50**	**50**	**50**	**45**			
	Was kann noch bei max. Umgebungstemperatur betrieben werden, oder gibt es eine Einschränkung?														
Slide-in compact Laufwerke	On-Board CompactFlash[1)]	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		80	I/O
	5AC801.HDDI-00	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		80	
	5AC801.HDDI-01	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		80	
	5AC801.HDDI-02	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		80	
	5AC801.HDDI-03	50	50	50	50	50		✓	✓	✓	✓	✓		60	
	5AC801.HDDI-04	50	50	50	50	50		✓	✓	✓	✓	✓		60	
	5AC801.SSDI-00	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		70	
	5AC801.SSDI-01	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		70	
	5AC801.SSDI-02	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		70	
	5AC801.SSDI-03 ≤ Rev. C0	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		70	
	5AC801.SSDI-03 ≥ Rev. D0	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		80	
	5AC801.SSDI-04 ≤ Rev. C0	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		70	
	5AC801.SSDI-04 ≥ Rev. D0	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		80	
	5AC801.SSDI-05	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		80	
Slide-in Laufwerke	5AC801.HDDS-00	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		80	Slide-in Laufwerk
	5AC801.DVDS-00	50	50	50	50	50		✓	✓	✓	✓	✓		50	
	5AC801.DVRS-00	50	50	50	50	50		✓	✓	✓	✓	✓		50	
Hauptspeicher	5MMDDR.0512-01	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		-	-
	5MMDDR.1024-01	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		-	
	5MMDDR.2048-01	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		-	
Systemeinheiten	5PC810.SX01-00	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		80	Netzteil
	5PC810.SX02-00	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		80	
	5PC810.SX03-00	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		80	
	5PC810.SX05-00	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		80	
Zusatzsteckkarten Schnittstellen / AP Link	5AC600.CANI-00	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		-	-
	5AC600.485I-00	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		-	
	5AC801.SDL0-00	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		-	
	5AC801.RDYR-00	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		-	
	5ACPCI.RAIC-01 (24 Stunden/ Standard)	30/ 40	30/ 40	30/ 40	30/ 40	30/ 40		30/ 40	30/ 40	30/ 40	30/ 40	30/ 40		-	
	5ACPCI.RAIC-03 (24 Stunden/ Standard)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		-	
	5ACPCI.RAIC-05 (24 Stunden/ Standard)	50	50	50	50	50		✓	✓	✓	✓	✓		-	
	5ACPCI.RAIC-06 (24 Stunden/ Standard)	50	50	50	50	50		✓	✓	✓	✓	✓		-	

1) Nur in Verbindung mit einer bei B&R erhältlichen und mit dem Gerät kompatiblen CompactFlash Karte möglich.

Tabelle 8: Umgebungstemperatur mit Lüfter

Information:

- **KEINE Unterscheidung zwischen bis 100 MBit und bis 1 GBit Betrieb von ETH1 und ETH2.**
- **Senkrechte wie auch waagrechte (minus 5°C) Einbaulage erlaubt (siehe "Einbaulagen" auf Seite 198).**
- **Die Angaben in der folgenden Tabelle gelten nur für Systemeinheiten mit den Kühlkörpern 5AC801.HS00-00 ≥ Rev. D0 und 5AC801.HS00-01 ≥ Rev. D0 und das CPU Board 5PC800.B945-05 mit Kühlkörper 5AC801.HS00-02.**

	Alle Temperaturangaben in Grad Celsius (°C) bei 500 m ü. NN. Herabsenkung (Derating) der maximalen Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 m ü. NN.	L2400 5PC800.B945-10	L7400 5PC800.B945-11	U7500 5PC800.B945-12	M 423 5PC800.B945-13	T7400 5PC800.B945-14	N270 5PC800.B945-05	Temperaturgrenzen	Sensor(en) im Bereich
	Maximale Umgebungstemperatur	**55**	**55**	**55**	**55**	**55**	**60**		
	Was kann noch bei max. Umgebungstemperatur betrieben werden, oder gibt es eine Einschränkung?								
Slide-in compact Laufwerke	On-Board CompactFlash[1)]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	80	I/O
	5AC801.HDDI-00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	80	
	5AC801.HDDI-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	80	
	5AC801.HDDI-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	80	
	5AC801.HDDI-03	50	50	50	50	50	50	60	
	5AC801.HDDI-04	50	50	50	50	50	50	60	
	5AC801.SSDI-00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	70	
	5AC801.SSDI-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	70	
	5AC801.SSDI-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	70	
	5AC801.SSDI-03 ≤ Rev. C0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	70	
	5AC801.SSDI-03 ≥ Rev. D0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	80	
	5AC801.SSDI-04 ≤ Rev. C0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	70	
	5AC801.SSDI-04 ≥ Rev. D0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	80	
	5AC801.SSDI-05	✓	✓	✓	✓	✓	✓	80	
Slide-in Laufwerke	5AC801.HDDS-00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	80	Slide-in Laufwerk
	5AC801.DVDS-00	50	50	50	50	50	50	50	
	5AC801.DVRS-00	50	50	50	50	50	50	50	
Hauptspeicher	5MMDDR.0512-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
	5MMDDR.1024-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
	5MMDDR.2048-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
Systemeinheiten	5PC810.SX01-00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	80	Netzteil
	5PC810.SX02-00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	80	
	5PC810.SX03-00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	80	
	5PC810.SX05-00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	80	
Zusatzsteckkarten Schnittstellen / AP Link	5AC600.CANI-00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
	5AC600.485I-00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
	5AC801.SDL0-00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
	5AC801.RDYR-00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
	5ACPCI.RAIC-01 (24 Stunden/ Standard)	30/ 40	30/ 40	30/ 40	30/ 40	30/ 40	30/ 40	-	
	5ACPCI.RAIC-03 (24 Stunden/ Standard)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
	5ACPCI.RAIC-05 (24 Stunden/ Standard)	50	50	50	50	50	50	-	
	5ACPCI.RAIC-06 (24 Stunden/ Standard)	50	50	50	50	50	50	-	

1) Nur in Verbindung mit einer bei B&R erhältlichen und mit dem Gerät kompatiblen CompactFlash Karte möglich.

Tabelle 9: Umgebungstemperatur mit Lüfter

2.1.1.3 Wie bestimmt man die maximale Umgebungstemperatur?

1. Auswahl des CPU Boards (Verwendung mit oder ohne Lüfter Kit).
2. Die Zeile „Maximale Umgebungstemperatur“ zeigt die maximale Umgebungstemperatur des Gesamtsystems in Verbindung mit dem jeweiligen CPU Board an.

> **Information:**
>
> **Die maximalen Temperaturangaben entsprechen einer Angabe bei 500 Metern ü. NN. Herabsenkung (Derating) der maximalen Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 Metern ü. NN.**

3. Sind im APC810 System zusätzlich Laufwerke (Add-on, Slide-in), Hauptspeicher, Zusatzsteckkarten, usw. eingebaut, kann es vorkommen, dass bedingt durch diese Komponente(n) eine Temperatureinschränkung besteht.

Ist bei der verbauten Komponente ein „✓“ (Häkchen), so kann diese bei der maximalen Umgebungstemperatur des Gesamtsystems problemlos betrieben werden.

Ist bei der verbauten Komponente eine Temperaturangabe z.B. „35“, so darf die Umgebungstemperatur des gesamten APC810 Systems diese nicht überschreiten.

2.1.2 Minimale Umgebungstemperatur

Die minimale Umgebungstemperatur liegt in Verbindung mit einer der folgenden Komponenten bei +5°C: 5AC801.DVDS-00, 5AC801.DVRS-00, 5ACPCI.RAIC-01, 5ACPCI.RAIC-02. Wird keine der genannten Komponenten verwendet so liegt die minimale Umgebungstemperatur bei 0°C.

2.1.3 Temperaturüberwachung

Sensoren überwachen Temperaturwerte in verschiedensten Bereichen (CPU, Board, Board I/O, Board ETH2, Board Netzteil, ETH2 Controller, Netzteil und Slide-in Laufwerke 1/2) im APC810. Die Position der Temperatursensoren ist der Abbildung Abb. 3 "Temperatursensorpositionen" auf Seite 39 zu entnehmen. Der angegebene Wert in der Tabelle stellt die definierte maximale Temperatur bei dieser Messstelle[2)] dar. Beim Überschreiten der Temperatur wird kein Alarm ausgelöst. Die Temperaturen können im BIOS (Menüpunkt Advanced - Baseboard/Panel Features - Baseboard Monitor) oder unter freigegebenen Microsoft Windows Betriebssystemen mittels B&R Control Center ausgelesen werden.

Desweiteren sind die bei B&R erhältlichen Hard Disks für APC810 Systeme mit der S.M.A.R.T (Self Monitoring, Analysis, and Reporting Technology) Technologie ausgestattet. D.h., es können verschiedene Parameter, wie z. B. Temperatur mittels Software (z.B. HDD Thermometer - Freeware) unter freigegebenen Microsoft Windows Betriebssystemen (außer Windows CE) ausgelesen werden.

[2)] Die gemessene Temperatur stellt einen Richtwert für die unmittelbare Umgebungstemperatur dar, kann aber auf Grund benachbarter Bauteile beeinflusst worden sein.

2.1.4 Temperatursensorpositionen

Sensoren zeigen Temperaturwerte in verschiedensten Bereichen (CPU, Board I/O, Slide-in Laufwerk, usw.) im APC810 an. Die Temperaturen[3] können im BIOS (Menüpunkt Advanced - CPU Monitor) oder unter Microsoft Windows Betriebssystemen mittels B&R Control Center[4] ausgelesen werden.

Für Anwendungen, die nicht unter Windows laufen, kann die Auswertung der Temperaturen mit Hilfe der B&R Implementierungsanleitung durchgeführt werden. Zusätzlich zur Implementierungsanleitung sind auch lauffähige MS-DOS Beispielprogramme verfügbar.

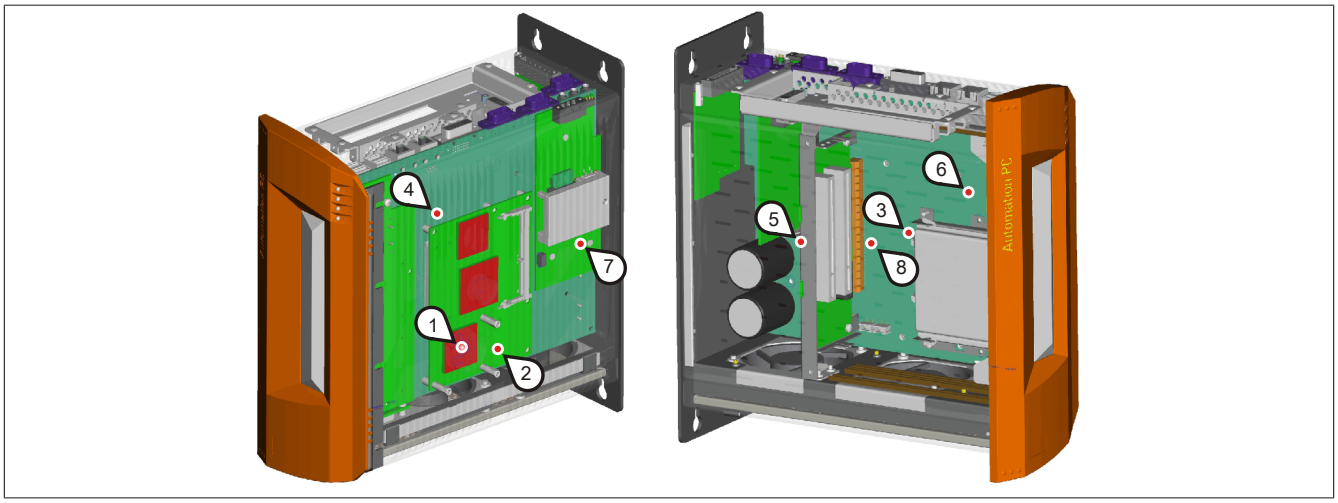


Abbildung 3: Temperatursensorpositionen

Position	Messpunkt für	Messung	max. spezifiziert
1	CPU	Temperatur des Prozessors (Sensor integriert im Prozessor).	100°C
2	Board	Temperatur des CPU Boards (Sensor integriert im CPU Board).	85°C
3	Board I/O	Temperatur des Board I/O Bereiches (Sensor auf dem Baseboard).	85°C
4	Board ETH2	Temperatur des Baseboards im Bereich des ETH2 Controllers (Sensor am Baseboard).	80°C
5	Board Netzteil	Temperatur des Board Netzteils (Sensor am Baseboard).	80°C
6	ETH2 Controller	Temperatur des ETH2 Controllers (Sensor im ETH2 Controller).	125°C
7	Netzteil	Temperatur des Netzteils (Sensor am Netzteil).	80°C
8	Slide-in Laufwerk 1	Temperatur eines Slide-in Laufwerks 1 (Sensor ist auf dem Slide-in Einschub integriert).	laufwerkabhängig
8	Slide-in Laufwerk 2	Temperatur eines Slide-in Laufwerks 2 (Sensor ist auf dem Slide-in Einschub integriert).	laufwerkabhängig

Tabelle 10: Temperatursensorpositionen

[3] Die gemessene Temperatur stellt einen Richtwert für die unmittelbare Umgebungstemperatur dar, kann aber auf Grund benachbarter Bauteile beeinflusst worden sein.

[4] Das B&R Control Center - ADI Treiber - kann kostenlos im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladenwerden.

2.2 Luftfeuchtigkeitsangaben

Die nachfolgende Tabelle zeigt die minimale und maximale relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) der Einzelkomponenten, die für die Einschränkung der Luftfeuchtigkeit des Gesamtgerätes von Bedeutung sind. Für die Bestimmung ist immer der gemeinsame kleinste, wie auch größte Wert zu verwenden.

Komponente		Betrieb	Lagerung	Transport
CPU Boards 945GME COM Express		10 bis 90%	5 bis 95%	5 bis 95%
Systemeinheiten (alle Varianten)		5 bis 90%	5 bis 95%	5 bis 95%
Hauptspeicher für CPU Boards		10 bis 90%	5 bis 95%	5 bis 95%
Slide-in compact Laufwerke	5AC801.HDDI-00	5 bis 90%	5 bis 95%	5 bis 95%
	5AC801.HDDI-01	5 bis 90%	5 bis 95%	5 bis 95%
	5AC801.HDDI-02	8 bis 90%	5 bis 95%	5 bis 95%
	5AC801.HDDI-03	5 bis 95%	5 bis 95%	5 bis 95%
	5AC801.HDDI-04	8 bis 90%	5 bis 95%	5 bis 95%
	5AC801.SSDI-00	5 bis 95%	5 bis 95%	5 bis 95%
	5AC801.SSDI-01	5 bis 95%	5 bis 95%	5 bis 95%
	5AC801.SSDI-02	5 bis 95%	5 bis 95%	5 bis 95%
	5AC801.SSDI-03 ≤ Rev. C0	8 bis 90%	8 bis 95%	8 bis 95%
	5AC801.SSDI-03 ≥ Rev. D0	5 bis 90%	5 bis 95%	5 bis 95%
	5AC801.SSDI-04 ≤ Rev. C0	8 bis 90%	8 bis 95%	8 bis 95%
	5AC801.SSDI-04 ≥ Rev. D0	5 bis 90%	5 bis 95%	5 bis 95%
	5AC801.SSDI-05	5 bis 90%	5 bis 95%	5 bis 95%
Slide-in Laufwerke	5AC801.HDDS-00	5 bis 90%	5 bis 90%	5 bis 90%
	5AC801.DVDS-00	8 bis 90%	5 bis 95%	5 bis 95%
	5AC801.DVRS-00	8 bis 90%	5 bis 95%	5 bis 95%
Zusatzsteckkarten	5AC600.CANI-00	5 bis 90%	5 bis 95%	5 bis 95%
	5AC600.485I-00	5 bis 90%	5 bis 95%	5 bis 95%
	5AC801.SDL0-00	5 bis 90%	5 bis 95%	5 bis 95%
	5AC801.RDYR-00	5 bis 90%	5 bis 95%	5 bis 95%
	5ACPCI.RAIC-01 (24 Stunden/Standard)	5 bis 90%	5 bis 95%	5 bis 95%
	5ACPCI.RAIC-02 (24 Stunden/Standard)	5 bis 90%	5 bis 95%	5 bis 95%
	5ACPCI.RAIC-03 (24 Stunden/Standard)	8 bis 90%	5 bis 95%	5 bis 95%
	5ACPCI.RAIC-04 (24 Stunden/Standard)	8 bis 90%	5 bis 95%	5 bis 95%
	5ACPCI.RAIC-05 (24 Stunden/Standard)	5 bis 95%	5 bis 95%	5 bis 95%
	5ACPCI.RAIC-06 (24 Stunden/Standard)	8 bis 90%	5 bis 95%	5 bis 95%
	5MMHDD.0250-00 (24 Stunden/Standard)	5 bis 95%	5 bis 95%	5 bis 95%
	5MMHDD.0500-00 (24 Stunden/Standard)	8 bis 90%	5 bis 95%	5 bis 95%
Zubehör	CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx-06	85%	85%	85%
	CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx-04	85%	85%	85%
	CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx-03	8 bis 95%	8 bis 95%	8 bis 95%
	Memory Stick 5MMUSB.2048-00	10 bis 90%	5 bis 90%	5 bis 90%
	Memory Stick 5MMUSB.xxxx-01	85%	85%	85%
	USB Media Drive 5MD900.USB2-01	20 bis 80%	5 bis 90%	5 bis 90%

Tabelle 11: Übersicht Luftfeuchtigkeitsangaben der Einzelkomponenten

Die aufgelisteten Angaben entsprechen der relativen Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) bei einer Umgebungstemperatur von 30°C. Genauere Informationen zur spezifizierten Luftfeuchtigkeit in Abhängigkeit der Temperatur ist den technischen Daten der Einzelkomponenten zu entnehmen.

2.3 Leistungshaushalt

2.3.1 Blockschaltbild Spannungsversorgung

Das nachfolgende Blockschaltbild stellt den vereinfachten Aufbau der APC810 Spannungsversorgung für die Systemeinheiten dar.

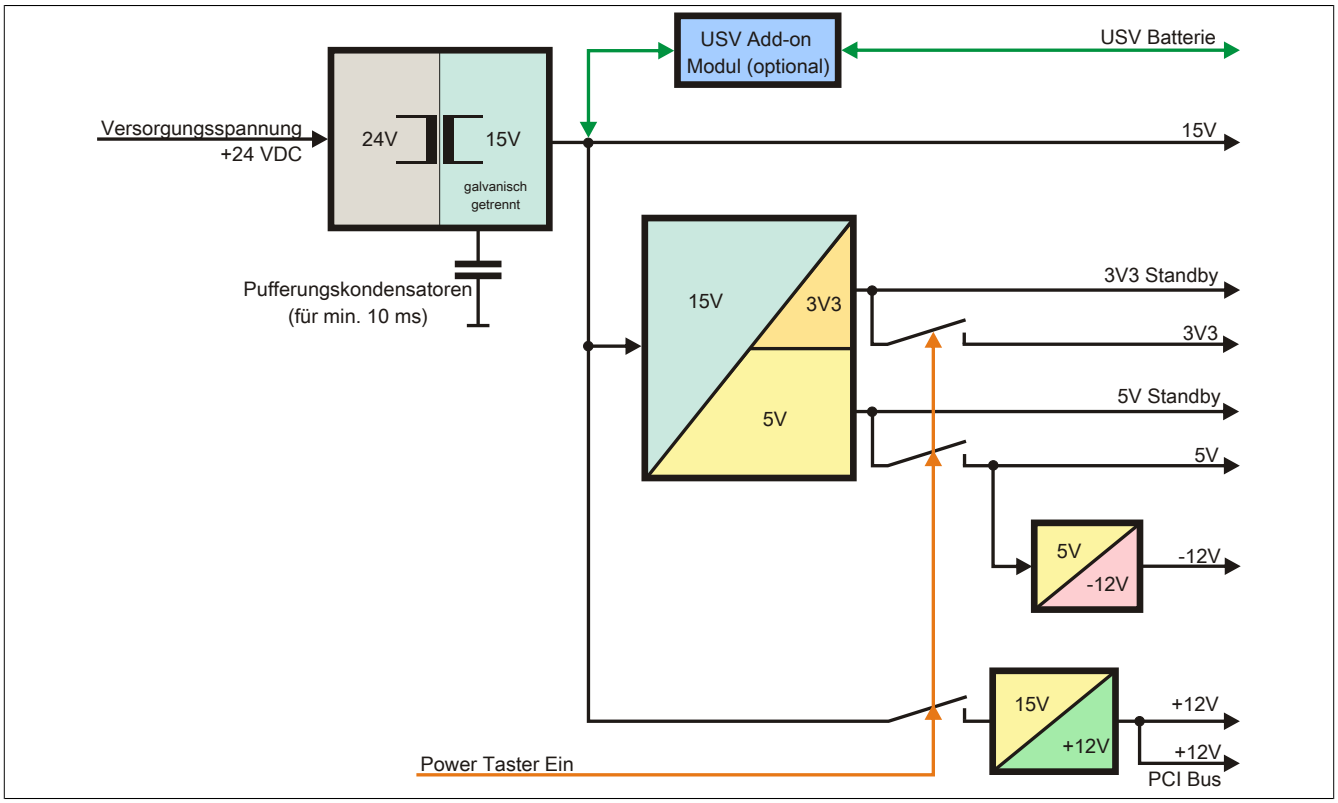


Abbildung 4: Spannungsversorgung für Systemeinheiten

Erläuterung

Aus der Versorgungsspannung werden durch einen DC/DC Wandler 15 V generiert. Diese galvanisch getrennten 15 V speisen weitere DC/DC Wandler, welche die restlichen Spannungen generieren.

Nach dem Einschalten des Systems (z.B. durch den Power Taster) werden die Spannungen 3V3 und 5 V auf den Bus gelegt. Beim 5 V Ausgang generiert ein weiterer DC/DC Wandler -12 V und legt diese auf den Bus. Ein zusätzlicher DC/DC Wandler generiert +12 V.

Die optional anschließbare Add-on USV inklusive Batterieeinheit wird über 15 V versorgt und gewährleistet bei Verlust der Versorgungsspannung eine unterbrechungsfreie Stromversorgung des 15 V Bus.

2.3.2 Leistungskalkulation mit 5PC810.SX01-00 Revision ≥ D0

Information: Alle Angaben in **Watt**. Bei den Angaben der **Erzeuger** handelt sich um Maximalwerte. Bei den Angaben der **Verbraucher** handelt es sich um gemittelte maximale Werte, jedoch keine Peak-Werte.			CPU Board						Vorliegendes System
			5PC800.B945-00 5PC800.B945-10	5PC800.B945-01 5PC800.B945-11	5PC800.B945-02 5PC800.B945-12	5PC800.B945-03 5PC800.B945-13	5PC800.B945-04 5PC800.B945-14	5PC800.B945-05	Werte in dieser Spalte Eintragen
			Leistung Gesamtnetzteil (maximal)						**130**
Gesamtnetzteil		Add-on USV Modul, optional	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	
			maximal möglich bei +12 V						**75**
	+12 V	CPU Board, Fixverbraucher	26	30	18	14	43	11	
		Arbeitsspeicher 512 MB max. 2 Stück je 1,5 W							
		Arbeitsspeicher 1024 MB max. 2 Stück je 2,5 W							
		Arbeitsspeicher 2048 MB max. 2 Stück je 3 W							
		Lüfter Kit, optional	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	
		Externer Verbraucher, optional (über Baseboard)	10	10	10	10	10	10	
		Leistungsangabe PCI Karte, optional (max. 3 W ohne Lüfter Kit, max. 6 W mit Lüfter Kit)[1]							
		Leistungsangabe PCIe x1 Karte, optional (max. 3 W ohne Lüfter Kit, max. 20 W mit Lüfter Kit)[1]							
		Verbraucher +12 V ∑							
			maximal möglich bei +5 V						**65**
	+5 V	Systemeinheit, Fixverbraucher	4	4	4	4	4	4	
		Hard Disk (Slide-in compact)	4	4	4	4	4	4	
		USB Peripherie USB2 und USB4 je 2,5 W							
		USB Peripherie USB1, USB3 und USB5 je 5 W							
		Schnittstellenoption (Add-on Interface), optional	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
		Externer Verbraucher, optional (über Baseboard)	5	5	5	5	5	5	
		Leistungsangabe PCI Karte, optional (max. 3 W ohne Lüfter Kit, max. 20 W mit Lüfter Kit)[1]							
			maximal möglich bei -12 V						**1.2**
	-12 V	Leistungsangabe PCI Karte, optional (max. 1,2 W ohne und mit Lüfter Kit)[1]							
		Verbraucher -12 V ∑							
		Verbraucher +5 V ∑							
			maximal möglich bei 3V3						**40**
	3V3	Systemeinheit, Fixverbraucher	4	4	4	4	4	4	
		CompactFlash, je 1 W							
		Schnittstellenoption (Add-on Interface), optional	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	
		Leistungsangabe PCI Karte, optional (max. 3 W ohne Lüfter Kit, max. 15 W mit Lüfter Kit)[1]							
		Leistungsangabe PCIe x1 Karte, optional (max. 3 W ohne Lüfter Kit, max. 10 W mit Lüfter Kit)[1]							
		Verbraucher 3V3 ∑							
		Verbraucher ∑							

1) Die Gesamtleistung einer PCI / PCIe Karte pro PCI Steckplatz (= Summe der Leistungsaufnahmen pro Spannungsbereich) darf die max. Leistungsangabe mit und ohne Lüfter Kit nicht überschreiten.

Tabelle 12: Leistungskalkulation APC 1 Slot

2.3.3 Leistungskalkulation mit 5PC810.SX01-00 Revision < D0

Information: Alle Angaben in **Watt**. Bei den Angaben der **Erzeuger** handelt sich um Maximalwerte. Bei den Angaben der **Verbraucher** handelt es sich um gemittelte maximale Werte, jedoch keine Peak-Werte.			CPU Board						Vorliegendes System
			5PC800.B945-00 5PC800.B945-10	5PC800.B945-01 5PC800.B945-11	5PC800.B945-02 5PC800.B945-12	5PC800.B945-03 5PC800.B945-13	5PC800.B945-04 5PC800.B945-14	5PC800.B945-05	Werte in dieser Spalte Eintragen
		Leistung Gesamtnetzteil (maximal)							**85**
Gesamtnetzteil		Add-on USV Modul, optional	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	
		maximal möglich bei +12 V							**75**
	+12 V	CPU Board, Fixverbraucher	26	30	18	14	43	11	
		Arbeitsspeicher 512 MB max. 2 Stück je 1,5 W							
		Arbeitsspeicher 1024 MB max. 2 Stück je 2,5 W							
		Arbeitsspeicher 2048 MB max. 2 Stück je 3 W							
		Lüfter Kit, optional	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	
		Externer Verbraucher, optional (über Baseboard)	10	10	10	10	10	10	
		Leistungsangabe PCI Karte, optional (max. 3 W ohne Lüfter Kit, max. 6 W mit Lüfter Kit)[1]							
		Leistungsangabe PCIe x1 Karte, optional (max. 3 W ohne Lüfter Kit, max. 20 W mit Lüfter Kit)[1]							
		Verbraucher +12 V ∑							
		maximal möglich bei +5 V							**65**
	+5 V	Systemeinheit, Fixverbraucher	4	4	4	4	4	4	
		Hard Disk (Slide-in compact)	4	4	4	4	4	4	
		USB Peripherie USB2 und USB4 je 2,5 W							
		USB Peripherie USB1, USB3 und USB5 je 5 W							
		Schnittstellenoption (Add-on Interface), optional	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
		Externer Verbraucher, optional (über Baseboard)	5	5	5	5	5	5	
		Leistungsangabe PCI Karte, optional (max. 3 W ohne Lüfter Kit, max. 20 W mit Lüfter Kit)[1]							
		maximal möglich bei -12 V							**1.2**
	-12 V	Leistungsangabe PCI Karte, optional (max. 1,2 W ohne und mit Lüfter Kit)[1]							
		Verbraucher -12 V ∑							
		Verbraucher +5 V ∑							
		maximal möglich bei 3V3							**40**
	3V3	Systemeinheit, Fixverbraucher	4	4	4	4	4	4	
		CompactFlash, je 1 W							
		Schnittstellenoption (Add-on Interface), optional	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	
		Leistungsangabe PCI Karte, optional (max. 3 W ohne Lüfter Kit, max. 15 W mit Lüfter Kit)[1]							
		Leistungsangabe PCIe x1 Karte, optional (max. 3 W ohne Lüfter Kit, max. 10 W mit Lüfter Kit)[1]							
		Verbraucher 3V3 ∑							
		Verbraucher ∑							

1) Die Gesamtleistung einer PCI / PCIe Karte pro PCI Steckplatz (= Summe der Leistungsaufnahmen pro Spannungsbereich) darf die max. Leistungsangabe mit und ohne Lüfter Kit nicht überschreiten.

Tabelle 13: Leistungskalkulation APC 1 Slot

2.3.4 Leistungskalkulation mit 5PC810.SX02-00 Revision ≥ D0

Information: Alle Angaben in **Watt**. Bei den Angaben der **Erzeuger** handelt sich um Maximalwerte. Bei den Angaben der **Verbraucher** handelt es sich um gemittelte maximale Werte, jedoch keine Peak-Werte.			CPU Board						Vorliegendes System
			5PC800.B945-00 5PC800.B945-10	5PC800.B945-01 5PC800.B945-11	5PC800.B945-02 5PC800.B945-12	5PC800.B945-03 5PC800.B945-13	5PC800.B945-04 5PC800.B945-14	5PC800.B945-05	Werte in dieser Spalte Eintragen
			Leistung Gesamtnetzteil (maximal)						**130**
		Add-on USV Modul, optional	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	
Gesamtnetzteil			**maximal möglich bei +12 V**						**75**
Gesamtnetzteil	+12 V	CPU Board, Fixverbraucher	26	30	18	14	43	11	
Gesamtnetzteil	+12 V	Arbeitsspeicher 512 MB max. 2 Stück je 1,5 W							
Gesamtnetzteil	+12 V	Arbeitsspeicher 1024 MB max. 2 Stück je 2,5 W							
Gesamtnetzteil	+12 V	Arbeitsspeicher 2048 MB max. 2 Stück je 3 W							
Gesamtnetzteil	+12 V	Lüfter Kit, optional	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	
Gesamtnetzteil	+12 V	Externer Verbraucher, optional (über Baseboard)	10	10	10	10	10	10	
Gesamtnetzteil	+12 V	Leistungsangabe PCI Karte, optional (max. 3 W ohne Lüfter Kit, max. 6 W mit Lüfter Kit)[1)]							
Gesamtnetzteil	+12 V	Leistungsangabe PCIe x1 Karte, optional (max. 3 W ohne Lüfter Kit, max. 20 W mit Lüfter Kit)[1)]							
Gesamtnetzteil	+12 V	**Verbraucher +12 V ∑**							
Gesamtnetzteil			**maximal möglich bei +5 V**						**65**
Gesamtnetzteil	+5 V	Systemeinheit, Fixverbraucher	4	4	4	4	4	4	
Gesamtnetzteil	+5 V	Hard Disk (Slide-in compact)	4	4	4	4	4	4	
Gesamtnetzteil	+5 V	Slide-in Laufwerk (Hard Disk, DVD-ROM,…)	4	4	4	4	4	4	
Gesamtnetzteil	+5 V	USB Peripherie USB2 und USB4 je 2,5 W							
Gesamtnetzteil	+5 V	USB Peripherie USB1, USB3 und USB5 je 5 W							
Gesamtnetzteil	+5 V	Schnittstellenoption (Add-on Interface), optional	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
Gesamtnetzteil	+5 V	Grafikadapter (AP Link), optional	5	5	5	5	5	5	
Gesamtnetzteil	+5 V	Externer Verbraucher, optional (über Baseboard)	5	5	5	5	5	5	
Gesamtnetzteil	+5 V	Leistungsangabe PCI Karte, optional (max. 3 W ohne Lüfter Kit, max. 20 W mit Lüfter Kit)[1)]							
Gesamtnetzteil			**maximal möglich bei -12 V**						**1.2**
Gesamtnetzteil	-12 V	Leistungsangabe PCI Karte, optional (max. 1,2 W ohne und mit Lüfter Kit)[1)]							
Gesamtnetzteil	-12 V	**Verbraucher -12 V ∑**							
Gesamtnetzteil	+5 V	**Verbraucher +5 V ∑**							
Gesamtnetzteil			**maximal möglich bei 3V3**						**40**
Gesamtnetzteil	3V3	Systemeinheit, Fixverbraucher	4	4	4	4	4	4	
Gesamtnetzteil	3V3	CompactFlash, je 1 W							
Gesamtnetzteil	3V3	Schnittstellenoption (Add-on Interface), optional	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	
Gesamtnetzteil	3V3	Grafikadapter (AP Link), optional	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	
Gesamtnetzteil	3V3	Leistungsangabe PCI Karte, optional (max. 3 W ohne Lüfter Kit, max. 15 W mit Lüfter Kit)[1)]							
Gesamtnetzteil	3V3	Leistungsangabe PCIe x1 Karte, optional (max. 3 W ohne Lüfter Kit, max. 10 W mit Lüfter Kit)[1)]							
Gesamtnetzteil	3V3	**Verbraucher 3V3 ∑**							
Gesamtnetzteil		**Verbraucher ∑**							

1) Die Gesamtleistung einer PCI / PCIe Karte pro PCI Steckplatz (= Summe der Leistungsaufnahmen pro Spannungsbereich) darf die max. Leistungsangabe mit und ohne Lüfter Kit nicht überschreiten.

Tabelle 14: Leistungskalkulation APC 2 Slot

2.3.5 Leistungskalkulation mit 5PC810.SX02-00 Revision < D0

Information: Alle Angaben in **Watt** Bei den Angaben der **Erzeuger** handelt sich um Maximalwerte. Bei den Angaben der **Verbraucher** handelt es sich um gemittelte maximale Werte, jedoch keine Peak-Werte.			**CPU Board**						**Vorliegendes System**
			5PC800.B945-00 5PC800.B945-10	5PC800.B945-01 5PC800.B945-11	5PC800.B945-02 5PC800.B945-12	5PC800.B945-03 5PC800.B945-13	5PC800.B945-04 5PC800.B945-14	5PC800.B945-05	Werte in dieser Spalte Eintragen
Gesamtnetzteil									**Leistung Gesamtnetzteil (maximal)**	**85**
		Add-on USV Modul, optional	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	
	+12 V								**maximal möglich bei +12 V**	**75**
		CPU Board, Fixverbraucher	26	30	18	14	43	11	
		Arbeitsspeicher 512 MB max. 2 Stück je 1,5 W							
		Arbeitsspeicher 1024 MB max. 2 Stück je 2,5 W							
		Arbeitsspeicher 2048 MB max. 2 Stück je 3 W							
		Lüfter Kit, optional	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	
		Externer Verbraucher, optional (über Baseboard)	10	10	10	10	10	10	
		Leistungsangabe PCI Karte, optional (max. 3 W ohne Lüfter Kit, max. 6 W mit Lüfter Kit)[1)]							
		Leistungsangabe PCIe x1 Karte, optional (max. 3 W ohne Lüfter Kit, max. 20 W mit Lüfter Kit)[1)]							
									Verbraucher +12 V ∑	
	+5 V								**maximal möglich bei +5 V**	**65**
		Systemeinheit, Fixverbraucher	4	4	4	4	4	4	
		Hard Disk (Slide-in compact)	4	4	4	4	4	4	
		Slide-in Laufwerk (Hard Disk, DVD-ROM,…)	4	4	4	4	4	4	
		USB Peripherie USB2 und USB4 je 2,5 W							
		USB Peripherie USB1, USB3 und USB5 je 5 W							
		Schnittstellenoption (Add-on Interface), optional	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
		Grafikadapter (AP Link), optional	5	5	5	5	5	5	
		Externer Verbraucher, optional (über Baseboard)	5	5	5	5	5	5	
		Leistungsangabe PCI Karte, optional (max. 3 W ohne Lüfter Kit, max. 20 W mit Lüfter Kit)[1)]							
									maximal möglich bei -12 V	**1.2**
		-12 V Leistungsangabe PCI Karte, optional (max. 1,2 W ohne und mit Lüfter Kit)[1)]							
									Verbraucher -12 V ∑	
									Verbraucher +5 V ∑	
	3V3								**maximal möglich bei 3V3**	**40**
		Systemeinheit, Fixverbraucher	4	4	4	4	4	4		
		CompactFlash, je 1 W								
		Schnittstellenoption (Add-on Interface), optional	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25		
		Grafikadapter (AP Link), optional	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5		
		Leistungsangabe PCI Karte, optional (max. 3 W ohne Lüfter Kit, max. 15 W mit Lüfter Kit)[1)]								
		Leistungsangabe PCIe x1 Karte, optional (max. 3 W ohne Lüfter Kit, max. 10 W mit Lüfter Kit)[1)]								
									Verbraucher 3V3 ∑	
									Verbraucher ∑	

1) Die Gesamtleistung einer PCI / PCIe Karte pro PCI Steckplatz (= Summe der Leistungsaufnahmen pro Spannungsbereich) darf die max. Leistungsangabe mit und ohne Lüfter Kit nicht überschreiten.

Tabelle 15: Leistungskalkulation APC 2 Slot

2.3.6 Leistungskalkulation mit 5PC810.SX03-00

Information: Alle Angaben in **Watt**. Bei den Angaben der **Erzeuger** handelt sich um Maximalwerte. Bei den Angaben der **Verbraucher** handelt es sich um gemittelte maximale Werte, jedoch keine Peak-Werte.			CPU Board						Vorliegendes System
			5PC800.B945-00 5PC800.B945-10	5PC800.B945-01 5PC800.B945-11	5PC800.B945-02 5PC800.B945-12	5PC800.B945-03 5PC800.B945-13	5PC800.B945-04 5PC800.B945-14	5PC800.B945-05	Werte in dieser Spalte Eintragen
Gesamtnetzteil									**Leistung Gesamtnetzteil (maximal)** 130
		Add-on USV Modul, optional	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	
	+12 V								**maximal möglich bei +12 V** 75
		CPU Board, Fixverbraucher	26	30	18	14	43	11	
		Arbeitsspeicher 512 MB max. 2 Stück je 1,5 W							
		Arbeitsspeicher 1024 MB max. 2 Stück je 2,5 W							
		Arbeitsspeicher 2048 MB max. 2 Stück je 3 W							
		Lüfter Kit, optional	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	
		Externer Verbraucher, optional (über Baseboard)	10	10	10	10	10	10	
		Leistungsangabe PCI Karte, optional (max. 3 W ohne Lüfter Kit, max. 6 W mit Lüfter Kit)[1)]							
		Leistungsangabe PCIe x1 Karte, optional (max. 3 W ohne Lüfter Kit, max. 20 W mit Lüfter Kit)[1)]							
									Verbraucher +12 V ∑
	+5 V								**maximal möglich bei +5 V** 65
		Systemeinheit, Fixverbraucher	4	4	4	4	4	4	
		Hard Disk (Slide-in compact)	4	4	4	4	4	4	
		Slide-in Laufwerk (Hard Disk, DVD-ROM,…)	4	4	4	4	4	4	
		USB Peripherie USB2 und USB4 je 2,5 W							
		USB Peripherie USB1, USB3 und USB5 je 5 W							
		Schnittstellenoption (Add-on Interface), optional	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
		Grafikadapter (AP Link), optional	5	5	5	5	5	5	
		Externer Verbraucher, optional (über Baseboard)	5	5	5	5	5	5	
		Leistungsangabe PCI Karte, optional (max. 3 W ohne Lüfter Kit, max. 20 W mit Lüfter Kit)[1)]							
									maximal möglich bei -12 V 1.2
	-12 V	Leistungsangabe PCI Karte, optional (max. 1,2 W ohne und mit Lüfter Kit)[1)]							
									Verbraucher -12 V ∑
									Verbraucher +5 V ∑
	3V3								**maximal möglich bei 3V3** 40
		Systemeinheit, Fixverbraucher	4	4	4	4	4	4	
		CompactFlash, je 1 W							
		Schnittstellenoption (Add-on Interface), optional	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	
		Grafikadapter (AP Link), optional	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	
		Leistungsangabe PCI Karte, optional (max. 3 W ohne Lüfter Kit, max. 15 W mit Lüfter Kit)[1)]							
		Leistungsangabe PCIe x1 Karte, optional (max. 3 W ohne Lüfter Kit, max. 10 W mit Lüfter Kit)[1)]							
									Verbraucher 3V3 ∑
									Verbraucher ∑

1) Die Gesamtleistung einer PCI / PCIe Karte pro PCI Steckplatz (= Summe der Leistungsaufnahmen pro Spannungsbereich) darf die max. Leistungsangabe mit und ohne Lüfter Kit nicht überschreiten.

Tabelle 16: Leistungskalkulation APC 3 Slot

2.3.7 Leistungskalkulation mit 5PC810.SX05-00

Information: Alle Angaben in **Watt** Bei den Angaben der **Erzeuger** handelt sich um Maximalwerte. Bei den Angaben der **Verbraucher** handelt es sich um gemittelte maximale Werte, jedoch keine Peak-Werte.			**CPU Board**						**Vorliegendes System**
			5PC800.B945-00 5PC800.B945-10	5PC800.B945-01 5PC800.B945-11	5PC800.B945-02 5PC800.B945-12	5PC800.B945-03 5PC800.B945-13	5PC800.B945-04 5PC800.B945-14	5PC800.B945-05	Werte in dieser Spalte Eintragen
Gesamtnetzteil									**Leistung Gesamtnetzteil (maximal)** **130**
		Add-on USV Modul, optional	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	
	+12 V								**maximal möglich bei +12 V** **75**
		CPU Board, Fixverbraucher	26	30	18	14	43	11	
		Arbeitsspeicher 512 MB max. 2 Stück je 1,5 W							
		Arbeitsspeicher 1024 MB max. 2 Stück je 2,5 W							
		Arbeitsspeicher 2048 MB max. 2 Stück je 3 W							
		Lüfter Kit, optional	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	
		Externer Verbraucher, optional (über Baseboard)	10	10	10	10	10	10	
		Leistungsangabe PCI Karte, optional (max. 3 W ohne Lüfter Kit, max. 6 W mit Lüfter Kit)[1)]							
		Leistungsangabe PCIe x1 Karte, optional (max. 3 W ohne Lüfter Kit, max. 20 W mit Lüfter Kit)[1)]							
									Verbraucher +12 V ∑
	+5 V								**maximal möglich bei +5 V** **65**
		Systemeinheit, Fixverbraucher	4	4	4	4	4	4	
		Hard Disk (Slide-in compact)	4	4	4	4	4	4	
		Slide-in Laufwerk (Hard Disk, DVD-ROM,…)	4	4	4	4	4	4	
		USB Peripherie USB2 und USB4 je 2,5 W							
		USB Peripherie USB1, USB3 und USB5 je 5 W							
		Schnittstellenoption (Add-on Interface), optional	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
		Grafikadapter (AP Link), optional	5	5	5	5	5	5	
		Externer Verbraucher, optional (über Baseboard)	5	5	5	5	5	5	
		Leistungsangabe PCI Karte, optional (max. 3 W ohne Lüfter Kit, max. 20 W mit Lüfter Kit)[1)]							
									maximal möglich bei -12 V **1.2**
		-12 V Leistungsangabe PCI Karte, optional (max. 1,2 W ohne und mit Lüfter Kit)[1)]							
									Verbraucher -12 V ∑
									Verbraucher +5 V ∑
	3V3								**maximal möglich bei 3V3** **40**
		Systemeinheit, Fixverbraucher	4	4	4	4	4	4	
		CompactFlash, je 1 W							
		Schnittstellenoption (Add-on Interface), optional	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	
		Grafikadapter (AP Link), optional	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	
		Leistungsangabe PCI Karte, optional (max. 3 W ohne Lüfter Kit, max. 15 W mit Lüfter Kit)[1)]							
		Leistungsangabe PCIe x1 Karte, optional (max. 3 W ohne Lüfter Kit, max. 10 W mit Lüfter Kit)[1)]							
									Verbraucher 3V3 ∑
									Verbraucher ∑

1) Die Gesamtleistung einer PCI / PCIe Karte pro PCI Steckplatz (= Summe der Leistungsaufnahmen pro Spannungsbereich) darf die max. Leistungsangabe mit und ohne Lüfter Kit nicht überschreiten.

Tabelle 17: Leistungskalkulation APC 5 Slot

2.4 Serialnummernaufkleber

Jedes B&R Gerät wird mit einem einzigartigen Serialnummernaufkleber mit Barcode (Type 128) versehen, um eine eindeutige Identifizierung des Gerätes zu ermöglichen. Hinter dieser Serialnummer sind alle in dem System verbauten Komponenten (Bestellnummer, Bezeichnung, Revision, Serialnummer, Lieferdatum und Garantieende) abgebildet.

Abbildung 5: Serialnummernaufkleber Vorderseite

Ein Aufkleber mit detaillierten Informationen der verbauten Komponenten ist auch auf der Rückseite der Montageplatte zu finden.

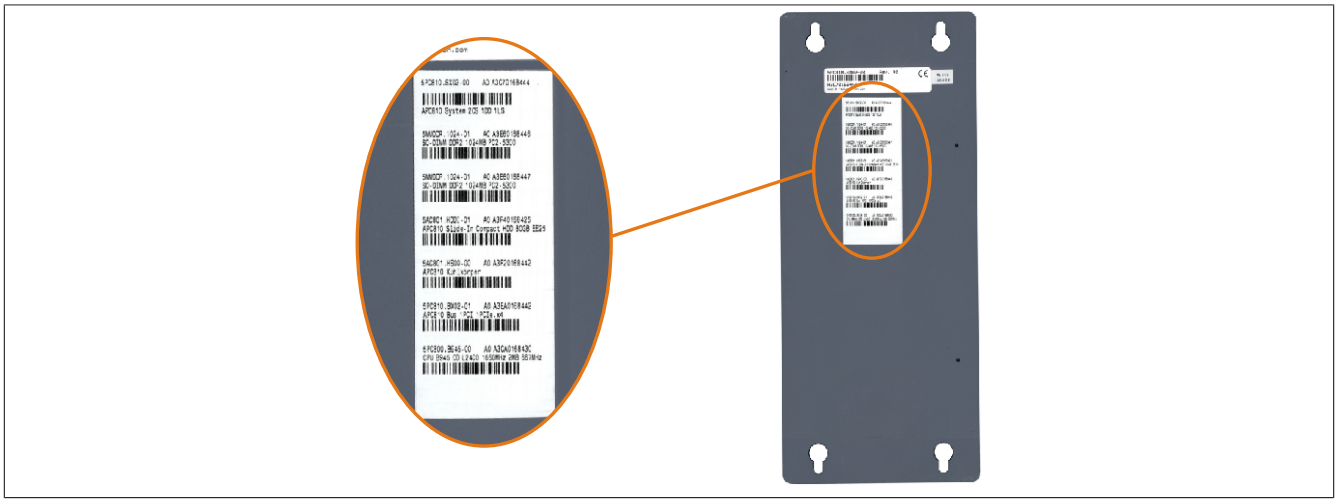


Abbildung 6: Serialnummernaufkleber Rückseite

Hinter der Serialnummer sind alle in dem System verbauten Komponenten (Serialnummer, Materialnummer, Revision, Lieferdatum und Garantieende) abgebildet. Diese Information kann über die B&R Homepage abgerufen werden. Hierzu ist auf der Startseite www.br-automation.com die Serialnummer des Gesamtgerätes im Suchfeld einzugeben und auf den Tab "Serialnummer" zu wechseln. Nach der Suche erhält man eine detaillierte Auflistung der verbauten Komponenten.

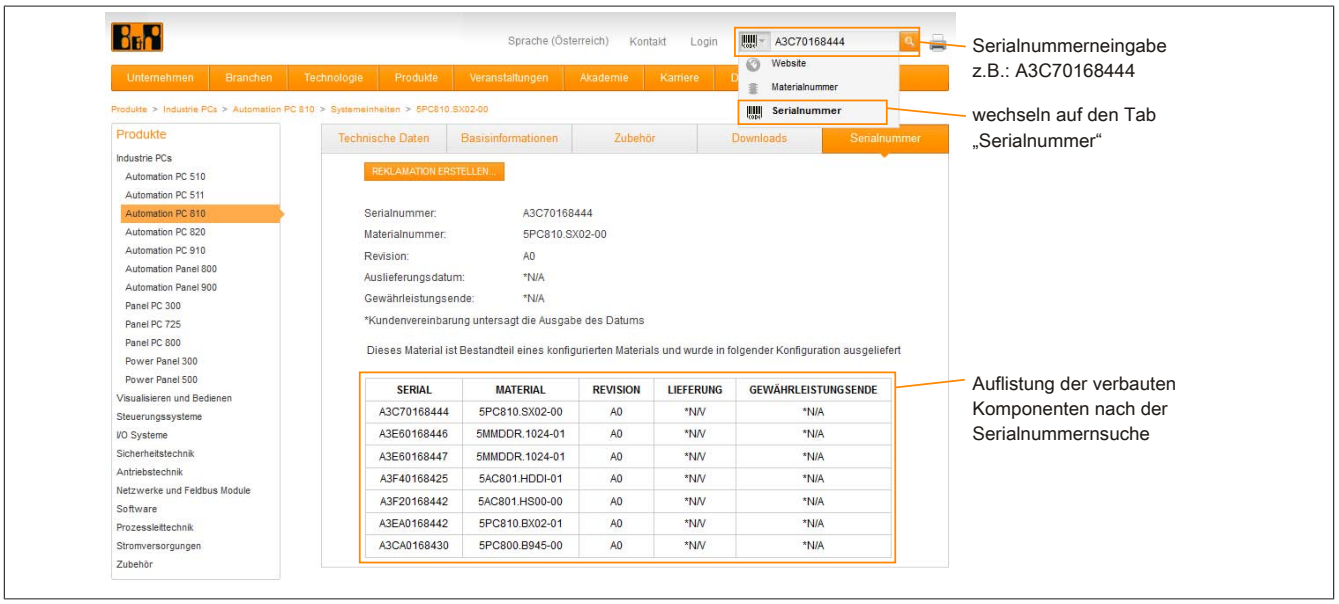


Abbildung 7: Beispiel Serialnummernsuche - A3C70168444

2.5 Blockschaltbilder

Die nachfolgenden Blockschaltbilder zeigen den vereinfachten Aufbau der Systemeinheiten mit einem CPU Board in Abhängigkeit der verschiedenen Buseinheiten.

2.5.1 Systemeinheit 5PC810.SX01-00 + Buseinheit 5PC810.BX01-00

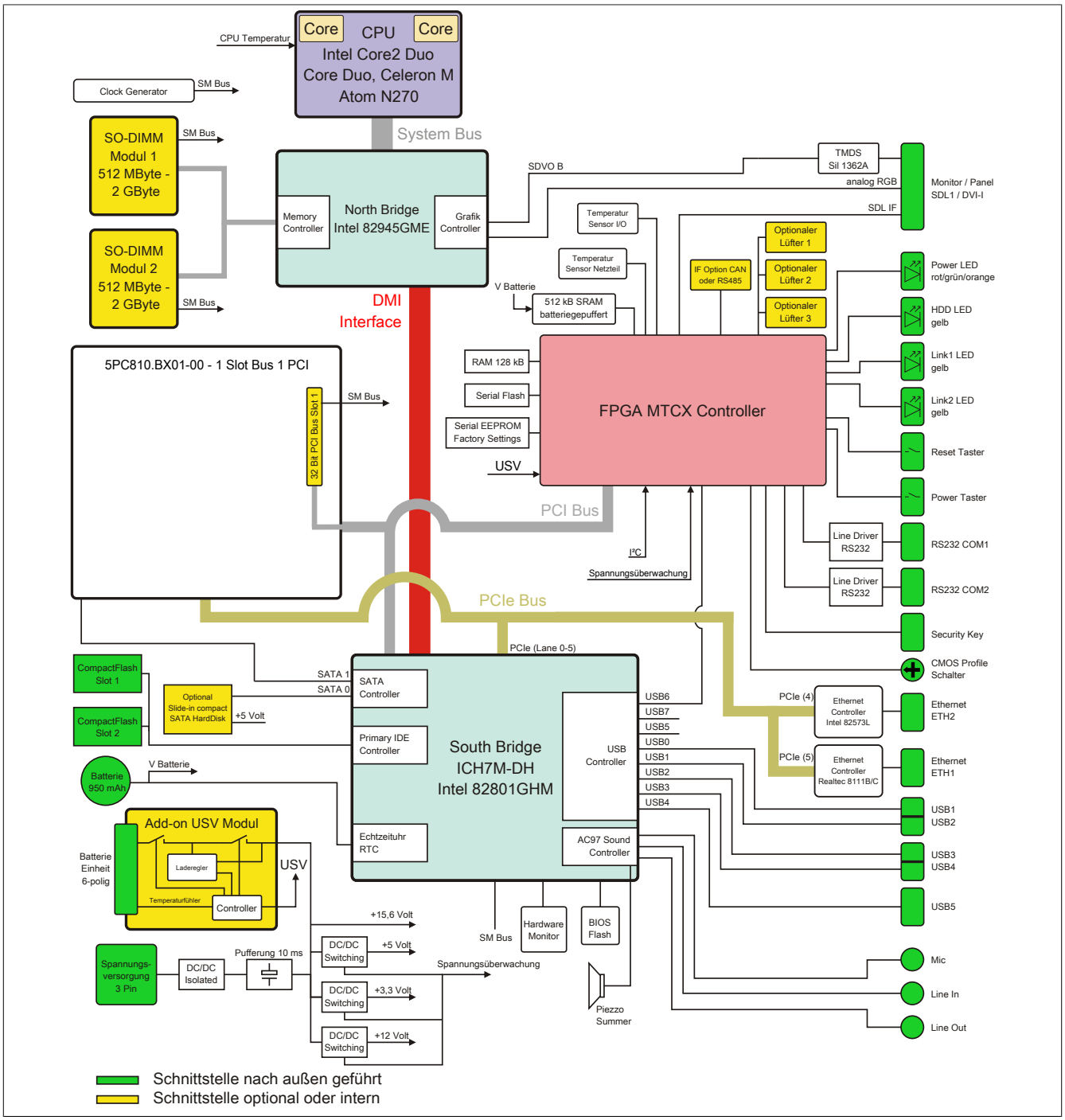


Abbildung 8: 5PC810.SX01-00 + 5PC810.BX01-00 Blockschaltbild

2.5.2 Systemeinheit 5PC810.SX01-00 + Buseinheit 5PC810.BX01-01

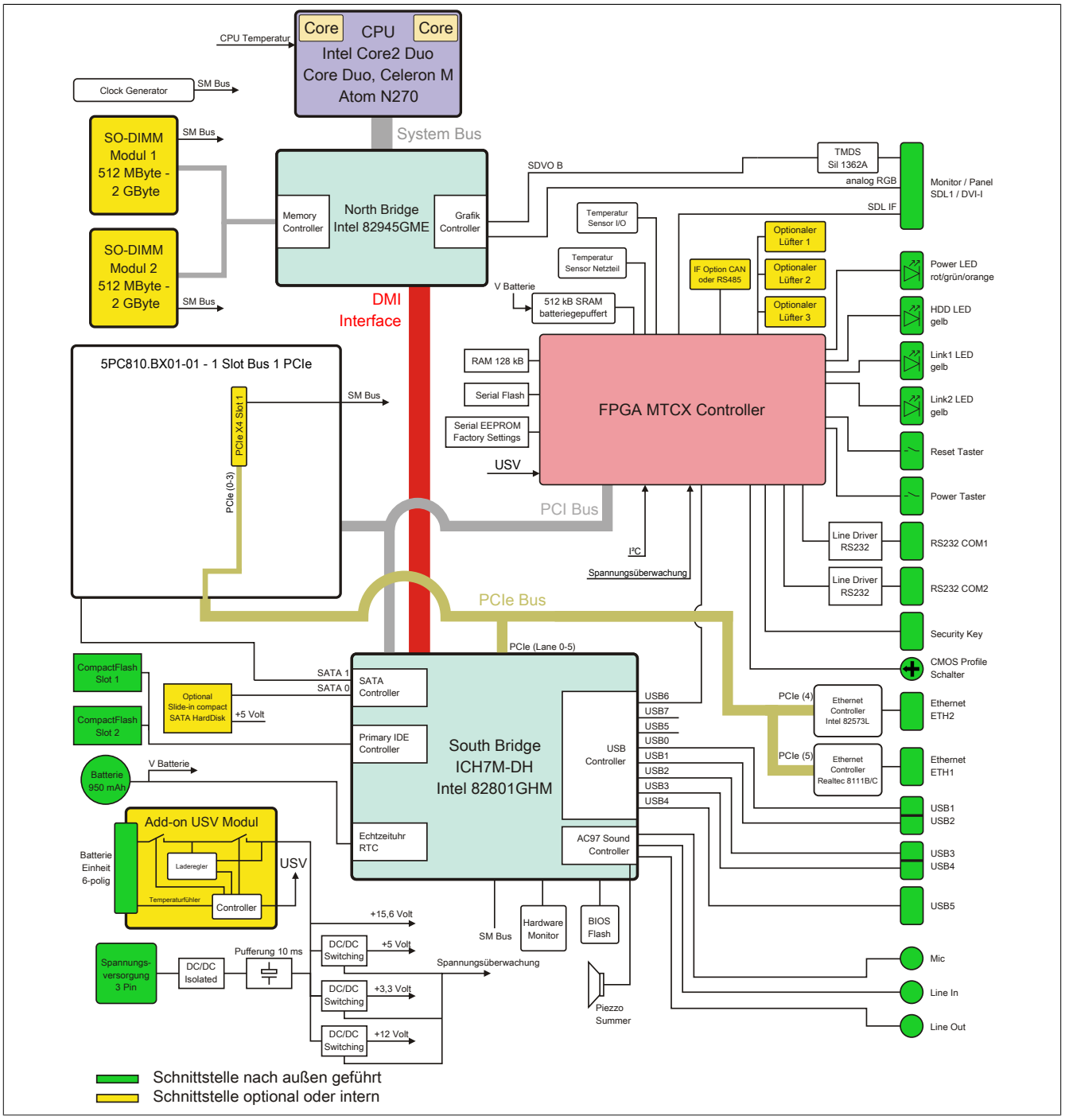


Abbildung 9: 5PC810.SX01-00 + 5PC810.BX01-01 Blockschaltbild

2.5.3 Systemeinheit 5PC810.SX02-00 + Buseinheit 5PC810.BX02-00

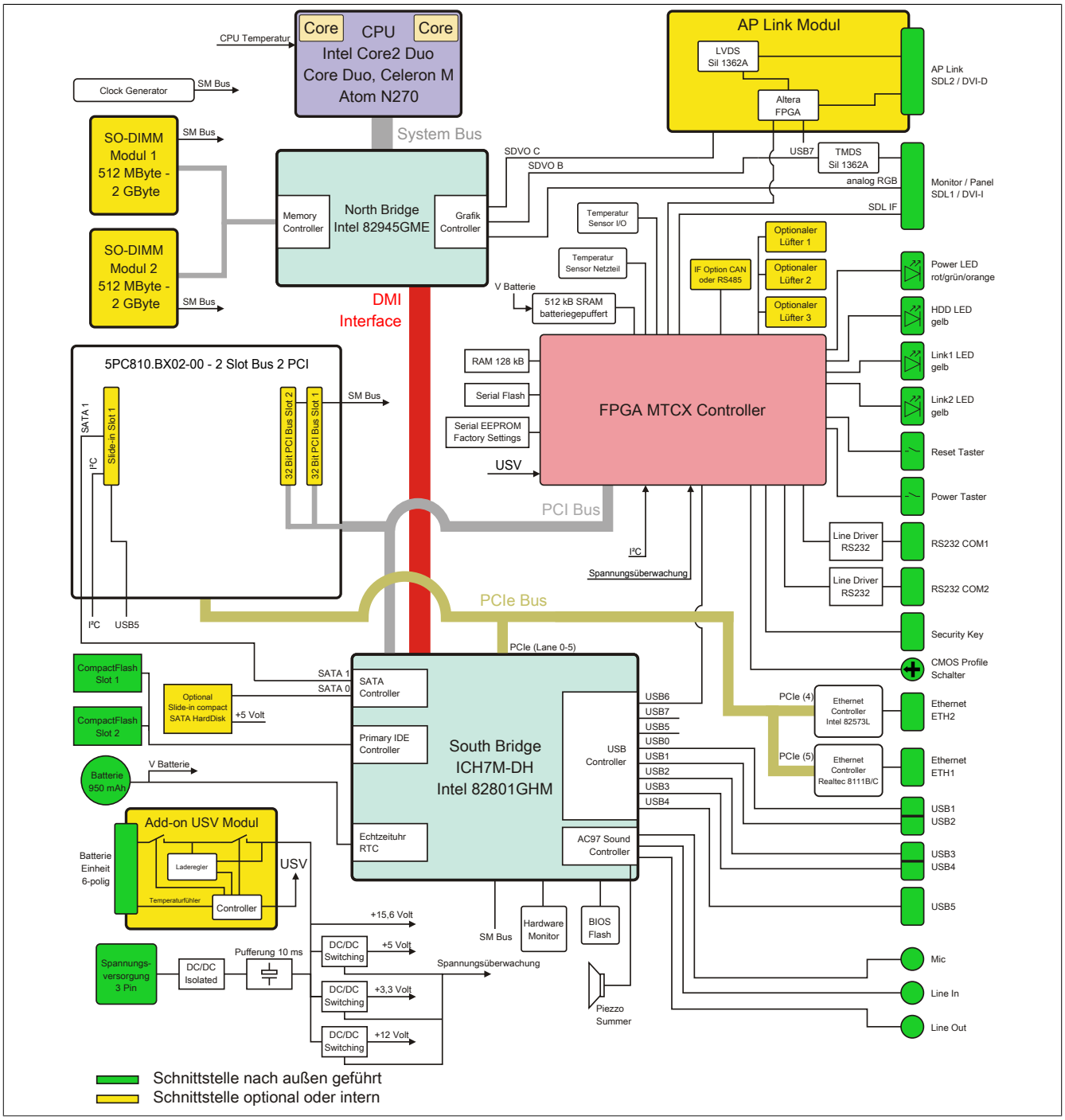


Abbildung 10: 5PC810.SX02-00 + 5PC810.BX02-00 Blockschaltbild

2.5.4 Systemeinheit 5PC810.SX02-00 + Buseinheit 5PC810.BX02-01

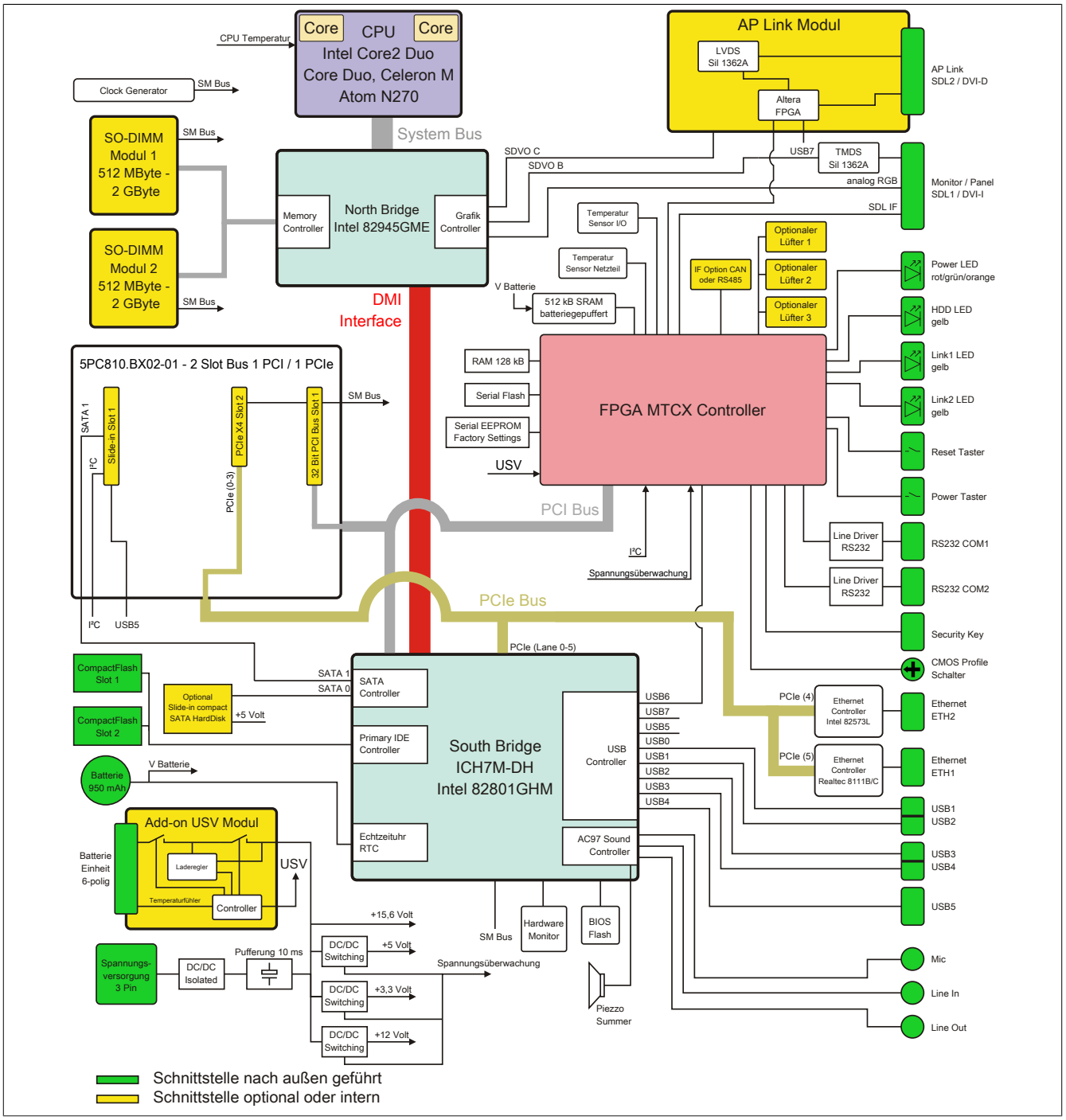


Abbildung 11: 5PC810.SX02-00 + 5PC810.BX02-01 Blockschaltbild

2.5.5 Systemeinheit 5PC810.SX03-00 + Buseinheit 5PC810.BX03-00

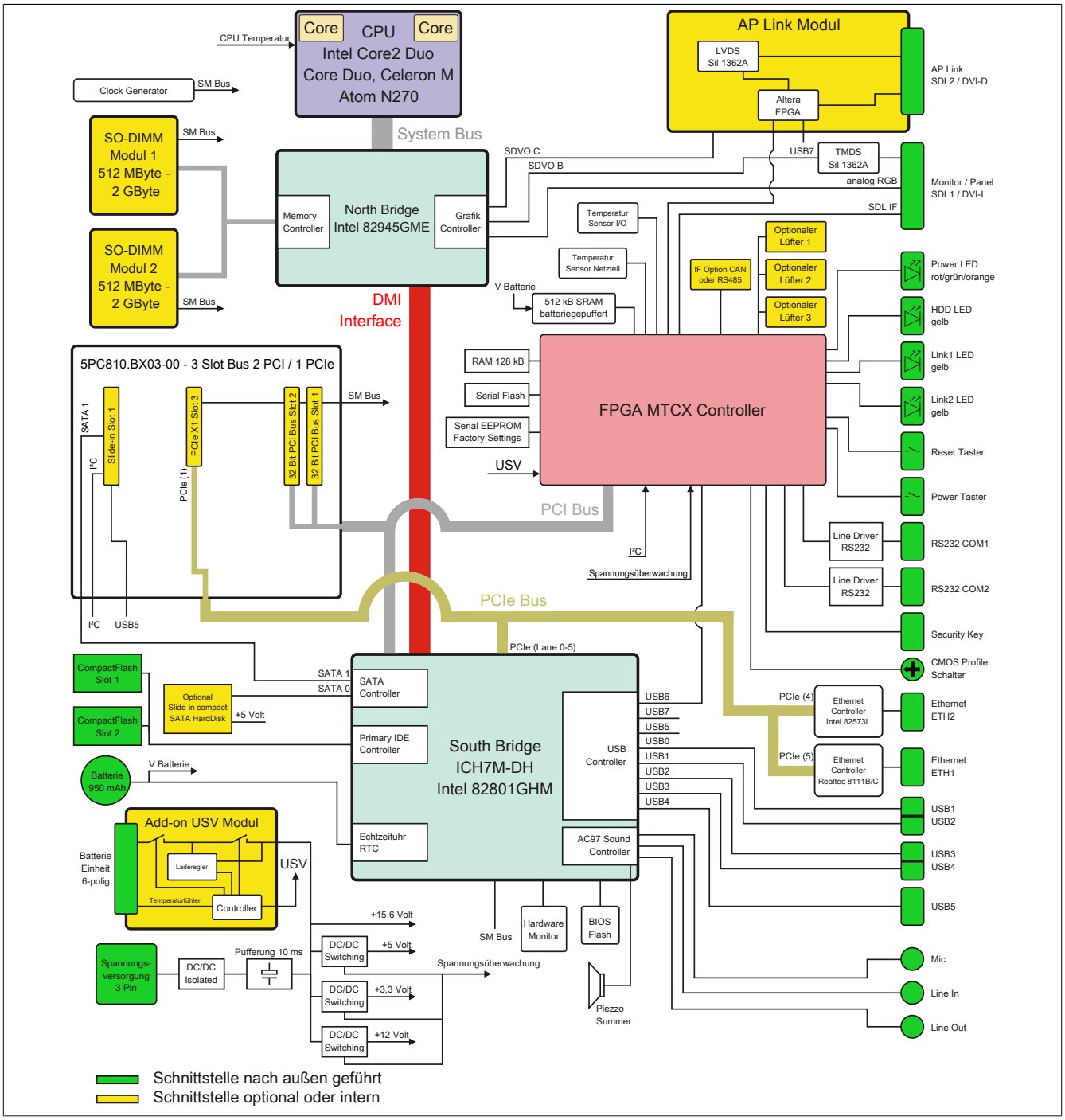


Abbildung 12: 5PC810.SX03-00 + 5PC810.BX03-00 Blockschaltbild

2.5.6 Systemeinheit 5PC810.SX05-00 + Buseinheit 5PC810.BX05-00

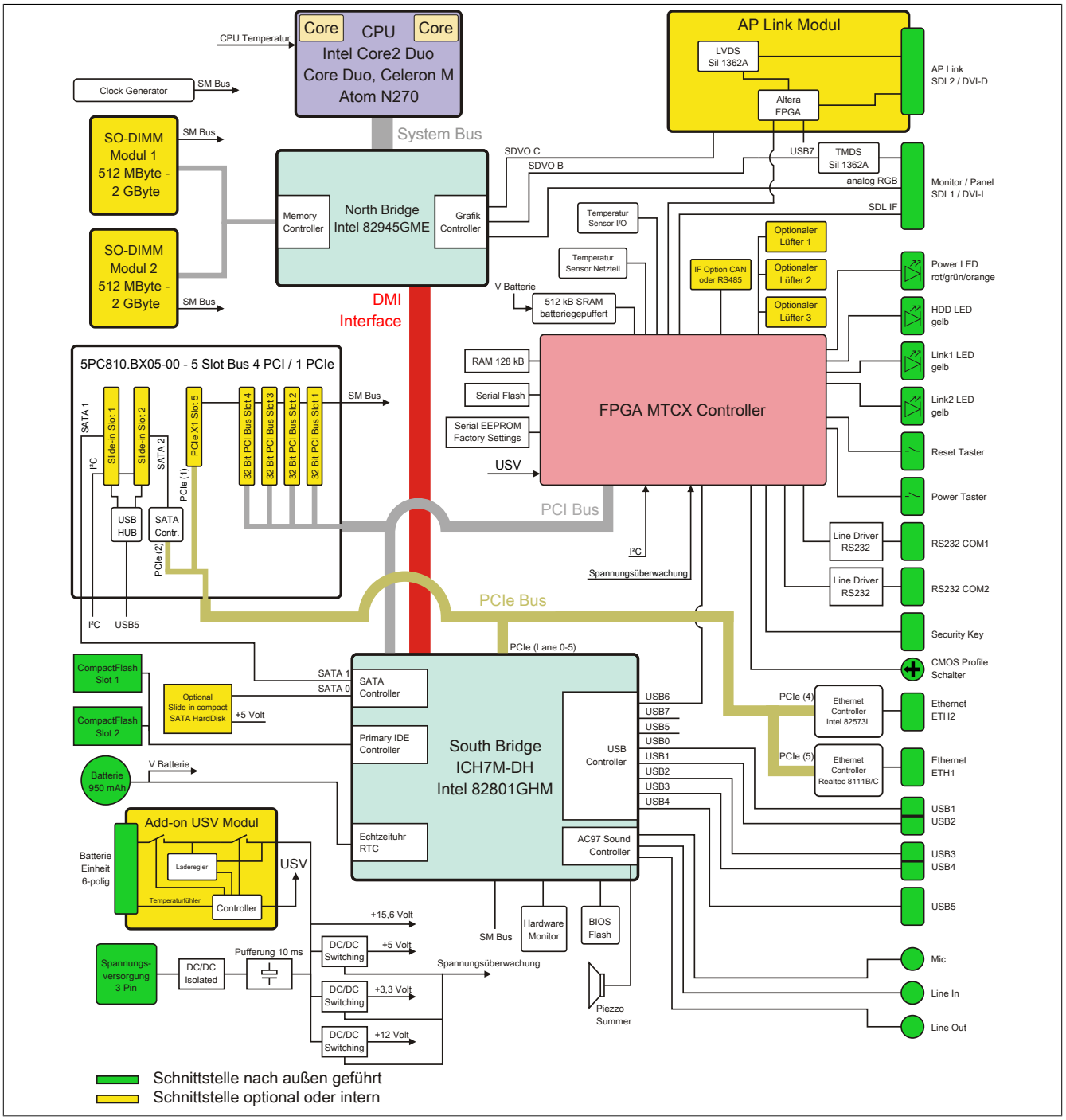


Abbildung 13: 5PC810.SX05-00 + 5PC810.BX05-00 Blockschaltbild

2.5.7 Systemeinheit 5PC810.SX05-00 + Buseinheit 5PC810.BX05-01

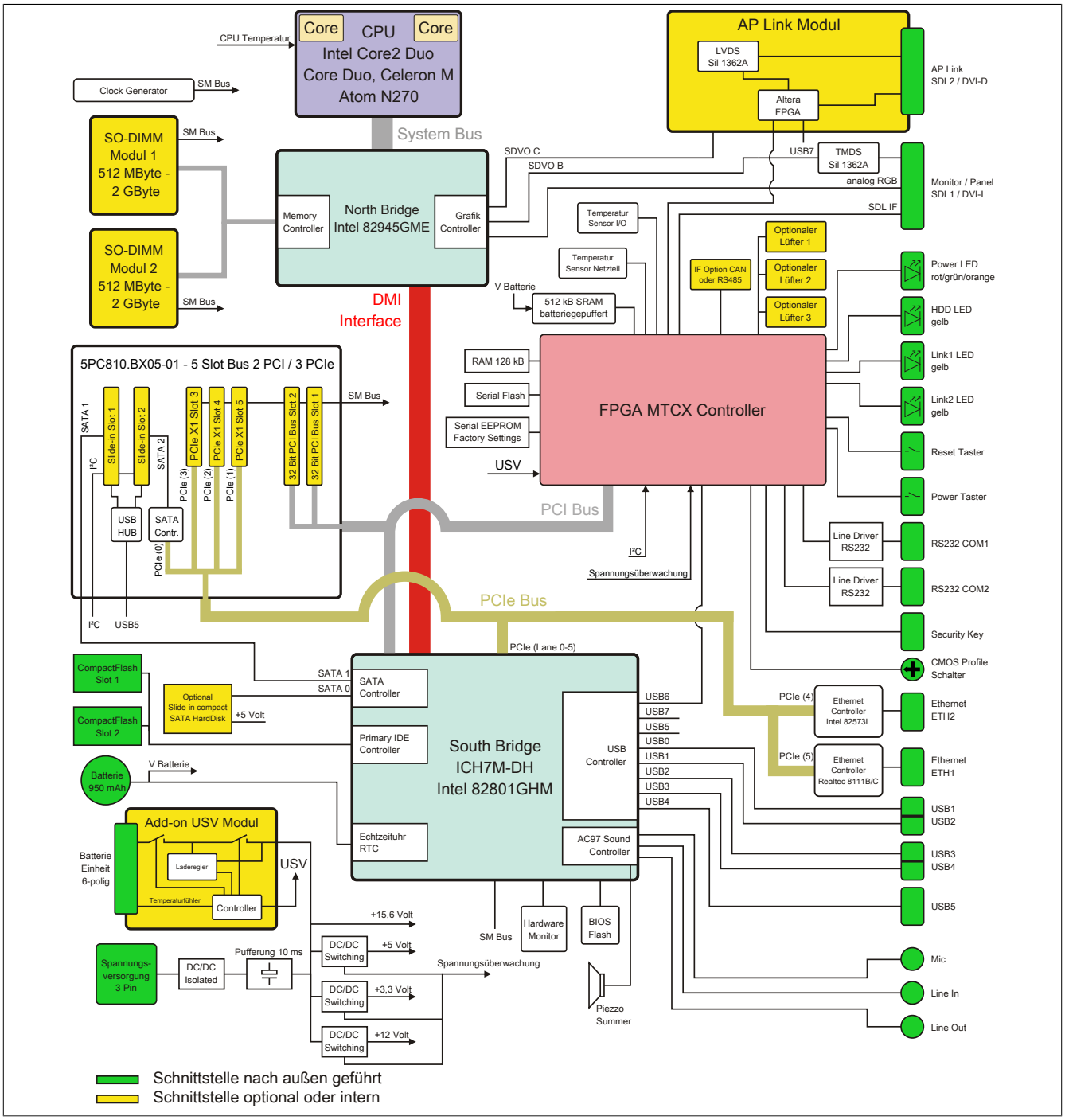


Abbildung 14: 5PC810.SX05-00 + 5PC810.BX05-01 Blockschaltbild

2.5.8 Systemeinheit 5PC810.SX05-00 + Buseinheit 5PC810.BX05-02

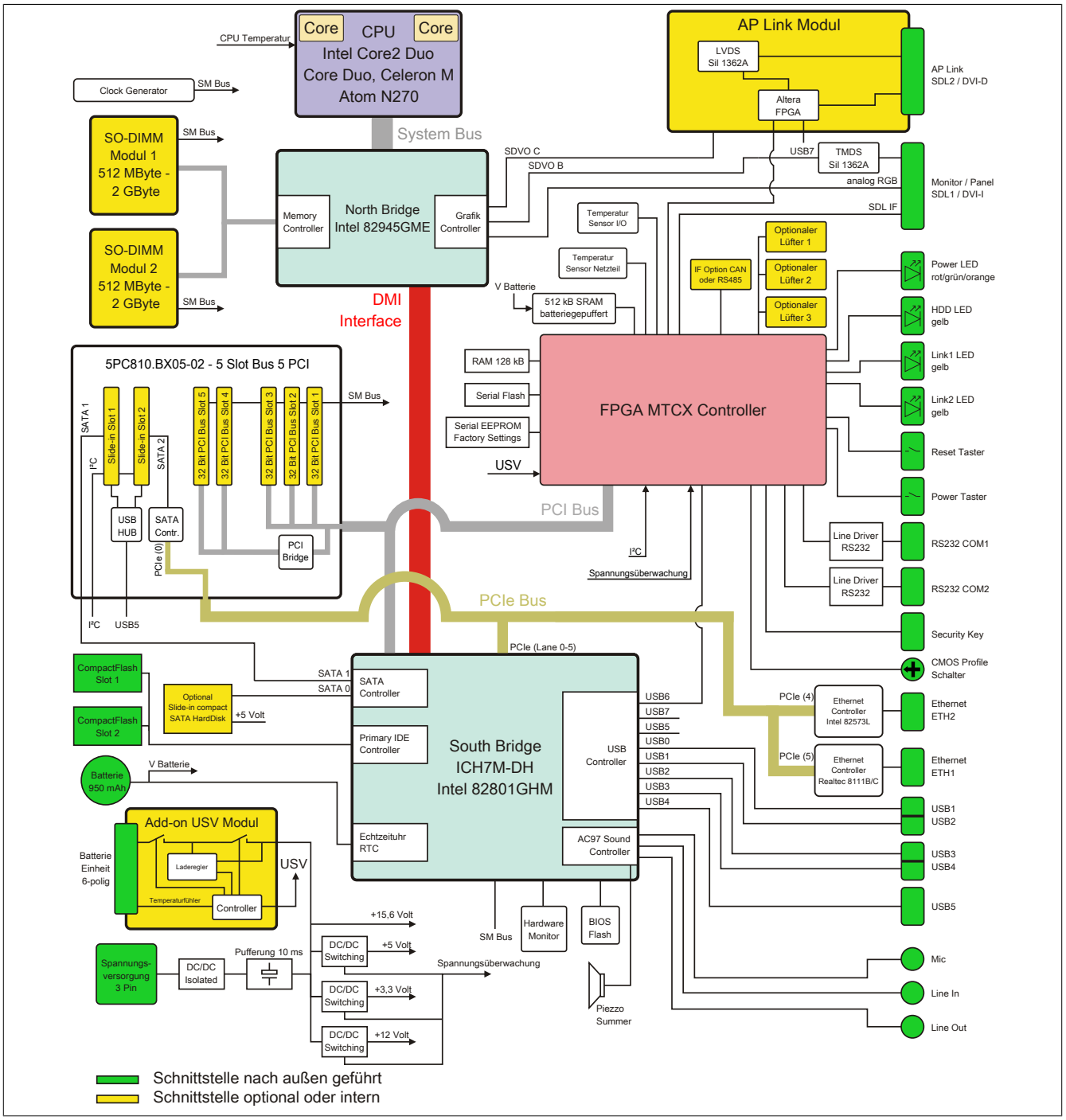


Abbildung 15: 5PC810.SX05-00 + 5PC810.BX05-02 Blockschaltbild

2.6 Geräteschnittstellen und Einschübe

2.6.1 Spannungsversorgung +24 VDC

Gefahr!

Das Gerät darf nur mit einem SELV / PELV Netzteil bzw. mit einer sicheren Kleinspannung (SELV) gemäß EN 60950 versorgt werden.

Der für den Anschluss der Spannungsversorgung notwendige 3-polige Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten. Dieser kann bei B&R unter der Best.Nr. 0TB103.9 (Schraubklemme) oder 0TB103.91 (Federzugklemme) bestellt werden.

Die Belegung der Pins ist entweder der folgenden Tabelle oder dem Aufdruck auf dem APC810 Gehäuse zu entnehmen. Die Versorgungsspannung wird intern durch eine fix aufgelötete Sicherung (15A, flink) abgesichert, sodass bei Überlast (Austausch der Sicherung notwendig) oder falschem Anschließen (Verpolungsschutz - kein Austausch der Sicherung notwendig) der Versorgungsspannung keine Beschädigung des Gerätes erfolgt. Wird die Sicherung in einem Fehlerfalle zerstört, so muss das Gerät an B&R zur Reparatur geschickt werden.

Spannungsversorgung	
verpolungssicher	Buchse, 3-polig, male
Pin	**Beschreibung**
1	+
2	Funktionserde
3	-
Bestellnummer	**Kurzbeschreibung**
	Feldklemmem
0TB103.9	Stecker 24 V 5.08 3p Schraubklemme
0TB103.91	Stecker 24 V 5.08 3p Federzugklemme

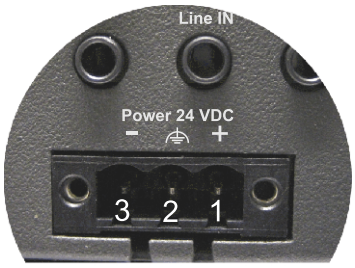


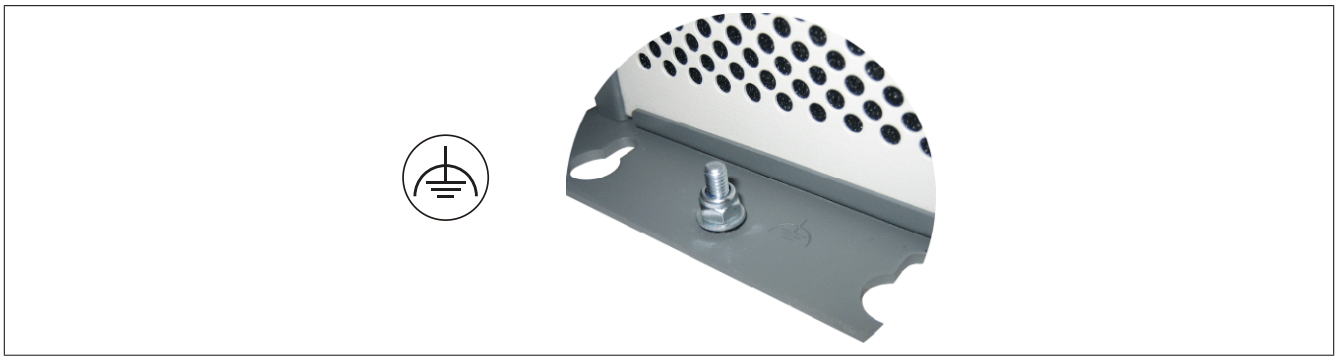
Tabelle 18: Spannungsversorgungsanschluss Power 24 VDC

2.6.1.1 Erdung

Vorsicht!

Die Funktionserde (Spannungsversorgung Pin 2 und Erdungsanschluss) muss möglichst kurz und mit dem größt möglichen Leiterquerschnitt am zentralen Erdungspunkt (z.B. dem Schaltschrank oder der Anlage) verbunden werden.

Die APC810 Systeme besitzen auf der Unterseite einen Erdungsanschluss.



Mit der M4 Sicherheitsmutter muss z.B. ein Kupferband, das an einem zentralen Erdungspunkt des Schaltschrankes oder der Anlage in der der APC810 eingebaut wird, befestigt werden. Der Leitungsquerschnitt sollte dabei so groß wie möglich (mindestens 2,5 mm²) gewählt werden.

2.6.2 Serielle Schnittstelle COM1

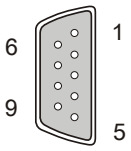
Serielle Schnittstelle COM1[1)]		
	RS232	DSUB-Buchse, 9-polig, male 
Typ	RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt	
UART	16550 kompatibel, 16 Byte FIFO	
Übertragungsgeschwindigkeit	max. 115 kBit/s	
Buslänge	max. 15 m	
Pin	**Belegung**	
1	DCD	
2	RXD	
3	TXD	
4	DTR	
5	GND	
6	DSR	
7	RTS	
8	CTS	
9	RI	

Tabelle 19: Pinbelegung COM1

1) Die am Gerät bzw. Modul verfügbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert. Diese Nummerierung kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.

2.6.3 Serielle Schnittstelle COM2

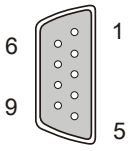
Serielle Schnittstelle COM2[1)]		
	RS232	DSUB-Buchse, 9-polig, male 
Typ	RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt	
UART	16550 kompatibel, 16 Byte FIFO	
Übertragungsgeschwindigkeit	max. 115 kBit/s	
Buslänge	max. 15 m	
Pin	**Belegung**	
1	DCD	
2	RXD	
3	TXD	
4	DTR	
5	GND	
6	DSR	
7	RTS	
8	CTS	
9	RI	

Tabelle 20: Pinbelegung COM2

1) Die am Gerät bzw. Modul verfügbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert. Diese Nummerierung kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.

2.6.4 Monitor / Panel Anschluss - SDL (Smart Display Link / DVI)

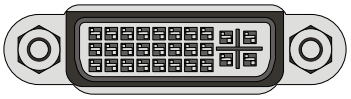
Monitor / Panel Anschluss - SDL (Smart Display Link) / DVI	
Die nachfolgende Übersicht zeigt einen Überblick der möglichen verfügbaren Videosignale beim Monitor / Panel Ausgang. Details siehe Technische Daten des verwendeten CPU Boards.	
CPU Board	**Videosignale mit allenSystemeinheitenvarianten**
5PC800.B945-00 / -10	RGB, DVI, SDL
5PC800.B945-01 / -11	RGB, DVI, SDL
5PC800.B945-02 / -12	RGB, DVI, SDL
5PC800.B945-03 / -13	RGB, DVI, SDL
5PC800.B945-04 / -14	RGB, DVI, SDL
5PC800.B945-05	RGB, DVI, SDL

Tabelle 21: Monitor / Panel Anschluss - RGB, DVI, SDL

Information:

Das hot-plugging der Anzeigegeräte am Monitor / Panel Anschluss wird nicht unterstützt.

Information:

Bei der RGB-Schnittstelle handelt es sich um ein analoges Signal, die mögliche Leitungslänge ist von der Auflösung sowie den herrschenden Umwelteinflüssen abhängig. Daher wird der Einsatz dieser Schnittstelle nur für Servicezwecke empfohlen.

2.6.4.1 Pinbelegung

Pin	Belegung	Beschreibung	Pin	Belegung	Beschreibung
1	TMDS Data 2-	DVI Lane 2 (negative)	16	HPD	Hot plug detect
2	TMDS Data 2+	DVI Lane 2 (positive)	17	TMDS Data 0-	DVI Lane 0 (negative)
3	TMDS Data 2/4 SHIELD	Shield of Data pair 2 and 4	18	TMDS Data 0+	DVI Lane 0 (positive)
4	SDL-	SDL Lane (negative)	19	TMDS Data 0/ XUSB1 SHIELD	Shield of Data pair 0 and USB1
5	SDL+	SDL Lane (positive)	20	XUSB1-	USB Lane 1 (negative)
6	DDC Clock	DDC based control signal (clock)	21	XUSB1+	USB Lane 1 (positive)
7	DDC Data	DDC based control signal (data)	22	TMDS Clock Shield	Shield of Clock pair
8	ANALOG VERT SYNC	Analog Vertical Synchronization	23	TMDS Clock+	DVI Clock (positive)
9	TMDS Data 1-	DVI Lane 1 (negative)	24	TMDS Clock -	DVI Clock (negative)
10	TMDS DATA 1+	DVI Lane 1 (negative) HDMI Clock (positive)	C1	ANALOG RED	Analog Red
11	TMDS DATA 1/ XUSB0 SHIELD	Shield of Data pair 1 and USB0	C2	ANALOG GREEN	Analog Green
12	XUSB0-	USB Lane 0 (negative)	C3	ANALOG BLUE	Analog Blue
13	XUSB0+	USB Lane 0 (positive)	C4	ANALOG HORZ SYNC	Analog Horizontal Synchronization
14	+5 V Power[1)]	+5V Power Supply	C5	ANALOG GND	Analog ground (Return for R, G and B signals)
15	Ground (return for +5 V, HSync and VSync)	Ground			

DVI, 24-polig, female

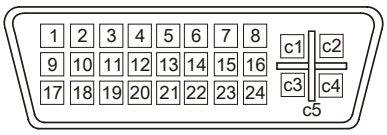


Tabelle 22: Pinbelegung DVI-Schnittstelle

1) Wird intern durch eine Multifuse abgesichert.

2.6.4.2 Kabellängen und Auflösungen bei SDL-Übertragung

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen Segmentlänge und max. Auflösung in Abhängigkeit des SDL-Kabels:

SDL-Kabel	Auflösung						
Segmentlänge [m]	VGA 640 x 480	SVGA 800 x 600	XGA 1024 x 768	HD 1366 x 768	SXGA 1280 x 1024	UXGA 1600 x 1200	FHD 1920 x 1080
0,8	5CASDL.0008-00	5CASDL.0008-00	5CASDL.0008-00	5CASDL.0008-00	5CASDL.0008-00	5CASDL.0008-00	5CASDL.0008-00
1,8	5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-03
5	5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-03
10	5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-03
15	5CASDL.0150-00 5CASDL.0150-01 5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-00 5CASDL.0150-01 5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-00 5CASDL.0150-01 5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-00 5CASDL.0150-01 5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-00 5CASDL.0150-01 5CASDL.0150-03	- - -	- - 5CASDL.0150-03
20	5CASDL.0200-00 5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-00 5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-00 5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-00 5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-00 5CASDL.0200-03	- -	- 5CASDL.0200-03
25	5CASDL.0250-00 5CASDL.0250-03	5CASDL.0250-00 5CASDL.0250-03	5CASDL.0250-00 5CASDL.0250-03	5CASDL.0250-00 5CASDL.0250-03	- -	- -	- -
30	5CASDL.0300-00 5CASDL.0300-03	5CASDL.0300-00 5CASDL.0300-03	- 5CASDL.0300-13	- 5CASDL.0300-13	- 5CASDL.0300-13	- -	- 5CASDL.0300-13
40	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	-	5CASDL.0400-13

Tabelle 23: Kabellängen und Auflösungen bei SDL-Übertragung

2.6.4.3 Kabellängen und Auflösungen bei DVI-Übertragung

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen Segmentlänge und max. Auflösung in Abhängigkeit des DVI-Kabels:

DVI-Kabel	Auflösung						
Segmentlänge [m]	VGA 640 x 480	SVGA 800 x 600	XGA 1024 x 768	HD 1366 x 768	SXGA 1280 x 1024	UXGA 1600 x 1200	FHD 1920 x 1080
1,8	5CADVI.0018-00	5CADVI.0018-00	5CADVI.0018-00	5CADVI.0018-00	5CADVI.0018-00	5CADVI.0018-00	5CADVI.0018-00
5	5CADVI.0050-00	5CADVI.0050-00	5CADVI.0050-00	5CADVI.0050-00	5CADVI.0050-00	5CADVI.0050-00	5CADVI.0050-00

Tabelle 24: Kabellängen und Auflösungen bei DVI-Übertragung

Die maximale Kabellänge bei der DVI-Übertragung ist aufgrund der USB-Spezifikation auf 5 m begrenzt.

2.6.5 Ethernet 1 (ETH1)

Dieser Ethernet Controller ist im CPU Board integriert und wird über die Systemeinheit nach außen geführt.

Ethernet 1 Anschluss (ETH1[1])			
Controller	Realtek RTL8111B/C[2]		RJ45-Buchse, female
Verkabelung	S/STP (Cat5e)		
Übertragungsgeschwindigkeit	10/100/1000 MBit/s[3]		
Kabellänge	max. 100 m (min. Cat5e)		
Speed LED	**Ein**	**Aus**	
Grün	100 MBit/s	10 MBit/s[4]	
Orange	1000 MBit/s	-	
Link LED	**Ein**	**Aus**	
Orange	Link (Eine Verbindung zu einem Ethernet Netzwerk ist vorhanden)	Activity (blinkt) (Daten werden übertragen)	

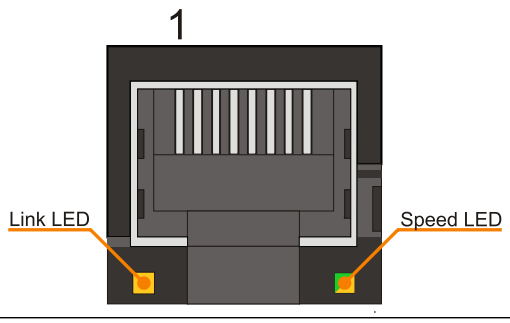


Tabelle 25: Ethernet Anschluss (ETH1)

1) Die am Gerät bzw. Modul verfügbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert. Diese Nummerierung kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.
2) Bei den CPU Boards 5PC800.B945-00, -01, -02, -03, -04 ist der Realtek 8111B integriert.
Bei den CPU Boards 5PC800.B945-05 und 5PC800.B945-10, -11, -12, -13, -14 ist der Realtek 8111C integriert.
3) Umschaltung erfolgt automatisch.
4) Die 10 MBit/s Übertragungsgeschwindigkeit / Verbindung ist nur vorhanden, wenn zeitgleich die Link LED aktiv ist.

Wichtige Information zur Übertragungsgeschwindigkeit

Auf Grund thermischer Gegebenheiten ist der Betrieb der ETH1 im 1000 MBit/s Modus mit den CPU Boards 5PC800.B945-00, -01, -02, -03, -04 nur unter Verwendung eines Lüfter Kits oder Verwendung von Kühlkörpern (5AC801.HS00-00, 5AC801.HS00-01) ab Rev. D0 (siehe "Temperaturangaben" auf Seite 32) erlaubt. Bei den CPU Boards 5PC800.B945-10, -11, -12, -13, -14 mit den Kühlkörpern 5AC801.HS00-00 und 5AC801.HS00-01 und dem CPU Board 5PC800.B945-05 mit dem Kühlkörper 5AC801.HS00-02 entfällt diese Limitierung.

Treibersupport

Für den Betrieb des Realtek Ethernet-Controllers RTL8111B/C ist ein spezieller Treiber notwendig. Es stehen für die freigegebenen Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage www.br-automation.com Treiber zum Download bereit.

Information:

Benötigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzuladen.

2.6.6 Ethernet 2 (ETH2)

Dieser Ethernet Controller ist im Basisboard integriert und wird über die Systemeinheit nach außen geführt.

Ethernet 2 Anschluss (ETH2[1])			
Controller	Intel 82573L		RJ45-Buchse, female
Verkabelung	S/STP (Cat5e)		
Übertragungsgeschwindigkeit	10/100/1000 MBit/s[2]		
Kabellänge	max. 100 m (min. Cat5e)		
Speed LED	**Ein**	**Aus**	
Grün	100 MBit/s	10 MBit/s[3]	
Orange	1000 MBit/s	-	
Link LED	**Ein**	**Aus**	
Orange	Link (Eine Verbindung zu einem Ethernet Netzwerk ist vorhanden)	Activity (blinkt) (Daten werden übertragen)	

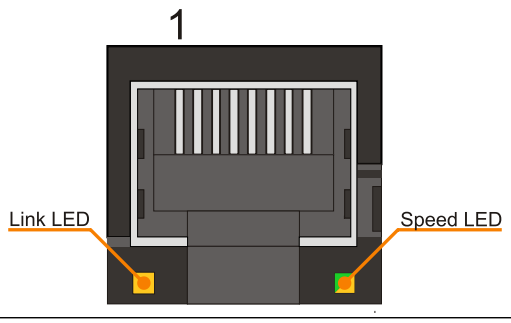


Tabelle 26: Ethernet Anschluss (ETH2)

1) Die am Gerät bzw. Modul verfügbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert. Diese Nummerierung kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.
2) Umschaltung erfolgt automatisch.
3) Die 10 MBit/s Übertragungsgeschwindigkeit / Verbindung ist nur vorhanden, wenn zeitgleich die Link LED aktiv ist.

Treibersupport

Für den Betrieb des Intel Ethernet-Controllers 82573L ist ein spezieller Treiber notwendig. Es stehen für die freigegebenen Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage www.br-automation.com Treiber zum Download bereit.

Information:

Benötigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzuladen.

2.6.7 USB Schnittstellen (USB1, 2, 3, 4, 5)

Die APC810 Geräte verfügen über einen USB 2.0 (Universal Serial Bus) Host Controller mit mehreren USB Ports, wovon 5 nach außen geführt und für den Anwender frei verfügbar sind.

Warnung!

An die USB-Schnittstellen können USB-Peripheriegeräte angeschlossen werden. Auf Grund der Vielfältigkeit der am Markt erhältlichen USB-Geräte, kann B&R keine Garantie für deren Funktion übernehmen. Für die bei B&R erhältlichen USB-Geräte wird die Funktion gewährleistet.

Information:

Weitere Informationen siehe 3 "Inbetriebnahme", Abschnitt "Anschluss von USB Peripheriegeräten" auf Seite 232.

Vorsicht!

Auf Grund der allgemeinen PC- Spezifikation ist diese Schnittstelle mit äußerster Sorgfalt bezüglich EMV, Kabelführung etc. zu behandeln.

USB1,2,3,4

Universal Serial Bus (USB1, USB2, USB3, USB4[1])		
Typ	USB 2.0	4 x USB Typ A, female
Ausführung	Typ A	
Übertragungsgeschwindigkeit	Low Speed (1,5 MBit/s),Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)	
Strombelastbarkeit[2] USB1, USB3 USB2, USB4	 max. 1 A max. 500 mA	
Kabellänge	max. 5 m (ohne Hub)	

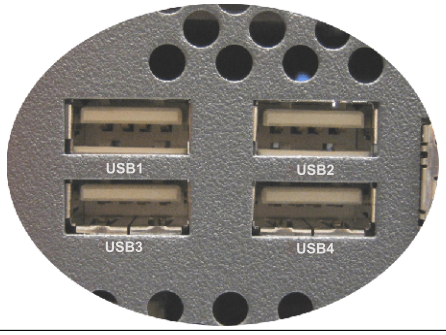


Tabelle 27: USB1, USB2, USB3, USB4 Anschluss

1) Die am Gerät bzw. Modul verfügbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert. Diese Nummerierung kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.
2) Jeder USB Port wird durch einen wartungsfreien „USB Strombegrenzungsschalter“ (max. 500 mA bzw. 1 A) abgesichert.

USB5

Universal Serial Bus (USB5)[1]		
Typ	USB 2.0	1 x USB Typ A, female
Ausführung	Typ A	
Übertragungsgeschwindigkeit	Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)	
Stromversorgung[2] USB5	 max. 1 A	
Kabellänge	max. 5 m (ohne Hub)	

Tabelle 28: USB5 Anschluss

1) Die am Gerät bzw. Modul verfügbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert. Diese Nummerierung kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.
2) Der USB Port wird durch einen wartungsfreien „USB Strombegrenzungsschalter“ (max. 1 A) abgesichert.

2.6.8 MIC, Line IN, Line OUT

Bei allen APC810 Systemen ist ein AC97 (Rev. 2.2) kompatibler Soundchip vorhanden bei dem die Kanäle MIC, Line IN und Line OUT von außen zugänglich sind.

MIC, Line IN, Line OUT		
Controller	Realtek AC97 Rev. 2.2	3,5 mm Klinkenanschluss, female
MIC	Anschluss eines Mono Mikrofon über 3,5 mm Klinkenstecker.	
Line IN	Einspeisung eines Stereo Line in Signals über 3,5 mm Klinkenstecker.	
Line OUT	Anschluss eines Stereo Wiedergabegerätes (z.B. Verstärker) über einen 3,5 mm Klinkenstecker.	

Tabelle 29: MIC, Line IN, Line OUT

Treibersupport

Für den Betrieb des Audio Controllers ist ein spezieller Treiber notwendig. Es stehen für die freigegebenen Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) Treiber zum Download bereit.

> **Information:**
>
> **Benötigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzuladen.**

2.6.9 Add-on Schnittstellensteckplatz

Hier kann eine optionale Add-on Schnittstelle (z.B. CAN, RS485) gesteckt werden. Siehe auch "Schnittstellenoptionen (IF Option)" auf Seite 191.

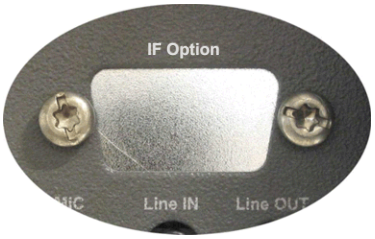
Add-on Schnittstellensteckplatz	
Bestellnummer	**Kurzbeschreibung**
	Serialadapter
5AC600.CANI-00	Add-on CAN Interface
5AC600.458I-00	Add-on RS232/422/458 Interface
	

Tabelle 30: Add-on Schnittstellensteckplatz

2.6.10 Add-on USV Steckplatz

An diesem Steckplatz kann ein optionales Automation PC Add-on USV Modul oder das APC810 Ready Relais /2 montiert werden.

Add-on USV Steckplatz	
Pinbelegung bei montiertem Add-on USV Modul	
1	+
2	+
3	-
4	-
5	NTC (für Batterietemperaturmessung)
6	NTC (für Batterietemperaturmessung)
Bestellnummer	**Kurzbeschreibung**
	Unterbrechungsfreie Stromversorgung
5AC600.UPSI-00	Add-on USV Modul
5AC600.UPSB-00	Batterieeinheit 5 Ah
5CAUPS.0005-00	USV Kabel 0,5 m
5CAUPS.0030-00	USV Kabel 3 m
	APC810 Ready Relais
5AC801.RDYR-01	APC810 Ready Relais /2

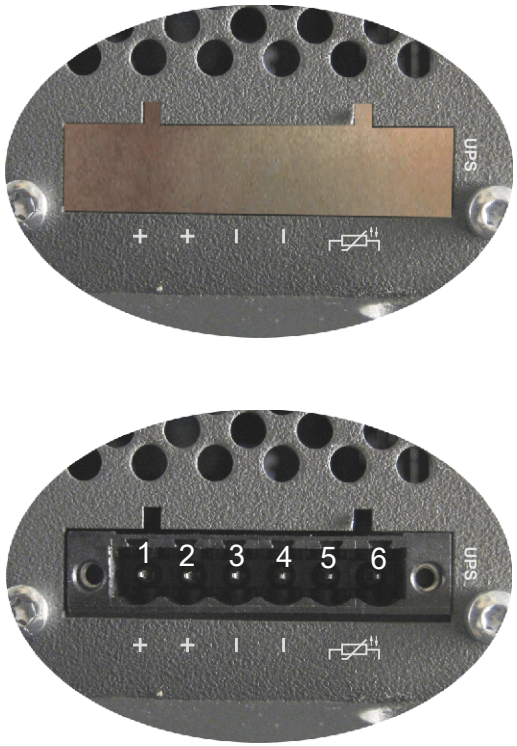


Tabelle 31: Add-on USV Steckplatz (ohne und mit montierter USV)

Informationen zum USV Modul siehe "Zubehör", Abschnitt "Unterbrechungsfreie Stromversorgung".

Informationen zum Ready Relais siehe 3.9 "Ready Relais" auf Seite 189.

2.6.11 AP Link Steckplatz

In Verbindung mit der AP Link Steckkarte 5AC801.SDL0-00 besteht die Möglichkeit, einen zweiten Grafikstrang mit DVI und SDL aber ohne RGB Signalen zu realisieren. Weiters kann das APC810 Ready Relais 5AC801.RDYR-00 montiert werden.

Information:

Die Montage von AP Link Steckkarten ist nur in Verbindung mit den Systemeinheiten 5PC810.SX02-00, 5PC810.SX03-00 und 5PC810.SX05-00 möglich.

2.6.12 Card Slot Steckplatz (PCI / PCIe)

Je nach Variante der Buseinheit können Standard PCI 2.2 half-size Karten bzw. PCI Express (PCIe) half-size Karten gesteckt werden. Diese dürfen die nachfolgenden Abmessungen nicht überschreiten.

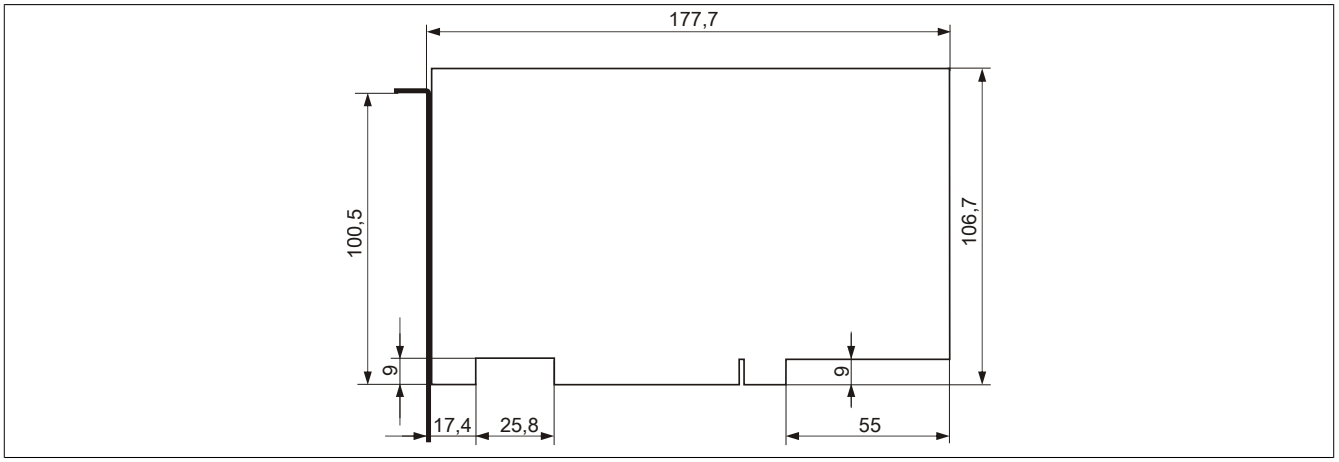


Abbildung 16: Abmessungen Standard half-size 32-Bit PCI-Karte

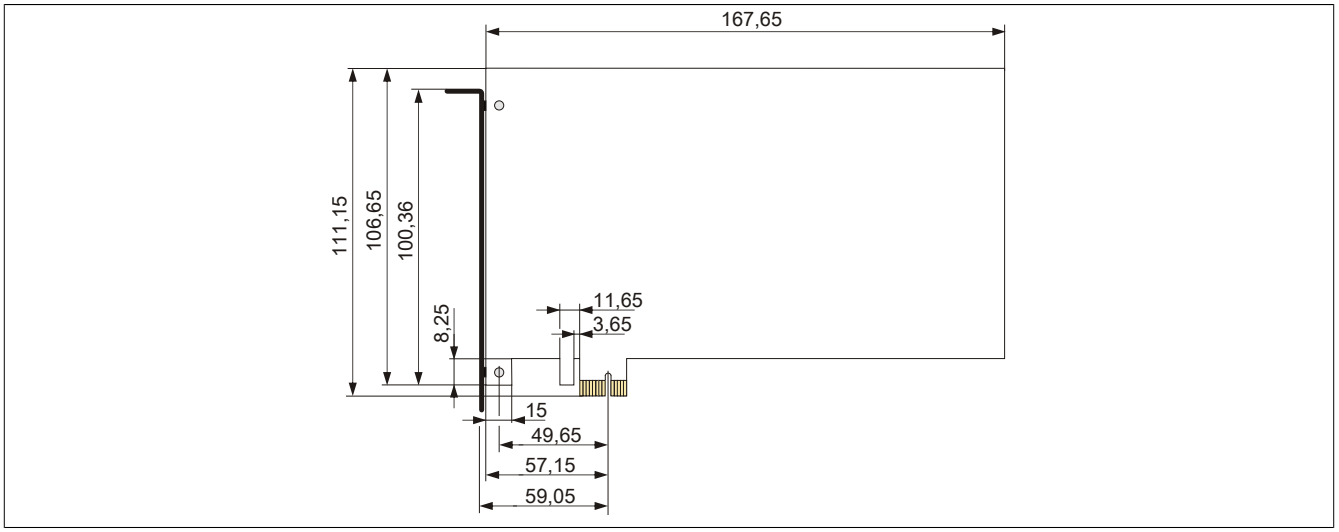
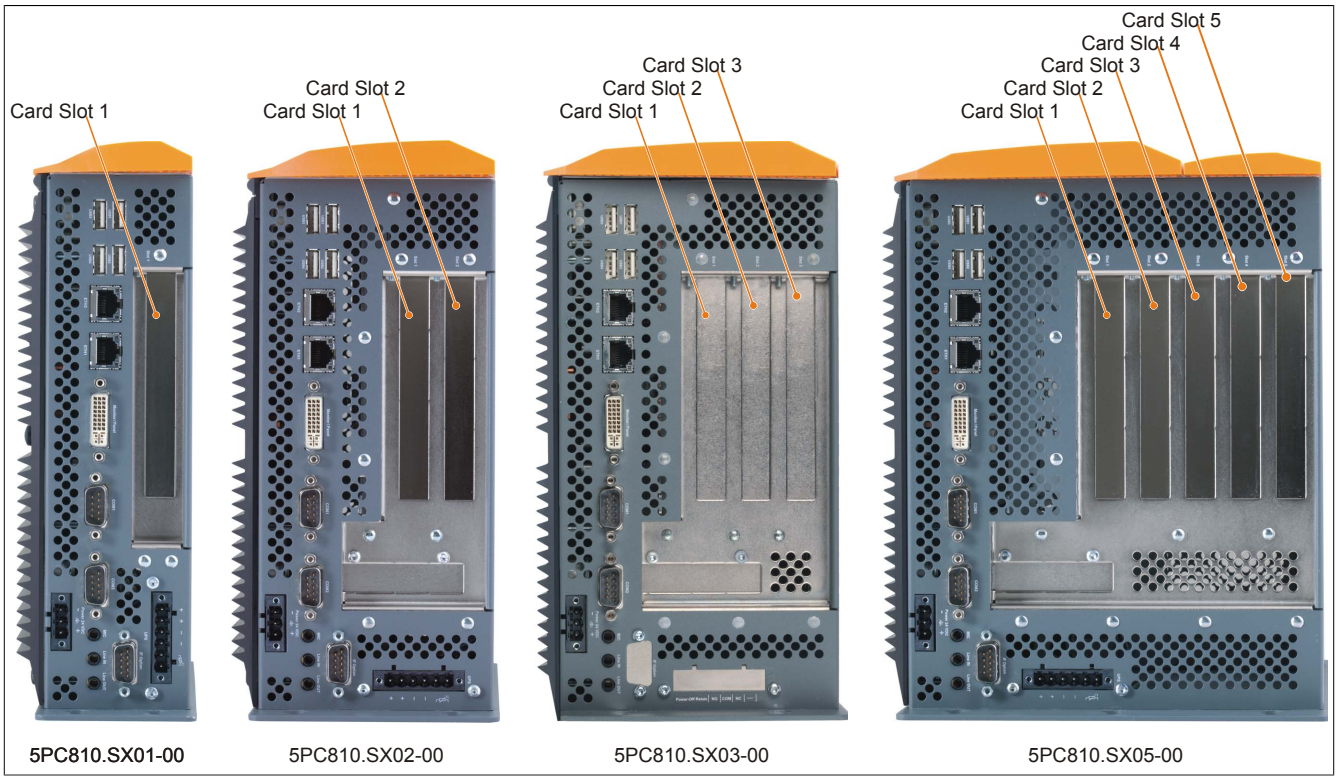


Abbildung 17: Abmessungen Standard half-size PCIe-Karte

Aufgrund mechanischer Einschränkungen kann eine 64-Bit PCI Karte nicht in jede Systemeinheit bzw. jeden Card Slot gesteckt werden. Nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht in welchen Card Slot das Stecken von 64-Bit Karten möglich ist.

		Card Slot 1	Card Slot 2	Card Slot 3	Card Slot 4	Card Slot 5
Systemeinheit	**Buseinheit**					
5PC810.SX01-00	5PC810.BX01-00	32-Bit PCI				
	5PC810.BX01-01	PCIe				
5PC810.SX02-00	5PC810.BX02-00	32 und 64-Bit PCI	32-Bit PCI			
	5PC810.BX02-01	32 und 64-Bit PCI	PCIe			
5PC810.SX03-00	5PC810.BX03-00	32 und 64-Bit PCI	32-Bit PCI	PCIe		
5PC810.SX05-00	5PC810.BX05-00	32 und 64-Bit PCI	32 und 64-Bit PCI	32 und 64-Bit PCI	32-Bit PCI	PCIe
	5PC810.BX05-01	32 und 64-Bit PCI	32 und 64-Bit PCI	PCIe	PCIe	PCIe
	5PC810.BX05-02	32 und 64-Bit PCI	32 und 64-Bit PCI	32 und 64-Bit PCI	32 und 64-Bit PCI	32 und 64-Bit PCI

Tabelle 32: Übersicht 64-Bit Karten



5PC810.SX01-00 5PC810.SX02-00 5PC810.SX03-00 5PC810.SX05-00

2.6.13 Status LEDs

Die Status LEDs sind in der Systemeinheit integriert und befinden sich hinter der orangen Frontabdeckung.

Status LEDs			
LED	**Farbe**	**Status**	**Bedeutung**
Power	Grün	Ein	Spannungsversorgung OK
	Rot	Ein	Das System befindet sich im Stromspar- Standby Modus (S5: Soft-off Modus; S4: Hibernate Modus -Suspend-to-Disk oder S3: Suspend-to-RAM)
	Orange[1)]	Ein	Spannungsversorgung nicht OK; das System läuft im Batteriebetrieb.
HDD	Gelb	Ein	Signalisiert einen IDE Laufwerkszugriff (CF, HDD, CD, usw.)
Link1	Gelb	Ein	Zeigt eine aktive SDL Verbindung am Monitor / Panel Stecker an.
		Blinkend	Eine aktive SDL Verbindung wurde durch einen Spannungsverlust der Displayeinheit unterbrochen.
Link2	Gelb	Ein	Zeigt eine aktive SDL Verbindung am AP Link an.
		Blinkend	Eine aktive SDL Verbindung am AP Link wurde durch einen Spannungsverlust der Displayeinheit unterbrochen.

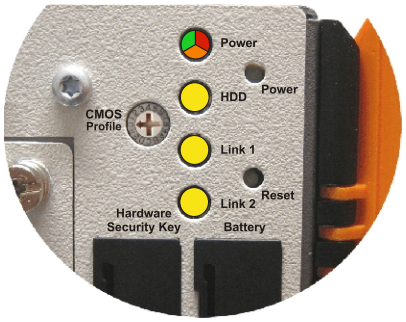


Tabelle 33: Daten Status LEDs

1) Leuchtet nur bei installierter Add-on USV.

Das Licht der Status LEDs wird über Lichtleiter an die Vorderseite der Frontabdeckung geführt.

Abbildung 18: Status LEDs Vorderseite

2.6.14 CMOS Profile Schalter

CMOS Profile Schalter	
Mit dem 16 stelligen CMOS Profile Schalter können verschiedene BIOS Defaultwerteprofile eingestellt werden.	
Schalterstellung	**Beschreibung**
0	Profil 0: Defaultprofil reserviert.
1	**Profil 1: Optimiert für die Systemeinheiten 5PC810.SX01-00, 5PC810.SX02-00 und 5PC810.SX03-00**
2	**Profil 2: Optimiert für die Systemeinheit 5PC810.SX05-00**
3	Profil 3: Optimiert für die Systemeinheit 5PC820.SX01-00 und 5PC820.SX01-01
4	Profil 4: Reserviert
5	Profil 5: Optimiert für die Systemeinheiten 5PC820.1505-00 und 5PC820.1906-00

Tabelle 34: CMOS Profile Schalter

Information:

Die bei der Lieferung eingestellte Position des Schalters stellt die optimalen BIOS Defaultwerte für dieses System dar und sollte daher nicht geändert werden.

Die Position des CMOS Profile Schalters wird unter anderem in den BIOS Setupseiten und im B&R ADI Control Center angezeigt.

2.6.15 Power Taster

Auf Grund der vollen ATX-Netzteilunterstützung besitzt der Power Taster verschiedenste Funktionalitäten.

Power Taster	
Der Power Taster kann mit einem spitzen Gegenstand (z.B. mit einer Kugelschreiberspitze) betätigt werden. Der Power Taster verhält sich wie z.B. der Netzschalter bei aktuellen Desktop PCs mit ATX-Netzteil: **kurzes Drücken** ... APC810 einschalten bzw. Betriebssystem herunterfahren und APC810 ausschalten. **langes Drücken** ... ATX-Netzteil schaltet ohne herunterfahren den APC810 aus (**Datenverlust möglich!**). Beim Drücken des Power Tasters wird der MTCX Prozessor nicht resetiert.	

Tabelle 35: Power Taster

2.6.16 Reset Taster

Information:

Ab der MTCX PX32 Firmware ≥ V00.11 ist der Reset Taster nur mehr Flanken getriggert, das heißt, dass das Gerät trotz gedrückter Reset Taste durchbootet. Bei MTCX PX32 Firmware < V00.11 startet das System bei längerem Drücken (ca. 10 Sekunden) und wieder loslassen des Reset Tasters nicht mehr.

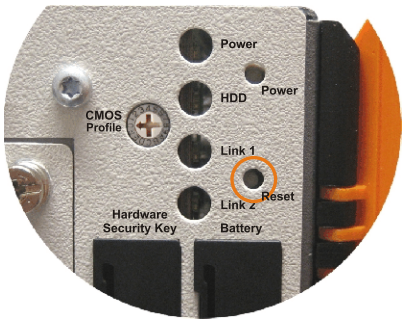
Reset Taster	
Der Reset-Taster kann mit einem spitzen Gegenstand (z.B. mit einer Kugelschreiberspitze) betätigt werden. Wenn der Reset Taster betätigt wird, wird ein Hardware-Reset, PCI-Reset ausgelöst. Der APC810 startet neu (Kaltstart). Bei einem Reset wird der MTCX Prozessor nicht resetiert.	

Tabelle 36: Reset Taster

Warnung!

Ein Reset des Systems kann zu Datenverlust führen!

2.6.17 Batterie

Die Lithiumbatterie (3 V, 950 mAh) stellt die Pufferung der internen Echtzeituhr (RTC), der individuell gespeicherten BIOS Einstellungen sowie der Daten im SRAM sicher und befindet sich hinter der schwarzen Abdeckung. Die Pufferdauer der Batterie beträgt mindestens 2½ Jahre (bei 50°C, 8,5 µA der zu versorgenden Komponenten und einer Selbstentladung von 40%). Die Batterie stellt ein Verschleißteil dar und sollte regelmäßig (mindestens nach der angegebenen Lebensdauer) per Batteriewechsel erneuert werden.

Batterie		
Batterie Typ Tauschbar Lebensdauer	 Renata 950 mAh Ja, von außen zugänglich 2½ Jahre[1)]	
Bestellnummer	**Kurzbeschreibung**	
	Batterien	
0AC201.91	Lithium Batterien 4 Stück, 3 V, 950 mAh Knopfzelle	
4A0006.00-000	Lithium Batterie 1 Stück, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle	

Tabelle 37: Batterie

1) Bei 50°C, 8,5 µA der zu versorgenden Komponenten und einer Selbstentladung von 40%.

Batteriestatusermittlung

Der Batteriestatus wird sofort nach dem Einschalten des Gerätes und in weiterer Folge alle 24 Stunden vom System ermittelt. Bei der Messung wird kurzzeitig (ca. 1 Sekunde) die Batterie belastet und anschließend bewertet. Der ermittelte Batteriestatus wird in den BIOS Setup Seiten (unter Advanced - Baseboard/Panel Features - Baseboard Monitor) und im B&R Control Center (ADI Treiber) angezeigt, kann aber auch in einer Kundenapplikation über die ADI Library ausgelesen werden.

Batteriestatus	Bedeutung
N/A	Es wird eine zu alte Hardware bzw. Firmware verwendet die das Auslesen nicht unterstützt.
GOOD	Pufferung der Daten ist gewährleistet.
BAD	Ab dem Zeitpunkt, ab dem die Batteriekapazität als BAD (nicht ausreichend) erkannt wird, ist eine Pufferung der Daten noch für ca. 500 Stunden gewährleistet.

Tabelle 38: Bedeutung Batteriestatus

Ab dem Zeitpunkt, ab dem die Batteriekapazität als nicht ausreichend erkannt wird, ist eine Pufferung der Daten noch für ca. 500 Stunden gewährleistet. Beim Wechseln der Batterie werden die Daten noch ca. 10 Minuten durch einen Goldfolienkondensator gepuffert.

2.6.18 Hardware Security Key (Dongle)

Als Hardware Security Key (Dongle) für den Kopierschutz der Software empfiehlt B&R einen Dongle basierend auf dem DS1425 von MAXIM (früher Dallas Semiconductors).

Hardware Security Key	
Hinter der schwarzen Abdeckung kann ein Hardware Security Key (Dongle) gesteckt werden.	

Tabelle 39: Hardware Security Key

Warnung!

Ein- und Ausbau des Hardware Security Keys darf nur in spannungslosem Zustand erfolgen!

2.6.19 CompactFlash Slot 1

Dieser CompactFlash Slot ist fixer Bestandteil eines APC810 Systems und ist intern über IDE PATA mit dem Chipset verbunden. Es können CompactFlash Karten des Types I gesteckt werden.

CompactFlash Slot (CF1)	
Anschluss	PATA Master
CompactFlash Typ	Typ I
Bestellnummer	**Kurzbeschreibung**
	CompactFlash
5CFCRD.0512-06	CompactFlash 512 MByte B&R
5CFCRD.1024-06	CompactFlash 1024 MByte B&R
5CFCRD.2048-06	CompactFlash 2048 MByte B&R
5CFCRD.4096-06	CompactFlash 4096 MByte B&R
5CFCRD.8192-06	CompactFlash 8192 MByte B&R
5CFCRD.016G-06	CompactFlash 16 GByte B&R
5CFCRD.032G-06	CompactFlash 32 GByte B&R
5CFCRD.0064-03	CompactFlash 64 MByte WD
5CFCRD.0128-03	CompactFlash 128 MByte WD
5CFCRD.0256-03	CompactFlash 256 MByte WD
5CFCRD.0512-03	CompactFlash 512 MByte WD
5CFCRD.1024-03	CompactFlash 1024 MByte WD
5CFCRD.2048-03	CompactFlash 2048 MByte WD
5CFCRD.4096-03	CompactFlash 4096 MByte WD
5CFCRD.8192-03	CompactFlash 8192 MByte WD

Tabelle 40: CompactFlash Slot (CF1)

Warnung!

An- und Abstecken der CompactFlash Karte darf nur in spannungslosem Zustand erfolgen!

2.6.20 CompactFlash Slot 2

Dieser CompactFlash Slot ist fixer Bestandteil eines APC810 Systems und ist intern über IDE PATA mit dem Chipset verbunden. Es können CompactFlash Karten des Types I gesteckt werden.

CompactFlash Slot (CF2)	
Anschluss	PATA Slave
CompactFlash Typ	Typ I
Bestellnummer	**Kurzbeschreibung**
	CompactFlash
5CFCRD.0512-06	CompactFlash 512 MByte B&R
5CFCRD.1024-06	CompactFlash 1024 MByte B&R
5CFCRD.2048-06	CompactFlash 2048 MByte B&R
5CFCRD.4096-06	CompactFlash 4096 MByte B&R
5CFCRD.8192-06	CompactFlash 8192 MByte B&R
5CFCRD.016G-06	CompactFlash 16 GByte B&R
5CFCRD.032G-06	CompactFlash 32 GByte B&R
5CFCRD.0064-03	CompactFlash 64 MByte WD
5CFCRD.0128-03	CompactFlash 128 MByte WD
5CFCRD.0256-03	CompactFlash 256 MByte WD
5CFCRD.0512-03	CompactFlash 512 MByte WD
5CFCRD.1024-03	CompactFlash 1024 MByte WD
5CFCRD.2048-03	CompactFlash 2048 MByte WD
5CFCRD.4096-03	CompactFlash 4096 MByte WD
5CFCRD.8192-03	CompactFlash 8192 MByte WD

Tabelle 41: CompactFlash Slot (CF2)

Warnung!

An- und Abstecken der CompactFlash Karte darf nur in spannungslosem Zustand erfolgen!

2.6.21 Slide-in Slot 1

Der Slide-in Slot 1 ist intern über SATA I und USB mit dem Chipset verbunden.

Slide-in Slot 1		
Anschluss	SATA I und USB	
Bestellnummer	**Kurzbeschreibung**	
	Laufwerke	
5AC801.ADAS-00	SATA Hard Disk Adapter zum Betrieb einer Slide-in compact Hard Disk in einem Slide-in Slot.	
5AC801.HDDS-00	40 GByte SATA Hard Disk (Slide-in); 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.	
5AC801.DVRS-00	DVD-R/RW DVD+R/RW SATA Laufwerk (Slide-in).	
5AC801.DVDS-00	DVD-ROM SATA Laufwerk (Slide-in).	

Tabelle 42: Slide-in Slot 1

Information:

Die SATA I Schnittstelle besitzt die Fähigkeit zum Austausch von Datenträgern im laufenden Betrieb (Hot-Plug). Um diese Eigenschaft nutzen zu können, muss dies vom Betriebssystem unterstützt werden.

2.6.22 Slide-in Slot 2

Der Slide-in Slot 2 ist intern über eine PCIe to SATA Bridge (SiL 3531) und USB mit dem Chipset verbunden.

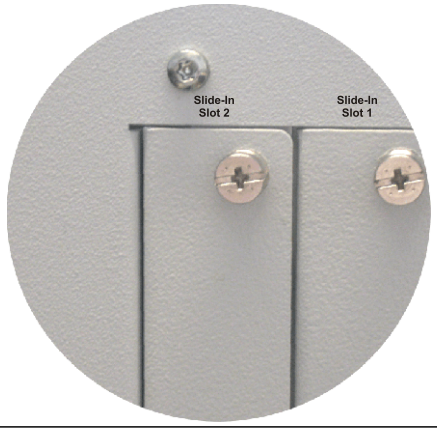
Slide-in Slot 2		
Anschluss	PCIe to SATA Bridge (SiL 3531) und USB	
Bestellnummer	**Kurzbeschreibung**	
	Laufwerke	
5AC801.HDDS-00	40 GByte SATA Hard Disk (Slide-in); 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.	
5AC801.DVRS-00	DVD-R/RW DVD+R/RW SATA Laufwerk (Slide-in).	
5AC801.DVDS-00	DVD-ROM SATA Laufwerk (Slide-in).	

Tabelle 43: Slide-in Slot 2

Information:

Der APC810 Slide-in compact Adapter 5AC801.ADAS-00 kann aus mechanischen Gegebenheiten (Schließen der Fronttüre) nur im Slide-in Slot 1 gesteckt werden.

Information:

Die SATA I Schnittstelle besitzt die Fähigkeit zum Austausch von Datenträgern im laufenden Betrieb (Hot-Plug). Um diese Eigenschaft nutzen zu können, muss dies vom Betriebssystem unterstützt werden.

Information:

Benötigte Treiber sind je nach verwendetem Betriebssystem von der B&R Homepage herunterzuladen.

2.6.23 Slide-in compact Slot

Der Slide-in compact Slot ist intern über SATA I mit dem Chipset verbunden.

Slide-in compact Slot		
Anschluss	SATA I	
Bestellnummer	**Kurzbeschreibung**	
	Laufwerke	
5AC801.HDDI-00	40 GByte SATA Hard Disk (Slide-in compact); 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.	
5AC801.HDDI-03	250 GByte SATA Hard Disk (Slide-in compact); 24/7 Hard Disk. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.	
5AC801.HDDI-04	500 GByte SATA Hard Disk (Slide-in compact); 24/7 Hard Disk. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.	
5AC801.SSDI-00	32 GByte SATA SSD (SLC), Slide-in compact	
5AC801.SSDI-01	60 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact	
5AC801.SSDI-02	180 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact	
5AC801.SSDI-03	60 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact	
5AC801.SSDI-04	128 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact	
5AC801.SSDI-05	256 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact	

Tabelle 44: Slide-in compact Slot

Information:

Die SATA I Schnittstelle besitzt die Fähigkeit zum Austausch von Datenträgern im laufenden Betrieb (Hot-Plug). Um diese Eigenschaft nutzen zu können, muss dies vom Betriebssystem unterstützt werden.

Einbau bzw. Tausch eines Slide-in compact Laufwerks siehe "Vorgangsweise" auf Seite 421.

3 Einzelkomponenten

3.1 Systemeinheiten

Die Systemeinheit vereint alle Einzelkomponenten in sich zu einem kompakten Gerät. Sie besteht aus dem Gehäuse mit integriertem Basisboard. Die Schnittstellen sind vorderseitig hinter der orangenen Fronttüre bzw. oberseitig leicht zugänglich. Die Systemeinheiten gibt es in den Größen mit 1, 2, 3 oder 5 Card Slots.

3.1.1 5PC810.SX01-00

3.1.1.1 Allgemeines

- Steckplatz für eine Buseinheit mit 1 PCI oder 1 PCIe Slot
- SRAM 512 kByte onboard
- Einschub für 1 Slide-in compact Laufwerk

3.1.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Systemeinheiten	
5PC810.SX01-00	APC810 Systemeinheit 1 Slot (PCI Express, PCI, abhängig vom Bus); 1 Slide-in compact Steckplatz; Smart Display Link/DVI/ Monitor, 2x RS232, 5x USB 2.0, 2x ETH 10/100/1000, 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzug- klemme 0TB103.91 gesondert bestellen)	
	Erforderliches Zubehör	
	Buseinheiten	
5PC810.BX01-00	APC810 Bus, 1 PCI	
5PC810.BX01-01	APC810 Bus, 1 PCI Express (x4)	
	CPU Boards	
5PC800.B945-05	Intel Atom N270 CPU Board, 1,6 GHz, Single-Core, 533 MHz FSB, 512 kByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
5PC800.B945-10	Intel Core Duo L2400 CPU Board, 1,66 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
5PC800.B945-11	Intel Core2 Duo L7400 CPU Board, 1,5 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
5PC800.B945-12	Intel Core2 Duo U7500 CPU Board, 1,06 GHz, Dual-Core, 533 MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
5PC800.B945-13	Intel Celeron M 423 CPU Board, 1,06 GHz, Single-Core, 533 MHz FSB, 1 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
5PC800.B945-14	Intel Core2 Duo T7400 CPU Board, 2,16 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
	Feldklemmen	
0TB103.9	Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Schraubklemme 3,31 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch	
0TB103.91	Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Federzugklemme 3,31 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch	
	Hauptspeicher	
5MMDDR.0512-01	SO-DIMM DDR2 RAM 512 MByte PC2-5300	
5MMDDR.1024-01	SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MByte PC2-5300	
5MMDDR.2048-01	SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MByte PC2-5300	
	Kühlkörper	
5AC801.HS00-00	APC810 Kühlkörper für CPU Boards mit Dual Core Prozessoren L2400, L7400, U7500 und Celeron M 423.	
5AC801.HS00-01	APC810 Kühlkörper für CPU Boards mit Dual Core Prozessor T7400, T9400 und P8400.	
5AC801.HS00-02	APC810 Kühlkörper für CPU Board mit Atom Prozessor N270.	
	Optionales Zubehör	
	Laufwerke	
5AC801.HDDI-00	40 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	

Tabelle 45: 5PC810.SX01-00 - Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
5AC801.HDDI-04	500 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	
5AC801.SSDI-03	60 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.	
5AC801.SSDI-04	128 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.	
5AC801.SSDI-05	256 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.	
5ACPCI.RAIC-06	PCI RAID System SATA 2x 500 GByte; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	
	Lüfter Kit	
5PC810.FA01-00	APC810 Lüfterkit für Systemeinheit 5PC810.SX01-00.	
	Serialadapter	
5AC600.485I-00	RS232/422/485 Interface; zum Einbau in einen APC620, APC810 oder PPC700.	
5AC600.CANI-00	CAN Interface; Zum Einbau in einen APC620, APC810 oder PPC700.	
	Unterbrechungsfreie Stromversorgung	
5AC600.UPSI-00	USV Modul für APC620, APC810, PPC800; für Systemeinheiten 5PC600.SX01-00 (ab Rev. H0), 5PC600.SX02-00 (ab Rev. G0), 5PC600.SX02-01 (ab Rev. H0), 5PC600.SX05-00 (ab Rev. F0), 5PC600.SX05-01 (ab Rev. F0), 5PC600.SF03-00 (ab Rev. A0), 5PC810.SX*. 5PC820.1505-00, 5PC820.1906-00. Kabel (5CAUPS.0005-00 bzw. 5CAUPS.0030-00) und Batterieeinheit (5AC600.UPSB-00) sind separat zu bestellen.	
	Zubehör	
5ACPCI.ETH1-01	PCI Ethernet Card 1x 10/100	
5ACPCI.ETH3-01	PCI Ethernet Card 3x 10/100	

Tabelle 45: 5PC810.SX01-00 - Bestelldaten

3.1.1.3 Schnittstellen

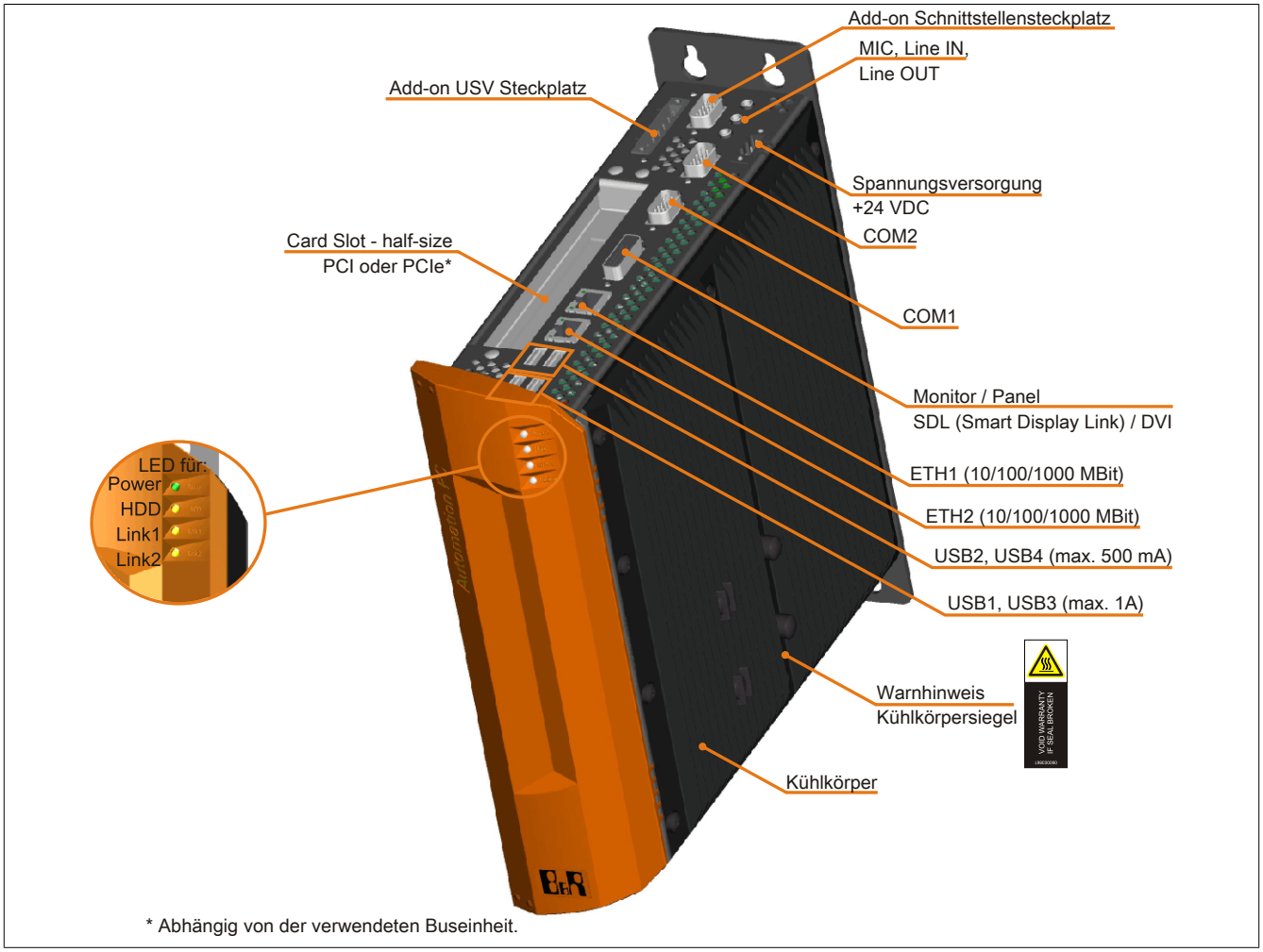


Abbildung 19: 5PC810.SX01-00 - Schnittstellen Oberseite

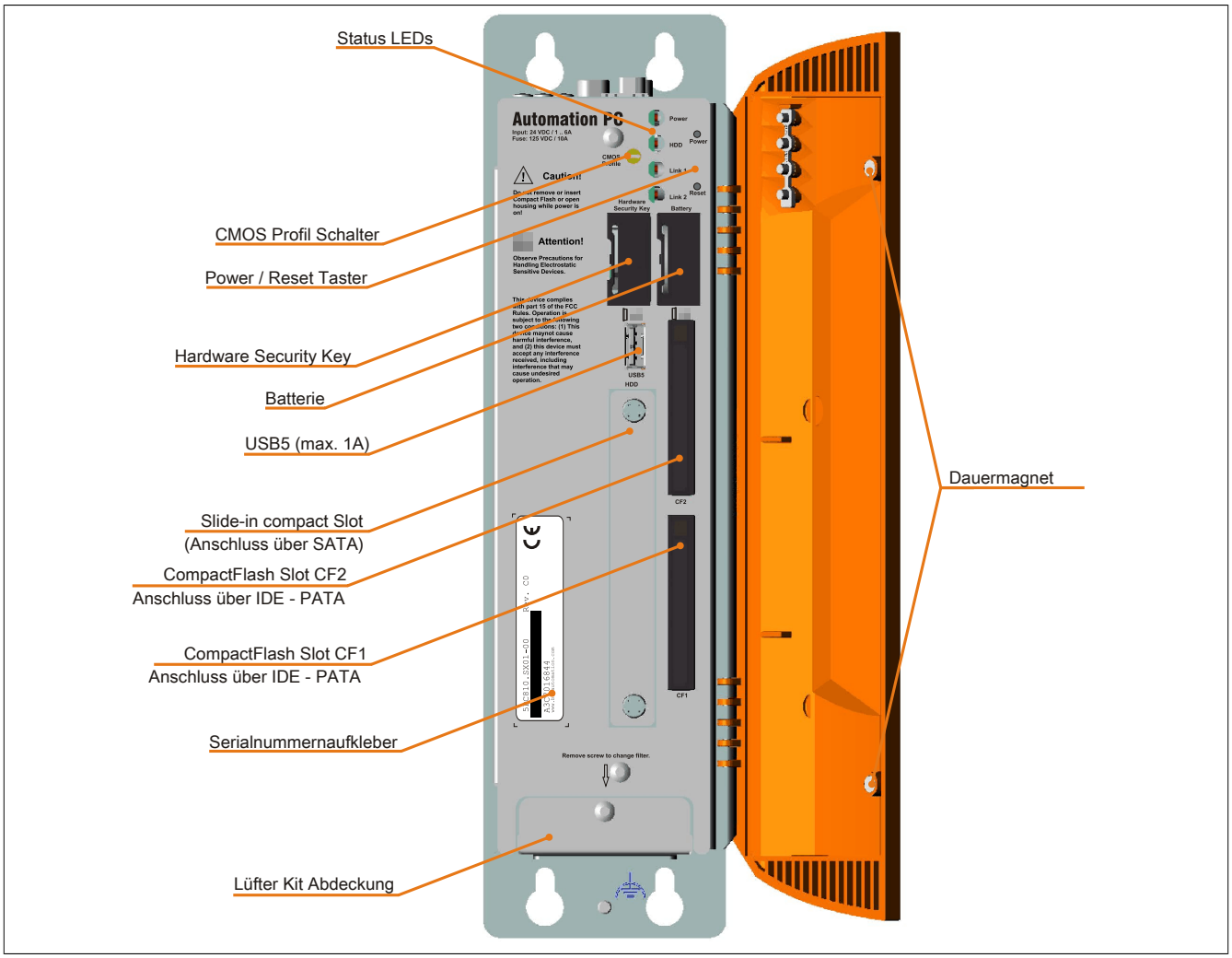


Abbildung 20: 5PC810.SX01-00 - Schnittstellen Vorderseite

3.1.1.4 Technische Daten

Produktbezeichnung	5PC810.SX01-00
Allgemeines	
Donglehalter	Ja
Kühlung	Passiv über Kühlkörper und optional unterstützend durch ein aktives Lüfter Kit [1]
LEDs	Power, HDD, Link 1, Link 2
B&R ID-Code	0xA3ED
Batterie	
Typ	Renata 950 mAh
Lebensdauer	2½ Jahre [2]
tauschbar	Ja, hinter der orangen Fronttüre zugänglich
Ausführung	Lithium Ionen
Power-Taster	Ja
Reset-Taster	Ja
Summer	Ja
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
cULus HazLoc Class 1 Division 2	Ja [3]
ATEX Zone 22	Ja [3]
GOST-R	Ja
GL	Ja [4]
Controller	
Boot-Loader	BIOS
Echtzeituhr	
batteriegepuffert	Ja
Power Fail Logik	
Controller	MTCX [5]
Pufferzeit	10 ms
Grafik	
Controller	abhängig vom verwendeten CPU Board

Tabelle 46: 5PC810.SX01-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5PC810.SX01-00
SRAM	
Größe	512 kByte
batteriegepuffert	Ja
Remanente Variablen im Power Fail Mode	192 kByte (für z.B. Automation Runtime, siehe AS Hilfe)
Speicher	
Typ	abhängig vom verwendeten CPU Board
Speichergröße	abhängig vom verwendeten CPU Board
Schnittstellen	
COM1	
Typ	RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt
Ausführung	DSUB-Buchse, 9-polig, male
UART	16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
max. Baudrate	115 kBit/s
COM2	
Typ	RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt
Ausführung	DSUB-Buchse, 9-polig, male
UART	16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
max. Baudrate	115 kBit/s
CompactFlash Slot 1	
Anzahl	1
Typ	Typ I
CompactFlash Slot 2	
Anzahl	1
Typ	Typ I
USB	
Anzahl	5
Typ	USB 2.0
Ausführung	Typ A
Übertragungsrate	Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
Strombelastbarkeit	je Anschluss max. 500 mA bzw. 1 A
Ethernet	
Anzahl	2
Ausführung	geschirmter RJ45 Port
Übertragungsrate	10/100/1000 MBit/s
max. Baudrate	1 GBit/s
Panel/Monitor-Schnittstelle	
Ausführung	DVI-I Buchse
Typ	SDL/DVI/Monitor
CAN	
Anmerkung	optional
Audio	
Typ	AC97 Sound [6]
Eingänge	Mikrofon, Line In
Ausgänge	Line Out
Add-on Schnittstellensteckplatz	
Anzahl	1
Einschübe	
PCI / PCIe Slots	
Anzahl	1 PCI Slot oder 1 PCIe Slot [7]
Slide-in Laufwerke	Nein
Slide-in compact Laufwerke	1
Automation Panel Link Slot	Nein
Add-on USV Steckplatz	Ja
Einschub für Lüfter Kit	Ja
Elektrische Eigenschaften	
Nennspannung	24 VDC ±25%, SELV [8]
Nennstrom	6 A
Einschaltstrom	typ. 7 A, max. 50 A für < 300 µs
Überspannungskategorie nach EN 61131-2	II
Galvanische Trennung	Ja
Einsatzbedingungen	
Schutzart nach EN 60529	IP20
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	
Betrieb	komponentenabhängig
Lagerung	-20 bis 60°C
Transport	-20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	komponentenabhängig
Lagerung	komponentenabhängig
Transport	komponentenabhängig

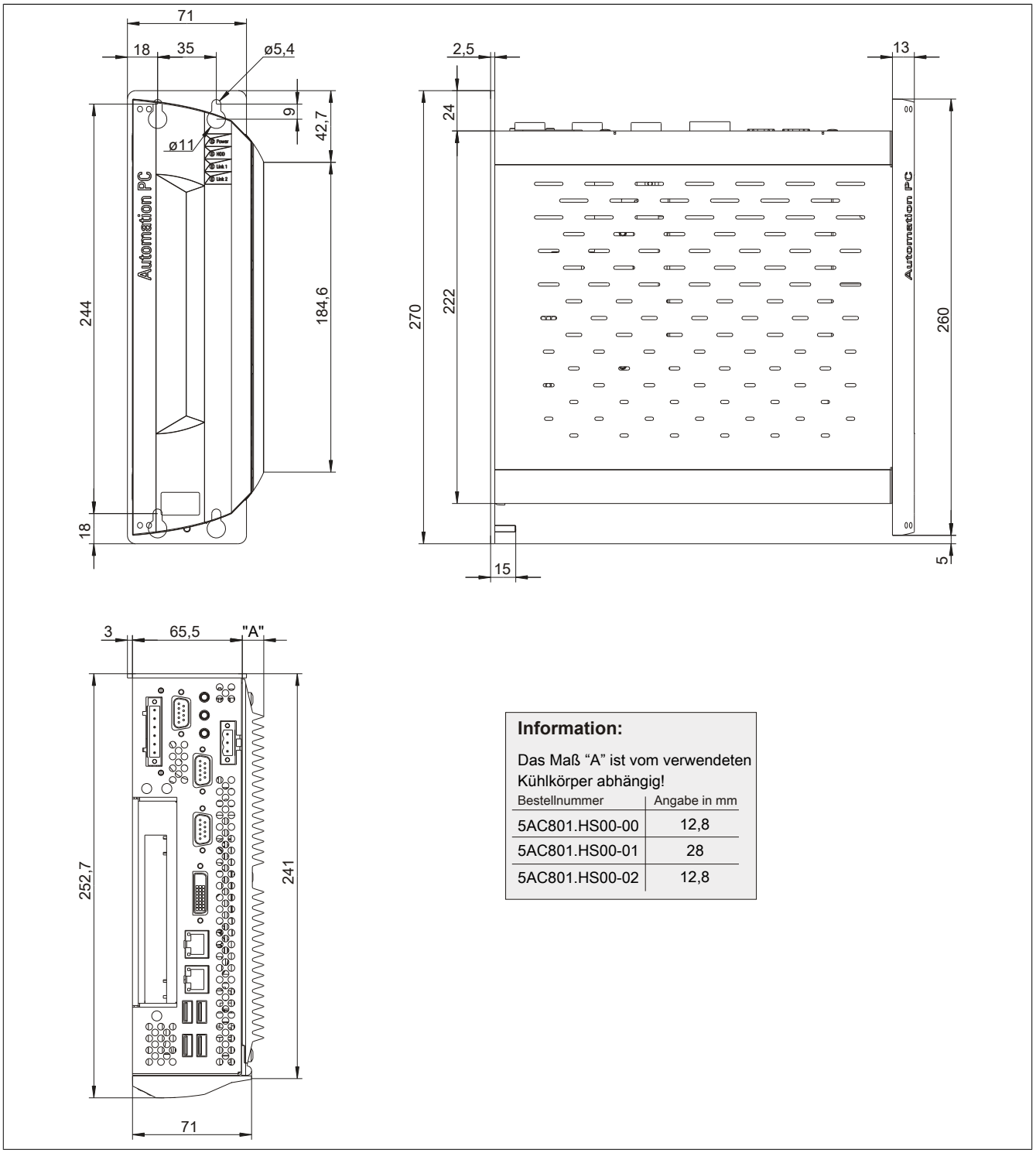
Tabelle 46: 5PC810.SX01-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5PC810.SX01-00
Vibration [9]	
Betrieb (dauerhaft)	2 bis 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 0,5 g
Betrieb (gelegentlich)	2 bis 9 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 1 g
Lagerung	2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Transport	2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Schock [9]	
Betrieb	15 g, 11 ms
Lagerung	30 g, 15 ms
Transport	30 g, 15 ms
Meereshöhe	
Betrieb	max. 3000 m (komponentenabhängig) [10]
Mechanische Eigenschaften	
Gehäuse [11]	
Material	verzinktes Blech, Kunststoff
Frontabdeckung	eingefärbter oranger Kunststoff (ähnlich Pantone 144CV)
Lackierung	hellgrau (ähnlich Pantone 427CV), dunkelgrau (ähnlich Pantone 432CV)
Abmessungen	
Breite	81,3 mm mit Kühlkörper 5AC801.HS00-00 und 5AC801.HS00-02 96,5 mm mit Kühlkörper 5AC801.HS00-01
Höhe	270 mm
Tiefe	252,7 mm
Gewicht	ca. 2200 g (komponentenabhängig)

Tabelle 46: 5PC810.SX01-00 - Technische Daten

1) Beim APC810 GM45 ist ein Lüfter Kit zwingend erforderlich.
2) Bei 50°C, 8,5 µA der zu versorgenden Komponenten und einer Selbstentladung von 40%.
3) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben und das Gesamtgerät die entsprechende Kennzeichnung trägt.
4) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
5) Maintenance Controller Extended
6) Wird vom GM45 Chipsatz nicht mehr unterstützt.
7) Die PCI Slots und PCIe Slots sind abhängig von der verwendeten Buseinheit 5PC810.BX01-00 und 5PC810.BX01-01.
8) Die Anforderungen sind gemäß EN 60950 einzuhalten, siehe Kapitel 2.6.1 Spannungsversorgung +24 VDC.
9) Maximalwerte, sofern eine Einzelkomponente keinen anderen angibt.
10) Herabsenkung (Derating) der maximalen Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 Meter ü. NN.
11) Prozess- bzw. chargenbedingt sind optische Abweichungen in der Farbe und Oberflächenbeschaffenheit möglich.

3.1.1.5 Abmessungen



Information:

Das Maß “A” ist vom verwendeten Kühlkörper abhängig!

Bestellnummer	Angabe in mm
5AC801.HS00-00	12,8
5AC801.HS00-01	28
5AC801.HS00-02	12,8

Abbildung 21: 5PC810.SX01-00 - Abmessungen

3.1.1.6 Bohrschablone

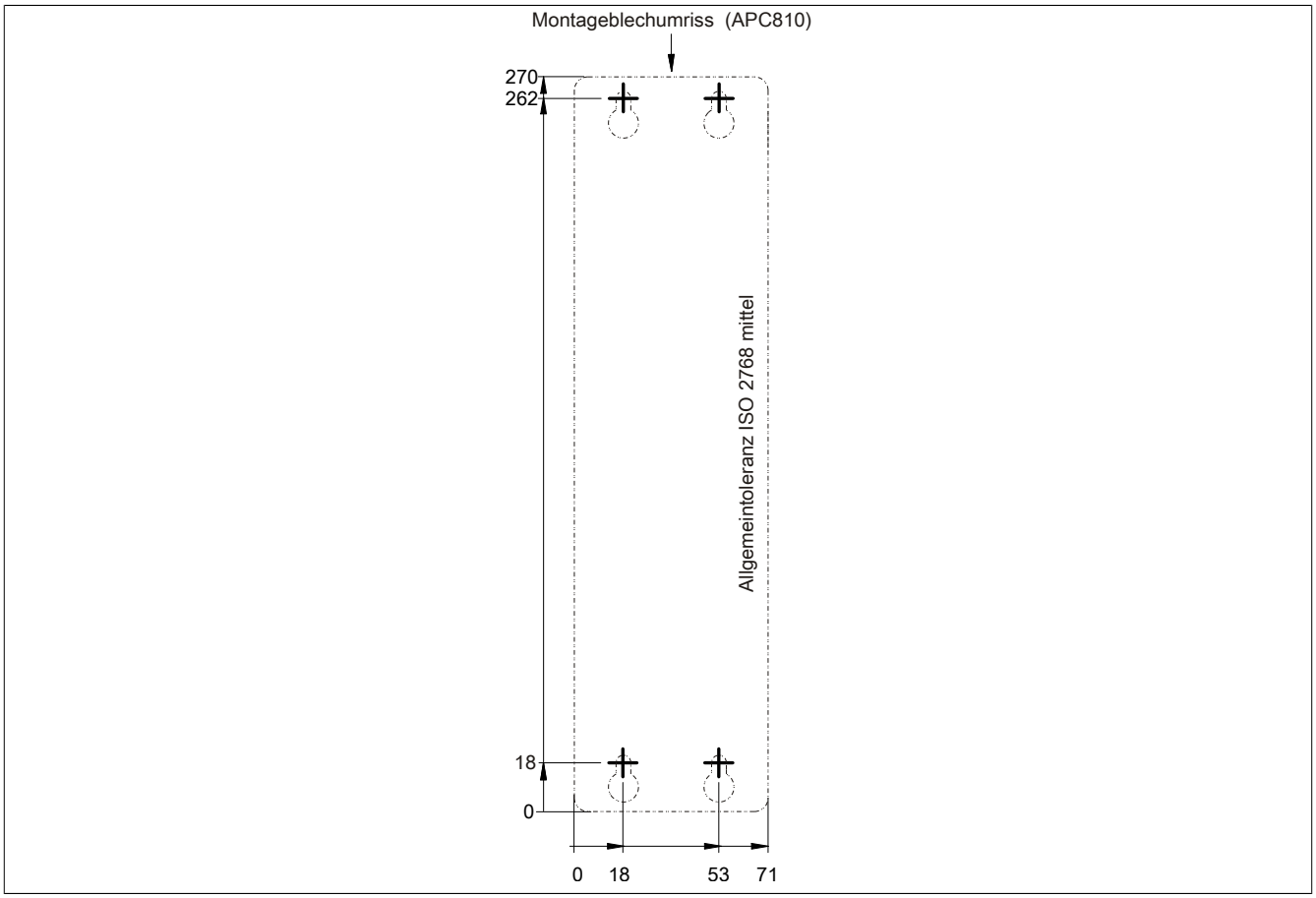


Abbildung 22: 5PC810.SX01-00 - Bohrschablone

3.1.2 5PC810.SX02-00

3.1.2.1 Allgemeines

- Steckplatz für eine Buseinheit mit 2 PCI Slots oder 1 PCI und 1 PCIe Slot
- SRAM 512 kByte onboard
- Einschub für 1 Slide-in compact Laufwerk und 1 Slide-in Laufwerk
- Automation Panel Link Slot zum Anschluss von Automation Panels über SDL

3.1.2.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Systemeinheiten	
5PC810.SX02-00	APC810 Systemeinheit 2 Slots (PCI Ex- press, PCI, abhängig vom Bus); 1 Slot für Automation Panel Link Transmitter; 1 Slide-in compact und 1 Slide-in Steckplatz; Smart Display Link/ DVI/Monitor, 2x RS232, 5x USB 2.0, 2x ETH 10/100/1000, 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Feder- zugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen)	
	Erforderliches Zubehör	
	Buseinheiten	
5PC810.BX02-00	APC810 Bus, 2 PCI	
5PC810.BX02-01	APC810 Bus, 1 PCI, 1 PCI Express (x4)	
	CPU Boards	
5PC800.B945-05	Intel Atom N270 CPU Board, 1,6 GHz, Single-Core, 533 MHz FSB, 512 kByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
5PC800.B945-10	Intel Core Duo L2400 CPU Board, 1,66 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
5PC800.B945-11	Intel Core2 Duo L7400 CPU Board, 1,5 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
5PC800.B945-12	Intel Core2 Duo U7500 CPU Board, 1,06 GHz, Dual-Core, 533 MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
5PC800.B945-13	Intel Celeron M 423 CPU Board, 1,06 GHz, Single-Core, 533 MHz FSB, 1 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
5PC800.B945-14	Intel Core2 Duo T7400 CPU Board, 2,16 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
	Feldklemmen	
0TB103.9	Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Schraubklemme 3,31 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch	
0TB103.91	Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Federzugklemme 3,31 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch	
	Hauptspeicher	
5MMDDR.0512-01	SO-DIMM DDR2 RAM 512 MByte PC2-5300	
5MMDDR.1024-01	SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MByte PC2-5300	
5MMDDR.2048-01	SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MByte PC2-5300	
	Kühlkörper	
5AC801.HS00-00	APC810 Kühlkörper für CPU Boards mit Dual Core Prozessoren L2400, L7400, U7500 und Celeron M 423.	
5AC801.HS00-01	APC810 Kühlkörper für CPU Boards mit Dual Core Prozessor T7400, T9400 und P8400.	
5AC801.HS00-02	APC810 Kühlkörper für CPU Board mit Atom Prozessor N270.	
	Optionales Zubehör	
	Automation Panel Link Steckkarten	
5AC801.RDYR-00	Ready Relais für APC810	
5AC801.SDL0-00	Smart Display Link/DVI-D Transmitter	
	Laufwerke	
5AC801.ADAS-00	SATA Hard Disk Adapter zum Betrieb einer Slide-in compact Hard Disk in einem Slide-in Slot.	
5AC801.DVDS-00	DVD-ROM SATA Laufwerk, Slide-in.	
5AC801.DVRS-00	DVD-R/RW DVD+R/RW SATA Laufwerk, Slide-in.	
5AC801.HDDI-00	40 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	

Tabelle 47: 5PC810.SX02-00 - Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
5AC801.HDDI-04	500 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	
5AC801.HDDS-00	40 GByte SATA Hard Disk, Slide-in; 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	
5AC801.SSDI-03	60 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.	
5AC801.SSDI-04	128 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.	
5AC801.SSDI-05	256 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.	
5ACPCI.RAIC-06	PCI RAID System SATA 2x 500 GByte; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	
	Lüfter Kit	
5PC810.FA02-01	APC810 Lüfterkit für Systemeinheit 5PC810.SX02-00 ab Revision D0.	
	Serialadapter	
5AC600.485I-00	RS232/422/485 Interface; zum Einbau in einen APC620, APC810 oder PPC700.	
5AC600.CANI-00	CAN Interface; Zum Einbau in einen APC620, APC810 oder PPC700.	
	Unterbrechungsfreie Stromversorgung	
5AC600.UPSI-00	USV Modul für APC620, APC810, PPC800; für Systemeinheiten 5PC600.SX01-00 (ab Rev. H0), 5PC600.SX02-00 (ab Rev. G0), 5PC600.SX02-01 (ab Rev. H0), 5PC600.SX05-00 (ab Rev. F0), 5PC600.SX05-01 (ab Rev. F0), 5PC600.SF03-00 (ab Rev. A0), 5PC810.SX*. 5PC820.1505-00, 5PC820.1906-00. Kabel (5CAUPS.0005-00 bzw. 5CAUPS.0030-00) und Batterieeinheit (5AC600.UPSB-00) sind separat zu bestellen.	
	Zubehör	
5ACPCI.ETH1-01	PCI Ethernet Card 1x 10/100	
5ACPCI.ETH3-01	PCI Ethernet Card 3x 10/100	

Tabelle 47: 5PC810.SX02-00 - Bestelldaten

3.1.2.3 Schnittstellen

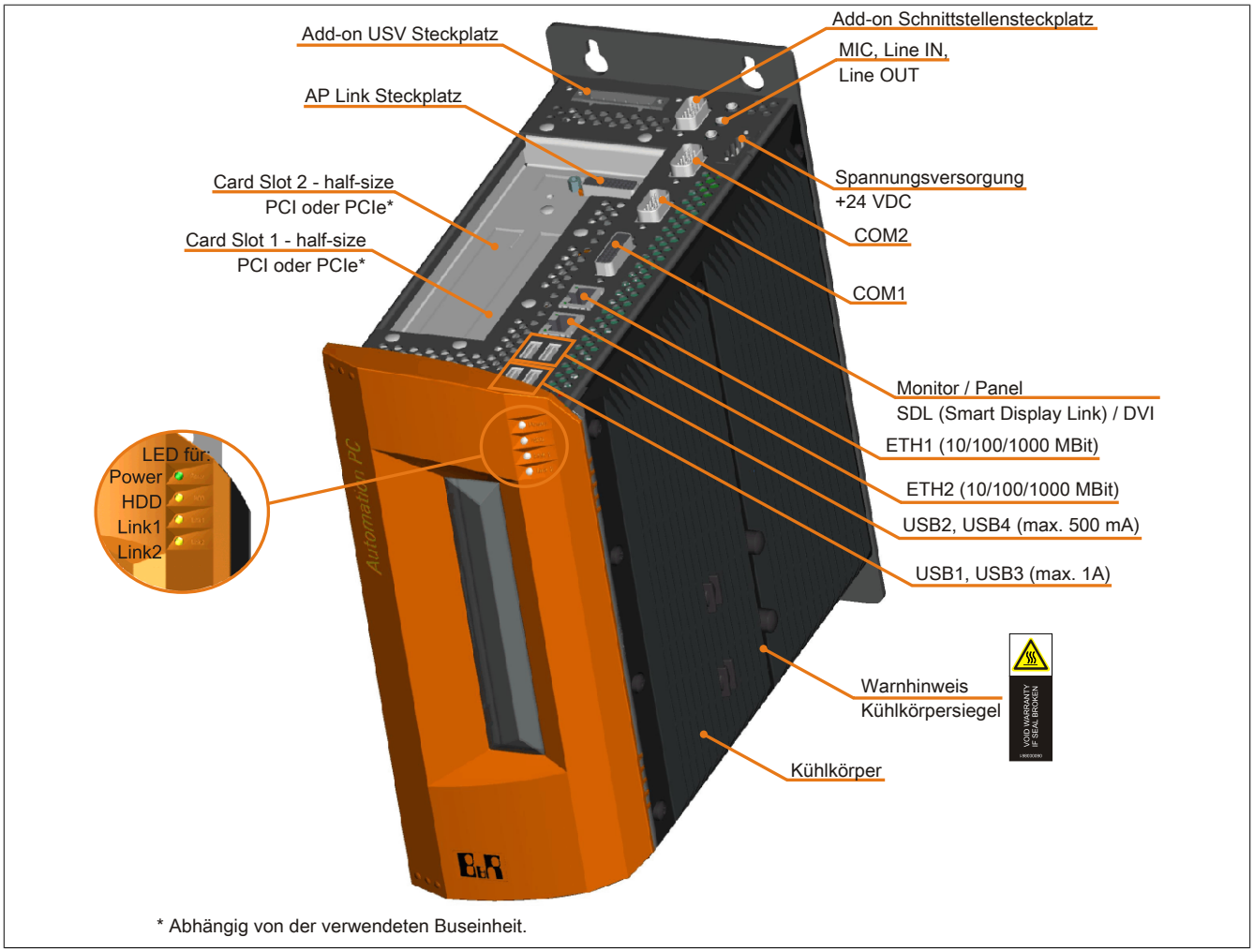


Abbildung 23: 5PC810.SX02-00 - Schnittstellen Oberseite

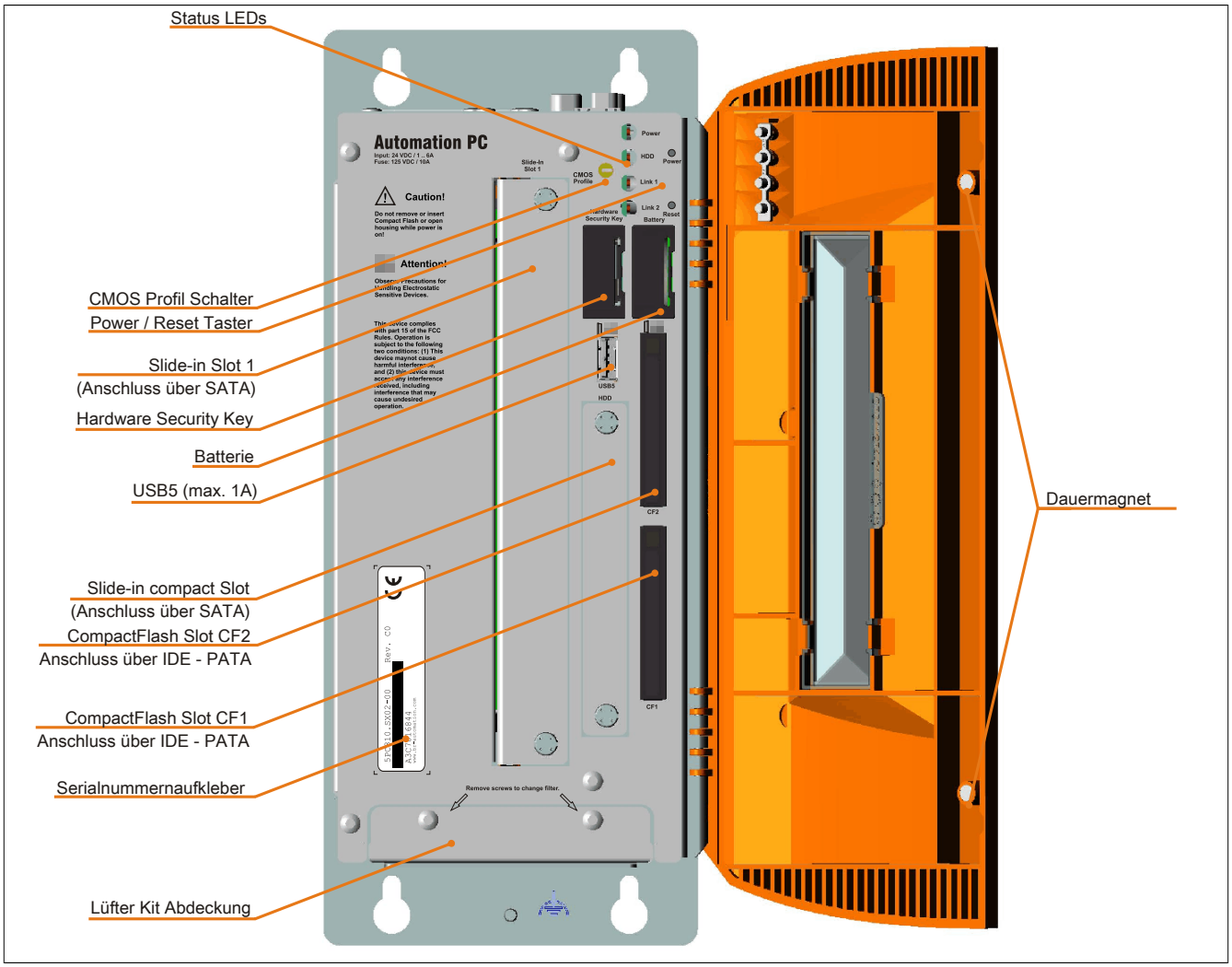


Abbildung 24: 5PC810.SX02-00 - Schnittstellen Vorderseite

3.1.2.4 Technische Daten

Produktbezeichnung	5PC810.SX02-00
Allgemeines	
Donglehalter	Ja
Kühlung	Passiv über Kühlkörper und optional unterstützend durch ein aktives Lüfter Kit [1]
LEDs	Power, HDD, Link 1, Link 2
B&R ID-Code	0xA3C7
Batterie	
Typ	Renata 950 mAh
Lebensdauer	2½ Jahre [2]
tauschbar	Ja, hinter der orangen Fronttüre zugänglich
Ausführung	Lithium Ionen
Power-Taster	Ja
Reset-Taster	Ja
Summer	Ja
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
cULus HazLoc Class 1 Division 2	Ja [3]
ATEX Zone 22	Ja [3]
GOST-R	Ja
GL	Ja [4]
Controller	
Boot-Loader	BIOS
Echtzeituhr	
batteriegepuffert	Ja
Power Fail Logik	
Controller	MTCX [5]
Pufferzeit	10 ms
Grafik	
Controller	abhängig vom verwendeten CPU Board

Tabelle 48: 5PC810.SX02-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5PC810.SX02-00
SRAM	
Größe	512 kByte
batteriegepuffert	Ja
Remanente Variablen im Power Fail Mode	192 kByte (für z.B. Automation Runtime, siehe AS Hilfe)
Speicher	
Typ	abhängig vom verwendeten CPU Board
Speichergröße	abhängig vom verwendeten CPU Board
Schnittstellen	
COM1	
Typ	RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt
Ausführung	DSUB-Buchse, 9-polig, male
UART	16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
max. Baudrate	115 kBit/s
COM2	
Typ	RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt
Ausführung	DSUB-Buchse, 9-polig, male
UART	16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
max. Baudrate	115 kBit/s
CompactFlash Slot 1	
Anzahl	1
Typ	Typ I
CompactFlash Slot 2	
Anzahl	1
Typ	Typ I
USB	
Anzahl	5
Typ	USB 2.0
Ausführung	Typ A
Übertragungsrate	Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
Strombelastbarkeit	je Anschluss max. 500 mA bzw. 1 A
Ethernet	
Anzahl	2
Ausführung	geschirmter RJ45 Port
Übertragungsrate	10/100/1000 MBit/s
max. Baudrate	1 GBit/s
Panel/Monitor-Schnittstelle	
Ausführung	DVI-I Buchse
Typ	SDL/DVI/Monitor
CAN	
Anmerkung	optional
Audio	
Typ	AC97 Sound [6]
Eingänge	Mikrofon, Line In
Ausgänge	Line Out
Add-on Schnittstellensteckplatz	
Anzahl	1
Einschübe	
PCI / PCIe Slots	
Anzahl	2 PCI Slots oder 1 PCI und 1PCIe Slot [7]
Slide-in Laufwerke	1
Slide-in compact Laufwerke	1
Automation Panel Link Slot	Ja
Add-on USV Steckplatz	Ja
Einschub für Lüfter Kit	Ja
Elektrische Eigenschaften	
Nennspannung	24 VDC ±25%, SELV [8]
Nennstrom	6 A
Einschaltstrom	typ. 7 A, max. 50 A für < 300 µs
Überspannungskategorie nach EN 61131-2	II
Galvanische Trennung	Ja
Einsatzbedingungen	
Schutzart nach EN 60529	IP20
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	
Betrieb	komponentenabhängig
Lagerung	-20 bis 60°C
Transport	-20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	komponentenabhängig
Lagerung	komponentenabhängig
Transport	komponentenabhängig

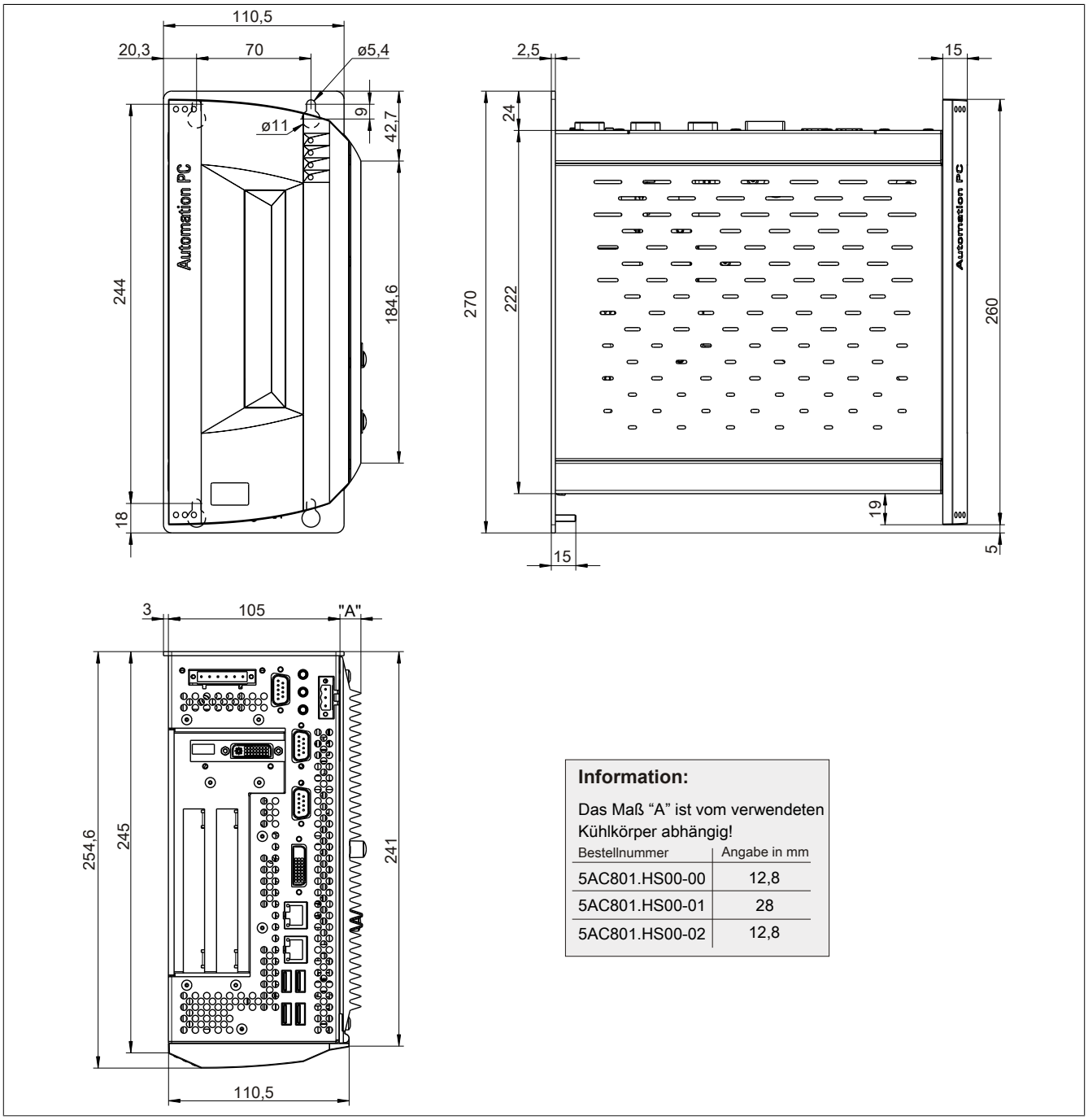
Tabelle 48: 5PC810.SX02-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5PC810.SX02-00
Vibration [9]	
Betrieb (dauerhaft)	2 bis 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 0,5 g
Betrieb (gelegentlich)	2 bis 9 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 1 g
Lagerung	2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Transport	2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Schock [9]	
Betrieb	15 g, 11 ms
Lagerung	30 g, 15 ms
Transport	30 g, 15 ms
Meereshöhe	
Betrieb	max. 3000 m (komponentenabhängig) [10]
Mechanische Eigenschaften	
Gehäuse [11]	
Material	verzinktes Blech, Kunststoff
Frontabdeckung	eingefärbter oranger Kunststoff (ähnlich Pantone 144CV)
Lackierung	hellgrau (ähnlich Pantone 427CV), dunkelgrau (ähnlich Pantone 432CV)
Abmessungen	
Breite	120,8 mm mit Kühlkörper 5AC801.HS00-00 und 5AC801.HS00-02 136 mm mit Kühlkörper 5AC801.HS00-01
Höhe	270 mm
Tiefe	254,6 mm
Gewicht	ca. 2800 g (komponentenabhängig)

Tabelle 48: 5PC810.SX02-00 - Technische Daten

1) Beim APC810 GM45 ist ein Lüfter Kit zwingend erforderlich.
2) Bei 50°C, 8,5 µA der zu versorgenden Komponenten und einer Selbstentladung von 40%.
3) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben und das Gesamtgerät die entsprechende Kennzeichnung trägt.
4) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
5) Maintenance Controller Extended
6) Wird vom GM45 Chipsatz nicht mehr unterstützt.
7) Die PCI Slots und PCIe Slots sind abhängig von der verwendeten Buseinheit 5PC810.BX02-00 und 5PC810.BX02-01.
8) Die Anforderungen sind gemäß EN 60950 einzuhalten, siehe Kapitel 2.6.1 Spannungsversorgung +24 VDC.
9) Maximalwerte, sofern eine Einzelkomponente keinen anderen angibt.
10) Herabsenkung (Derating) der maximalen Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 Meter ü. NN.
11) Prozess- bzw. chargenbedingt sind optische Abweichungen in der Farbe und Oberflächenbeschaffenheit möglich.

3.1.2.5 Abmessungen



Information:

Das Maß “A” ist vom verwendeten Kühlkörper abhängig!

Bestellnummer	Angabe in mm
5AC801.HS00-00	12,8
5AC801.HS00-01	28
5AC801.HS00-02	12,8

Abbildung 25: 5PC810.SX02-00 - Abmessungen

3.1.2.6 Bohrschablone

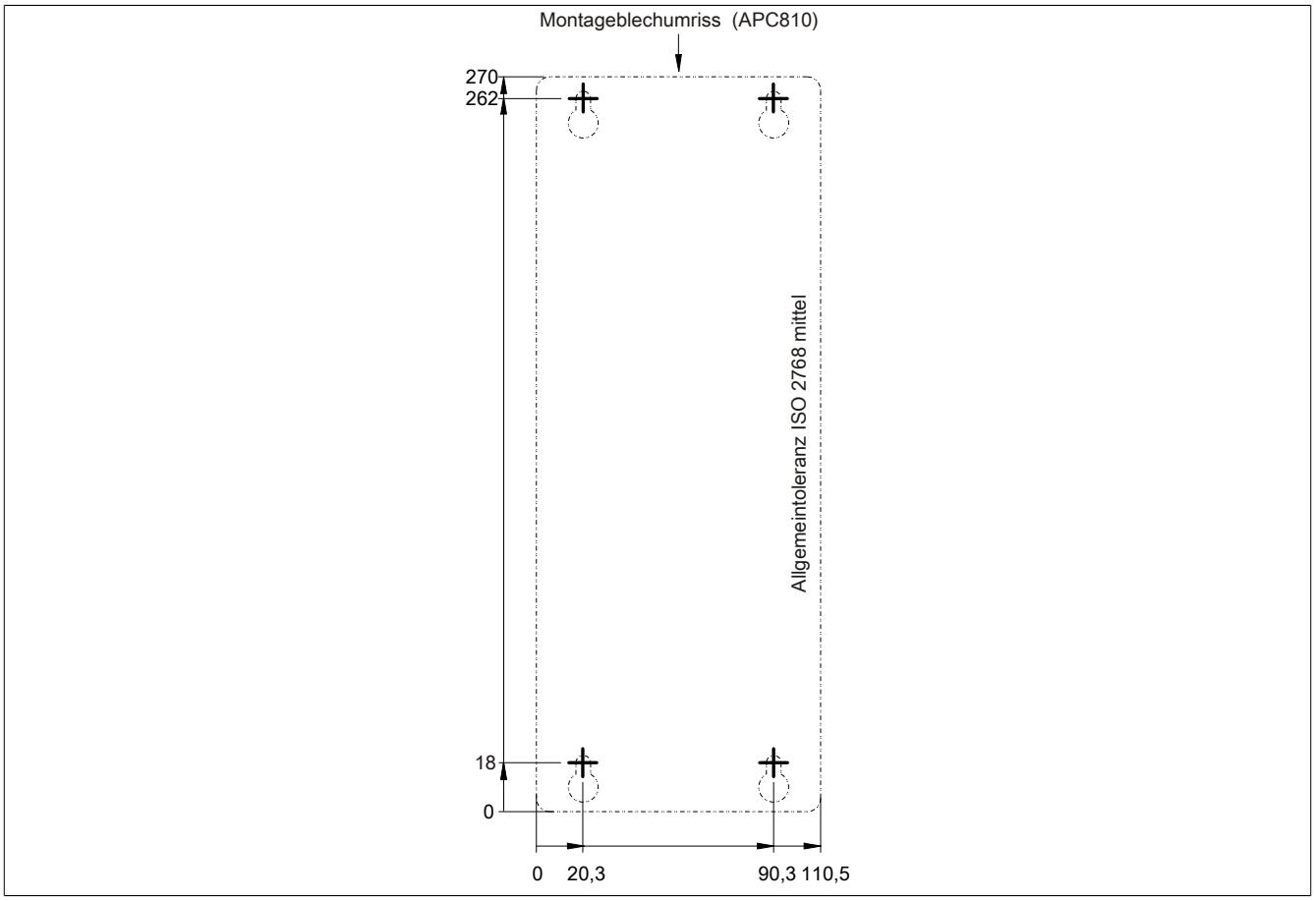


Abbildung 26: 5PC810.SX02-00 - Bohrschablone

3.1.3 5PC810.SX03-00

3.1.3.1 Allgemeines

- Steckplatz für eine Buseinheit mit 2 PCI und 1 PCIe Slot
- SRAM 512 kByte onboard
- Einschub für 1 Slide-in compact Laufwerk und 1 Slide-in Laufwerk
- Automation Panel Link Slot zum Anschluss von Automation Panels über SDL

3.1.3.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Systemeinheiten	
5PC810.SX03-00	APC810 Systemeinheit 3 Slots (PCI Ex- press, PCI, abhängig vom Bus); 1 Slot für Automation Panel Link Transmitter; 1 Slide-in compact und 1 Slide-in Steckplatz; Smart Display Link/DVI/Monitor, 2x RS232, 5x USB 2.0, 2x ETH 10/100/1000, AC97 Sound, 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen)	
	Erforderliches Zubehör	
	Buseinheiten	
5PC810.BX03-00	APC810 Bus, 2 PCI, 1 PCI Express (x4)	
	CPU Boards	
5PC800.B945-05	Intel Atom N270 CPU Board, 1,6 GHz, Single-Core, 533 MHz FSB, 512 kByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
5PC800.B945-10	Intel Core Duo L2400 CPU Board, 1,66 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
5PC800.B945-11	Intel Core2 Duo L7400 CPU Board, 1,5 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
5PC800.B945-12	Intel Core2 Duo U7500 CPU Board, 1,06 GHz, Dual-Core, 533 MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
5PC800.B945-13	Intel Celeron M 423 CPU Board, 1,06 GHz, Single-Core, 533 MHz FSB, 1 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
5PC800.B945-14	Intel Core2 Duo T7400 CPU Board, 2,16 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
	Feldklemmen	
0TB103.9	Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Schraubklemme 3,31 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch	
0TB103.91	Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Federzugklemme 3,31 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch	
	Hauptspeicher	
5MMDDR.0512-01	SO-DIMM DDR2 RAM 512 MByte PC2-5300	
5MMDDR.1024-01	SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MByte PC2-5300	
5MMDDR.2048-01	SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MByte PC2-5300	
	Kühlkörper	
5AC801.HS00-00	APC810 Kühlkörper für CPU Boards mit Dual Core Prozessoren L2400, L7400, U7500 und Celeron M 423.	
5AC801.HS00-01	APC810 Kühlkörper für CPU Boards mit Dual Core Prozessor T7400, T9400 und P8400.	
5AC801.HS00-02	APC810 Kühlkörper für CPU Board mit Atom Prozessor N270.	
	Optionales Zubehör	
	Automation Panel Link Steckkarten	
5AC801.RDYR-00	Ready Relais für APC810	
5AC801.SDL0-00	Smart Display Link/DVI-D Transmitter	
	Laufwerke	
5AC801.ADAS-00	SATA Hard Disk Adapter zum Betrieb einer Slide-in compact Hard Disk in einem Slide-in Slot.	
5AC801.DVDS-00	DVD-ROM SATA Laufwerk, Slide-in.	
5AC801.DVRS-00	DVD-R/RW DVD+R/RW SATA Laufwerk, Slide-in.	
5AC801.HDDI-00	40 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	
5AC801.HDDI-04	500 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	

Tabelle 49: 5PC810.SX03-00 - Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
5AC801.HDDS-00	40 GByte SATA Hard Disk, Slide-in; 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	
5AC801.SSDI-03	60 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.	
5AC801.SSDI-04	128 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.	
5AC801.SSDI-05	256 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.	
5ACPCI.RAIC-06	PCI RAID System SATA 2x 500 GByte; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	
	Lüfter Kit	
5PC810.FA03-00	APC810 Lüfterkit für Systemeinheit 5PC810.SX03-00.	
	Serialadapter	
5AC600.485I-00	RS232/422/485 Interface; zum Einbau in einen APC620, APC810 oder PPC700.	
5AC600.CANI-00	CAN Interface; Zum Einbau in einen APC620, APC810 oder PPC700.	
	Unterbrechungsfreie Stromversorgung	
5AC600.UPSI-00	USV Modul für APC620, APC810, PPC800; für Systemeinheiten 5PC600.SX01-00 (ab Rev. H0), 5PC600.SX02-00 (ab Rev. G0), 5PC600.SX02-01 (ab Rev. H0), 5PC600.SX05-00 (ab Rev. F0), 5PC600.SX05-01 (ab Rev. F0), 5PC600.SF03-00 (ab Rev. A0), 5PC810.SX*. 5PC820.1505-00, 5PC820.1906-00. Kabel (5CAUPS.0005-00 bzw. 5CAUPS.0030-00) und Batterieeinheit (5AC600.UPSB-00) sind separat zu bestellen.	
	Zubehör	
5ACPCI.ETH1-01	PCI Ethernet Card 1x 10/100	
5ACPCI.ETH3-01	PCI Ethernet Card 3x 10/100	

Tabelle 49: 5PC810.SX03-00 - Bestelldaten

3.1.3.3 Schnittstellen

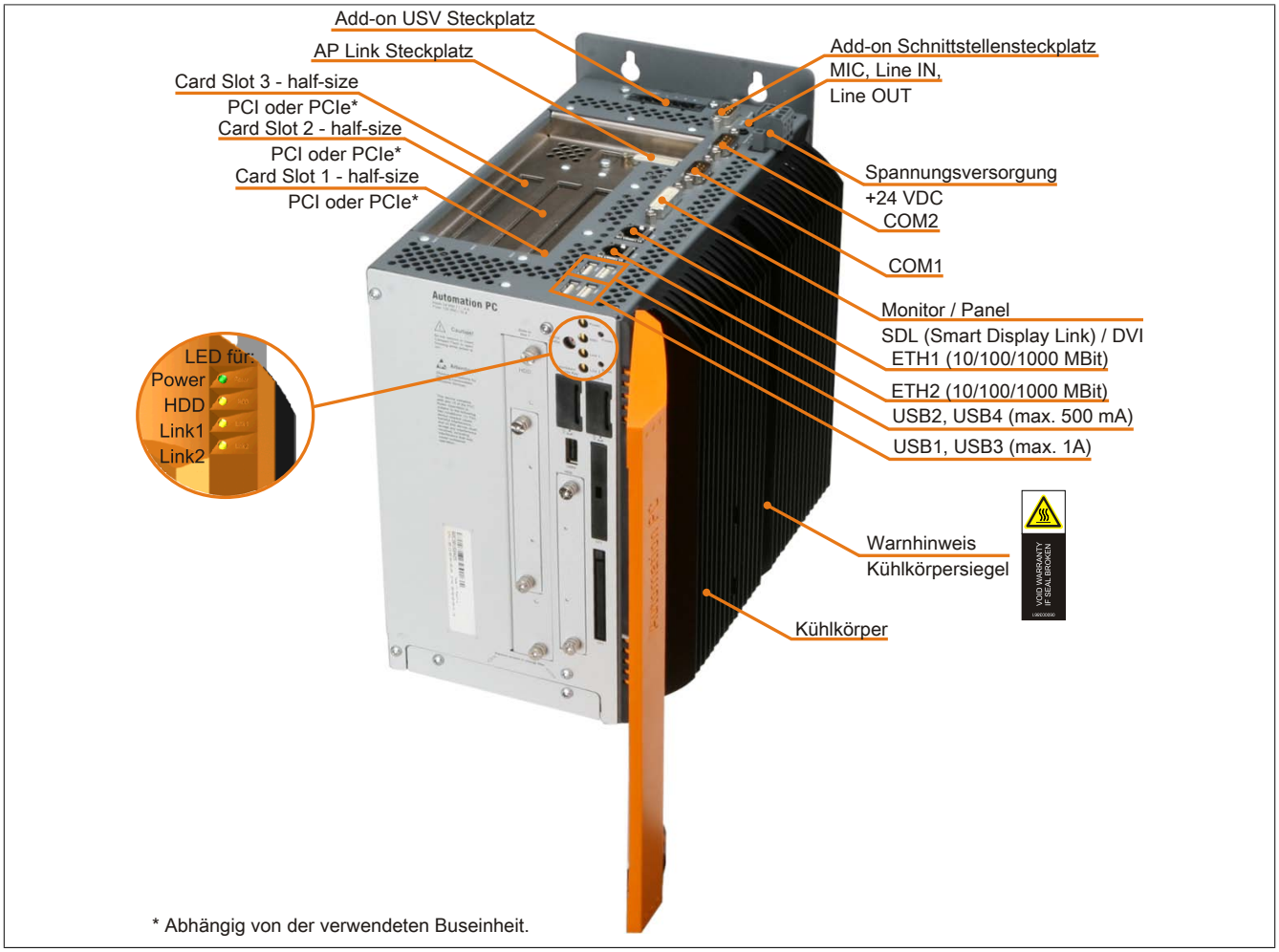


Abbildung 27: 5PC810.SX03-00 - Schnittstellen Oberseite

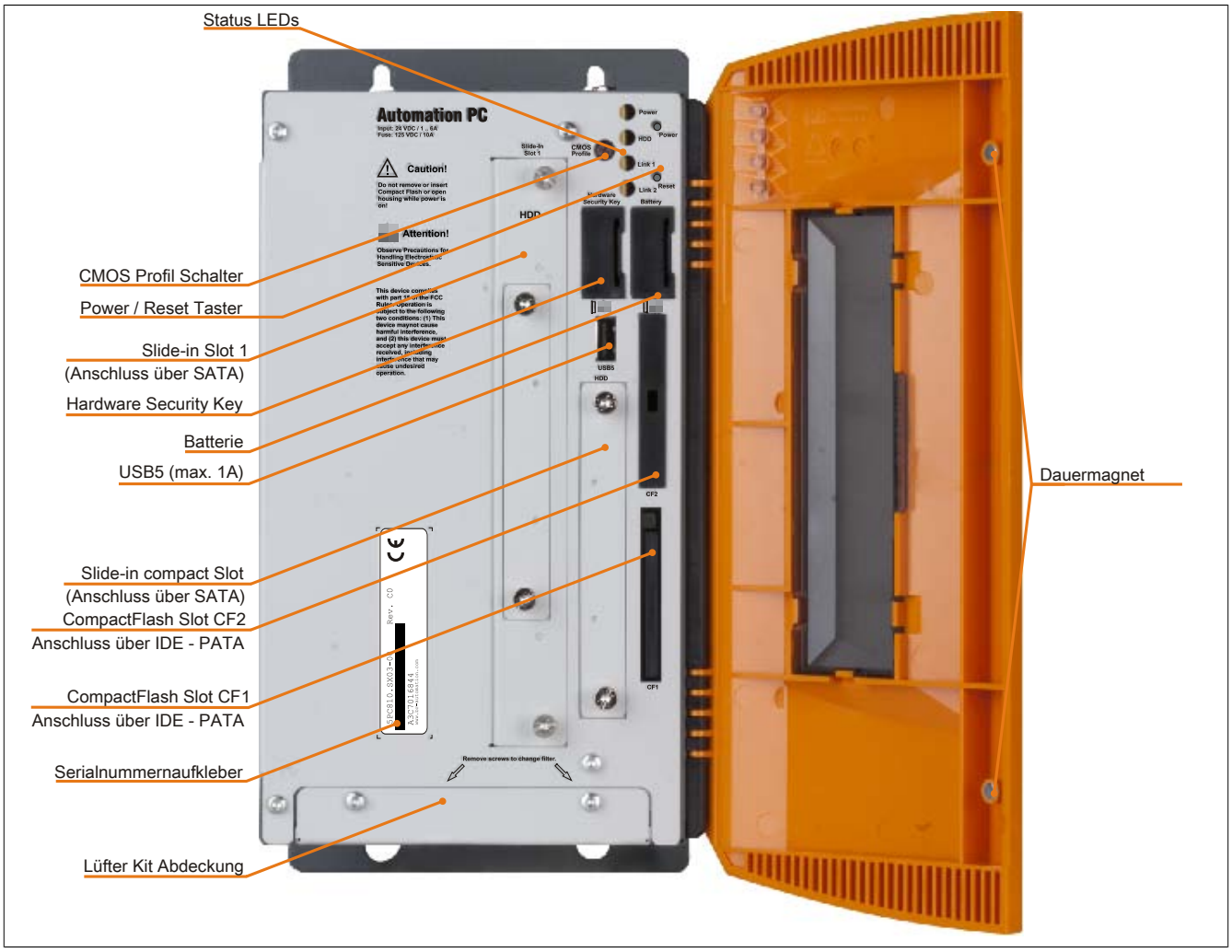


Abbildung 28: 5PC810.SX03-00 - Schnittstellen Vorderseite

3.1.3.4 Technische Daten

Produktbezeichnung	5PC810.SX03-00
Allgemeines	
Donglehalter	Ja
Kühlung	Passiv über Kühlkörper und optional unterstützend durch ein aktives Lüfter Kit [1)]
LEDs	Power, HDD, Link 1, Link 2
B&R ID-Code	0xB2C3
Batterie	
Typ	Renata 950 mAh
Lebensdauer	2½ Jahre [2)]
tauschbar	Ja, hinter der orangen Fronttüre zugänglich
Ausführung	Lithium Ionen
Power-Taster	Ja
Reset-Taster	Ja
Summer	Ja
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
GOST-R	Ja
Controller	
Boot-Loader	BIOS
Echtzeituhr	
batteriegepuffert	Ja
Power Fail Logik	
Controller	MTCX [3)]
Pufferzeit	10 ms
Grafik	
Controller	abhängig vom verwendeten CPU Board

Tabelle 50: 5PC810.SX03-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5PC810.SX03-00
SRAM	
Größe	512 kByte
batteriegepuffert	Ja
Remanente Variablen im Power Fail Mode	192 kByte (für z.B. Automation Runtime, siehe AS Hilfe)
Speicher	
Typ	abhängig vom verwendeten CPU Board
Speichergröße	abhängig vom verwendeten CPU Board
Schnittstellen	
COM1	
Typ	RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt
Ausführung	DSUB-Buchse, 9-polig, male
UART	16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
max. Baudrate	115 kBit/s
COM2	
Typ	RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt
Ausführung	DSUB-Buchse, 9-polig, male
UART	16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
max. Baudrate	115 kBit/s
CompactFlash Slot 1	
Anzahl	1
Typ	Typ I
CompactFlash Slot 2	
Anzahl	1
Typ	Typ I
USB	
Anzahl	5
Typ	USB 2.0
Ausführung	Typ A
Übertragungsrate	Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
Strombelastbarkeit	je Anschluss max. 500 mA bzw. 1 A
Ethernet	
Anzahl	2
Ausführung	geschirmter RJ45 Port
Übertragungsrate	10/100/1000 MBit/s
max. Baudrate	1 GBit/s
Panel/Monitor-Schnittstelle	
Ausführung	DVI-I Buchse
Typ	SDL/DVI/Monitor
CAN	
Anmerkung	optional
Audio	
Typ	AC97 Sound [4]
Eingänge	Mikrofon, Line In
Ausgänge	Line Out
Add-on Schnittstellensteckplatz	
Anzahl	1
Einschübe	
PCI / PCIe Slots	
Anzahl	2 PCI und 1PCIe Slot [5]
Slide-in Laufwerke	1
Slide-in compact Laufwerke	1
Automation Panel Link Slot	Ja
Add-on USV Steckplatz	Ja
Einschub für Lüfter Kit	Ja
Elektrische Eigenschaften	
Nennspannung	24 VDC ±25%, SELV [6]
Nennstrom	6 A
Einschaltstrom	typ. 7 A, max. 50 A für < 300 µs
Überspannungskategorie nach EN 61131-2	II
Galvanische Trennung	Ja
Einsatzbedingungen	
Schutzart nach EN 60529	IP20
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	
Betrieb	komponentenabhängig
Lagerung	-20 bis 60°C
Transport	-20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	komponentenabhängig
Lagerung	komponentenabhängig
Transport	komponentenabhängig

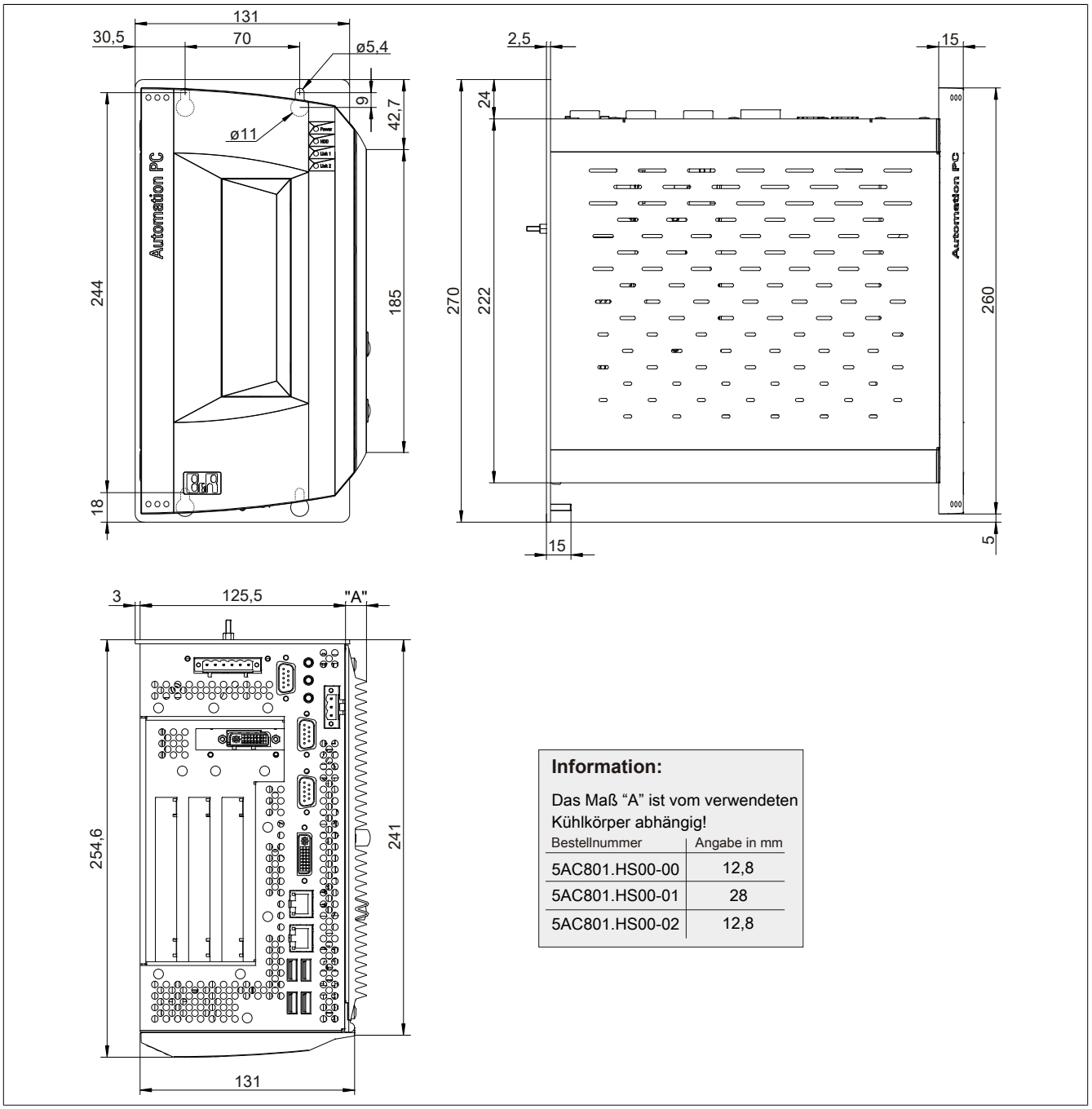
Tabelle 50: 5PC810.SX03-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5PC810.SX03-00
Vibration [7]	
Betrieb (dauerhaft)	2 bis 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 0,5 g
Betrieb (gelegentlich)	2 bis 9 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 1 g
Lagerung	2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Transport	2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Schock [7]	
Betrieb	15 g, 11 ms
Lagerung	30 g, 15 ms
Transport	30 g, 15 ms
Meereshöhe	
Betrieb	max. 3000 m (komponentenabhängig) [8]
Mechanische Eigenschaften	
Gehäuse [9]	
Material	verzinktes Blech, Kunststoff
Frontabdeckung	eingefärbter oranger Kunststoff (ähnlich Pantone 144CV)
Lackierung	hellgrau (ähnlich Pantone 427CV), dunkelgrau (ähnlich Pantone 432CV)
Abmessungen	
Breite	140,8 mm mit Kühlkörper 5AC801.HS00-00 und 5AC801.HS00-02 156,5 mm mit Kühlkörper 5AC801.HS00-01
Höhe	270 mm
Tiefe	254,6 mm
Gewicht	ca. 3200 g (komponentenabhängig)

Tabelle 50: 5PC810.SX03-00 - Technische Daten

1) Beim APC810 GM45 ist ein Lüfter Kit zwingend erforderlich.
2) Bei 50°C, 8,5 µA der zu versorgenden Komponenten und einer Selbstentladung von 40%.
3) Maintenance Controller Extended
4) Wird vom GM45 Chipsatz nicht mehr unterstützt.
5) Es kann die Buseinheit 5PC810.BX03-00 mit 2 PCI und 1 PCIe Slot verwendet werden.
6) Die Anforderungen sind gemäß EN 60950 einzuhalten, siehe Kapitel 2.6.1 Spannungsversorgung +24 VDC.
7) Maximalwerte, sofern eine Einzelkomponente keinen anderen angibt.
8) Herabsenkung (Derating) der maximalen Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 Meter ü. NN.
9) Prozess- bzw. chargenbedingt sind optische Abweichungen in der Farbe und Oberflächenbeschaffenheit möglich.

3.1.3.5 Abmessungen



Information:

Das Maß “A” ist vom verwendeten Kühlkörper abhängig!

Bestellnummer	Angabe in mm
5AC801.HS00-00	12,8
5AC801.HS00-01	28
5AC801.HS00-02	12,8

Abbildung 29: 5PC810.SX03-00 - Abmessungen

3.1.3.6 Bohrschablone

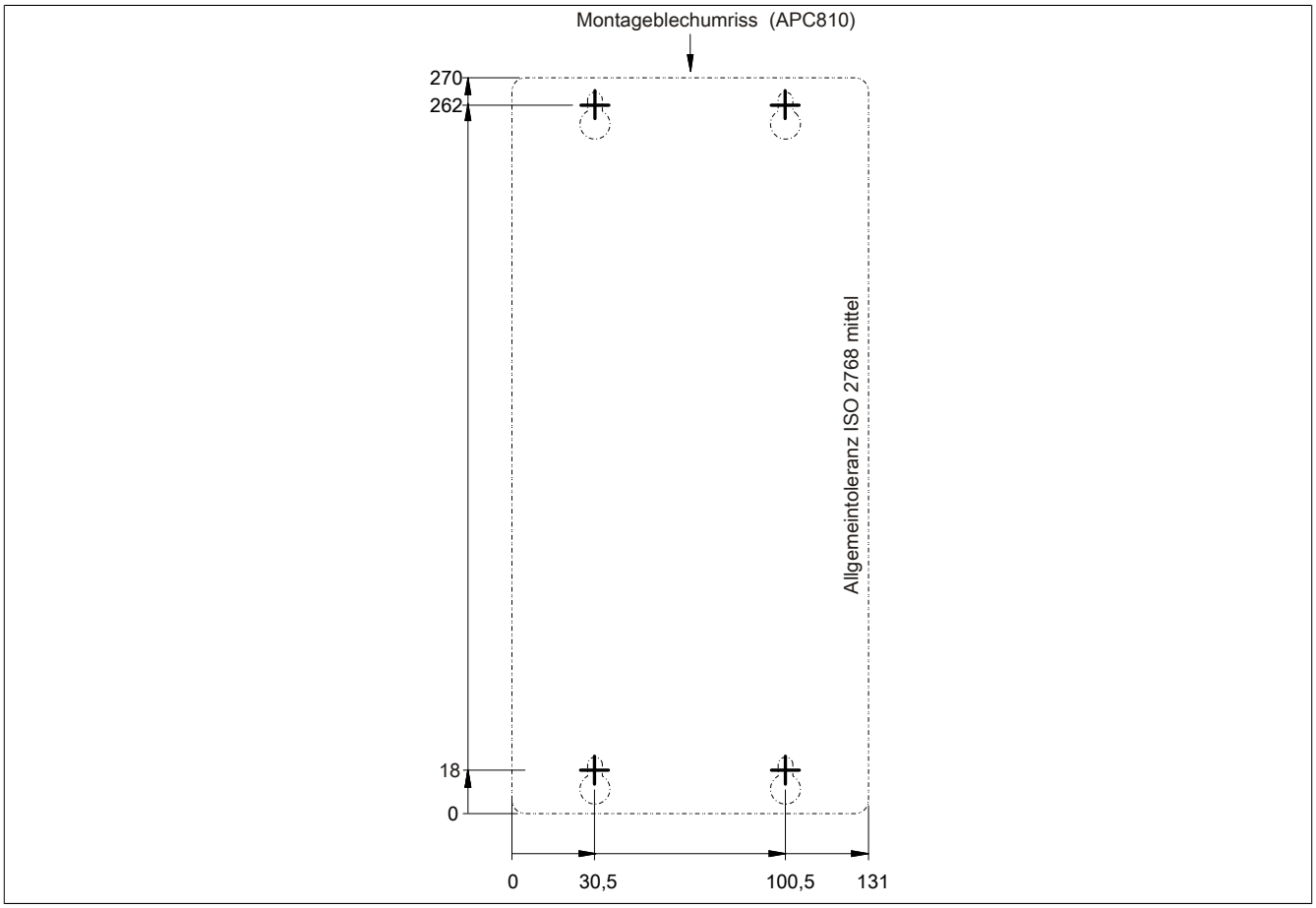


Abbildung 30: 5PC810.SX03-00 - Bohrschablone

3.1.4 5PC810.SX05-00

3.1.4.1 Allgemeines

- Steckplatz für eine Buseinheit mit 4 PCI und 1 PCIe Slot oder 2 PCI und 3 PCIe Slots oder 5 PCI Slots
- SRAM 512 kByte onboard
- Einschub für 1 Slide-in compact Laufwerk und 2 Slide-in Laufwerke
- Automation Panel Link Slot zum Anschluss von Automation Panels über SDL

3.1.4.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Systemeinheiten	
5PC810.SX05-00	APC810 Systemeinheit 5 Slots (PCI Ex- press, PCI, abhängig vom Bus); 1 Slot für Automation Panel Link Transmitter; 1 Slide-in compact und 2 Slide-in Steckplätze; Smart Display Link/ DVI/ Monitor, 2x RS232, 5x USB 2.0, 2x ETH 10/100/1000, 24 VDC Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzug- klemme 0TB103.91 gesondert bestellen)	
	Erforderliches Zubehör	
	Buseinheiten	
5PC810.BX05-00	APC810 Bus, 4 PCI, 1 PCI Express (x1)	
5PC810.BX05-01	APC810 Bus, 2 PCI, 3 PCI Express (x1)	
5PC810.BX05-02	APC810 Bus, 5 PCI	
	CPU Boards	
5PC800.B945-05	Intel Atom N270 CPU Board, 1,6 GHz, Single-Core, 533 MHz FSB, 512 kByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
5PC800.B945-10	Intel Core Duo L2400 CPU Board, 1,66 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
5PC800.B945-11	Intel Core2 Duo L7400 CPU Board, 1,5 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
5PC800.B945-12	Intel Core2 Duo U7500 CPU Board, 1,06 GHz, Dual-Core, 533 MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
5PC800.B945-13	Intel Celeron M 423 CPU Board, 1,06 GHz, Single-Core, 533 MHz FSB, 1 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
5PC800.B945-14	Intel Core2 Duo T7400 CPU Board, 2,16 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
	Feldklemmen	
0TB103.9	Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Schraubklemme 3,31 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch	
0TB103.91	Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Federzugklemme 3,31 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch	
	Hauptspeicher	
5MMDDR.0512-01	SO-DIMM DDR2 RAM 512 MByte PC2-5300	
5MMDDR.1024-01	SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MByte PC2-5300	
5MMDDR.2048-01	SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MByte PC2-5300	
	Kühlkörper	
5AC801.HS00-00	APC810 Kühlkörper für CPU Boards mit Dual Core Prozessoren L2400, L7400, U7500 und Celeron M 423.	
5AC801.HS00-01	APC810 Kühlkörper für CPU Boards mit Dual Core Prozessor T7400, T9400 und P8400.	
5AC801.HS00-02	APC810 Kühlkörper für CPU Board mit Atom Prozessor N270.	
	Optionales Zubehör	
	Automation Panel Link Steckkarten	
5AC801.RDYR-00	Ready Relais für APC810	
5AC801.SDL0-00	Smart Display Link/DVI-D Transmitter	
	Laufwerke	
5AC801.ADAS-00	SATA Hard Disk Adapter zum Betrieb einer Slide-in compact Hard Disk in einem Slide-in Slot.	
5AC801.DVDS-00	DVD-ROM SATA Laufwerk, Slide-in.	
5AC801.DVRS-00	DVD-R/RW DVD+R/RW SATA Laufwerk, Slide-in.	
5AC801.HDDI-00	40 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	

Tabelle 51: 5PC810.SX05-00 - Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
5AC801.HDDI-04	500 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	
5AC801.HDDS-00	40 GByte SATA Hard Disk, Slide-in; 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	
5AC801.SSDI-03	60 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.	
5AC801.SSDI-04	128 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.	
5AC801.SSDI-05	256 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.	
5ACPCI.RAIC-06	PCI RAID System SATA 2x 500 GByte; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	
	Lüfter Kit	
5PC810.FA05-00	APC810 Lüfterkit für Systemeinheit 5PC810.SX05-00.	
	Serialadapter	
5AC600.485I-00	RS232/422/485 Interface; zum Einbau in einen APC620, APC810 oder PPC700.	
5AC600.CANI-00	CAN Interface; Zum Einbau in einen APC620, APC810 oder PPC700.	
	Unterbrechungsfreie Stromversorgung	
5AC600.UPSI-00	USV Modul für APC620, APC810, PPC800; für Systemeinheiten 5PC600.SX01-00 (ab Rev. H0), 5PC600.SX02-00 (ab Rev. G0), 5PC600.SX02-01 (ab Rev. H0), 5PC600.SX05-00 (ab Rev. F0), 5PC600.SX05-01 (ab Rev. F0), 5PC600.SF03-00 (ab Rev. A0), 5PC810.SX*. 5PC820.1505-00, 5PC820.1906-00. Kabel (5CAUPS.0005-00 bzw. 5CAUPS.0030-00) und Batterieeinheit (5AC600.UPSB-00) sind separat zu bestellen.	
	Zubehör	
5ACPCI.ETH1-01	PCI Ethernet Card 1x 10/100	
5ACPCI.ETH3-01	PCI Ethernet Card 3x 10/100	

Tabelle 51: 5PC810.SX05-00 - Bestelldaten

3.1.4.3 Schnittstellen

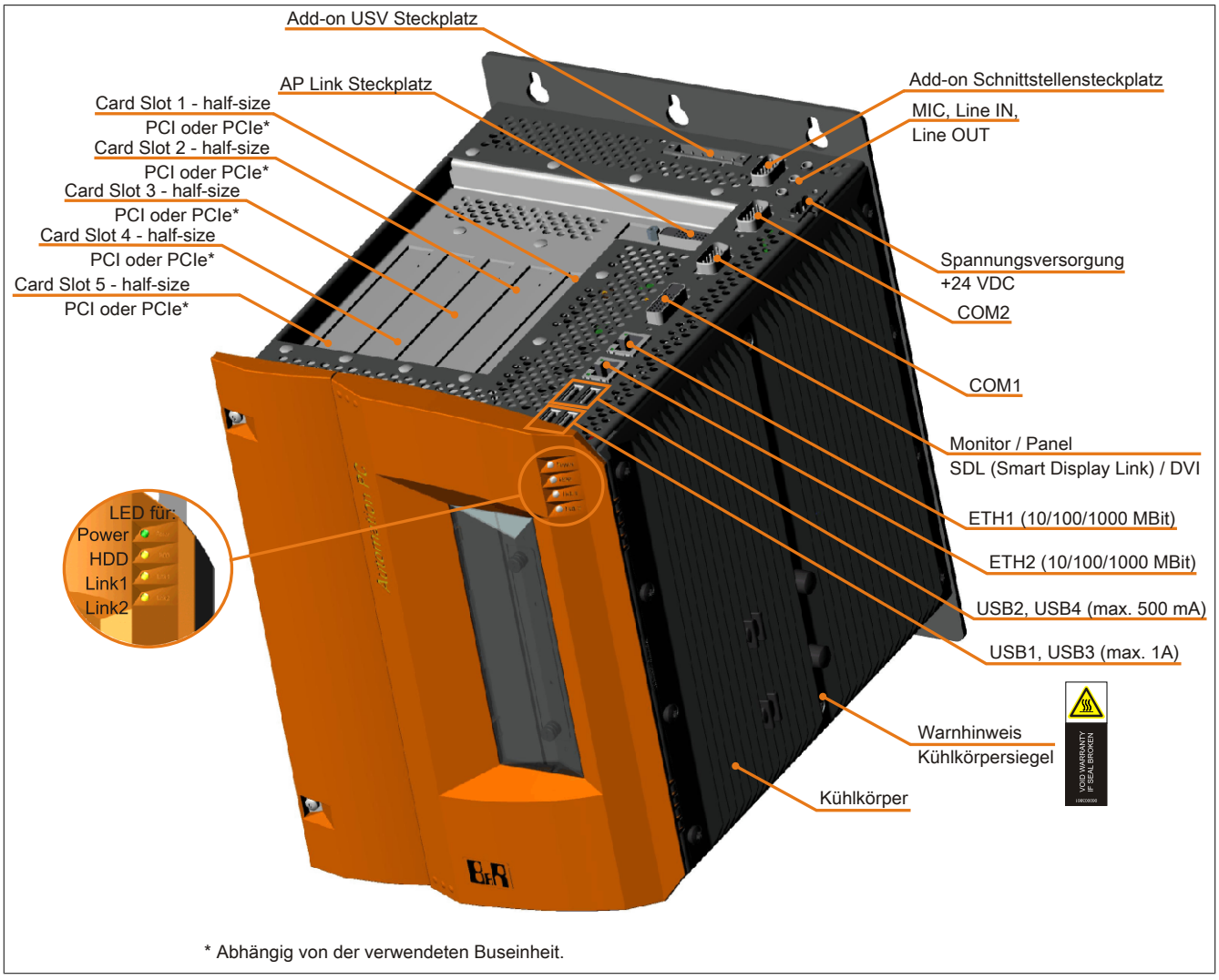


Abbildung 31: 5PC810.SX05-00 - Schnittstellen Oberseite

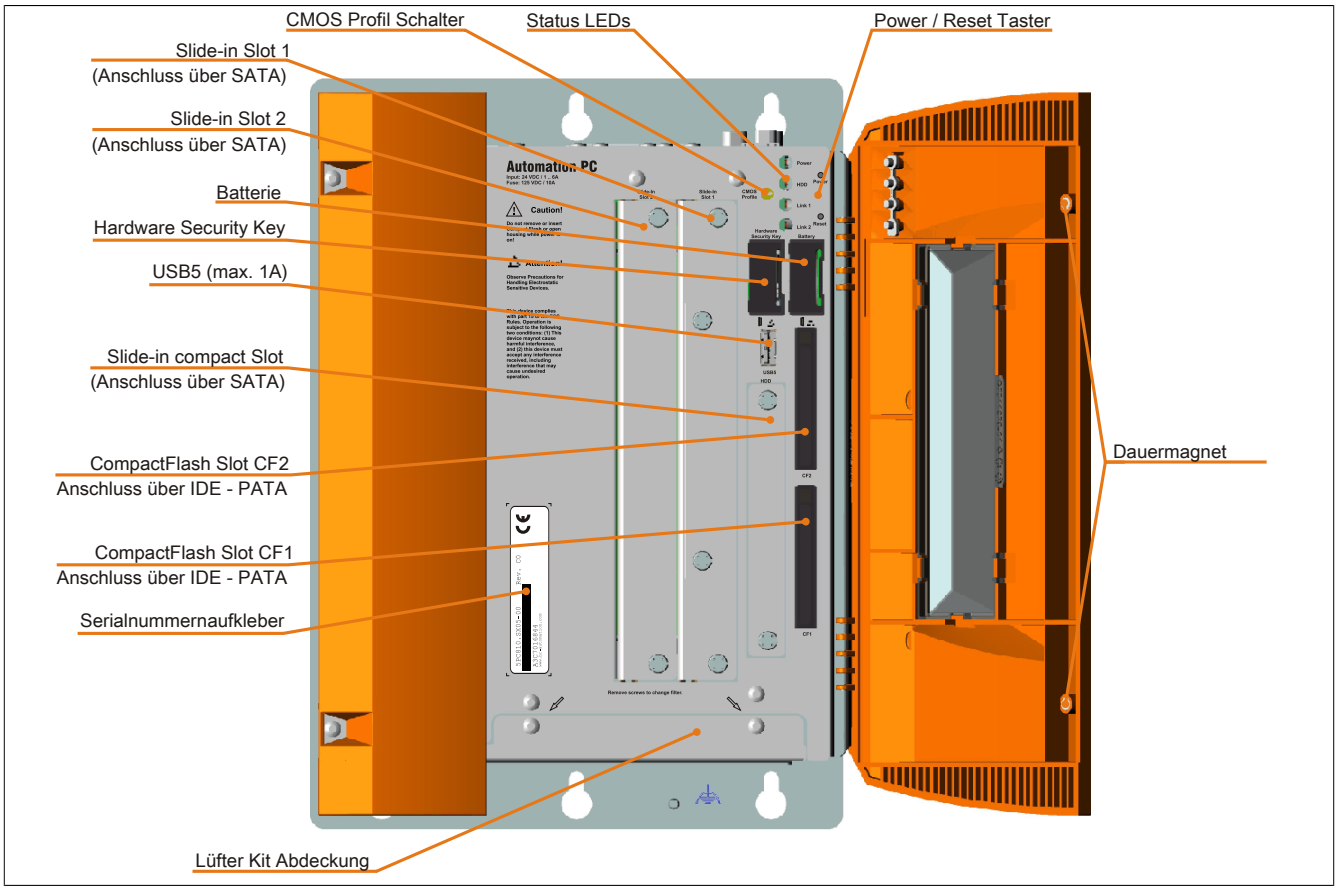


Abbildung 32: 5PC810.SX05-00 - Schnittstellen Vorderseite

3.1.4.4 Technische Daten

Produktbezeichnung	5PC810.SX05-00
Allgemeines	
Donglehalter	Ja
Kühlung	Passiv über Kühlkörper und optional unterstützend durch ein aktives Lüfter Kit [1]
LEDs	Power, HDD, Link 1, Link 2
B&R ID-Code	0xA3EE
Batterie	
Typ	Renata 950 mAh
Lebensdauer	2½ Jahre [2]
tauschbar	Ja, hinter der orangen Fronttüre zugänglich
Ausführung	Lithium Ionen
Power-Taster	Ja
Reset-Taster	Ja
Summer	Ja
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
GOST-R	Ja
Controller	
Boot-Loader	BIOS
Echtzeituhr	
batteriegepuffert	Ja
Power Fail Logik	
Controller	MTCX [3]
Pufferzeit	10 ms
Grafik	
Controller	abhängig vom verwendeten CPU Board
SRAM	
Größe	512 kByte
batteriegepuffert	Ja
Remanente Variablen im Power Fail Mode	192 kByte (für z.B. Automation Runtime, siehe AS Hilfe)
Speicher	
Typ	abhängig vom verwendeten CPU Board
Speichergröße	abhängig vom verwendeten CPU Board

Tabelle 52: 5PC810.SX05-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5PC810.SX05-00
Schnittstellen	
COM1	
Typ	RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt
Ausführung	DSUB-Buchse, 9-polig, male
UART	16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
max. Baudrate	115 kBit/s
COM2	
Typ	RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt
Ausführung	DSUB-Buchse, 9-polig, male
UART	16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
max. Baudrate	115 kBit/s
CompactFlash Slot 1	
Anzahl	1
Typ	Typ I
CompactFlash Slot 2	
Anzahl	1
Typ	Typ I
USB	
Anzahl	5
Typ	USB 2.0
Ausführung	Typ A
Übertragungsrate	Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
Strombelastbarkeit	je Anschluss max. 500 mA bzw. 1 A
Ethernet	
Anzahl	2
Ausführung	geschirmter RJ45 Port
Übertragungsrate	10/100/1000 MBit/s
max. Baudrate	1 GBit/s
Panel/Monitor-Schnittstelle	
Ausführung	DVI-I Buchse
Typ	SDL/DVI/Monitor
CAN	
Anmerkung	optional
Audio	
Typ	AC97 Sound [4]
Eingänge	Mikrofon, Line In
Ausgänge	Line Out
Add-on Schnittstellensteckplatz	
Anzahl	1
Einschübe	
PCI / PCIe Slots	
Anzahl	4 PCI und 1 PCIe Slots oder 2 PCI und 3 PCIe Slots oder 5 PCI Slots [5]
Slide-in Laufwerke	2
Slide-in compact Laufwerke	1
Automation Panel Link Slot	Ja
Add-on USV Steckplatz	Ja
Einschub für Lüfter Kit	Ja
Elektrische Eigenschaften	
Nennspannung	24 VDC ±25%, SELV [6]
Nennstrom	6 A
Einschaltstrom	typ. 7 A, max. 50 A für < 300 µs
Überspannungskategorie nach EN 61131-2	II
Galvanische Trennung	Ja
Einsatzbedingungen	
Schutzart nach EN 60529	IP20
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	
Betrieb	komponentenabhängig
Lagerung	-20 bis 60°C
Transport	-20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	komponentenabhängig
Lagerung	komponentenabhängig
Transport	komponentenabhängig
Vibration [7]	
Betrieb (dauerhaft)	2 bis 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 0,5 g
Betrieb (gelegentlich)	2 bis 9 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 1 g
Lagerung	2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Transport	2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Schock [7]	
Betrieb	15 g, 11 ms
Lagerung	30 g, 15 ms
Transport	30 g, 15 ms

Tabelle 52: 5PC810.SX05-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5PC810.SX05-00
Meereshöhe	
Betrieb	max. 3000 m (komponentenabhängig) [8]
Mechanische Eigenschaften	
Gehäuse [9]	
Material	verzinktes Blech, Kunststoff
Frontabdeckung	eingefärbter oranger Kunststoff (ähnlich Pantone 144CV)
Lackierung	hellgrau (ähnlich Pantone 427CV), dunkelgrau (ähnlich Pantone 432CV)
Abmessungen	
Breite	201,7 mm mit Kühlkörper 5AC801.HS00-00 und 5AC801.HS00-02 216,9 mm mit Kühlkörper 5AC801.HS00-01
Höhe	270 mm
Tiefe	254,5 mm
Gewicht	ca. 3900 g (komponentenabhängig)

Tabelle 52: 5PC810.SX05-00 - Technische Daten

1) Beim APC810 GM45 ist ein Lüfter Kit zwingend erforderlich.
2) Bei 50°C, 8,5 µA der zu versorgenden Komponenten und einer Selbstentladung von 40%.
3) Maintenance Controller Extended
4) Wird vom GM45 Chipsatz nicht mehr unterstützt.
5) Die PCI Slots und PCIe Slots sind abhängig von der verwendeten Buseinheit 5PC810.BX05-00, 5PC810.BX05-01 und 5PC810.BX05-02.
6) Die Anforderungen sind gemäß EN 60950 einzuhalten, siehe Kapitel 2.6.1 Spannungsversorgung +24 VDC.
7) Maximalwerte, sofern eine Einzelkomponente keinen anderen angibt.
8) Herabsenkung (Derating) der maximalen Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 Meter ü. NN.
9) Prozess- bzw. chargenbedingt sind optische Abweichungen in der Farbe und Oberflächenbeschaffenheit möglich.

3.1.4.5 Abmessungen

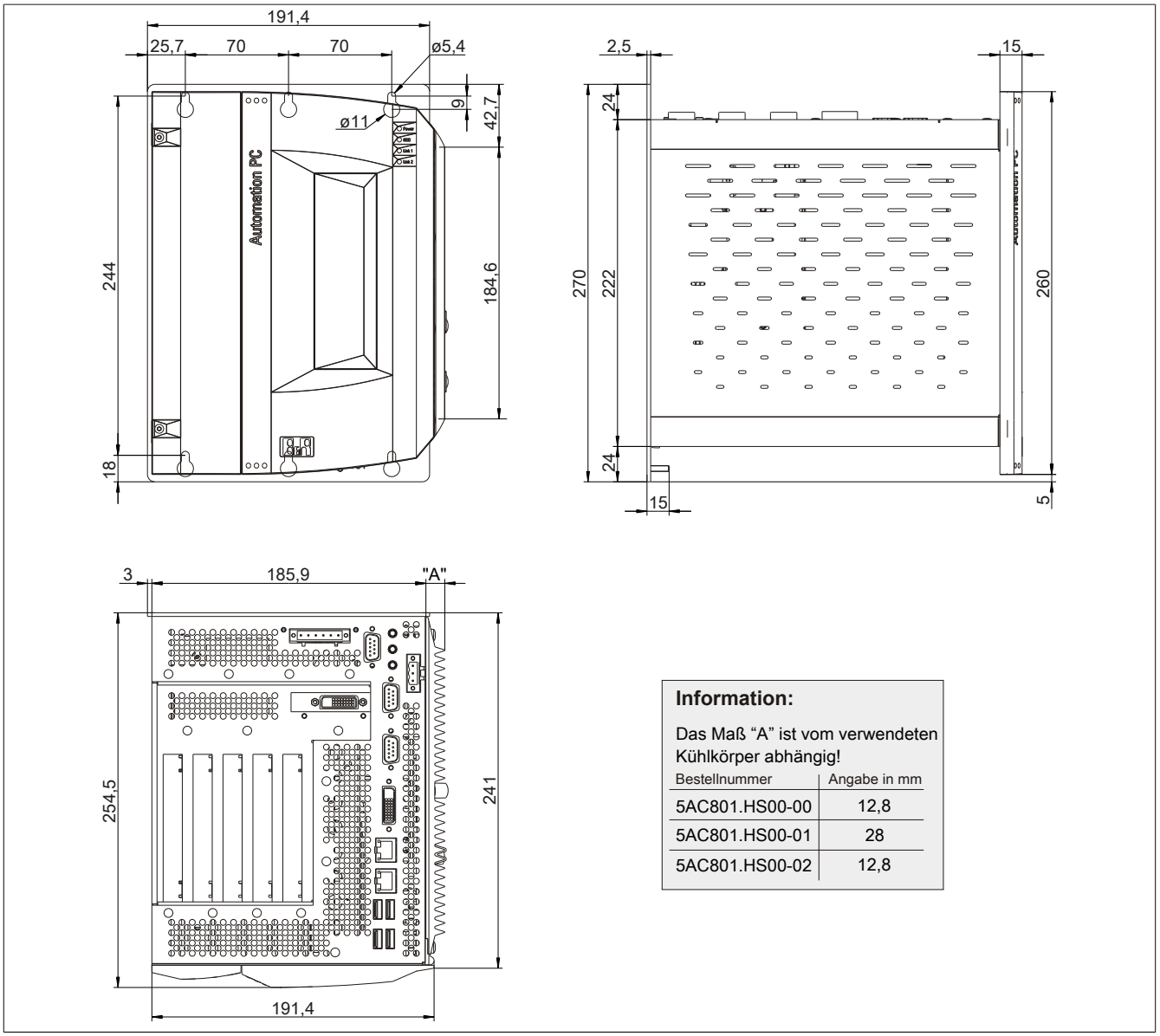


Abbildung 33: 5PC810.SX05-00 - Abmessungen

3.1.4.6 Bohrschablone

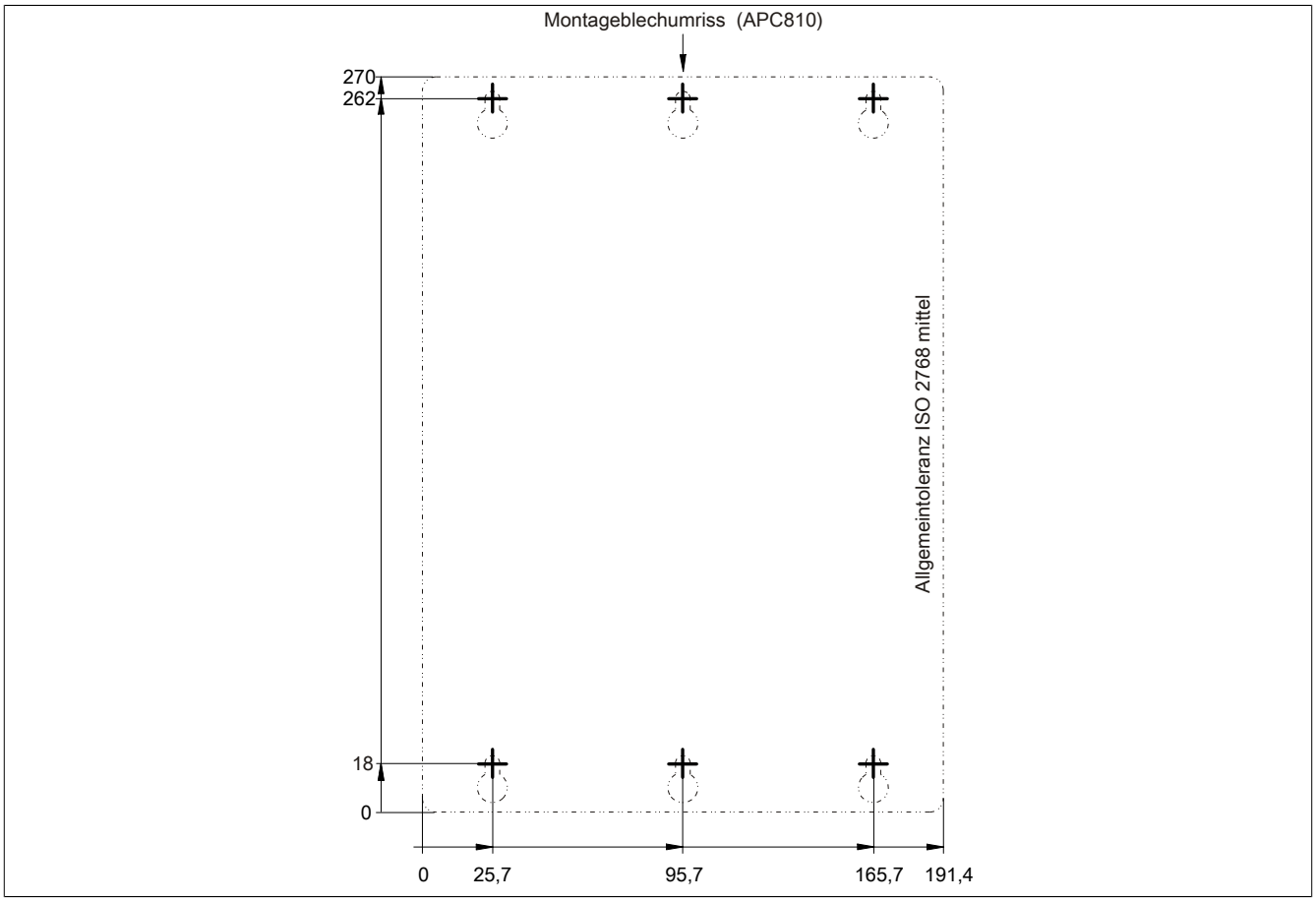


Abbildung 34: 5PC810.SX05-00 - Bohrschablone

3.2 Buseinheiten

3.2.1 Allgemeines

Die Buseinheiten sind passend zu den Systemeinheiten in 1, 2, 3 bzw. 5 Card Slot Größen mit PCI und / oder PCI Express Unterstützung erhältlich.

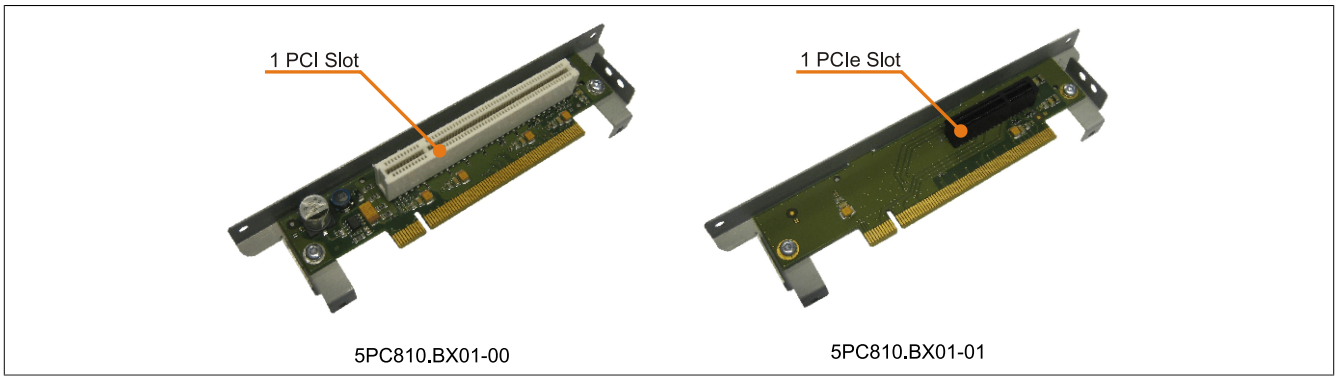


Abbildung 35: 1 Slot Buseinheiten

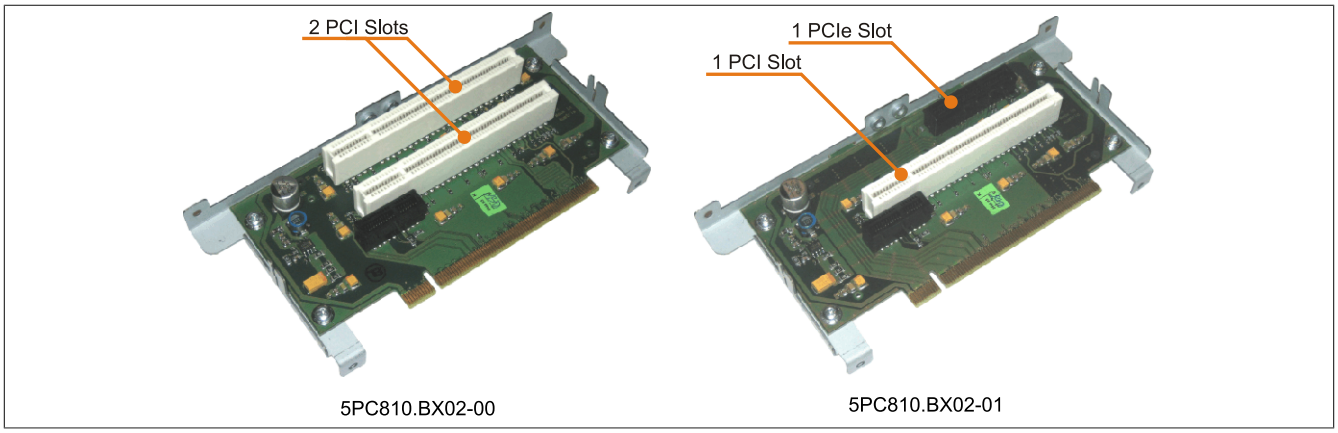


Abbildung 36: 2 Slot Buseinheiten

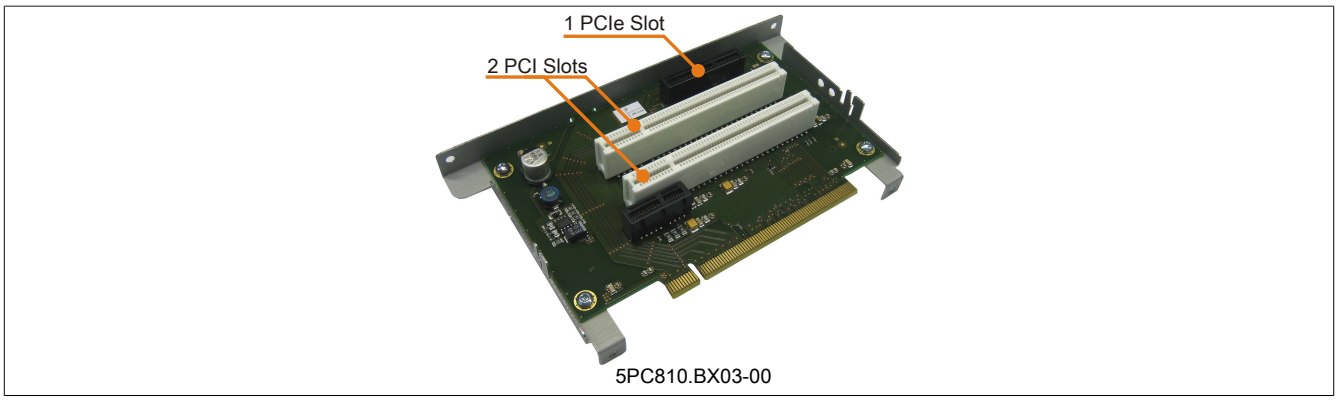


Abbildung 37: 3 Slot Buseinheit

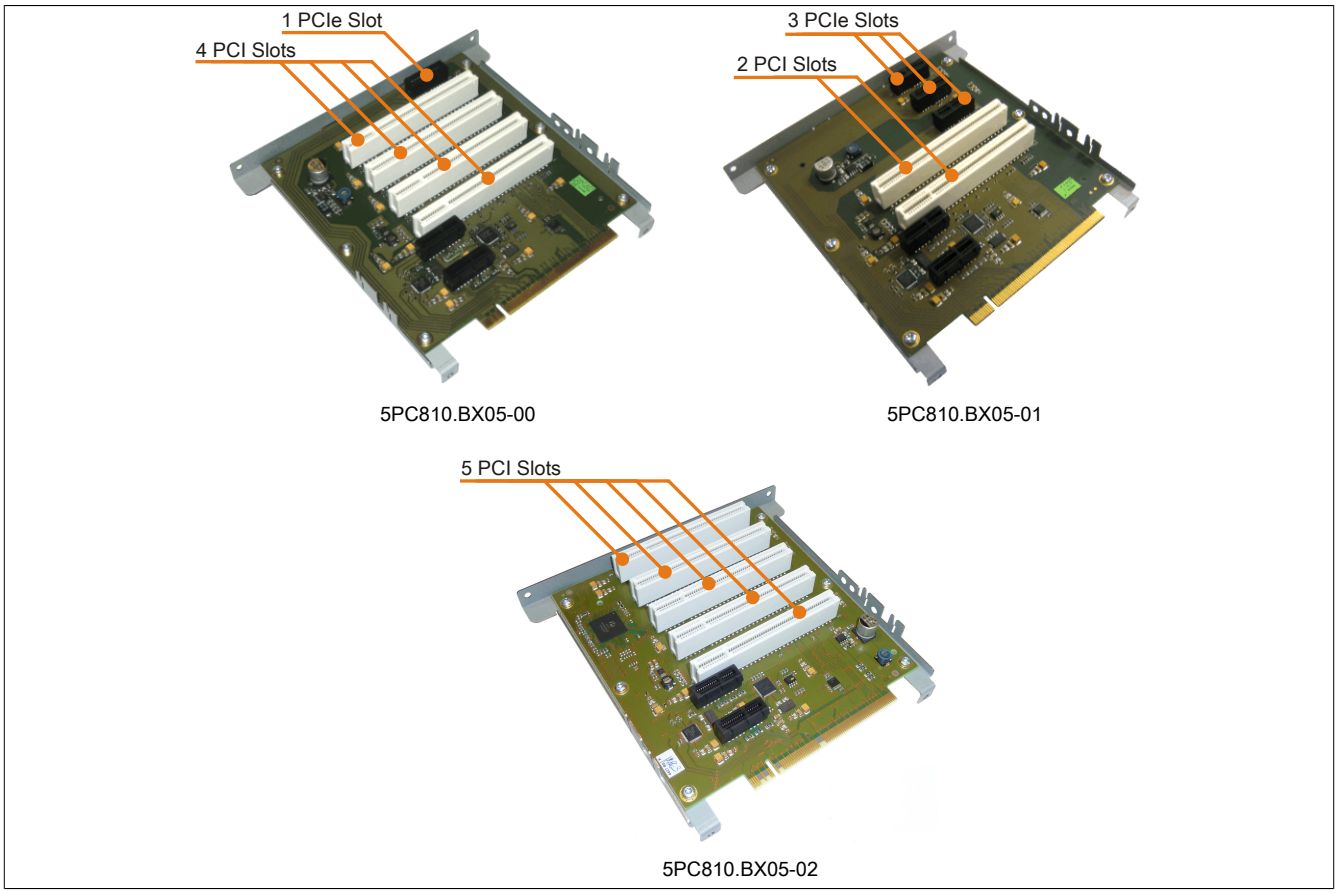


Abbildung 38: 5 Slot Buseinheiten

3.2.2 Bestelldaten

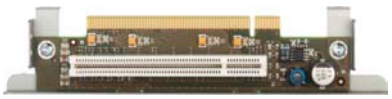
Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Buseinheiten	
5PC810.BX01-00	APC810 Bus, 1 PCI	
5PC810.BX01-01	APC810 Bus, 1 PCI Express (x4)	
5PC810.BX02-00	APC810 Bus, 2 PCI	
5PC810.BX02-01	APC810 Bus, 1 PCI, 1 PCI Express (x4)	
5PC810.BX03-00	APC810 Bus, 2 PCI, 1 PCI Express (x4)	
5PC810.BX05-00	APC810 Bus, 4 PCI, 1 PCI Express (x1)	
5PC810.BX05-01	APC810 Bus, 2 PCI, 3 PCI Express (x1)	
5PC810.BX05-02	APC810 Bus, 5 PCI	

Tabelle 53: 5PC810.BX01-00, 5PC810.BX01-01, 5PC810.BX02-00, 5PC810.BX02-01, 5PC810.BX03-00, 5PC810.BX05-00, 5PC810.BX05-01, 5PC810.BX05-02 - Bestelldaten

3.2.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5PC810. BX01-00	5PC810. BX01-01	5PC810. BX02-00	5PC810. BX02-01	5PC810. BX03-00	5PC810. BX05-00	5PC810. BX05-01	5PC810. BX05-02
Allgemeines								
Zertifizierungen								
CE	Ja							
cULus HazLoc Class 1 Division 2	Ja [1]	-	Ja [1]	-	-	-	-	-
ATEX Zone 22	Ja [1]	-	Ja [1]	-	-	-	-	-
GOST-R	Ja							
GL	Ja [2]	Ja [2]	Ja [2]	Ja [2]	-	-	-	-
Einschübe								
PCI Slots								
Anzahl	1	-	2	1	2	4	2	5
Typ	32 Bit	-	32 Bit	32 Bit	32 Bit	32 Bit	32 Bit	32 Bit
Ausführung	PCI half-size	-	PCI half-size	PCI half-size	PCI half-size	PCI half-size	PCI half-size	PCI half-size
Standard	2.2 [3]	-	2.2 [3]	2.2 [3]	2.2 [3]	2.2 [3]	2.2 [3]	2.2 [3]
Bus Speed	33 MHz	-	33 MHz	33 MHz	33 MHz	33 MHz	33 MHz	33 MHz
PCI to PCI Bridge	-	-	-	-	-	-	-	Ja, Slot 4 und 5

Tabelle 54: 5PC810.BX01-00, 5PC810.BX01-01, 5PC810.BX02-00, 5PC810.BX02-01, 5PC810.BX03-00, 5PC810.BX05-00, 5PC810.BX05-01, 5PC810.BX05-02 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5PC810. BX01-00	5PC810. BX01-01	5PC810. BX02-00	5PC810. BX02-01	5PC810. BX03-00	5PC810. BX05-00	5PC810. BX05-01	5PC810. BX05-02
PCIe Slots								
Anzahl	-	1	-	1	1	1	3	-
Ausführung	-	PCIe half-size	-	PCIe half-size	PCIe half-size	PCIe half-size	PCIe half-size	-
Standard	-	1.0a	-	1.0a	1.0a	1.0a	1.0a	-
Bus Speed	-	x4 (10 GByte/s)	-	x4 (10 GByte/s)	x4 (10 GByte/s)	x1 (2,5 GByte/s)	x1 (2,5 GByte/s)	-

Tabelle 54: 5PC810.BX01-00, 5PC810.BX01-01, 5PC810.BX02-00, 5PC810.BX02-01, 5PC810.BX03-00, 5PC810.BX05-00, 5PC810.BX05-01, 5PC810.BX05-02 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben und das Gesamtgerät die entsprechende Kennzeichnung trägt.
2) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
3) Aufgrund mechanischer Einschränkungen kann eine 64-Bit PCI Karte nicht in jede Systemeinheit bzw. jeden Card Slot gesteckt werden. Eine Tabelle im Anwenderhandbuch gibt eine Übersicht in welchen Card Slot das Stecken von 64-Bit Karten möglich ist.

3.3 CPU Boards 945GME

3.3.1 Allgemeines

- AMI BIOS
- Intel® 945GME Chipsatz
- 2x DDR2 Speichersockel
- Dual Channel Memory
- Intel® GMA 950
- Gigabit Ethernet

3.3.2 Bestelldaten

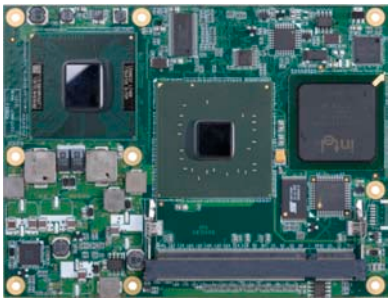
Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	CPU Boards	
5PC800.B945-00	Intel Core Duo L2400 CPU Board, 1,66 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111B.	
5PC800.B945-01	Intel Core2 Duo L7400 CPU Board, 1,5 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111B.	
5PC800.B945-02	Intel Core2 Duo U7500 CPU Board, 1,06 GHz, Dual-Core, 533 MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111B.	
5PC800.B945-03	Intel Celeron M 423 CPU Board, 1,06 GHz, Single-Core, 533 MHz FSB, 1 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111B.	
5PC800.B945-04	Intel Core2 Duo T7400 CPU Board, 2,16 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111B.	
5PC800.B945-05	Intel Atom N270 CPU Board, 1,6 GHz, Single-Core, 533 MHz FSB, 512 kByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
	Erforderliches Zubehör	
	Hauptspeicher	
5MMDDR.0512-01	SO-DIMM DDR2 RAM 512 MByte PC2-5300	
5MMDDR.1024-01	SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MByte PC2-5300	
5MMDDR.2048-01	SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MByte PC2-5300	

Tabelle 55: 5PC800.B945-00, 5PC800.B945-01, 5PC800.B945-02, 5PC800.B945-03, 5PC800.B945-04, 5PC800.B945-05 - Bestelldaten

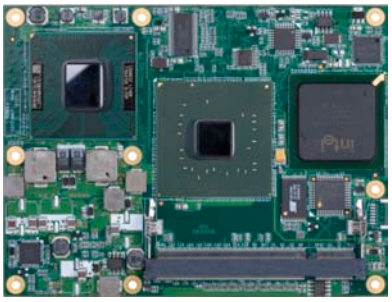
Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	CPU Boards	
5PC800.B945-10	Intel Core Duo L2400 CPU Board, 1,66 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
5PC800.B945-11	Intel Core2 Duo L7400 CPU Board, 1,5 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
5PC800.B945-12	Intel Core2 Duo U7500 CPU Board, 1,06 GHz, Dual-Core, 533 MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
5PC800.B945-13	Intel Celeron M 423 CPU Board, 1,06 GHz, Single-Core, 533 MHz FSB, 1 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
5PC800.B945-14	Intel Core2 Duo T7400 CPU Board, 2,16 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
	Erforderliches Zubehör	
	Hauptspeicher	
5MMDDR.0512-01	SO-DIMM DDR2 RAM 512 MByte PC2-5300	
5MMDDR.1024-01	SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MByte PC2-5300	
5MMDDR.2048-01	SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MByte PC2-5300	

Tabelle 56: 5PC800.B945-10, 5PC800.B945-11, 5PC800.B945-12, 5PC800.B945-13, 5PC800.B945-14 - Bestelldaten

3.3.3 Technische Daten 5PC800.B945-0x

Produktbezeichnung	5PC800.B945-00	5PC800.B945-01	5PC800.B945-02	5PC800.B945-03	5PC800.B945-04	5PC800.B945-05
Allgemeines						
Zertifizierungen						
CE	Ja					
cULus	-	-	-	-	-	Ja
GOST-R	-	-	-	Ja	-	Ja
GL	-	-	-	-	-	Ja [1]
Controller						
Boot-Loader	embedded AMI BIOS					
Prozessor						
Typ	Intel® Core™ Duo L2400	Intel® Core™2 Duo L7400	Intel® Core™2 Duo U7500	Intel® Celeron® M 423	Intel® Core™2 Duo T7400	Intel® Atom™ N270
Taktfrequenz	1660 MHz	1500 MHz	1060 MHz	1060 MHz	2160 MHz	1660 MHz
Anzahl der Kerne	2	2	2	1	2	1
Architektur	65 nm	65 nm	65 nm	65 nm	65 nm	45 nm
L1 Cache	32 kByte	32 kByte	32 kByte	32 kByte	32 kByte	24 kByte
L2 Cache	2 MByte	4 MByte	2 MByte	1 MByte	4 MByte	512 kByte
Externer Bus	667 MHz	667 MHz	533 MHz	533 MHz	667 MHz	533 MHz
Intel 64 Architecture	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein
Intel Virtualization Technology (VT-x)	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein
Enhanced Intel SpeedStep Technology	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Chipsatz	Intel® 945GME Intel® 82801 GHM (ICH7M-DH)					
Echtzeituhr						
Genauigkeit	bei 25°C: typ. 12 ppm (1 Sekunde) pro Tag					
batteriegepuffert	Ja					
Speichersockel						
Typ	DDR2					
Speichergröße	max. 3 GByte					
Grafik						
Controller	Intel® Graphics Media Accelerator 950					
Speicher	bis zu 224 MByte [2]					
Farbtiefe	max. 32 Bit					
Auflösung						
DVI	2x Intel compliant SDVO Ports, 1920 x 1080					
RGB	400 MHz RAMDAC, Auflösung bis zu 2048 x 1536 @75 Hz (QXGA) und 1920 x 1080 @85 Hz (HDTV)					
Massenspeicherverwaltung	2x SATA, 1x IDE					
Power Management	ACPI 2.0, S3 Support (suspend to RAM)					

Tabelle 57: 5PC800.B945-00, 5PC800.B945-01, 5PC800.B945-02, 5PC800.B945-03, 5PC800.B945-04, 5PC800.B945-05 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
2) Wird im Hauptspeicher allokiert.

3.3.4 Technische Daten 5PC800.B945-1x

Produktbezeichnung	5PC800.B945-10	5PC800.B945-11	5PC800.B945-12	5PC800.B945-13	5PC800.B945-14
Allgemeines					
Zertifizierungen					
CE	Ja				
cULus	Ja				
GOST-R	Ja				
Controller					
Boot-Loader	embedded AMI BIOS				
Prozessor					
Typ	Intel® Core™ Duo L2400	Intel® Core™2 Duo L7400	Intel® Core™2 Duo U7500	Intel® Celeron® M 423	Intel® Core™2 Duo T7400
Taktfrequenz	1660 MHz	1500 MHz	1060 MHz	1060 MHz	2160 MHz
Anzahl der Kerne	2	2	2	1	2
Architektur	65 nm				
L1 Cache	32 kByte				
L2 Cache	2 MByte	4 MByte	2 MByte	1 MByte	4 MByte
Externer Bus	667 MHz	667 MHz	533 MHz	533 MHz	667 MHz
Intel 64 Architecture	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja
Intel Virtualization Technology (VT-x)	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja
Enhanced Intel SpeedStep Technology	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja
Chipsatz	Intel® 945GME Intel® 82801 GHM (ICH7M-DH)				

Tabelle 58: 5PC800.B945-10, 5PC800.B945-11, 5PC800.B945-12, 5PC800.B945-13, 5PC800.B945-14 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5PC800.B945-10	5PC800.B945-11	5PC800.B945-12	5PC800.B945-13	5PC800.B945-14
Echtzeituhr					
Genauigkeit	bei 25°C: typ. 12 ppm (1 Sekunde) pro Tag				
batteriegepuffert	Ja				
Speichersockel					
Typ	DDR2				
Speichergröße	max. 3 GByte				
Grafik					
Controller	Intel® Graphics Media Accelerator 950				
Speicher	bis zu 224 MByte [1]				
Farbtiefe	max. 32 Bit				
Auflösung					
DVI	2x Intel compliant SDVO Ports, 1920 x 1080				
RGB	400 MHz RAMDAC, Auflösung bis zu 2048 x 1536 @75 Hz (QXGA) und 1920 x 1080 @85 Hz (HDTV)				
Massenspeicherverwaltung	2x SATA, 1x IDE				
Power Management	ACPI 2.0, S3 Support (suspend to RAM)				

Tabelle 58: 5PC800.B945-10, 5PC800.B945-11, 5PC800.B945-12, 5PC800.B945-13, 5PC800.B945-14 - Technische Daten

1) Wird im Hauptspeicher allokiert.

3.4 Kühlkörper

3.4.1 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Kühlkörper	
5AC801.HS00-00	APC810 Kühlkörper für CPU Boards mit Dual Core Prozessoren L2400, L7400, U7500 und Celeron M 423.	
5AC801.HS00-01	APC810 Kühlkörper für CPU Boards mit Dual Core Prozessor T7400, T9400 und P8400.	
5AC801.HS00-02	APC810 Kühlkörper für CPU Board mit Atom Prozessor N270.	
	Erforderliches Zubehör	
	CPU Boards	
5PC800.B945-00	Intel Core Duo L2400 CPU Board, 1,66 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111B.	
5PC800.B945-01	Intel Core2 Duo L7400 CPU Board, 1,5 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111B.	
5PC800.B945-02	Intel Core2 Duo U7500 CPU Board, 1,06 GHz, Dual-Core, 533 MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111B.	
5PC800.B945-03	Intel Celeron M 423 CPU Board, 1,06 GHz, Single-Core, 533 MHz FSB, 1 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111B.	
5PC800.B945-04	Intel Core2 Duo T7400 CPU Board, 2,16 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111B.	
5PC800.B945-05	Intel Atom N270 CPU Board, 1,6 GHz, Single-Core, 533 MHz FSB, 512 kByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
5PC800.B945-10	Intel Core Duo L2400 CPU Board, 1,66 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
5PC800.B945-11	Intel Core2 Duo L7400 CPU Board, 1,5 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
5PC800.B945-12	Intel Core2 Duo U7500 CPU Board, 1,06 GHz, Dual-Core, 533 MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
5PC800.B945-13	Intel Celeron M 423 CPU Board, 1,06 GHz, Single-Core, 533 MHz FSB, 1 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
5PC800.B945-14	Intel Core2 Duo T7400 CPU Board, 2,16 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	

Tabelle 59: 5AC801.HS00-00, 5AC801.HS00-01, 5AC801.HS00-02 - Bestelldaten

3.4.2 Technische Daten

Product ID	5AC801.HS00-00	5AC801.HS00-01	5AC801.HS00-02
Allgemeines			
geeignet für CPU Boards	5PC800.B945-00 / -10 5PC800.B945-01 / -11 5PC800.B945-02 / -12 5PC800.B945-03 / -13	5PC800.B945-04 / -14	5PC800.B945-05
Zertifizierungen			
CE		Ja	
cULus HazLoc Class 1 Division 2	-	Ja [1]	-
ATEX Zone 22	-	Ja [1]	-
GOST-R		Ja	
GL	-	-	Ja [1]
Mechanische Eigenschaften			
Material	Aluminium, schwarz lackiert mit Kupfer Heat Pipes		

Tabelle 60: 5AC801.HS00-00, 5AC801.HS00-01, 5AC801.HS00-02 - Technical data

Product ID	5AC801.HS00-00	5AC801.HS00-01	5AC801.HS00-02
Abmessungen			
Breite		228,7 mm	
Höhe		218 mm	
Tiefe	12,8 mm	28 mm	12,8 mm
Gewicht	ca. 1700 g	ca. 2000 g	ca. 1700 g

Tabelle 60: 5AC801.HS00-00, 5AC801.HS00-01, 5AC801.HS00-02 - Technical data

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

3.5 Hauptspeicher

3.5.1 Allgemeines

Diese 200-poligen DDR2 Hauptspeicher arbeiten mit einer Speichergeschwindigkeit von 677 MHz und sind mit einer Speichergröße von 512 MByte, 1 GByte und 2 GByte verfügbar.

Werden zwei gleich große (z.B. 1 GByte) Module gesteckt so wird die Dual-Channel Memory Technologie unterstützt. Werden zwei ungleich große (z.B. 1 GByte und 2 GByte) Module gesteckt, so wird diese Technologie nicht unterstützt.

Werden zwei 2 GByte Module gesteckt, so sind nur 3 GByte Hauptspeicher verwendbar.

3.5.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Hauptspeicher	
5MMDDR.0512-01	SO-DIMM DDR2 RAM 512 MByte PC2-5300	
5MMDDR.1024-01	SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MByte PC2-5300	
5MMDDR.2048-01	SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MByte PC2-5300	

Tabelle 61: 5MMDDR.0512-01, 5MMDDR.1024-01, 5MMDDR.2048-01 - Bestelldaten

3.5.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5MMDDR.0512-01	5MMDDR.1024-01	5MMDDR.2048-01
Allgemeines			
Zertifizierungen			
CE		Ja	
cULus		Ja	
GOST-R		Ja	
GL		Ja [1)]	
Controller			
Speicher			
Typ		SO-DIMM DDR2-SDRAM	
Speichergröße	512 MByte	1 GByte	2 GByte
Bauart		200 Pin	
Organisation	64M x 64 Bit	128M x 64 Bit	256M x 64 Bit
Geschwindigkeit		DDR2-667 (PC2-5300)	

Tabelle 62: 5MMDDR.0512-01, 5MMDDR.1024-01, 5MMDDR.2048-01 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

Information:

Ein Hauptspeichertausch kann NUR im Werk B&R durchgeführt werden.

3.6 Laufwerke

3.6.1 5AC801.HDDI-00

3.6.1.1 Allgemeines

Diese 40 GByte Slide-in compact Hard Disk ist für den 24 Stunden Betrieb spezifiziert und bietet zusätzlich eine erweiterte Temperaturspezifikation. Das Slide-in compact Laufwerk kann in APC810 und PPC800 Systemeinheiten verwendet werden.

Bei Verwendung in einem APC810

Intern wird das Slide-in compact Laufwerk bei Steckung in den Slide-in compact Slot als SATA angesprochen.

3.6.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	
5AC801.HDDI-00	40 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	

Tabelle 63: 5AC801.HDDI-00 - Bestelldaten

3.6.1.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für diese Einzelkomponente alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5AC801.HDDI-00
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
GOST-R	Ja
GL	Ja [1]
Hard Disk	
Kapazität	40 GByte
Anzahl der Köpfe	1
Anzahl der Sektoren	78.140.160
Bytes pro Sektor	512
Cache	8 MByte
Drehzahl	5400 rpm ±1%
Hochlaufzeit	typ. 3 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)
MTBF	750.000 POH [2]
S.M.A.R.T. Support	Ja
Schnittstelle	SATA
Zugriffszeit	5,6 ms
Datentransferrate	
intern	max. 450 MBits/s
zum / vom Host	max. 150 MByte/s (Ultra-DMA Mode 5)
Positionierzeit	
minimal (Spur zu Spur)	1 ms
nominal (Lesezugriff)	12,5 ms
maximal (Lesezugriff)	23 ms

Tabelle 64: 5AC801.HDDI-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5AC801.HDDI-00
Umgebungsbedingungen	
Temperatur [3]	
Betrieb [4]	-30 bis 85°C
Betrieb - 24 Stunden [5]	-30 bis 85°C
Lagerung	-40 bis 95°C
Transport	-40 bis 95°C
Luftfeuchtigkeit [6]	
Betrieb	5 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration	
Betrieb	5 bis 500 Hz: 2 g; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung	5 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Transport	5 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Schock	
Betrieb	300 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler 150 g und 11 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung	800 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler 400 g und 0,5 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Transport	800 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler 400 g und 0,5 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Meereshöhe	
Betrieb	-300 bis 5000 m
Lagerung	-300 bis 12192 m
Mechanische Eigenschaften	
Montage	fix [7]
Abmessungen	
Breite	13 mm
Höhe	98 mm
Tiefe	105 mm
Gewicht	134 g
Herstellerinformation	
Hersteller	Seagate
Herstellerbezeichnung	ST940817SM

Tabelle 64: 5AC801.HDDI-00 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
2) Bei 8760 POH (Power On Hours) pro Jahr und 70°C Oberflächentemperatur.
3) Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshöhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle 305 Meter um 1°C verringert werden. Die Temperatur Zu- und Abnahme darf pro Stunde maximal 20°C betragen.
4) Standardbetrieb bedeutet 333 POH (Power On Hours) pro Monat.
5) 24 Stundenbetrieb bedeutet 732 POH (Power On Hours) pro Monat.
6) Luftfeuchtigkeitsgradient: Maximal 15% pro Stunde.
7) Montageweise auf Slide-in compact.

3.6.1.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm

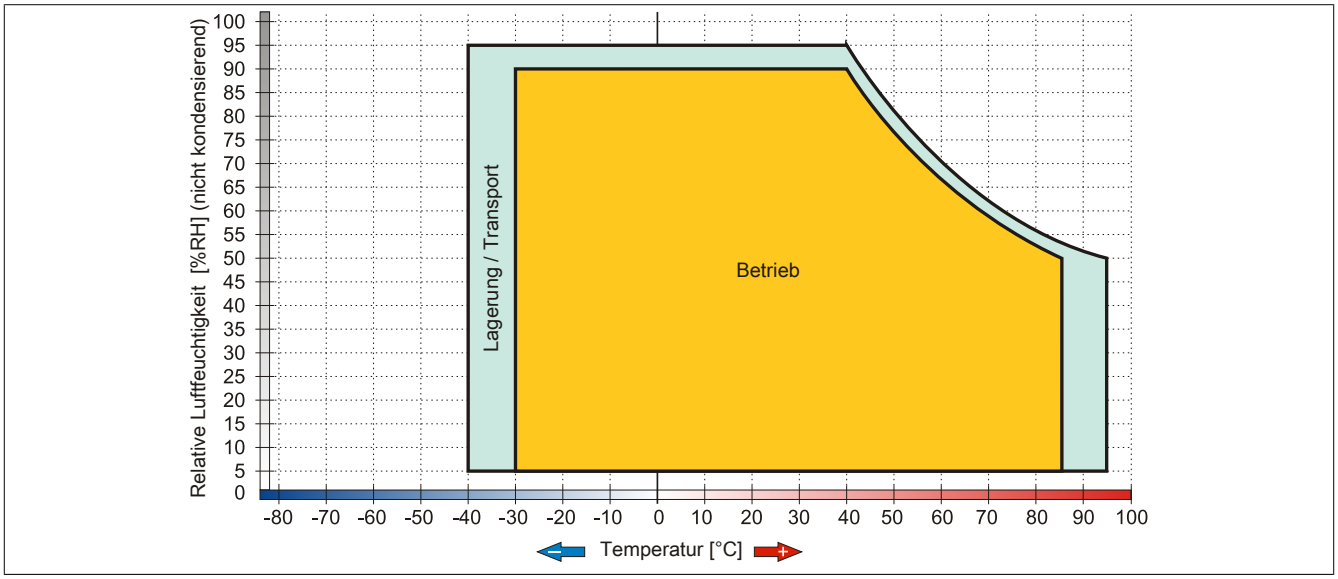


Abbildung 39: 5AC801.HDDI-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.6.2 5AC801.HDDI-01

3.6.2.1 Allgemeines

Diese 80 GByte Slide-in compact Hard Disk ist für den 24 Stunden Betrieb spezifiziert und bietet zusätzlich eine erweiterte Temperaturspezifikation. Das Slide-in compact Laufwerk kann in APC810 und PPC800 Systemeinheiten verwendet werden.

Bei Verwendung in einem APC810

Intern wird das Slide-in compact Laufwerk bei Steckung in den Slide-in compact Slot als SATA angesprochen.

3.6.2.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	
5AC801.HDDI-01	80 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.	

Tabelle 65: 5AC801.HDDI-01 - Bestelldaten

3.6.2.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5AC801.HDDI-01
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
Hard Disk	
Kapazität	80 GByte
Anzahl der Köpfe	2
Anzahl der Sektoren	156.301.488
Bytes pro Sektor	512
Cache	8 MByte
Drehzahl	5400 rpm ±1%
Hochlaufzeit	typ. 3 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)
MTBF	750.000 POH [1]
S.M.A.R.T. Support	Ja
Schnittstelle	SATA
Zugriffszeit	5,6 ms
Datentransferrate	
intern	max. 450 MBits/s
zum / vom Host	max. 150 MByte/s (Ultra-DMA Mode 5)
Positionierzeit	
minimal (Spur zu Spur)	1 ms
nominal (Lesezugriff)	12,5 ms
maximal (Lesezugriff)	23 ms
Umgebungsbedingungen	
Temperatur [2]	
Betrieb [3]	-30 bis 85°C
Betrieb - 24 Stunden [4]	-30 bis 85°C
Lagerung	-40 bis 95°C
Transport	-40 bis 95°C
Luftfeuchtigkeit [5]	
Betrieb	5 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend

Tabelle 66: 5AC801.HDDI-01 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5AC801.HDDI-01
Vibration	
Betrieb	5 bis 500 Hz: 2 g; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung	5 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Transport	5 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Schock	
Betrieb	300 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler 150 g und 11 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung	300 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler 150 g und 11 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Transport	300 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler 150 g und 11 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Meereshöhe	
Betrieb	-300 bis 5000 m
Lagerung	-300 bis 12192 m
Mechanische Eigenschaften	
Montage	fix [6]
Abmessungen	
Breite	13 mm
Höhe	98 mm
Tiefe	105 mm
Gewicht	133 g
Herstellerinformation	
Hersteller	Seagate
Herstellerbezeichnung	ST980817SM

Tabelle 66: 5AC801.HDDI-01 - Technische Daten

1) Bei 8760 POH (Power On Hours) pro Jahr und 70°C Oberflächentemperatur.
2) Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshöhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle 305 Meter um 1°C verringert werden. Die Temperatur Zu- und Abnahme darf pro Stunde maximal 20°C betragen.
3) Standardbetrieb bedeutet 333 POH (Power On Hours) pro Monat.
4) 24 Stundenbetrieb bedeutet 732 POH (Power On Hours) pro Monat.
5) Luftfeuchtigkeitsgradient: Maximal 15% pro Stunde.
6) Montageweise auf Slide-in compact.

3.6.2.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm

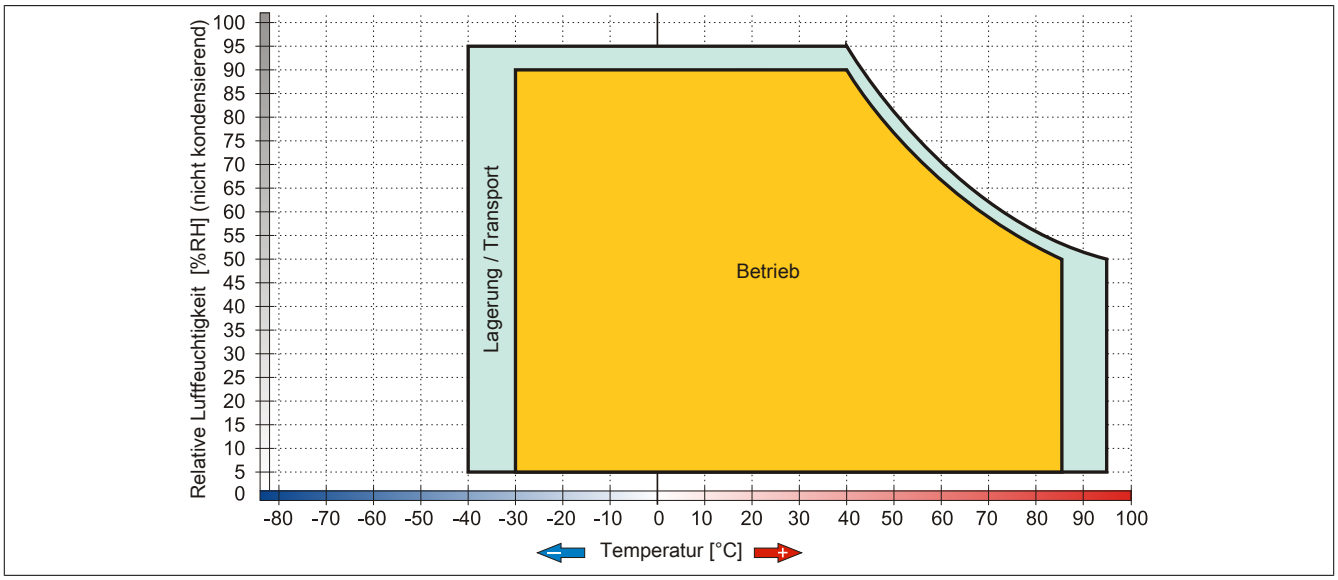


Abbildung 40: 5AC801.HDDI-01 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.6.3 5AC801.HDDI-02

3.6.3.1 Allgemeines

Diese 160 GByte Slide-in compact Hard Disk ist für den 24 Stunden Betrieb (24x7) spezifiziert und bietet zusätzlich eine erweiterte Temperaturspezifikation (ET). Das Slide-in compact Laufwerk kann in APC810 und PPC800 Systemeinheiten verwendet werden.

Bei Verwendung in einem APC810

Intern wird das Slide-in compact Laufwerk bei Steckung in den Slide-in compact Slot als SATA angesprochen.

3.6.3.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	
5AC801.HDDI-02	160 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	

Tabelle 67: 5AC801.HDDI-02 - Bestelldaten

3.6.3.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für diese Einzelkomponente alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5AC801.HDDI-02
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
GL	Ja [1]
Hard Disk	
Kapazität	160 GByte
Anzahl der Köpfe	3
Anzahl der Sektoren	312.581.808
Bytes pro Sektor	512
Cache	8 MByte
Drehzahl	5400 rpm ±1%
Hochlaufzeit	typ. 4 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)
MTBF	300.000 POH [2]
S.M.A.R.T. Support	Ja
Schnittstelle	SATA
Zugriffszeit	12 ms
Datentransferrate	
intern	max. 84,6 MBits/s
zum / vom Host	max. 150 MByte/s (Ultra-DMA Mode 5)
Positionierzeit	
minimal (Spur zu Spur)	1,5 ms
nominal (Lesezugriff)	12 ms
maximal (Lesezugriff)	22 ms

Tabelle 68: 5AC801.HDDI-02 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5AC801.HDDI-02
Umgebungsbedingungen	
Temperatur [3]	
Betrieb	-15 bis 80°C
Betrieb - 24 Stunden [4]	-15 bis 80°C
Lagerung	-40 bis 95°C
Transport	-40 bis 95°C
Luftfeuchtigkeit [5]	
Betrieb	8 bis 90%, nicht kondensierend [6]
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend [7]
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend [7]
Vibration	
Betrieb	5 bis 500 Hz: 1 g; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung	5 bis 500 Hz: 5 g, keine Beschädigung
Transport	5 bis 500 Hz: 5 g, keine Beschädigung
Schock	
Betrieb	325 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung	900 g, 1 ms; keine Beschädigung 120 g, 11 ms; keine Beschädigung
Transport	900 g, 1 ms; keine Beschädigung 120 g, 11 ms; keine Beschädigung
Meereshöhe	
Betrieb	-300 bis 3000 m
Lagerung	-300 bis 12192 m
Mechanische Eigenschaften	
Montage	fix [8]
Abmessungen	
Breite	13 mm
Höhe	98 mm
Tiefe	105 mm
Gewicht	135 g
Herstellerinformation	
Hersteller	Fujitsu
Herstellerbezeichnung	MHY2160BH-ESW

Tabelle 68: 5AC801.HDDI-02 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
2) Bei 8760 POH (Power On Hours) pro Jahr und 70°C Oberflächentemperatur.
3) Standardbetrieb bedeutet 333 POH (Power On Hours) pro Monat.
4) 24 Stundenbetrieb bedeutet 732 POH (Power On Hours) pro Monat.
5) Luftfeuchtigkeitsgradient: Maximal 15% pro Stunde.
6) Maximalfeuchtigkeit bei 29°C.
7) Maximalfeuchtigkeit bei 40°C.
8) Montageweise auf Slide-in compact.

3.6.3.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm

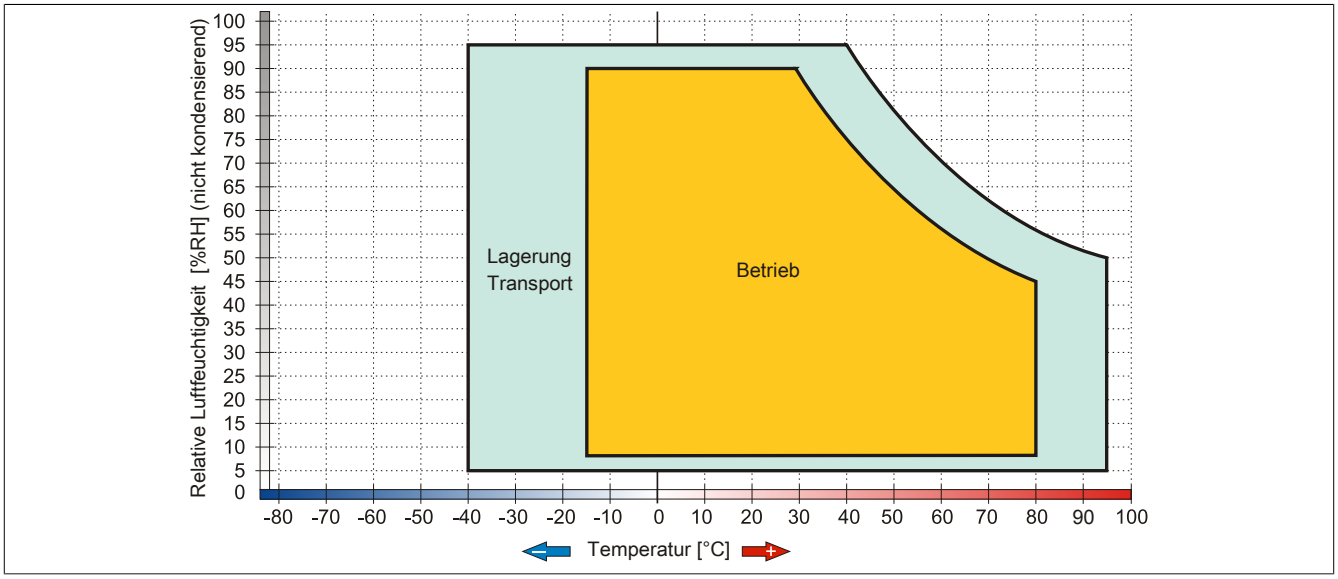


Abbildung 41: 5AC801.HDDI-02 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.6.4 5AC801.HDDI-03

3.6.4.1 Allgemeines

Diese 250 GByte Slide-in compact Hard Disk ist für den 24 Stunden Betrieb spezifiziert. Das Slide-in compact Laufwerk kann in APC810 und PPC800 Systemeinheiten verwendet werden.

Bei Verwendung in einem APC810

Intern wird das Slide-in compact Laufwerk bei Steckung in den Slide-in compact Slot als SATA angesprochen.

3.6.4.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	
5AC801.HDDI-03	250 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	
	Optionales Zubehör	
	Laufwerke	
5MMHDD.0250-00	250 GByte SATA Hard Disk Ersatzteil für 5AC801.HDDI-03 und 5ACPCI.RAIC-05; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	

Tabelle 69: 5AC801.HDDI-03 - Bestelldaten

3.6.4.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für diese Einzelkomponente alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5AC801.HDDI-03
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
cULus HazLoc Class 1 Division 2	Ja [1]
ATEX Zone 22	Ja [1]
GOST-R	Ja
GL	Ja [2]
Hard Disk	
Kapazität	250 GByte
Anzahl der Köpfe	1
Anzahl der Sektoren	488.397.168
Bytes pro Sektor	512
Cache	8 MByte
Drehzahl	5400 rpm ±0,2%
Hochlaufzeit	typ. 3,6 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)
MTBF	550.000 POH [3]
S.M.A.R.T. Support	Ja
Schnittstelle	SATA
Zugriffszeit	5,56 ms
unterstützte Transfermodi	SATA 1.0, Serial ATA Revision 2.6 PIO Modus 0-4, Multiword DMA Modus 0-2, UDMA Modus 0-6
Datentransferrate	
intern	max. 1175 MBit/s
zum / vom Host	max. 150 MByte/s (SATA I), max. 300 MByte/s (SATA II)
Positionierzeit	
minimal (Spur zu Spur)	1 ms
nominal (Lesezugriff)	14 ms
maximal (Lesezugriff)	30 ms

Tabelle 70: 5AC801.HDDI-03 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5AC801.HDDI-03
Umgebungsbedingungen	
Temperatur [4]	
Betrieb [5]	0 bis 60°C
Betrieb - 24 Stunden [6]	0 bis 60°C
Lagerung	-40 bis 70°C
Transport	-40 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit [7]	
Betrieb	5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration	
Betrieb	5 bis 500 Hz: 0,5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung	5 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Transport	5 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Schock	
Betrieb	350 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung	800 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler 1000 g und 1 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler 600 g und 0,5 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Transport	800 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler 1000 g und 1 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler 600 g und 0,5 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Meereshöhe	
Betrieb	-300 bis 3048 m
Lagerung	-300 bis 12192 m
Mechanische Eigenschaften	
Montage	fix [8]
Abmessungen	
Breite	13 mm
Höhe	98 mm
Tiefe	105 mm
Gewicht	134 g
Herstellerinformation	
Hersteller	Seagate
Herstellerbezeichnung	ST9250315AS

Tabelle 70: 5AC801.HDDI-03 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben und das Gesamtgerät die entsprechende Kennzeichnung trägt.
2) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
3) Bei 8760 POH (Power On Hours) pro Jahr und 25°C Oberflächentemperatur.
4) Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshöhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle 305 Meter um 1°C verringert werden. Die Temperatur Zu- und Abnahme darf pro Stunde maximal 20°C betragen.
5) Standardbetrieb bedeutet 333 POH (Power On Hours) pro Monat.
6) 24 Stundenbetrieb bedeutet 732 POH (Power On Hours) pro Monat.
7) Luftfeuchtigkeitsgradient: Maximal 30% pro Stunde.
8) Montageweise auf Slide-in compact.

3.6.4.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm

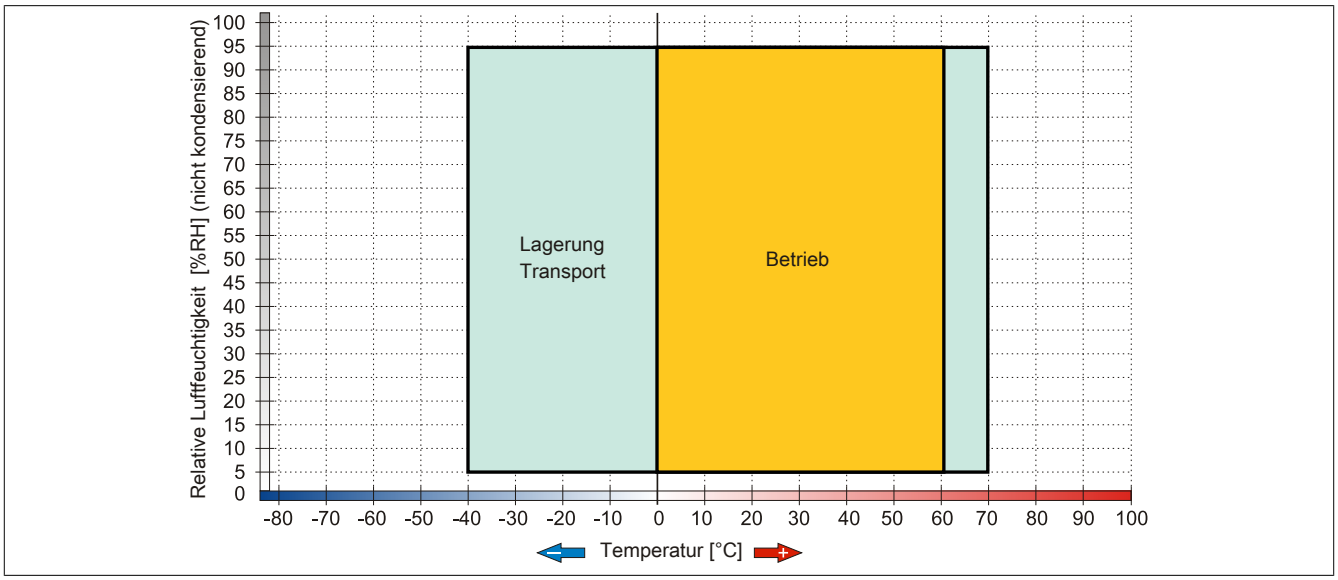


Abbildung 42: 5AC801.HDDI-03 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.6.5 5AC801.HDDI-04

3.6.5.1 Allgemeines

Diese 500 GByte Slide-in compact Hard Disk ist für den 24 Stunden Betrieb spezifiziert. Das Slide-in compact Laufwerk kann in APC810 und PPC800 Systemeinheiten verwendet werden.

- 500 GByte Hard Disk
- Slide-in compact
- für 24 Stunden Betrieb spezifiziert
- S.M.A.R.T. Support

Bei Verwendung in einem APC810

Intern wird das Slide-in compact Laufwerk bei Steckung in den Slide-in compact Slot als SATA angesprochen.

3.6.5.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	
5AC801.HDDI-04	500 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	
	Optionales Zubehör	
	Laufwerke	
5MMHDD.0500-00	500 GByte Hard Disk - SATA	

Tabelle 71: 5AC801.HDDI-04 - Bestelldaten

3.6.5.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5AC801.HDDI-04
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
GOST-R	Ja
GL	Ja [1]
Hard Disk	
Kapazität	500 GByte
Anzahl der Köpfe	2
Anzahl der Sektoren	976.773.168
Bytes pro Sektor	512 (logical) / 4096 (physical)
Cache	16 MByte
Drehzahl	5400 rpm ±0,2%
Hochlaufzeit	typ. 3,5 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)
Lebensdauer	5 Jahre
MTBF	1.000.000 POH [2]
S.M.A.R.T. Support	Ja
Schnittstelle	SATA
Zugriffszeit	5,5 ms
unterstützte Transfermodi	SATA II
Datentransferrate	
intern	max. 147 MByte/s
zum / vom Host	max. 150 MByte/s (SATA I), max. 300 MByte/s (SATA II)
Positionierzeit	
nominal (Lesezugriff)	11 ms
maximal (Lesezugriff)	21 ms
Umgebungsbedingungen	
Temperatur [3]	
Betrieb [4]	0 bis 60°C
Betrieb - 24 Stunden [5]	0 bis 60°C
Lagerung	-40 bis 70°C
Transport	-40 bis 70°C

Tabelle 72: 5AC801.HDDI-04 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5AC801.HDDI-04
Luftfeuchtigkeit [6]	
Betrieb	8 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration	
Betrieb (dauerhaft)	5 bis 500 Hz: 0,25 g; keine nicht behebbaren Fehler
Betrieb (gelegentlich)	5 bis 500 Hz: 0,5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung	10 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Transport	10 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Schock	
Betrieb	400 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung	1000 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Transport	1000 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Meereshöhe	
Betrieb	-305 bis 3048 m
Lagerung	-305 bis 12192 m
Mechanische Eigenschaften	
Montage	fix [7]
Abmessungen	
Breite	13 mm
Höhe	98 mm
Tiefe	105 mm
Gewicht	134 g
Herstellerinformation	
Hersteller	Western Digital
Herstellerbezeichnung	WD5000LUCT

Tabelle 72: 5AC801.HDDI-04 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
2) Bei 8760 POH (Power On Hours) pro Jahr und 25°C Oberflächentemperatur.
3) Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshöhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle 305 Meter um 1°C verringert werden. Die Temperatur Zu- und Abnahme darf pro Stunde maximal 20°C betragen.
4) Standardbetrieb bedeutet 333 POH (Power On Hours) pro Monat.
5) 24 Stundenbetrieb bedeutet 732 POH (Power On Hours) pro Monat.
6) Luftfeuchtigkeitsgradient: Maximal 20% pro Stunde.
7) Montageweise auf Slide-in compact.

3.6.5.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm

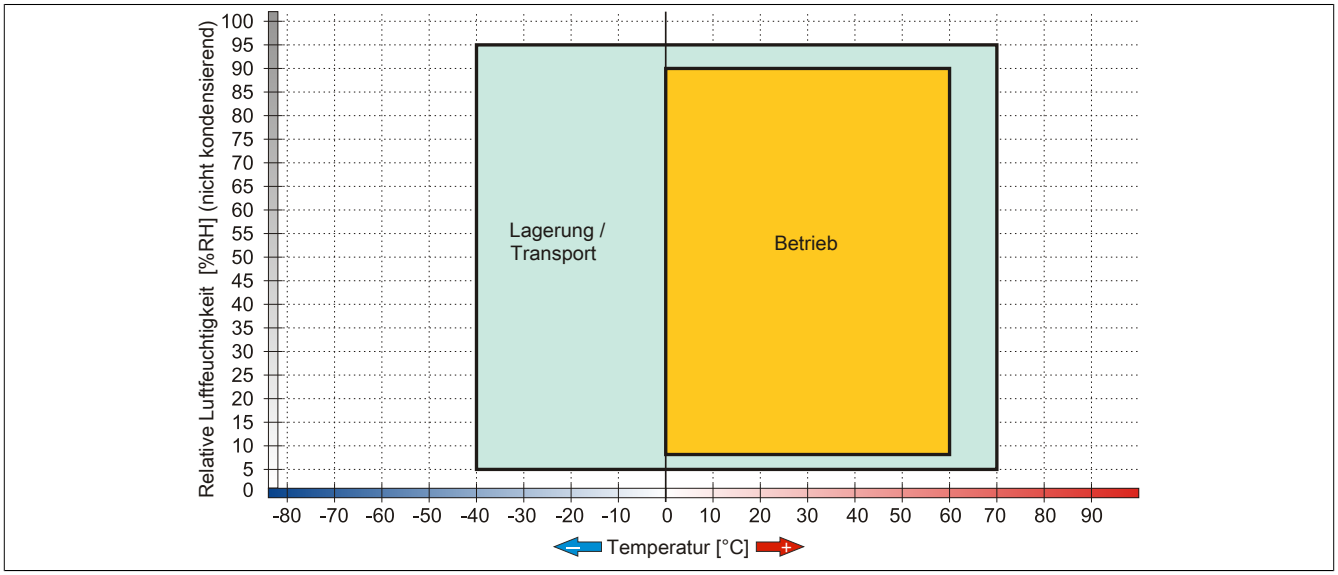


Abbildung 43: 5AC801.HDDI-04 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.6.6 5AC801.SSDI-00

3.6.6.1 Allgemeines

Dieses 32 GByte Slide-in compact SSD (Solid State Drive) Laufwerk kann in APC810 und PPC800 Systemeinheiten verwendet werden. Die SSD basiert auf der Single Level Cell (SLC) Technologie.

Bei Verwendung in einem APC810

Information:

Die Slide-in compact SSD kann in der 5 Card Slot Variante des APC810 im Slide-in Slot 2 mit dem 5AC801.ADAS-00 Adapter nicht verwendet werden.

Intern wird das Slide-in compact Laufwerk bei Steckung in den Slide-in compact Slot als SATA angesprochen.

3.6.6.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	
5AC801.SSDI-00	32 GByte SATA SSD (SLC), Slide-in compact.	

Tabelle 73: 5AC801.SSDI-00 - Bestelldaten

3.6.6.3 Technische Daten

Vorsicht!

Ein plötzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust führen! In sehr seltenen Fällen kann es darüber hinaus zu einer Beschädigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschädigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwendung einer USV empfohlen.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für diese Einzelkomponente alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5AC801.SSDI-00
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
GOST-R	Ja
GL	Ja [1)]
Solid State Drive	
Kapazität	32 GByte
Datenverlässlichkeit	< 1 nichtbehebbarer Fehler in 10^{15} Bit Lesezugriffen
MTBF	2.000.000 Stunden
Power On/Off Cycles	50.000
S.M.A.R.T. Support	Ja
Schnittstelle	SATA
Wartung	keine
kontinuierliches Lesen	max. 250 MByte/s
kontinuierliches Schreiben	max. 170 MByte/s

Tabelle 74: 5AC801.SSDI-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5AC801.SSDI-00
IOPS [2]	
4k lesen	35.000
4k schreiben	3.300
Endurance	
SLC-Flash	Ja
garantierte Datenmenge	
garantiert	700 TByte
ergibt bei 5 Jahren	350 GByte/Tag
Wear Leveling	statisch
Error Correction Coding (ECC)	Ja
Kompatibilität	SATA Revision 2.6 complient, kompatibel mit SATA 1,5 GBit/s und 3 GBit/s Interface Raten ATA/ATAPI-7 SSD Enhanced SMART ATA feature set Native Command Queuing (NCQ) Kommando
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	
Betrieb	0 bis 70°C
Lagerung	-55 bis 95°C
Transport	-55 bis 95°C
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration	
Betrieb	7 bis 800 Hz: 2,17 g
Lagerung	10 bis 500 Hz: 3,13 g
Transport	10 bis 500 Hz: 3,13 g
Schock	
Betrieb	1000 g, 0,5 ms
Lagerung	1000 g, 0,5 ms
Transport	1000 g, 0,5 ms
Meereshöhe	
Betrieb	-300 bis 12.192 m
Lagerung	-300 bis 12.192 m
Transport	-300 bis 12.192 m
Mechanische Eigenschaften	
Montage	fix [3]
Abmessungen	
Breite	13 mm
Höhe	98 mm
Tiefe	105 mm
Gewicht	118 g
Herstellerinformation	
Hersteller	Intel
Herstellerbezeichnung	SSDSA2SH032G1

Tabelle 74: 5AC801.SSDI-00 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
2) IOPS: Random Read and Write Input/Output Operations per Second
3) Montageweise auf Slide-in compact.

3.6.6.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm

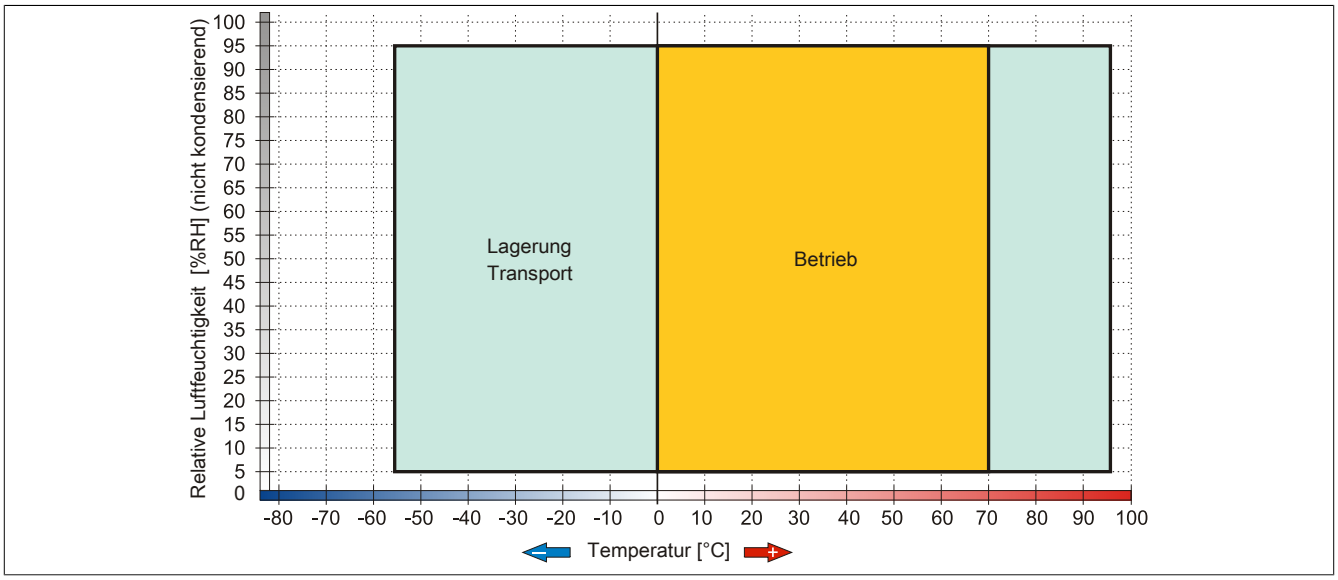


Abbildung 44: 5AC801.SSDI-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.6.6.5 Benchmark

Die nachfolgenden zwei Benchmarks zeigen einen Vergleich der Intel Solid State Drive (5AC801.SSDI-00) und der Seagate Hard Disk (5AC801.HDDI-00) beim zyklischen lesen bzw. schreiben.

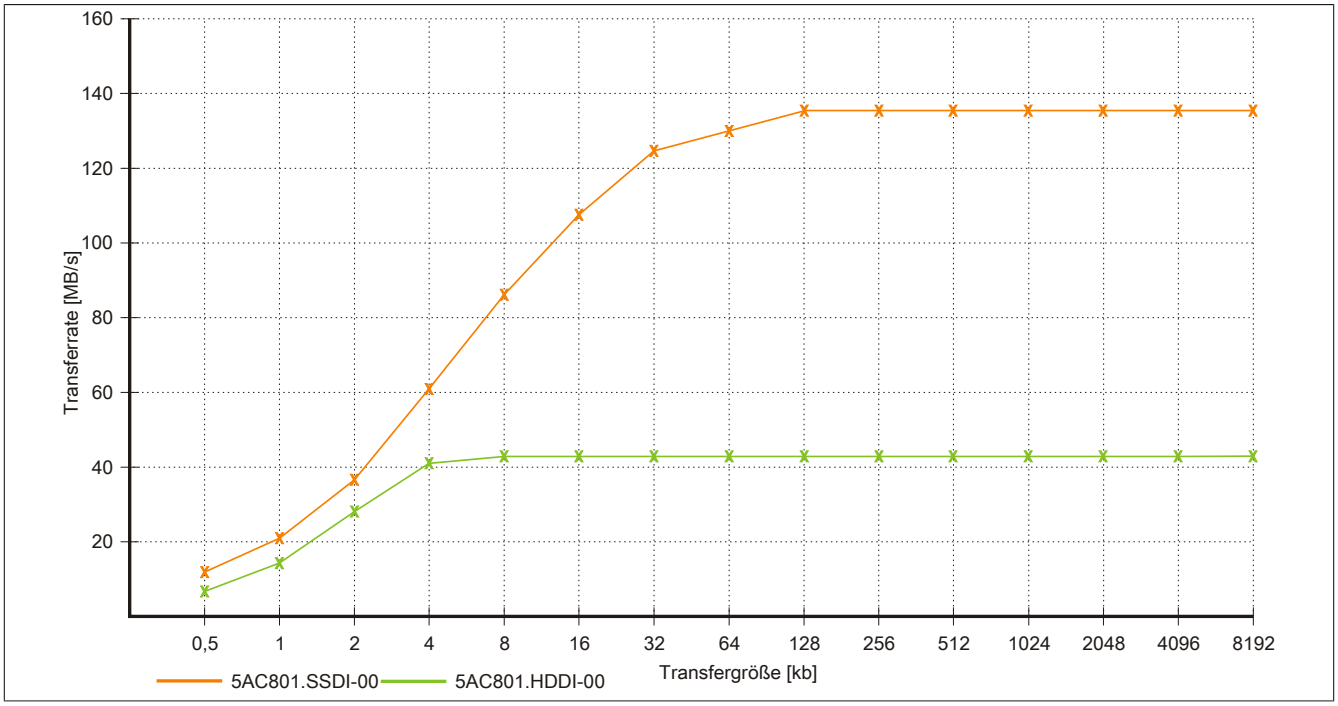


Abbildung 45: 5AC801.SSDI-00 - ATTO Disk Benchmark v2.34 zyklisches Lesen

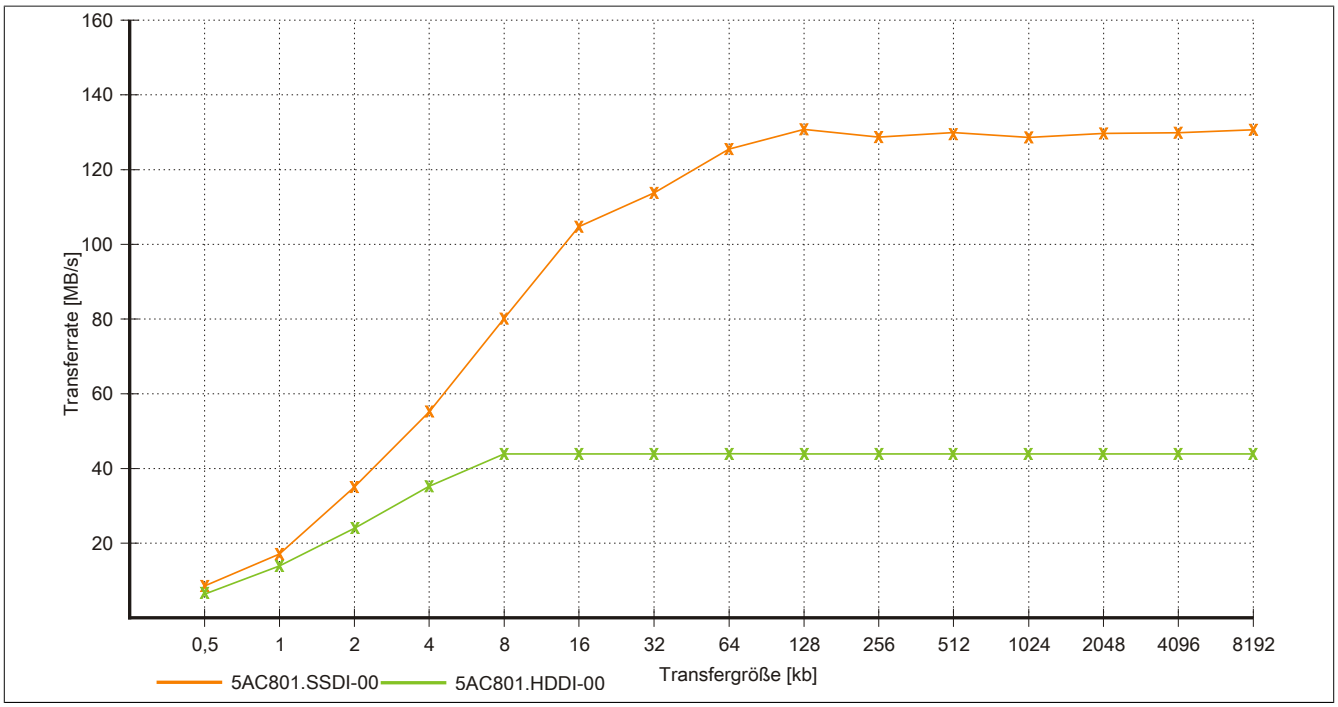


Abbildung 46: 5AC801.SSDI-00 - ATTO Disk Benchmark v2.34 zyklisches Schreiben

3.6.7 5AC801.SSDI-01

3.6.7.1 Allgemeines

Dieses 60 GByte Slide-in compact SSD (Solid State Drive) Laufwerk kann in APC810 und PPC800 Systemeinheiten verwendet werden. Die SSD basiert auf der Multi Level Cell (MLC) Technologie.

Bei Verwendung in einem APC810

Information:

Die Slide-in compact SSD kann in der 5 Card Slot Variante des APC810 im Slide-in Slot 2 mit dem 5AC801.ADAS-00 Adapter nicht verwendet werden.

Intern wird das Slide-in compact Laufwerk bei Steckung in den Slide-in compact Slot als SATA angesprochen.

3.6.7.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	
5AC801.SSDI-01	60 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.	
	Optionales Zubehör	
	Laufwerke	
5MMSSD.0060-00	60 GByte SSD MLC - Intel - SATA	

Tabelle 75: 5AC801.SSDI-01 - Bestelldaten

3.6.7.3 Technische Daten

Vorsicht!

Ein plötzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust führen! In sehr seltenen Fällen kann es darüber hinaus zu einer Beschädigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschädigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwendung einer USV empfohlen.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5AC801.SSDI-01
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
GOST-R	Ja
GL	Ja [1)]
Solid State Drive	
Kapazität	60 GByte
Datenverlässlichkeit	< 1 nichtbehebbarer Fehler in 10^{16} Bit Lesezugriffen
MTBF	1.200.000 Stunden
S.M.A.R.T. Support	Ja
Schnittstelle	SATA
Wartung	keine
kontinuierliches Lesen	max. 550 MByte/s bei SATA 6 GBit/s max. 280 MByte/s bei SATA 3 GBit/s

Tabelle 76: 5AC801.SSDI-01 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5AC801.SSDI-01
kontinuierliches Schreiben	max. 475 MByte/s bei SATA 6 GBit/s max. 245 MByte/s bei SATA 3 GBit/s
IOPS [2]	
4k lesen	15.000
4k schreiben	
typisch	23.000
maximal	80.000
Endurance	
MLC-Flash	Ja
Kompatibilität	SATA Revision 3.0 complient ACS-2 SSD Enhanced SMART ATA feature set Native Command Queuing (NCQ) Kommando
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	
Betrieb	0 bis 70°C
Lagerung	-55 bis 95°C
Transport	-55 bis 95°C
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration	
Betrieb	5 bis 700 Hz: 2,17 g
Lagerung	5 bis 800 Hz: 3,13 g
Transport	5 bis 800 Hz: 3,13 g
Schock	
Betrieb	1500 g, 0,5 ms
Lagerung	1500 g, 0,5 ms
Transport	1500 g, 0,5 ms
Meereshöhe	
Betrieb	-300 bis 12.192 m
Lagerung	-300 bis 12.192 m
Transport	-300 bis 12.192 m
Mechanische Eigenschaften	
Montage	fix [3]
Abmessungen	
Breite	13 mm
Höhe	98 mm
Tiefe	105 mm
Gewicht	118 g
Herstellerinformation	
Hersteller	Intel
Herstellerbezeichnung	SSDSC2CW060A3

Tabelle 76: 5AC801.SSDI-01 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
2) IOPS: Random Read and Write Input/Output Operations per Second
3) Montageweise auf Slide-in compact.

3.6.7.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm

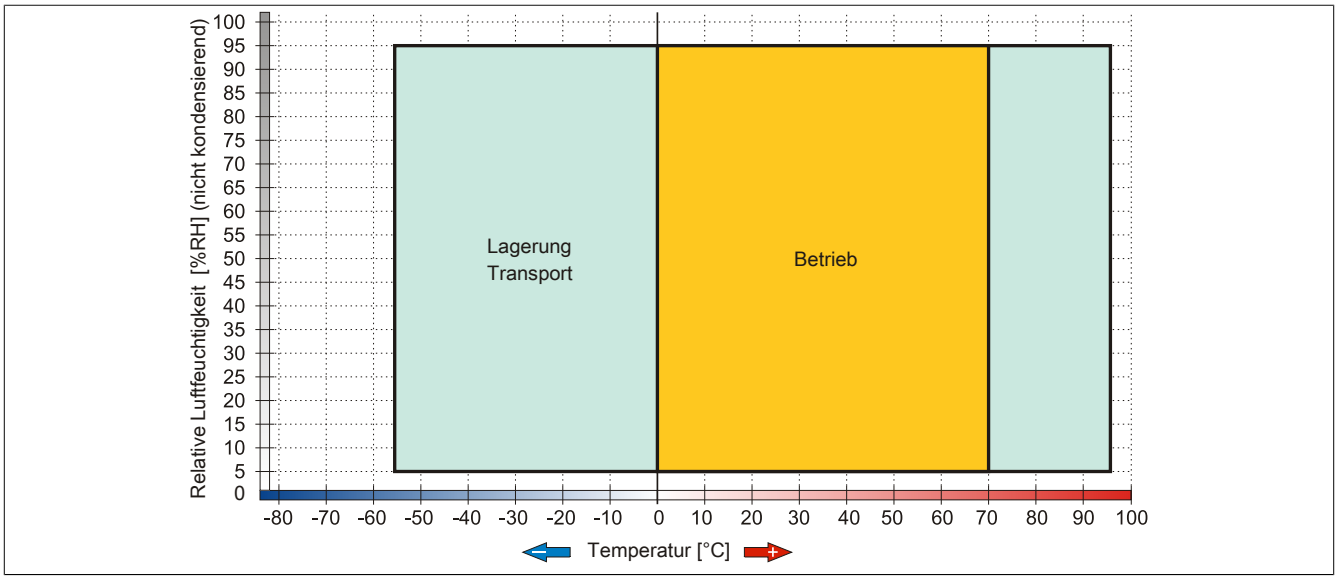


Abbildung 47: 5AC801.SSDI-01 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.6.8 5AC801.SSDI-02

3.6.8.1 Allgemeines

Dieses 180 GByte Slide-in compact SSD (Solid State Drive) Laufwerk kann in APC810 und PPC800 Systemeinheiten verwendet werden. Die SSD basiert auf der Multi Level Cell (MLC) Technologie.

Bei Verwendung in einem APC810

Information:

Die Slide-in compact SSD kann in der 5 Card Slot Variante des APC810 im Slide-in Slot 2 mit dem 5AC801.ADAS-00 Adapter nicht verwendet werden.

Intern wird das Slide-in compact Laufwerk bei Steckung in den Slide-in compact Slot als SATA angesprochen.

3.6.8.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	
5AC801.SSDI-02	180 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.	
	Optionales Zubehör	
	Laufwerke	
5MMSSD.0180-00	180 GByte SSD MLC - Intel - SATA	

Tabelle 77: 5AC801.SSDI-02 - Bestelldaten

3.6.8.3 Technische Daten

Vorsicht!

Ein plötzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust führen! In sehr seltenen Fällen kann es darüber hinaus zu einer Beschädigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschädigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwendung einer USV empfohlen.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5AC801.SSDI-02
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
GOST-R	Ja
GL	Ja [1)]
Solid State Drive	
Kapazität	180 GByte
Datenverlässlichkeit	< 1 nichtbehebbarer Fehler in 10^{16} Bit Lesezugriffen
MTBF	1.200.000 Stunden
S.M.A.R.T. Support	Ja
Schnittstelle	SATA
Wartung	keine
kontinuierliches Lesen	max. 550 MByte/s bei SATA 6 GBit/s max. 280 MByte/s bei SATA 3 GBit/s

Tabelle 78: 5AC801.SSDI-02 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5AC801.SSDI-02
kontinuierliches Schreiben	max. 520 MByte/s bei SATA 6 GBit/s max. 260 MByte/s bei SATA 3 GBit/s
IOPS [2]	
4k lesen	50.000
4k schreiben	
typisch	60.000
maximal	80.000
Endurance	
MLC-Flash	Ja
Kompatibilität	SATA Revision 3.0 complient ACS-2 SSD Enhanced SMART ATA feature set Native Command Queuing (NCQ) Kommando
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	
Betrieb	0 bis 70°C
Lagerung	-55 bis 95°C
Transport	-55 bis 95°C
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration	
Betrieb	5 bis 700 Hz: 2,17 g
Lagerung	5 bis 800 Hz: 3,13 g
Transport	5 bis 800 Hz: 3,13 g
Schock	
Betrieb	1500 g, 0,5 ms
Lagerung	1500 g, 0,5 ms
Transport	1500 g, 0,5 ms
Meereshöhe	
Betrieb	-300 bis 12.192 m
Lagerung	-300 bis 12.192 m
Transport	-300 bis 12.192 m
Mechanische Eigenschaften	
Montage	fix [3]
Abmessungen	
Breite	13 mm
Höhe	98 mm
Tiefe	105 mm
Gewicht	118 g
Herstellerinformation	
Hersteller	Intel
Herstellerbezeichnung	SSDSC2CW180A3

Tabelle 78: 5AC801.SSDI-02 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
2) IOPS: Random Read and Write Input/Output Operations per Second
3) Montageweise auf Slide-in compact.

3.6.8.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm

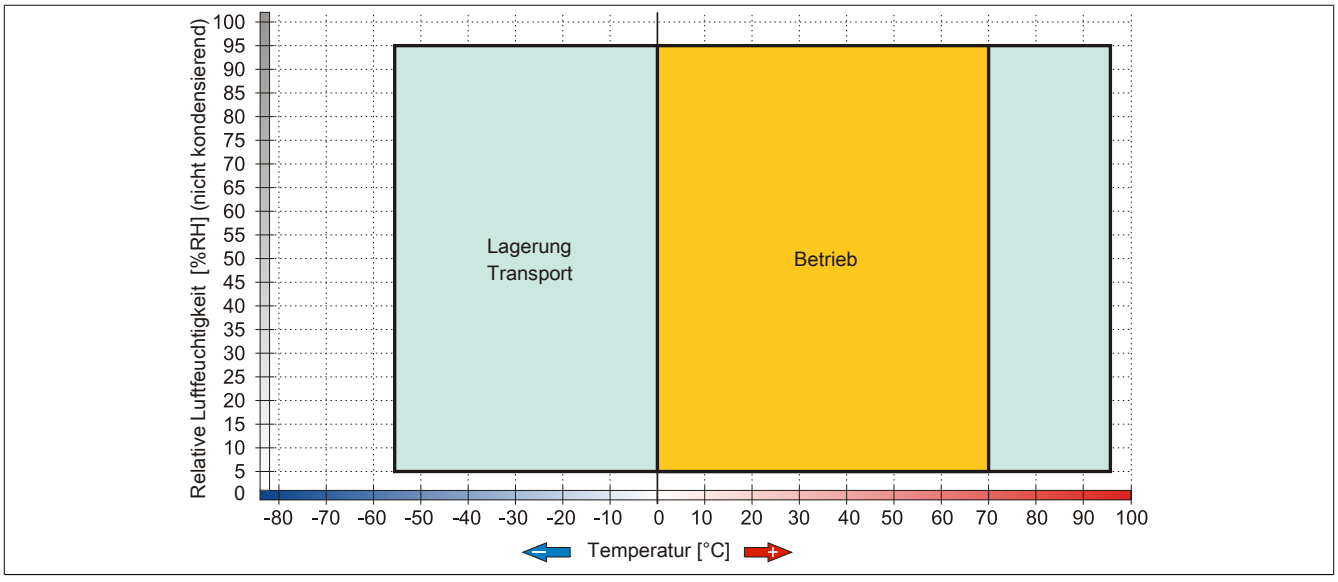


Abbildung 48: 5AC801.SSDI-02 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.6.9 5AC801.SSDI-03

3.6.9.1 Allgemeines

Dieses 60 GByte Slide-in compact SSD (Solid State Drive) Laufwerk kann in APC810 und PPC800 Systemeinheiten verwendet werden. Die SSD basiert auf der Multi Level Cell (MLC) Technologie.

Bei Verwendung in einem APC810

Information:

Die Slide-in compact SSD kann in der 5 Card Slot Variante des APC810 im Slide-in Slot 2 mit dem 5AC801.ADAS-00 Adapter nicht verwendet werden.

Intern wird das Slide-in compact Laufwerk bei Steckung in den Slide-in compact Slot als SATA angesprochen.

3.6.9.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	
5AC801.SSDI-03	60 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.	
	Optionales Zubehör	
	Laufwerke	
5MMSSD.0060-01	60 GByte SSD MLC - Intel - SATA	

Tabelle 79: 5AC801.SSDI-03 - Bestelldaten

3.6.9.3 Technische Daten

Vorsicht!

Ein plötzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust führen! In sehr seltenen Fällen kann es darüber hinaus zu einer Beschädigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschädigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwendung einer USV empfohlen.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5AC801.SSDI-03		
Revision	**C0**	**D0**	**E0**
Allgemeines			
Zertifizierungen			
CE	Ja		
cULus	Ja		
GOST-R	Ja		
GL	Ja [1]		
Solid State Drive			
Kapazität	60 GByte		
Datenverlässlichkeit	< 1 nichtbehebbarer Fehler in 10^{15} Bit Lesezugriffen		
MTBF	1.500.000 Stunden		
S.M.A.R.T. Support	Ja		
Schnittstelle	SATA		
Wartung	keine		
kontinuierliches Lesen	max. 510 MByte/s		
kontinuierliches Schreiben	max. 430 MByte/s		
IOPS [2]			
4k lesen	max. 50.000 (random)		
4k schreiben	max. 25.000 (random)		
Endurance			
MLC-Flash	Ja		
garantierte Datenmenge			
garantiert	35 TBW [3]		47 TBW [3]

Tabelle 80: 5AC801.SSDI-03, 5AC801.SSDI-03, 5AC801.SSDI-03 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5AC801.SSDI-03		
Revision	**C0**	**D0**	**E0**
Kompatibilität	SATA Revision 3.0 compliant ACS-2 SSD Enhanced SMART ATA feature set Native Command Queuing (NCQ) Kommando		
Umgebungsbedingungen			
Temperatur			
Betrieb	0 bis 70°C	-30 bis 85°C	-40 bis 85°C
Lagerung		-40 bis 85°C	
Transport		-40 bis 85°C	
Luftfeuchtigkeit			
Betrieb	8 bis 90%, nicht kondensierend	5 bis 90%, nicht kondensierend	
Lagerung	8 bis 95%, nicht kondensierend	5 bis 95%, nicht kondensierend	
Transport	8 bis 95%, nicht kondensierend	5 bis 95%, nicht kondensierend	
Vibration			
Betrieb	10 bis 2000 Hz: 20 g		
Lagerung	10 bis 2000 Hz: 20 g		
Transport	10 bis 2000 Hz: 20 g		
Schock			
Betrieb	1500 g, 0,5 ms		
Lagerung	1500 g, 0,5 ms		
Transport	1500 g, 0,5 ms		
Meereshöhe			
Betrieb	-300 bis 12.192 m		
Lagerung	-300 bis 12.192 m		
Transport	-300 bis 12.192 m		
Mechanische Eigenschaften			
Montage	fix [4]		
Abmessungen			
Breite	13 mm		
Höhe	98 mm		
Tiefe	105 mm		
Gewicht	118 g		
Herstellerinformation			
Hersteller	Toshiba		
Herstellerbezeichnung	THNSNH060GBST	THNSNJ060WCST	THNSNJ060WCSU

Tabelle 80: 5AC801.SSDI-03, 5AC801.SSDI-03, 5AC801.SSDI-03 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
2) IOPS: Random Read and Write Input/Output Operations per Second
3) TBW: Terabyte written
4) Montageweise auf Slide-in compact.

3.6.9.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm

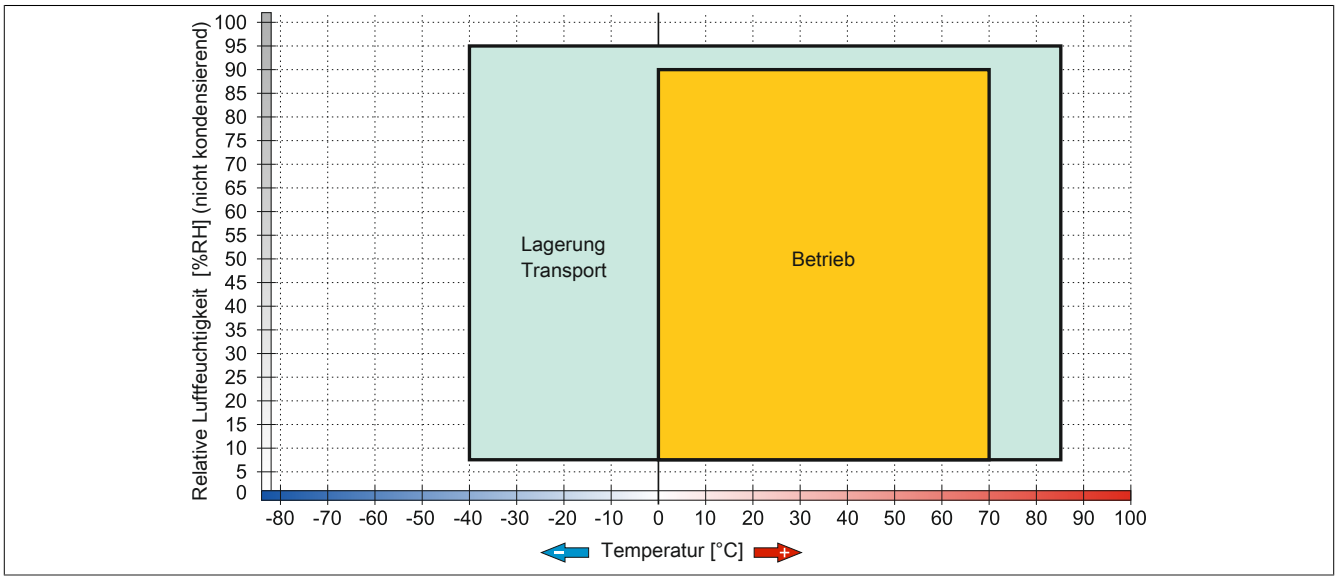


Abbildung 49: 5AC801.SSDI-03 ≤ Rev. C0 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

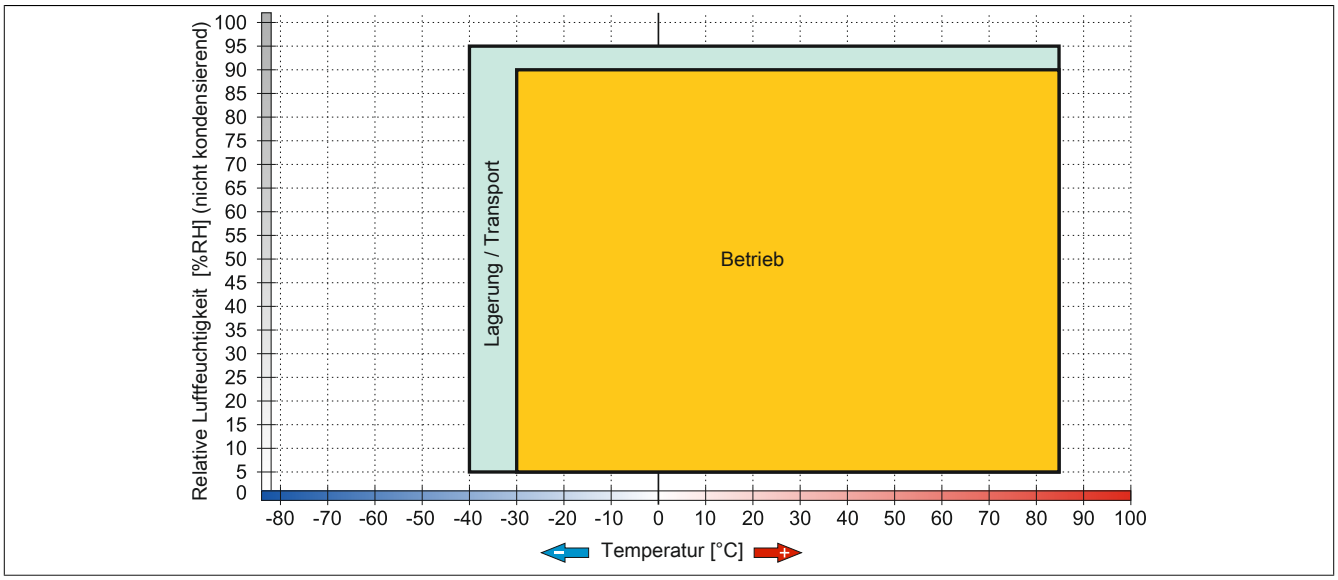


Abbildung 50: 5AC801.SSDI-03 Rev. D0 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

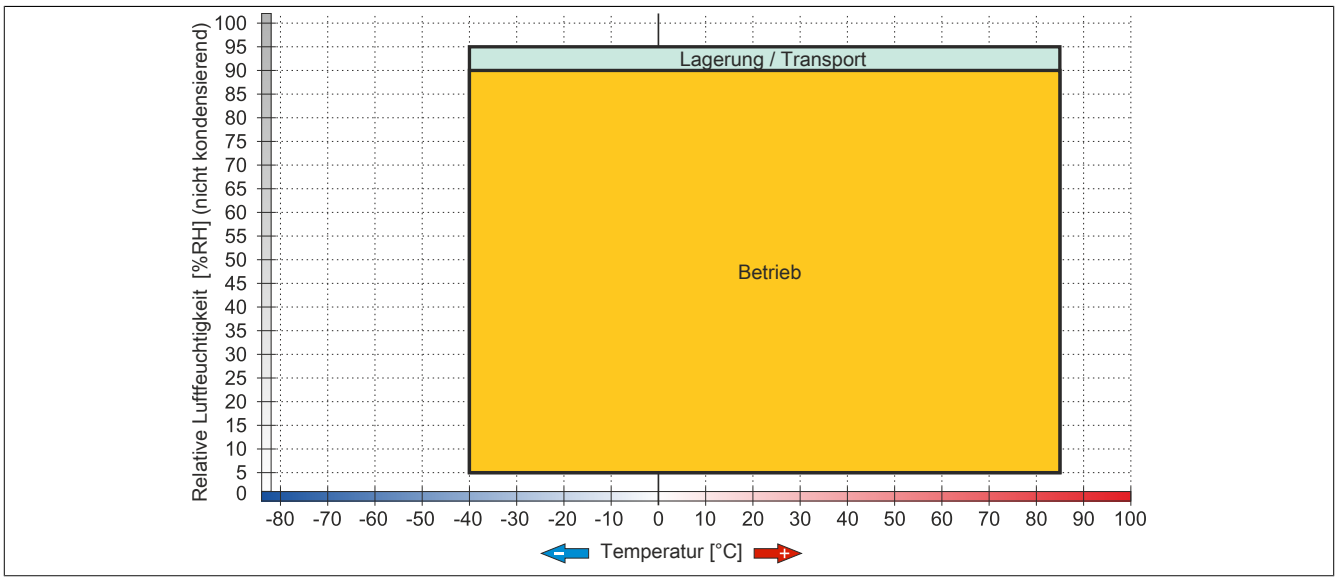


Abbildung 51: 5AC801.SSDI-03 ≥ Rev. E0 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.6.10 5AC801.SSDI-04

3.6.10.1 Allgemeines

Dieses 128 GByte Slide-in compact SSD (Solid State Drive) Laufwerk kann in APC810 und PPC800 Systemeinheiten verwendet werden. Die SSD basiert auf der Multi Level Cell (MLC) Technologie.

Bei Verwendung in einem APC810

Information:

Die Slide-in compact SSD kann in der 5 Card Slot Variante des APC810 im Slide-in Slot 2 mit dem 5AC801.ADAS-00 Adapter nicht verwendet werden.

Intern wird das Slide-in compact Laufwerk bei Steckung in den Slide-in compact Slot als SATA angesprochen.

3.6.10.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	
5AC801.SSDI-04	128 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.	
	Optionales Zubehör	
	Laufwerke	
5MMSSD.0128-01	128 GByte SSD MLC - Toshiba - SATA	

Tabelle 81: 5AC801.SSDI-04 - Bestelldaten

3.6.10.3 Technische Daten

Vorsicht!

Ein plötzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust führen! In sehr seltenen Fällen kann es darüber hinaus zu einer Beschädigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschädigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwendung einer USV empfohlen.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5AC801.SSDI-04		
Revision	**C0**	**D0**	**E0**
Allgemeines			
Zertifizierungen			
CE	Ja		
cULus	Ja		
GOST-R	Ja		
GL	Ja [1)]		
Solid State Drive			
Kapazität	128 GByte		
Datenverlässlichkeit	< 1 nichtbehebbarer Fehler in 10^{15} Bit Lesezugriffen		
MTBF	1.500.000 Stunden		
S.M.A.R.T. Support	Ja		
Schnittstelle	SATA		
Wartung	keine		
kontinuierliches Lesen	max. 510 MByte/s		
kontinuierliches Schreiben	max. 450 MByte/s		

Tabelle 82: 5AC801.SSDI-04, 5AC801.SSDI-04, 5AC801.SSDI-04 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5AC801.SSDI-04		
Revision	**C0**	**D0**	**E0**
IOPS [2]			
4k lesen		max. 85.000 (random)	
4k schreiben		max. 35.000 (random)	
Endurance			
MLC-Flash		Ja	
garantierte Datenmenge			
garantiert		74 TBW [3]	100 TBW [3]
Kompatibilität		SATA Revision 3.0 compliant ACS-2 SSD Enhanced SMART ATA feature set Native Command Queuing (NCQ) Kommando	
Umgebungsbedingungen			
Temperatur			
Betrieb	0 bis 70°C	-30 bis 85°C	-40 bis 85°C
Lagerung		-40 bis 85°C	
Transport		-40 bis 85°C	
Luftfeuchtigkeit			
Betrieb	8 bis 90%, nicht kondensierend	5 bis 90%, nicht kondensierend	
Lagerung	8 bis 95%, nicht kondensierend	5 bis 95%, nicht kondensierend	
Transport	8 bis 95%, nicht kondensierend	5 bis 95%, nicht kondensierend	
Vibration			
Betrieb		10 bis 2000 Hz: 20 g	
Lagerung		10 bis 2000 Hz: 20 g	
Transport		10 bis 2000 Hz: 20 g	
Schock			
Betrieb		1500 g, 0,5 ms	
Lagerung		1500 g, 0,5 ms	
Transport		1500 g, 0,5 ms	
Meereshöhe			
Betrieb		-300 bis 12.192 m	
Lagerung		-300 bis 12.192 m	
Transport		-300 bis 12.192 m	
Mechanische Eigenschaften			
Montage		fix [4]	
Abmessungen			
Breite		13 mm	
Höhe		98 mm	
Tiefe		105 mm	
Gewicht		118 g	
Herstellerinformation			
Hersteller		Toshiba	
Herstellerbezeichnung	THNSNH128GBST	THNSNJ128WCST	THNSNJ128WCSU

Tabelle 82: 5AC801.SSDI-04, 5AC801.SSDI-04, 5AC801.SSDI-04 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
2) IOPS: Random Read and Write Input/Output Operations per Second
3) TBW: Terabyte written
4) Montageweise auf Slide-in compact.

3.6.10.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm

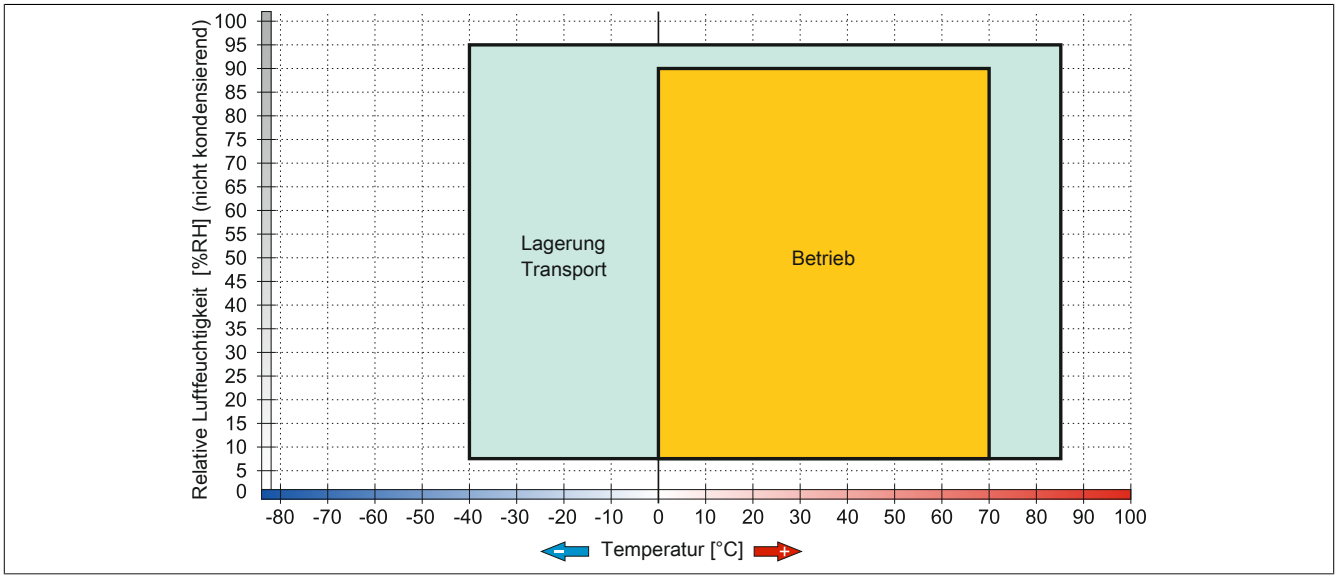


Abbildung 52: 5AC801.SSDI-04 ≤ Rev. C0 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

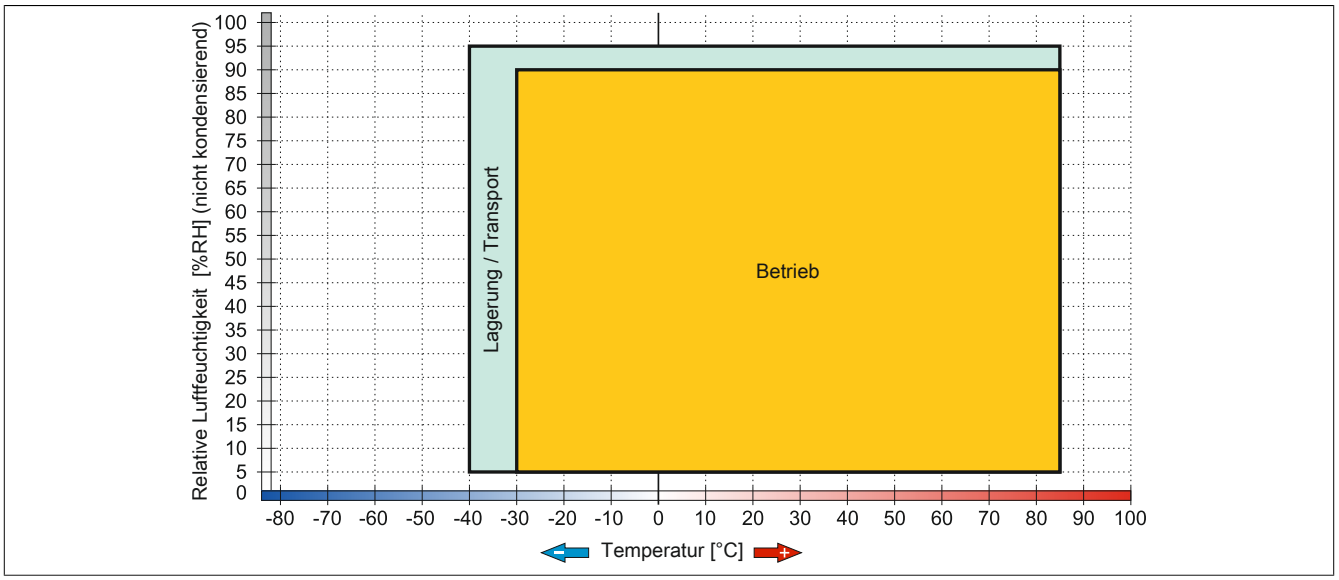


Abbildung 53: 5AC801.SSDI-04 Rev. D0 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

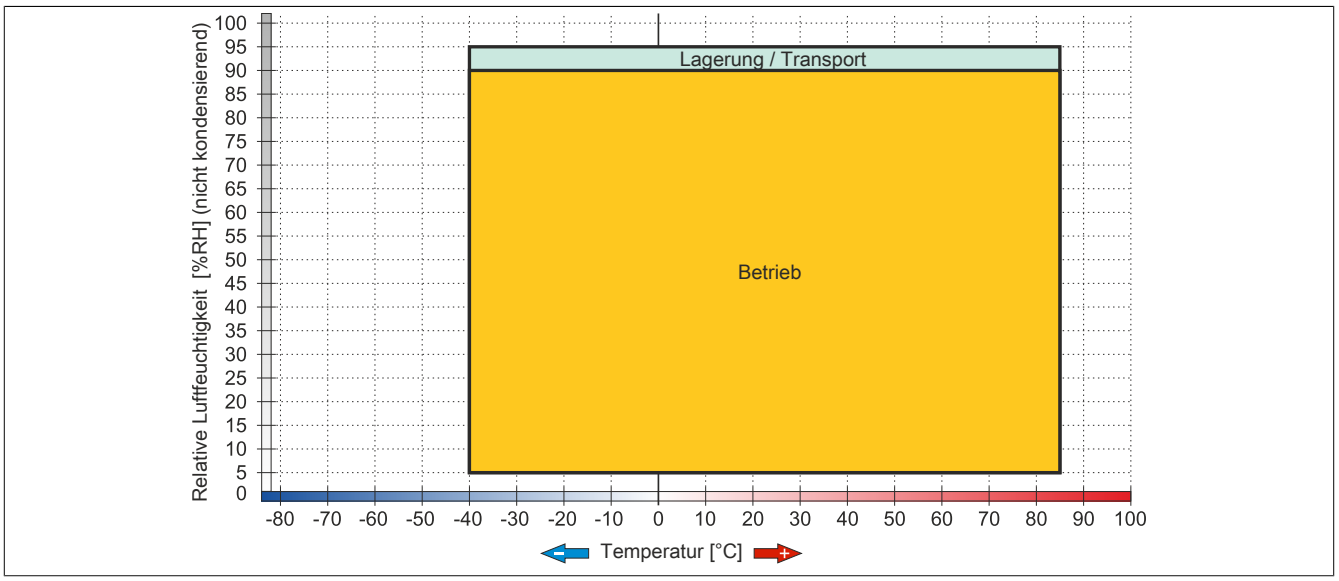


Abbildung 54: 5AC801.SSDI-04 ≥ Rev. E0 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.6.11 5AC801.SSDI-05

3.6.11.1 Allgemeines

Dieses 256 GByte Slide-in compact SSD (Solid State Drive) Laufwerk kann in APC810 und PPC800 Systemeinheiten verwendet werden. Die SSD basiert auf der Multi Level Cell (MLC) Technologie.

Bei Verwendung in einem APC810

Information:

Die Slide-in compact SSD kann in der 5 Card Slot Variante des APC810 im Slide-in Slot 2 mit dem 5AC801.ADAS-00 Adapter nicht verwendet werden.

Intern wird das Slide-in compact Laufwerk bei Steckung in den Slide-in compact Slot als SATA angesprochen.

3.6.11.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	
5AC801.SSDI-05	256 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.	
	Optionales Zubehör	
	Laufwerke	
5MMSSD.0256-00	256 GByte SSD MLC - Toshiba - SATA	

Tabelle 83: 5AC801.SSDI-05 - Bestelldaten

3.6.11.3 Technische Daten

Vorsicht!

Ein plötzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust führen! In sehr seltenen Fällen kann es darüber hinaus zu einer Beschädigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschädigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwendung einer USV empfohlen.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5AC801.SSDI-05	
Revision	**C0**	**D0**
Allgemeines		
Zertifizierungen		
CE	Ja	
cULus	Ja	
GOST-R	Ja	
GL	Ja [1)]	
Solid State Drive		
Kapazität	256 GByte	
Datenverlässlichkeit	< 1 nichtbehebbarer Fehler in 10^{15} Bit Lesezugriffen	
MTBF	1.500.000 Stunden	
S.M.A.R.T. Support	Ja	
Schnittstelle	SATA	
Wartung	keine	
kontinuierliches Lesen	max. 510 MByte/s	
kontinuierliches Schreiben	max. 460 MByte/s	

Tabelle 84: 5AC801.SSDI-05, 5AC801.SSDI-05 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5AC801.SSDI-05	
Revision	**C0**	**D0**
IOPS [2]		
4k lesen	max. 90.000 (random)	
4k schreiben	max. 35.000 (random)	
Endurance		
MLC-Flash	Ja	
garantierte Datenmenge		
garantiert	148 TBW [3]	200 TBW [3]
Kompatibilität	SATA Revision 3.0 compliant ACS-2 SSD Enhanced SMART ATA feature set Native Command Queuing (NCQ) Kommando	
Umgebungsbedingungen		
Temperatur		
Betrieb	-30 bis 85°C	-40 bis 85°C
Lagerung	-40 bis 85°C	
Transport	-40 bis 85°C	
Luftfeuchtigkeit		
Betrieb	5 bis 90%, nicht kondensierend	
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend	
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend	
Vibration		
Betrieb	10 bis 2000 Hz: 20 g	
Lagerung	10 bis 2000 Hz: 20 g	
Transport	10 bis 2000 Hz: 20 g	
Schock		
Betrieb	1500 g, 0,5 ms	
Lagerung	1500 g, 0,5 ms	
Transport	1500 g, 0,5 ms	
Meereshöhe		
Betrieb	-300 bis 12.192 m	
Lagerung	-300 bis 12.192 m	
Transport	-300 bis 12.192 m	
Mechanische Eigenschaften		
Montage	fix [4]	
Abmessungen		
Breite	13 mm	
Höhe	98 mm	
Tiefe	105 mm	
Gewicht	118 g	
Herstellerinformation		
Hersteller	Toshiba	
Herstellerbezeichnung	THNSNJ256WCST	THNSNJ256WCSU

Tabelle 84: 5AC801.SSDI-05, 5AC801.SSDI-05 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
2) IOPS: Random Read and Write Input/Output Operations per Second
3) TBW: Terabyte written
4) Montageweise auf Slide-in compact.

3.6.11.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm

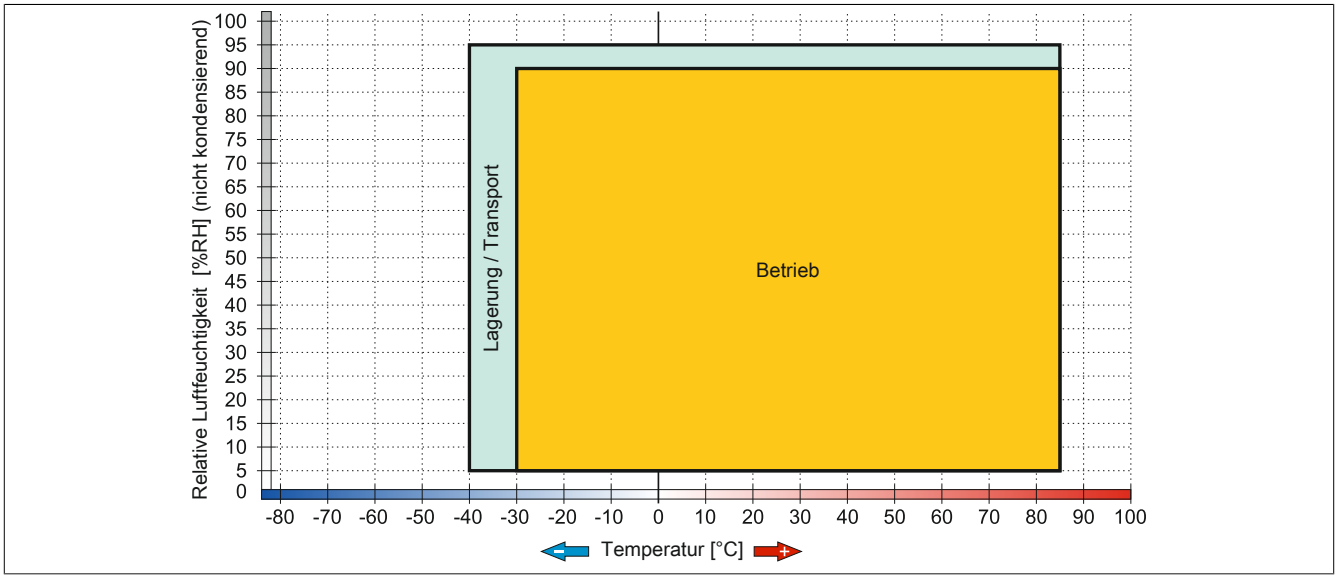


Abbildung 55: 5AC801.SSDI-05 ≤ Rev. C0 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

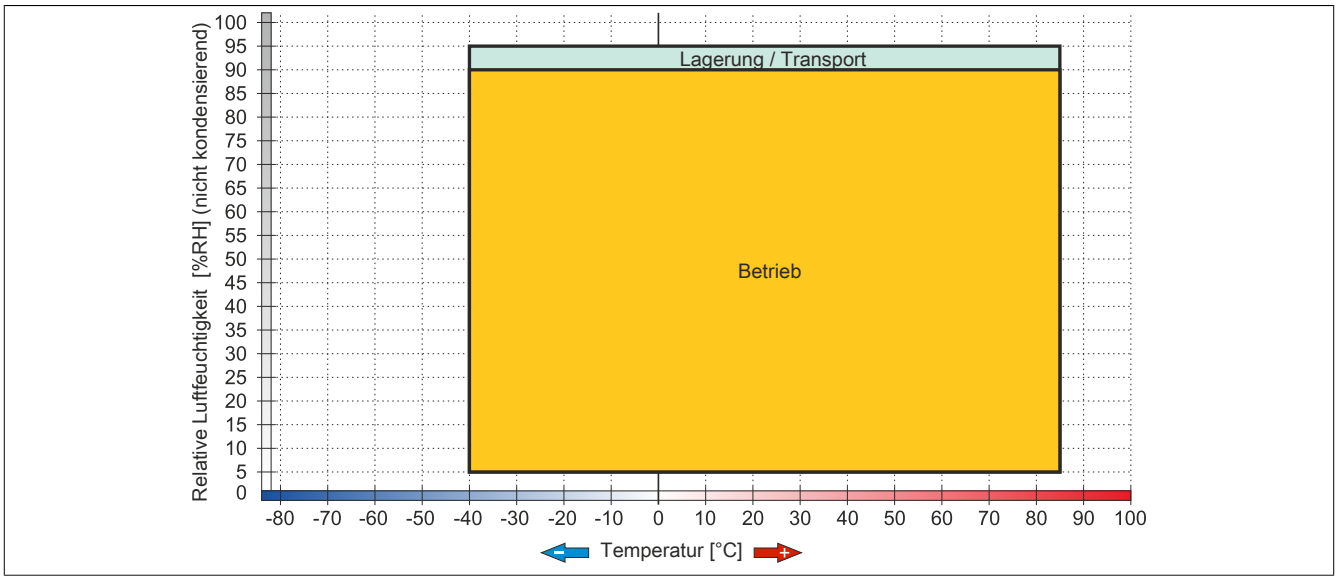


Abbildung 56: 5AC801.SSDI-05 ≥ Rev. D0 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.6.12 5MMSSD.0060-00

3.6.12.1 Allgemeines

Dieses 60 GByte SSD (Solid State Drive) Laufwerk kann als Ersatzteil oder Zubehörteil verwendet werden. Die SSD basiert auf der Multi Level Cell (MLC) Technologie.

- Ersatzlaufwerk für die SSD-Laufwerke 5AC801.SSDI-01 bzw. 5AC901.CSSD-01
- Zubehör für APC510 (optionale SSD für I/O Board)

3.6.12.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	
5MMSSD.0060-00	60 GByte SSD MLC - Intel - SATA	

Tabelle 85: 5MMSSD.0060-00 - Bestelldaten

3.6.12.3 Technische Daten

Vorsicht!

Ein plötzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust führen! In sehr seltenen Fällen kann es darüber hinaus zu einer Beschädigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschädigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwendung einer USV empfohlen.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5MMSSD.0060-00
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
cULus HazLoc Class 1 Division 2	Ja [1]
GOST-R	Ja
Solid State Drive	
Kapazität	60 GByte
Datenverlässlichkeit	< 1 nichtbehebbarer Fehler in 10^{16} Bit Lesezugriffen
MTBF	1.200.000 Stunden
S.M.A.R.T. Support	Ja
Schnittstelle	SATA
Wartung	keine
kontinuierliches Lesen	max. 550 MByte/s bei SATA 6 GBit/s max. 280 MByte/s bei SATA 3 GBit/s
kontinuierliches Schreiben	max. 475 MByte/s bei SATA 6 GBit/s max. 245 MByte/s bei SATA 3 GBit/s
IOPS [2]	
4k lesen	15.000
4k schreiben	
typisch	23.000
maximal	80.000
Endurance	
MLC-Flash	Ja

Tabelle 86: 5MMSSD.0060-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5MMSSD.0060-00
Kompatibilität	SATA Revision 3.0 compliant ACS-2 SSD Enhanced SMART ATA feature set Native Command Queuing (NCQ) Kommando
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	
Betrieb	0 bis 70°C
Lagerung	-55 bis 95°C
Transport	-55 bis 95°C
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration	
Betrieb	5 bis 700 Hz: 2,17 g
Lagerung	5 bis 800 Hz: 3,13 g
Transport	5 bis 800 Hz: 3,13 g
Schock	
Betrieb	1500 g, 0,5 ms
Lagerung	1500 g, 0,5 ms
Transport	1500 g, 0,5 ms
Meereshöhe	
Betrieb	-300 bis 12.192 m
Lagerung	-300 bis 12.192 m
Transport	-300 bis 12.192 m
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen	
Breite	9,5 mm
Höhe	69 mm
Tiefe	100 mm
Gewicht	78 g
Herstellerinformation	
Hersteller	Intel
Herstellerbezeichnung	SSDSC2CW060A3

Tabelle 86: 5MMSSD.0060-00 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben und das Gesamtgerät die entsprechende Kennzeichnung trägt.
2) IOPS: Random Read and Write Input/Output Operations per Second

3.6.12.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm

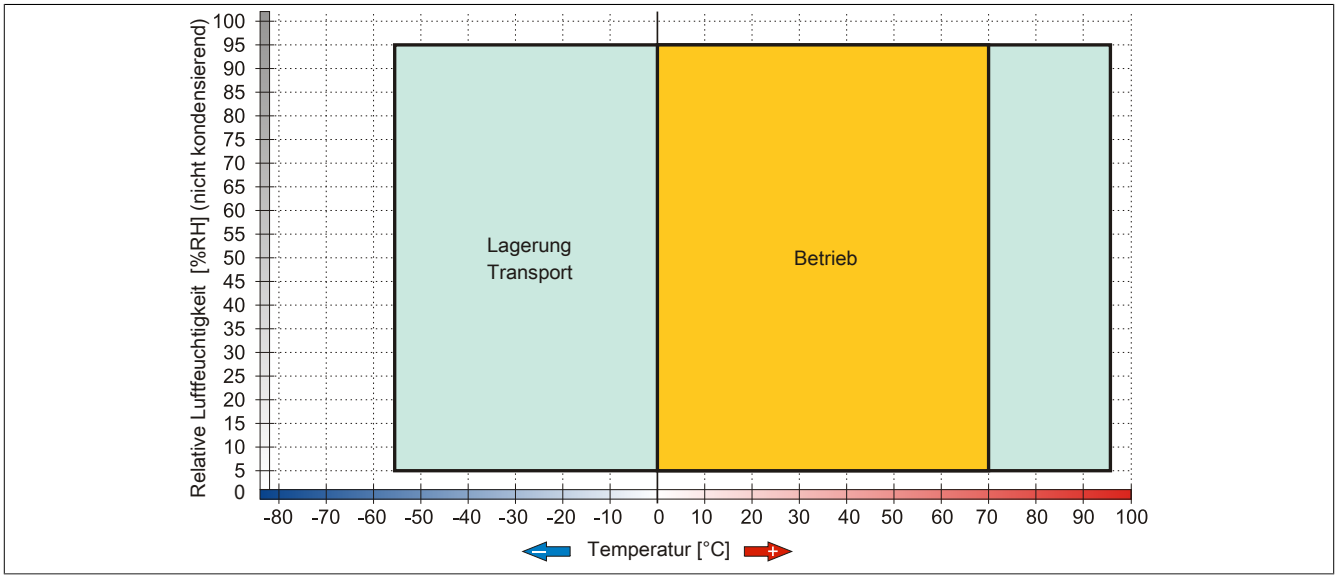


Abbildung 57: 5MMSSD.0060-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.6.13 5MMSSD.0060-01

3.6.13.1 Allgemeines

Dieses 60 GByte SSD (Solid State Drive) Laufwerk kann als Ersatzteil oder Zubehörteil verwendet werden. Die SSD basiert auf der Multi Level Cell (MLC) Technologie.

- Ersatzlaufwerk für die SSD-Laufwerke 5AC801.SSDI-03 bzw. 5AC901.CSSD-03
- Zubehör für APC510 (optionale SSD für I/O Board)

3.6.13.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	
5MMSSD.0060-01	60 GByte SSD MLC - Intel - SATA	

Tabelle 87: 5MMSSD.0060-01 - Bestelldaten

3.6.13.3 Technische Daten

Vorsicht!

Ein plötzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust führen! In sehr seltenen Fällen kann es darüber hinaus zu einer Beschädigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschädigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwendung einer USV empfohlen.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5MMSSD.0060-01		
Revision	**C0**	**D0**	**E0**
Allgemeines			
Zertifizierungen			
CE	Ja		
cULus	Ja		
cULus HazLoc Class 1 Division 2	Ja [1)]		
GOST-R	Ja		
Solid State Drive			
Kapazität	60 GByte		
Datenverlässlichkeit	< 1 nichtbehebbarer Fehler in 10^{15} Bit Lesezugriffen		
MTBF	1.500.000 Stunden		
S.M.A.R.T. Support	Ja		
Schnittstelle	SATA		
Wartung	keine		
kontinuierliches Lesen	max. 510 MByte/s		
kontinuierliches Schreiben	max. 430 MByte/s		
IOPS [2)]			
4k lesen	max. 50.000 (random)		
4k schreiben	max. 25.000 (random)		
Endurance			
MLC-Flash	Ja		
garantierte Datenmenge			
garantiert	35 TBW [3)]		47 TBW [3)]
Kompatibilität	SATA Revision 3.0 compliant ACS-2 SSD Enhanced SMART ATA feature set Native Command Queuing (NCQ) Kommando		

Tabelle 88: 5MMSSD.0060-01, 5MMSSD.0060-01, 5MMSSD.0060-01 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5MMSSD.0060-01		
Revision	**C0**	**D0**	**E0**
Umgebungsbedingungen			
Temperatur			
Betrieb	0 bis 70°C	-30 bis 85°C	-40 bis 85°C
Lagerung		-40 bis 85°C	
Transport		-40 bis 85°C	
Luftfeuchtigkeit			
Betrieb	8 bis 90%, nicht kondensierend	5 bis 90%, nicht kondensierend	
Lagerung	8 bis 95%, nicht kondensierend	5 bis 95%, nicht kondensierend	
Transport	8 bis 95%, nicht kondensierend	5 bis 95%, nicht kondensierend	
Vibration			
Betrieb	10 bis 2000 Hz: 20 g		
Lagerung	10 bis 2000 Hz: 20 g		
Transport	10 bis 2000 Hz: 20 g		
Schock			
Betrieb	1500 g, 0,5 ms		
Lagerung	1500 g, 0,5 ms		
Transport	1500 g, 0,5 ms		
Meereshöhe			
Betrieb	-300 bis 12.192 m		
Lagerung	-300 bis 12.192 m		
Transport	-300 bis 12.192 m		
Mechanische Eigenschaften			
Abmessungen			
Breite	9,5 mm	7 mm	
Höhe	69 mm		
Tiefe	100 mm		
Gewicht	78 g		
Herstellerinformation			
Hersteller	Toshiba		
Herstellerbezeichnung	THNSNH060GBST	THNSNJ060WCST	THNSNJ060WCSU

Tabelle 88: 5MMSSD.0060-01, 5MMSSD.0060-01, 5MMSSD.0060-01 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben und das Gesamtgerät die entsprechende Kennzeichnung trägt.
2) IOPS: Random Read and Write Input/Output Operations per Second
3) TBW: Terabyte written

3.6.13.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm

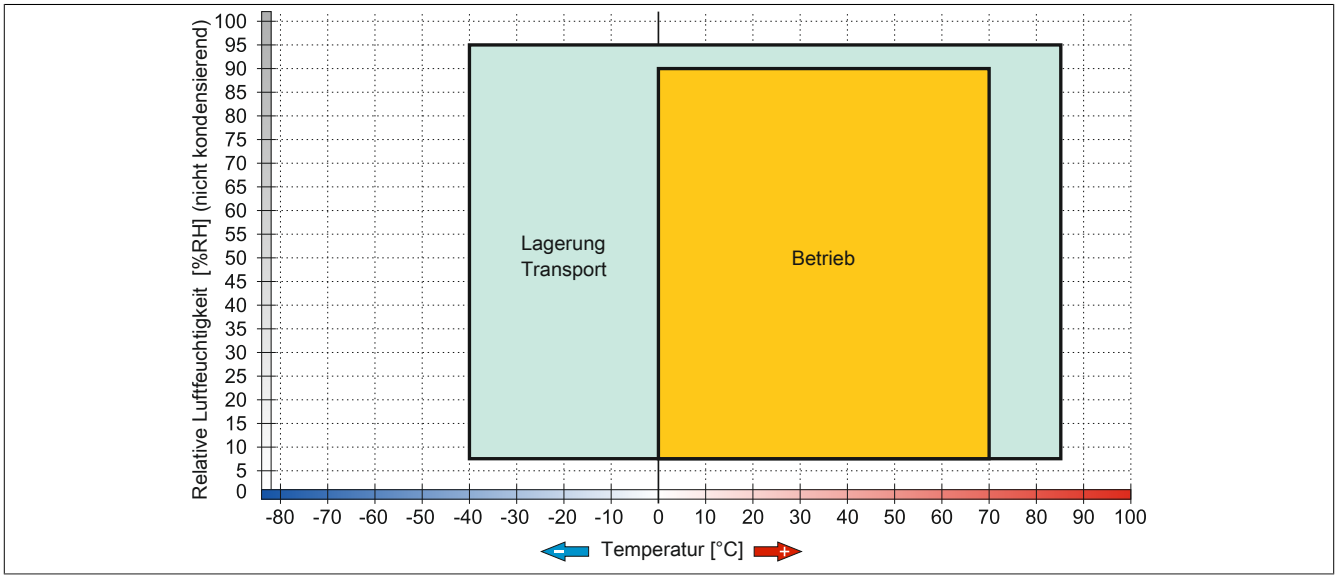


Abbildung 58: 5MMSSD.0060-01 ≤ Rev. C0 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

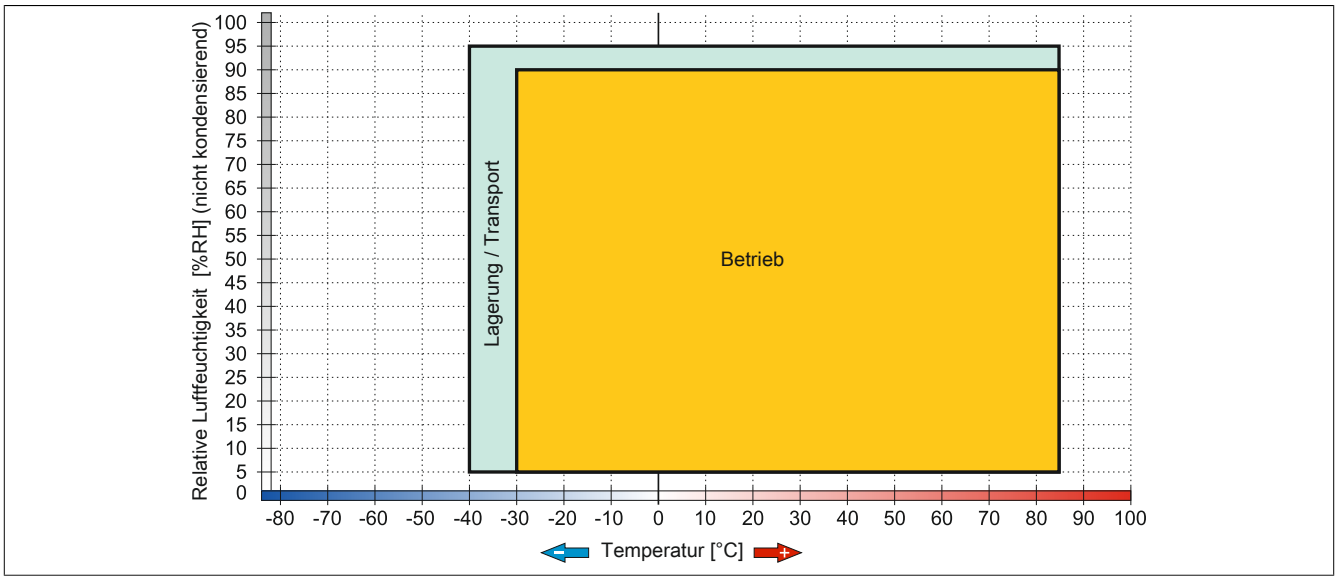


Abbildung 59: 5MMSSD.0060-01 Rev. D0 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

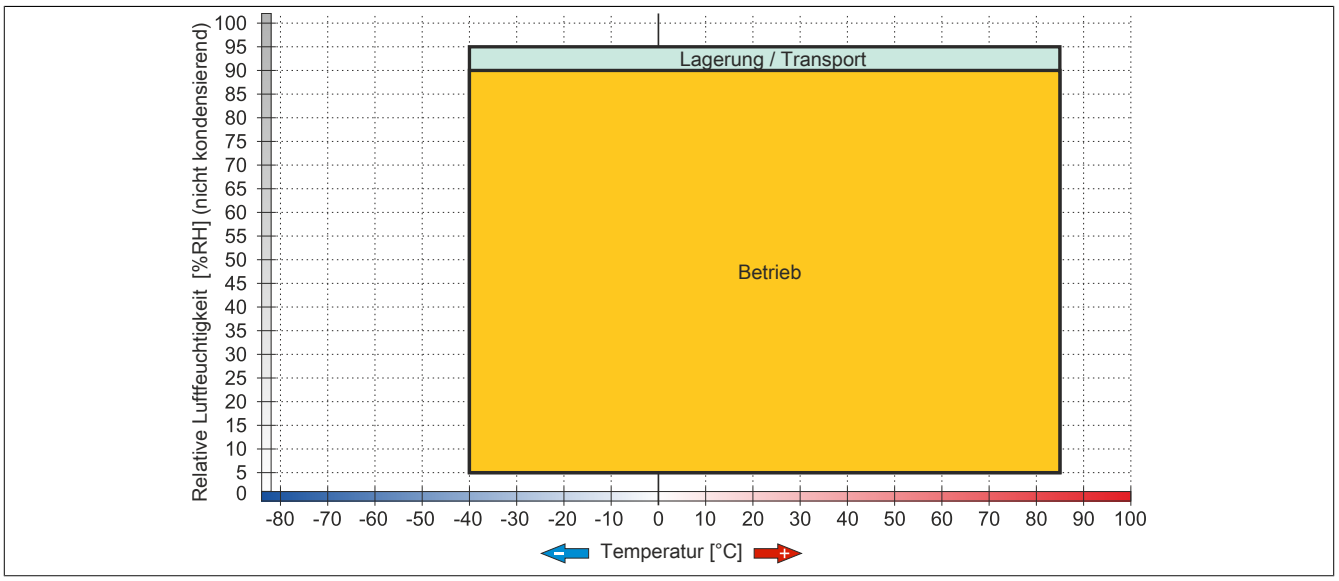


Abbildung 60: 5MMSSD.0060-01 ≥ Rev. E0 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.6.14 5MMSSD.0128-01

3.6.14.1 Allgemeines

Dieses 128 GByte SSD (Solid State Drive) Laufwerk kann als Ersatzteil oder Zubehörteil verwendet werden. Die SSD basiert auf der Multi Level Cell (MLC) Technologie.

- Ersatzlaufwerk für die SSD-Laufwerke 5AC801.SSDI-04 bzw. 5AC901.CSSD-04
- Zubehör für APC510 (optionale SSD für I/O Board)

3.6.14.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	
5MMSSD.0128-01	128 GByte SSD MLC - Toshiba - SATA	

Tabelle 89: 5MMSSD.0128-01 - Bestelldaten

3.6.14.3 Technische Daten

Vorsicht!

Ein plötzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust führen! In sehr seltenen Fällen kann es darüber hinaus zu einer Beschädigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschädigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwendung einer USV empfohlen.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5MMSSD.0128-01		
Revision	**C0**	**D0**	**E0**
Allgemeines			
Zertifizierungen			
CE	Ja		
cULus	Ja		
cULus HazLoc Class 1 Division 2	Ja [1)]		
GOST-R	Ja		
Solid State Drive			
Kapazität	128 GByte		
Datenverlässlichkeit	< 1 nichtbehebbarer Fehler in 10^{15} Bit Lesezugriffen		
MTBF	1.500.000 Stunden		
S.M.A.R.T. Support	Ja		
Schnittstelle	SATA		
Wartung	keine		
kontinuierliches Lesen	max. 510 MByte/s		
kontinuierliches Schreiben	max. 450 MByte/s		
IOPS [2)]			
4k lesen	max. 85.000 (random)		
4k schreiben	max. 35.000 (random)		
Endurance			
MLC-Flash	Ja		
garantierte Datenmenge			
garantiert	74 TBW [3)]		100 TBW [3)]
Kompatibilität	SATA Revision 3.0 compliant ACS-2 SSD Enhanced SMART ATA feature set Native Command Queuing (NCQ) Kommando		

Tabelle 90: 5MMSSD.0128-01, 5MMSSD.0128-01, 5MMSSD.0128-01 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5MMSSD.0128-01		
Revision	**C0**	**D0**	**E0**
Umgebungsbedingungen			
Temperatur			
Betrieb	0 bis 70°C	-30 bis 85°C	-40 bis 85°C
Lagerung		-40 bis 85°C	
Transport		-40 bis 85°C	
Luftfeuchtigkeit			
Betrieb	8 bis 90%, nicht kondensierend	5 bis 90%, nicht kondensierend	
Lagerung	8 bis 95%, nicht kondensierend	5 bis 95%, nicht kondensierend	
Transport	8 bis 95%, nicht kondensierend	5 bis 95%, nicht kondensierend	
Vibration			
Betrieb	10 bis 2000 Hz: 20 g		
Lagerung	10 bis 2000 Hz: 20 g		
Transport	10 bis 2000 Hz: 20 g		
Schock			
Betrieb	1500 g, 0,5 ms		
Lagerung	1500 g, 0,5 ms		
Transport	1500 g, 0,5 ms		
Meereshöhe			
Betrieb	-300 bis 12.192 m		
Lagerung	-300 bis 12.192 m		
Transport	-300 bis 12.192 m		
Mechanische Eigenschaften			
Abmessungen			
Breite	9,5 mm	7 mm	
Höhe	69 mm		
Tiefe	100 mm		
Gewicht	78 g		
Herstellerinformation			
Hersteller	Toshiba		
Herstellerbezeichnung	THNSNH128GBST	THNSNJ128WCST	THNSNJ128WCSU

Tabelle 90: 5MMSSD.0128-01, 5MMSSD.0128-01, 5MMSSD.0128-01 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben und das Gesamtgerät die entsprechende Kennzeichnung trägt.
2) IOPS: Random Read and Write Input/Output Operations per Second
3) TBW: Terabyte written

3.6.14.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm

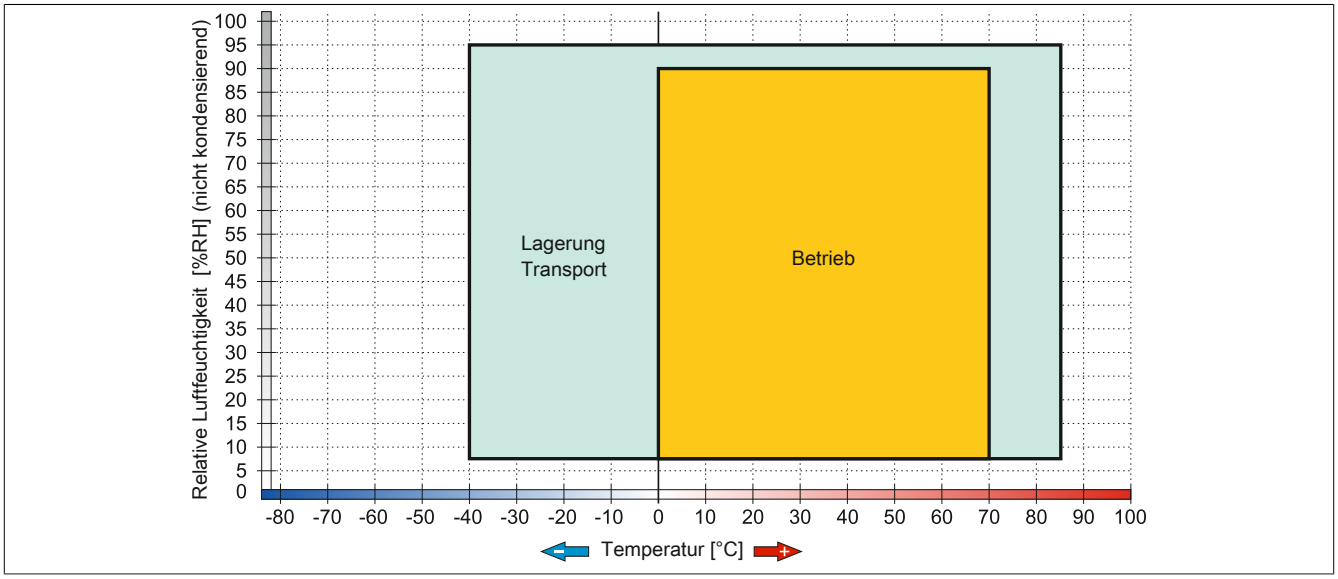


Abbildung 61: 5MMSSD.0128-01 ≤ Rev. C0 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

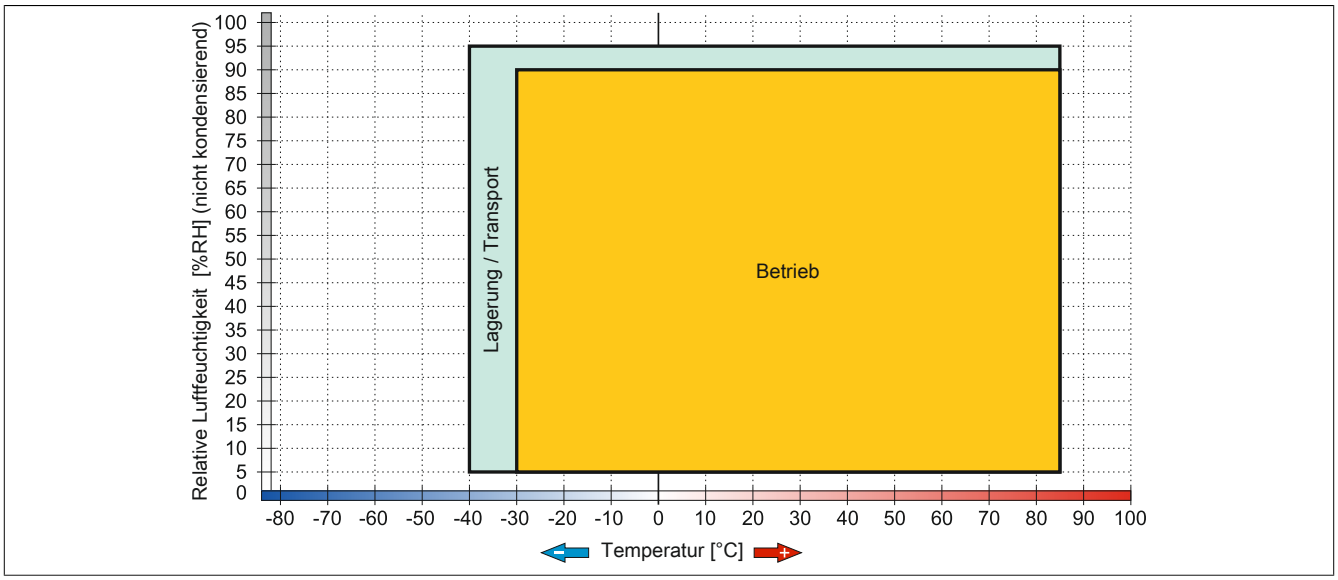


Abbildung 62: 5MMSSD.0128-01 Rev. D0 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

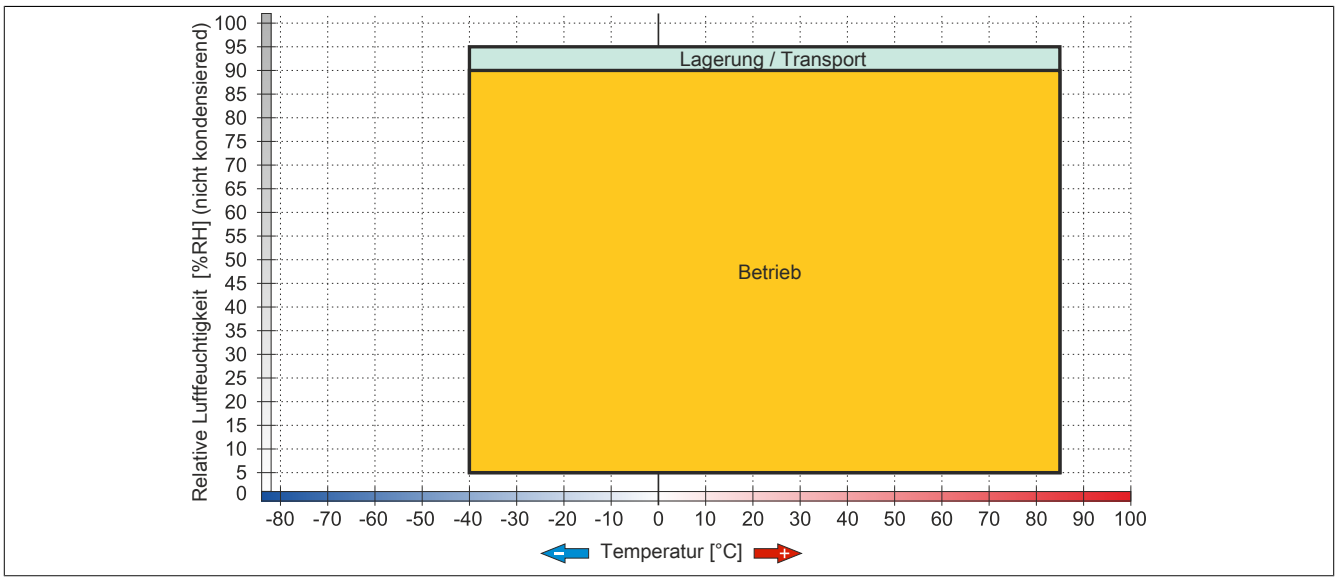


Abbildung 63: 5MMSSD.0128-01 ≥ Rev. E0 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.6.15 5MMSSD.0180-00

3.6.15.1 Allgemeines

Dieses 180 GByte SSD (Solid State Drive) Laufwerk kann als Erstzteil oder Zubehörteil verwendet werden. Die SSD basiert auf der Multi Level Cell (MLC) Technologie.

- Ersatzlaufwerk für die SSD-Laufwerke 5AC801.SSDI-02 bzw. 5AC901.CSSD-02
- Zubehör für APC510 (optionale SSD für I/O Board)

3.6.15.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	
5MMSSD.0180-00	180 GByte SSD MLC - Intel - SATA	

Tabelle 91: 5MMSSD.0180-00 - Bestelldaten

3.6.15.3 Technische Daten

Vorsicht!

Ein plötzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust führen! In sehr seltenen Fällen kann es darüber hinaus zu einer Beschädigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschädigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwendung einer USV empfohlen.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5MMSSD.0180-00
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
cULus HazLoc Class 1 Division 2	Ja [1]
GOST-R	Ja
Solid State Drive	
Kapazität	180 GByte
Datenverlässlichkeit	< 1 nichtbehebbarer Fehler in 10^{16} Bit Lesezugriffen
MTBF	1.200.000 Stunden
S.M.A.R.T. Support	Ja
Schnittstelle	SATA
Wartung	keine
kontinuierliches Lesen	max. 550 MByte/s bei SATA 6 GBit/s max. 280 MByte/s bei SATA 3 GBit/s
kontinuierliches Schreiben	max. 520 MByte/s bei SATA 6 GBit/s max. 260 MByte/s bei SATA 3 GBit/s
IOPS [2]	
4k lesen	50.000
4k schreiben	
typisch	60.000
maximal	80.000
Endurance	
MLC-Flash	Ja

Tabelle 92: 5MMSSD.0180-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5MMSSD.0180-00
Kompatibilität	SATA Revision 3.0 compliant ACS-2 SSD Enhanced SMART ATA feature set Native Command Queuing (NCQ) Kommando
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	
Betrieb	0 bis 70°C
Lagerung	-55 bis 95°C
Transport	-55 bis 95°C
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration	
Betrieb	5 bis 700 Hz: 2,17 g
Lagerung	5 bis 800 Hz: 3,13 g
Transport	5 bis 800 Hz: 3,13 g
Schock	
Betrieb	1500 g, 0,5 ms
Lagerung	1500 g, 0,5 ms
Transport	1500 g, 0,5 ms
Meereshöhe	
Betrieb	-300 bis 12.192 m
Lagerung	-300 bis 12.192 m
Transport	-300 bis 12.192 m
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen	
Breite	9,5 mm
Höhe	69 mm
Tiefe	100 mm
Gewicht	78 g
Herstellerinformation	
Hersteller	Intel
Herstellerbezeichnung	SSDSC2CW180A3

Tabelle 92: 5MMSSD.0180-00 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben und das Gesamtgerät die entsprechende Kennzeichnung trägt.
2) IOPS: Random Read and Write Input/Output Operations per Second

3.6.15.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm

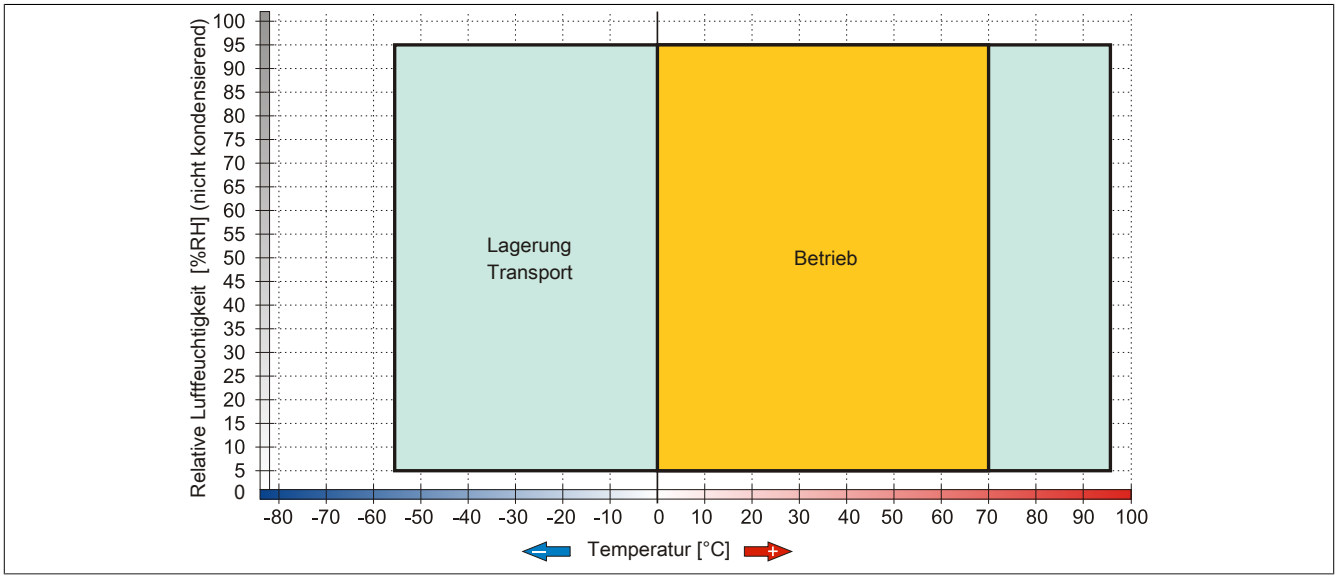


Abbildung 64: 5MMSSD.0180-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.6.16 5MMSSD.0256-00

3.6.16.1 Allgemeines

Dieses 256 GByte SSD (Solid State Drive) Laufwerk kann als Ersatzteil oder Zubehörteil verwendet werden. Die SSD basiert auf der Multi Level Cell (MLC) Technologie.

- Ersatzlaufwerk für die SSD-Laufwerke 5AC801.SSDI-05 bzw. 5AC901.CSSD-05
- Zubehör für APC510 (optionale SSD für I/O Board)

3.6.16.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	
5MMSSD.0256-00	256 GByte SSD MLC - Toshiba - SATA	

Tabelle 93: 5MMSSD.0256-00 - Bestelldaten

3.6.16.3 Technische Daten

Vorsicht!

Ein plötzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust führen! In sehr seltenen Fällen kann es darüber hinaus zu einer Beschädigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschädigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwendung einer USV empfohlen.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5MMSSD.0256-00	
Revision	**C0**	**D0**
Allgemeines		
Zertifizierungen		
CE	Ja	
cULus	Ja	
cULus HazLoc Class 1 Division 2	Ja [1]	
Solid State Drive		
Kapazität	256 GByte	
Datenverlässlichkeit	< 1 nichtbehebbarer Fehler in 10^{15} Bit Lesezugriffen	
MTBF	1.500.000 Stunden	
S.M.A.R.T. Support	Ja	
Schnittstelle	SATA	
Wartung	keine	
kontinuierliches Lesen	max. 510 MByte/s	
kontinuierliches Schreiben	max. 460 MByte/s	
IOPS [2]		
4k lesen	max. 90.000 (random)	
4k schreiben	max. 35.000 (random)	
Endurance		
MLC-Flash	Ja	
garantierte Datenmenge		
garantiert	148 TBW [3]	200 TBW [3]
Kompatibilität	SATA Revision 3.0 compliant ACS-2 SSD Enhanced SMART ATA feature set Native Command Queuing (NCQ) Kommando	

Tabelle 94: 5MMSSD.0256-00, 5MMSSD.0256-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5MMSSD.0256-00	
Revision	**C0**	**D0**
Umgebungsbedingungen		
Temperatur		
Betrieb	-30 bis 85°C	-40 bis 85°C
Lagerung	-40 bis 85°C	
Transport	-40 bis 85°C	
Luftfeuchtigkeit		
Betrieb	5 bis 90%, nicht kondensierend	
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend	
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend	
Vibration		
Betrieb	10 bis 2000 Hz: 20 g	
Lagerung	10 bis 2000 Hz: 20 g	
Transport	10 bis 2000 Hz: 20 g	
Schock		
Betrieb	1500 g, 0,5 ms	
Lagerung	1500 g, 0,5 ms	
Transport	1500 g, 0,5 ms	
Meereshöhe		
Betrieb	-300 bis 12.192 m	
Lagerung	-300 bis 12.192 m	
Transport	-300 bis 12.192 m	
Mechanische Eigenschaften		
Abmessungen		
Breite	7 mm	
Höhe	69 mm	
Tiefe	100 mm	
Gewicht	78 g	
Herstellerinformation		
Hersteller	Toshiba	
Herstellerbezeichnung	THNSNJ256WCST	THNSNJ256WCSU

Tabelle 94: 5MMSSD.0256-00, 5MMSSD.0256-00 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben und das Gesamtgerät die entsprechende Kennzeichnung trägt.
2) IOPS: Random Read and Write Input/Output Operations per Second
3) TBW: Terabyte written

3.6.16.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm

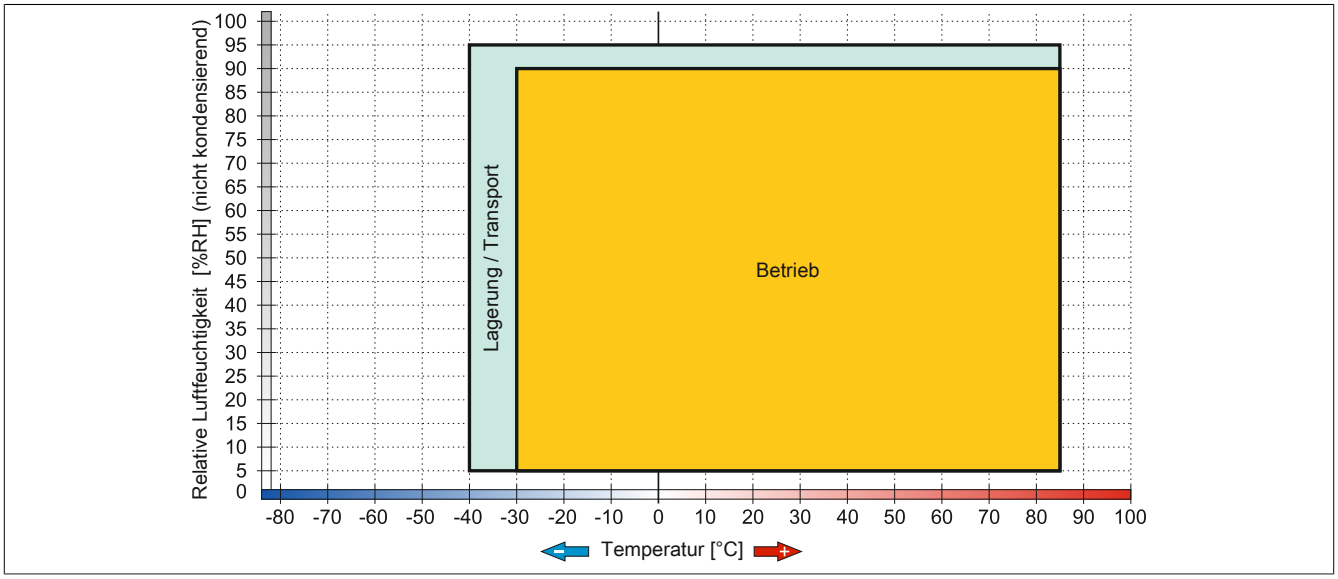


Abbildung 65: 5MMSSD.0256-00 ≤ C0 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

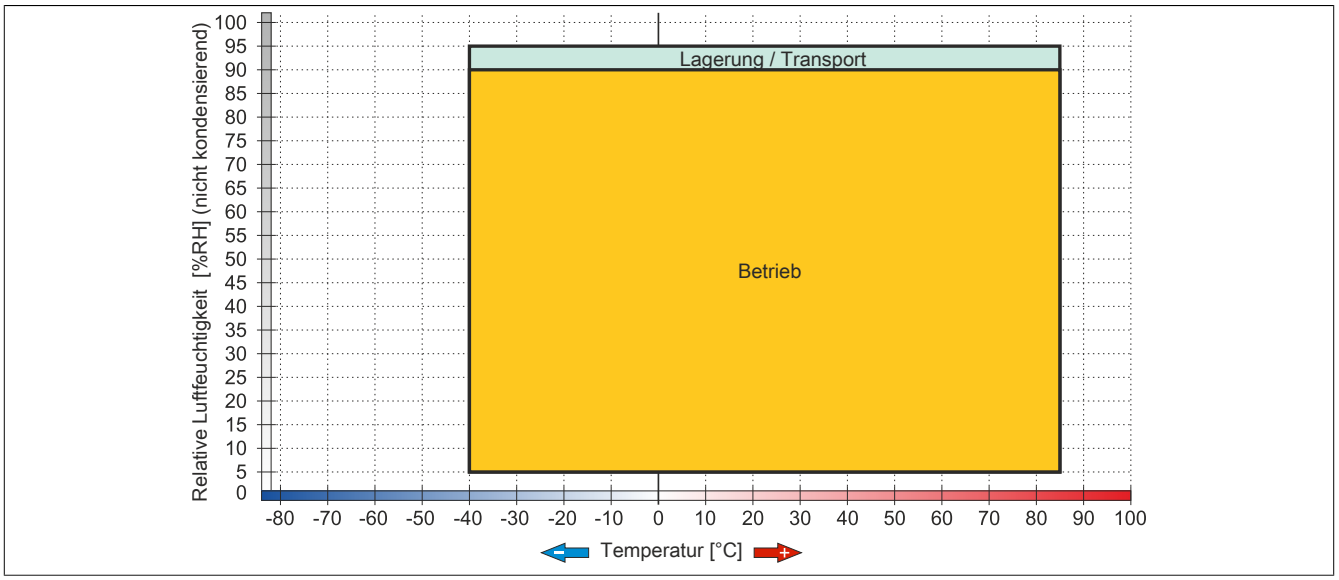


Abbildung 66: 5MMSSD.0256-00 ≥ D0 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.6.17 5AC801.ADAS-00

3.6.17.1 Allgemeines

Der Hard Disk Adapter ist ein Slide-in Adapter, in welchen man Slide-in compact Laufwerke stecken und somit am B&R Industrie PC betreiben kann. Dieser Adapter kann in APC810 und PPC800 Systemeinheiten mit Slide-in Laufwerkeinschub verwendet werden.

Bei Verwendung in einem APC810

Information:

Der Slide-in compact Adapter kann aus mechanischen Gegebenheiten (Schließen der Fronttüre) nur im Slide-in Slot 1 gesteckt werden.

3.6.17.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	
5AC801.ADAS-00	SATA Hard Disk Adapter zum Betrieb einer Slide-in compact Hard Disk in einem Slide-in Slot.	

Tabelle 95: 5AC801.ADAS-00 - Bestelldaten

3.6.17.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5AC801.ADAS-00
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
GOST-R	Ja
GL	Ja [1]
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen	
Breite	22 mm
Höhe	172,5 mm
Tiefe	150 mm
Gewicht	328 g

Tabelle 96: 5AC801.ADAS-00 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

3.6.18 5AC801.HDDS-00

3.6.18.1 Allgemeines

Diese 40 GByte Hard Disk ist für den 24 Stunden Betrieb (24x7) spezifiziert und bietet zusätzlich eine erweiterte Temperaturspezifikation (ET). Das Slide-in Laufwerk kann in APC810 und PPC800 Systemeinheiten mit Slide-in Laufwerkeinschub verwendet werden.

Information:

Ein nachträglicher Ein- und Ausbau eines Slide-in Laufwerkes ist jederzeit möglich.

Bei Verwendung in einem APC810

Intern wird das Slide-in Laufwerk bei Steckung in den Slide-in Slot 1 oder Slide-in Slot 2 als SATA und USB angesprochen.

3.6.18.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	
5AC801.HDDS-00	40 GByte SATA Hard Disk, Slide-in; 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	

Tabelle 97: 5AC801.HDDS-00 - Bestelldaten

3.6.18.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für diese Einzelkomponente alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5AC801.HDDS-00
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
GOST-R	Ja
GL	Ja [1]
Hard Disk	
Kapazität	40 GByte
Anzahl der Köpfe	1
Anzahl der Sektoren	78.140.160
Bytes pro Sektor	512
Cache	8 MByte
Drehzahl	5400 rpm ±1%
Hochlaufzeit	typ. 3 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)
MTBF	750.000 POH [2]
S.M.A.R.T. Support	Ja
Schnittstelle	SATA
Zugriffszeit	5,6 ms
Datentransferrate	
intern	max. 450 MBits/s
zum / vom Host	max. 150 MByte/s (Ultra-DMA Mode 5)

Tabelle 98: 5AC801.HDDS-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5AC801.HDDS-00
Positionierzeit	
minimal (Spur zu Spur)	1 ms
nominal (Lesezugriff)	12,5 ms
maximal (Lesezugriff)	23 ms
Umgebungsbedingungen	
Temperatur [3]	
Betrieb [4]	-30 bis 85°C
Betrieb - 24 Stunden [5]	-30 bis 85°C
Lagerung	-40 bis 95°C
Transport	-40 bis 95°C
Luftfeuchtigkeit [6]	
Betrieb	5 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration	
Betrieb	5 bis 500 Hz: 2 g; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung	5 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Transport	5 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Schock	
Betrieb	300 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler 150 g und 11 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung	800 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler 400 g und 0,5 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Transport	800 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler 400 g und 0,5 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Meereshöhe	
Betrieb	-300 bis 5000 m
Lagerung	-300 bis 12192 m
Mechanische Eigenschaften	
Montage	fix [7]
Abmessungen	
Breite	22 mm
Höhe	172,5 mm
Tiefe	150 mm
Gewicht	387 g
Herstellerinformation	
Hersteller	Seagate
Herstellerbezeichnung	ST940817SM

Tabelle 98: 5AC801.HDDS-00 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
2) Bei 8760 POH (Power On Hours) pro Jahr und 70°C Oberflächentemperatur.
3) Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshöhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle 305 Meter um 1°C verringert werden. Die Temperatur Zu- und Abnahme darf pro Stunde maximal 20°C betragen.
4) Standardbetrieb bedeutet 333 POH (Power On Hours) pro Monat.
5) 24 Stundenbetrieb bedeutet 732 POH (Power On Hours) pro Monat.
6) Luftfeuchtigkeitsgradient: Maximal 15% pro Stunde.
7) Montageweise auf Slide-in compact.

3.6.18.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm

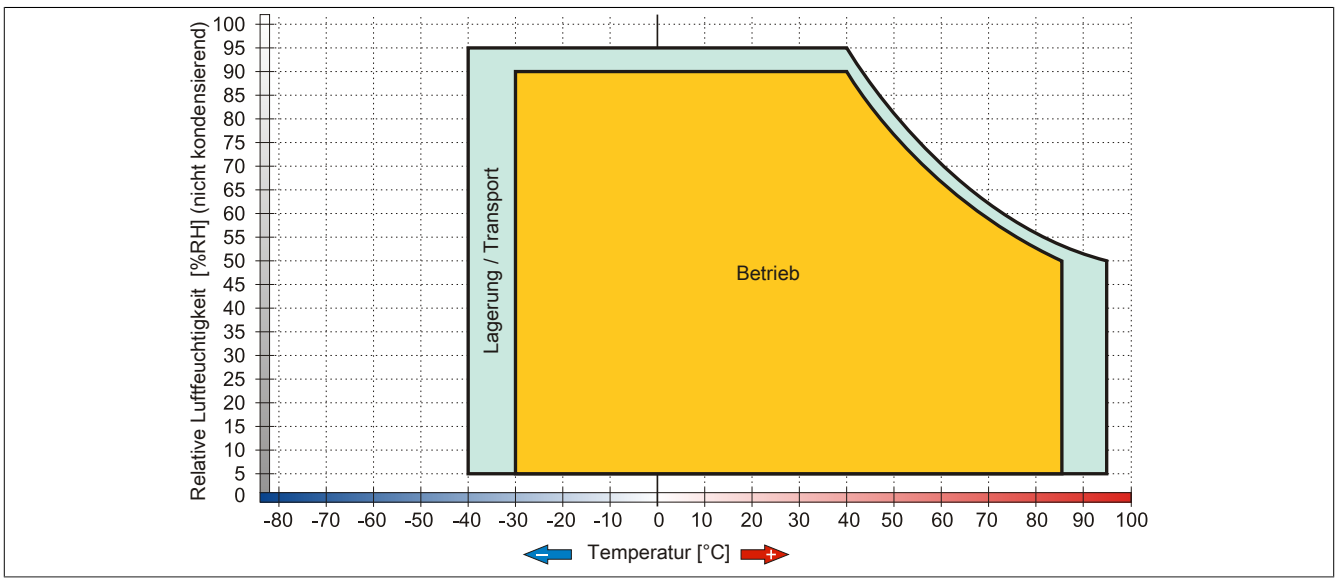


Abbildung 67: 5AC801.HDDS-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.6.19 5AC801.DVDS-00

3.6.19.1 Allgemeines

Das DVD-ROM Slide-in Laufwerk kann in APC810 und PPC800 Systemeinheiten mit Slide-in Laufwerkeinschub verwendet werden.

Information:

Ein nachträglicher Ein- und Ausbau eines Slide-in Laufwerkes ist jederzeit möglich.

Bei Verwendung in einem APC810

Intern wird das Slide-in Laufwerk bei Steckung in den Slide-in Slot 1 oder Slide-in Slot 2 als SATA und USB angesprochen.

3.6.19.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	
5AC801.DVDS-00	DVD-ROM SATA Laufwerk, Slide-in.	

Tabelle 99: 5AC801.DVDS-00 - Bestelldaten

3.6.19.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für diese Einzelkomponente alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5AC801.DVDS-00
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
GOST-R	Ja
GL	Ja [1)]
CD / DVD Laufwerk	
Datentransferrate	max. 1,5 GBit/s
Drehzahl	max. 5090 rpm ±1%
Geräuschpegel	ca. 45 dBA in 50 cm Entfernung (voller Lesezugriff)
Kompatible Formate	CD-DA, CD-ROM Mode 1/ Mode 2 CD-ROM XA Mode 2 (Form 1, Form 2) Photo CD (single/multi-session) Enhanced CD, CD-Text DVD-ROM, DVD-Video (Double Layer), DVD-R (Single/Multi-border), DVD-R DL (Single/Multi-border), DVD-RW (Single/Multi-border), DVD+R (Single/Multi session), DVD+R DL (Single/Multi session), DVD+RW (Single/Multi session), DVD-RAM (4,7 GB, 2,6 GB)
Laserklasse	Class 1 Laser
Lebensdauer	60.000 POH (Power On Hours)
Schnittstelle	SATA
Hochlaufzeit	
CD	max. 19 Sekunden (von 0 rpm auf Lesezugriff)
DVD	max. 19 Sekunden (von 0 rpm auf Lesezugriff)

Tabelle 100: 5AC801.DVDS-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5AC801.DVDS-00
Zugriffszeit	
CD	durchschnittlich 130 ms
DVD	durchschnittlich 140 ms
Lesbare Medien	
CD	CD-ROM (12 cm, 8 cm), CD-A CD-R, CD-RW
DVD	DVD-ROM, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, DVD+R DVD+R DL, DVD+RW, DVD-RAM
Lesegeschwindigkeit	
CD	24x
DVD	8x
Umgebungsbedingungen	
Temperatur [2]	
Betrieb	5 bis 55°C [3]
Lagerung	-20 bis 60°C
Transport	-40 bis 65°C
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	8 bis 80%, nicht kondensierend
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration	
Betrieb	5 bis 500 Hz: 0,2 g
Lagerung	5 bis 500 Hz: 2 g
Transport	5 bis 500 Hz: 2 g
Schock	
Betrieb	5 g und 11 ms Dauer
Lagerung	60 g und 11 ms Dauer 200 g und 2 ms Dauer
Transport	60 g und 11 ms Dauer 200 g und 2 ms Dauer
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen	
Breite	22 mm
Höhe	172,5 mm
Tiefe	150 mm
Gewicht	455 g

Tabelle 100: 5AC801.DVDS-00 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
2) Die Temperaturangaben entsprechen einer Angabe bei 500 Metern ü. NN. Herabsenkung (Derating) der max. Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 Meter ü. NN.
3) Oberflächentemperatur des Laufwerks.

3.6.19.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm

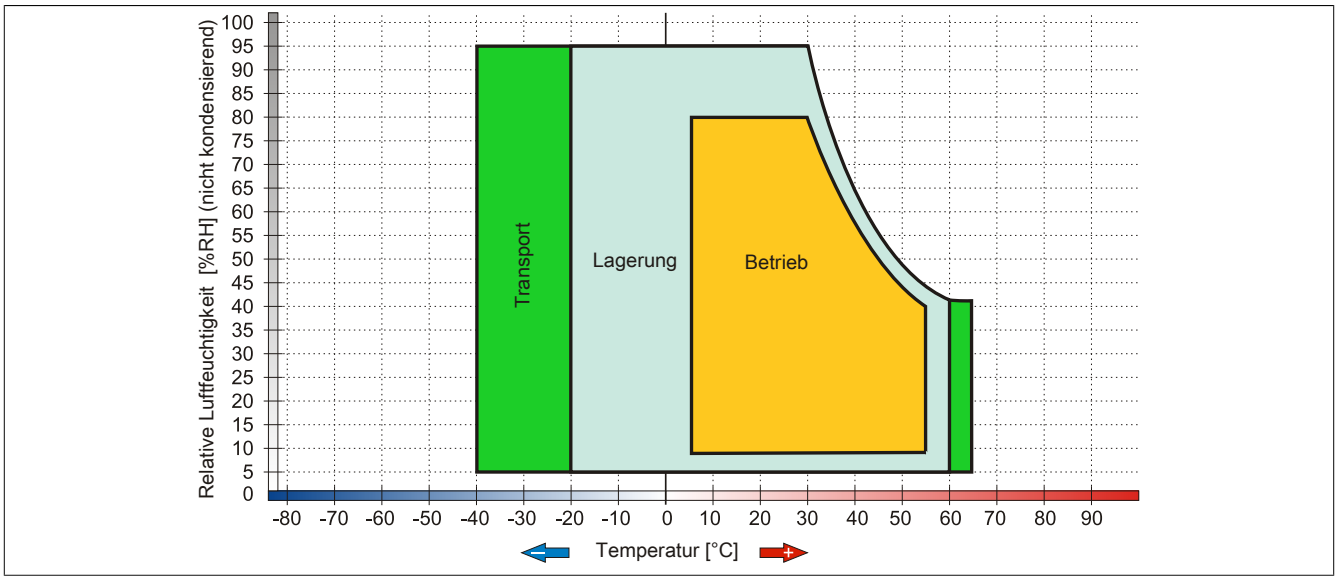


Abbildung 68: 5AC801.DVDS-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.6.19.5 Hot-Plug Fähigkeit

Hardwarerevision B0 des Slide-in DVD-ROM - 5AC801.DVDS-00 bietet keine SATA Hotplugfähigkeit. Andere Hardwarerevisionen sind hotplugfähig.

3.6.20 5AC801.DVRS-00

3.6.20.1 Allgemeines

Das DVD-R/RW Slide-in Laufwerk kann in APC810 und PPC800 Systemeinheiten mit Slide-in Laufwerkeinschub verwendet werden.

Information:

Ein nachträglicher Ein- und Ausbau eines Slide-in Laufwerkes ist jederzeit möglich.

Bei Verwendung in einem APC810

Intern wird das Slide-in Laufwerk bei Steckung in den Slide-in Slot 1 oder Slide-in Slot 2 als SATA und USB angesprochen.

3.6.20.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	
5AC801.DVRS-00	DVD-R/RW DVD+R/RW SATA Laufwerk, Slide-in.	
	Optionales Zubehör	
	Sonstiges	
5SWUTI.0000-00	OEM Nero CD-RW Software, nur in Verbindung mit einem CD-RW Laufwerk erhältlich.	

Tabelle 101: 5AC801.DVRS-00 - Bestelldaten

3.6.20.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für diese Einzelkomponente alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5AC801.DVRS-00
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
GOST-R	Ja
GL	Ja [1)]
CD / DVD Laufwerk	
Datenpufferkapazität	2 MByte
Datentransferrate	max. 33,3 MByte/s
Drehzahl	max. 5160 rpm ±1%
Geräuschpegel	ca. 45 dBA in 50 cm Entfernung (voller Lesezugriff)
Kompatible Formate	CD-DA, CD-ROM Mode 1/ Mode 2 CD-ROM XA Mode 2 (Form 1, Form 2) Photo CD (single/multi-session), Enhanced CD, CD-Text DVD-ROM, DVD-R, DVD-R (Double Layer), DVD-RW, DVD-Video DVD-RAM (4,7 GB, 2,6 GB) DVD+R, DVD+R (Double Layer), DVD+RW
Laserklasse	Class 1 Laser
Lebensdauer	60.000 POH (Power On Hours)
Schnittstelle	SATA
Hochlaufzeit	
CD	max. 14 Sekunden (von 0 rpm auf Lesezugriff)
DVD	max. 15 Sekunden (von 0 rpm auf Lesezugriff)

Tabelle 102: 5AC801.DVRS-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5AC801.DVRS-00
Zugriffszeit	
CD	durchschnittlich 140 ms (24x)
DVD	durchschnittlich 150 ms (8x)
Lesbare Medien	
CD	CD/CD-ROM (12 cm, 8 cm), CD-R, CD-RW
DVD	DVD-ROM, DVD-R, DVD-R (Double Layer), DVD-RW. DVD-RAM, DVD+R, DVD+R (Double Layer),DVD+RW, DVD-RAM
Beschreibbare Medien	
CD	CD-R, CD-RW
DVD	DVD-R/RW, DVD-R (Double Layer), DVD-RAM (4,7 GB), DVD+R/RW, DVD+R (Double Layer)
Lesegeschwindigkeit	
CD	24x
DVD	8x
Schreibgeschwindigkeit	
CD-R	24x, 16x, 10x und 4x
CD-RW	24x, 16x, 10x und 4x
DVD+R	8x, 4x und 2,4x
DVD+R (Double Layer)	6x, 4x und 2,4x
DVD+RW	4x und 2x
DVD-R	8x, 4x und 2x
DVD-R (Double Layer)	6x, 4x und 2x
DVD-RAM [2]	5x, 3x und 2x
DVD-RW	6x, 4x und 2x
Schreibmethoden	
CD	Disc at once, Session at once, Packet write, Track at once
DVD	Disc at once, Incremental, Over write, Sequential, Multi-session
Umgebungsbedingungen	
Temperatur [3]	
Betrieb	5 bis 55°C [4]
Lagerung	-20 bis 60°C
Transport	-40 bis 65°C
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	8 bis 80%, nicht kondensierend
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration	
Betrieb	5 bis 500 Hz: 0,2 g
Lagerung	5 bis 500 Hz: 2 g
Transport	5 bis 500 Hz: 2 g
Schock	
Betrieb	bei max. 5 g und 11 ms Dauer
Lagerung	bei max. 60 g und 11 ms Dauer bei max. 200 g und 2 ms Dauer
Transport	bei max. 60 g und 11 ms Dauer bei max. 200 g und 2 ms Dauer
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen	
Breite	22 mm
Höhe	172,5 mm
Tiefe	150 mm
Gewicht	400 g

Tabelle 102: 5AC801.DVRS-00 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
2) RAM Treiber werden vom Hersteller nicht zur Verfügung gestellt. Unterstützung der RAM Funktion durch die Brennsoftware „Nero“ (Best. Nr. 5SWUTI.0000-00) oder anderer Brennsoftwarepakete bzw. Treibern von Drittanbietern.
3) Die Temperaturangaben entsprechen einer Angabe bei 500 Metern. Herabsenkung (Derating) der max. Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 Metern ü. NN.
4) Oberflächentemperatur des Laufwerks.

3.6.20.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm

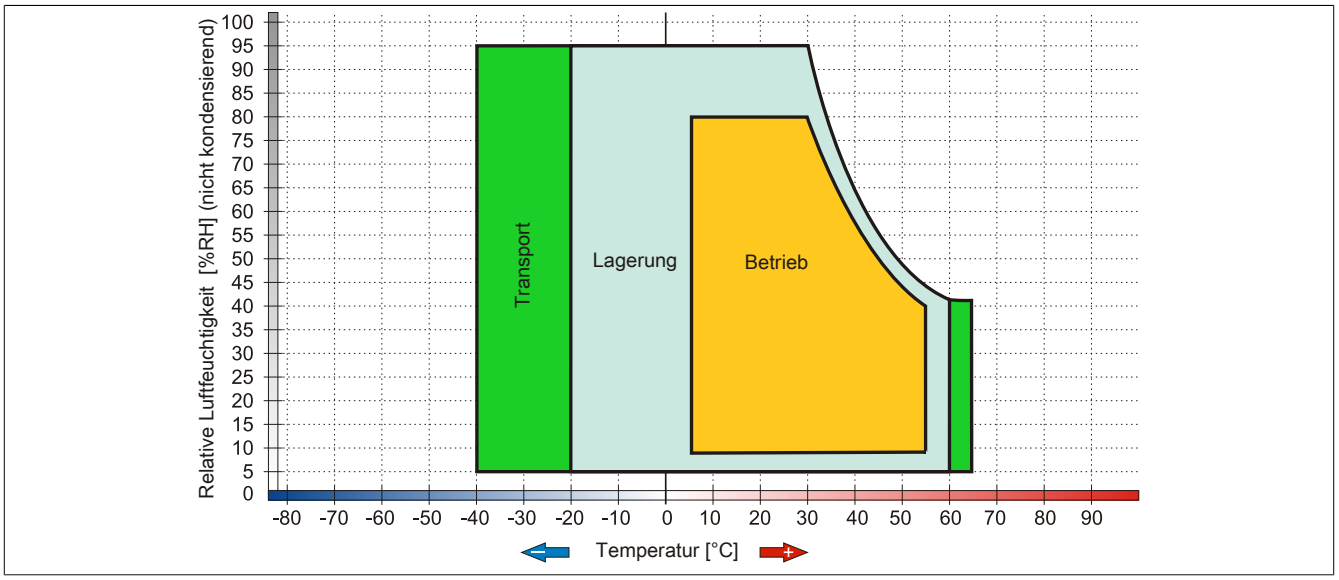


Abbildung 69: 5AC801.DVRS-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.6.21 5ACPCI.RAIC-01

3.6.21.1 Allgemeines

Dieser SATA RAID Controller unterstützt RAID Level 0 und 1 und ist in einen PCI Slot steckbar. Die verwendeten Hard Disks sind für den 24 Stunden Betrieb (24x7) spezifiziert.

- SATA RAID Controller
- RAID Level 0 (Aufteilung) und 1 (Spiegelung)
- 2 SATA Hard Disk Laufwerke (geeignet für 24 Stunden Betrieb)
- Benötigt nur 1 PCI Slot
- Übertragungsraten bis zu 150 MByte/s

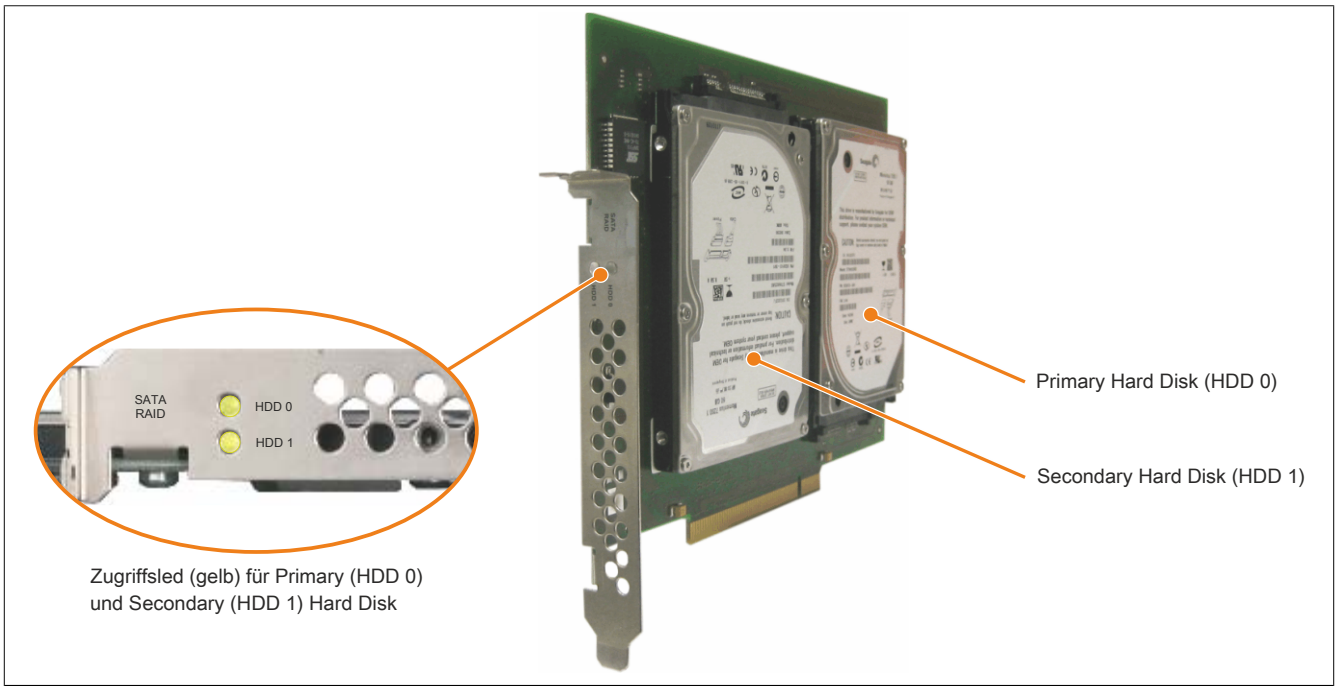


Abbildung 70: PCI SATA RAID Controller

Information:

Der PCI SATA RAID Controller kann nicht als Ersatz für eine „Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)“ eingesetzt werden. Wird das Betriebssystem nicht korrekt beendet, so wird dies beim nächsten Starten des Systems als Fehlerzustand (bei RAID 1 Verbund) erkannt und ein kompletter Rebuild durchgeführt. Dies nimmt in der Regel mindestens 50 Minuten (konigurierbar) in Anspruch.

3.6.21.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	
5ACPCI.RAIC-01	PCI RAID System SATA 2x 60 GByte Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.	
	Optionales Zubehör	
	Laufwerke	
5ACPCI.RAIC-02	60 GByte SATA Hard Disk Ersatzteil für 5ACPCI.RAIC-01 Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.	

Tabelle 103: 5ACPCI.RAIC-01 - Bestelldaten

3.6.21.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für diese Einzelkomponente alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5ACPCI.RAIC-01
Allgemeines	
Anzahl der Hard Disks	2
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
Controller	
Typ	Sil 3512 SATA Link
Spezifikation	Serial ATA 1.0
Datenübertragungsrate	max. 1,5 GBit/s (150 MByte/s)
RAID Level	unterstützt RAID 0, 1
BIOS Extension ROM Bedarf	ca. 32 kByte
Hard Disk	
Kapazität	60 GByte
Anzahl der Köpfe	3
Anzahl der Sektoren	117.210.240
Bytes pro Sektor	512
Cache	8 MByte
Drehzahl	7200 rpm ±1%
Hochlaufzeit	typ. 4 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)
Lebensdauer	5 Jahre
S.M.A.R.T. Support	Ja
Zugriffszeit	4,2 ms
unterstützte Transfermodi	SATA 1.0, PIO Modus 0-4, Multiword DMA Modus 0-2, UDMA 0-5
Datentransferrate	
intern	max. 539 MBits/s
zum / vom Host	max. 150 MByte/s
Positionierzeit	
minimal (Spur zu Spur)	1,5 ms
nominal (Lesezugriff)	10,5 ms
maximal (Lesezugriff)	22 ms
Elektrische Eigenschaften	
Leistungsaufnahme	0,3 A bei 3,3 V (PCI Bus) 1 A bei 5 V (PCI Bus)
Umgebungsbedingungen	
Temperatur [1]	
Betrieb [2]	5 bis 55°C
Betrieb - 24 Stunden [3]	5 bis 40°C
Lagerung	-40 bis 70°C
Transport	-40 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	5 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration [4]	
Betrieb (dauerhaft)	5 bis 500 Hz: 0,125 g (1,225 m/s² 0-peak) Dauer 1 Oktave pro Minute; keine Beschädigung
Betrieb (gelegentlich)	5 bis 500 Hz: 0,25 g (2,45 m/s² 0-peak) Dauer 1 Oktave pro Minute; keine Beschädigung
Lagerung	bei max. 5 bis 500 Hz und 5 g (49 m/s² 0-peak) Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung
Transport	bei max. 5 bis 500 Hz und 5 g (49 m/s² 0-peak) Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung
Schock	
Betrieb	bei max. 125 g (1226 m/s² 0-peak) und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung	bei max. 400 g (3924 m/s² 0-peak) und 2 ms Dauer; keine Beschädigung bei max. 450 g (4424 m/s² 0-peak) und 1 ms Dauer; keine Beschädigung bei max. 200 g (1962 m/s² 0-peak) und 0,5 ms Dauer; keine Beschädigung
Transport	bei max. 400 g (3924 m/s² 0-peak) und 2 ms Dauer; keine Beschädigung bei max. 450 g (4424 m/s² 0-peak) und 1 ms Dauer; keine Beschädigung bei max. 200 g (1962 m/s² 0-peak) und 0,5 ms Dauer; keine Beschädigung
Meereshöhe	
Betrieb	-300 bis 3048 m
Lagerung	-300 bis 12192 m
Mechanische Eigenschaften	
Montage [5]	fix
Abmessungen	
Breite	70 mm
Länge	100 mm
Höhe	9,5 mm

Tabelle 104: 5ACPCI.RAIC-01 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5ACPCI.RAIC-01
Gewicht	350 g
Herstellerinformation	
Hersteller	Seagate
Herstellerbezeichnung	Momentus 7200.1 ST96023AS

Tabelle 104: 5ACPCI.RAIC-01 - Technische Daten

1) Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshöhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle 305 Meter um 1 °C verringert werden. Die Temperatur Zu- und Abnahme darf pro Minute maximal 3 °C betragen.
2) Standardbetrieb bedeutet 333 POH (Power On Hours) pro Monat.
3) 24 Stundenbetrieb bedeutet 732 POH (Power On Hours) pro Monat.
4) Bei Einsatz in vibrations- und schockgefährdeten Bereichen besteht im Betrieb die Möglichkeit von Performanceeinbrüchen (absinken der Übertragungsrate).
5) Montageweise auf PCI Einschub.

3.6.21.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm

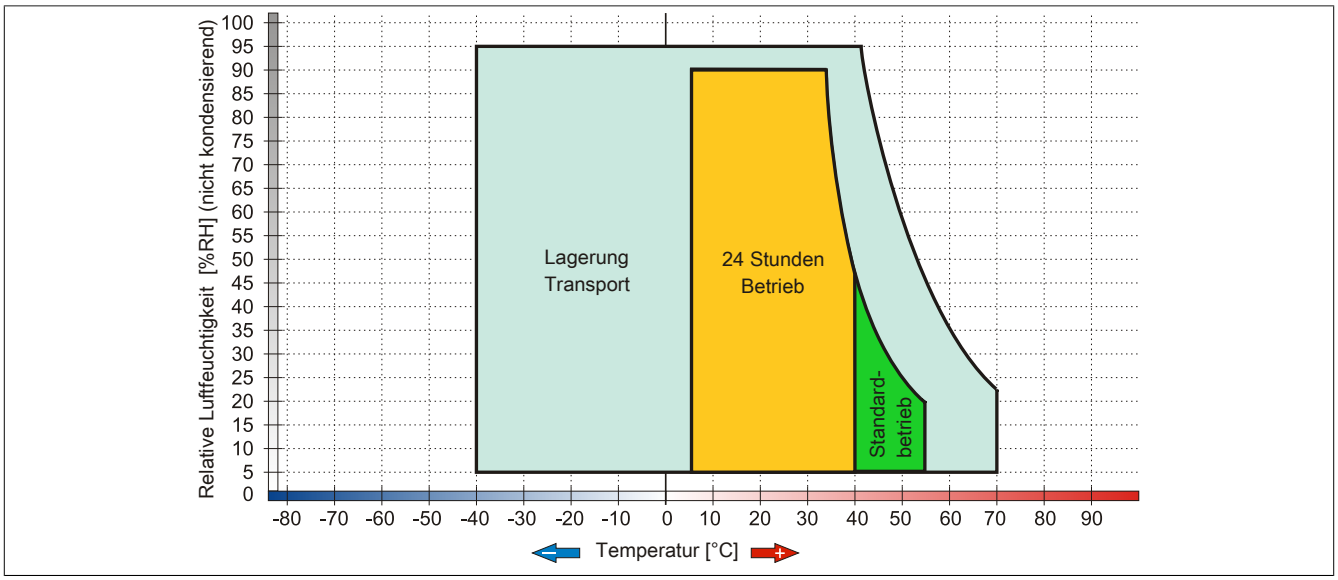


Abbildung 71: 5ACPCI.RAIC-01 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.6.21.5 Treibersupport

Für den Betrieb des PCI SATA RAID Controllers sind spezielle Treiber notwendig. Es stehen für die unterstützten und freigegebenen Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) Treiber zum Download bereit.

Ebenfalls auf der B&R Homepage ist die auf .NET basierende SATA Raid™ Serial ATA RAID Management Software zu finden.

Information:

Benötigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzuladen.

3.6.21.6 Konfiguration

Konfiguration eines SATA RAID Verbundes 3 "Inbetriebnahme", Abschnitt 7 "Konfiguration eines SATA RAID Verbundes" auf Seite 234.

3.6.21.7 Tauschen einer HDD

Eine Hard Disk kann im Fehlerfalle bei RAID1 (Spiegelung) Konfiguration einfach getauscht werden ohne das System neu installieren zu müssen. Dazu ist die Ersatz SATA HDD 60GB 5ACPCI.RAIC-02 als Ersatzteil für eine HDD verfügbar.

Eine Tauschanleitung dazu siehe Kapitel 7 "Wartung / Instandhaltung", Abschnitt 11 "Tauschen einer PCI SATA RAID Hard Disk bei RAID 1" auf Seite 444.

3.6.22 5ACPCI.RAIC-02

3.6.22.1 Allgemeines

Die Hard Disk kann als Ersatzteil für eine HDD des PCI SATA RAID Controllers 5ACPCI.RAIC-01 verwendet werden.

3.6.22.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	
5ACPCI.RAIC-02	60 GByte SATA Hard Disk Ersatzteil für 5ACPCI.RAIC-01 Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.	

Tabelle 105: 5ACPCI.RAIC-02 - Bestelldaten

3.6.22.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für diese Einzelkomponente alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5ACPCI.RAIC-02
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
cULus HazLoc Class 1 Division 2	Ja [1]
GOST-R	Ja
Hard Disk	
Kapazität	60 GByte
Anzahl der Köpfe	3
Anzahl der Sektoren	117.210.240
Bytes pro Sektor	512
Cache	8 MByte
Drehzahl	7200 rpm ±1%
Hochlaufzeit	typ. 4 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)
Lebensdauer	5 Jahre
S.M.A.R.T. Support	Ja
Zugriffszeit	4,2 ms
unterstützte Transfermodi	SATA 1.0, PIO Modus 0-4, Multiword DMA Modus 0-2, UDMA 0-5
Datentransferrate	
intern	max. 539 MBits/s
zum / vom Host	max. 150 MByte/s
Positionierzeit	
minimal (Spur zu Spur)	1,5 ms
nominal (Lesezugriff)	10,5 ms
maximal (Lesezugriff)	22 ms
Umgebungsbedingungen	
Temperatur [2]	
Betrieb [3]	5 bis 55°C
Betrieb - 24 Stunden [4]	5 bis 40°C
Lagerung	-40 bis 70°C
Transport	-40 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	5 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration [5]	
Betrieb (dauerhaft)	5 bis 500 Hz: 0,125 g (1,225 m/s² 0-peak) Dauer 1 Oktave pro Minute; keine Beschädigung
Betrieb (gelegentlich)	5 bis 500 Hz: 0,25 g (2,45 m/s² 0-peak) Dauer 1 Oktave pro Minute; keine Beschädigung
Lagerung	bei max. 5 bis 500 Hz und 5 g (49 m/s² 0-peak) Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung
Transport	bei max. 5 bis 500 Hz und 5 g (49 m/s² 0-peak) Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung

Tabelle 106: 5ACPCI.RAIC-02 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5ACPCI.RAIC-02
Schock	
Betrieb	bei max. 125 g (1226 m/s² 0-peak) und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung	bei max. 400 g (3924 m/s² 0-peak) und 2 ms Dauer; keine Beschädigung bei max. 450 g (4424 m/s² 0-peak) und 1 ms Dauer; keine Beschädigung bei max. 200 g (1962 m/s² 0-peak) und 0,5 ms Dauer; keine Beschädigung
Transport	bei max. 400 g (3924 m/s² 0-peak) und 2 ms Dauer; keine Beschädigung bei max. 450 g (4424 m/s² 0-peak) und 1 ms Dauer; keine Beschädigung bei max. 200 g (1962 m/s² 0-peak) und 0,5 ms Dauer; keine Beschädigung
Meereshöhe	
Betrieb	-300 bis 3048 m
Lagerung	-300 bis 12192 m
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen	
Breite	70 mm
Länge	100 mm
Höhe	9,5 mm
Gewicht	350 g
Herstellerinformation	
Hersteller	Seagate
Herstellerbezeichnung	Momentus 7200.1 ST96023AS

Tabelle 106: 5ACPCI.RAIC-02 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben und das Gesamtgerät die entsprechende Kennzeichnung trägt.
2) Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshöhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle 305 Meter um 1°C verringert werden. Die Temperatur Zu- und Abnahme darf pro Minute maximal 3°C betragen.
3) Standardbetrieb bedeutet 333 POH (Power On Hours) pro Monat.
4) 24 Stundenbetrieb bedeutet 732 POH (Power On Hours) pro Monat.
5) Bei Einsatz in vibrations- und schockgefährdeten Bereichen besteht im Betrieb die Möglichkeit von Performanceeinbrüchen (absinken der Übertragungsrate).

3.6.22.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm

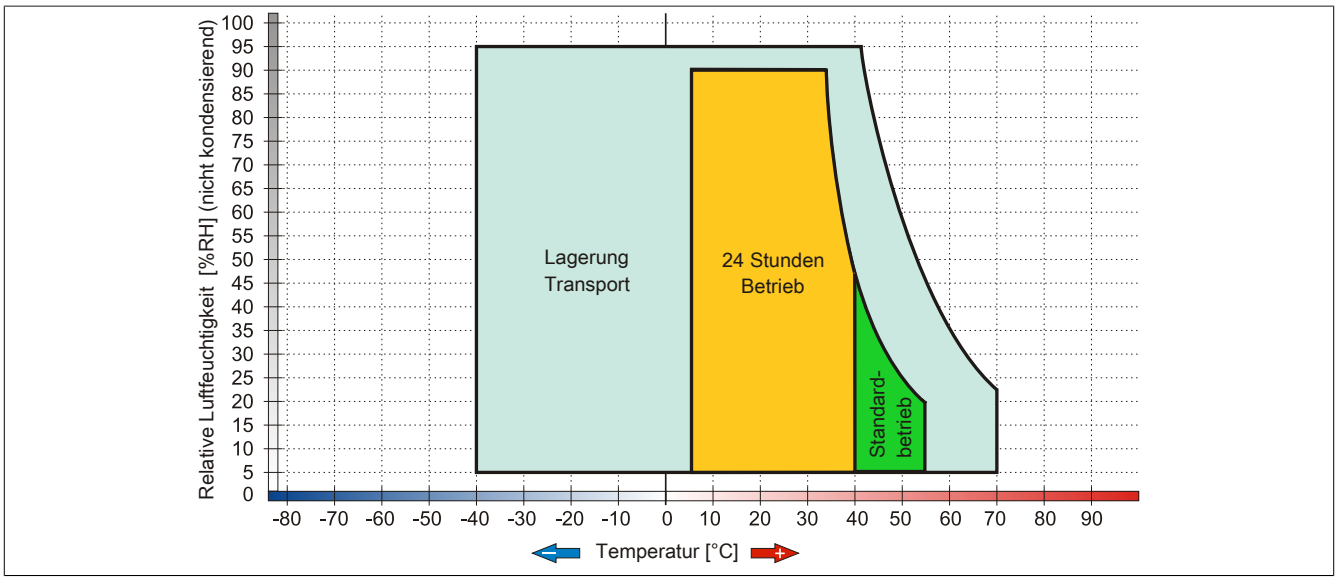


Abbildung 72: 5ACPCI.RAIC-02 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.6.23 5ACPCI.RAIC-03

3.6.23.1 Allgemeines

Dieser SATA RAID Controller unterstützt RAID Level 0 und 1 und ist in einen PCI Slot steckbar. Die verwendeten Hard Disks sind für den 24 Stunden Betrieb (24x7) spezifiziert und bieten zusätzlich eine erweiterte Temperaturspezifikation (ET).

- SATA RAID Controller
- RAID Level 0 (Aufteilung) und 1 (Spiegelung)
- 2 SATA Hard Disk Laufwerke (geeignet für 24 Stunden Betrieb)
- Benötigt nur 1 PCI Slot
- Übertragungsraten bis zu 150 MByte/s

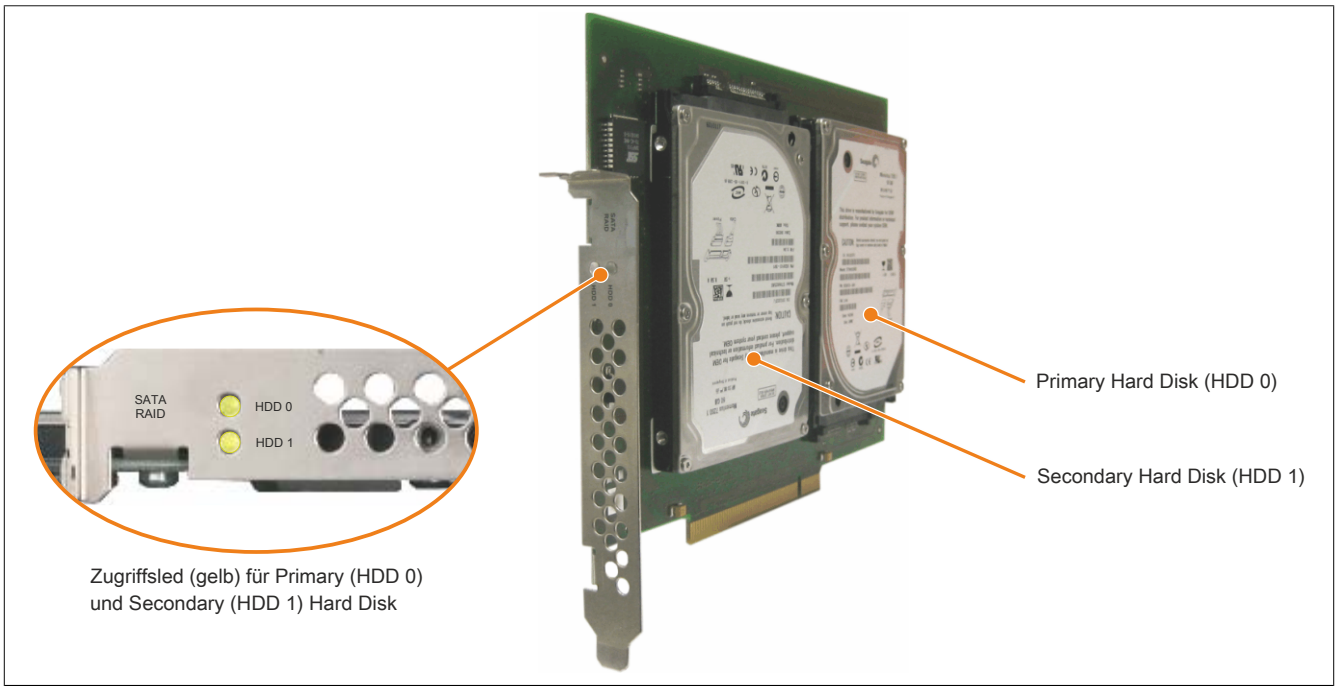


Abbildung 73: PCI SATA RAID Controller

Information:

Der PCI SATA RAID Controller kann nicht als Ersatz für eine „Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)“ eingesetzt werden. Wird das Betriebssystem nicht korrekt beendet, so wird dies beim nächsten Starten des Systems als Fehlerzustand (bei RAID 1 Verbund) erkannt und ein kompletter Rebuild durchgeführt. Dies nimmt in der Regel bei einer Speichergröße von 160 GByte ca. 160 Minuten (konfigurierbar) in Anspruch.

3.6.23.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	
5ACPCI.RAIC-03	PCI RAID System SATA 2x 160 GByte; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.	
	Optionales Zubehör	
	Laufwerke	
5ACPCI.RAIC-04	160 GByte SATA Hard Disk Ersatzteil für 5ACPCI.RAIC-03; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.	

Tabelle 107: 5ACPCI.RAIC-03 - Bestelldaten

3.6.23.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für diese Einzelkomponente alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5ACPCI.RAIC-03
Allgemeines	
Anzahl der Hard Disks	2
Zertifizierungen	
CE	Ja
Controller	
Typ	Sil 3512 SATA Link
Spezifikation	Serial ATA 1.0
Datenübertragungsrate	max. 1,5 GBit/s (150 MByte/s)
RAID Level	unterstützt RAID 0, 1
BIOS Extension ROM Bedarf	ca. 32 kByte
Hard Disk	
Kapazität	160 GByte
Anzahl der Köpfe	3
Anzahl der Sektoren	312.581.808
Bytes pro Sektor	512
Cache	8 MByte
Drehzahl	5400 rpm ±1%
Hochlaufzeit	typ. 4 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)
Lebensdauer	5 Jahre
S.M.A.R.T. Support	Ja
Zugriffszeit	5,56 ms
unterstützte Transfermodi	SATA 1.0, PIO Modus 0-4, Multiword DMA Modus 0-2, UDMA 0-5
Datentransferrate	
intern	max. 84,6 MBits/s
zum / vom Host	max. 150 MByte/s
Positionierzeit	
minimal (Spur zu Spur)	1,5 ms
nominal (Lesezugriff)	12 ms
maximal (Lesezugriff)	22 ms
Elektrische Eigenschaften	
Leistungsaufnahme	0,3 A bei 3,3 V (PCI Bus) 1 A bei 5 V (PCI Bus)
Umgebungsbedingungen	
Temperatur [1]	
Betrieb [2]	-15 bis 80°C
Betrieb - 24 Stunden [3]	-15 bis 80°C
Lagerung	-40 bis 95°C
Transport	-40 bis 95°C
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	8 bis 90%, nicht kondensierend [4]
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend [5]
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend [5]
Vibration [6]	
Betrieb (dauerhaft)	5 bis 500 Hz: max. 0,125 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler
Betrieb (gelegentlich)	5 bis 500 Hz: max. 0,25 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung	5 bis 500 Hz: max. 5 g; Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung
Transport	5 bis 500 Hz: max. 5 g; Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung
Schock	
Betrieb	max. 125 g, 2 ms; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung	max. 400 g, 2 ms; keine Beschädigung max. 450 g, 1 ms; keine Beschädigung max. 200 g, 0,5 ms; keine Beschädigung
Transport	max. 400 g, 2 ms; keine Beschädigung max. 450 g, 1 ms; keine Beschädigung max. 200 g, 0,5 ms; keine Beschädigung
Meereshöhe	
Betrieb	-300 bis 3048 m
Lagerung	-300 bis 12192 m
Mechanische Eigenschaften	
Montage [7]	fix
Abmessungen	
Breite	70 mm
Länge	100 mm
Höhe	9,5 mm

Tabelle 108: 5ACPCI.RAIC-03 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5ACPCI.RAIC-03
Gewicht	350 g
Herstellerinformation	
Hersteller	Fujitsu
Herstellerbezeichnung	M120-ESW MHY2160BH-ESW

Tabelle 108: 5ACPCI.RAIC-03 - Technische Daten

1) Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshöhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle 305 Meter um 1°C verringert werden. Die Temperatur Zu- und Abnahme darf pro Minute maximal 3°C betragen.
2) Standardbetrieb bedeutet 333 POH (Power On Hours) pro Monat.
3) 24 Stundenbetrieb bedeutet 732 POH (Power On Hours) pro Monat.
4) Maximalfeuchtigkeit bei 29°C.
5) Maximalfeuchtigkeit bei 40°C.
6) Bei Einsatz in vibrations- und schockgefährdeten Bereichen besteht im Betrieb die Möglichkeit von Performanceeinbrüchen (absinken der Übertragungsrate).
7) Montageweise auf PCI Einschub.

3.6.23.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm

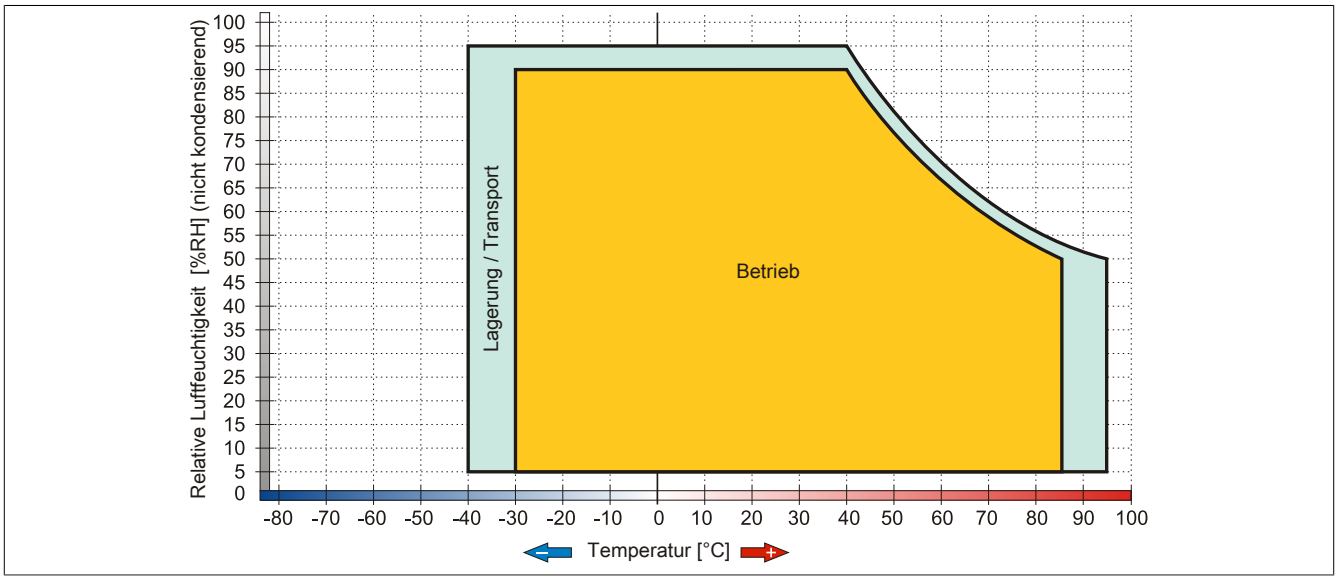


Abbildung 74: 5ACPCI.RAIC-03 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.6.23.5 Treibersupport

Für den Betrieb des PCI SATA RAID Controllers sind spezielle Treiber notwendig. Es stehen für die unterstützten und freigegebenen Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) Treiber zum Download bereit.

Ebenfalls auf der B&R Homepage ist die auf .NET basierende SATA Raid™ Serial ATA RAID Management Software zu finden.

Information:

Benötigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzuladen.

3.6.23.6 Konfiguration

Konfiguration eines SATA RAID Verbundes 3 "Inbetriebnahme", Abschnitt 7 "Konfiguration eines SATA RAID Verbundes" auf Seite 234.

3.6.23.7 Tauschen einer HDD

Eine Hard Disk kann im Fehlerfalle bei RAID1 (Spiegelung) Konfiguration einfach getauscht werden ohne das System neu installieren zu müssen. Dazu ist die Ersatz SATA HDD 160GB 5ACPCI.RAIC-04 als Ersatzteil für eine HDD verfügbar.

Eine Tauschanleitung dazu siehe Kapitel 7 "Wartung / Instandhaltung", Abschnitt 11 "Tauschen einer PCI SATA RAID Hard Disk bei RAID 1" auf Seite 444.

3.6.24 5ACPCI.RAIC-04

3.6.24.1 Allgemeines

Die Hard Disk kann als Ersatzteil für eine HDD des PCI SATA RAID Controllers 5ACPCI.RAIC-03 verwendet werden.

3.6.24.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	
5ACPCI.RAIC-04	160 GByte SATA Hard Disk Ersatzteil für 5ACPCI.RAIC-03; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.	

Tabelle 109: 5ACPCI.RAIC-04 - Bestelldaten

3.6.24.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für diese Einzelkomponente alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5ACPCI.RAIC-04
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
Hard Disk	
Kapazität	160 GByte
Anzahl der Köpfe	3
Anzahl der Sektoren	312.581.808
Bytes pro Sektor	512
Cache	8 MByte
Drehzahl	5400 rpm ±1%
Hochlaufzeit	typ. 4 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)
Lebensdauer	5 Jahre
S.M.A.R.T. Support	Ja
Zugriffszeit	5,56 ms
unterstützte Transfermodi	SATA 1.0, PIO Modus 0-4, Multiword DMA Modus 0-2, UDMA 0-5
Datentransferrate	
intern	max. 84,6 MBits/s
zum / vom Host	max. 150 MByte/s
Positionierzeit	
minimal (Spur zu Spur)	1,5 ms
nominal (Lesezugriff)	12 ms
maximal (Lesezugriff)	22 ms
Elektrische Eigenschaften	
Leistungsaufnahme	0,3 A bei 3,3 V (PCI Bus) 1 A bei 5 V (PCI Bus)
Umgebungsbedingungen	
Temperatur [1]	
Betrieb [2]	-15 bis 80°C
Betrieb - 24 Stunden [3]	-15 bis 80°C
Lagerung	-40 bis 95°C
Transport	-40 bis 95°C
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	8 bis 90%, nicht kondensierend [4]
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend [5]
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend [5]
Vibration [6]	
Betrieb (dauerhaft)	5 bis 500 Hz: max. 0,125 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler
Betrieb (gelegentlich)	5 bis 500 Hz: max. 0,25 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung	5 bis 500 Hz: max. 5 g; Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung
Transport	5 bis 500 Hz: max. 5 g; Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung

Tabelle 110: 5ACPCI.RAIC-04 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5ACPCI.RAIC-04
Schock	
Betrieb	max. 125 g, 2 ms; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung	max. 400 g, 2 ms; keine Beschädigung max. 450 g, 1 ms; keine Beschädigung max. 200 g, 0,5 ms; keine Beschädigung
Transport	max. 400 g, 2 ms; keine Beschädigung max. 450 g, 1 ms; keine Beschädigung max. 200 g, 0,5 ms; keine Beschädigung
Meereshöhe	
Betrieb	-300 bis 3048 m
Lagerung	-300 bis 12192 m
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen	
Breite	70 mm
Länge	100 mm
Höhe	9,5 mm
Gewicht	350 g
Herstellerinformation	
Hersteller	Fujitsu
Herstellerbezeichnung	M120-ESW MHY2160BH-ESW

Tabelle 110: 5ACPCI.RAIC-04 - Technische Daten

1) Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshöhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle 305 Meter um 1°C verringert werden. Die Temperatur Zu- und Abnahme darf pro Minute maximal 3°C betragen.
2) Standardbetrieb bedeutet 333 POH (Power On Hours) pro Monat.
3) 24 Stundenbetrieb bedeutet 732 POH (Power On Hours) pro Monat.
4) Maximalfeuchtigkeit bei 29°C.
5) Maximalfeuchtigkeit bei 40°C.
6) Bei Einsatz in vibrations- und schockgefährdeten Bereichen besteht im Betrieb die Möglichkeit von Performanceeinbrüchen (absinken der Übertragungsrate).

3.6.24.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm

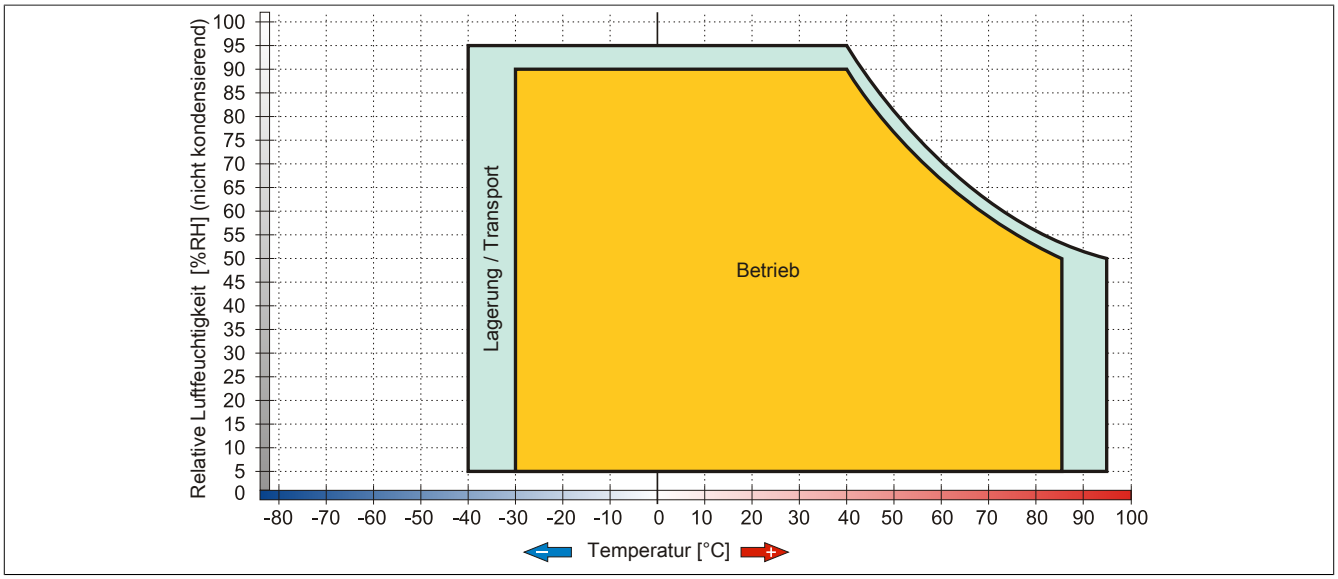


Abbildung 75: 5ACPCI.RAIC-04 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.6.25 5ACPCI.RAIC-05

3.6.25.1 Allgemeines

Dieser SATA RAID Controller unterstützt RAID Level 0 und 1 und ist in einen PCI Slot steckbar. Die verwendeten 250 GByte Hard Disks sind für den 24 Stunden Betrieb (24x7) spezifiziert.

- SATA RAID Controller
- RAID Level 0 (Aufteilung) und 1 (Spiegelung)
- 2 SATA Hard Disk Laufwerke (geeignet für 24 Stunden Betrieb)
- Benötigt nur 1 PCI Slot
- Übertragungsraten bis zu 150 MByte/s

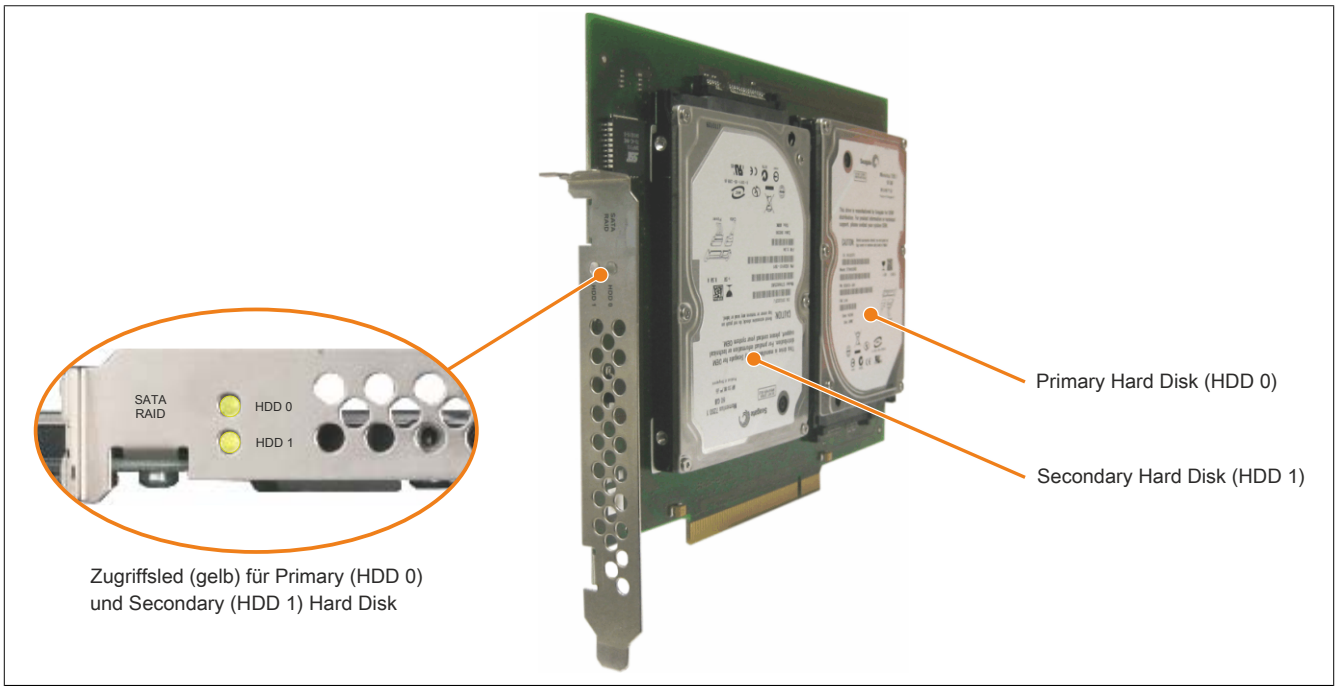


Abbildung 76: PCI SATA RAID Controller

Information:

Der PCI SATA RAID Controller kann nicht als Ersatz für eine „Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)“ eingesetzt werden. Wird das Betriebssystem nicht korrekt beendet, so wird dies beim nächsten Starten des Systems als Fehlerzustand (bei RAID 1 Verbund) erkannt und ein kompletter Rebuild durchgeführt. Dies nimmt in der Regel bei einer Speichergröße von 250 GByte ca. 250 Minuten (konfigurierbar) in Anspruch.

3.6.25.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	
5ACPCI.RAIC-05	PCI RAID System SATA 2x 250 GByte; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	
	Optionales Zubehör	
	Laufwerke	
5MMHDD.0250-00	250 GByte SATA Hard Disk Ersatzteil für 5AC801.HDDI-03 und 5ACPCI.RAIC-05; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	

Tabelle 111: 5ACPCI.RAIC-05 - Bestelldaten

3.6.25.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5ACPCI.RAIC-05
Allgemeines	
Anzahl der Hard Disks	2
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
cULus HazLoc Class 1 Division 2	Ja [1]
GOST-R	Ja
Controller	
Typ	Sil 3512 SATA Link
Spezifikation	Serial ATA 1.0
Datenübertragungsrate	max. 1,5 GBit/s (150 MByte/s)
RAID Level	unterstützt RAID 0, 1
BIOS Extension ROM Bedarf	ca. 32 kByte
Hard Disk	
Kapazität	250 GByte
Anzahl der Köpfe	1
Anzahl der Sektoren	488.397.168
Bytes pro Sektor	512
Cache	8 MByte
Drehzahl	5400 rpm ±0,2%
Hochlaufzeit	typ. 3,6 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)
S.M.A.R.T. Support	Ja
Zugriffszeit	5,56 ms
unterstützte Transfermodi	SATA 1.0, Serial ATA Revision 2.6 PIO Modus 0-4, Multiword DMA Modus 0-2, UDMA Modus 0-6
Datentransferrate	
intern	max. 1175 MBit/s
zum / vom Host	max. 150 MByte/s
Positionierzeit	
minimal (Spur zu Spur)	1 ms
nominal (Lesezugriff)	14 ms
maximal (Lesezugriff)	30 ms
Elektrische Eigenschaften	
Leistungsaufnahme	0,3 A bei 3,3 V (PCI Bus) 1 A bei 5 V (PCI Bus)
Umgebungsbedingungen	
Temperatur [2]	
Betrieb [3]	0 bis 60°C
Betrieb - 24 Stunden [4]	0 bis 60°C
Lagerung	-40 bis 70°C
Transport	-40 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit [5]	
Betrieb	5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration [6]	
Betrieb (dauerhaft)	5 bis 500 Hz: max. 0,125 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler
Betrieb (gelegentlich)	5 bis 500 Hz: max. 0,25 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung	5 bis 500 Hz: 5 g; Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung
Transport	5 bis 500 Hz: 5 g; Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung
Schock [6]	
Betrieb	max. 125 g, 2 ms; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung	max. 400 g, 2 ms; keine Beschädigung max. 500 g, 1 ms; keine Beschädigung max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung
Transport	max. 400 g, 2 ms; keine Beschädigung max. 500 g, 1 ms; keine Beschädigung max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung
Meereshöhe	
Betrieb	- 300 bis 3048 m
Lagerung	- 300 bis 12192 m
Mechanische Eigenschaften	
Montage	fix [7]
Gewicht	350 g
Herstellerinformation	
Hersteller	Seagate
Herstellerbezeichnung	ST9250315AS

Tabelle 112: 5ACPCI.RAIC-05 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben und das Gesamtgerät die entsprechende Kennzeichnung trägt.
2) Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshöhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle 305 Meter um 1°C verringert werden. Die Temperatur Zu- und Abnahme darf pro Stunde maximal 20°C betragen.
3) Standardbetrieb bedeutet 333 POH (Power On Hours) pro Monat.

4) 24 Stundenbetrieb bedeutet 732 POH (Power On Hours) pro Monat.
5) Luftfeuchtigkeitsgradient: Maximal 30% pro Stunde.
6) Bei Einsatz in vibrations- und schockgefährdeten Bereichen besteht im Betrieb die Möglichkeit von Performanceeinbrüchen (absinken der Übertragungsrate).
7) Montageweise auf PCI Einschub.

3.6.25.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm

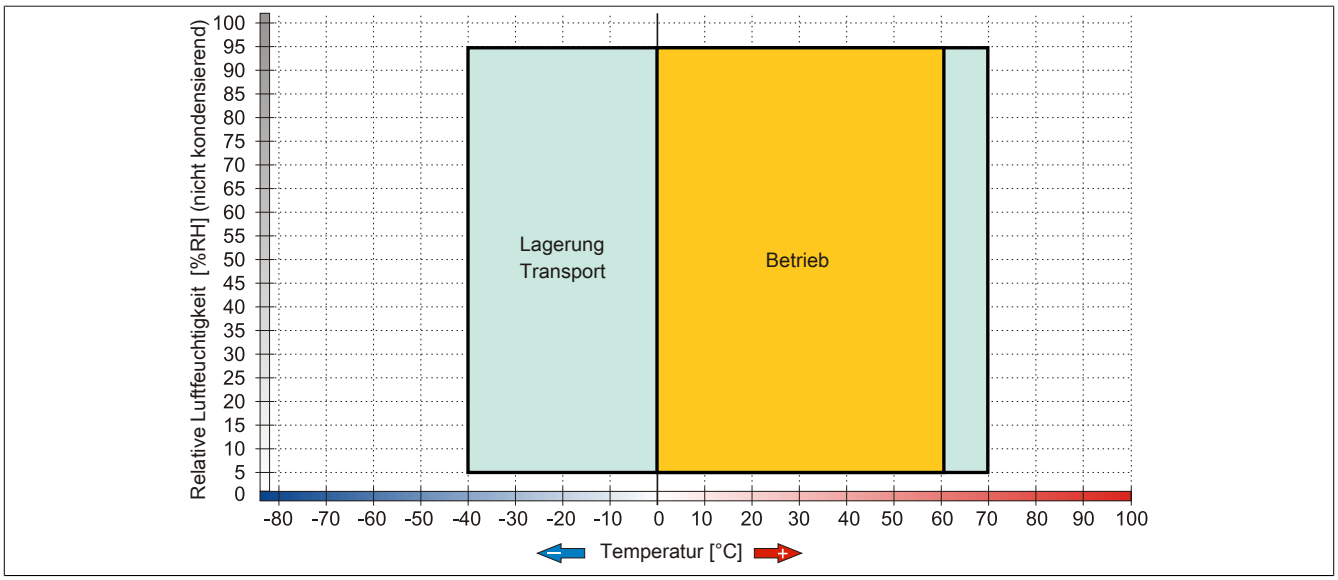


Abbildung 77: 5ACPCI.RAIC-05 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.6.25.5 Treibersupport

Für den Betrieb des PCI SATA RAID Controllers sind spezielle Treiber notwendig. Es stehen für die unterstützten und freigegebenen Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) Treiber zum Download bereit.

Ebenfalls auf der B&R Homepage ist die auf .NET basierende SATA Raid™ Serial ATA RAID Management Software zu finden.

Information:

Benötigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzuladen.

3.6.25.6 Konfiguration

Konfiguration eines SATA RAID Verbundes 3 "Inbetriebnahme", Abschnitt 7 "Konfiguration eines SATA RAID Verbundes" auf Seite 234.

3.6.25.7 Tauschen einer HDD

Eine Hard Disk kann im Fehlerfalle bei RAID1 (Spiegelung) Konfiguration einfach getauscht werden ohne das System neu installieren zu müssen. Dazu ist die Ersatz SATA HDD 250GB 5MMHDD.0250-00 als Ersatzteil für eine HDD verfügbar.

Eine Tauschanleitung dazu siehe "Tauschen einer PCI SATA RAID Hard Disk bei RAID 1" auf Seite 444.

3.6.26 5ACPCI.RAIC-06

3.6.26.1 Allgemeines

Dieser SATA RAID Controller unterstützt RAID Level 0 und 1 und ist in einen PCI Slot steckbar. Die verwendeten 500 GByte Hard Disks sind für den 24 Stunden Betrieb (24x7) spezifiziert.

- SATA RAID Controller
- RAID Level 0 (Aufteilung) und 1 (Spiegelung)
- 2x 500 GByte SATA Hard Disk (geeignet für 24 Stunden Betrieb)
- Benötigt nur 1 PCI Slot
- Übertragungsraten bis zu 150 MByte/s

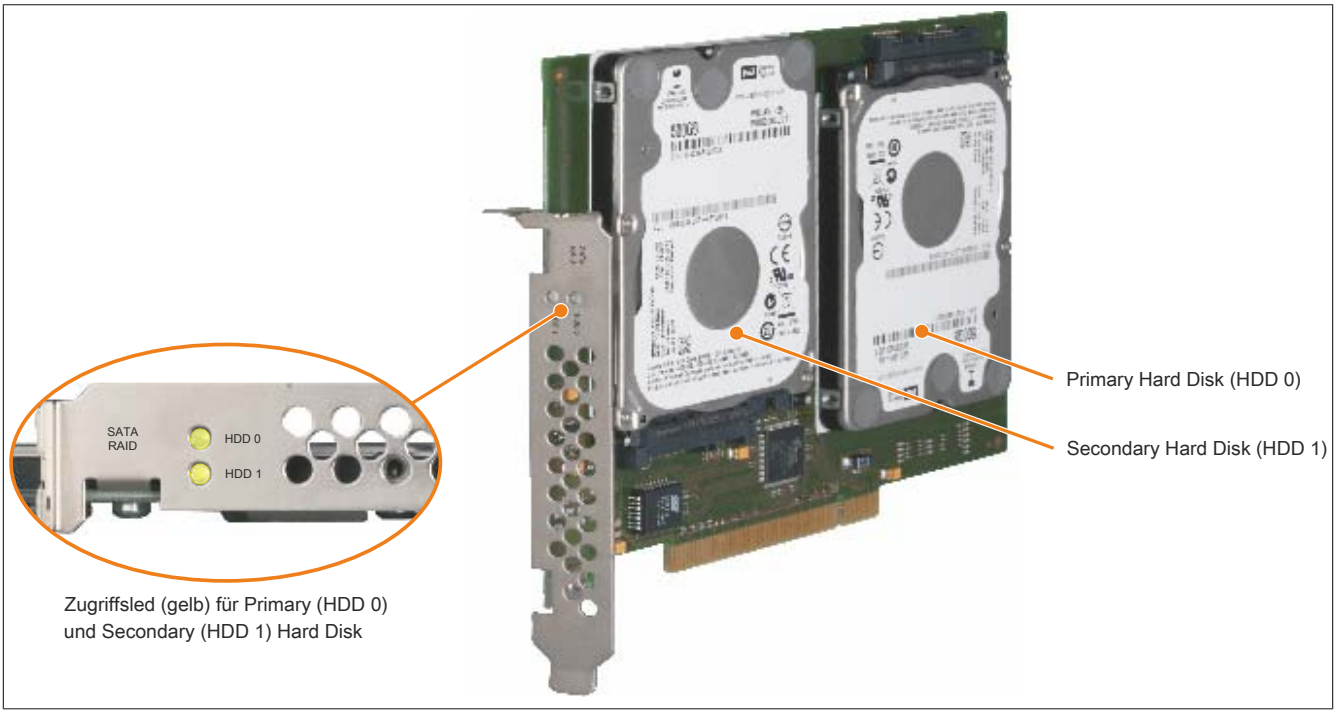


Abbildung 78: PCI SATA RAID Controller

Information:

Der PCI SATA RAID Controller kann nicht als Ersatz für eine „Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)“ eingesetzt werden. Wird das Betriebssystem nicht korrekt beendet, so wird dies beim nächsten Starten des Systems als Fehlerzustand (bei RAID 1 Verbund) erkannt und ein kompletter Rebuild durchgeführt. Dies nimmt in der Regel bei einer Speichergröße von 500 GByte ca. 500 Minuten (konfigurierbar) in Anspruch.

3.6.26.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	
5ACPCI.RAIC-06	PCI RAID System 2x 500 GByte - SATA	
	Optionales Zubehör	
	Laufwerke	
5MMHDD.0500-00	500 GByte Hard Disk - SATA	

Tabelle 113: 5ACPCI.RAIC-06 - Bestelldaten

3.6.26.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5ACPCI.RAIC-06
Allgemeines	
Kapazität	2x 500 GByte
Anzahl der Hard Disks	2
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
cULus HazLoc Class 1 Division 2	Ja [1]
GOST-R	Ja
Controller	
Typ	Sil 3512 SATA Link
Spezifikation	Serial ATA 1.0
Datenübertragungsrate	max. 1,5 GBit/s (150 MByte/s)
RAID Level	unterstützt RAID 0, 1
BIOS Extension ROM Bedarf	ca. 32 kByte
Hard Disk [2]	
Kapazität	500 GByte
Anzahl der Köpfe	2
Anzahl der Sektoren	976.773.168
Bytes pro Sektor	512 (logical) / 4096 (physical)
Cache	16 MByte
Drehzahl	5400 rpm ±0,2%
Hochlaufzeit	typ. 3,5 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)
Lebensdauer	5 Jahre
MTBF	1.000.000 POH [3]
S.M.A.R.T. Support	Ja
Schnittstelle	SATA
Zugriffszeit	5,5 ms
unterstützte Transfermodi	SATA II
Datentransferrate	
intern	max. 147 MByte/s
zum / vom Host	max. 150 MByte/s (SATA I), max. 300 MByte/s (SATA II)
Positionierzeit	
nominal (Lesezugriff)	11 ms
maximal (Lesezugriff)	21 ms
Umgebungsbedingungen	
Temperatur [4]	
Betrieb [5]	0 bis 60°C
Betrieb - 24 Stunden [6]	0 bis 60°C
Lagerung	-40 bis 70°C
Transport	-40 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit [7]	
Betrieb	8 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration [8]	
Betrieb (dauerhaft)	5 bis 500 Hz: 0,125 g; keine nicht behebbaren Fehler
Betrieb (gelegentlich)	5 bis 500 Hz: 0,25 g; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung	10 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Transport	10 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Schock	
Betrieb	200 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung	1000 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Transport	1000 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Meereshöhe	
Betrieb	-305 bis 3048 m
Lagerung	-305 bis 12192 m
Mechanische Eigenschaften	
Montage	fix [9]

Tabelle 114: 5ACPCI.RAIC-06 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5ACPCI.RAIC-06
Gewicht	350 g
Herstellerinformation	
Hersteller	Western Digital
Herstellerbezeichnung	WD5000LUCT

Tabelle 114: 5ACPCI.RAIC-06 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben und das Gesamtgerät die entsprechende Kennzeichnung trägt.
2) Technische Daten für eine Hard Disk.
3) Bei 8760 POH (Power On Hours) pro Jahr und 25°C Oberflächentemperatur.
4) Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshöhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle 305 Meter um 1°C verringert werden. Die Temperatur Zu- und Abnahme darf pro Stunde maximal 20°C betragen.
5) Standardbetrieb bedeutet 333 POH (Power On Hours) pro Monat.
6) 24 Stundenbetrieb bedeutet 732 POH (Power On Hours) pro Monat.
7) Luftfeuchtigkeitsgradient: Maximal 20% pro Stunde.
8) Bei Einsatz in vibrations- und schockgefährdeten Bereichen besteht im Betrieb die Möglichkeit von Performanceeinbrüchen (absinken der Übertragungsrate).
9) Montageweise auf PCI Einschub.

3.6.26.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm

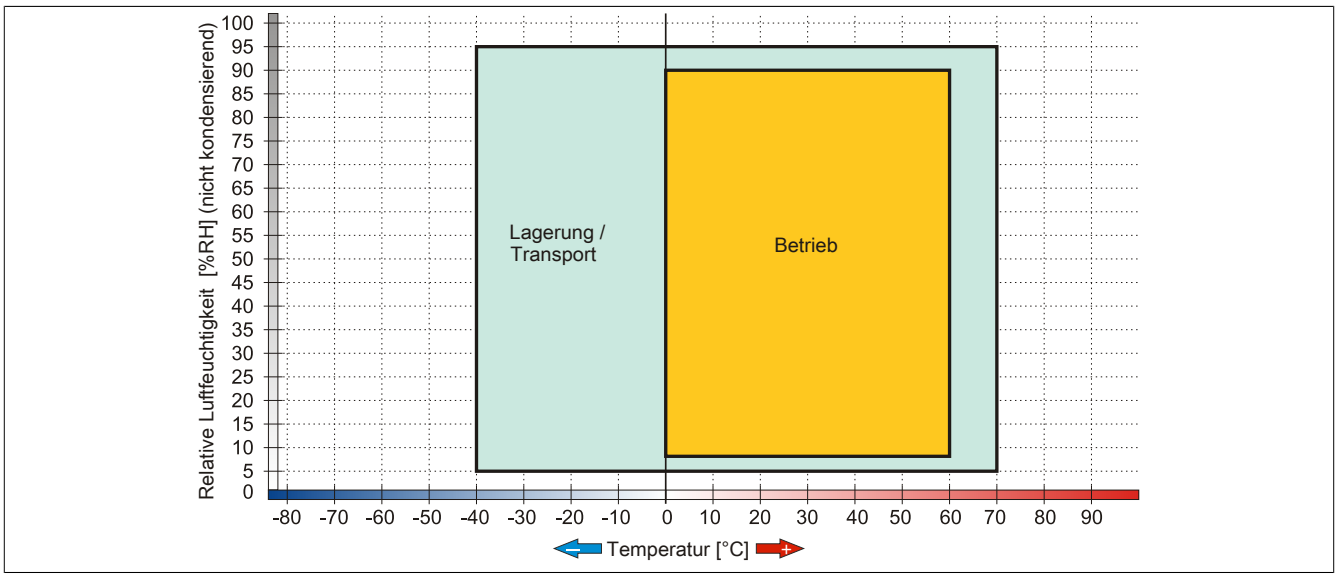


Abbildung 79: 5ACPCI.RAIC-06 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.6.26.5 Treibersupport

Für den Betrieb des PCI SATA RAID Controllers sind spezielle Treiber notwendig. Es stehen für die unterstützten und freigegebenen Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) Treiber zum Download bereit.

Ebenfalls auf der B&R Homepage ist die auf .NET basierende SATA Raid™ Serial ATA RAID Management Software zu finden.

Information:

Benötigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzuladen.

3.6.26.6 Konfiguration

Konfiguration eines SATA RAID Verbundes 3 "Inbetriebnahme", Abschnitt 7 "Konfiguration eines SATA RAID Verbundes" auf Seite 234.

3.6.26.7 Tauschen einer HDD

Eine Hard Disk kann im Fehlerfalle bei RAID1 (Spiegelung) Konfiguration einfach getauscht werden ohne das System neu installieren zu müssen. Dazu ist die Ersatz SATA HDD 500 GByte 5MMHDD.0500-00 als Ersatzteil für eine Hard Disk verfügbar.

Eine Tauschanleitung dazu siehe "Tauschen einer PCI SATA RAID Hard Disk bei RAID 1" auf Seite 444.

3.6.27 5MMHDD.0250-00

3.6.27.1 Allgemeines

Diese 250 GByte Hard Disk kann als Ersatzteil oder als Zubehörteil verwendet werden.

- 250 GByte Hard Disk
- Ersatz Hard Disk für die Hard Disk 5AC801.HDDI-03 oder für den RAID Controller 5ACPCI.RAIC-05
- Zubehör für APC510 (optionale Hard Disk für I/O-Board)
- für 24 Stunden Betrieb spezifiziert
- S.M.A.R.T. Support

3.6.27.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	
5MMHDD.0250-00	250 GByte SATA Hard Disk Ersatzteil für 5AC801.HDDI-03 und 5ACPCI.RAIC-05; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	

Tabelle 115: 5MMHDD.0250-00 - Bestelldaten

3.6.27.3 Technische Daten

Vorsicht!

Ein plötzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust führen! In sehr seltenen Fällen kann es darüber hinaus zu einer Beschädigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschädigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwendung einer USV empfohlen.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für diese Einzelkomponente alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5MMHDD.0250-00
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
cULus HazLoc Class 1 Division 2	Ja [1]
GOST-R	Ja
Hard Disk	
Kapazität	250 GByte
Anzahl der Köpfe	1
Anzahl der Sektoren	488.397.168
Bytes pro Sektor	512
Cache	8 MByte
Drehzahl	5400 rpm ±0,2%
Hochlaufzeit	typ. 3,6 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)
MTBF	550.000 POH [2]
S.M.A.R.T. Support	Ja
Schnittstelle	SATA
Zugriffszeit	5,56 ms
unterstützte Transfermodi	SATA 1.0, Serial ATA Revision 2.6 PIO Modus 0-4, Multiword DMA Modus 0-2, UDMA Modus 0-6
Datentransferrate	
intern	max. 1175 MBit/s
zum / vom Host	max. 150 MByte/s (SATA I), max. 300 MByte/s (SATA II)

Tabelle 116: 5MMHDD.0250-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5MMHDD.0250-00
Positionierzeit	
minimal (Spur zu Spur)	1 ms
nominal (Lesezugriff)	14 ms
maximal (Lesezugriff)	30 ms
Umgebungsbedingungen	
Temperatur [3]	
Betrieb [4]	0 bis 60°C
Betrieb - 24 Stunden [5]	0 bis 60°C
Lagerung	-40 bis 70°C
Transport	-40 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit [6]	
Betrieb	5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration	
Betrieb	5 bis 500 Hz: 0,5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung	5 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Transport	5 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Schock	
Betrieb	350 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung	800 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler 1000 g und 1 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler 600 g und 0,5 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Transport	800 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler 1000 g und 1 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler 600 g und 0,5 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Meereshöhe	
Betrieb	-300 bis 3048 m
Lagerung	-300 bis 12192 m
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen	
Breite	9,5 mm
Höhe	69 mm
Tiefe	100 mm
Gewicht	100 g
Herstellerinformation	
Hersteller	Seagate
Herstellerbezeichnung	ST9250315AS

Tabelle 116: 5MMHDD.0250-00 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben und das Gesamtgerät die entsprechende Kennzeichnung trägt.
2) Bei 8760 POH (Power On Hours) pro Jahr und 25°C Oberflächentemperatur.
3) Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshöhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle 305 Meter um 1°C verringert werden. Die Temperatur Zu- und Abnahme darf pro Stunde maximal 20°C betragen.
4) Standardbetrieb bedeutet 333 POH (Power On Hours) pro Monat.
5) 24 Stundenbetrieb bedeutet 732 POH (Power On Hours) pro Monat.
6) Luftfeuchtigkeitsgradient: Maximal 30% pro Stunde.

3.6.27.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm

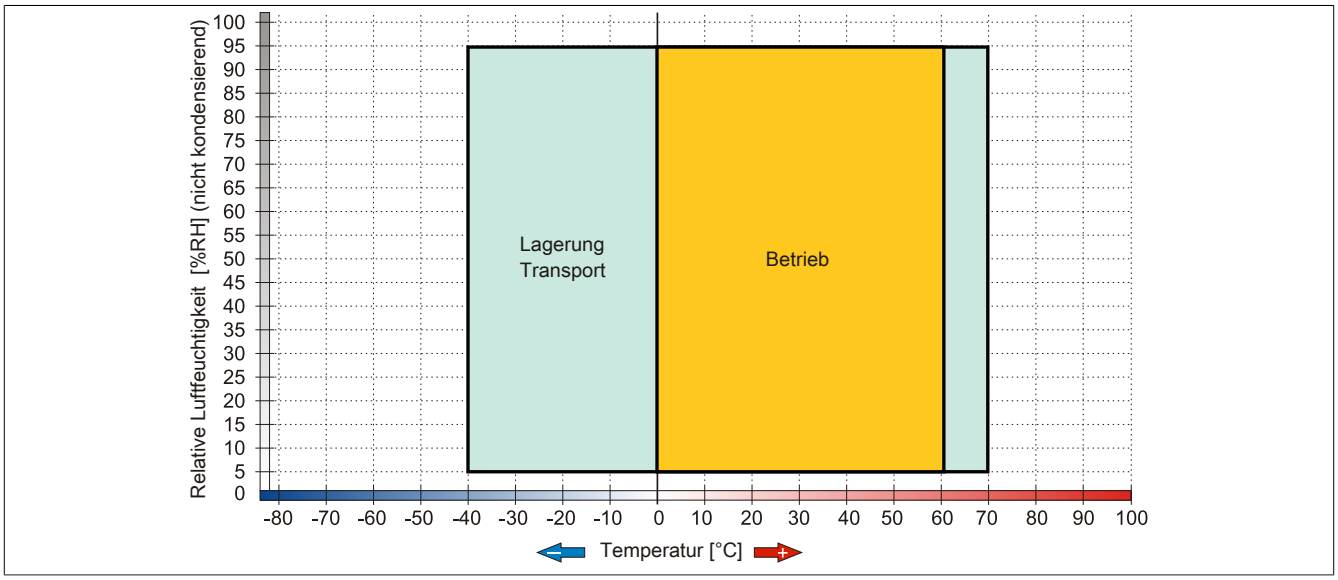


Abbildung 80: 5MMHDD.0250-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.6.28 5MMHDD.0500-00

3.6.28.1 Allgemeines

Diese 500 GByte Hard Disk kann als Ersatzteil oder als Zubehörteil verwendet werden.

- 500 GByte Hard Disk
- Ersatz Hard Disk für die Hard Disk 5AC801.HDDI-04 bzw. 5AC901.CHDD-01 oder für den RAID Controller 5ACPCI.RAIC-06
- Zubehör für APC510 (optionale Hard Disk für I/O-Board)
- für 24 Stunden Betrieb spezifiziert
- S.M.A.R.T. Support

3.6.28.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	
5MMHDD.0500-00	500 GByte Hard Disk - SATA	

Tabelle 117: 5MMHDD.0500-00 - Bestelldaten

3.6.28.3 Technische Daten

Vorsicht!

Ein plötzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust führen! In sehr seltenen Fällen kann es darüber hinaus zu einer Beschädigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschädigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwendung einer USV empfohlen.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5MMHDD.0500-00
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
cULus HazLoc Class 1 Division 2	Ja [1]
GOST-R	Ja
Hard Disk	
Kapazität	500 GByte
Anzahl der Köpfe	2
Anzahl der Sektoren	976.773.168
Bytes pro Sektor	512 (logical) / 4096 (physical)
Cache	16 MByte
Drehzahl	5400 rpm ±0,2%
Hochlaufzeit	typ. 3,5 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)
Lebensdauer	5 Jahre
MTBF	1.000.000 POH [2]
S.M.A.R.T. Support	Ja
Schnittstelle	SATA
Zugriffszeit	5,5 ms

Tabelle 118: 5MMHDD.0500-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5MMHDD.0500-00
unterstützte Transfermodi	SATA II
Datentransferrate	
intern	max. 147 MByte/s
zum / vom Host	max. 150 MByte/s (SATA I), max. 300 MByte/s (SATA II)
Positionierzeit	
nominal (Lesezugriff)	11 ms
maximal (Lesezugriff)	21 ms
Umgebungsbedingungen	
Temperatur [3]	
Betrieb [4]	0 bis 60°C
Betrieb - 24 Stunden [5]	0 bis 60°C
Lagerung	-40 bis 70°C
Transport	-40 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit [6]	
Betrieb	8 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration	
Betrieb (dauerhaft)	5 bis 500 Hz: 0,25 g; keine nicht behebbaren Fehler
Betrieb (gelegentlich)	5 bis 500 Hz: 0,5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung	10 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Transport	10 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Schock	
Betrieb	400 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung	1000 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Transport	1000 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Meereshöhe	
Betrieb	-305 bis 3048 m
Lagerung	-305 bis 12192 m
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen	
Breite	7 mm
Höhe	69 mm
Tiefe	100 mm
Gewicht	100 g
Herstellerinformation	
Hersteller	Western Digital
Herstellerbezeichnung	WD5000LUCT

Tabelle 118: 5MMHDD.0500-00 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben und das Gesamtgerät die entsprechende Kennzeichnung trägt.
2) Bei 8760 POH (Power On Hours) pro Jahr und 25°C Oberflächentemperatur.
3) Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshöhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle 305 Meter um 1°C verringert werden. Die Temperatur Zu- und Abnahme darf pro Stunde maximal 20°C betragen.
4) Standardbetrieb bedeutet 333 POH (Power On Hours) pro Monat.
5) 24 Stundenbetrieb bedeutet 732 POH (Power On Hours) pro Monat.
6) Luftfeuchtigkeitsgradient: Maximal 20% pro Stunde.

3.6.28.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm

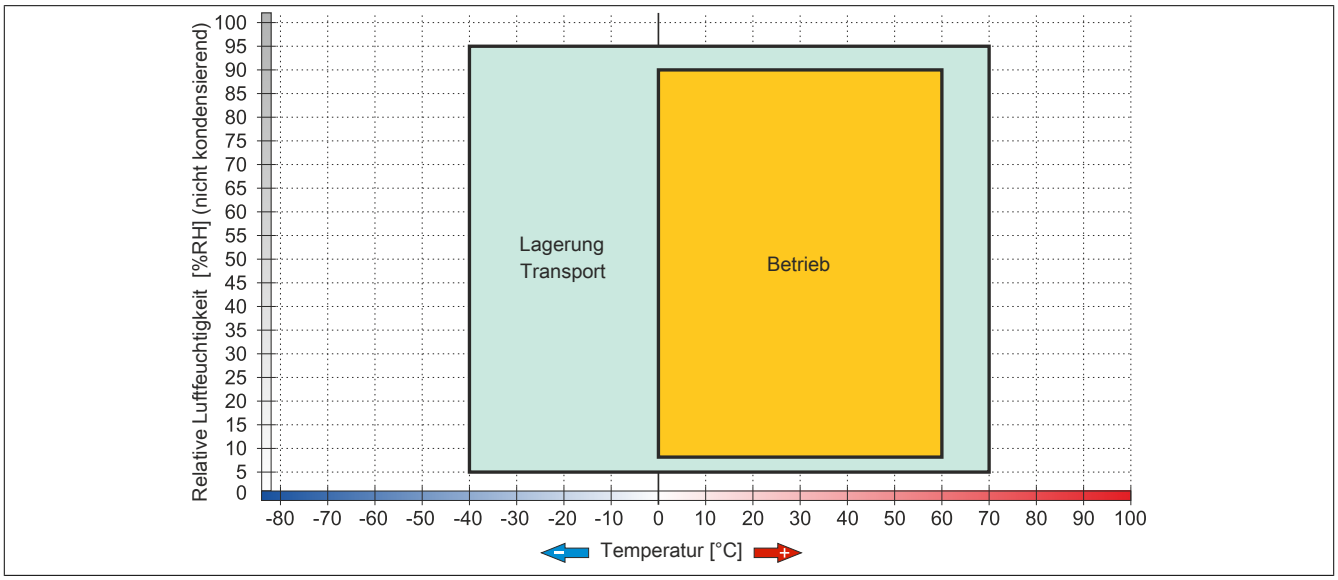


Abbildung 81: 5MMHDD.0500-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.7 Lüfter Kit

> **Information:**
>
> **Lüfter sind notwendig wenn Komponenten eingesetzt werden, die eine eingeschränkte Umgebungstemperatur aufweisen, z.B. RAID Controller, DVD Combo, PCI Karten.**
>
> **Die Lüfter bzw. Staubfilter stellen ein Verschleißteil dar und müssen in angemessenem Abstand kontrolliert und bei nicht ausreichender Funktion (z. B. durch Verschmutzung) gereinigt oder ausgetauscht werden.**

Für Informationen zu den Einschaltgrenzen des Lüfters siehe Anhang A.

3.7.1 5PC810.FA01-00

3.7.1.1 Allgemeines

Dieses Lüfter Kit kann optional bei Systemeinheiten mit 1 Card Slot eingebaut werden.

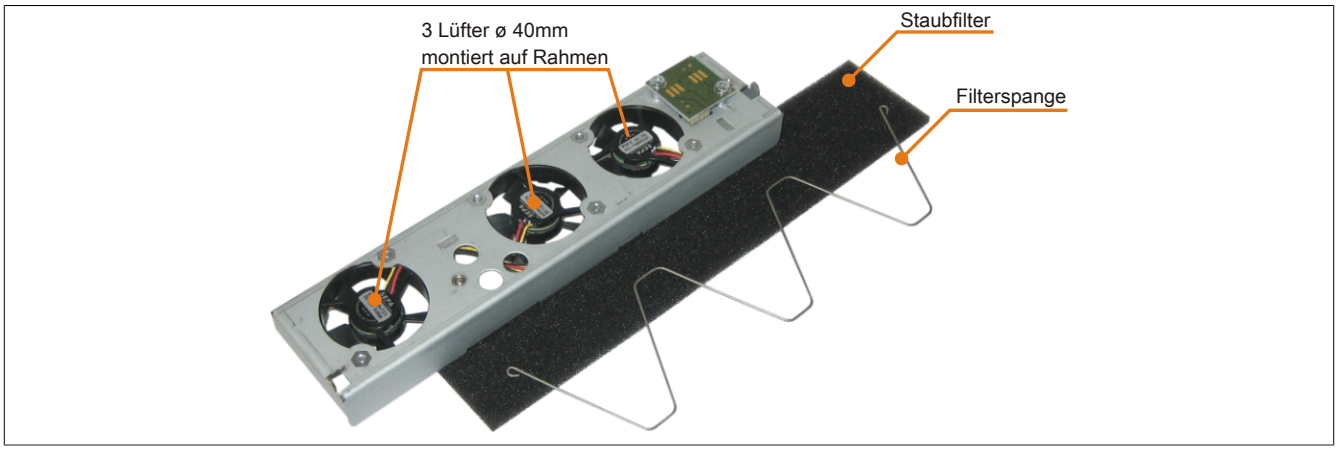


Abbildung 82: 5PC810.FA01-00 - Lüfter Kit

3.7.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Lüfter Kit	
5PC810.FA01-00	APC810 Lüfterkit für Systemeinheit 5PC810.SX01-00.	
	Optionales Zubehör	
	Zubehör	
5AC801.FA01-00	APC810 Ersatz Lüfterfilter für 5PC810.SX01-00; 5 Stk.	

Tabelle 119: 5PC810.FA01-00 - Bestelldaten

3.7.1.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5PC810.FA01-00
Allgemeines	
Anzahl der Lüfter	3
Drehzahl	max. 6100 rpm
Geräuschpegel	21 dB
Lebensdauer	29000 Stunden bei 70°C 95000 Stunden bei 20°C
Typ	doppelt kugelgelagert
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus HazLoc Class 1 Division 2	Ja [1]
ATEX Zone 22	Ja [1]
GOST-R	Ja
GL	Ja [2]

Tabelle 120: 5PC810.FA01-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5PC810.FA01-00
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen	
Lüfter	
Breite	40 mm
Höhe	40 mm
Tiefe	10 mm

Tabelle 120: 5PC810.FA01-00 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben und das Gesamtgerät die entsprechende Kennzeichnung trägt.
2) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

Informationen zum Einbau bzw. Tauschen des Lüfter Kits siehe Kapitel "Wartung / Instandhaltung", Abschnitt 6 "Lüfter Kit Einbau / Tausch" auf Seite 425.

3.7.2 5PC810.FA02-01

3.7.2.1 Allgemeines

Diese Lüfter Kits können optional bei Systemeinheiten mit 2 Card Slots eingebaut werden.

Das Lüfter Kit 5PC810.5A02-01 unterscheidet sich vom 5PC810.FA02-00 nur insofern, als zusätzliche Führungselemente wie bei den Lüfter Kits der 1 und 5 Slot Variante eingearbeitet sind. Somit wird der Lüfter Kit Einbau bzw. Tausch erleichtert. Für die Systemeinheit 5PC810.SX02- 00 kann ab der Revision D0 nur noch das Lüfer Kit 5PC810.5A02-01 eingebaut werden.

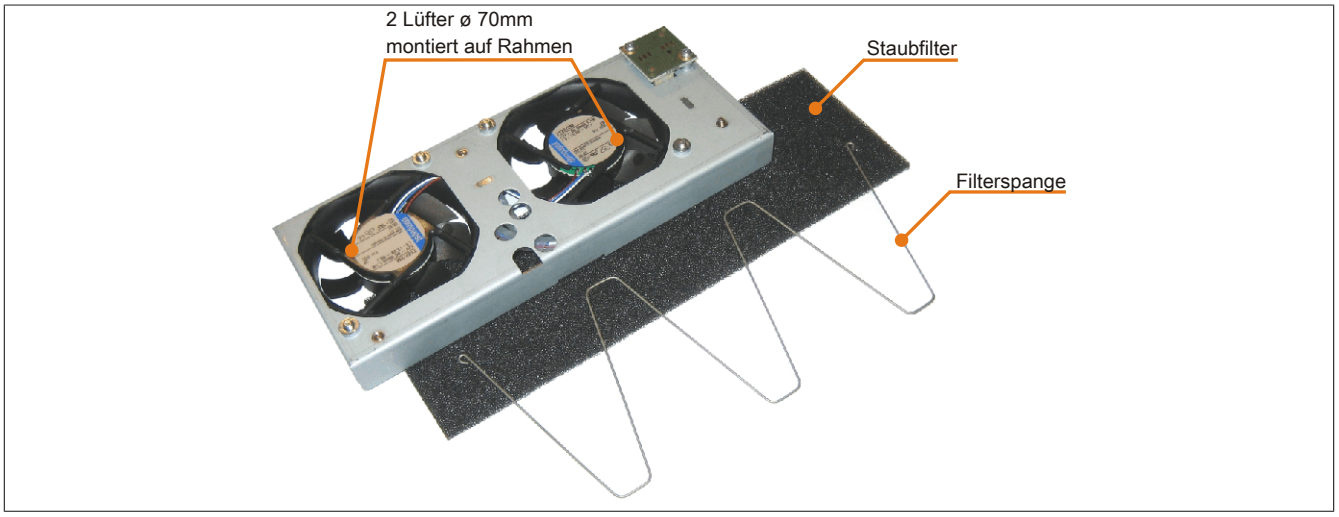


Abbildung 83: 5PC810.FA02-00 und 5PC810.FA02-01 - Lüfter Kit

3.7.2.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Lüfter Kit	
5PC810.FA02-00	APC810 Lüfterkit für Systemeinheit 5PC810.SX02-00	
5PC810.FA02-01	APC810 Lüfterkit für Systemeinheit 5PC810.SX02-00 ab Revision D0.	
	Optionales Zubehör	
	Zubehör	
5AC801.FA02-00	APC810 Ersatz Lüfterfilter für 5PC810.SX02-00; 5 Stk.	

Tabelle 121: 5PC810.FA02-00, 5PC810.FA02-01 - Bestelldaten

3.7.2.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5PC810.FA02-00	5PC810.FA02-01
Allgemeines		
Anzahl der Lüfter	2	
Drehzahl	max. 4300 rpm ±12,5%	
Geräuschpegel	32 dB	
Lebensdauer	60000 Stunden bei 40°C	
Typ	doppelt kugelgelagert	
Zertifizierungen		
CE	Ja	
cULus HazLoc Class 1 Division 2	-	Ja [1]
ATEX Zone 22	-	Ja [1]
GOST-R	-	Ja
GL	-	Ja [2]
Mechanische Eigenschaften		
Abmessungen		
Lüfter		
Breite	70 mm	
Höhe	70 mm	
Tiefe	15 mm	

Tabelle 122: 5PC810.FA02-00, 5PC810.FA02-01 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben und das Gesamtgerät die entsprechende Kennzeichnung trägt.
2) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

Informationen zum Einbau bzw. Tauschen des Lüfter Kits siehe Kapitel "Wartung / Instandhaltung", Abschnitt 6 "Lüfter Kit Einbau / Tausch" auf Seite 425.

3.7.3 5PC810.FA03-00

3.7.3.1 Allgemeines

Dieses Lüfter Kit kann optional bei Systemeinheiten mit 3 Card Slots eingebaut werden.

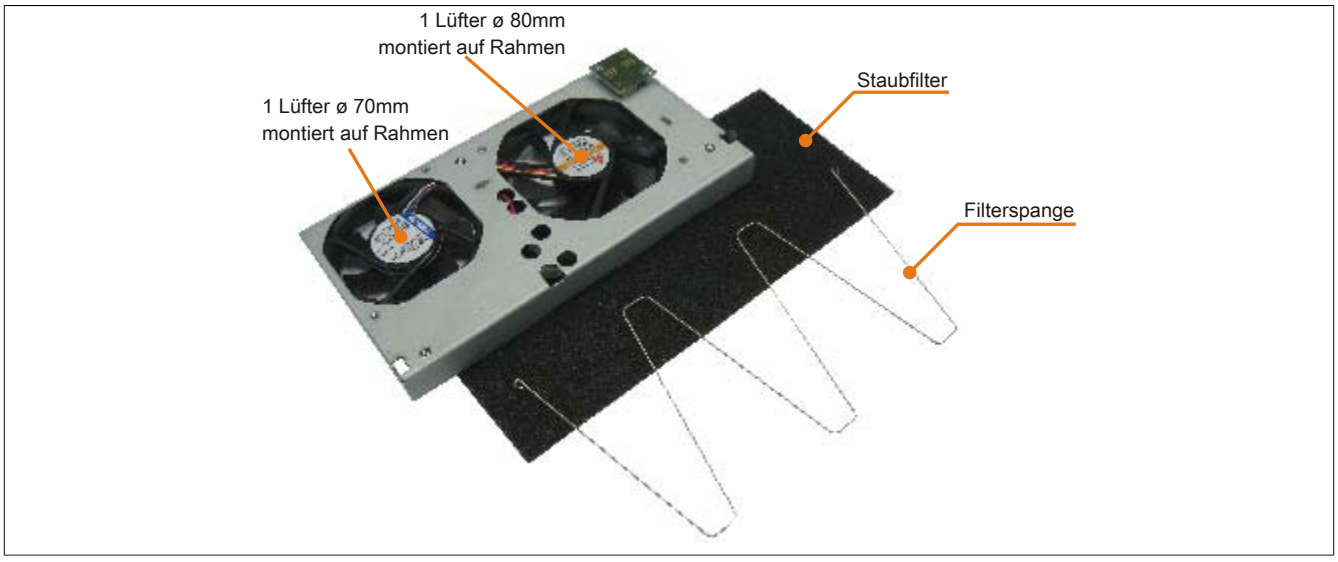


Abbildung 84: 5PC810.FA03-00 - Lüfter Kit

3.7.3.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Lüfter Kit	
5PC810.FA03-00	APC810 Lüfterkit für Systemeinheit 5PC810.SX03-00.	
	Optionales Zubehör	
	Zubehör	
5AC801.FA03-00	APC810 Ersatz Lüfterfilter für 5PC810.SX03-00; 5 Stk.	

Tabelle 123: 5PC810.FA03-00 - Bestelldaten

3.7.3.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5PC810.FA03-00
Allgemeines	
Anzahl der Lüfter	2
Drehzahl	Lüfter 1: max. 4300 rpm ±12,5% Lüfter 2: max. 3200 rpm ±10%
Geräuschpegel	Lüfter 1: 32 dB Lüfter 2: 33 dB
Lebensdauer	Lüfter 1: 60000 Stunden bei 40°C Lüfter 2: 75000 Stunden bei 40°C
Typ	doppelt kugelgelagert
Zertifizierungen	
CE	Ja
GOST-R	Ja
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen	
Lüfter	
Breite	Lüfter 1: 70 mm Lüfter 2: 80 mm
Höhe	Lüfter 1: 70 mm Lüfter 2: 80 mm
Tiefe	Lüfter 1: 15 mm Lüfter 2: 15 mm

Tabelle 124: 5PC810.FA03-00 - Technische Daten

Informationen zum Einbau bzw. Tauschen des Lüfter Kits siehe Kapitel "Wartung / Instandhaltung", Abschnitt 6 "Lüfter Kit Einbau / Tausch" auf Seite 425.

3.7.4 5PC810.FA05-00

3.7.4.1 Allgemeines

Dieses Lüfter Kit kann optional bei Systemeinheiten mit 5 Card Slots eingebaut werden.

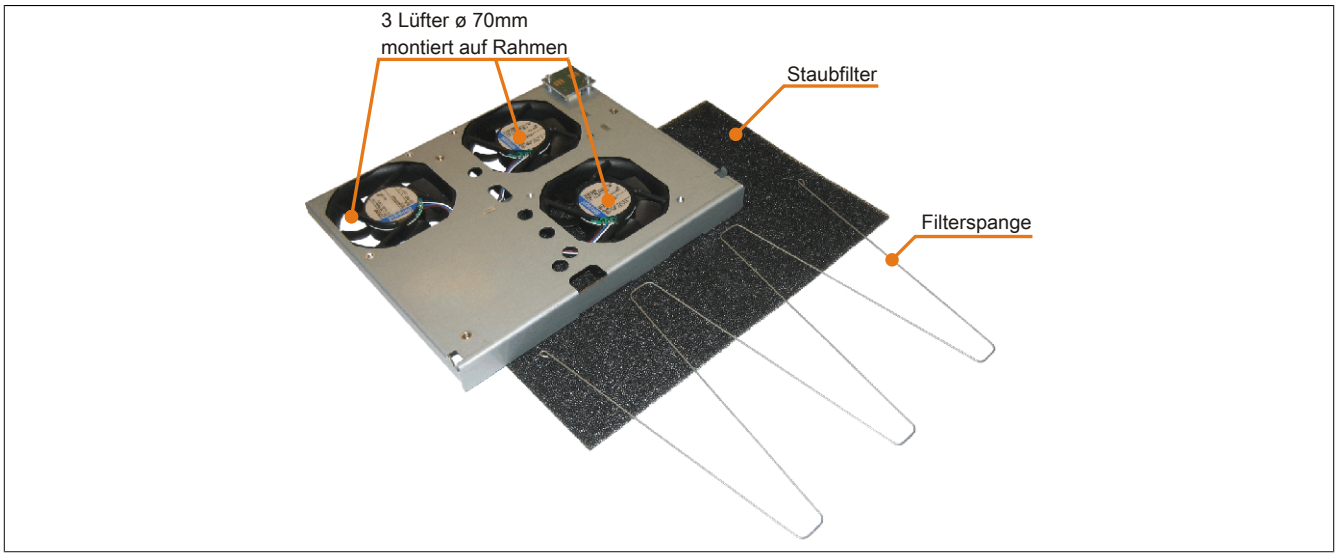


Abbildung 85: 5PC810.FA05-00 - Lüfter Kit

3.7.4.2 Bestelldaten

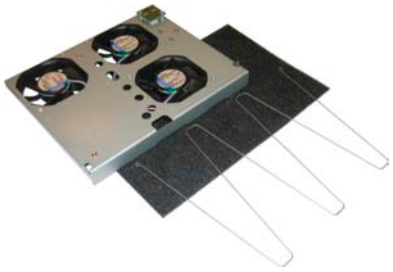
Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Lüfter Kit	
5PC810.FA05-00	APC810 Lüfterkit für Systemeinheit 5PC810.SX05-00.	
	Optionales Zubehör	
	Zubehör	
5AC801.FA05-00	APC810 Ersatz Lüfterfilter für 5PC810.SX05-00; 5 Stk.	

Tabelle 125: 5PC810.FA05-00 - Bestelldaten

3.7.4.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5PC810.FA05-00
Allgemeines	
Anzahl der Lüfter	3
Drehzahl	max. 4300 rpm ±10%
Geräuschpegel	32 dB
Lebensdauer	60000 Stunden bei 40°C
Typ	doppelt kugelgelagert
Zertifizierungen	
CE	Ja
GOST-R	Ja
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen	
Lüfter	
Breite	70 mm
Höhe	70 mm
Tiefe	15 mm

Tabelle 126: 5PC810.FA05-00 - Technische Daten

Informationen zum Einbau bzw. Tauschen des Lüfter Kits siehe Kapitel "Wartung / Instandhaltung", Abschnitt 6 "Lüfter Kit Einbau / Tausch" auf Seite 425.

3.8 AP Link Steckkarten

AP Link Steckkarten können bei den APC810 Systemeinheiten 5PC810.SX02-00, 5PC810.SX03-00 und 5PC810.SX05-00 montiert werden.

3.8.1 5AC801.SDL0-00

3.8.1.1 Allgemeines

Mit einer AP Link Grafikadapter Steckkarte ist es möglich einen 2-ten Grafikstrang zu realisieren. Bei diesem stehen die Signale DVI und SDL zur Verfügung. RGB Signale werden nicht unterstützt. Details sind den Technische Daten des verwendeten CPU Boards zu entnehmen.

Information:

Die Montage des AP Link SDL Transmitters ist nur in Verbindung mit den Systemeinheiten 5PC810.SX02-00, 5PC810.SX03-00 und 5PC810.SX05-00 möglich.

Informationen zum Einbau des AP Link SDL Transmitters siehe "AP Link Montage" auf Seite 443.

Information:

Das hot-plugging der Anzeigegeräte am AP Link SDL Transmitter wird nicht unterstützt.

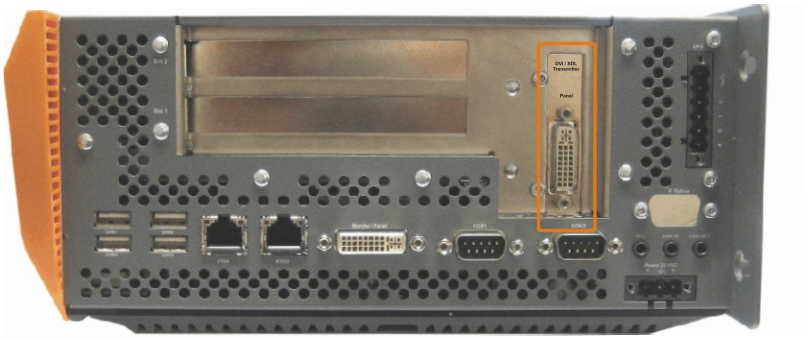


Abbildung 86: 5PC810.SX02-00 - Montagebeispiel mit der Systemeinheit

3.8.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Automation Panel Link Steckkarten	
5AC801.SDL0-00	Smart Display Link/DVI-D Transmitter	

Tabelle 127: 5AC801.SDL0-00 - Bestelldaten

3.8.1.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5AC801.SDL0-00
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
GOST-R	Ja
GL	Ja [1)]

Tabelle 128: 5AC801.SDL0-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5AC801.SDL0-00
Schnittstellen	
Panel/Monitor-Schnittstelle	
Ausführung	DVI-D Buchse
Typ	SDL/DVI

Tabelle 128: 5AC801.SDL0-00 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

3.8.1.4 Pinbelegung

Pin	Belegung	Beschreibung	Pin	Belegung	Beschreibung
1	TMDS Data 2-	DVI Lane 2 (negative)	16	HPD	Hot plug detect
2	TMDS Data 2+	DVI Lane 2 (positive)	17	TMDS Data 0-	DVI Lane 0 (negative)
3	TMDS Data 2/4 SHIELD	Shield of Data pair 2 and 4	18	TMDS Data 0+	DVI Lane 0 (positive)
4	SDL-	SDL Lane (negative)	19	TMDS Data 0/ XUSB1 SHIELD	Shield of Data pair 0 and USB1
5	SDL+	SDL Lane (positive)	20	XUSB1-	USB Lane 1 (negative)
6	DDC Clock	DDC based control signal (clock)	21	XUSB1+	USB Lane 1 (positive)
7	DDC Data	DDC based control signal (data)	22	TMDS Clock Shield	Shield of Clock pair
8	n.c.	not connected	23	TMDS Clock+	DVI Clock (positive)
9	TMDS Data 1-	DVI Lane 1 (negative)	24	TMDS Clock -	DVI Clock (negative)
10	TMDS DATA 1+	DVI Lane 1 (negative) HDMI Clock (positive)	C1	n.c.	not connected
11	TMDS DATA 1/ XUSB0 SHIELD	Shield of Data pair 1 and USB0	C2	n.c.	not connected
12	XUSB0-	USB Lane 0 (negative)	C3	n.c.	not connected
13	XUSB0+	USB Lane 0 (positive)	C4	n.c.	not connected
14	+5 V Power[1)]	+5V Power Supply	C5	n.c.	not connected
15	Ground (return for +5 V, HSync and VSync)	Ground			

DVI, 24-polig, female

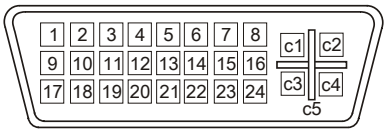


Tabelle 129: Pinbelegung DVI-Schnittstelle

1) Wird intern durch eine Multifuse abgesichert.

3.8.1.5 Kabellängen und Auflösungen bei SDL-Übertragung

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen Segmentlänge und max. Auflösung in Abhängigkeit des SDL-Kabels:

SDL-Kabel	Auflösung						
Segmentlänge [m]	VGA 640 x 480	SVGA 800 x 600	XGA 1024 x 768	HD 1366 x 768	SXGA 1280 x 1024	UXGA 1600 x 1200	FHD 1920 x 1080
0,8	5CASDL.0008-00	5CASDL.0008-00	5CASDL.0008-00	5CASDL.0008-00	5CASDL.0008-00	5CASDL.0008-00	5CASDL.0008-00
1,8	5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-03
5	5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-03
10	5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-03
15	5CASDL.0150-00 5CASDL.0150-01 5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-00 5CASDL.0150-01 5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-00 5CASDL.0150-01 5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-00 5CASDL.0150-01 5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-00 5CASDL.0150-01 5CASDL.0150-03	- - -	- - 5CASDL.0150-03
20	5CASDL.0200-00 5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-00 5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-00 5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-00 5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-00 5CASDL.0200-03	- -	- 5CASDL.0200-03
25	5CASDL.0250-00 5CASDL.0250-03	5CASDL.0250-00 5CASDL.0250-03	5CASDL.0250-00 5CASDL.0250-03	5CASDL.0250-00 5CASDL.0250-03	- -	- -	- -
30	5CASDL.0300-00 5CASDL.0300-03	5CASDL.0300-00 5CASDL.0300-03	- 5CASDL.0300-13	- 5CASDL.0300-13	- 5CASDL.0300-13	- -	- 5CASDL.0300-13
40	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	-	5CASDL.0400-13

Tabelle 130: Kabellängen und Auflösungen bei SDL-Übertragung

3.8.1.6 Kabellängen und Auflösungen bei DVI-Übertragung

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen Segmentlänge und max. Auflösung in Abhängigkeit des DVI-Kabels:

DVI-Kabel	Auflösung						
Segmentlänge [m]	VGA 640 x 480	SVGA 800 x 600	XGA 1024 x 768	HD 1366 x 768	SXGA 1280 x 1024	UXGA 1600 x 1200	FHD 1920 x 1080
1,8	5CADVI.0018-00	5CADVI.0018-00	5CADVI.0018-00	5CADVI.0018-00	5CADVI.0018-00	5CADVI.0018-00	5CADVI.0018-00
5	5CADVI.0050-00	5CADVI.0050-00	5CADVI.0050-00	5CADVI.0050-00	5CADVI.0050-00	5CADVI.0050-00	5CADVI.0050-00

Tabelle 131: Kabellängen und Auflösungen bei DVI-Übertragung

Die maximale Kabellänge bei der DVI-Übertragung ist aufgrund der USB-Spezifikation auf 5 m begrenzt.

3.8.2 5AC801.RDYR-00

3.8.2.1 Allgemeines

Da das Ready Relais 5AC801.RDYR-00 die Relaiskontakte schaltet sobald der B&R Automation PC 810 gebootet hat und intern mit allen Spannungen versorgt ist, können an das Relais zusätzliche Geräte angeschlossen werden, die somit ebenfalls eingeschaltet werden.

Das Ready Relais 5AC801.RDYR-00 ist nur für den Einbau in einem AP Link Slot bestimmt.

Information:

Die Montage des Ready Relais ist nur in Verbindung mit den Systemeinheiten 5PC810.SX02-00, 5PC810.SX03-00 und 5PC810.SX05-00 möglich.

Informationen zum Einbau des Ready Relais siehe "AP Link Montage" auf Seite 443.

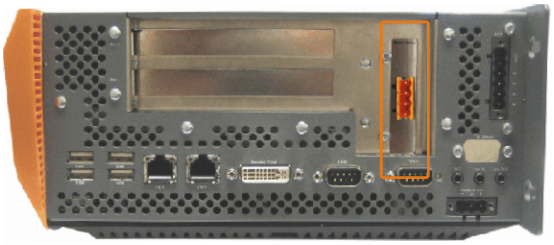


Abbildung 87: Montagebeispiel mit der Systemeinheit 5PC810.SX02-00

3.8.2.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Automation Panel Link Steckkarten	
5AC801.RDYR-00	Ready Relais für APC810	
	Erforderliches Zubehör	
	Feldklemmen	
0TB704.9	Zubehör Feldklemme, 4-polig, Schraubklemme 2,5 mm²	
0TB704.91	Zubehör Feldklemme, 4-polig, Federzugklemme 2,5 mm²	

Tabelle 132: 5AC801.RDYR-00 - Bestelldaten

3.8.2.3 Pinbelegung

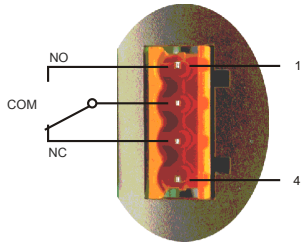
Ready Relais Pinbelegung		
Schließer und Öffner, max. 30 VDC, max. 10 A		Buchse, 4-polig, male
Pin	**Belegung**	
1	Schließer (NO)	
2	Wechselkontakt (COM)	
3	Öffner (NC)	
4	n.c.	

Tabelle 133: 5AC801.RDYR-00 - Pinbelegung Ready Relais

3.9 Ready Relais

3.9.1 5AC801.RDYR-01

3.9.2 Allgemeines

Da das Ready Relais 5AC801.RDYR-01 die Relaiskontakte schaltet sobald der B&R Automation PC 810 gebootet hat und intern mit allen Spannungen versorgt ist, können an das Relais zusätzliche Geräte angeschlossen werden, die somit ebenfalls eingeschaltet werden.

Das Ready Relais 5AC801.RDYR-01 kann nur in den Add-on USV Steckplatz des APC810 gesteckt werden, hierzu muss dieser Steckplatz noch frei verfügbar sein.

In dem Beipackzettel ist beschrieben, wie die Aufklebestreifen an den Automation PC 810 anzubringen sind.

Information:

Informationen zur Montage des Ready Relais siehe Kapitel 7 "Wartung / Instandhaltung" Abschnitt 13 "Montage des Ready Relais /2 am Add-on USV Steckplatz" auf Seite 447.

3.9.3 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Zubehör	
5AC801.RDYR-01	Ready Relais für APC810 für die Montage an einem Add-on USV Steckplatz	

Tabelle 134: 5AC801.RDYR-01 - Bestelldaten

3.9.4 Pinbelegung

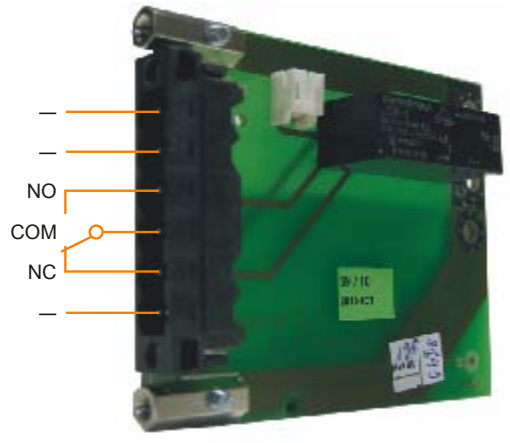
Pin	Belegung	Beschreibung	Abbildung
1	-	nicht verbunden	
2	-	nicht verbunden	
3	NO	normally open (Schließer)	
4	COM	Wechselkontakt	
5	NC	normally closed (Öffner)	
6	-	nicht verbunden	

Tabelle 135: 5AC801.RDYR-01 - Pinbelegung

3.9.5 Lieferumfang

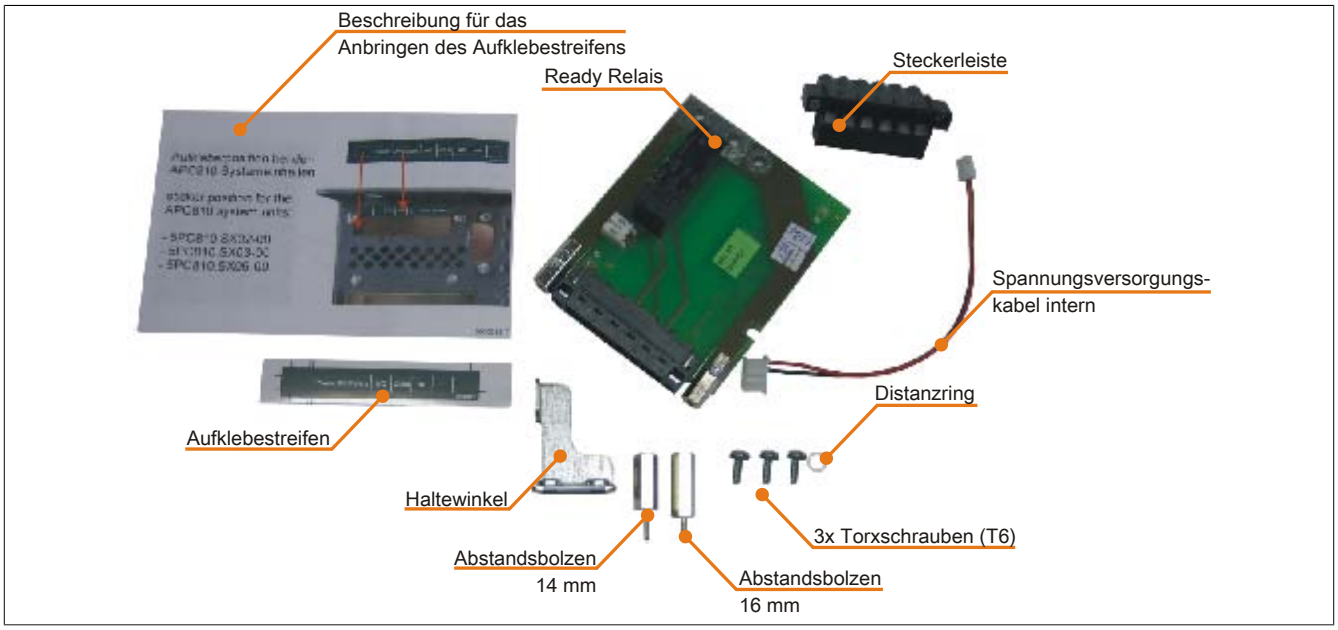


Abbildung 88: 5AC801.RDYR-01 - Lieferumfang

3.10 Schnittstellenoptionen (IF Option)

3.10.1 Allgemeines

Es kann eine zusätzliche Schnittstelle (CAN oder kombinierte RS232/422/485) in den IF Option Steckplatz des APC810 montiert werden.

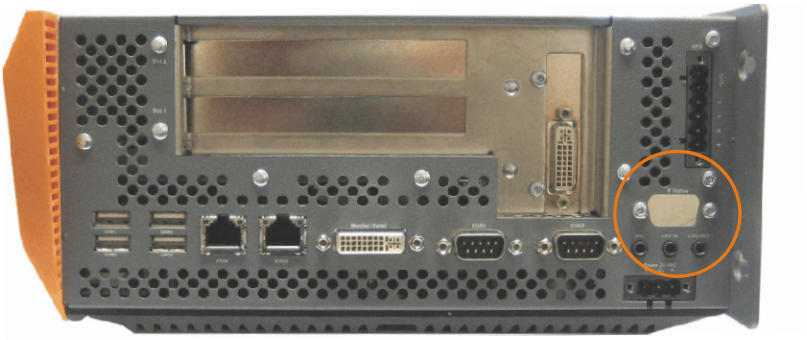


Abbildung 89: Schnittstellenoptionen (IF Option)

Information:

Ein nachträglicher Ein- und Ausbau einer Schnittstellenoption ist jederzeit möglich.

Information:

Der Ein- und Ausbau einer Schnittstellenoption darf nur in spannungslosem Zustand erfolgen.

3.10.2 5AC600.CANI-00

3.10.2.1 Allgemeines

Das Add-on CAN Interface ist mit einem Intel 82527 CAN Controller ausgerüstet, welcher der CAN Spezifikation 2.0 Part A/B entspricht. Der CAN-Controller kann einen NMI (Non Maskable Interrupt) auslösen.

3.10.2.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Serialadapter	
5AC600.CANI-00	CAN Interface; Zum Einbau in einen APC620, APC810 oder PPC700.	

Tabelle 136: 5AC600.CANI-00 - Bestelldaten

3.10.2.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5AC600.CANI-00
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
GOST-R	Ja
Schnittstellen	
CAN	
Anzahl	1
Controller	Bosch CC770 (kompatibel zum Intel 82527 CAN Controller)
Ausführung	DSUB-Buchse, 9-polig, male
Abschlusswiderstand	
Typ	aktivier- und deaktivierbar mittels Schiebeschalter
Defaulteinstellung	deaktiviert

Tabelle 137: 5AC600.CANI-00 - Technische Daten

3.10.2.4 Pinbelegung

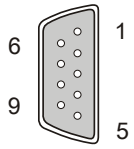
Add-on CAN		
Typ	potenzialgetrennt	DSUB-Buchse, 9-polig, male 
Übertragungsgeschwindigkeit	max. 500 kBit/s	
Buslänge	max. 1000 Meter	
Pin	**Belegung**	
1	n.c.	
2	CAN LOW	
3	GND	
4	n.c.	
5	n.c.	
6	Reserviert	
7	CAN HIGH	
8	n.c.	
9	n.c.	

Tabelle 138: Pinbelegung CAN

3.10.2.5 I/O Adresse und IRQ

Ressource	Default-Einstellung	Weitere Einstellmöglichkeiten
I/O Adresse	384h / 385h	-
IRQ	IRQ10	NMI[1]

Tabelle 139: Add-on CAN - I/O Adresse und IRQ

1 NMI = Non Maskable Interrupt.

Die Einstellung des IRQ kann im BIOS Setup geändert werden. Bei Veränderung ist auf einen möglichen Konflikt mit einer anderen Ressource zu achten.

I/O Adresse	Register	Funktion
384h	Adressregister	Definiert die Registernummer, auf die zugegriffen werden soll.
385h	Datenregister	Zugriff auf das im Adressregister definierte Register.

3.10.2.6 Buslänge und Kabeltyp

Der zu verwendende Kabeltyp hängt weitgehend von der geforderten Buslänge und der Knotenzahl ab. Die Buslänge wird von der Übertragungsrate bestimmt. Nach CiA (CAN in Automation) ist die maximale Buslänge 1000 Meter.

Bei einer maximal erlaubten Oszillatortoleranz von 0,121 % sind folgende Buslängen zulässig:

Ausdehnung [m]	Übertragungsrate [kBit/s]
≤ 1000	typ. 50
≤ 200	typ. 250
≤ 60	typ. 500

Tabelle 140: CAN Buslänge und Übertragungsrate

Vorzugsweise sollte das verwendete Kabelmaterial folgende Eigenschaften aufweisen bzw. nur geringfügig davon abweichen um eine optimale Übertragungsrate zu erreichen.

CAN Kabel	Eigenschaft
Signalleiter Kabelquerschnitt Aderisolation Leiterwiderstand Verseilung Schirm	 2x 0,25 mm² (24AWG/19), verzinnte Cu-Litze PE ≤ 82 Ω / km Adern zum Paar verseilt Paarschirmung mit Aluminiumfolie
Groundleiter Kabelquerschnitt Aderisolation Leiterwiderstand	 1x 0,34 mm² (22AWG/19), verzinnte Cu-Litze PE ≤ 59 Ω / km
Außenmantel Material Eigenschaften Gesamtschirmung	 PUR Mischung halogenfrei aus verzinnten Cu-Drähten

Tabelle 141: CAN Kabel Anforderungen

3.10.2.7 Abschlusswiderstand

Die Verdrahtung eines CAN-Netzes erfolgt in Busstruktur, wobei die beiden Busenden mit einem Abschlusswiderstand zu beschalten sind. Die Add-on CAN Interface Schnittstelle besitzt einen integrierten Abschlusswiderstand (Auslieferungszustand: deaktiviert auf Stellung „Aus“).

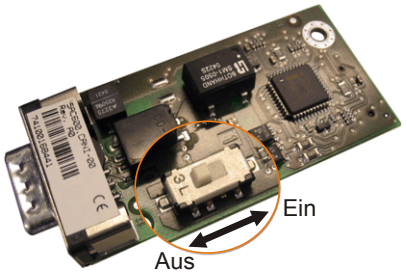


Abbildung 90: 5AC600.CANI-00 - Abschlusswiderstand Add-on CAN Interface

3.10.2.8 Lieferumfang

Für den Einbau sind die im Montagekit beigelegten Schrauben zu verwenden.

Abbildung 91: 5AC600.CANI-00 - Lieferumfang / Montagematerial

3.10.2.9 Treibersupport

Auf Grund der Dual Core Prozessoren ist für Betrieb die INACAN.SYS Treiberversion 2.36, enthalten im PVI Setup 2.6.0.3105, Voraussetzung.

Information:

Benötigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzuladen.

3.10.3 5AC600.485I-00

3.10.3.1 Allgemeines

Die Serielle Schnittstelle ist eine kombinierte RS232/RS422/RS485-Schnittstelle. Die Auswahl der Betriebsart (RS232/RS422/RS485) erfolgt dabei automatisch je nach elektrischer Anschaltung.

3.10.3.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Serialadapter	
5AC600.485I-00	RS232/422/485 Interface; zum Einbau in einen APC620, APC810 oder PPC700.	

Tabelle 142: 5AC600.485I-00 - Bestelldaten

3.10.3.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5AC600.485I-00
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
GOST-R	Ja
GL	Ja [1)]
Schnittstellen	
COM1	
Typ	RS232, nicht modemfähig, galvanisch getrennt
Ausführung	DSUB-Buchse, 9-polig, male
max. Baudrate	115 kBit/s

Tabelle 143: 5AC600.485I-00 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

3.10.3.4 Pinbelegung

Add-on RS232/422/485		
	RS232	**RS422/485**
Typ	RS232 nicht modemfähig; galvanisch getrennt	
UART	16550 kompatibel, 16 Byte FIFO	
Übertragungsgeschwindigkeit	max. 115 kBit/s	
Buslänge	max. 15 Meter	max. 1200 Meter
Pin	**Belegung RS232**	**Belegung RS422**
1	n.c.	TXD\
2	RXD	n.c.
3	TXD	n.c.
4	n.c.	TXD
5	GND	GND
6	n.c.	RXD\
7	RTS	n.c.
8	CTS	n.c.
9	n.c.	RXD

DSUB-Buchse, 9-polig, male

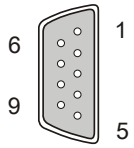


Tabelle 144: Pinbelegung RS232/RS422

3.10.3.5 I/O Adresse und IRQ

Ressource	Default-Einstellung	Weitere Einstellmöglichkeiten
I/O Adresse	2E8h	238, 2F8, 338, 3E8, 3F8
IRQ	IRQ10	IRQ 3, 4, 5, 7, 11, 12

Tabelle 145: Add-on RS232/422/485 - I/O Adresse und IRQ

Die Einstellung der I/O Adresse und des IRQ kann im BIOS Setup (unter „Advanced“ - Untermenü „Baseboard/Panel Features“ - Untermenü „Legacy Devices“ Einstellung „COM E“) geändert werden. Bei Veränderung ist auf einen möglichen Konflikt mit einer anderen Ressource zu achten.

3.10.3.6 Buslänge und Kabeltyp RS232

Die maximale Übertragungsrate von 115 kBit/s ist von der Kabellänge und vom verwendeten Kabeltyp abhängig.

Ausdehnung [m]	Übertragungsrate [kBit/s]
≤ 15	typ. 64
≤ 10	typ. 115
≤ 5	typ. 115

Tabelle 146: RS232 Buslänge und Übertragungsrate

Vorzugsweise sollte das verwendete Kabelmaterial folgende Eigenschaften aufweisen bzw. nur geringfügig davon abweichen um eine optimale Übertragungsrate zu erreichen.

RS232 Kabel	
Signalleiter Kabelquerschnitt Aderisolation Leiterwiderstand Verseilung Schirm	 4x 0,16 mm² (26AWG), verzinnte Cu-Litze PE ≤ 82 Ω / km Adern zum Paar verseilt Paarschirmung mit Aluminiumfolie
Groundleiter Kabelquerschnitt Aderisolation Leiterwiderstand	 1x 0,34 mm² (22AWG/19), verzinnte Cu-Litze PE ≤ 59 Ω / km
Außenmantel Material Eigenschaften Gesamtschirmung	 PUR Mischung halogenfrei aus verzinnten Cu-Drähten

Tabelle 147: RS232 Kabel Anforderungen

3.10.3.7 Buslänge und Kabeltyp RS422

Die RTS- Leitung muss eingeschaltet werden um den Sender aktiv zu schalten.

Die maximale Übertragungsrate von 115 kBit/s ist von der Kabellänge und vom verwendeten Kabeltyp abhängig.

Ausdehnung [m]	Übertragungsrate [kBit/s]
1200	typ. 115

Tabelle 148: RS422 Buslänge und Übertragungsraten

Vorzugsweise sollte das verwendete Kabelmaterial folgende Eigenschaften aufweisen bzw. nur geringfügig davon abweichen um eine optimale Übertragungsrate zu erreichen.

RS422 Kabel	Eigenschaft
Signalleiter Kabelquerschnitt Aderisolation Leiterwiderstand Verseilung Schirm	 4x 0,25 mm² (24AWG/19), verzinnte Cu-Litze PE ≤ 82 Ω / km Adern zum Paar verseilt Paarschirmung mit Aluminiumfolie
Groundleiter Kabelquerschnitt Aderisolation Leiterwiderstand	 1x 0,34 mm² (22AWG/19), verzinnte Cu-Litze PE ≤ 59 Ω / km
Außenmantel Material Eigenschaften Gesamtschirmung	 PUR Mischung halogenfrei aus verzinnten Cu-Drähten

Tabelle 149: RS422 Kabel Anforderungen

3.10.3.8 Betrieb als RS485-Schnittstelle

Für den Betrieb sind die Pins der RS422 Defaultschnittstelle (1, 4, 6 und 9) zu verwenden. Dazu sind die Pins wie abgebildet zu verbinden.

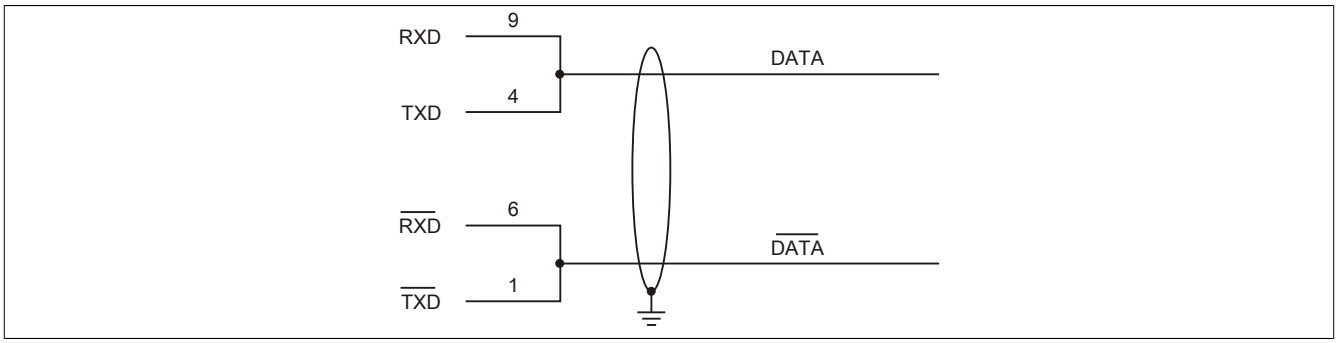


Abbildung 92: Add-on RS232/422/485 Interface - Betrieb im RS485 Modus

Das Schalten der RTS Leitung muss für jedes Senden wie auch Empfangen vom Treiber durchgeführt werden, es gibt keine automatische Rückschaltung. Dies kann nicht in Windows konfiguriert werden.

Bei großen Leitungslängen kann es durch den Spannungsabfall zu größeren Potentialdifferenzen zwischen den Busteilnehmern kommen, die die Kommunikation behindern. Dies kann durch mitführen der Masseleitung verbessert werden.

Die Leitungsenden der RS485 Schnittstelle sollten (zumindest bei größeren Leitungslängen bzw. größeren Übertragungsraten) abgeschlossen werden. Dazu kann in der Regel ein passiver Abschluss durch verbinden der Signalleitungen über jeweils einen 120 Ω Widerstand an den beiden Busenden verwendet werden.

3.10.3.9 Buslänge und Kabeltyp RS485

Die maximale Übertragungsrate von 115 kBit/s ist von der Kabellänge und vom verwendeten Kabeltyp abhängig.

Ausdehnung [m]	Übertragungsrate [kBit/s]
1200	typ. 115

Tabelle 150: RS485 Buslänge und Übertragungsraten

Vorzugsweise sollte das verwendete Kabelmaterial folgende Eigenschaften aufweisen bzw. nur geringfügig davon abweichen um eine optimale Übertragungsrate zu erreichen.

RS485 Kabel	Eigenschaft
Signalleiter	
Kabelquerschnitt	4x 0,25 mm² (24AWG/19), verzinnte Cu-Litze
Aderisolation	PE
Leiterwiderstand	≤ 82 Ω / km
Verseilung	Adern zum Paar verseilt
Schirm	Paarschirmung mit Aluminiumfolie
Groundleiter	
Kabelquerschnitt	1x 0,34 mm² (22AWG/19), verzinnte Cu-Litze
Aderisolation	PE
Leiterwiderstand	≤ 59 Ω / km
Außenmantel	
Material	PUR Mischung
Eigenschaften	halogenfrei
Gesamtschirmung	aus verzinnten Cu-Drähten

Tabelle 151: RS422 Kabel Anforderungen

3.10.3.10 Lieferumfang

Für den Einbau sind die im Montagekit beigelegten Schrauben zu verwenden.

Abbildung 93: 5AC600.485I-00 - Lieferumfang / Montagematerial

Kapitel 3 • Inbetriebnahme

1 Montage

Gefahr!

- **Die gesamte Spannungsversorgung muss getrennt werden, bevor Abdeckungen oder Komponenten des Geräts entnommen und Zubehör, Hardware oder Kabel installiert bzw. entfernt werden.**
- **Das Netzkabel vom Gerät und von der Spannungsversorgung entfernen.**
- **Bevor das Gerät an die Spannungsversorgung angeschlossen und eingeschaltet wird, müssen alle Abdeckungen und Komponenten, Zubehör, Hardware und Kabel montiert bzw. befestigt sein.**

Die Geräte werden mit den am Gehäuse befindlichen Befestigungslaschen montiert. Die Laschen sind für M5 Schrauben konzipiert.

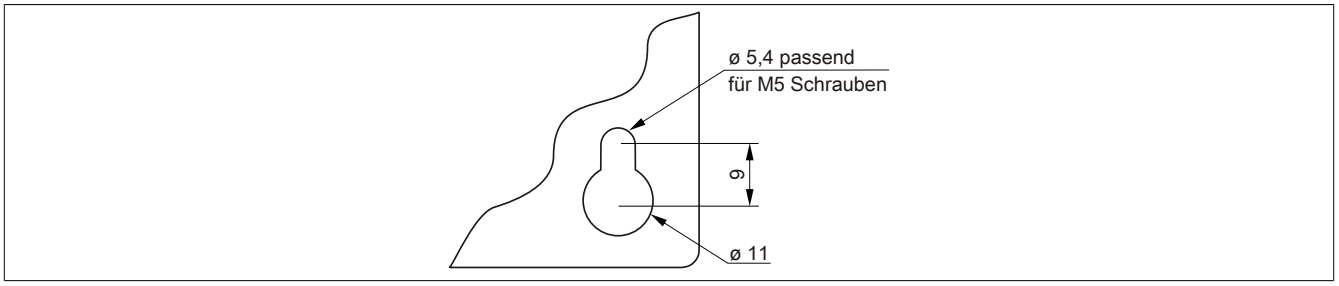


Abbildung 94: Befestigungslasche

Die genaue Position für die Befestigungsbohrungen kann aus den Bohrschablonen im 2 "Technische Daten", Abschnitt "Einzelkomponenten" auf Seite 76 entnommen werden.

1.1 Vorgehensweise

1. Die Montagefläche mit den benötigten Bohrungen versehen. Die genaue Position für die Befestigungsbohrungen kann aus den Bohrschablonen entnommen werden.
2. Den B&R Industrie PC mit M5 Schrauben montieren.

1.2 Wichtige Informationen zur Montage

- Es müssen die klimatischen Umgebungsbedingungen beachtet werden.
- Beim Einbau in ein geschlossenes Gehäuse, muss ausreichend Volumen zur Luftumwälzung vorhanden sein.
- Das Gerät muss auf planer, sauberer und gratfreier Oberfläche montiert werden.
- Das Gerät ist nur für den Betrieb in geschlossenen Räumen zugelassen.
- Das Gerät darf nicht direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt werden.
- Die Lüftungslöcher dürfen nicht verdeckt werden.
- Bei der Montage des Geräts sind unbedingt die zulässigen Einbaulagen zu beachten.
- Es ist darauf zu achten, dass die Wand oder das Schaltschrankblech das vierfache Gesamtgewicht des Geräts tragen kann.
- Beim Anschluss von Kabeln (DVI, SDL, USB, etc.) ist auf den Biegeradius zu achten.

1.3 Einbaulagen

Ein APC810 System darf nur wie nachfolgend abgebildet bzw. beschrieben montiert werden.

1.3.1 Einbaulage - senkrecht

Diese Art der Montage kann sowohl für APC810 Systeme mit und ohne Lüfter Kit verwendet werden.

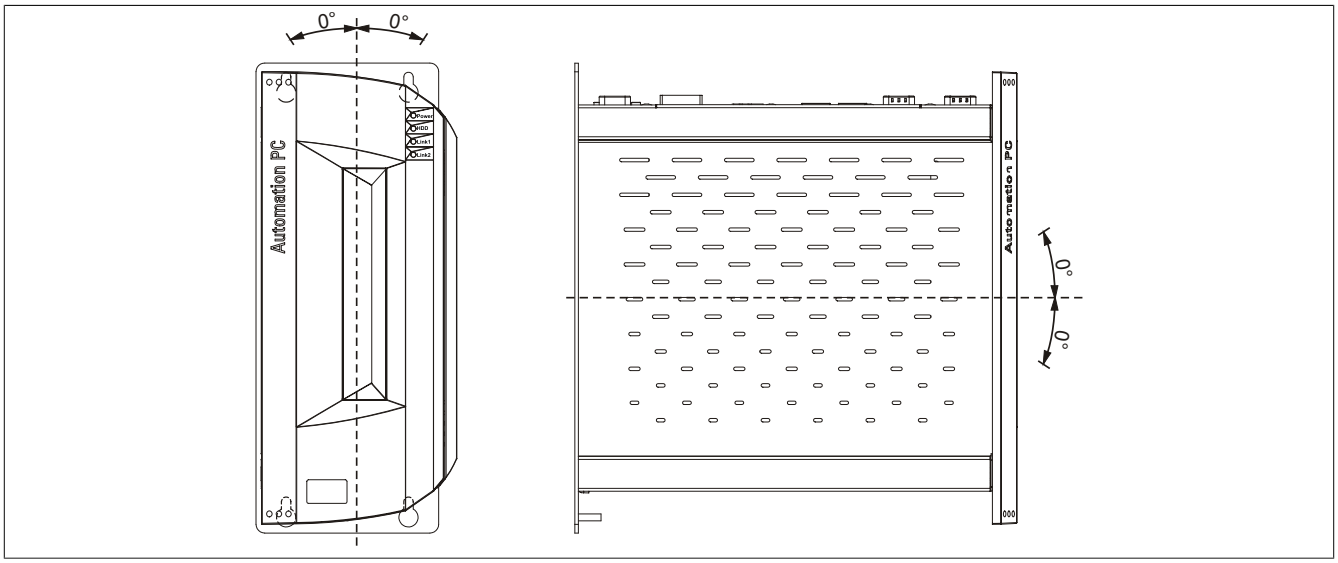


Abbildung 95: Einbaulage - senkrecht

Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die Abstände wie in Abschnitt "Luftzirkulationsabstände" auf Seite 199 eingehalten werden, um eine natürliche Luftzirkulation zu erreichen.

1.3.2 Einbaulage - waagrecht

Der Betrieb in waagrechter Einbaulage (Kühlkörper nach oben) ist nur in Verbindung mit einem Lüfter Kit erlaubt. Die maximale Umgebungstemperaturspezifikation muss um 5°C herabgesetzt werden.

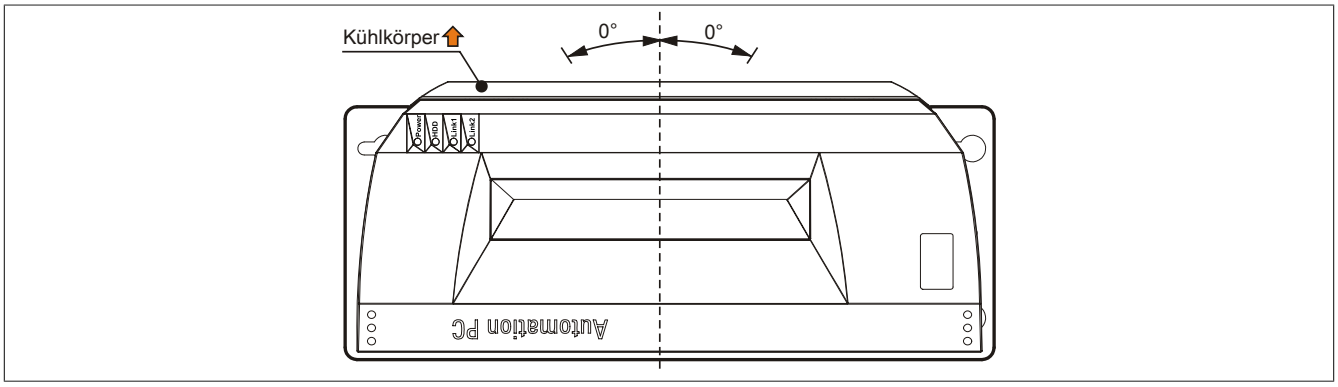


Abbildung 96: Einbaulage - waagrecht

Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die Abstände wie in Abschnitt "Luftzirkulationsabstände" auf Seite 199 eingehalten werden, um eine natürliche Luftzirkulation zu erreichen.

1.4 Luftzirkulationsabstände

Um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten ist oberhalb, unterhalb, seitlich und rückseitig des Automation PC 810 ein spezifizierter Freiraum vorzusehen. Der minimal spezifizierte Freiraum kann den nachfolgenden Zeichnungen entnommen werden. Dieser ist für sämtliche Automation PC 810 Varianten gültig.

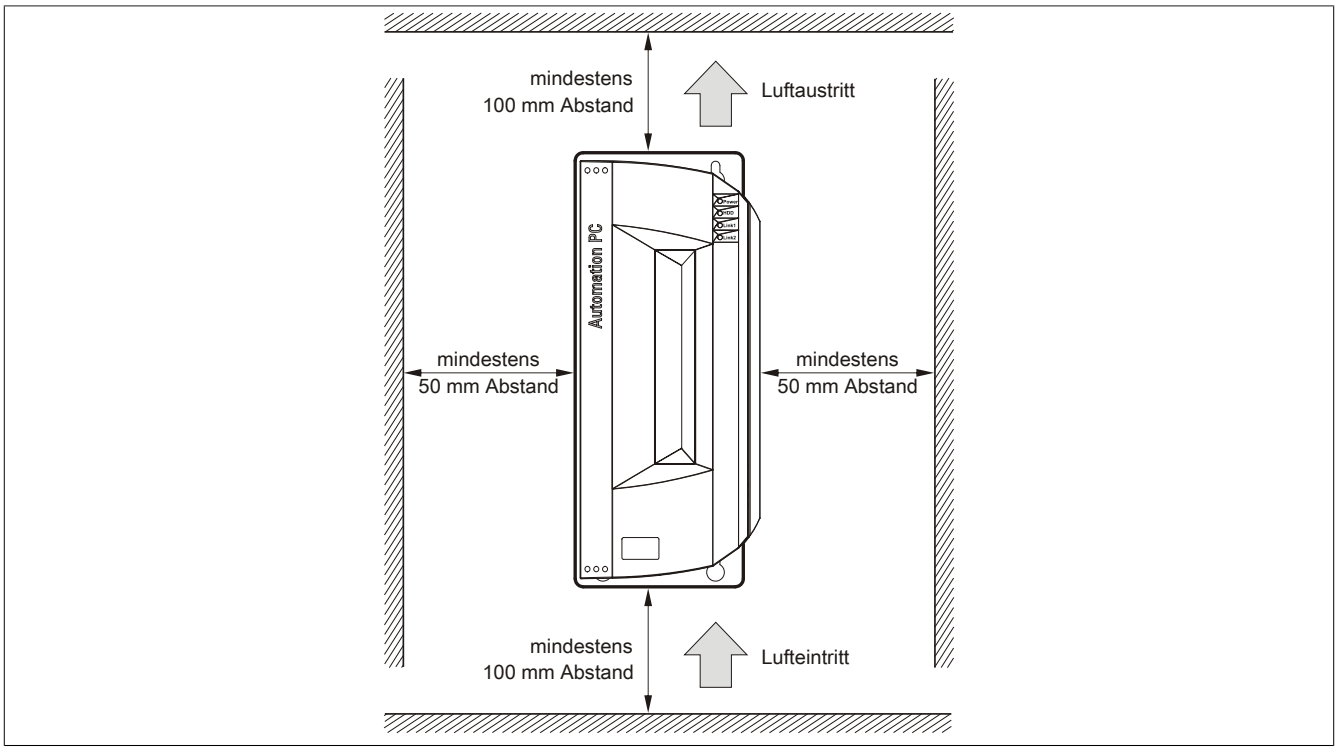


Abbildung 97: Standardmontage - Montageabstände

Diese definierten Abstände gelten sowohl für die senkrechte als auch die waagrechte Montage des APC810.

Information:

Die angegebenen Luftzirkulationsabstände gelten für den Worst Case Betrieb bei der maximal spezifizierten Umgebungstemperatur (siehe "Temperaturangaben" im Kapitel "Technische Daten").

Können die angegebenen Luftzirkulationsabstände nicht eingehalten werden, sind die maximal spezifizierten Temperaturen der Temperatursensoren (siehe "Temperatursensorpositionen" im Kapitel "Technische Daten") vom Anwender zu überwachen und bei Überschreiten dieser Werte entsprechende Maßnahmen zu setzen.

2 Anschluss von Kabeln

Beim Anschluss bzw. der Verlegung von Kabeln muss die Biegeradiusspezifikation eingehalten werden.

Information:

Das maximale Anzugsdrehmoment der Fixierschrauben beträgt 0,5 Nm.

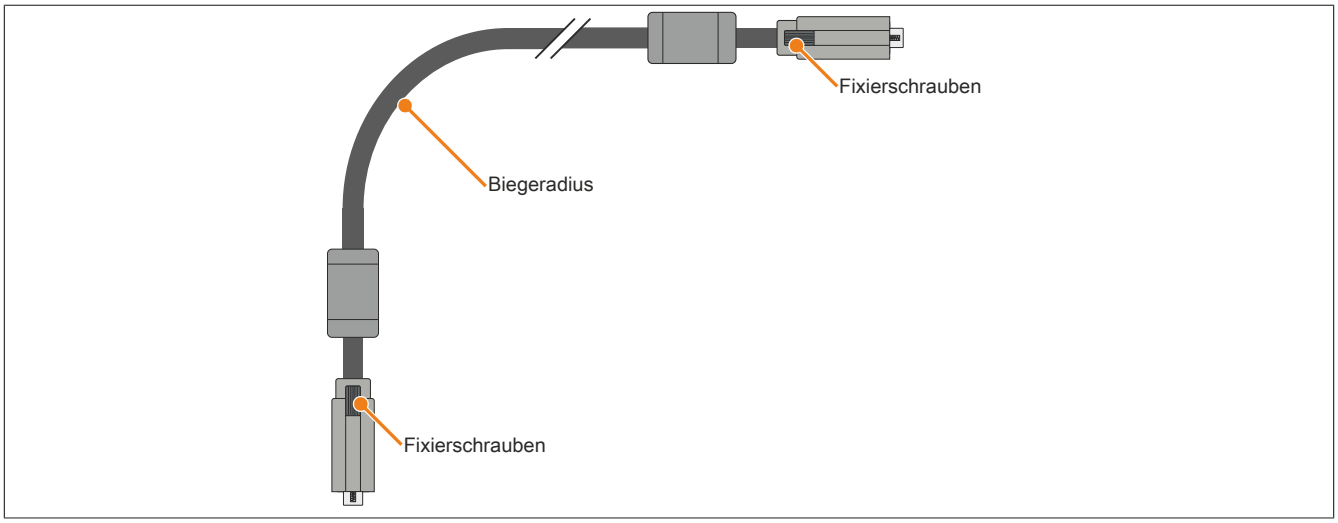


Abbildung 98: Biegeradius Kabelanschluss (Symbolbild)

Information:

Der spezifizierte Biegeradius ist den technischen Daten des jeweiligen Kabels zu entnehmen.

3 Erdungskonzept

Die Funktionserde ist ein Strompfad niedriger Impedanz zwischen Stromkreisen und Erde, der nicht als Schutzmaßnahme sondern z.B. zur Verbesserung der Störfestigkeit gedacht ist. Sie dient lediglich der Störungsableitung und nicht als Berührungsschutz für Personen.

Das Gerät verfügt über 2 Funktionserde-Anschlüsse:

- Spannungsversorgung
- Erdungsanschluss

Um eine sichere Ableitung von elektrischen Störungen zu gewährleisten, sind folgende Punkte zu beachten:

- Gerät auf möglichst kurzem Weg mit dem zentralen Erdungspunkt am Schaltschrank verbinden.
- Ausführung der Kabel mit mind. 2,5 mm² pro Anschluss; wird ein Kabel mit Aderendhülse an der Feldklemme 0TB103.9 oder 0TB103.91 verwendet ist ein Kabel mit maximal 1,5 mm² pro Anschluss möglich.
- Schirmungskonzept der Leiter beachten; alle an das Gerät angeschlossenen Datenkabel sind mit geschirmten Leitungen auszuführen.

Die Funktionserde ist am B&R Gerät mit folgendem Symbol gekennzeichnet: ⏚

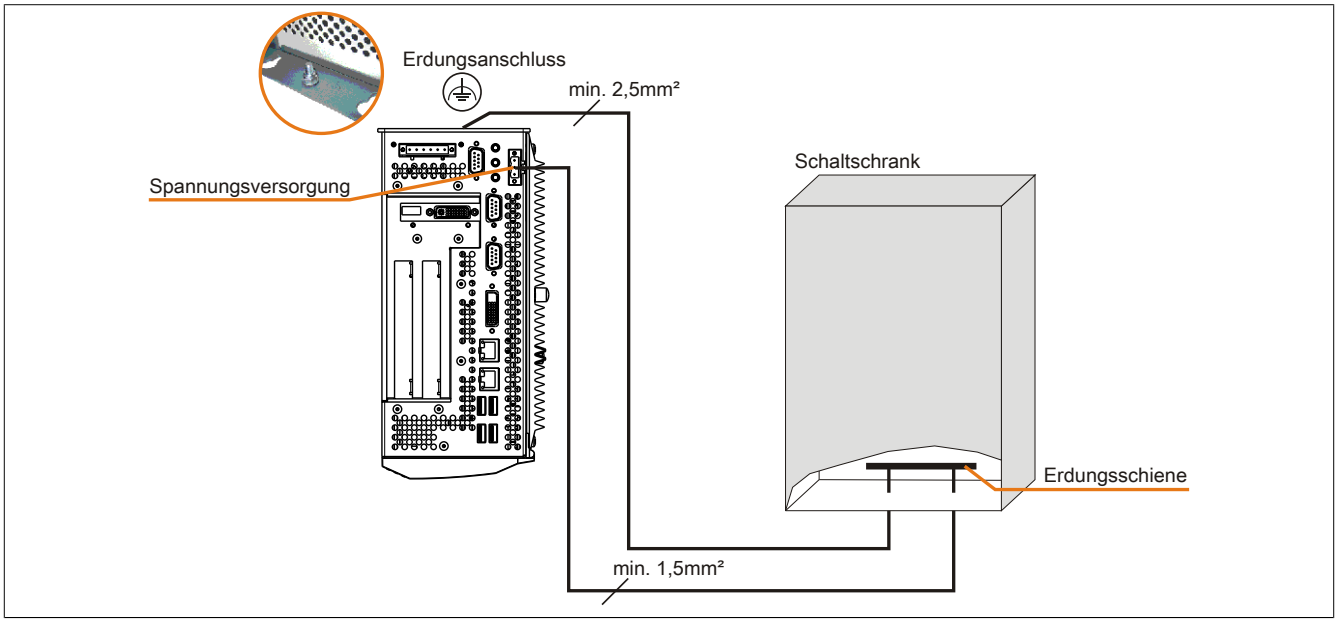


Abbildung 99: Erdungskonzept

4 Allgemeine Anleitung zur Vorgehensweise bei Temperaturtests

Zweck dieser Anleitung ist die allgemeine Vorgehensweise von applikationsspezifischen Temperaturtests mit B&R Industrie PCs oder Power Panels zu erklären. Diese Anleitung stellt jedoch lediglich eine Richtlinie dar.

4.1 Vorgehensweise

Um genaue Ergebnisse zu erhalten, sollten die Testbedingungen den Bedingungen im Feldeinsatz entsprechen. Dies bedeutet, dass während den Temperaturtests die Zielapplikation laufen sollte, der PC im später verwendeten Schaltschrankgehäuse montiert sein sollte, etc.

Weiters sollte ein Temperatursensor für das zu testende Gerät montiert werden, um die Umgebungstemperatur laufend zu überwachen. Um korrekte Werte zu erhalten, ist dieser in einem Abstand von ca. 5 bis 10 cm vom B&R Industrie PC, in der Nähe der Luftansaugung (nicht in der Nähe der Abgabeluft), anzubringen.

Jeder B&R Industrie PC oder jedes Power Panel ist mit internen Temperatursensoren ausgestattet. Je nach Gerätefamilie sind diese an verschiedenen Positionen angebracht. Die Anzahl und Temperaturgrenzen sind je nach Gerätefamilie unterschiedlich.

Angaben zur Lage der Temperatursensoren sowie deren maximal spezifizierte Temperaturen sind dem Abschnitt "Temperatursensorpositionen" im 2 "Technische Daten" zu entnehmen.

Zur optimalen Bestimmung und Beurteilung der Temperatursituation wird eine Mindesttestzeit von 8 Stunden empfohlen.

4.2 Auswertung der Temperaturen unter Windows Betriebssystemen

4.2.1 Auswertung mit dem B&R Control Center

Zur Auswertung der Temperaturen kann das B&R Control Center verwendet werden. Die Temperaturen können im Reiter „Temperaturen“ angesehen werden. Das B&R Control Center kann als freier Download von der B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen werden. Das B&R Control Center verwendet das B&R Automation Device Interface (ADI).

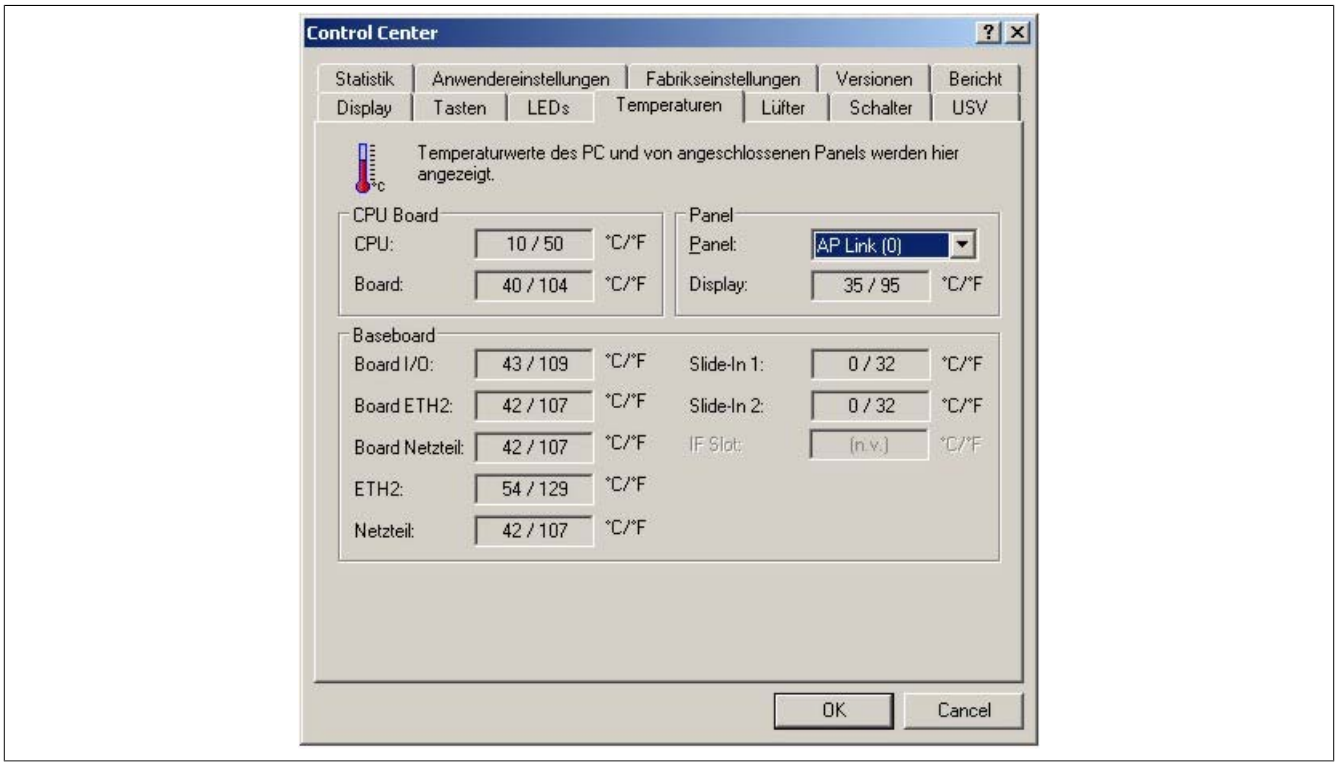


Abbildung 100: Auswertung mit B&R Control Center anhand eines APC810 2 Slot mit DVD

Ist eine historische Aufzeichnung der Daten notwendig, so kann eine eigene Applikation erstellt werden.

Information:

Zur Erstellung einer eigenen Applikation sind auf der B&R Homepage (www.br-automation.com) eigene SDK’s verfügbar, wie z.B. das ADI .NET SDK.

4.2.2 Auswertung mit dem BurnIn Tool von Passmark

Wird zur Temperaturauswertung keine eigene Applikation erstellt bzw. verwendet, so empfiehlt B&R die Verwendung des Softwaretools BurnIn Test der Firma Passmark.

Das Softwaretool BurnIn ist in einer Standard und Professional Version erhältlich. Zusätzlich zum Softwarepaket sind auch noch verschiedene Loopback Adapter (Seriell, Parallel, USB, …) und Test-CDs bzw. DVDs erhältlich. Je nach Ausbaustufe der Software und vorhandenen Loopback Adapter kann eine entsprechend hohe System- und Peripherielast erzeugt werden.

Information:

Loopback Adapter können ebenfalls von der Firma Passmark bezogen werden. Mehr Informationen dazu sind unter www.passmark.com zu finden.

Die nachfolgenden Screenshots beziehen sich auf die Passmark BurnIn Pro Version V4 anhand eines APC810 2 Slot mit DVD.

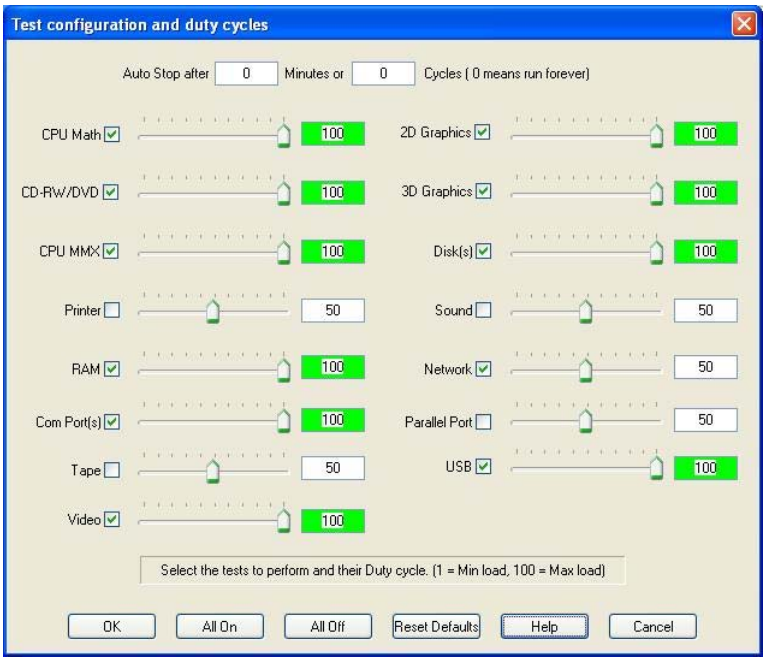


Abbildung 101: Einstellungen für Passmark BurnIn Pro V4 anhand eines APC810 2 Slot mit DVD

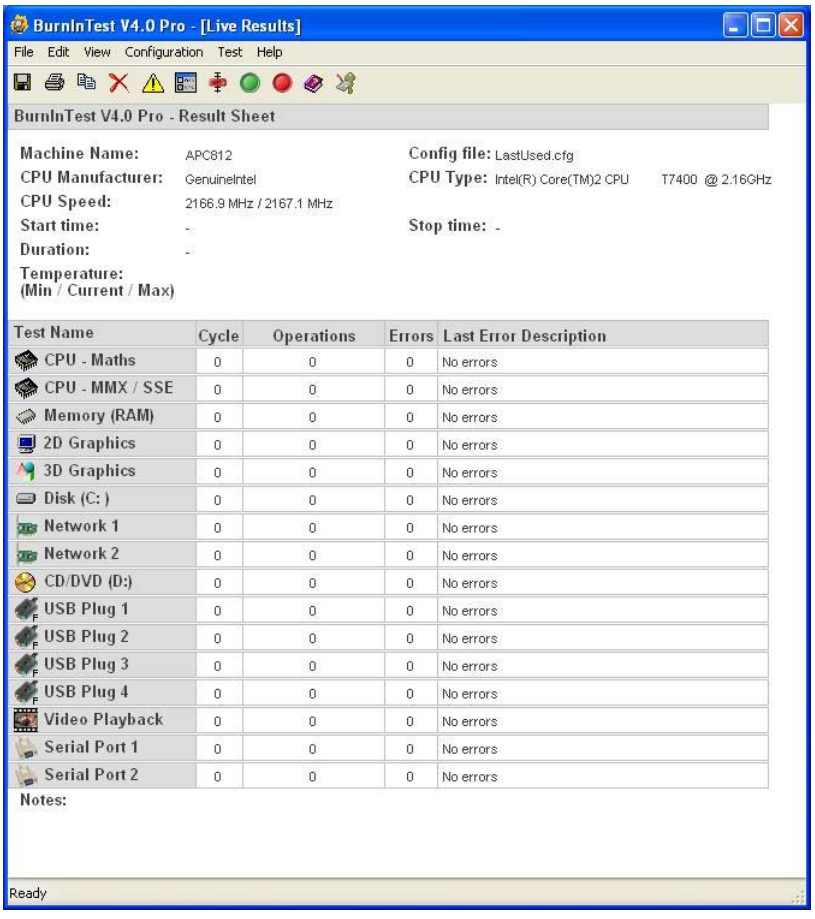


Abbildung 102: Testübersicht eines APC810 2 Slot mit DVD

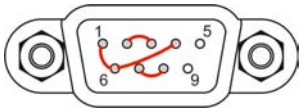
Je nach Verfügbarkeit der Loopback Adapter und DVDs muss eine entsprechende Feineinstellung in den jeweiligen Testproperties vorgenommen werden.

Information:

Stehen keine USB- Loopback Adapter zur Verfügung, so können auch USB Memory Sticks verwendet werden. Die USB Memory Sticks müssen unter Windows als formatiertes Laufwerk zur Verfügung stehen. Der Test USB ist dann abzuwählen und die USB Memory Stick Laufwerke müssen in den Diskproperties als Testdevice konfiguriert werden.

Information:

Serielle Loopback Adapter können relativ einfach selbst erstellt werden. Dazu sind lediglich einige Pins mit Drähten an der seriellen Schnittstelle zu verbinden.



4.3 Auswertung der Temperaturen unter Nicht- Windows Betriebssystemen

Für Anwendungen, die nicht unter Windows laufen, kann die Auswertung der Temperaturen mit Hilfe der B&R Implementierungsanleitung durchgeführt werden. Zusätzlich zur Implementierungsanleitung sind auch lauffähige MS-DOS Beispielprogramme verfügbar.

Die Implementierungsanleitung beschreibt nur die gerätespezifischen Funktionen und nicht die Hauptfunktion der Beispielprogramme.

Wird der Code aus den Beispielprogrammen übernommen, sind die Hinweise in der Implementierungsanleitung zu den TODO Anweisungen, I/O Zugriffsfunktionen usw. zu beachten!

Information:

Für jeden B&R Industrie PC oder jedes Power Panel können Beispielprogramme und Implementierungsanleitungen von der B&R Homepage (www.br-automation.com) kostenlos heruntergeladen werden.

4.4 Auswertung der Messergebnisse

Der aufgezeichnete maximale Temperaturwert jedes einzelnen Sensors darf die in den Anwenderhandbüchern spezifizierte Temperaturgrenze nicht überschreiten.

Wenn die Temperaturtests nicht in einer geregelten Klimakammer durchgeführt werden können, so können diese z.B. in Büroumgebung durchgeführt werden. Dabei ist allerdings die Erfassung der Umgebungstemperatur notwendig. Auf Grund der im Hause B&R gewonnenen Erfahrung, können bei passiven Systemen (Systeme ohne Lüfter Kit) die gemessenen Temperaturwerte linear zur Umgebungstemperatur hochgerechnet werden. Um auch die Temperaturwerte bei Systemen mit Lüfter Kit hochrechnen zu können, müssen die Lüfter laufen. Weiters ist dabei auf die Drehzahl, usw. zu achten.

Werden die Temperaturtests in einer geregelten Klimakammer mit Lüfter durchgeführt, so werden die zu testenden Geräte durch diesen Lüfter gekühlt und somit auch die Messergebnisse verfälscht. Bei passiven Geräten sind die Messergebnisse somit unbrauchbar. Um jedoch auch Temperaturtests in Klimakammern mit Lüfter durchführen zu können ohne die Messergebnisse zu verfälschen, ist der Lüfter der Klimakammer auszuschalten und eine entsprechend große Vorlaufzeit (mehrere Stunden) einzuhalten.

Beispiel anhand eines APC810 2 Slot

Nachfolgendes Beispiel ist nur unter Einhaltung der Montage- und Einbaulagenvorschriften laut Anwenderhandbuch gültig.

Temperatursensor	Gemessene Temperatur	Hochgerechnete Temperatur	
Umgebungstemperatur	20°C	35°C	45°C
CPU	48°C	63°C	73°C
CPU Board	51°C	66°C	76°C
Board I/O	51°C	66°C	76°C
Board ETH2	52°C	67°C	77°C
Board Netzteil	51°C	66°C	76°C
ETH2	65°C	80°C	90°C
Netzteil	51°C	66°C	76°C

Tabelle 152: Auswertungsbeispiel anhand eines APC810 2 Slot

5 Anschlussbeispiele

Die nachfolgenden Beispiele bieten einen Überblick über die Konfigurationsmöglichkeiten, in welcher Art Automation Panel 900 Geräte und/oder Automation Panel 800 Geräte mit dem APC810 verbunden werden können. Es sollen dabei unter anderem folgende Fragen beantwortet werden:

- Wie können Automation Panel 900 Geräte am Monitor / Panel Ausgang des APC810 angeschlossen werden und worauf ist Acht zu geben?
- Wie können Automation Panel 800 Geräte am Monitor / Panel Ausgang des APC810 angeschlossen werden und worauf ist Acht zu geben?
- Wie können Automation Panel 900 Geräte gleichzeitig am Monitor / Panel Ausgang und am optionalen SDL AP Link des APC810 angeschlossen werden und worauf ist Acht zu geben?
- Was bedeutet „Display Clone“ und „Erweiterter Desktop“ Betrieb?
- Wie viele Automation Panel 900 Geräte können pro Strang angeschlossen werden?
- Wie viele Automation Panel 900 Geräte können mit einem Automation Panel 800 Gerät pro Strang angeschlossen werden?
- Wie werden die angeschlossenen Geräte intern nummeriert?
- Gibt es Einschränkungen bei der Segmentlänge, wenn ja welche?
- Welche Kabel und Linkbaugruppen werden benötigt?
- Müssen BIOS Einstellungen für eine bestimmte Konfiguration geändert werden?

5.1 Auswahl der Displayeinheiten

Wenn ein Automation Panel 800 und ein Automation Panel 900 an einem Strang angeschlossen werden sollen, müssen die Geräte den gleichen Displaytyp besitzen. In der folgenden Tabelle werden die möglichen AP900 Geräte aufgelistet die mit einem AP800 Gerät an einem Strang angeschlossen werden können.

Automation Panel 800	Automation Panel 900
5AP820.1505-00	5AP920.1505-01 5AP951.1505-01 5AP980.1505-01 5AP981.1505-01
5AP880.1505-00	5AP920.1505-01 5AP951.1505-01 5AP980.1505-01 5AP981.1505-01

Tabelle 153: Auswahl der Displayeinheiten

5.2 Ein Automation Panel 900 über DVI onboard

An die integrierte DVI Schnittstelle (onboard) ist ein Automation Panel 900 mit max. SXGA Auflösung angeschlossen. Alternativ kann auch ein Office TFT mit DVI Schnittstelle oder ein analoger Monitor (über Adapter Best. Nr. 5AC900.1000-00) betrieben werden. Touch Screen und USB werden jeweils über eigene Kabel geführt. Sollen USB Geräte am Automation Panel 900 betrieben werden, so kann die Distanz max. 5 Meter betragen. USB Geräte können nur direkt (ohne Hub) an die Automation Panel angeschlossen werden.

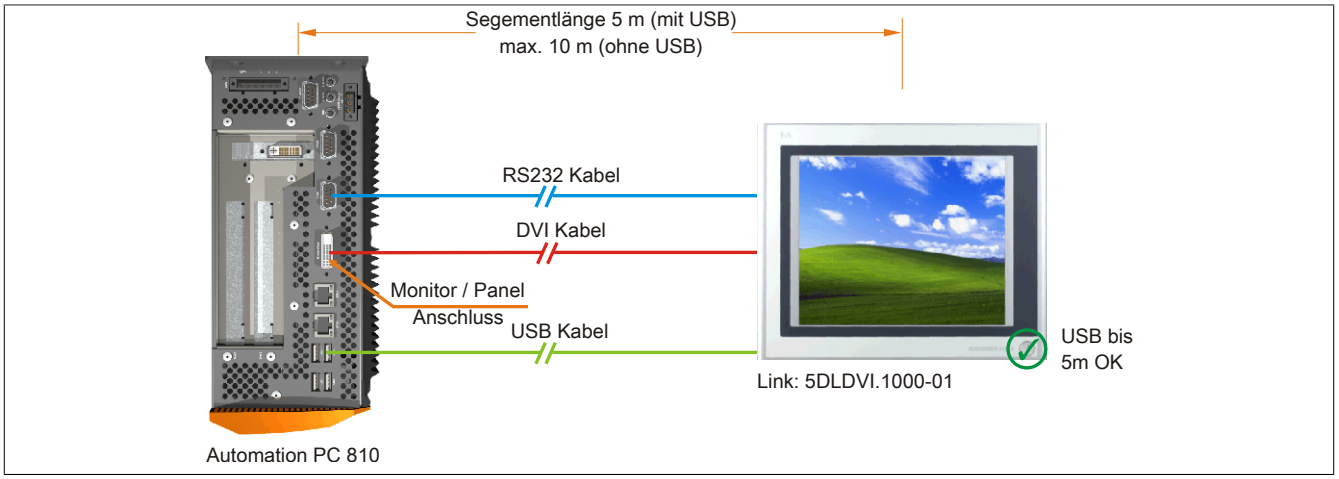


Abbildung 103: Ein Automation Panel 900 über DVI onboard (Symbolfoto)

5.2.1 Voraussetzung Grundsystem

Die nachfolgende Tabelle zeigt die möglichen Kombinationen von APC810 Systemeinheit und CPU Board um die in der obigen Abbildung gezeigte Konfiguration zu realisieren. Tritt bei der Kombination eine Einschränkung der max. Auflösung auf, so kann man dies auch folgender Tabelle entnehmen (z.B. für den Anschluss eines nicht B&R Automation Panel 900 Gerätes).

CPU Board	mit Systemeinheit				Einschränkung Auflösung
	5PC810.SX01-00	5PC810.SX02-00	5PC810.SX03-00	5PC810.SX05-00	
5PC800.B945-00 5PC800.B945-10	✓	✓	✓	✓	max. SXGA
5PC800.B945-01 5PC800.B945-11	✓	✓	✓	✓	max. SXGA
5PC800.B945-02 5PC800.B945-12	✓	✓	✓	✓	max. SXGA
5PC800.B945-03 5PC800.B945-13	✓	✓	✓	✓	max. SXGA
5PC800.B945-04 5PC800.B945-14	✓	✓	✓	✓	max. SXGA
5PC800.B945-05	✓	✓	✓	✓	max. SXGA

Tabelle 154: Mögliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board

5.2.2 Linkbaugruppe

Information:

Für jedes verwendete Gerät muss die entsprechende Linkbaugruppe ausgewählt werden!

Bestellnummer	Beschreibung	Anmerkung
5DLDVI.1000-01	**Automation Panel Link DVI Receiver** Anschlüsse für DVI-D, RS232 und USB 2.0 (Typ B); 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen).	für Automation Panel 900

Tabelle 155: Linkbaugruppen

5.2.3 Kabel

Auswahl jeweils eines Automation Panel 900 Kabels aus den 3 benötigten Typen.

Bestellnummer	Beschreibung	Länge
5CADVI.0018-00	DVI-D Kabel, 1,8 m.	1,8 m ±50 mm
5CADVI.0050-00	DVI-D Kabel, 5 m.	5 m ±80 mm
5CADVI.0100-00	DVI-D Kabel, 10 m.	10 m ±100 mm
9A0014.02	RS232 Verlängerungskabel zum Betrieb einer abgesetzten Displayeinheit mit Touch Screen, 1,8 m.	1,8 m ±50 mm
9A0014.05	RS232 Verlängerungskabel zum Betrieb einer abgesetzten Displayeinheit mit Touch Screen, 5 m.	5 m ±80 mm
9A0014.10	RS232 Verlängerungskabel zum Betrieb einer abgesetzten Displayeinheit mit Touch Screen, 10 m.	10 m ±100 mm
5CAUSB.0018-00	USB 2.0 Verbindungskabel Typ A - Typ B, 1,8 m.	1,8 m ±30 mm
5CAUSB.0050-00	USB 2.0 Verbindungskabel Typ A - Typ B, 5 m.	5 m ±50 mm

Tabelle 156: Kabel für DVI Konfigurationen

Information:

Detaillierte technische Daten zu den Kabeln siehe Automation Panel 900 Anwenderhandbuch. Dieses kann in elektronischer Form (pdf) von der B&R Homepage www.br-automation.com heruntergeladen werden.

5.2.4 Mögliche Automation Panel Geräte, Auflösungen und Segmentlängen

Es können folgende Automation Panel 900 Geräte verwendet werden, wobei in seltenen Fällen eine Einschränkung der Segmentlänge in Abhängigkeit der Auflösung besteht.

Bestellnummer	Diagonale	Auflösung	Touchscreen	Tasten	max. Segmentlänge
5AP920.1043-01	10,4“	VGA	✓	-	5 m / 10 m[1)]
5AP920.1214-01	12,1“	SVGA	✓	-	5 m / 10 m[1)]
5AP920.1505-01	15,0“	XGA	✓	-	5 m / 10 m[1)]
5AP920.1706-01	17,0“	SXGA	✓	-	5 m / 10 m[1)]
5AP920.1906-01	19,0“	SXGA	✓	-	5 m / 10 m[1)]

Tabelle 157: Mögliche Automation Panel Geräte, Auflösungen und Segmentlängen

1) Keine USB Unterstützung am Automation Panel 900 möglich, da USB nur bis 5 m begrenzt einsetzbar ist.

Information:

Bei der Übertragunsart DVI ist kein Auslesen von Statistikwerten bei den Automation Panel 900 Geräten möglich.

5.2.5 BIOS Einstellungen

Es müssen für den Betrieb keine speziellen BIOS Einstellungen vorgenommen werden.

5.3 Ein Automation Panel 900 über SDL onboard

An die integrierte SDL Schnittstelle (onboard) ist ein Automation Panel 900 über SDL Kabel angeschlossen. USB Geräte können nur direkt (ohne Hub) an die Automation Panel angeschlossen werden.

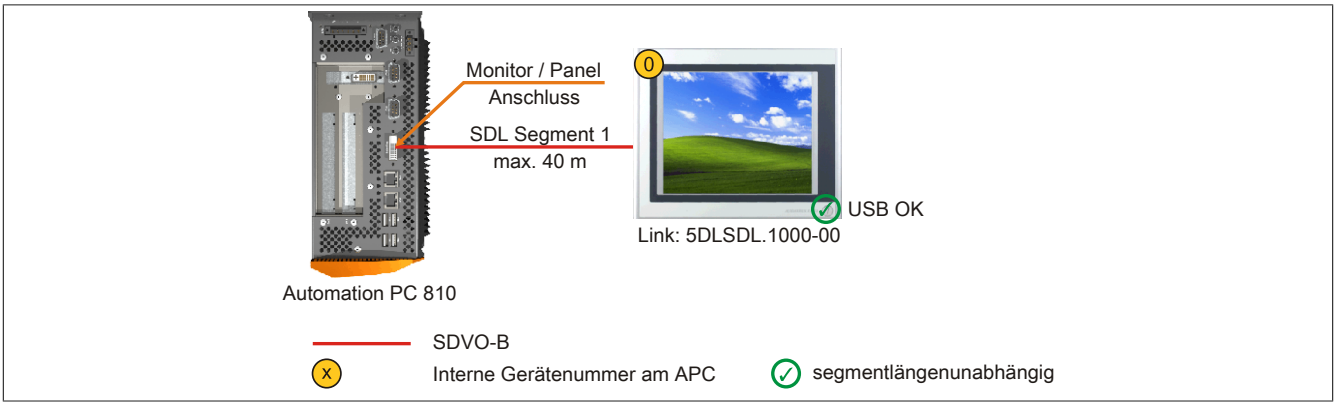


Abbildung 104: Ein Automation Panel 900 über SDL onboard (Symbolfoto)

5.3.1 Voraussetzung Grundsystem

Die nachfolgende Tabelle zeigt die möglichen Kombinationen von APC810 Systemeinheit und CPU Board um die in der obigen Abbildung gezeigte Konfiguration zu realisieren. Tritt bei der Kombination eine Einschränkung der max. Auflösung auf, so kann man dies auch folgender Tabelle entnehmen (z.B. für den Anschluss eines nicht B&R Automation Panel 900 Gerätes).

CPU Board	mit Systemeinheit				Einschränkung Auflösung
	5PC810.SX01-00	5PC810.SX02-00	5PC810.SX03-00	5PC810.SX05-00	
5PC800.B945-00 5PC800.B945-10	✓	✓	✓	✓	max. UXGA
5PC800.B945-01 5PC800.B945-11	✓	✓	✓	✓	max. UXGA
5PC800.B945-02 5PC800.B945-12	✓	✓	✓	✓	max. UXGA
5PC800.B945-03 5PC800.B945-13	✓	✓	✓	✓	max. UXGA
5PC800.B945-04 5PC800.B945-14	✓	✓	✓	✓	max. UXGA
5PC800.B945-05	✓	✓	✓	✓	max. UXGA

Tabelle 158: Mögliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board

5.3.2 Linkbaugruppe

Information:

Für jedes verwendete Gerät muss die entsprechende Linkbaugruppe ausgewählt werden!

Bestellnummer	Beschreibung	Anmerkung
5DLSDL.1000-00	**Automation Panel Link SDL Receiver** Anschluss für SDL in; Übertragung von Displaydaten, Touch Screen, USB 1.1, Matrixtasten, und Servicedaten; 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen).	für Automation Panel 900

Tabelle 159: Linkbaugruppen

5.3.3 Kabel

Auswahl eines Automation Panel 900 Kabels aus der nachfolgenden Tabelle.

Bestellnummer	Beschreibung	Länge
5CASDL.0008-00	SDL Kabel, 0,8 m.	0,8 m ±25 mm
5CASDL.0018-00	SDL Kabel, 1,8 m.	1,8 m ±30 mm
5CASDL.0050-00	SDL Kabel, 5 m.	5 m ±30 mm
5CASDL.0100-00	SDL Kabel, 10 m.	10 m ±50 mm
5CASDL.0150-00	SDL Kabel, 15 m.	15 m ±100 mm
5CASDL.0200-00	SDL Kabel, 20 m.	20 m ±100 mm
5CASDL.0250-00	SDL Kabel, 25 m.	25 m ±100 mm
5CASDL.0300-00	SDL Kabel, 30 m.	30 m ±100 mm
5CASDL.0018-03	SDL Kabel flex, 1,8 m.	1,8 m ±20 mm

Tabelle 160: Kabel für SDL Konfigurationen

Bestellnummer	Beschreibung	Länge
5CASDL.0050-03	SDL Kabel flex, 5 m.	5 m ±45 mm
5CASDL.0100-03	SDL Kabel flex, 10 m.	10 m ±90 mm
5CASDL.0150-03	SDL Kabel flex, 15 m.	15 m ±135 mm
5CASDL.0200-03	SDL Kabel flex, 20 m.	20 m ±180 mm
5CASDL.0250-03	SDL Kabel flex, 25 m.	25 m ±225 mm
5CASDL.0300-03	SDL Kabel flex, 30 m.	30 m ±270 mm
5CASDL.0300-13	SDL Kabel flex mit Extender, 30 m.	30 m ±280 mm
5CASDL.0400-13	SDL Kabel flex mit Extender, 40 m.	40 m ±380 mm
5CASDL.0430-13	SDL Kabel flex mit Extender, 43 m.	43 m ±410 mm
5CASDL.0018-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 1,8 m.	1,8 m ±30 mm
5CASDL.0050-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 5 m.	5 m ±50 mm
5CASDL.0100-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 10 m.	10 m ±100 mm
5CASDL.0150-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 15 m.	15 m ±100 mm

Tabelle 160: Kabel für SDL Konfigurationen

Information:

Detaillierte technische Daten zu den Kabeln siehe Automation Panel 900 Anwenderhandbuch. Dieses kann in elektronischer Form (pdf) von der B&R Homepage www.br-automation.com heruntergeladen werden.

5.3.3.1 Kabellängen und Auflösungen bei SDL-Übertragung

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen Segmentlänge und max. Auflösung in Abhängigkeit des SDL-Kabels:

SDL-Kabel	Auflösung						
Segmentlänge [m]	VGA 640 x 480	SVGA 800 x 600	XGA 1024 x 768	HD 1366 x 768	SXGA 1280 x 1024	UXGA 1600 x 1200	FHD 1920 x 1080
0,8	5CASDL.0008-00	5CASDL.0008-00	5CASDL.0008-00	5CASDL.0008-00	5CASDL.0008-00	5CASDL.0008-00	5CASDL.0008-00
1,8	5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-03
5	5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-03
10	5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-03
15	5CASDL.0150-00 5CASDL.0150-01 5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-00 5CASDL.0150-01 5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-00 5CASDL.0150-01 5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-00 5CASDL.0150-01 5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-00 5CASDL.0150-01 5CASDL.0150-03	- - -	- - 5CASDL.0150-03
20	5CASDL.0200-00 5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-00 5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-00 5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-00 5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-00 5CASDL.0200-03	- -	- 5CASDL.0200-03
25	5CASDL.0250-00 5CASDL.0250-03	5CASDL.0250-00 5CASDL.0250-03	5CASDL.0250-00 5CASDL.0250-03	5CASDL.0250-00 5CASDL.0250-03	- -	- -	- -
30	5CASDL.0300-00 5CASDL.0300-03	5CASDL.0300-00 5CASDL.0300-03	- 5CASDL.0300-13	- 5CASDL.0300-13	- 5CASDL.0300-13	- -	- 5CASDL.0300-13
40	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	-	5CASDL.0400-13

Tabelle 161: Kabellängen und Auflösungen bei SDL-Übertragung

5.3.4 BIOS Einstellungen

Es müssen für den Betrieb keine speziellen BIOS Einstellungen vorgenommen werden.

Für nähere Informationen siehe Anwenderhandbuch des verwendeten B&R Industrie PCs.

Touch Screen Funktionalität

Für den Betrieb des Touch Screens des angeschlossenen Panels am Monitor/Panel Anschluss, muss die COM C im BIOS aktiviert werden (zu finden im BIOS Menü unter „Advanced - Baseboard / Panel Features - Legacy Devices“).

5.4 Ein Automation Panel 800 über SDL onboard

An die integrierte SDL Schnittstelle (onboard) ist ein Automation Panel 800 über SDL Kabel angeschlossen. USB Geräte können nur direkt (ohne Hub) am Extension Keyboard angeschlossen werden.

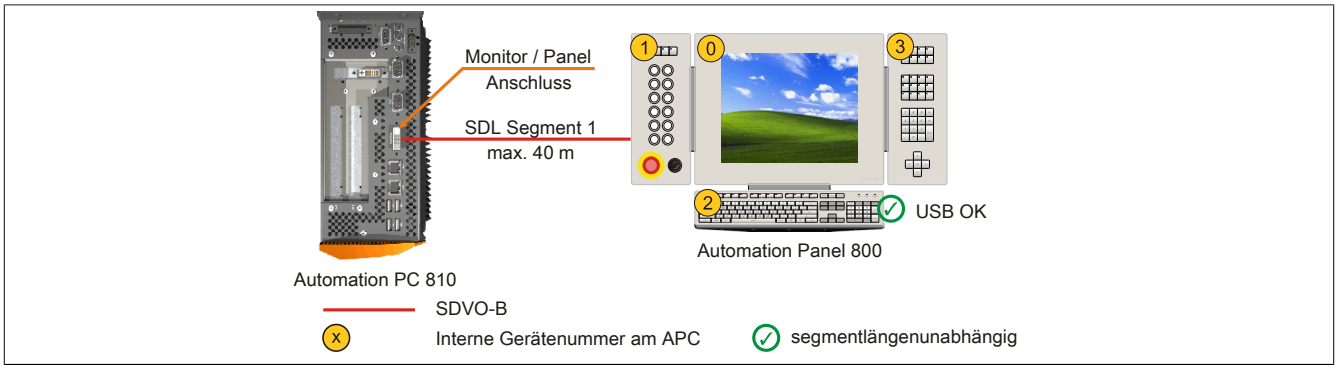


Abbildung 105: Ein Automation Panel 800 über SDL onboard (Symbolfoto)

5.4.1 Voraussetzung Grundsystem

Die nachfolgende Tabelle zeigt die möglichen Kombinationen von APC810 Systemeinheit und CPU Board um die in der obigen Abbildung gezeigte Konfiguration zu realisieren. Tritt bei der Kombination eine Einschränkung der max. Auflösung auf, so kann man dies auch folgender Tabelle entnehmen (z.B. für den Anschluss eines nicht B&R Automation Panel 900 Gerätes).

CPU Board	mit Systemeinheit				Einschränkung Auflösung
	5PC810.SX01-00	5PC810.SX02-00	5PC810.SX03-00	5PC810.SX05-00	
5PC800.B945-00 5PC800.B945-10	✓	✓	✓	✓	max. UXGA
5PC800.B945-01 5PC800.B945-11	✓	✓	✓	✓	max. UXGA
5PC800.B945-02 5PC800.B945-12	✓	✓	✓	✓	max. UXGA
5PC800.B945-03 5PC800.B945-13	✓	✓	✓	✓	max. UXGA
5PC800.B945-04 5PC800.B945-14	✓	✓	✓	✓	max. UXGA
5PC800.B945-05	✓	✓	✓	✓	max. UXGA

Tabelle 162: Mögliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board

5.4.2 Kabel

Auswahl eines Automation Panel 800 SDL Kabels aus der nachfolgenden Tabelle.

Bestellnummer	Beschreibung	Länge
5CASDL.0018-20	SDL Kabel flex für Automation Panel 800, 1,8 m.	1,8 m ±20 mm
5CASDL.0050-20	SDL Kabel flex für Automation Panel 800, 5 m.	5 m ±45 mm
5CASDL.0100-20	SDL Kabel flex für Automation Panel 800, 10 m.	10 m ±90 mm
5CASDL.0150-20	SDL Kabel flex für Automation Panel 800, 15 m.	15 m ±135 mm
5CASDL.0200-20	SDL Kabel flex für Automation Panel 800, 20 m.	20 m ±180 mm
5CASDL.0250-20	SDL Kabel flex für Automation Panel 800, 25 m.	25 m ±230 mm
5CASDL.0300-30	SDL Kabel flex für Automation Panel 800 mit Extender, 30 m.	30 m ±280 mm
5CASDL.0400-30	SDL Kabel flex für Automation Panel 800 mit Extender, 40 m.	40 m ±380 mm

Tabelle 163: Kabel für SDL Konfigurationen

Information:

Detaillierte technische Daten zu den Kabeln siehe Automation Panel 800 Anwenderhandbuch. Dieses kann in elektronischer Form (pdf) von der B&R Homepage www.br-automation.com heruntergeladen werden.

5.4.2.1 Kabellängen und Auflösungen bei SDL-Übertragung

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen Segmentlänge und max. Auflösung in Abhängigkeit des SDL-Kabels:

Kabel	Auflösung
Segmentlänge [m]	XGA 1024 x 768
1,8	5CASDL.0018-20
5	5CASDL.0050-20
10	5CASDL.0100-20
15	5CASDL.0150-20
20	5CASDL.0200-20
25	5CASDL.0250-20
30	5CASDL.0300-30
40	5CASDL.0400-30

Tabelle 164: Kabellängen und Auflösungen bei SDL-Übertragung

5.4.3 BIOS Einstellungen

Es müssen für den Betrieb keine speziellen BIOS Einstellungen vorgenommen werden.

Für nähere Informationen siehe Anwenderhandbuch des verwendeten B&R Industrie PCs.

Touch Screen Funktionalität

Für den Betrieb des Touch Screens des angeschlossenen Panels am Monitor/Panel Anschluss, muss die COM C im BIOS aktiviert werden (zu finden im BIOS Menü unter „Advanced - Baseboard / Panel Features - Legacy Devices“).

5.5 Ein AP900 und ein AP800 über SDL onboard

An die integrierte SDL Schnittstelle (onboard) sind ein Automation Panel 900 und ein Automation Panel 800 über SDL angeschlossen.

USB wird bis zu einer maximalen Distanz (Segment 1 + Segment 2) von 30 m an den beiden Displays unterstützt. Ab einer maximalen Distanz von 30 m steht USB ausschließlich nur am ersten Display (front- und rückseitig), bis maximal 40 m, zur Verfügung. USB Geräte können nur direkt (ohne Hub) am Automation Panel 900 bzw. am Extension Keyboard angeschlossen werden.

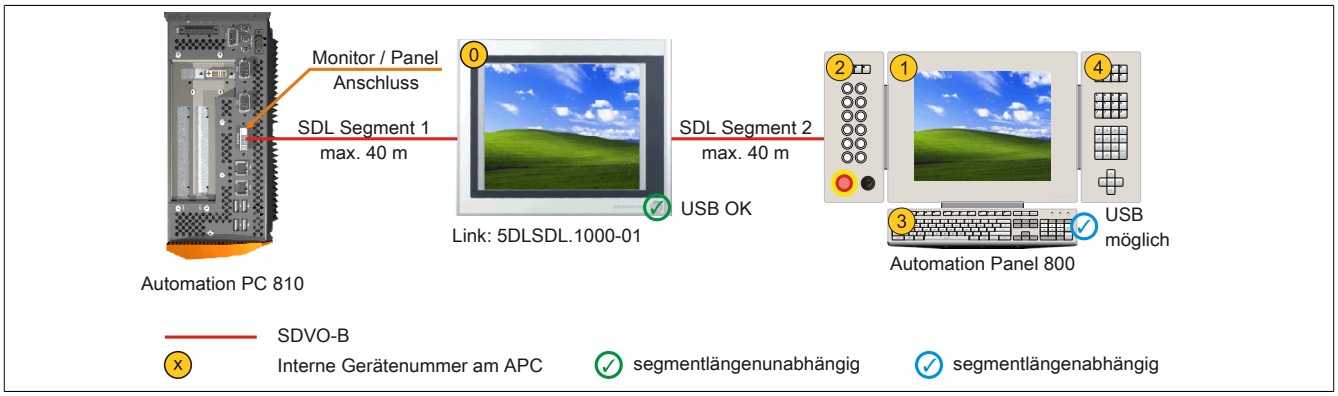


Abbildung 106: Ein AP900 und ein AP800 über SDL onboard (Symbolfoto)

5.5.1 Voraussetzung Grundsystem

Die nachfolgende Tabelle zeigt die möglichen Kombinationen von APC810 Systemeinheit und CPU Board um die in der obigen Abbildung gezeigte Konfiguration zu realisieren. Tritt bei der Kombination eine Einschränkung der max. Auflösung auf, so kann man dies auch folgender Tabelle entnehmen (z.B. für den Anschluss eines nicht B&R Automation Panel 900 Gerätes).

CPU Board	mit Systemeinheit				Einschränkung Auflösung
	5PC810.SX01-00	5PC810.SX02-00	5PC810.SX03-00	5PC810.SX05-00	
5PC800.B945-00 5PC800.B945-10	✓	✓	✓	✓	max. UXGA
5PC800.B945-01 5PC800.B945-11	✓	✓	✓	✓	max. UXGA
5PC800.B945-02 5PC800.B945-12	✓	✓	✓	✓	max. UXGA
5PC800.B945-03 5PC800.B945-13	✓	✓	✓	✓	max. UXGA
5PC800.B945-04 5PC800.B945-14	✓	✓	✓	✓	max. UXGA
5PC800.B945-05	✓	✓	✓	✓	max. UXGA

Tabelle 165: Mögliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board

5.5.2 Linkbaugruppe

Information:

Für jedes verwendete Gerät muss die entsprechende Linkbaugruppe ausgewählt werden!

Bestellnummer	Beschreibung	Anmerkung
5DLSDL.1000-01	**Automation Panel Link SDL Transceiver** Anschlüsse für SDL in und SDL out; Übertragung von Displaydaten, Touch Screen, USB 1.1, Matrixtasten, und Servicedaten; 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen).	für Automation Panel 900

Tabelle 166: Linkbaugruppen

5.5.3 Kabel

Auswahl eines SDL-Kabels für den Anschluss des AP900 Displays an das AP900 Display siehe "Kabel" auf Seite 209.

Auswahl eines SDL-Kabels für den Anschluss des AP800 Displays an das AP900 Display siehe "Kabel" auf Seite 211.

Information:

Detaillierte technische Daten zu den Kabeln siehe Kapitel "Zubehör".

5.5.4 BIOS Einstellungen

Es müssen für den Betrieb keine speziellen BIOS Einstellungen vorgenommen werden.

Für nähere Informationen siehe Anwenderhandbuch des verwendeten B&R Industrie PCs.

Touch Screen Funktionalität

Für den Betrieb des Touch Screens des angeschlossenen Panels am Monitor/Panel Anschluss, muss die COM C im BIOS aktiviert werden (zu finden im BIOS Menü unter „Advanced - Baseboard / Panel Features - Legacy Devices“).

5.6 Vier Automation Panel 900 über SDL onboard

An die integrierte SDL Schnittstelle (onboard) ist ein Automation Panel 900 über SDL Kabel angeschlossen. An diesem Automation Panel werden bis zu drei weitere Automation Panel des selben Typs über SDL Kabel betrieben. Alle vier Panel zeigen den gleichen Bildinhalt an (Display Clone).

USB wird bis zu einer maximalen Distanz (SDL Segment 1 + SDL Segment 2) von 30 m an den ersten beiden Panel (front- und rückseitig) unterstützt. Ab einer Distanz von 30 m steht USB ausschließlich nur mehr am ersten Panel (front- und rückseitig) zur Verfügung. USB Geräte können nur direkt (ohne Hub) an die Automation Panel angeschlossen werden.

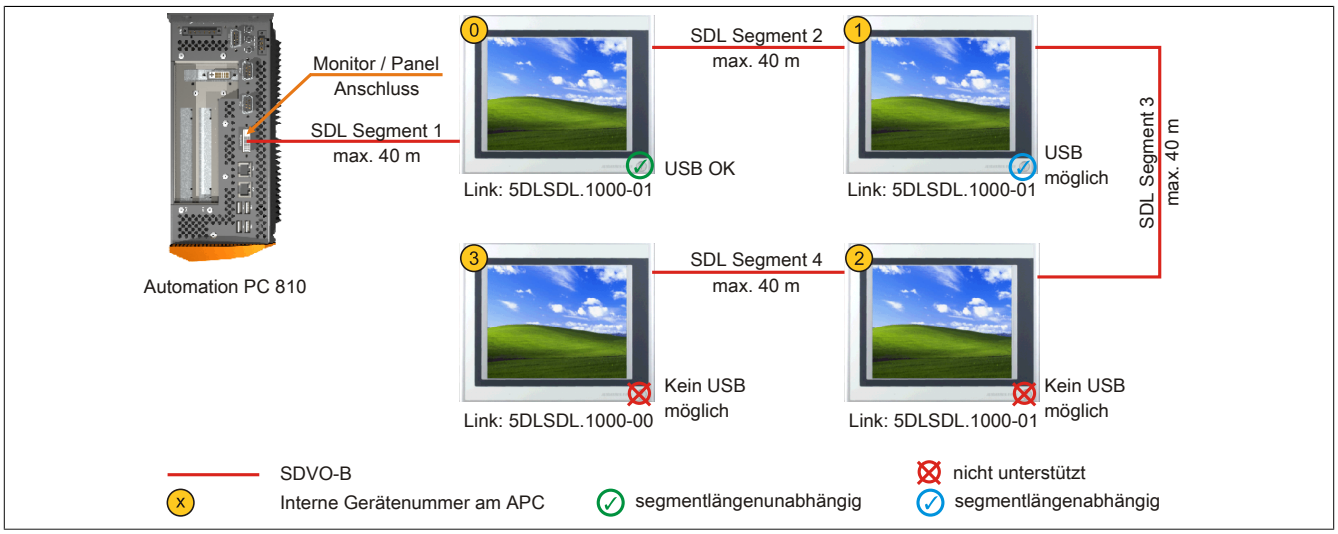


Abbildung 107: Vier Automation Panel 900 über SDL onboard (Symbolfoto)

5.6.1 Voraussetzung Grundsystem

Die nachfolgende Tabelle zeigt die möglichen Kombinationen von APC810 Systemeinheit und CPU Board um die in der obigen Abbildung gezeigte Konfiguration zu realisieren. Tritt bei der Kombination eine Einschränkung der max. Auflösung auf, so kann man dies auch folgender Tabelle entnehmen (z.B. für den Anschluss eines nicht B&R Automation Panel 900 Gerätes).

CPU Board	mit Systemeinheit				Einschränkung Auflösung
	5PC810.SX01-00	5PC810.SX02-00	5PC810.SX03-00	5PC810.SX05-00	
5PC800.B945-00 5PC800.B945-10	✓	✓	✓	✓	max. UXGA
5PC800.B945-01 5PC800.B945-11	✓	✓	✓	✓	max. UXGA
5PC800.B945-02 5PC800.B945-12	✓	✓	✓	✓	max. UXGA
5PC800.B945-03 5PC800.B945-13	✓	✓	✓	✓	max. UXGA
5PC800.B945-04 5PC800.B945-14	✓	✓	✓	✓	max. UXGA
5PC800.B945-05	✓	✓	✓	✓	max. UXGA

Tabelle 167: Mögliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board

5.6.2 Linkbaugruppen

Information:

Für jedes verwendete Gerät muss die entsprechende Linkbaugruppe ausgewählt werden!

Bestellnummer	Beschreibung	Anmerkung
5DLSDL.1000-00	**Automation Panel Link SDL Receiver** Anschluss für SDL in; Übertragung von Displaydaten, Touch Screen, USB 1.1, Matrixtasten, und Servicedaten; 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen).	für Automation Panel 900
5DLSDL.1000-01	**Automation Panel Link SDL Transceiver** Anschlüsse für SDL in und SDL out; Übertragung von Displaydaten, Touch Screen, USB 1.1, Matrixtasten, und Servicedaten; 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen).	für Automation Panel 900

Tabelle 168: Linkbaugruppen

5.6.3 Kabel

Auswahl eines Automation Panel 900 Kabels aus der nachfolgenden Tabelle.

Bestellnummer	Beschreibung	Länge
5CASDL.0008-00	SDL Kabel, 0,8 m.	0,8 m ±25 mm
5CASDL.0018-00	SDL Kabel, 1,8 m.	1,8 m ±30 mm
5CASDL.0050-00	SDL Kabel, 5 m.	5 m ±30 mm
5CASDL.0100-00	SDL Kabel, 10 m.	10 m ±50 mm
5CASDL.0150-00	SDL Kabel, 15 m.	15 m ±100 mm
5CASDL.0200-00	SDL Kabel, 20 m.	20 m ±100 mm
5CASDL.0250-00	SDL Kabel, 25 m.	25 m ±100 mm
5CASDL.0300-00	SDL Kabel, 30 m.	30 m ±100 mm
5CASDL.0018-03	SDL Kabel flex, 1,8 m.	1,8 m ±20 mm
5CASDL.0050-03	SDL Kabel flex, 5 m.	5 m ±45 mm
5CASDL.0100-03	SDL Kabel flex, 10 m.	10 m ±90 mm
5CASDL.0150-03	SDL Kabel flex, 15 m.	15 m ±135 mm
5CASDL.0200-03	SDL Kabel flex, 20 m.	20 m ±180 mm
5CASDL.0250-03	SDL Kabel flex, 25 m.	25 m ±225 mm
5CASDL.0300-03	SDL Kabel flex, 30 m.	30 m ±270 mm
5CASDL.0300-13	SDL Kabel flex mit Extender, 30 m.	30 m ±280 mm
5CASDL.0400-13	SDL Kabel flex mit Extender, 40 m.	40 m ±380 mm
5CASDL.0430-13	SDL Kabel flex mit Extender, 43 m.	43 m ±410 mm
5CASDL.0018-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 1,8 m.	1,8 m ±30 mm
5CASDL.0050-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 5 m.	5 m ±50 mm
5CASDL.0100-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 10 m.	10 m ±100 mm
5CASDL.0150-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 15 m.	15 m ±100 mm

Tabelle 169: Kabel für SDL Konfigurationen

Information:

Detaillierte technische Daten zu den Kabeln siehe Automation Panel 900 Anwenderhandbuch. Dieses kann in elektronischer Form (pdf) von der B&R Homepage www.br-automation.com heruntergeladen werden.

5.6.3.1 Kabellängen und Auflösungen bei SDL-Übertragung

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen Segmentlänge und max. Auflösung in Abhängigkeit des SDL-Kabels:

SDL-Kabel	Auflösung						
Segmentlänge [m]	VGA 640 x 480	SVGA 800 x 600	XGA 1024 x 768	HD 1366 x 768	SXGA 1280 x 1024	UXGA 1600 x 1200	FHD 1920 x 1080
0,8	5CASDL.0008-00	5CASDL.0008-00	5CASDL.0008-00	5CASDL.0008-00	5CASDL.0008-00	5CASDL.0008-00	5CASDL.0008-00
1,8	5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-03
5	5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-03
10	5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-03
15	5CASDL.0150-00 5CASDL.0150-01 5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-00 5CASDL.0150-01 5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-00 5CASDL.0150-01 5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-00 5CASDL.0150-01 5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-00 5CASDL.0150-01 5CASDL.0150-03	- - -	- - 5CASDL.0150-03
20	5CASDL.0200-00 5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-00 5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-00 5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-00 5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-00 5CASDL.0200-03	- -	- 5CASDL.0200-03
25	5CASDL.0250-00 5CASDL.0250-03	5CASDL.0250-00 5CASDL.0250-03	5CASDL.0250-00 5CASDL.0250-03	5CASDL.0250-00 5CASDL.0250-03	- -	- -	- -
30	5CASDL.0300-00 5CASDL.0300-03	5CASDL.0300-00 5CASDL.0300-03	- 5CASDL.0300-13	- 5CASDL.0300-13	- 5CASDL.0300-13	- -	- 5CASDL.0300-13
40	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	-	5CASDL.0400-13

Tabelle 170: Kabellängen und Auflösungen bei SDL-Übertragung

5.6.4 BIOS Einstellungen

Es müssen für den Betrieb keine speziellen BIOS Einstellungen vorgenommen werden.

Für nähere Informationen siehe Anwenderhandbuch des verwendeten B&R Industrie PCs.

Touch Screen Funktionalität

Für den Betrieb des Touch Screens des angeschlossenen Panels am Monitor/Panel Anschluss, muss die COM C im BIOS aktiviert werden (zu finden im BIOS Menü unter „Advanced - Baseboard / Panel Features - Legacy Devices“).

5.7 Ein Automation Panel 900 über SDL AP Link

An den optionalen SDL Transmitter (AP Link) ist ein Automation Panel 900 über SDL Kabel angeschlossen. USB Geräte können nur direkt (ohne Hub) an die Automation Panel angeschlossen werden.

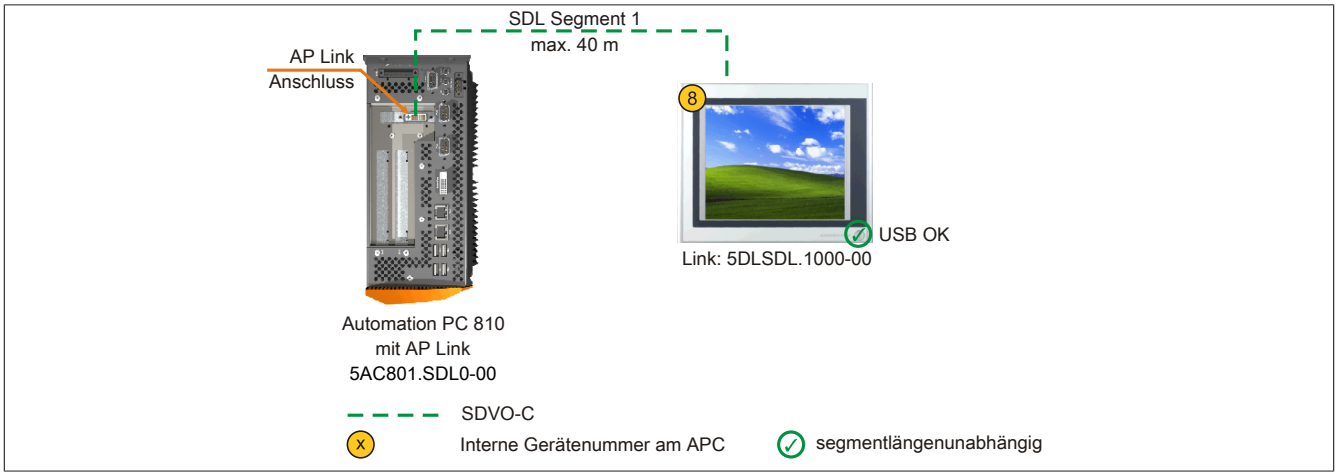


Abbildung 108: Ein Automation Panel 900 über SDL AP Link (Symbolfoto)

5.7.1 Voraussetzung Grundsystem

Die nachfolgende Tabelle zeigt die möglichen Kombinationen von APC810 Systemeinheit und CPU Board um die in der obigen Abbildung gezeigte Konfiguration zu realisieren. Tritt bei der Kombination eine Einschränkung der max. Auflösung auf, so kann man dies auch folgender Tabelle entnehmen (z.B. für den Anschluss eines nicht B&R Automation Panel 900 Gerätes).

CPU Board	mit Systemeinheit				Einschränkung Auflösung
	5PC810.SX01-00[1)]	5PC810.SX02-00	5PC810.SX03-00	5PC810.SX05-00	
5PC800.B945-00 5PC800.B945-10	-	✓	✓	✓	max. UXGA
5PC800.B945-01 5PC800.B945-11	-	✓	✓	✓	max. UXGA
5PC800.B945-02 5PC800.B945-12	-	✓	✓	✓	max. UXGA
5PC800.B945-03 5PC800.B945-13	-	✓	✓	✓	max. UXGA
5PC800.B945-04 5PC800.B945-14	-	✓	✓	✓	max. UXGA
5PC800.B945-05	-	✓	✓	✓	max. UXGA

Tabelle 171: Mögliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board

1) Keine Möglichkeit zur AP Link Montage.

5.7.2 Linkbaugruppe

> **Information:**
>
> **Für jedes verwendete Gerät muss die entsprechende Linkbaugruppe ausgewählt werden!**

Bestellnummer	Beschreibung	Anmerkung
5DLSDL.1000-00	**Automation Panel Link SDL Receiver** Anschluss für SDL in; Übertragung von Displaydaten, Touch Screen, USB 1.1, Matrixtasten, und Servicedaten; 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen).	für Automation Panel 900
5AC801.SDL0-00	**APC810 AP Link SDL Transmitter** Automation Panel Link Transmitter SDL	für Automation PC 810

Tabelle 172: Linkbaugruppen

5.7.3 Kabel

Auswahl eines Automation Panel 900 Kabels aus der nachfolgenden Tabelle.

Bestellnummer	Beschreibung	Länge
5CASDL.0008-00	SDL Kabel, 0,8 m.	0,8 m ±25 mm
5CASDL.0018-00	SDL Kabel, 1,8 m.	1,8 m ±30 mm
5CASDL.0050-00	SDL Kabel, 5 m.	5 m ±30 mm
5CASDL.0100-00	SDL Kabel, 10 m.	10 m ±50 mm

Tabelle 173: Kabel für SDL Konfigurationen

Bestellnummer	Beschreibung	Länge
5CASDL.0150-00	SDL Kabel, 15 m.	15 m ±100 mm
5CASDL.0200-00	SDL Kabel, 20 m.	20 m ±100 mm
5CASDL.0250-00	SDL Kabel, 25 m.	25 m ±100 mm
5CASDL.0300-00	SDL Kabel, 30 m.	30 m ±100 mm
5CASDL.0018-03	SDL Kabel flex, 1,8 m.	1,8 m ±20 mm
5CASDL.0050-03	SDL Kabel flex, 5 m.	5 m ±45 mm
5CASDL.0100-03	SDL Kabel flex, 10 m.	10 m ±90 mm
5CASDL.0150-03	SDL Kabel flex, 15 m.	15 m ±135 mm
5CASDL.0200-03	SDL Kabel flex, 20 m.	20 m ±180 mm
5CASDL.0250-03	SDL Kabel flex, 25 m.	25 m ±225 mm
5CASDL.0300-03	SDL Kabel flex, 30 m.	30 m ±270 mm
5CASDL.0300-13	SDL Kabel flex mit Extender, 30 m.	30 m ±280 mm
5CASDL.0400-13	SDL Kabel flex mit Extender, 40 m.	40 m ±380 mm
5CASDL.0430-13	SDL Kabel flex mit Extender, 43 m.	43 m ±410 mm
5CASDL.0018-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 1,8 m.	1,8 m ±30 mm
5CASDL.0050-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 5 m.	5 m ±50 mm
5CASDL.0100-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 10 m.	10 m ±100 mm
5CASDL.0150-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 15 m.	15 m ±100 mm

Tabelle 173: Kabel für SDL Konfigurationen

Information:

Detaillierte technische Daten zu den Kabeln siehe Automation Panel 900 Anwenderhandbuch. Dieses kann in elektronischer Form (pdf) von der B&R Homepage www.br-automation.com heruntergeladen werden.

5.7.3.1 Kabellängen und Auflösungen bei SDL-Übertragung

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen Segmentlänge und max. Auflösung in Abhängigkeit des SDL-Kabels:

SDL-Kabel	Auflösung						
Segmentlänge [m]	VGA 640 x 480	SVGA 800 x 600	XGA 1024 x 768	HD 1366 x 768	SXGA 1280 x 1024	UXGA 1600 x 1200	FHD 1920 x 1080
0,8	5CASDL.0008-00	5CASDL.0008-00	5CASDL.0008-00	5CASDL.0008-00	5CASDL.0008-00	5CASDL.0008-00	5CASDL.0008-00
1,8	5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-03
5	5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-03
10	5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-03
15	5CASDL.0150-00 5CASDL.0150-01 5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-00 5CASDL.0150-01 5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-00 5CASDL.0150-01 5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-00 5CASDL.0150-01 5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-00 5CASDL.0150-01 5CASDL.0150-03	- - -	- - 5CASDL.0150-03
20	5CASDL.0200-00 5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-00 5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-00 5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-00 5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-00 5CASDL.0200-03	- -	- 5CASDL.0200-03
25	5CASDL.0250-00 5CASDL.0250-03	5CASDL.0250-00 5CASDL.0250-03	5CASDL.0250-00 5CASDL.0250-03	5CASDL.0250-00 5CASDL.0250-03	- -	- -	- -
30	5CASDL.0300-00 5CASDL.0300-03	5CASDL.0300-00 5CASDL.0300-03	- 5CASDL.0300-13	- 5CASDL.0300-13	- 5CASDL.0300-13	- -	- 5CASDL.0300-13
40	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	-	5CASDL.0400-13

Tabelle 174: Kabellängen und Auflösungen bei SDL-Übertragung

5.7.4 BIOS Einstellungen

Es müssen für den Betrieb keine speziellen BIOS Einstellungen vorgenommen werden.

Für nähere Informationen siehe Anwenderhandbuch des verwendeten B&R Industrie PCs.

Touch Screen Funktionalität

Für den Betrieb des Touch Screens des angeschlossenen Panels am AP Link Anschluss, muss die COM D im BIOS aktiviert werden (zu finden im BIOS Menü unter „Advanced - Baseboard / Panel Features - Legacy Devices“).

5.8 Vier Automation Panel 900 über SDL AP Link

An den optionalen SDL Transmitter (AP Link) ist ein Automation Panel 900 über ein SDL Kabel angeschlossen. An diesem Automation Panel werden drei weitere Automation Panel des selben Typs über SDL betrieben. Alle vier Panel zeigen den gleichen Bildinhalt an (Display Clone).

USB wird bis zu einer maximalen Distanz (SDL Segment 1 + SDL Segment 2) von 30 m an den ersten beiden Panel (front- und rückseitig) unterstützt. Ab einer Distanz von 30 m steht USB ausschließlich nur mehr am ersten Panel (front- und rückseitig) zur Verfügung. USB Geräte können nur direkt (ohne Hub) an die Automation Panel angeschlossen werden.

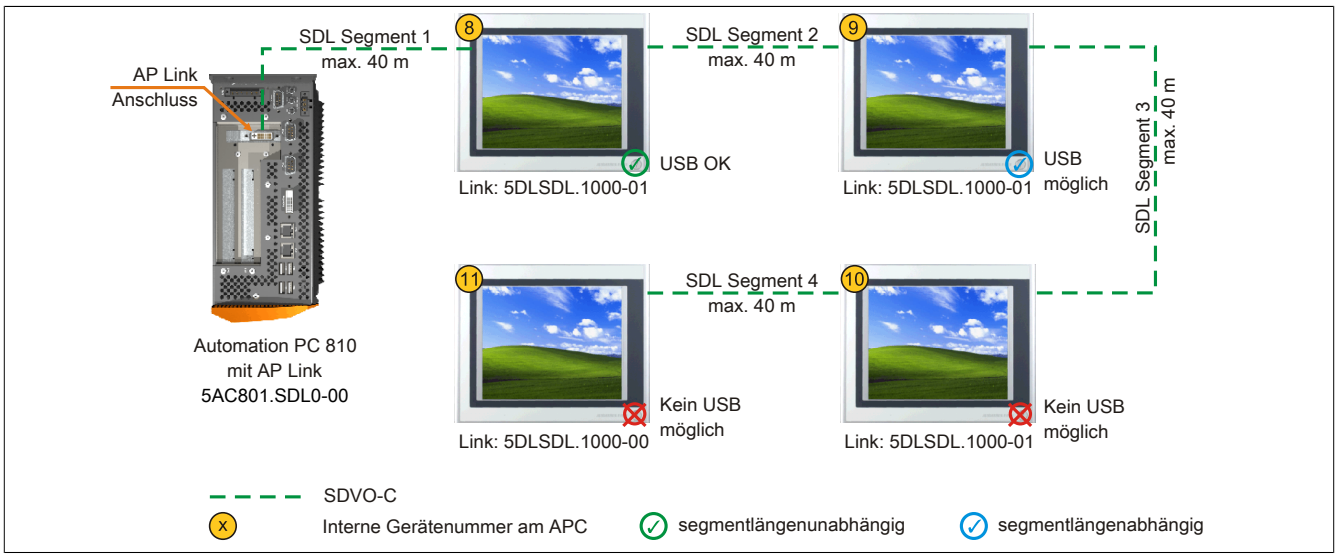


Abbildung 109: Vier Automation Panel 900 über SDL AP Link (Symbolfoto)

5.8.1 Voraussetzung Grundsystem

Die nachfolgende Tabelle zeigt die möglichen Kombinationen von APC810 Systemeinheit und CPU Board um die in der obigen Abbildung gezeigte Konfiguration zu realisieren. Tritt bei der Kombination eine Einschränkung der max. Auflösung auf, so kann man dies auch folgender Tabelle entnehmen (z.B. für den Anschluss eines nicht B&R Automation Panel 900 Gerätes).

CPU Board	mit Systemeinheit				Einschränkung Auflösung
	5PC810.SX01-00[1)]	5PC810.SX02-00	5PC810.SX03-00	5PC810.SX05-00	
5PC800.B945-00 5PC800.B945-10	-	✓	✓	✓	max. UXGA
5PC800.B945-01 5PC800.B945-11	-	✓	✓	✓	max. UXGA
5PC800.B945-02 5PC800.B945-12	-	✓	✓	✓	max. UXGA
5PC800.B945-03 5PC800.B945-13	-	✓	✓	✓	max. UXGA
5PC800.B945-04 5PC800.B945-14	-	✓	✓	✓	max. UXGA
5PC800.B945-05	-	✓	✓	✓	max. UXGA

Tabelle 175: Mögliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board

1) Keine Möglichkeit zur AP Link Montage.

5.8.2 Linkbaugruppe

Information:

Für jedes verwendete Gerät muss die entsprechende Linkbaugruppe ausgewählt werden!

Bestellnummer	Beschreibung	Anmerkung
5DLSDL.1000-00	**Automation Panel Link SDL Receiver** Anschluss für SDL in; Übertragung von Displaydaten, Touch Screen, USB 1.1, Matrixtasten, und Servicedaten; 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen).	für Automation Panel 900
5DLSDL.1000-01	**Automation Panel Link SDL Transceiver** Anschlüsse für SDL in und SDL out; Übertragung von Displaydaten, Touch Screen, USB 1.1, Matrixtasten, und Servicedaten; 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen).	für Automation Panel 900
5AC801.SDL0-00	**APC810 AP Link SDL Transmitter** Automation Panel Link Transmitter SDL	für Automation PC 810

Tabelle 176: Linkbaugruppen

5.8.3 Kabel

Auswahl eines Automation Panel 900 Kabels aus der nachfolgenden Tabelle.

Bestellnummer	Beschreibung	Länge
5CASDL.0008-00	SDL Kabel, 0,8 m.	0,8 m ±25 mm
5CASDL.0018-00	SDL Kabel, 1,8 m.	1,8 m ±30 mm
5CASDL.0050-00	SDL Kabel, 5 m.	5 m ±30 mm
5CASDL.0100-00	SDL Kabel, 10 m.	10 m ±50 mm
5CASDL.0150-00	SDL Kabel, 15 m.	15 m ±100 mm
5CASDL.0200-00	SDL Kabel, 20 m.	20 m ±100 mm
5CASDL.0250-00	SDL Kabel, 25 m.	25 m ±100 mm
5CASDL.0300-00	SDL Kabel, 30 m.	30 m ±100 mm
5CASDL.0018-03	SDL Kabel flex, 1,8 m.	1,8 m ±20 mm
5CASDL.0050-03	SDL Kabel flex, 5 m.	5 m ±45 mm
5CASDL.0100-03	SDL Kabel flex, 10 m.	10 m ±90 mm
5CASDL.0150-03	SDL Kabel flex, 15 m.	15 m ±135 mm
5CASDL.0200-03	SDL Kabel flex, 20 m.	20 m ±180 mm
5CASDL.0250-03	SDL Kabel flex, 25 m.	25 m ±225 mm
5CASDL.0300-03	SDL Kabel flex, 30 m.	30 m ±270 mm
5CASDL.0300-13	SDL Kabel flex mit Extender, 30 m.	30 m ±280 mm
5CASDL.0400-13	SDL Kabel flex mit Extender, 40 m.	40 m ±380 mm
5CASDL.0430-13	SDL Kabel flex mit Extender, 43 m.	43 m ±410 mm
5CASDL.0018-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 1,8 m.	1,8 m ±30 mm
5CASDL.0050-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 5 m.	5 m ±50 mm
5CASDL.0100-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 10 m.	10 m ±100 mm
5CASDL.0150-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 15 m.	15 m ±100 mm

Tabelle 177: Kabel für SDL Konfigurationen

Information:

Detaillierte technische Daten zu den Kabeln siehe Automation Panel 900 Anwenderhandbuch. Dieses kann in elektronischer Form (pdf) von der B&R Homepage www.br-automation.com heruntergeladen werden.

5.8.3.1 Kabellängen und Auflösungen bei SDL-Übertragung

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen Segmentlänge und max. Auflösung in Abhängigkeit des SDL-Kabels:

SDL-Kabel	Auflösung						
Segmentlänge [m]	VGA 640 x 480	SVGA 800 x 600	XGA 1024 x 768	HD 1366 x 768	SXGA 1280 x 1024	UXGA 1600 x 1200	FHD 1920 x 1080
0,8	5CASDL.0008-00	5CASDL.0008-00	5CASDL.0008-00	5CASDL.0008-00	5CASDL.0008-00	5CASDL.0008-00	5CASDL.0008-00
1,8	5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-03
5	5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-03
10	5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-03
15	5CASDL.0150-00 5CASDL.0150-01 5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-00 5CASDL.0150-01 5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-00 5CASDL.0150-01 5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-00 5CASDL.0150-01 5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-00 5CASDL.0150-01 5CASDL.0150-03	- - -	- - 5CASDL.0150-03
20	5CASDL.0200-00 5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-00 5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-00 5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-00 5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-00 5CASDL.0200-03	- -	- 5CASDL.0200-03
25	5CASDL.0250-00 5CASDL.0250-03	5CASDL.0250-00 5CASDL.0250-03	5CASDL.0250-00 5CASDL.0250-03	5CASDL.0250-00 5CASDL.0250-03	- -	- -	- -
30	5CASDL.0300-00 5CASDL.0300-03	5CASDL.0300-00 5CASDL.0300-03	- 5CASDL.0300-13	- 5CASDL.0300-13	- 5CASDL.0300-13	- -	- 5CASDL.0300-13
40	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	-	5CASDL.0400-13

Tabelle 178: Kabellängen und Auflösungen bei SDL-Übertragung

5.8.4 BIOS Einstellungen

Es müssen für den Betrieb keine speziellen BIOS Einstellungen vorgenommen werden.

Für nähere Informationen siehe Anwenderhandbuch des verwendeten B&R Industrie PCs.

Touch Screen Funktionalität

Für den Betrieb des Touch Screens des angeschlossenen Panels am AP Link Anschluss, muss die COM D im BIOS aktiviert werden (zu finden im BIOS Menü unter „Advanced - Baseboard / Panel Features - Legacy Devices“).

5.9 Zwei Automation Panel 900 über SDL onboard und SDL AP Link

An die integrierte SDL Schnittstelle (onboard) ist ein Automation Panel 900 (max. UXGA) über SDL angeschlossen. An dem optionalen SDL Transmitter (AP Link) wird ein weiteres Automation Panel 900 (max. UXGA) über SDL betrieben. Die Automation Panel zeigen unterschiedliche Bildinhalte (Erweiterter Desktop) und können verschiedene Typen sein.

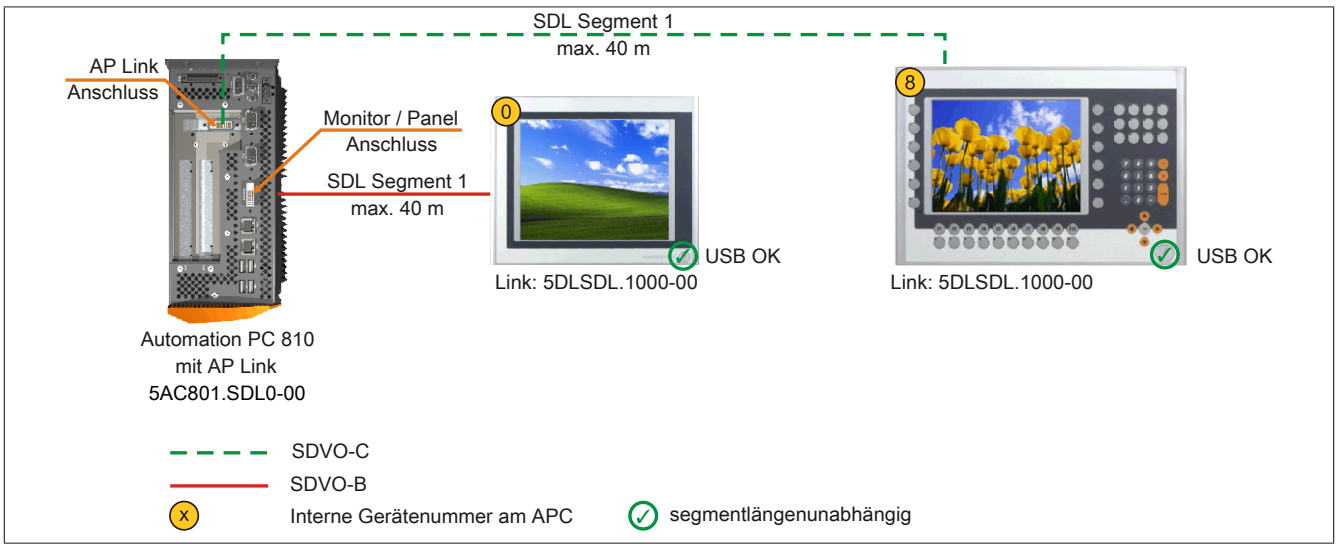


Abbildung 110: Zwei Automation Panel 900 über SDL onboard und SDL AP Link (Symbolfoto)

5.9.1 Voraussetzung Grundsystem

Die nachfolgende Tabelle zeigt die möglichen Kombinationen von APC810 Systemeinheit und CPU Board um die in der obigen Abbildung gezeigte Konfiguration zu realisieren. Tritt bei der Kombination eine Einschränkung der max. Auflösung auf, so kann man dies auch folgender Tabelle entnehmen (z.B. für den Anschluss eines nicht B&R Automation Panel 900 Gerätes).

CPU Board	mit Systemeinheit				Einschränkung Auflösung
	5PC810.SX01-00[1)]	5PC810.SX02-00	5PC810.SX03-00	5PC810.SX05-00	
5PC800.B945-00 5PC800.B945-10	-	✓	✓	✓	max. UXGA
5PC800.B945-01 5PC800.B945-11	-	✓	✓	✓	max. UXGA
5PC800.B945-02 5PC800.B945-12	-	✓	✓	✓	max. UXGA
5PC800.B945-03 5PC800.B945-13	-	✓	✓	✓	max. UXGA
5PC800.B945-04 5PC800.B945-14	-	✓	✓	✓	max. UXGA
5PC800.B945-05	-	✓	✓	✓	max. UXGA

Tabelle 179: Mögliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board

1) Keine Möglichkeit zur AP Link Montage.

5.9.2 Linkbaugruppe

Information:

Für jedes verwendete Gerät muss die entsprechende Linkbaugruppe ausgewählt werden!

Bestellnummer	Beschreibung	Anmerkung
5DLSDL.1000-00	**Automation Panel Link SDL Receiver** Anschluss für SDL in; Übertragung von Displaydaten, Touch Screen, USB 1.1, Matrixtasten, und Servicedaten; 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen).	für Automation Panel 900
5AC801.SDL0-00	**APC810 AP Link SDL Transmitter** Automation Panel Link Transmitter SDL	für Automation PC 810

Tabelle 180: Linkbaugruppen

5.9.3 Kabel

Auswahl eines Automation Panel 900 Kabels aus der nachfolgenden Tabelle.

Bestellnummer	Beschreibung	Länge
5CASDL.0008-00	SDL Kabel, 0,8 m.	0,8 m ±25 mm
5CASDL.0018-00	SDL Kabel, 1,8 m.	1,8 m ±30 mm
5CASDL.0050-00	SDL Kabel, 5 m.	5 m ±30 mm
5CASDL.0100-00	SDL Kabel, 10 m.	10 m ±50 mm
5CASDL.0150-00	SDL Kabel, 15 m.	15 m ±100 mm
5CASDL.0200-00	SDL Kabel, 20 m.	20 m ±100 mm
5CASDL.0250-00	SDL Kabel, 25 m.	25 m ±100 mm
5CASDL.0300-00	SDL Kabel, 30 m.	30 m ±100 mm
5CASDL.0018-03	SDL Kabel flex, 1,8 m.	1,8 m ±20 mm
5CASDL.0050-03	SDL Kabel flex, 5 m.	5 m ±45 mm
5CASDL.0100-03	SDL Kabel flex, 10 m.	10 m ±90 mm
5CASDL.0150-03	SDL Kabel flex, 15 m.	15 m ±135 mm
5CASDL.0200-03	SDL Kabel flex, 20 m.	20 m ±180 mm
5CASDL.0250-03	SDL Kabel flex, 25 m.	25 m ±225 mm
5CASDL.0300-03	SDL Kabel flex, 30 m.	30 m ±270 mm
5CASDL.0300-13	SDL Kabel flex mit Extender, 30 m.	30 m ±280 mm
5CASDL.0400-13	SDL Kabel flex mit Extender, 40 m.	40 m ±380 mm
5CASDL.0430-13	SDL Kabel flex mit Extender, 43 m.	43 m ±410 mm
5CASDL.0018-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 1,8 m.	1,8 m ±30 mm
5CASDL.0050-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 5 m.	5 m ±50 mm
5CASDL.0100-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 10 m.	10 m ±100 mm
5CASDL.0150-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 15 m.	15 m ±100 mm

Tabelle 181: Kabel für SDL Konfigurationen

Information:

Detaillierte technische Daten zu den Kabeln siehe Automation Panel 900 Anwenderhandbuch. Dieses kann in elektronischer Form (pdf) von der B&R Homepage www.br-automation.com heruntergeladen werden.

5.9.3.1 Kabellängen und Auflösungen bei SDL-Übertragung

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen Segmentlänge und max. Auflösung in Abhängigkeit des SDL-Kabels:

SDL-Kabel	Auflösung						
Segmentlänge [m]	VGA 640 x 480	SVGA 800 x 600	XGA 1024 x 768	HD 1366 x 768	SXGA 1280 x 1024	UXGA 1600 x 1200	FHD 1920 x 1080
0,8	5CASDL.0008-00	5CASDL.0008-00	5CASDL.0008-00	5CASDL.0008-00	5CASDL.0008-00	5CASDL.0008-00	5CASDL.0008-00
1,8	5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-03
5	5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-03
10	5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-03
15	5CASDL.0150-00 5CASDL.0150-01 5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-00 5CASDL.0150-01 5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-00 5CASDL.0150-01 5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-00 5CASDL.0150-01 5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-00 5CASDL.0150-01 5CASDL.0150-03	- - -	- - 5CASDL.0150-03
20	5CASDL.0200-00 5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-00 5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-00 5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-00 5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-00 5CASDL.0200-03	- -	- 5CASDL.0200-03
25	5CASDL.0250-00 5CASDL.0250-03	5CASDL.0250-00 5CASDL.0250-03	5CASDL.0250-00 5CASDL.0250-03	5CASDL.0250-00 5CASDL.0250-03	- -	- -	- -
30	5CASDL.0300-00 5CASDL.0300-03	5CASDL.0300-00 5CASDL.0300-03	- 5CASDL.0300-13	- 5CASDL.0300-13	- 5CASDL.0300-13	- -	- 5CASDL.0300-13
40	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	-	5CASDL.0400-13

Tabelle 182: Kabellängen und Auflösungen bei SDL-Übertragung

5.9.4 BIOS Einstellungen

Es müssen für den Betrieb keine speziellen BIOS Einstellungen vorgenommen werden.

Für nähere Informationen siehe Anwenderhandbuch des verwendeten B&R Industrie PCs.

Touch Screen Funktionalität

Für den Betrieb des Touch Screens der angeschlossenen Panel am Monitor/Panel bzw. AP Link Anschluss, muss die COM C bzw. COM D im BIOS aktiviert werden (zu finden im BIOS Menü unter „Advanced - Baseboard / Panel Features - Legacy Devices“).

5.10 Acht Automation Panel 900 über SDL onboard und SDL AP Link

An der integrierten SDL Schnittstelle (onboard) sind vier Automation Panel 900 (max. UXGA) über SDL angeschlossen. An den optionalen SDL Transmitter (AP Link) werden zusätzlich vier Automation Panel 900 (max. UXGA) betrieben. Die Automation Panel in jedem Strang müssen jeweils vom gleichen Typ sein. Die Bildinhalte der beiden Stränge sind verschieden (Erweiterter Desktop), wobei die Panel im jeweiligen Strang denselben Bildinhalt (Display Clone) zeigen.

USB wird bis zu einer maximalen Distanz (SDL Segment 1 + SDL Segment 2) von 30 m an den ersten beiden Panel (front- und rückseitig) der beiden Stränge unterstützt. Ab einer Distanz von 30 m steht USB ausschließlich nur mehr jeweils am ersten Panel jedes Stranges zur Verfügung. USB Geräte können dabei nur direkt (ohne Hub) an die Automation Panel angeschlossen werden.

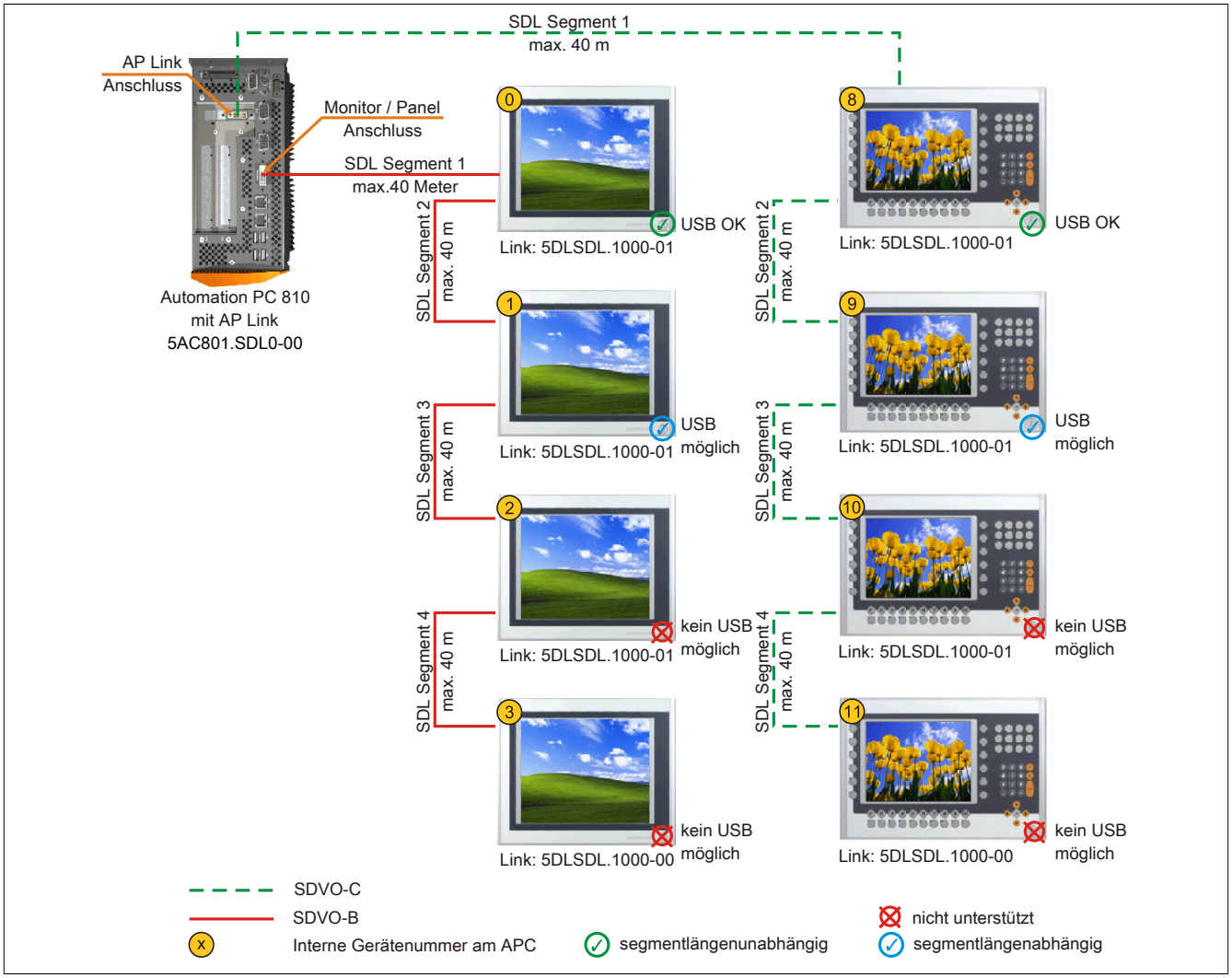


Abbildung 111: Acht Automation Panel 900 über SDL onboard und SDL AP Link (Symbolfoto)

5.10.1 Voraussetzung Grundsystem

Die nachfolgende Tabelle zeigt die möglichen Kombinationen von APC810 Systemeinheit und CPU Board um die in der obigen Abbildung gezeigte Konfiguration zu realisieren. Tritt bei der Kombination eine Einschränkung der max. Auflösung auf, so kann man dies auch folgender Tabelle entnehmen (z.B. für den Anschluss eines nicht B&R Automation Panel 900 Gerätes).

CPU Board	mit Systemeinheit				Einschränkung Auflösung
	5PC810.SX01-00[1)]	5PC810.SX02-00	5PC810.SX03-00	5PC810.SX05-00	
5PC800.B945-00 5PC800.B945-10	-	✓	✓	✓	max. UXGA
5PC800.B945-01 5PC800.B945-11	-	✓	✓	✓	max. UXGA

Tabelle 183: Mögliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board

CPU Board	mit Systemeinheit				Einschränkung Auflösung
	5PC810.SX01-00[1)]	5PC810.SX02-00	5PC810.SX03-00	5PC810.SX05-00	
5PC800.B945-02 5PC800.B945-12	-	✓	✓	✓	max. UXGA
5PC800.B945-03 5PC800.B945-13	-	✓	✓	✓	max. UXGA
5PC800.B945-04 5PC800.B945-14	-	✓	✓	✓	max. UXGA
5PC800.B945-05	-	✓	✓	✓	max. UXGA

Tabelle 183: Mögliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board

1) Keine Möglichkeit zur AP Link Montage.

5.10.2 Linkbaugruppe

Information:

Für jedes verwendete Gerät muss die entsprechende Linkbaugruppe ausgewählt werden!

Bestellnummer	Beschreibung	Anmerkung
5DLSDL.1000-00	**Automation Panel Link SDL Receiver** Anschluss für SDL in; Übertragung von Displaydaten, Touch Screen, USB 1.1, Matrixtasten, und Servicedaten; 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen).	für Automation Panel 900
5DLSDL.1000-01	**Automation Panel Link SDL Transceiver** Anschlüsse für SDL in und SDL out; Übertragung von Displaydaten, Touch Screen, USB 1.1, Matrixtasten, und Servicedaten; 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen).	für Automation Panel 900
5AC801.SDL0-00	**APC810 AP Link SDL Transmitter** Automation Panel Link Transmitter SDL	für Automation PC 810

Tabelle 184: Linkbaugruppen

5.10.3 Kabel

Auswahl eines Automation Panel 900 Kabels aus der nachfolgenden Tabelle.

Bestellnummer	Beschreibung	Länge
5CASDL.0008-00	SDL Kabel, 0,8 m.	0,8 m ±25 mm
5CASDL.0018-00	SDL Kabel, 1,8 m.	1,8 m ±30 mm
5CASDL.0050-00	SDL Kabel, 5 m.	5 m ±30 mm
5CASDL.0100-00	SDL Kabel, 10 m.	10 m ±50 mm
5CASDL.0150-00	SDL Kabel, 15 m.	15 m ±100 mm
5CASDL.0200-00	SDL Kabel, 20 m.	20 m ±100 mm
5CASDL.0250-00	SDL Kabel, 25 m.	25 m ±100 mm
5CASDL.0300-00	SDL Kabel, 30 m.	30 m ±100 mm
5CASDL.0018-03	SDL Kabel flex, 1,8 m.	1,8 m ±20 mm
5CASDL.0050-03	SDL Kabel flex, 5 m.	5 m ±45 mm
5CASDL.0100-03	SDL Kabel flex, 10 m.	10 m ±90 mm
5CASDL.0150-03	SDL Kabel flex, 15 m.	15 m ±135 mm
5CASDL.0200-03	SDL Kabel flex, 20 m.	20 m ±180 mm
5CASDL.0250-03	SDL Kabel flex, 25 m.	25 m ±225 mm
5CASDL.0300-03	SDL Kabel flex, 30 m.	30 m ±270 mm
5CASDL.0300-13	SDL Kabel flex mit Extender, 30 m.	30 m ±280 mm
5CASDL.0400-13	SDL Kabel flex mit Extender, 40 m.	40 m ±380 mm
5CASDL.0430-13	SDL Kabel flex mit Extender, 43 m.	43 m ±410 mm
5CASDL.0018-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 1,8 m.	1,8 m ±30 mm
5CASDL.0050-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 5 m.	5 m ±50 mm
5CASDL.0100-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 10 m.	10 m ±100 mm
5CASDL.0150-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 15 m.	15 m ±100 mm

Tabelle 185: Kabel für SDL Konfigurationen

Information:

Detaillierte technische Daten zu den Kabeln siehe Automation Panel 900 Anwenderhandbuch. Dieses kann in elektronischer Form (pdf) von der B&R Homepage www.br-automation.com heruntergeladen werden.

5.10.3.1 Kabellängen und Auflösungen bei SDL-Übertragung

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen Segmentlänge und max. Auflösung in Abhängigkeit des SDL-Kabels:

SDL-Kabel	Auflösung						
Segmentlänge [m]	VGA 640 x 480	SVGA 800 x 600	XGA 1024 x 768	HD 1366 x 768	SXGA 1280 x 1024	UXGA 1600 x 1200	FHD 1920 x 1080
0,8	5CASDL.0008-00	5CASDL.0008-00	5CASDL.0008-00	5CASDL.0008-00	5CASDL.0008-00	5CASDL.0008-00	5CASDL.0008-00
1,8	5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-03
5	5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-03
10	5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-03
15	5CASDL.0150-00 5CASDL.0150-01 5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-00 5CASDL.0150-01 5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-00 5CASDL.0150-01 5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-00 5CASDL.0150-01 5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-00 5CASDL.0150-01 5CASDL.0150-03	- - -	- - 5CASDL.0150-03
20	5CASDL.0200-00 5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-00 5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-00 5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-00 5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-00 5CASDL.0200-03	- -	- 5CASDL.0200-03
25	5CASDL.0250-00 5CASDL.0250-03	5CASDL.0250-00 5CASDL.0250-03	5CASDL.0250-00 5CASDL.0250-03	5CASDL.0250-00 5CASDL.0250-03	- -	- -	- -
30	5CASDL.0300-00 5CASDL.0300-03	5CASDL.0300-00 5CASDL.0300-03	- 5CASDL.0300-13	- 5CASDL.0300-13	- 5CASDL.0300-13	- -	- 5CASDL.0300-13
40	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	-	5CASDL.0400-13

Tabelle 186: Kabellängen und Auflösungen bei SDL-Übertragung

5.10.4 BIOS Einstellungen

Es müssen für den Betrieb keine speziellen BIOS Einstellungen vorgenommen werden.

Für nähere Informationen siehe Anwenderhandbuch des verwendeten B&R Industrie PCs.

Touch Screen Funktionalität

Für den Betrieb des Touch Screens der angeschlossenen Panel am Monitor/Panel bzw. AP Link Anschluss, muss die COM C bzw. COM D im BIOS aktiviert werden (zu finden im BIOS Menü unter „Advanced - Baseboard / Panel Features - Legacy Devices“).

5.11 Sechs AP900 und zwei AP800 über SDL onboard und SDL AP Link

An der integrierten SDL Schnittstelle (onboard) sind drei Automation Panel 900 (max. UXGA) und ein Automation Panel 800 über SDL angeschlossen. An den optionalen SDL Transmitter werden zusätzlich drei Automation Panel 900 (max. UXGA) und ein Autoamtion Panel 800 betrieben. Die Automation Panel in jedem Strang müssen jeweils vom gleichen Typ sein. Die Bildinhalte der beiden Stränge sind verschieden (Erweiterter Desktop), wobei die Displays im jeweiligen Strang denselben Bildinhalt (Display Clone) zeigen.

USB wird bis zu einer maximalen Distanz (Segment 1 + Segment 2) von 30 m an den ersten beiden Displays unterstützt. Ab einer maximalen Distanz von 30 m steht USB ausschließlich nur am ersten Display (front- und rückseitig), bis maximal 40 m, zur Verfügung. USB Geräte können nur direkt (ohne Hub) an den Automation Panel 900 Geräten angeschlossen werden.

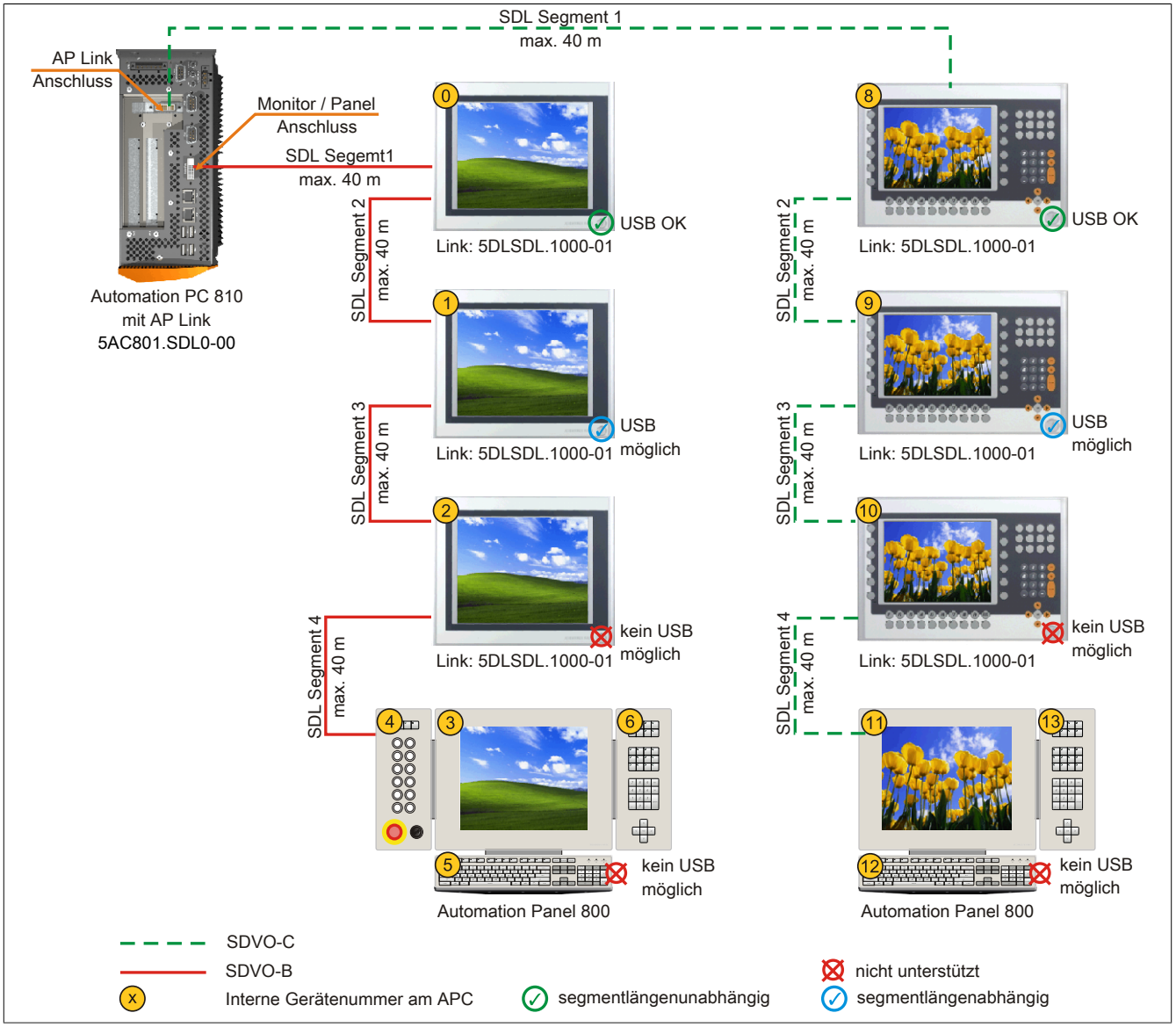


Abbildung 112: Sechs AP900 und zwei AP800 über SDL onboard und SDL AP Link (Symbolfoto)

5.11.1 Voraussetzung Grundsystem

Die nachfolgende Tabelle zeigt die möglichen Kombinationen von APC810 Systemeinheit und CPU Board um die in der obigen Abbildung gezeigte Konfiguration zu realisieren. Tritt bei der Kombination eine Einschränkung der max. Auflösung auf, so kann man dies auch folgender Tabelle entnehmen (z.B. für den Anschluss eines nicht B&R Automation Panel 900 Gerätes).

Wenn ein Automation Panel 800 und ein Automation Panel 900 an einem Strang angeschlossen werden sollen, müssen die Geräte den gleichen Displaytyp besitzen.

CPU Board	mit Systemeinheit				Einschränkung Auflösung
	5PC810.SX01-00[1)]	5PC810.SX02-00	5PC810.SX03-00	5PC810.SX05-00	
5PC800.B945-00 5PC800.B945-10	-	✓	✓	✓	max. UXGA
5PC800.B945-01 5PC800.B945-11	-	✓	✓	✓	max. UXGA
5PC800.B945-02 5PC800.B945-12	-	✓	✓	✓	max. UXGA
5PC800.B945-03 5PC800.B945-13	-	✓	✓	✓	max. UXGA
5PC800.B945-04 5PC800.B945-14	-	✓	✓	✓	max. UXGA
5PC800.B945-05	-	✓	✓	✓	max. UXGA

Tabelle 187: Mögliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board

1) Keine Möglichkeit zur AP Link Montage.

5.11.2 Linkbaugruppe

Information:

Für jedes verwendete Gerät muss die entsprechende Linkbaugruppe ausgewählt werden!

Bestellnummer	Beschreibung	Anmerkung
5DLSDL.1000-01	**Automation Panel Link SDL Transceiver** Anschlüsse für SDL in und SDL out; Übertragung von Displaydaten, Touch Screen, USB 1.1, Matrixtasten, und Servicedaten; 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzuglemme 0TB103.91 gesondert bestellen).	für Automation Panel 900
5AC801.SDL0-00	**APC810 AP Link SDL Transmitter** Automation Panel Link Transmitter SDL	für Automation PC 810

Tabelle 188: Linkbaugruppen

5.11.3 Kabel

Auswahl eines SDL-Kabels für den Anschluss des AP900 Displays an das AP900 Display siehe "Kabel" auf Seite 209.

Auswahl eines SDL-Kabels für den Anschluss des AP800 Displays an das AP900 Display siehe "Kabel" auf Seite 211.

Information:

Detaillierte technische Daten zu den Kabeln siehe Kapitel "Zubehör".

5.11.3.1 Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen Segmentlänge und max. Auflösung in Abhängigkeit des SDL Kabels:

Kabel Segmentlänge [m]	Auflösung				
	VGA 640 x 480	SVGA 800 x 600	XGA 1024 x 768	SXGA 1280 x 1024	UXGA 1600 x 1200
0,8	-	-	5CASDL.0008-00	-	-
1,8	- - - -	- - - -	5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-20 5CASDL.0018-03	- - - -	- - - -
5	- - - -	- - - -	5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-20 5CASDL.0050-03	- - - -	- - - -
10	- - - -	- - - -	5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-20 5CASDL.0100-03	- - - -	- - - -
15	- - - -	- - - -	5CASDL.0150-00 5CASDL.0150-01 5CASDL.0150-20 5CASDL.0150-03	- - - -	- - - -

Tabelle 189: Segmentlängen, Auflösungen und SDL Kabel

Kabel Segmentlänge [m]	Auflösung				
	VGA 640 x 480	SVGA 800 x 600	XGA 1024 x 768	SXGA 1280 x 1024	UXGA 1600 x 1200
20	- - -	- - -	5CASDL.0200-00 5CASDL.0200-20 5CASDL.0200-03	- - -	- -
25	- - -	- - -	5CASDL.0250-00 5CASDL.0250-20 5CASDL.0250-03	- - -	- - -
30	- - -	- - -	5CASDL.0300-10 5CASDL.0300-13 5CASDL.0300-30	- - -	- - -
40	- - -	- - -	5CASDL.0400-10 5CASDL.0400-13 5CASDL.0400-30	- - -	- - -

Tabelle 189: Segmentlängen, Auflösungen und SDL Kabel

5.11.4 BIOS Einstellungen

Es müssen für den Betrieb keine speziellen BIOS Einstellungen vorgenommen werden.

Für nähere Informationen siehe Anwenderhandbuch des verwendeten B&R Industrie PCs.

Touch Screen Funktionalität

Für den Betrieb des Touch Screens der angeschlossenen Panel am Monitor/Panel bzw. AP Link Anschluss, muss die COM C bzw. COM D im BIOS aktiviert werden (zu finden im BIOS Menü unter „Advanced - Baseboard / Panel Features - Legacy Devices“).

6 Anschluss von USB Peripheriegeräten

Warnung!

An die USB Schnittstellen können USB Peripheriegeräte angeschlossen werden. Auf Grund der Vielfältigkeit am Markt erhältlichen USB Geräte, kann B&R keine Garantie für deren Funktion übernehmen. Für die bei B&R erhältlichen USB Geräte wird die Funktion gewährleistet.

6.1 Lokal am APC810

An die 5 USB Schnittstellen können verschiedenste USB Peripheriegeräte angeschlossen werden. Dabei können die USB Schnittstellen USB1, USB3 und USB5 hierzu jeweils mit 1A bzw. die USB Schnittstellen USB2 und USB4 jeweils mit 500 mA belastet werden. Die Übertragungsgeschwindigkeit beträgt maximal USB 2.0.

Abbildung 113: Anschluss von USB Peripheriegeräten lokal am APC810

6.2 Remote am Automation Panel 900 über DVI

An die 2 oder 3 USB Schnittstellen am Automation Panel 900 können verschiedenste USB Peripheriegeräte angeschlossen werden. Dabei können diese jeweils mit 500 mA belastet werden. Die Übertragungsgeschwindigkeit beträgt maximal USB 2.0.

Information:

Am Automation Panel 900 kann kein HUB, sondern es können nur Endgeräte angeschlossen werden.

Abbildung 114: Anschluss von USB Peripheriegeräten remote am AP900 über DVI

6.3 Remote am Automation Panel 800 / 900 über SDL

An die 2 oder 3 USB Schnittstellen am Automation Panel 900 bzw. USB Anschlüsse bei Automation Panel 800 Geräten können verschiedenste USB Peripheriegeräte angeschlossen werden. Dabei können diese jeweils mit 500 mA belastet werden. Die Übertragungsgeschwindigkeit beträgt maximal USB 1.1.

Information:

Am Automation Panel 800/900 kann kein HUB, sondern es können nur Engeräte angeschlossen werden.

Abbildung 115: Anschluss von USB Peripheriegeräten remote am AP800/900 über SDL

7 Konfiguration eines SATA RAID Verbundes

Information:

Die nachfolgende Softwarebeschreibung ist für die PCI SATA Controller 5ACPCI.RAIC-01, 5ACPCI.RAIC-03, 5ACPCI.RAIC-05 und 5ACPCI.RAIC-06 gültig.

Für die Konfiguration ist es notwendig in das BIOS des „RAID Configuration Utility“ einzusteigen. Nach dem POST <Strg+S> oder <F4> Drücken um das RAID BIOS aufzurufen.

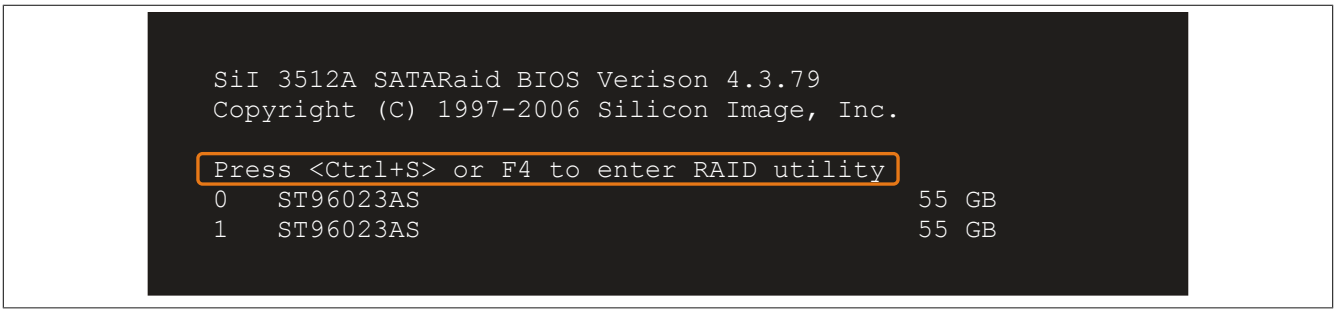


Abbildung 116: Einstieg in das RAID Configuration Utility

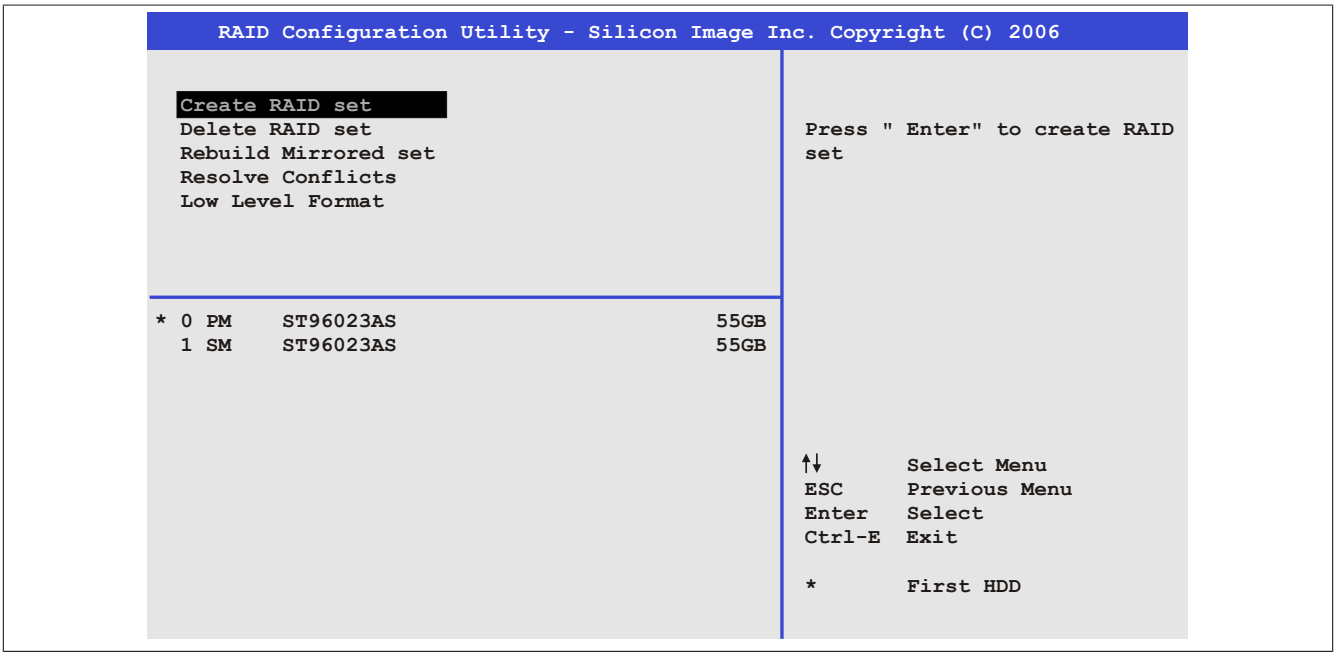


Abbildung 117: RAID Configuration Utility - Menü

Folgende Tasten können nach dem Einstieg in das BIOS Setup verwendet werden:

Taste	Funktion
Cursor ↑	Zum vorherigen Objekt.
Cursor ↓	Zum nächsten Objekt.
Enter	Auswahl des Punktes bzw. Aufruf von Untermenüs.
ESC	Rücksprung zum vorherigen Menü.
Ctrl+E	Ausstieg aus dem Setup und Speichern der vorgenommenen Einstellungen.

Tabelle 190: BIOS relevante Tasten im RAID Configuration Utility

7.1 Create RAID Set

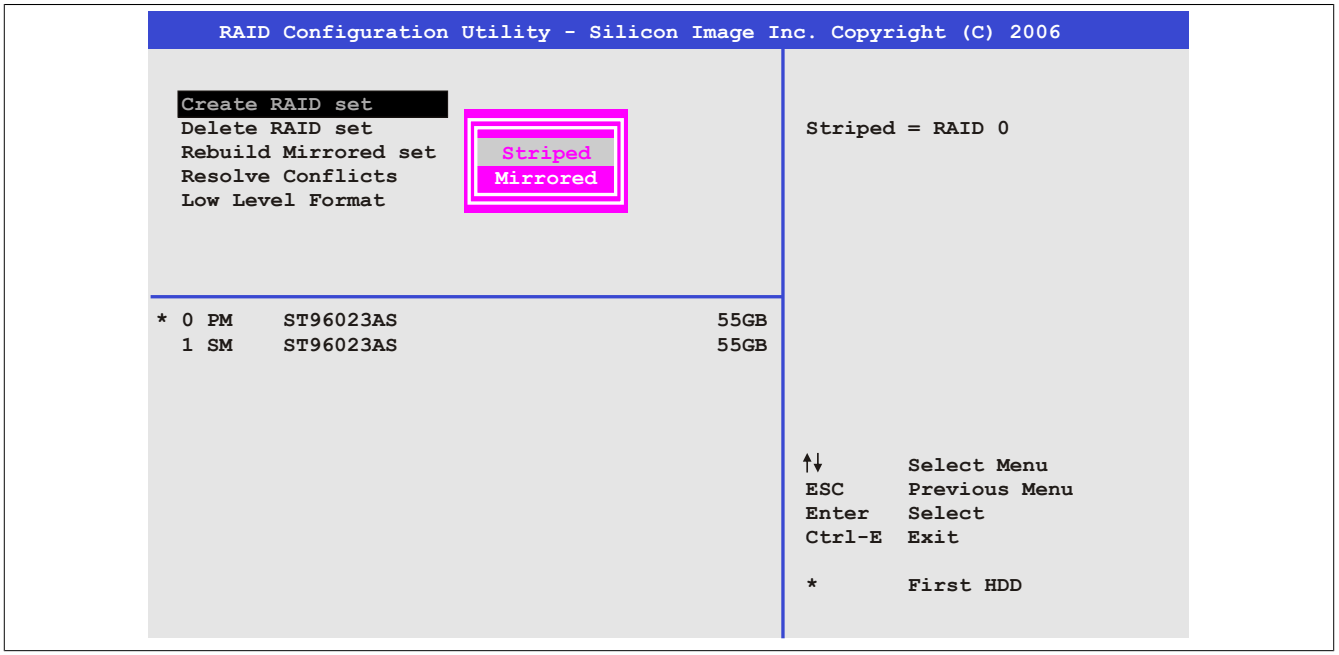


Abbildung 118: RAID Configuration Utility - Menü

Über das Menü „Create RAID set“ ist es möglich das RAID System als „Striped“ = RAID0 oder „Mirrored“ = RAID1 neu zu erstellen.

7.2 Create RAID Set - Striped

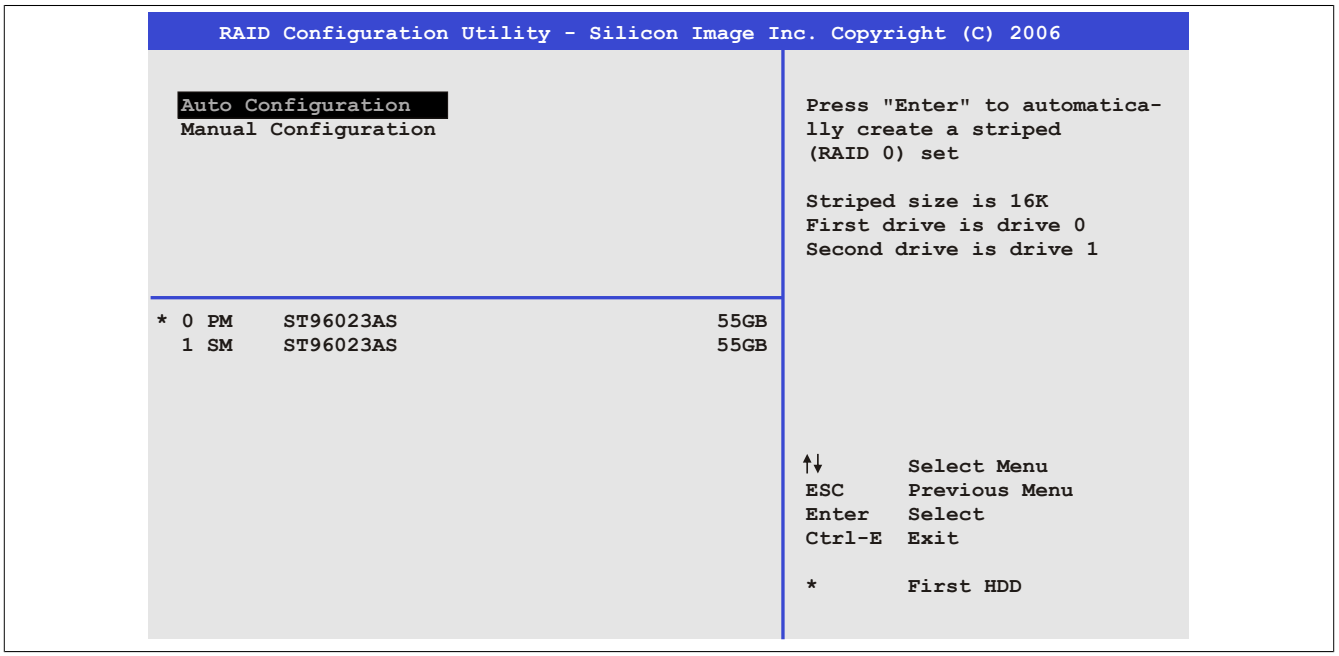


Abbildung 119: RAID Configuration Utility - Create RAID set - Striped

„Auto Configuration”
Bei der Auto Configuration werden alle Einstellungen optimal angepasst.

„Manual Configuration”
Es ist möglich die erste und zweite HDD zu bestimmen sowie die „Chunk Size“ (=Blockgröße, applikationsabhängig) auszuwählen.

7.3 Create RAID Set - Mirrored

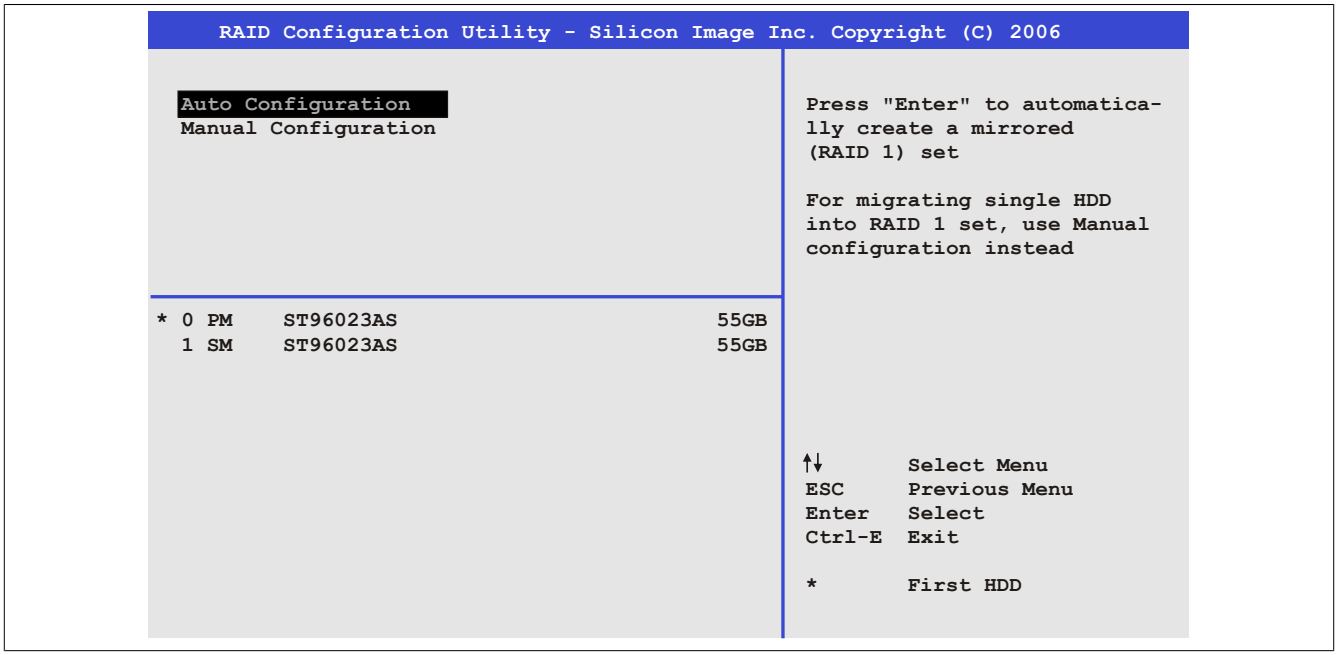


Abbildung 120: RAID Configuration Utility - Create RAID set - Mirrored

„Auto Configuration"
Bei der Auto Configuration werden alle Einstellungen optimal angepasst.

„Manual Configuration"
Es ist möglich die „Source" und „Target" HDD zu bestimmen, sowie ob sofort ein Rebuild (Spiegelung) durchgeführt werden soll (Dauer ca. 50 Minuten) oder nicht.

7.4 Delete RAID Set

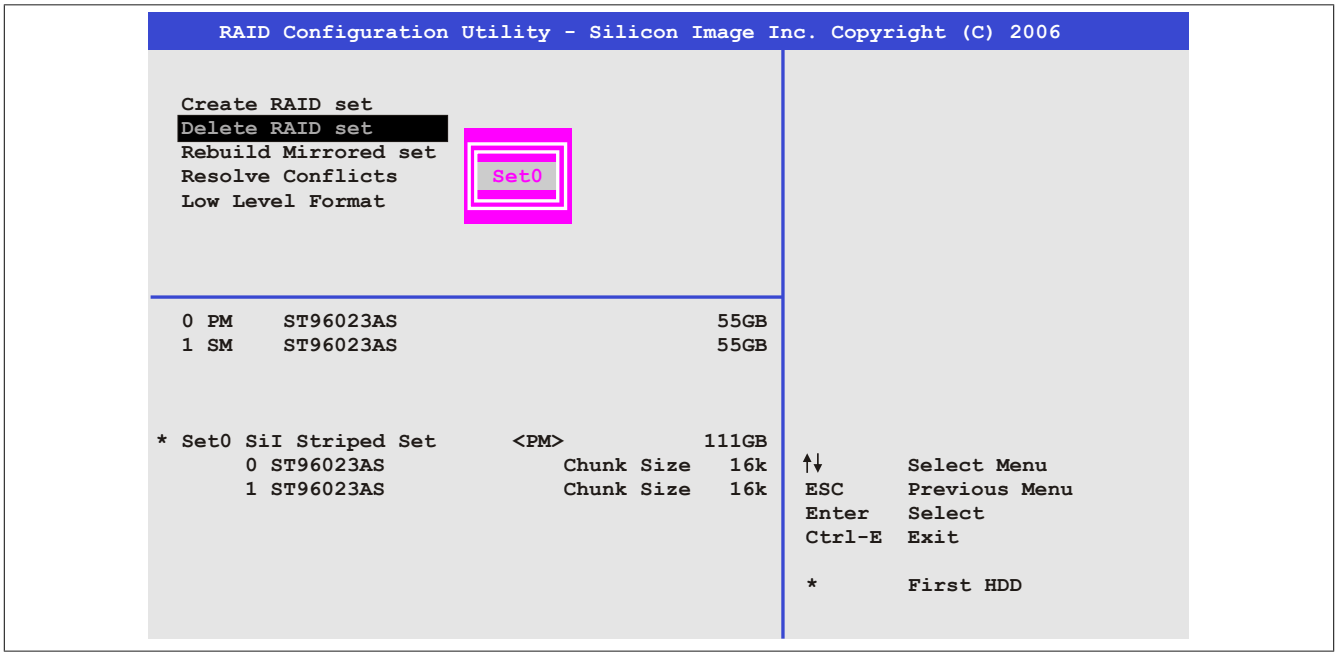


Abbildung 121: RAID Configuration Utility - Delete RAID set

Über das Menü „Delete RAID set" kann ein bestehender RAID Verbund aufgelöst werden.

7.5 Rebuild Mirrored Set

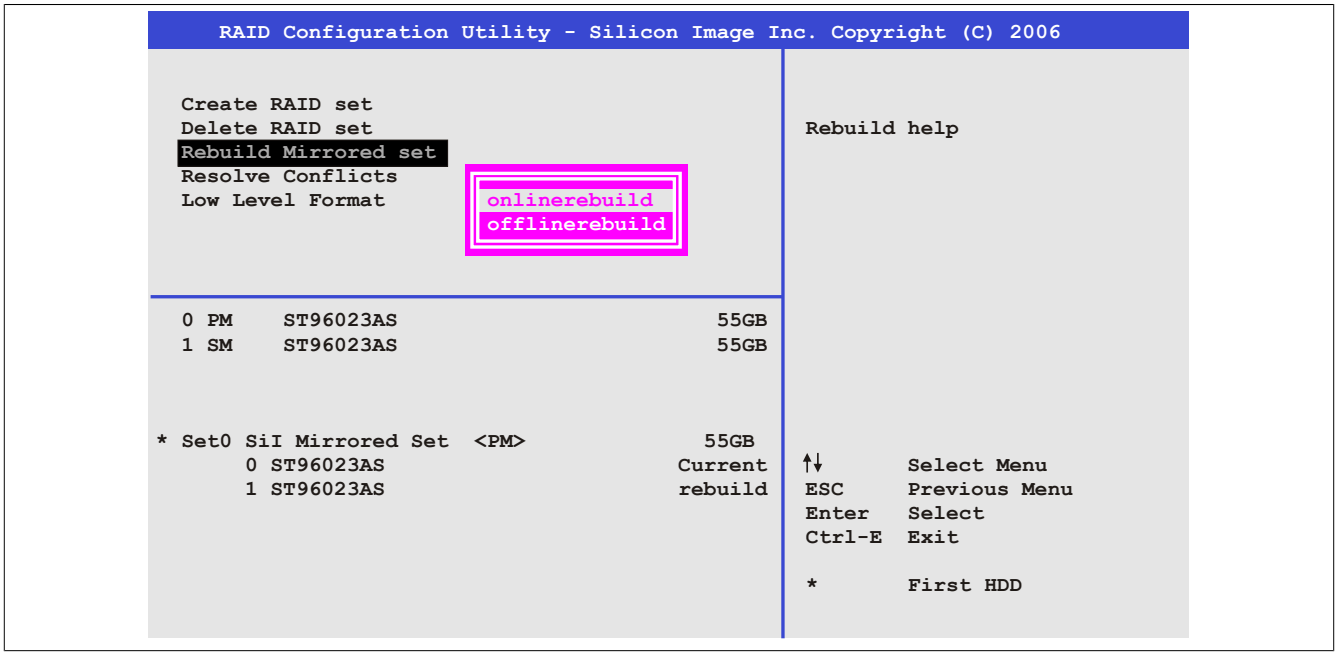


Abbildung 122: RAID Configuration Utility - Rebuild Mirrored set

Über das Menü „Rebuild Mirrored set“ kann ein Rebuild Vorgang bei RAID 1 Verbund bei einem Fehlerfalle, nach vorheriger Unterbrechung des Rebuild Vorganges oder beim Tausch einer Hard Disk neu gestartet werden.

Bei der Auswahl „onlinerebuild“ wird der Rebuild nach dem Hochfahren des Systems im laufenden Betrieb durchgeführt. Durch z.B. das installierte SATA RAID Konfigurationsprogramm wird ein Event Pop Up angezeigt: `SATA-Raid detected a new event` und der Rebuild wird gestartet. Dauer des kompletten Rebuilds beträgt ca. 50 Minuten.

Bei der Auswahl „offlinerebuild“ wird sofort ein Rebuild vor dem Start des Beriebssystems durchgeführt (Dauer abhänging von der jeweiligen Speichergröße).

7.6 Resolve Conflicts

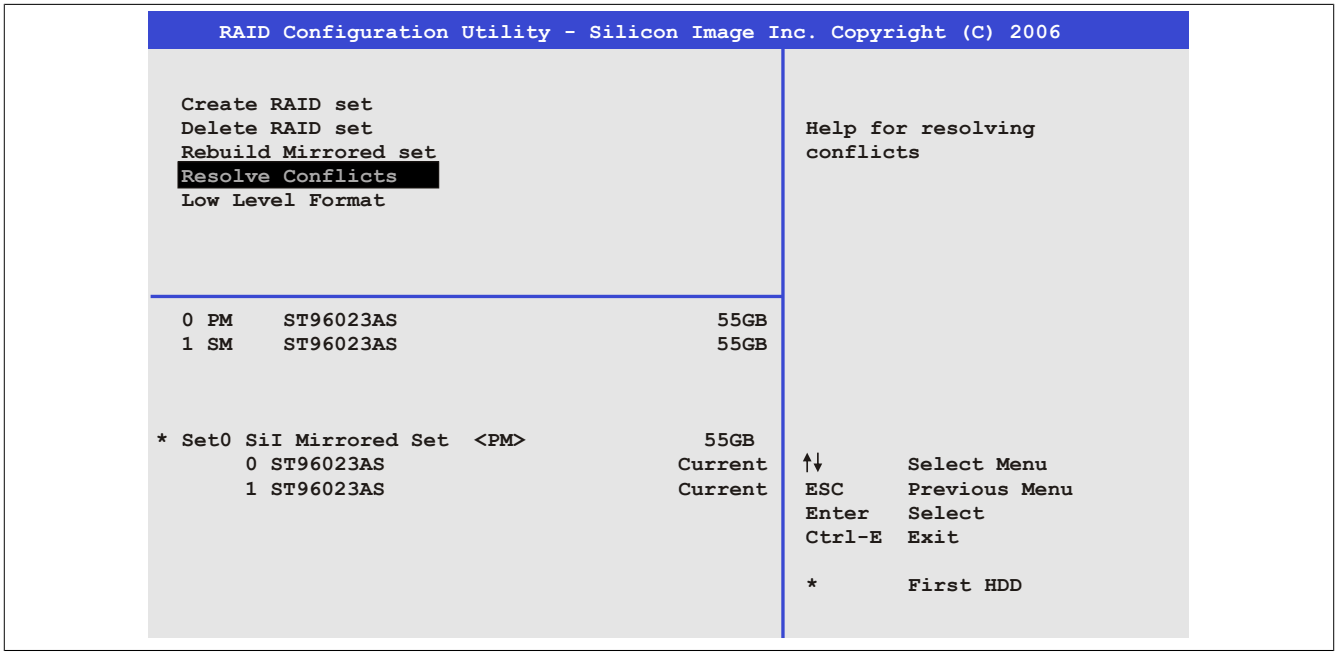


Abbildung 123: RAID Configuration Utility - Resolve Conflicts

Über das Menü „Resolve Conflicts“ kann man Konflikte eines RAID Verbundes lösen. Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn der Status der Festplatten “conflict” ist.

7.7 Low Level Format

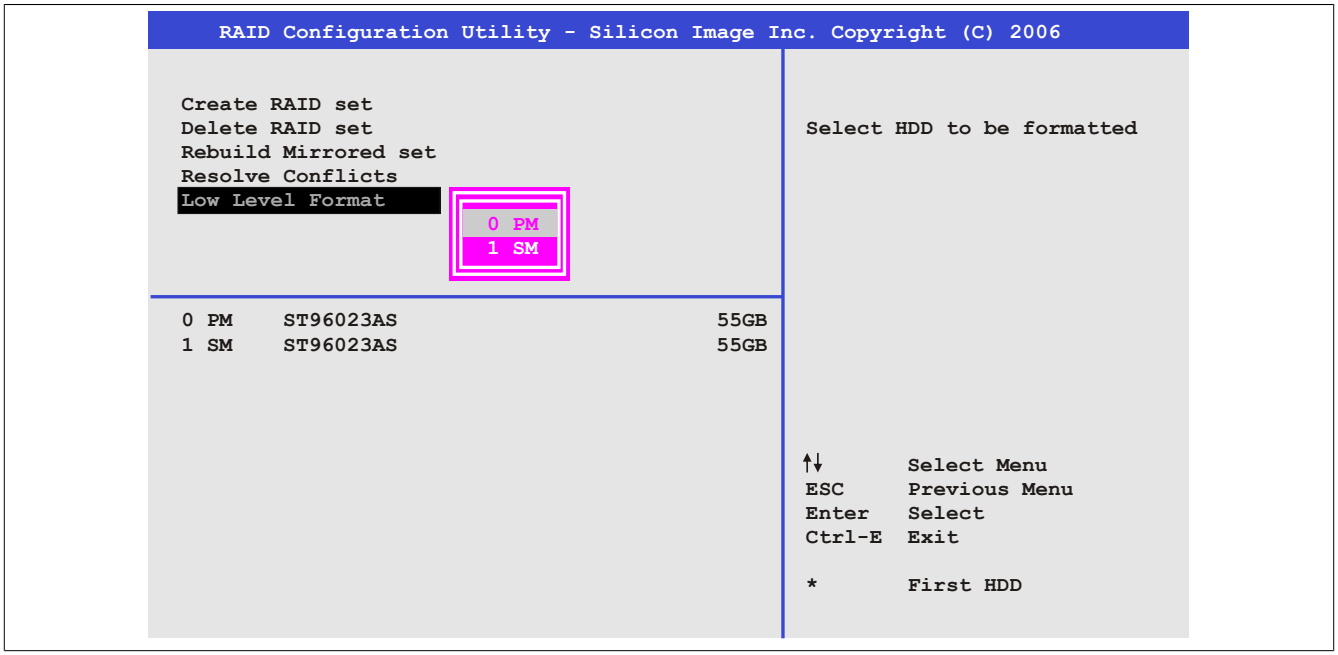


Abbildung 124: RAID Configuration Utility - Low Level Format

Über das Menü „Low Level Format“ können einzelne Hard Disks formatiert werden. Zu diesem Zweck darf kein RAID Verbund konfiguriert sein. Ein Low Level Format einer Festplatte dauert ca. 40 Minuten.

8 Bekannte Probleme / Eigenheiten

8.1 Probleme / Eigenheiten des ersten Fertigungsloses

Die nachfolgend aufgelisteten Punkte sind bis einschließlich 07.05.2008 bei den APC800 Geräten des ersten Fertigungsloses bekannt:

- Die Hardware Security Key Schnittstelle wird ab der MTCX FPGA Version 00.06 unterstützt.
- Die Statusanzeige der Link bzw. Activity LED der ETH1 Schnittstelle funktionierte noch nicht korrekt. Die Netzwerkverbindung wurde dadurch aber nicht beeinträchtig. Ab den Hardwarerevisionen 5PC810.SX02-00 (Revision B0) und 5PC800.B945-0x (Revision B0) funktioniert die Statusanzeige korrekt.
- Sporadisch konnte es bei einem Power On passieren, dass die ETH2 Schnittstelle nicht initialisiert wurde und diese somit nicht funktionierte. Das Problem konnte durch einen Reset bzw. Warmstart (Strg+Alt+Entf) behoben werden. Ab der MTCX FPGA Version 00.03 ist dieses Problem behoben.
- Besonderheiten beim „Kurzen Ausschalten“ - Befindet sich der APC810 im „Standby“ Betrieb - Power LED leuchtet rot (z.B. Windows XP herunterfahren) hält die Pufferung auf Grund von Kondensatoren und dem geringen Leistungsverbrauch etwas länger an. Ist im BIOS die Option „Power Loss Control“ auf „Power On“ oder „Last State“ eingestellt, kann es trotzdem vorkommen, dass das System nicht wieder neu startet, da kein Power Off/On erkannt wurde. Um mit diesen Systemeinheiten sicher zu gehen, dass das System nach einem Power Off/On wieder startet, sollte die Abschaltzeit mindestens 10 Sekunden betragen.
- Ab der MTCX PX32 Firmware ≥ V00.11 ist der Reset Taster nur mehr Flanken getriggert, das heißt, dass das Gerät trotz gedrückter Reset Taste durchbootet. Bei MTCX PX32 Firmware < V00.11 startet das System bei längerem Drücken (ca. 10 Sekunden) und wiederloslassen des Reset Tasters nicht mehr.

8.2 Probleme / Eigenheiten nachfolgender Fertigungslose

- First Boot Agent Windows XP Embedded und eingebautes SATA HDD Laufwerk Vor dem Einstecken einer CompactFlash mit einem Windows XP Embedded Image und Ausführung des First Boot Agent muss die BIOS Einstellung „Legacy IDE Channels“ unter Advanced - IDE Configuration auf „PATA only“ eingestellt werden oder es kann das SATA Laufwerk zuvor entfernt werden.
- Bei Verwendung von zwei Grafiksträngen werden beim Windows XP Grafiktreiber die Bezeichnungen „Digitalanzeige“ für den Monitor / Panel Stecker und „Digitalanzeige 2“ für den AP Link Stecker zugewiesen. In der Betriebsart „Erweiterter Desktop“ zeigt sich folgendes Verhalten: Wird das Anzeigegerät Digitalanzeige am Monitor / Panel Stecker entfernt (z.B. Kabelbruch), so wird automatisch die Digitalanzeige 2 zur Digitalanzeige und somit wechseln auch die getätigten Einstellungen im Grafiktreiber von der Digitalanzeige 2 zur Digitalanzeige über. Beim nächsten Reboot des Systems wird der Bildinhalt vom Monitor / Panel Stecker auf den AP Link Stecker umgeleitet. Wird nun die BIOS Option „SDVO/DVI Hotplug Support“ auf „Enabled“ (zu finden unter dem BIOS Menüpunkt „Advanced - Graphics Configuration“) gestellt wird sofort der Bildinhalt automatisch vom getrennten Monitor / Panel Stecker auf den 2’ten Grafikstrang am AP Link Stecker umgeleitet.
- Hardwarerevision B0 des Slide-in DVD-ROM - 5AC801.DVDS-00 bietet keine SATA Hotplugfähigkeit. Andere Hardwarerevisionen sind hotplugfähig.
- Im Daisy Chain Betrieb von mehreren AP800/AP900 Geräten via SDL kann es bei der Erkennung des Touchcontrollers zur Anzeige eines roten „X“ beim Touchcontroller Status im Control Center Applet des Touchtreibers kommen. Die Funktion des Touchsystems ist dadurch nicht beeinträchtigt. Dies kann durch Einstellen einer Panel Sperrzeit von 50 ms vermieden werden. Die Panel Sperrzeit kann mit dem B&R Key Editor konfiguriert werden.
- Der Betrieb von zwei CompactFlash Karten unterschiedlicher Type kann in Automation PCs und Panel PCs zu Problemen führen. Es kann vorkommen, dass beim Systemstart eine der beiden Karten nicht erkannt wird. Der Grund hierfür liegt in dem unterschiedlich schnellen Hochlaufverhalten. Die CompactFlash Karten älterer Technologie benötigen beim Systemstart erheblich mehr Zeit als CompactFlash Karten mit neuerer Technologie. Dieses Verhalten liegt im Grenzbereich des hierfür während des Hochlaufs zur Verfügung stehenden Zeitfensters. Da die Hochlaufzeit bei den CompactFlash Karten durch die Streuung der verwendeten Bauteile schwankt kann es daher zu dem beschriebenen Problem kommen. Je nach verwendeten CompactFlash Karten kann der Fehler nie, selten oder immer auftreten.

- Die Grafik Auflösung HD (1366x768) wird vom Intel VBIOS nicht vollständig unterstützt, weshalb es nach dem POST zu Anzeigefehlern kommt. Das Bild flackert und ist um eine Zeile nach unten verschoben. Der BIOS POST sowie das BIOS Setup werden noch korrekt dargestellt. Bei OS Systemen, für die kein Grafiktreiber verfügbar ist (z.B. MS-DOS) oder auch bevor der Grafiktreiber des OS gestartet ist (z.B. Bootlogo des Windows XP), tritt dieser Effekt auf. Bei einem korrekt gebooteten Windows XP bzw. Windows 7 mit installiertem Grafiktreiber, wird die HD Auflösung wieder richtig dargestellt.
- Die Interface Option 5AC600.CANI-00 wird ab Windows 7 nicht unterstützt.

Kapitel 4 • Software

1 BIOS Optionen

Information:

Die nachfolgenden Abbildungen bzw. BIOS Menüpunkte einschließlich Beschreibungen beziehen sich auf die BIOS Version 1.18. Es kann daher vorkommen, dass diese Abbildungen bzw. BIOS Beschreibungen nicht mit der installierten BIOS Version übereinstimmen.

1.1 Allgemeines

BIOS ist die Abkürzung für „Basic Input and Output System“. Es ist die grundlegende standardisierte Verbindung zwischen Anwender und System (Hardware). Bei diesem B&R Industrie PC wird das BIOS des American Megatrends Inc. verwendet.

Das BIOS Setup Utility ermöglicht die Modifizierung grundlegender Einstellungen der Systemkonfiguration. Diese Einstellungen werden im CMOS und im EEPROM (als Backup) gespeichert.

Die CMOS Daten werden durch eine Batterie - sofern vorhanden - gepuffert und bleiben auch im spannungslosen Zustand (keine 24 VDC Versorgung) des B&R Industrie PCs erhalten.

1.2 BIOS Setup und Startvorgang

Sofort nach dem Einschalten der Spannungsversorgung des B&R Industrie PCs bzw. Drücken des Power Buttons wird das BIOS aktiviert. Es wird überprüft, ob die Setupdaten aus dem EEPROM „OK“ sind. Sind diese „OK“, werden sie in das CMOS übertragen. Sind diese „nicht OK“, werden die CMOS Daten auf Gültigkeit überprüft. Sind die CMOS Daten auch fehlerhaft, so wird eine Fehlermeldung ausgegeben und man kann mit der Taste <F1> den Bootvorgang problemlos fortsetzen. Damit die Fehlermeldung nicht bei jedem Neustart erscheint, ist mit der Taste <Entf> das BIOS Setup aufzurufen und neu zu speichern.

Das BIOS liest die Systemkonfigurationsinformation, überprüft das System und konfiguriert es durch den Power On Self Test (POST).

Nach Abschluss dieser „Vorbereitungen“ durchsucht das BIOS die im System vorhandenen Datenspeicher (Festplatte, Diskettenlaufwerk, usw.) nach einem Betriebssystem. Das BIOS startet das Betriebssystem und übergibt diesem die Kontrolle über die Systemoperationen.

Um ins BIOS Setup zu gelangen, muss die „Entf“ Taste nach dem Initialisieren des USB Controllers gedrückt werden, sobald folgende Nachricht am Bildschirm erscheint (während POST): „Press DEL to run Setup“

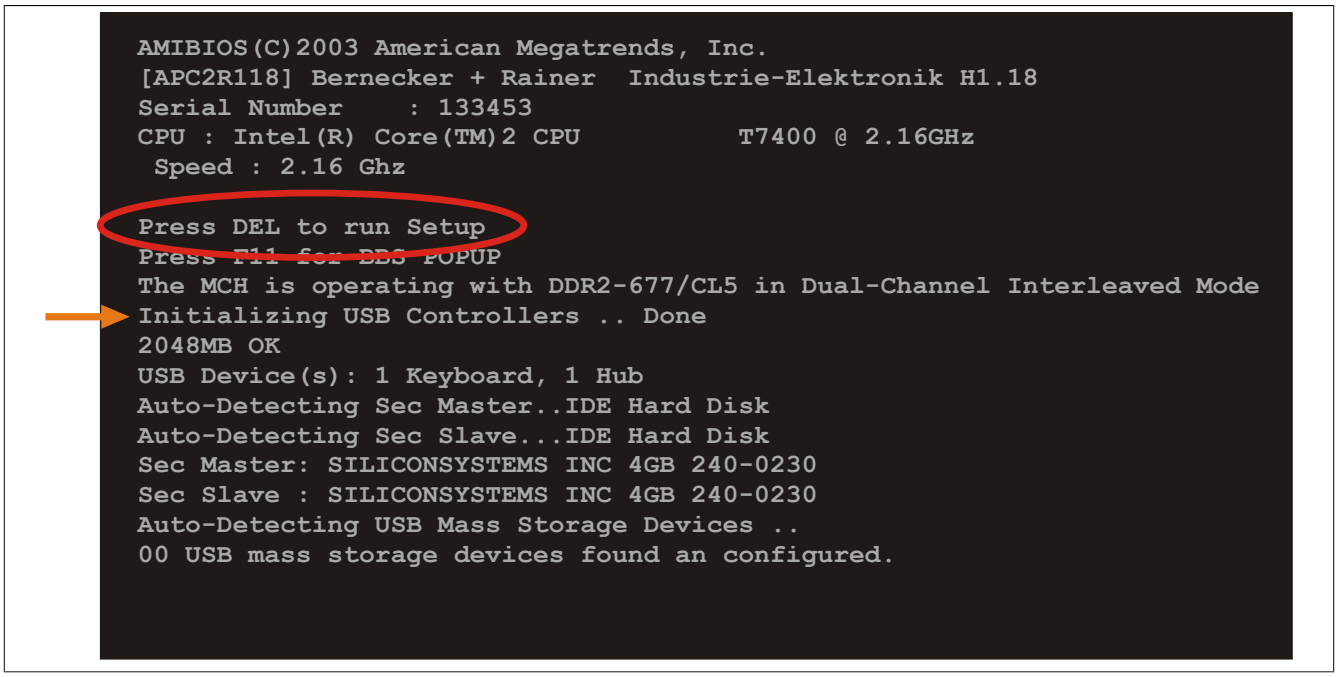


Abbildung 125: Boot Screen

1.2.1 BIOS Setup Tasten

Folgende Tasten sind während dem POST aktiviert:

Information:

Die Tastensignale der USB Tastatur werden erst nach dem Initialisieren des USB Controllers angenommen.

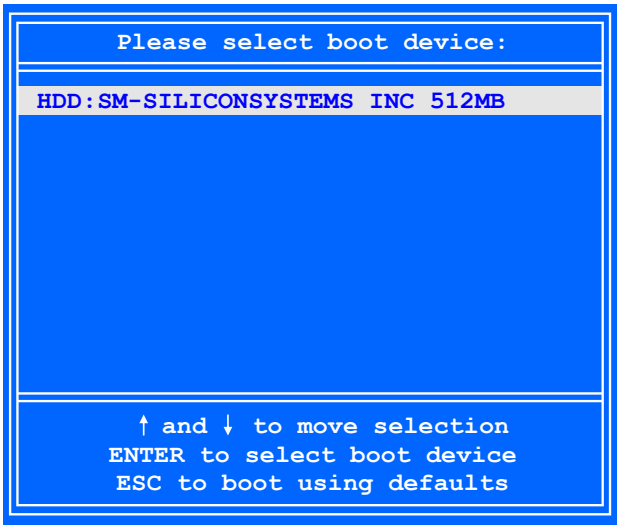
Tasten	Funktion
Entf	Einstieg in das BIOS Setup Menü.
F12	Mit F12 kann vom Netzwerk gebootet werden.
F11	Aufruf des Bootmenüs. Es werden sämtliche bootfähigen Geräte die mit dem System verbunden sind aufgelistet. Mit Cursor ↑ und Cursor ↓ und durch Bestätigen von <ENTER> wird von diesem Gerät gebootet. 
<Pause>	Mit der <Pause> Taste kann der POST angehalten werden. Nach Drücken jeder anderen beliebigen Taste läuft der POST weiter.

Tabelle 191: Biosrelevante Tasten beim POST

Folgende Tasten können nach dem Einstieg in das BIOS Setup verwendet werden:

Taste	Funktion
F1	Generelle Hilfe.
Cursor ↑	Zum vorigen Objekt.
Cursor ↓	Zum nächsten Objekt.
Cursor ←	Zum vorigen Objekt.
Cursor →	Zum nächsten Objekt.
+-	Ändert die Einstellung der ausgewählten Funktion.
Enter	In das ausgewählte Menü wechseln.
Bild ↑	Auf die vorherige Seite wechseln.
Bild ↓	Auf die nächste Seite wechseln.
Pos 1	Man springt zum ersten BIOS Menüpunkt bzw. Objekt.
Ende	Man springt zum letzten BIOS Menüpunkt bzw. Objekt.
F2 / F3	Die Farben des BIOS Setups werden getauscht.
F7	Änderungen werden zurückgesetzt.
F9	CMOS Default Werte für alle BIOS Einstellungen werden geladen und eingestellt.
F10	Speichern und schließen.
Esc	Untermenü verlassen.

Tabelle 192: Biosrelevante Tasten im BIOS Menü

1.3 Main

Unmittelbar nach Drücken der Taste „Entf“ beim Systemstart erscheint das Hauptmenü des BIOS Setups:

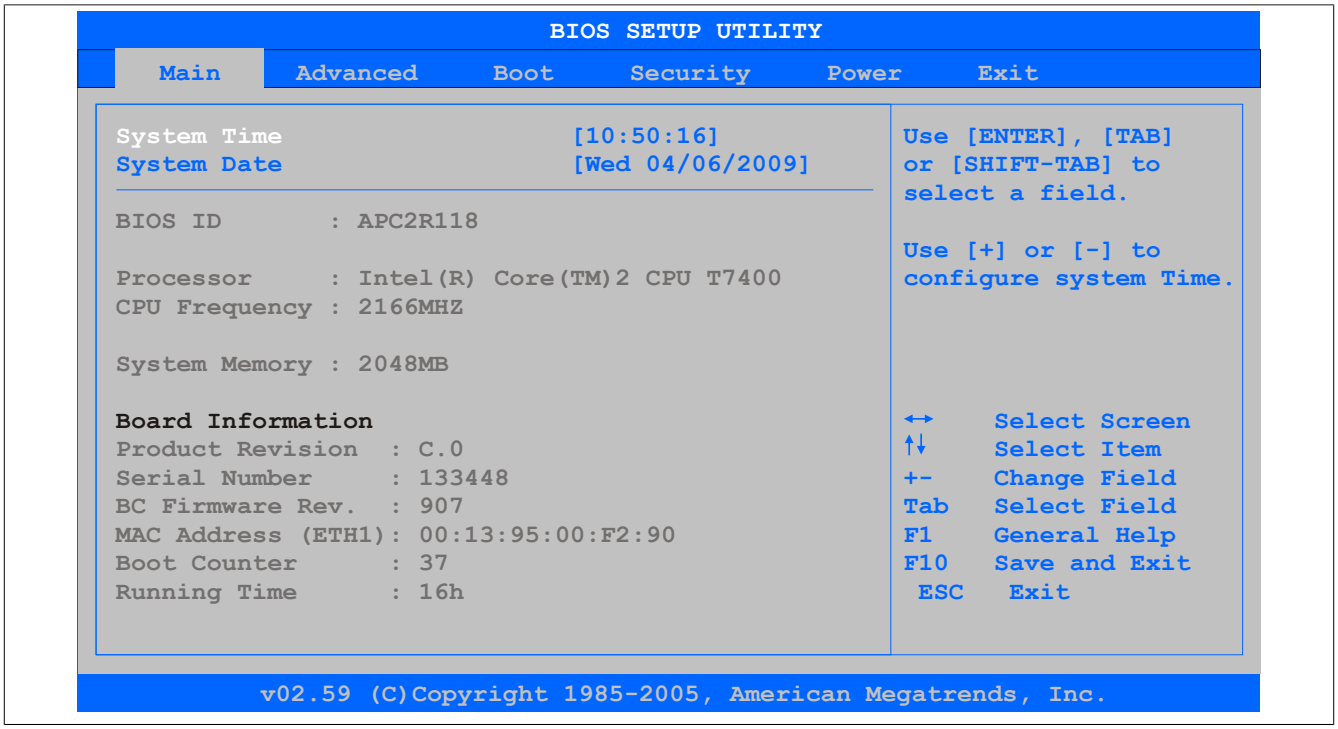


Abbildung 126: 945GME BIOS Main Menü

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
System Time	Ist die aktuell eingestellte Systemzeit. Wird nach dem Ausschalten des Systems durch eine Batterie (CMOS-Batterie) gepuffert.	Veränderung der Systemzeit	Individuelle Einstellung der Systemzeit im Format Stunde:Minute:Sekunde (hh:mm:ss).
System Date	Ist das aktuell eingestellte Systemdatum. Wird nach dem Ausschalten des Systems durch eine Batterie (CMOS-Batterie) gepuffert.	Veränderung vom Systemdatum	Individuelle Einstellung des Systemdatums im Format Monat:Tag:Jahr (mm:dd:yyyy).
BIOS ID	Anzeige der BIOS Erkennung.	keine	-
Processor	Anzeige des Prozessortyps.	keine	-
CPU Frequency	Anzeige der Prozessor Frequenz.	keine	-
System Memory	Anzeige der Arbeitsspeichergröße.	keine	-
Product Revision	Anzeige der HW-Revision des CPU Boards.	keine	-
Serial Number	Anzeige der Serialnummer des CPU Boards.	keine	-
BC Firmware Rev.	Anzeige der Firmware Revision des CPU Board-controllers.	keine	-
MAC Address (ETH1)	Anzeige der vergebenen MAC Adresse der ETH1 Schnittstelle.	keine	-
Boot Counter	Anzeige des Boot Zählers - jeder Neustart erhöht den Zähler um Eins (max. 16777215).	keine	-
Running Time	Anzeige der Laufzeit in ganzen Stunden. (max. 65535).	keine	-

Tabelle 193: 945GME Main Menü Einstellmöglichkeiten

1.4 Advanced

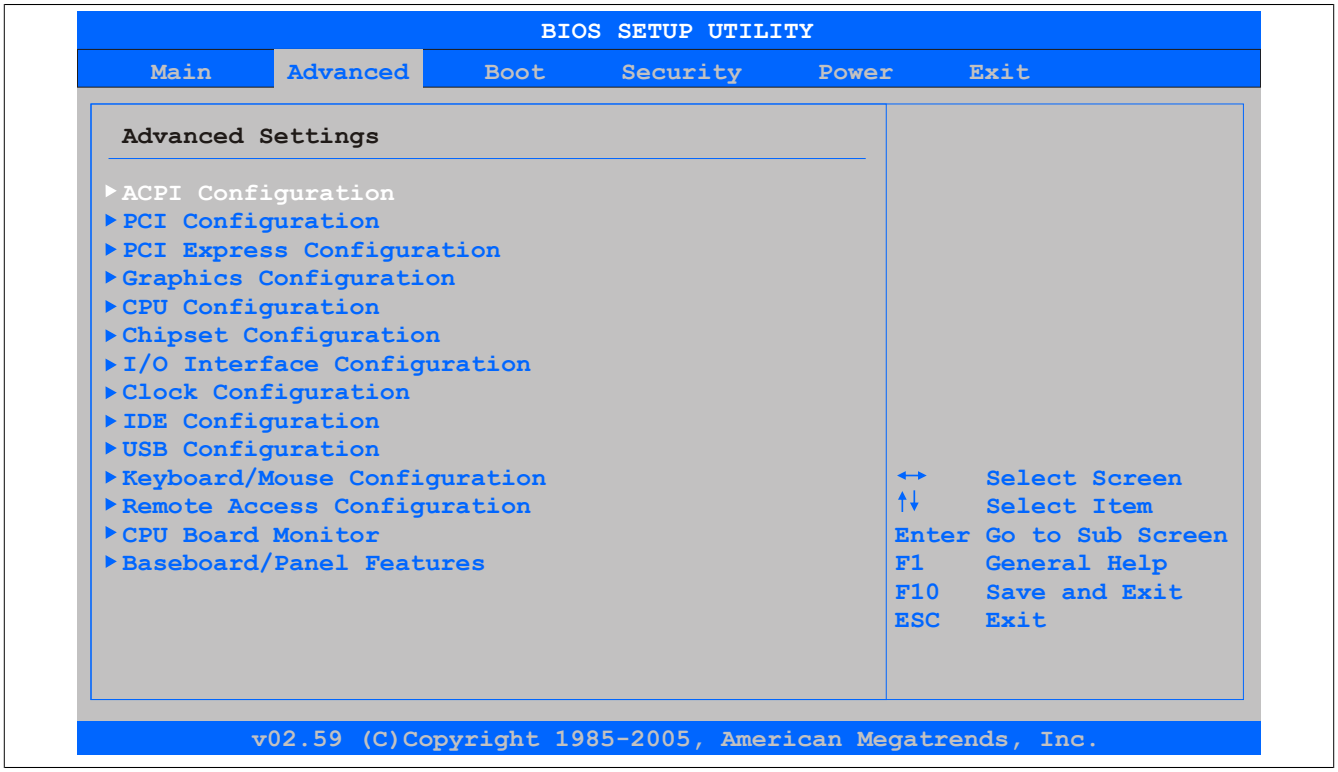


Abbildung 127: 945GME Advanced Menü

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
ACPI Configuration	Konfiguration der ACPI Geräte.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "ACPI Configuration" auf Seite 246
PCI Configuration	Konfiguration der PCI Geräte.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "PCI Configuration" auf Seite 247
PCI Express Configuration	Konfiguration der PCI Express Einstellungen.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "PCI Express Configuration" auf Seite 250
Graphics Configuration	Konfiguration der Grafikeinstellungen.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Graphics Configuration" auf Seite 252
CPU Configuration	Konfiguration der CPU Einstellungen.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "CPU Configuration" auf Seite 254
Chipset Configuration	Konfiguration der Chipset Einstellungen.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Chipset Configuration" auf Seite 255
I/O Interface Configuration	Konfiguration der I/O Geräte Einstellungen.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "I/O Interface Configuration" auf Seite 256
Clock Configuration	Konfiguration der Clock Einstellungen.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Clock Configuration" auf Seite 257
IDE Configuration	Konfiguration der IDE Funktionen.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "IDE Configuration" auf Seite 257
USB Configuration	Konfiguration der USB Einstellungen.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "USB Configuration" auf Seite 263
Keyboard/Mouse Configuration	Konfiguration der Keyboard/Mouse Einstellungen.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Keyboard/Mouse Configuration" auf Seite 264
Remote Access Configuration	Konfiguration der Remote Access Einstellungen.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Remote Access Configuration" auf Seite 265
CPU Board Monitor	Zeigt die aktuellen Spannungen wie auch die aktuellen Temperaturen des verwendeten Prozessors an.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "CPU Board Monitor" auf Seite 267
Baseboard/Panel Features	Anzeige gerätespezifischer Informationen und Einstellung gerätespezifischer Werte.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Baseboard/Panel Features" auf Seite 268

Tabelle 194: 945GME Advanced Menü Einstellmöglichkeiten

1.4.1 ACPI Configuration

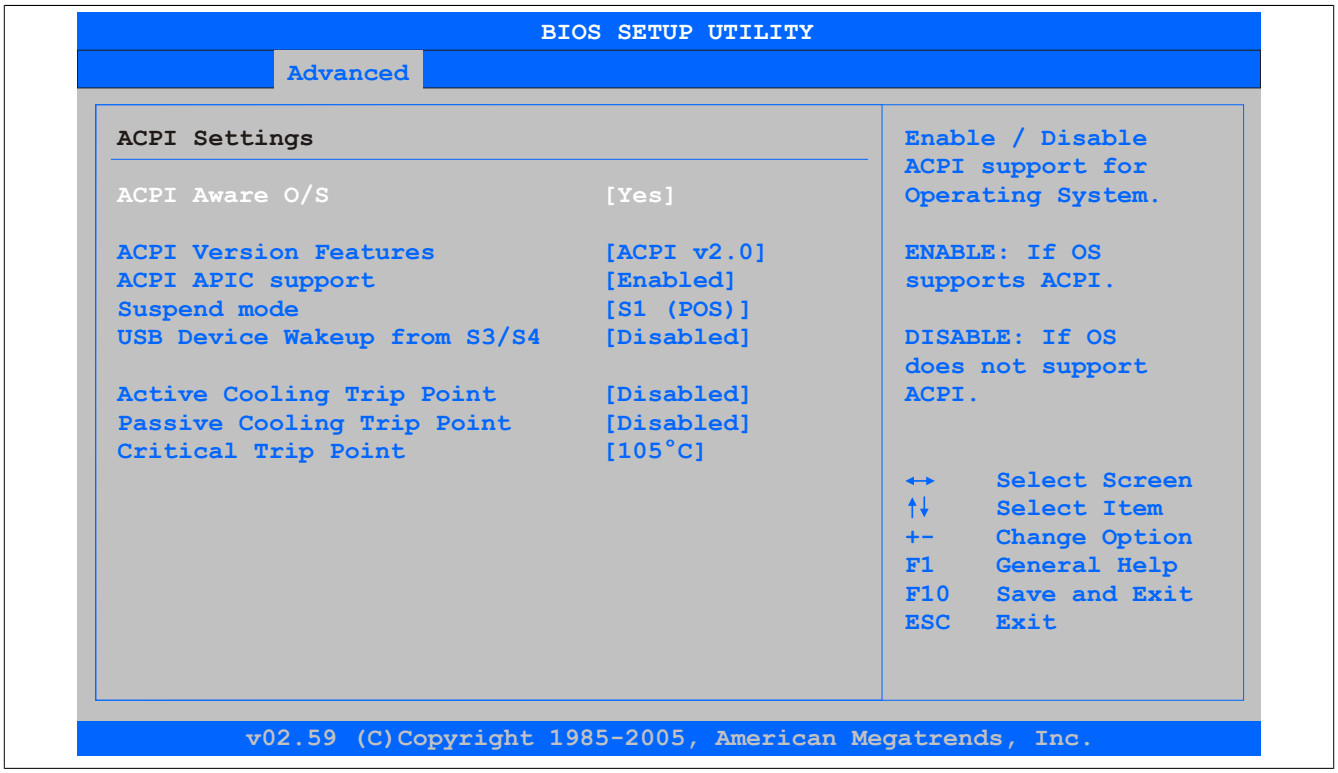


Abbildung 128: 945GME Advanced ACPI Configuration

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
ACPI Aware O/S	Über diese Funktion wird festgelegt, ob das Betriebssystem die ACPI-Funktion (Advanced Configuration and Power Interface) unterstützt.	Yes	Das Betriebssystem unterstützt ACPI.
		No	Das Betriebssystem unterstützt ACPI nicht.
ACPI Version Features	Option zum Einstellen der zu unterstützenden Energieoptionsspezifikationen. Die Nutzung der ACPI-Funktionen setzt eine entsprechende Unterstützung in den Treibern sowie in den eingesetzten Betriebssystemen voraus.	ACPI v1.0	Nutzen der ACPI Funktionen gemäß v1.0
		ACPI v2.0	Nutzen der ACPI Funktionen gemäß v2.0
		ACPI v3.0	Nutzen der ACPI Funktionen gemäß v3.0
ACPI APIC support	Über diese Option wird die Unterstützung des Advanced Programmable Interrupt Controllers im Prozessor festgelegt.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion
Suspend mode	Auswahl des ACPI Status welcher bei Aktivierung des Suspend Modus verwendet werden soll.	S1 (POS)	Einstellung S1 als Suspend Mode. Es werden nur wenige Funktionen ausgeschaltet und diese stehen auf Tastendruck wieder zur Verfügung
		S3 (STR)	Einstellung S3 als Suspend Mode. Hier wird der aktuelle Zustand des Betriebssystems in das RAM geschrieben und nur dieser wird dann mit Strom versorgt.
USB Device Wakeup from S3/S4	Mit dieser Option kann eine Aktivität an einem angeschlossenen USB-Gerät das System aus dem S3/S4 Schlafzustand aufwecken.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
Active Cooling Trip Point	Über diese Funktion wird ein optionaler CPU Lüfter über das Betriebssystem eingeschaltet, wenn die eingestellte CPU Temperatur erreicht ist.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		50°C, 60°C, 70°C, 80°C, 90°C	Temperatureinstellung für den Active Cooling Trip Point. In 10 Grad Schritten einstellbar.
Passive Cooling Trip Point	Über diese Funktion wird eingestellt, bei welcher CPU Temperatur das Betriebssystem die CPU Geschwindigkeit drosselt.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		50°C, 60°C, 70°C, 80°C, 90°C	Temperatureinstellung für den Passive Cooling Trip Point. In 10 Grad Schritten einstellbar.
Critical Trip Point	Über diese Funktion wird eingestellt, bei welcher CPU Temperatur das Betriebssystem das System herunterfährt.	80°C, 85°C, 90°C, 95°C, 100°C, 105°C, 110°C	Temperatureinstellung für den Critical Trip Point. In 5 Grad Schritten einstellbar.

Tabelle 195: 945GME Advanced ACPI Configuration Einstellmöglichkeiten

1.4.2 PCI Configuration

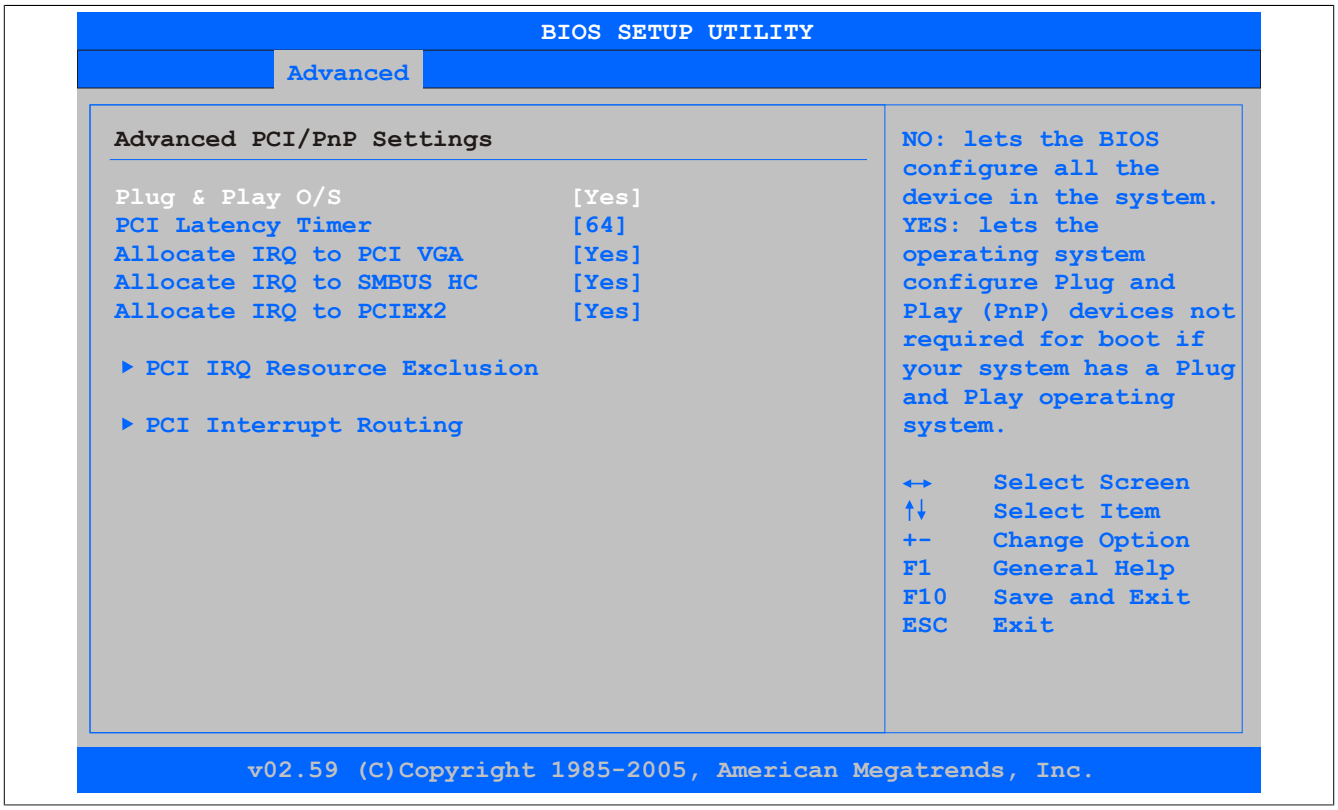


Abbildung 129: 945GME Advanced PCI Configuration

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Plug & Play O/S	Dem BIOS kann hier mitgeteilt werden ob das verwendete Betriebssystem Plug & Play-fähig ist.	Yes	Das Betriebssystem übernimmt die Verteilung der Ressourcen.
		No	BIOS übernimmt die Verteilung der Ressourcen.
PCI Latency Timer	Diese Option kontrolliert, wie lange (in PCI-Ticks) eine Karte des PCI-Bus den Master noch für sich beanspruchen darf, wenn eine andere PCI-Karte bereits einen Zugriff angemeldet hat.	32, 64, 96, 128, 160, 192, 224, 248	Manuelle Einstellung des Wertes in PCI-Ticks.
Allocate IRQ to PCI VGA	Mit dieser Funktion wird festgelegt ob dem PCI VGA ein Interrupt zugewiesen wird.	Yes	Automatische Zuweisung eines Interrupts.
		No	Keine Zuweisung eines Interrupts.
Allocate IRQ to SMBUS HC	Mit dieser Funktion wird festgelegt, ob der SM (System Management) Bus Controller einen PCI Interrupt zugewiesen bekommt oder nicht.	Yes	Automatische Zuweisung eines PCI Interrupts.
		No	Keine Zuweisung eines Interrrupts.
Allocate IRQ to PCIEX2	Mit dieser Funktion wird festgelegt, ob der PCIEX2 einen PCI Interrupt zugewiesen bekommt oder nicht.	Yes	Automatische Zuweisung eines PCI Interrupts.
		No	Keine Zuweisung eines Interrrupts.
PCI IRQ Resource Exclusion	Konfiguration der PCI IRQ Resource Einstellungen für ISA Legacy Geräte.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "PCI IRQ Resource Exclusion" auf Seite 248
PCI Interrupt Routing	Konfiguration des PCI Interrupt Routings	Enter	öffnen des Submenüs siehe "PCI Interrupt Routing" auf Seite 249

Tabelle 196: 945GME Advanced PCI Configuration Einstellmöglichkeiten

1.4.2.1 PCI IRQ Resource Exclusion

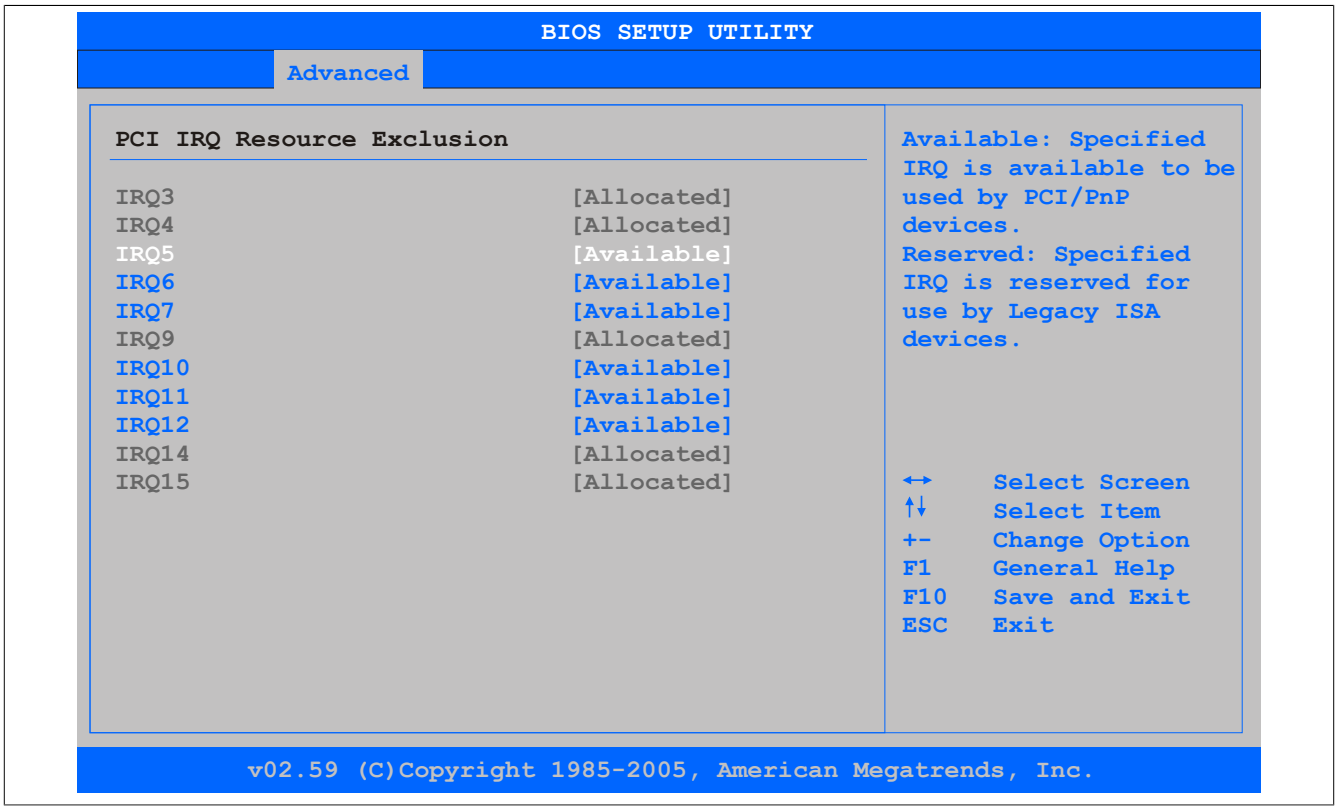


Abbildung 130: 945GME Advanced PCI IRQ Resource Exclusion

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
IRQx	IRQ Interruptzuweisung für Legacy ISA Geräte.	Allocated	Vom System belegt - kann nicht verwendet werden.
		Available	Verfügbar - kann verwendet werden.
		Reserved	Reserviert - kann nicht verwendet werden.

Tabelle 197: 945GME Advanced PCI IRQ Resource Exclusion Einstellmöglichkeiten

1.4.2.2 PCI Interrupt Routing

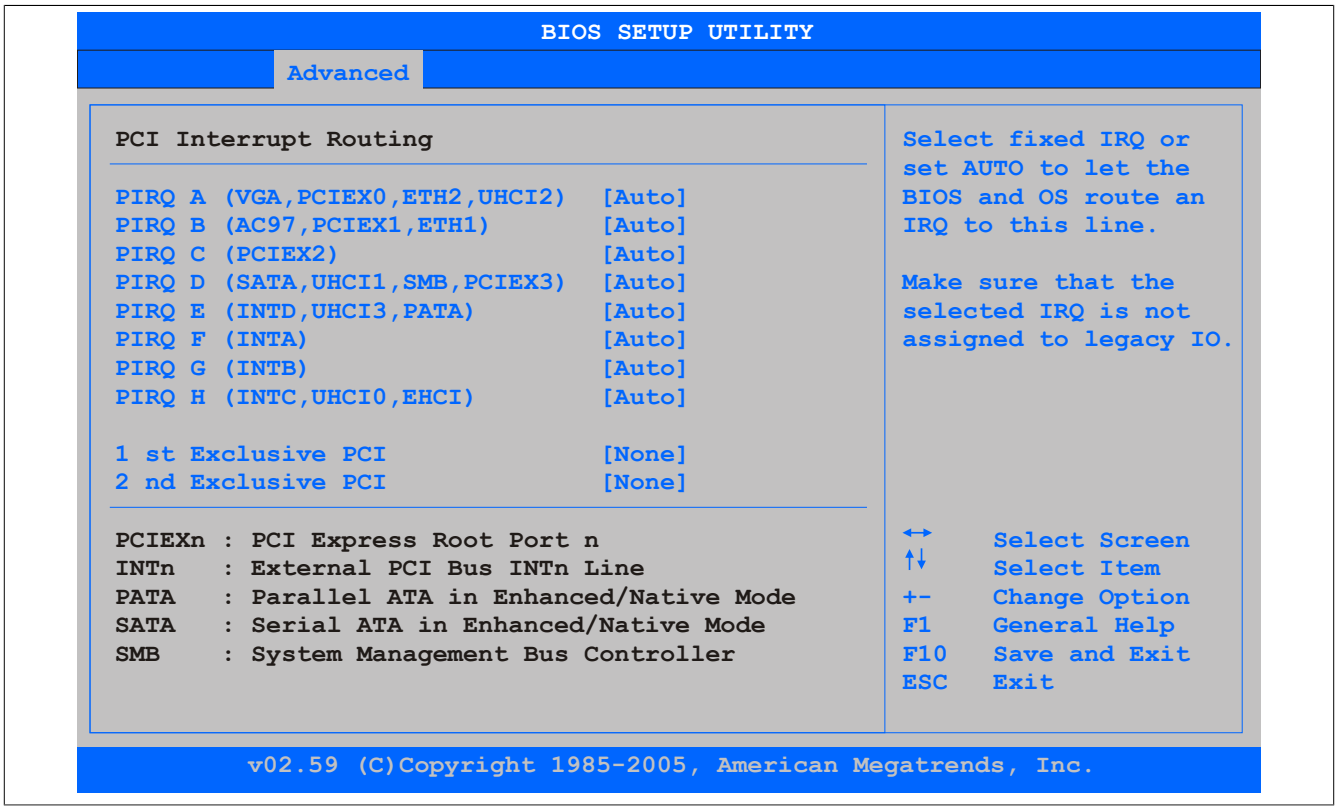


Abbildung 131: 945GME Advanced PCI Interrupt Routing

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
PIRQ A (VGA,PCIEX0, ETH2,UHCI2)	Option zum Einstellen des PIRQ A.	Auto	Automatische Zuordnung durch das BIOS und das Betriebssystem.
		5,6,7,9,10,11,12	Manuelle Zuordnung.
PIRQ B (AC97,PCIEX1, ETH1)	Option zum Einstellen des PIRQ B.	Auto	Automatische Zuordnung durch das BIOS und das Betriebssystem.
		5,6,7,9,10,11,12	Manuelle Zuordnung.
PIRQ C (PCIEX2)	Option zum Einstellen des PIRQ C.	Auto	Automatische Zuordnung durch das BIOS und das Betriebssystem.
		5,6,7,9,10,11,12	Manuelle Zuordnung.
PIRQ D (SATA,UH-CI1,SMB, PCIEX3)	Option zum Einstellen des PIRQ D.	Auto	Automatische Zuordnung durch das BIOS und das Betriebssystem.
		5,6,7,9,10,11,12	Manuelle Zuordnung.
PIRQ E (INTD,UHCI3,PA-TA)	Option zum Einstellen des PIRQ E.	Auto	Automatische Zuordnung durch das BIOS und das Betriebssystem.
		5,6,7,9,10,11,12	Manuelle Zuordnung.
PIRQ F (INTA)	Option zum Einstellen des PIRQ F.	Auto	Automatische Zuordnung durch das BIOS und das Betriebssystem.
		5,6,7,9,10,11,12	Manuelle Zuordnung.
PIRQ G (INTB)	Option zum Einstellen des PIRQ G.	Auto	Automatische Zuordnung durch das BIOS und das Betriebssystem.
		5,6,7,9,10,11,12	Manuelle Zuordnung.
PIRQ H (INTC,UHCI0,EH-CI)	Option zum Einstellen des PIRQ H.	Auto	Automatische Zuordnung durch das BIOS und das Betriebssystem.
		5,6,7,9,10,11,12	Manuelle Zuordnung.

Tabelle 198: 945GME Advanced PCI Interrupt Routing Einstellmöglichkeiten

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
1 st Exclusive PCI	Mit dieser Option wird festgelegt, ob der unter PIRQ x zugewiesene IRQ exklusive (kein IRQ sharing) behandelt wird. **Information:** **Wird nur angezeigt wenn ein PIRQ manuell eingestellt wird (z.B. 5).**	None	Es wird kein Interrupt zugewiesen.
		x	Zuweisung des PIRQ als 1st Exclusiv PCI IRQ.
2 nd Exclusive PCI	Mit dieser Option wird festgelegt, ob der unter PIRQ x zugewiesene IRQ exklusive (kein IRQ sharing) behandelt wird. **Information:** **Wird nur angezeigt wenn zwei PIRQ manuell eingestellt werden.**	None	Es wird kein Interrupt zugewiesen.
		x	Zuweisung des PIRQ als 2nd Exclusiv PCI IRQ.

Tabelle 198: 945GME Advanced PCI Interrupt Routing Einstellmöglichkeiten

1.4.3 PCI Express Configuration

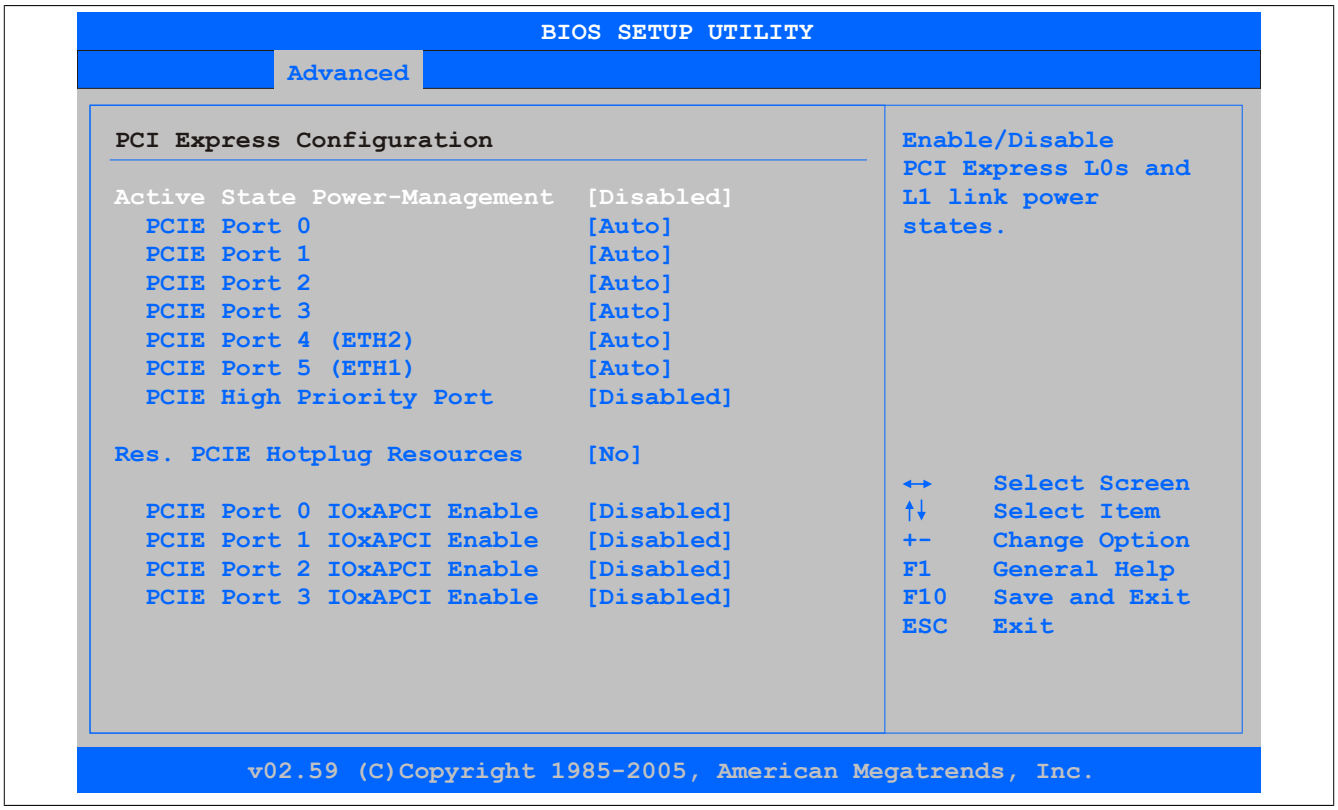


Abbildung 132: 945GME Advanced PCI Express Configuration

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Active State Power- Management	Option zum Einstellen einer Energiesparfunktion (L0s/L1) für PCIE Slots wenn diese nicht sämtliche Leistung benötigen.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
PCIE Port 0	Mit dieser Option aktivieren oder deaktivieren Sie die PCI Express-Anschlussfunktion. **Information:** **Verwenden Sie keine PCI-Express Geräte, sollten sie die Option deaktivieren.**	Auto	Automatische Zuordnung durch das BIOS und das Betriebssystem.
		Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
PCIE Port 1	Mit dieser Option aktivieren oder deaktivieren Sie die PCI Express-Anschlussfunktion. **Information:** **Verwenden Sie keine PCI-Express Geräte, sollten sie die Option deaktivieren.**	Auto	Automatische Zuordnung durch das BIOS und das Betriebssystem.
		Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
PCIE Port 2	Mit dieser Option aktivieren oder deaktivieren Sie die PCI Express-Anschlussfunktion.	Auto	Automatische Zuordnung durch das BIOS und das Betriebssystem.

Tabelle 199: 945GME Advanced PCI Express Configuration Einstellmöglichkeiten

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
	Information: **Verwenden Sie keine PCI-Express Geräte, sollten sie die Option deaktivieren.**	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
PCIE Port 3	Mit dieser Option aktivieren oder deaktivieren Sie die PCI Express-Anschlussfunktion. **Information:** **Verwenden Sie keine PCI-Express Geräte, sollten sie die Option deaktivieren.**	Auto	Automatische Zuordnung durch das BIOS und das Betriebssystem.
		Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
PCIE Port 4 (ETH2)	Mit dieser Option aktivieren oder deaktivieren Sie die PCI Express-Anschlussfunktion. **Information:** **Verwenden Sie keine PCI-Express Geräte, sollten sie die Option deaktivieren.**	Auto	Automatische Zuordnung durch das BIOS und das Betriebssystem.
		Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
PCIE Port 5 (ETH1)	Mit dieser Option aktivieren oder deaktivieren Sie die PCI Express-Anschlussfunktion. **Information:** **Verwenden Sie keine PCI-Express Geräte, sollten sie die Option deaktivieren.**	Auto	Automatische Zuordnung durch das BIOS und das Betriebssystem.
		Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
PCIE High Priority Port	Mit dieser Option aktivieren oder deaktivieren Sie den Prioritätsport für den PCIE.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Port 0	Aktivierung des Port 0 als Prioritätsport.
		Port 1	Aktivierung des Port 1 als Prioritätsport.
		Port 2	Aktivierung des Port 2 als Prioritätsport.
		Port 3	Aktivierung des Port 3 als Prioritätsport.
		ETH2	Aktivierung des ETH2 Port als Prioritätsport.
		ETH1	Aktivierung des ETH1 Port als Prioritätsport.
Res. PCIE Hotplug Resource	Mit dieser Option kann eine I/O und Memory Resource für einen nicht benützten PCIE Port reserviert werden. Einen PCIE Port auf Enabled zu setzen und Resourcen zu reservieren ist für eine ExpressCard hot-plug Unterstützung am betreffenden Port notwendig.	Yes	Resource wird reserviert.
		No	Resource wird nicht reserviert.
PCIE Port 0 IOxAPCI Enable	Mit dieser Option aktivieren oder deaktivieren Sie den APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller) am PCIE Port 0. Bei aktiviertem APIC-Modus werden die dem System zur Verfügung stehenden IRQ-Ressourcen erweitert.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
PCIE Port 1 IOxAPCI Enable	Mit dieser Option aktivieren oder deaktivieren Sie den APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller) am PCIE Port 1. Bei aktiviertem APIC-Modus werden die dem System zur Verfügung stehenden IRQ-Ressourcen erweitert.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
PCIE Port 2 IOxAPCI Enable	Mit dieser Option aktivieren oder deaktivieren Sie den APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller) am PCIE Port 2. Bei aktiviertem APIC-Modus werden die dem System zur Verfügung stehenden IRQ-Ressourcen erweitert.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
PCIE Port 3 IOxAPCI Enable	Mit dieser Option aktivieren oder deaktivieren Sie den APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller) am PCIE Port 3. Bei aktiviertem APIC-Modus werden die dem System zur Verfügung stehenden IRQ-Ressourcen erweitert.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.

Tabelle 199: 945GME Advanced PCI Express Configuration Einstellmöglichkeiten

1.4.4 Graphics Configuration

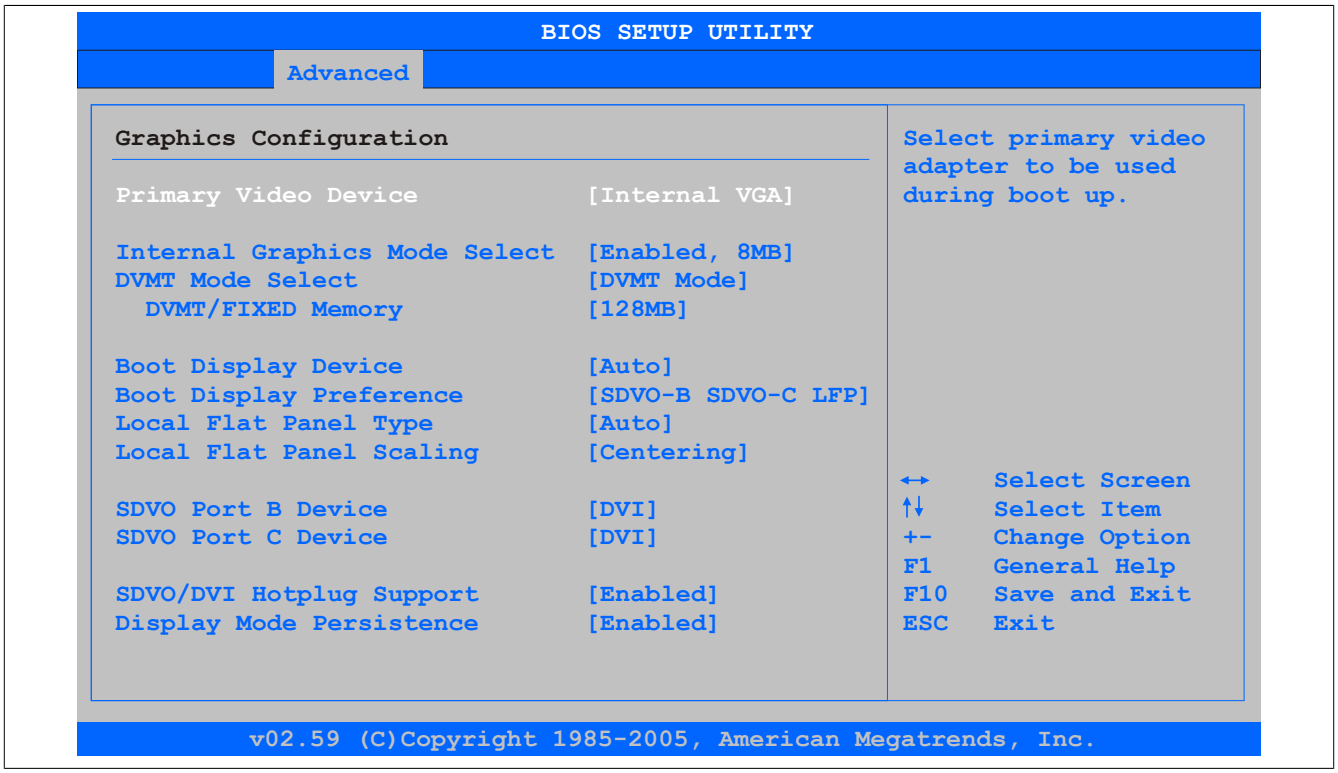


Abbildung 133: 945GME Advanced Graphics Configuration

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Primary Video Device	Option zur Auswahl des primären Anzeigegerätes.	Internal VGA	Als Anzeigegerät wird der interne Grafikchip am CPU Board verwendet (Monitor / Panel Anschluss).
		PCI / Int. VGA	Als Anzeigegerät wird der Grafikchip einer gesteckten Grafikkarte verwendet.
Internal Graphics Mode Select	Option zur Einstellung der Speichergröße, welche für den internen Grafikcontroller verwendet werden kann.	Disabled	Keine Reservierung - Deaktivierung des Grafikcontrollers.
		Enabled, 1MB	1MB Hauptspeicher wird zur Verfügung gestellt.
		Enabled, 8MB	8MB Hauptspeicher wird zur Verfügung gestellt.
DVMT Mode Select	Option zur Festlegung des DVMT Mode (Dynamic Video Memory Technology) des DVMT Grafiktreibers.	Fixed Mode	Dem Grafikchip wird eine feste Speichergröße zugeteilt, die dann allerdings dem PC nicht mehr zur Verfügung steht.
		DVMT Mode	Es erfolgt eine dynamische Regelung des Speicherbedarfs durch den DVMT Grafiktreiber. Es wird nur der benötigte Speicher belegt.
		Combo Mode	Der DVMT Grafiktreiber reserviert mind. 64MB, kann aber bei Bedarf bis zu 224MB belegen.
DVMT/FIXED Memory	Option zur Einstellung der verwendeten Speichergröße für den DVMT Modus.	64MB	64MB Hauptspeicher können verwendet werden.
		128MB	128MB Hauptspeicher können verwendet werden.
		Maximum DVMT	Der restliche freie Hauptspeicher kann verwendet werden.
Boot Display Device	Hier kann festgelegt werden, welcher Videokanal für ein Anzeigegerät beim Booten aktiviert werden soll.	Auto	Automatische Auswahl.
		CRT only	Nur den CRT (Cathode Ray Tube) Kanal benutzen.
		SDVO only	Nur den SDVO (Serial Digital Video Out) Kanal benutzen.
		CRT + SDVO	CRT und SDVO Kanal benutzen.
		LFP only	Nur den LFP (Local Flat Panel) Kanal benutzen.
		CRT + LFP	CRT + LFP Kanal benutzen.
Boot Display Preference	Die Option legt die Reihenfolge fest, in welcher die Geräte an den angeschlossenen Kanälen LFP und SDVO überprüft und gebootet werden sollen. **Information:** **Die Einstellung hat nur Auswirkung auf das System, wenn die Option Boot Display Device auf „Auto“ gestellt ist.**	LFP SDVO-B SDVO-C	Local Flat Panel - Serial Digital Video B output - Serial Video C output.
		LFP SDVO-C SDVO-B	Local Flat Panel - Serial Digital Video C output - Serial Video B output.
		SDVO-B SDVO-C LFP	Serial Digital Video B output - Serial Digital Video C output - Local Flat Panel.
		SDVO-C SDVO-B LFP	Serial Digital Video C output - Serial Digital Video B output - Local Flat Panel.

Tabelle 200: 945GME Advanced Graphics Configuration Einstellmöglichkeiten

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Local Flat Panel Type	Mit dieser Option kann ein vordefiniertes Profil für den LVDS Kanal eingestellt werden.	Auto	Automatische Erkennung und Einstellung anhand der EDID Daten.
		VGA 1x18 (002h)	640 x 480
		VGA 1x18 (013h)	640 x 480
		SVGA 1x18 (004h)	800 x 600
		XGA 1x18 (006h)	1024 x 768
		XGA 2x18 (007h)	1024 x 768
		XGA 1x24 (008h)	1024 x 768
		XGA 2x24 (012h)	1024 x 768
		SXGA 2x24 (00Ah)	1280 x 1024
		SXGA 2x24 (018h)	1280 x 1024
		UXGA 2x24 (00Ch)	1600 x 1200
		Customized EDID 1	Benutzerdefiniertes Profil
		Customized EDID 2	Benutzerdefiniertes Profil
		Customized EDID 3	Benutzerdefiniertes Profil
Local Flat Panel Scaling	Option zur Ausgabemöglichkeit des Bildinhaltes in Abhängigkeit des eingestellten Local Flat Panel Types.	Centering	Der Bildinhalt wird zentriert am Display ausgegeben.
		Expand Text	Der Text wird auf die gesamte Größe des Displays ausgedehnt dargestellt.
		Expand Graphics	Grafiken werden auf die gesamte Größe des Displays ausgedehnt dargestellt.
		Expand Text & Graphics	Text und Grafiken werden auf die gesamte Größe des Displays ausgedehnt dargestellt.
SDVO Port B Device	Option zur Auswahl des Anzeigegerätes welches am SDVO Port B angeschlossen ist.	None	Kein Anzeigegerät angeschlossen.
		DVI	Videosignale werden für ein DVI kompatibles Anzeigegerät optimiert ausgegeben.
		TV	Videosignale werden für ein TV kompatibles Anzeigegerät optimiert ausgegeben.
		CRT	Videosignale werden für ein CRT kompatibles Anzeigegerät optimiert ausgegeben.
		LVDS	Videosignale werden für ein LVDS kompatibles Anzeigegerät optimiert ausgegeben.
		DVI-Analog	Videosignale werden für ein analoges DVI kompatibles Anzeigegerät optimiert ausgegeben.
SDVO Port C Device	Option zur Auswahl des Anzeigegerätes welches am SDVO Port A angeschlossen ist.	None	Kein Anzeigegerät angeschlossen.
		DVI	Videosignale werden für ein DVI kompatibles Anzeigegerät optimiert ausgegeben.
		TV	Videosignale werden für ein TV kompatibles Anzeigegerät optimiert ausgegeben.
		CRT	Videosignale werden für ein CRT kompatibles Anzeigegerät optimiert ausgegeben.
		LVDS	Videosignale werden für ein LVDS kompatibles Anzeigegerät optimiert ausgegeben.
		DVI-Analog	Videosignale werden für ein analoges DVI kompatibles Anzeigegerät optimiert ausgegeben.
SDVO/DVI Hotplug Support	Ist die Option auf Enabled gestellt, so unterstützt der Windows XP Grafik Treiber „hotplug" und „configuration mode persistence" für DVI- Monitore, die an einen DVI SDVO Transmitter angeschlossen sind. „Hotplug"-Unterstützung bedeutet, dass ein angeschlossener DVI Monitor während laufendem Betriebssystem automatisch erkannt und aktiviert wird. „Configuration mode persistance" bedeutet, dass z.B. eine duale DVI Anzeigekonfiguration automatisch wiederhergestellt wird wenn beide DVI Monitore wieder angeschlossen sind auch wenn während eines früheren Bootvorgangs nur ein DVI Monitor angeschlossen und aktiviert wurde.	Enabled	Aktivierung des „Hotplug"- und „Configuration mode persistence"- Modus.
		Disabled	Deaktivierung des „Hotplug"- und „Configuration mode persistence"- Modus.
Display Mode Persistence	Display Mode Persistance bedeutet, dass sich das Betriebssystem an vergangene Display-Anschlusskonfigurationen erinnern und wiederherstellen kann. z.B. wird eine duale DVI Anzeigekonfiguration automatisch wiederhergestellt wenn beide DVI Monitore wieder angeschlossen werden, auch wenn während eines früheren Bootvorgangs nur ein DVI Monitor angeschlossen und aktiviert wurde.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.

Tabelle 200: 945GME Advanced Graphics Configuration Einstellmöglichkeiten

1.4.5 CPU Configuration

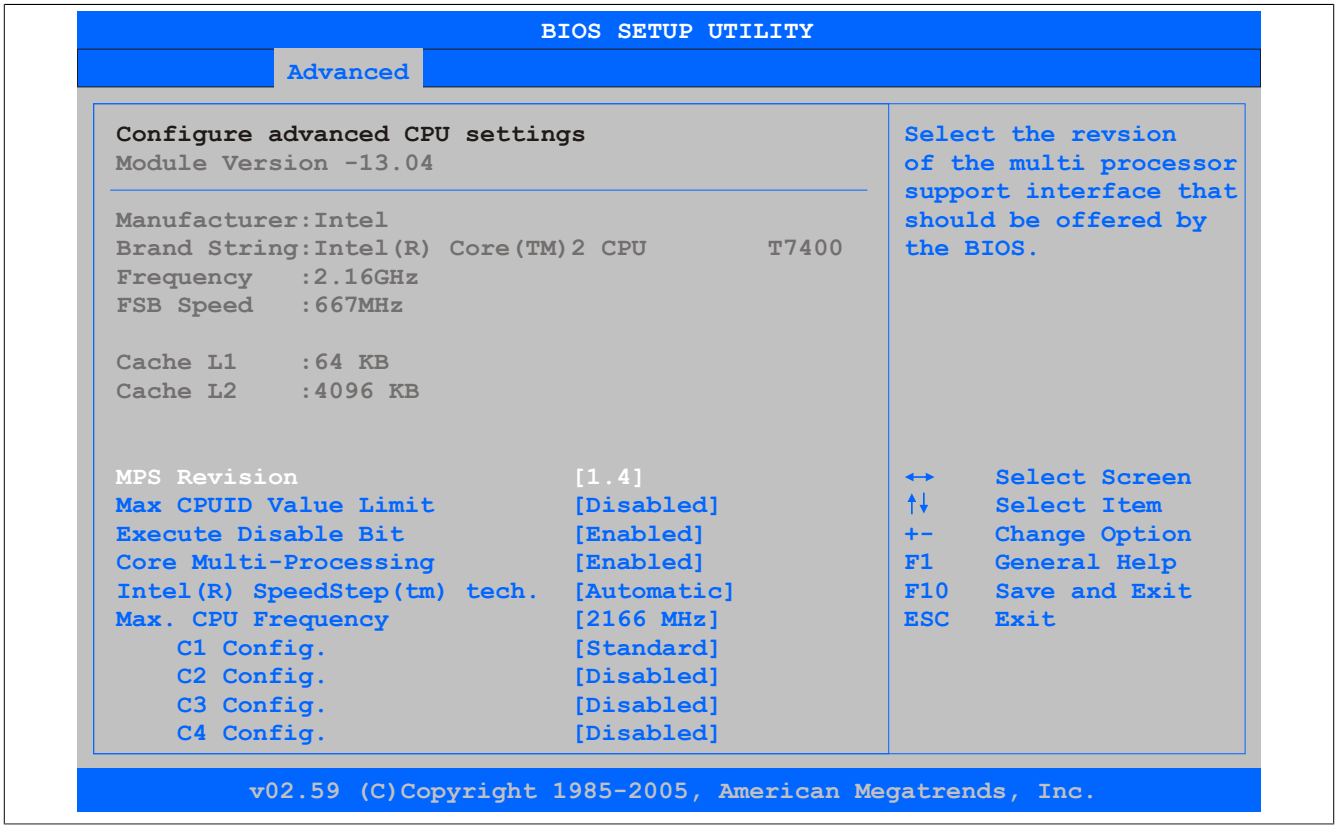


Abbildung 134: 945GME Advanced CPU Configuration

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
MPS Revision	Diese Option unterstützt den Einsatz von mehreren CPUs (MPS=Multiprozessorsystem).	1.1	Einstellung der MPS Unterstützung Revision 1.1
		1.4	Einstellung der MPS Unterstützung Revision 1.4
Max CPUID Value Limit	Option zur Limitierung des CPUID Eingangswertes. Dies kann z.B. bei älteren Betriebssystemen notwendig sein.	Enabled	Der Prozessor limitiert bei Bedarf den maximalen CPUID Eingangswert auf 03h wenn der Prozessor einen höheren Wert unterstützt.
		Disabled	Bei Anfrage des CPUID Eingangswertes liefert der Prozessor den aktuell maximalen Wert zurück.
Execute Disable Bit	Option zum Aktivieren oder Deaktivieren der Hardwareunterstützung zur Unterbindung der Datenausführung.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
Core Multi-Processing	Bei einem Dual Core Prozessor kann mit dieser Option ein Kern deaktiviert werden.	Enabled	Bei einem Dual Core Prozessor werden beide Kerne genutzt.
		Disabled	Bei einem Dual Core Prozessor wird nur ein Kern verwendet.
Intel(R) SpeedStep(TM) tech.	Option zum Regeln der Intel(R) SpeedStep(TM) Technologie. Der Prozessor wird entsprechend der Menge von auszuführenden Berechnungen hoch- oder heruntergetaktet. Dadurch hängt der Energieverbrauch stark von der Auslastung des Prozessors ab.	Automatic	Die Prozessorgeschwindigkeit wird durch das Betriebssystem geregelt.
		Maximum Speed	Die Prozessorgeschwindigkeit wird auf ein Maximum gesetzt.
		Minimum Speed	Die Prozessorgeschwindigkeit wird auf ein Minimum gesetzt.
		Disabled	Deaktivierung der SpeedStep Technologie.
Max. CPU Frequency	Option zur Einstellung der maximalen Prozessorgeschwindigkeit wenn bei der Option „Intel(R) SpeedStep(TM) tech.“ die Werte „Automatic“ oder „Maximum Speed“ eingestellt ist.	xxxx MHz	Die Prozessorgeschwindigkeit wird auf den eingestellten Wert begrenzt.
C1 Config	Power Management des Intel Core Duo Prozessores.	Standard	Standard C1 Unterstützung.
		Enhanced	Enhanced C1 Unterstützung.
C2 Config	Power Management des Intel Core Duo Prozessores.	Standard	Standard C2 Unterstützung.
		Enhanced	Enhanced C2 Unterstützung.
		Disabled	Disabled C2 Unterstützung.
C3 Config	Power Management des Intel Core Duo Prozessores.	Standard	Standard C3 Unterstützung.
		Enhanced	Enhanced C3 Unterstützung.
		Disabled	Disabled C3 Unterstützung.
C4 Config	Power Management des Intel Core Duo Prozessores.	Standard	Standard C4 Unterstützung.
		Enhanced	Enhanced C4 Unterstützung.
		Disabled	Disabled C4 Unterstützung.

Tabelle 201: 945GME Advanced CPU Configuration Einstellmöglichkeiten

1.4.6 Chipset Configuration

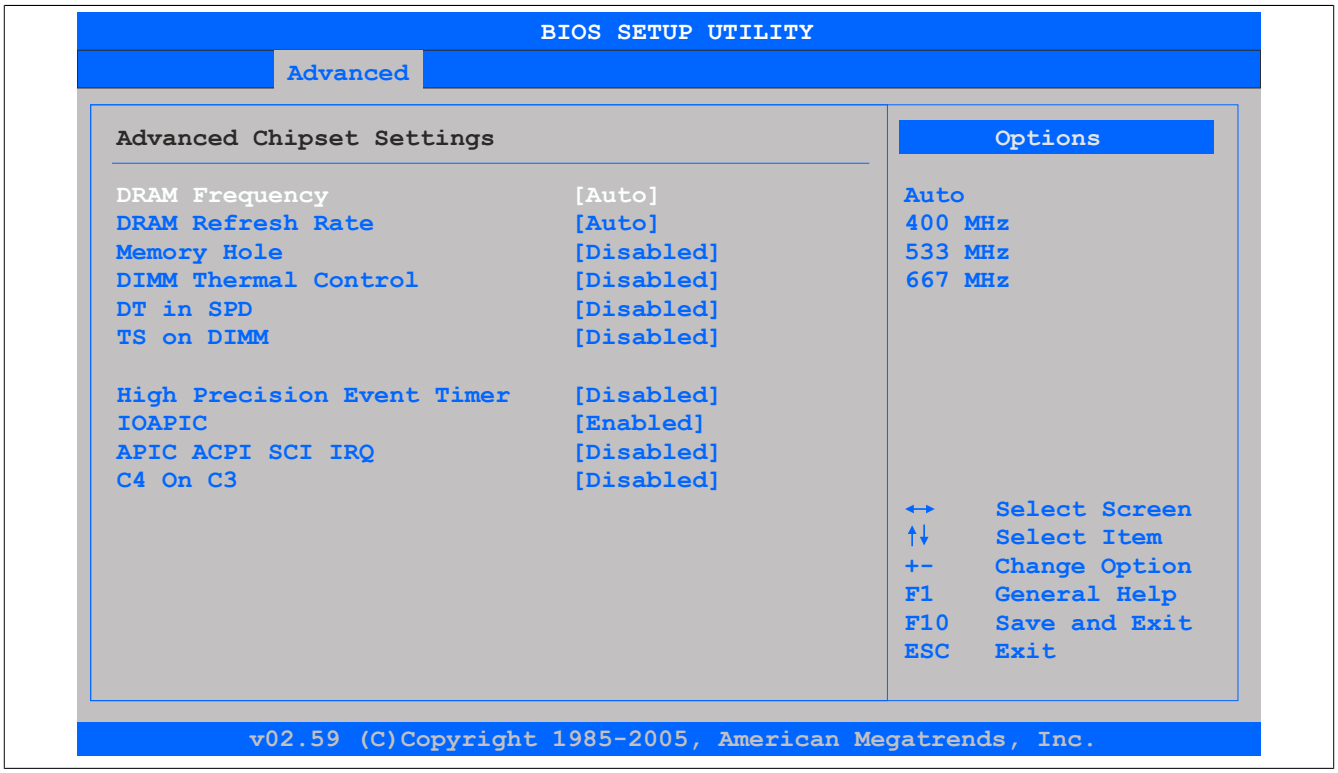


Abbildung 135: 945GME Advanced Chipset Configuration

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
DRAM Frequency	Option zum Einstellen der Arbeitsspeicherfrequenz.	Auto	Automatische Einstellung der Frequenz durch das BIOS.
		400, 533, 667 MHz	Manuelle Einstellung der gewünschten Taktfrequenz.
DRAM Refresh Rate	Option zum Einstellen der DRAM Refresh Rate.	Auto	DRAM Refresh wird aus den SPD Daten des DRAM Moduls gelesen.
		7,8µs	Manuelle Einstellung der DRAM Refresh Rate.
		3,9µs	Manuelle Einstellung der DRAM Refresh Rate.
Memory Hole	Option interessant für ISA-Karten mit einem Framebuffer. Bei einem APC810 nicht von Bedeutung.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		15MB-16MB	Der Adressbereich wird reserviert.
DIMM Thermal Control	Option zum Einstellen der maximalen Oberflächentemperatur der DIMM Module. Wird die eingestellte Oberflächentemperatur erreicht, dann wird durch eine Limitierung der Speicherbandbreite eine Kühlung des Modules erreicht.	Disabled	Keine Begrenzung der Oberflächentemperatur.
		40°C, 50°C, 60°C, 70°C, 80°C, 85°C, 90°C	Temperaturgrenzwert für die Limitierung.
DT in SPD	Option, ob der GMCH (Graphics and Memory Controller Hub) die DT (Delta Temperature) im SPD (Serial Presence Detect) Management Algorithmus des DIMM Moduls unterstützt.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
TS on DIMM	Option, ob der GMCH (Graphics and Memory Controller Hub) den TS (Thermal Sensor) im Thermal Management Algorithmus des DIMM Moduls unterstützt.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
High Precision Event Timer	Der HPET ist ein Zeitgeber im PC. Er ist in der Lage einen Interrupt mit sehr hoher Präzision auszulösen und andere Programme können diverse Anwendungen besser synchronisieren.	Enabled	Aktivierung der Funktion. Bei Mulitmedia Anwendungen wird empfohlen, die Funktion auf Enabled zu stellen.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
IOAPIC	Diese Option wird verwendet, um den APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller) zu aktivieren oder zu deaktivieren. **Information:** **Bei aktiviertem APIC-Modus werden die dem System zur Verfügung stehenden IRQ-Ressourcen erweitert.**	Enabled	Bei aktiviertem APIC-Modus werden die dem System zur Verfügung stehenden IRQ-Ressourcen erweitert.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.

Tabelle 202: 945GME Advanced Chipset Einstellmöglichkeiten

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
APIC ACPI SCI IRQ	Diese Option wird verwendet, um den SCI IRQ bei APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller) Modus zu modifizieren.	Enabled	IRQ20 wird für SCI verwendet.
		Disabled	IRQ9 wird für SCI verwendet.
C4 On C3	Verfeinerung der Energiesparfunktion bei einem ACPI Betriebssystem.	Enabled	Prozessor wird in C4 gebracht, wenn das Betriebssystem in einen C3 Zustand initiiert.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.

Tabelle 202: 945GME Advanced Chipset Einstellmöglichkeiten

1.4.7 I/O Interface Configuration

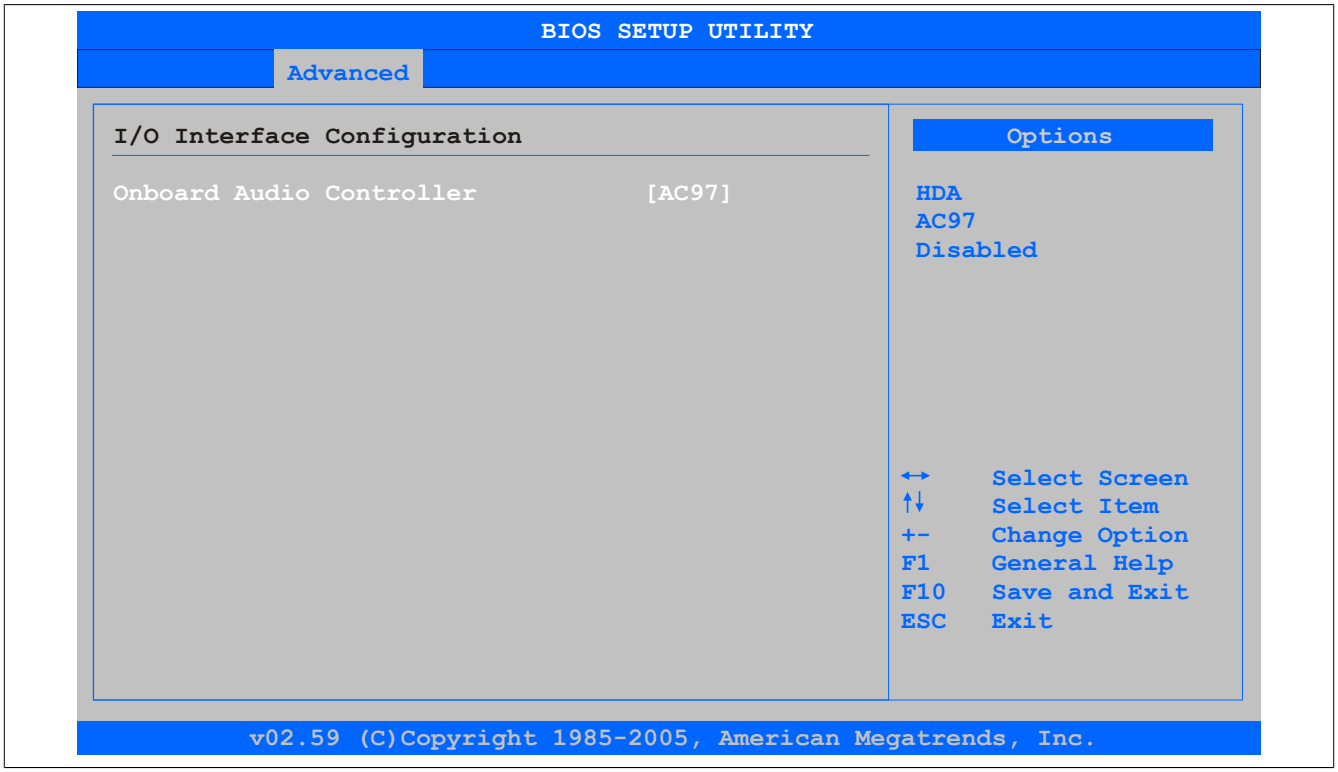


Abbildung 136: 945GME Advanced I/O Interface Configuration

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Onboard Audio Controller	Hier kann der Audio Modus ausgewählt bzw. ausgeschaltet werden.	HDA	Aktivierung des High Definition Audio Sound.
		AC97	Aktivierung des AC'97 Sound.
		Disabled	Deaktivierung des Audio Controllers.

Tabelle 203: 945GME Advanced I/O Interface Configuration Einstellmöglichkeiten

1.4.8 Clock Configuration

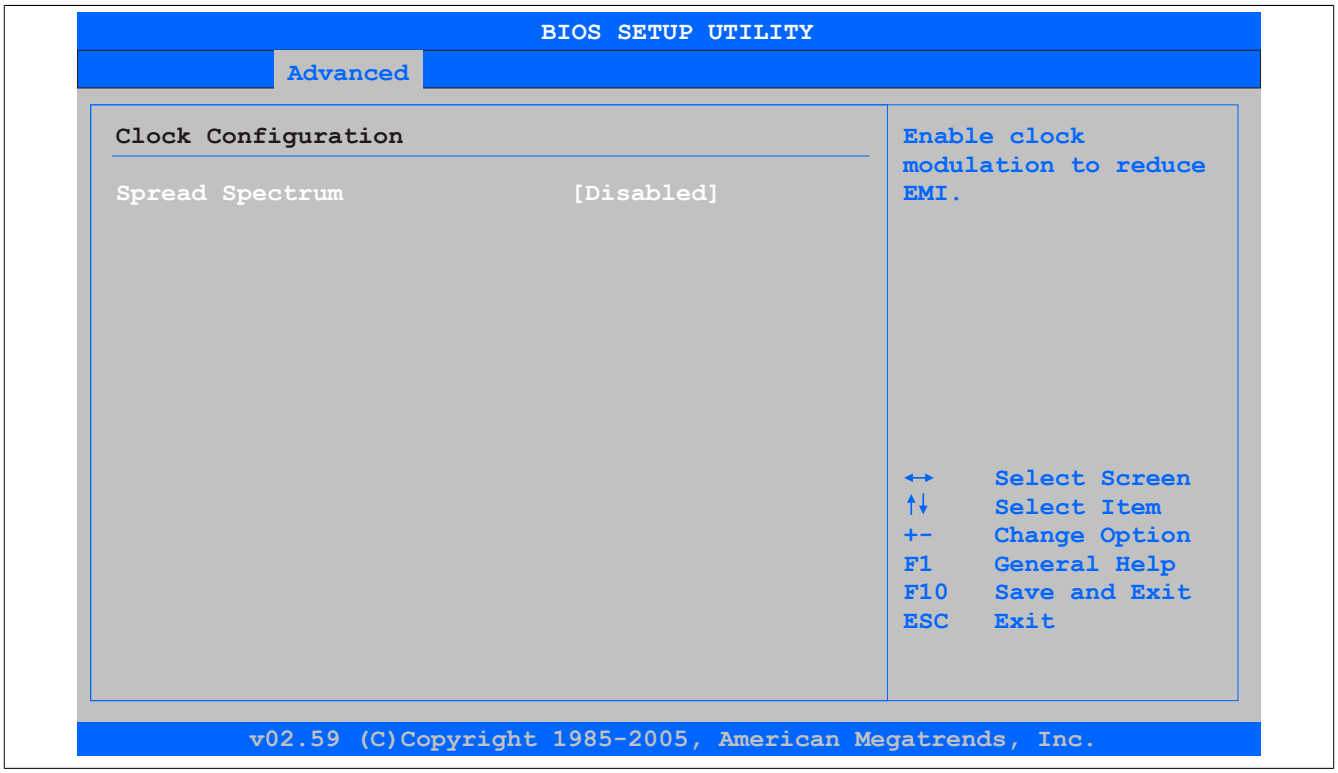


Abbildung 137: 945GME Advanced Clock Configuration

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Spread Spectrum	Mit dieser Option kann der Takt geringfügig frequenzmoduliert werden, wodurch sich die elektromagnetische Störstrahlung verringert.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.

Tabelle 204: 945GME Advanced Clock Configuration Einstellmöglichkeiten

1.4.9 IDE Configuration

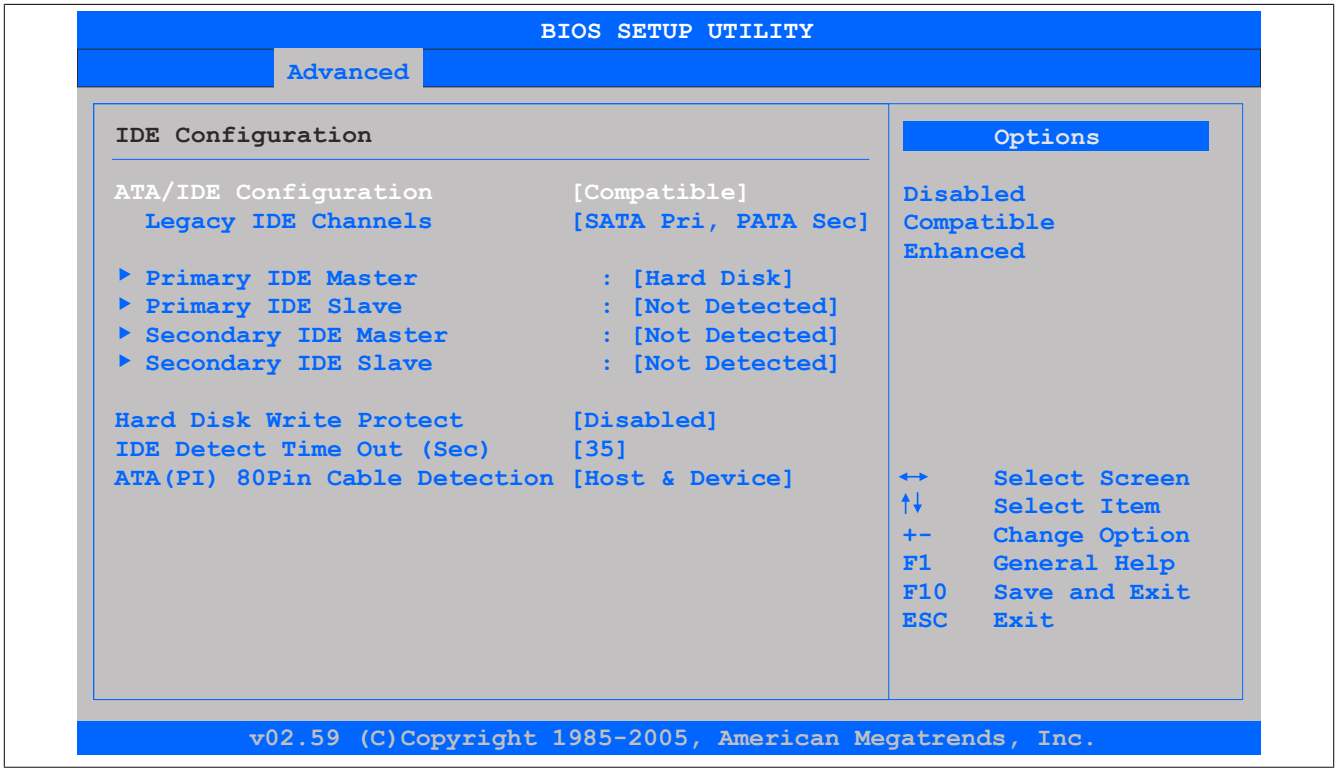


Abbildung 138: 945GME Advanced IDE Configuration

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
ATA/IDE Configuration	Option zum Konfigurieren der integrierten PATA und SATA Controller.	Compatible	Beide Controller arbeiten in Legacy oder Compatible Modus.
		Disabled	Deaktivierung beider Controller.
		Enhanced	Beide Controller arbeiten in Enhanced oder Native Modus.
Legacy IDE Channels[1]	Option zum Konfigurieren der Legacy IDE Kanäle im „Compatible“ Modus.	SATA Pri, PATA Sec	SATA Laufwerke werden primär und PATA Laufwerke werden sekundär angesprochen.
		SATA only	Nur SATA Laufwerke verwenden.
		PATA only	Nur PATA Laufwerke verwenden.
Configure SATA as[2]	Hier können die von der Southbridge unterstützten Serial ATA Anschlüsse eingestellt werden.	IDE	Die Serial ATA-Festplatte wird als Parallel ATA physikalisches Speicherlaufwerk benutzt.
		RAID	Hier kann RAID 0, 1, 5, 10 oder die Intel® Matrix Storage Technologie mit der Serial ATA Festplatte konfiguriert werden.
		AHCI	Mit der Einstellung AHCI kann man den internen Speichertreiber der SATA-Funktionen aktivieren, welche die Speicherleistung bei zufälligem Schreib-Lese-Zugriff erhöhen, indem das Laufwerk die Reihenfolge der Befehle selbst festlegt.
Configure SATA Channels[3]	Hier können SATA- bzw. PATA- Laufwerke als Primary bzw. Secondary Device eingestellt werden.	Before PATA	Die SATA- Laufwerke sind die Primary Devices, und PATA somit die Secondary.
		Behind PATA	Die PATA- Laufwerke sind die Primary Devices, und SATA somit die Secondary.
AHCI/RAID SATA Hotplug[4]	Hier kann der Hotplug-Support für AHCI/RAID-Systeme eingestellt werden.	Enabled	Aktiviert den Hotplug-Support.
		Disabled	Deaktiviert den Hotplug-Support.
Primary IDE Master	Hier wird das im System vorhandene Laufwerk, das am IDE Primary Master Port angeschlossen ist, parametriert.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Primary IDE Master" auf Seite 259
Primary IDE Slave	Hier wird das im System vorhandene Laufwerk, das am IDE Primary Slave Port angeschlossen ist, parametriert.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Primary IDE Slave" auf Seite 260
Secondary IDE Master	Hier wird das im System vorhandene Laufwerk, das am IDE Secondary Master Port angeschlossen ist, parametriert.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Secondary IDE Master" auf Seite 261
Secondary IDE Slave	Hier wird das im System vorhandene Laufwerk, das am IDE Secondary Slave Port angeschlossen ist, parametriert.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Secondary IDE Slave" auf Seite 262
Hard Disk Write Protect	Hier kann der Schreibschutz für die Festplatte aktiviert/deaktiviert werden.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
IDE Detect Time Out (Sec)	Einstellung des Zeitüberschreitungsgrenzwertes der ATA/ATAPI Geräteerkennung.	0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35	Zeiteinstellung in Sekunden.
ATA(PI) 80Pin Cable Detection	Hier wird eingestellt, ob ein 80Pin Kabel am Laufwerk, am Controller oder am Laufwerk und Controller angeschlossen ist. **Information:** **Diese Option ist beim APC810 CPU Board nicht vorhanden. Somit ist diese Einstellung unrelevant.**	Host & Device	Verwendung beider IDE Controller. (motherboard, disk drive).
		Host	Verwendung des Motherboard IDE Controllers.
		Device	Verwendung des IDE disk drive Controllers.

Tabelle 205: 945GME Advanced IDE Configuration Einstellmöglichkeiten

1) Diese Einstellungen sind nur möglich, wenn *ATA/IDE Configuration* auf *Compatible* eingestellt ist.
2) Diese Einstellungen sind nur möglich, wenn *ATA/IDE Configuration* auf *Enhanced* eingestellt ist.
3) Diese Einstellungen sind nur möglich, wenn *ATA/IDE Configuration* auf *Enhanced* und *Configure SATA as* auf *IDE* oder *AHCI* eingestellt ist.
4) Diese Einstellungen sind nur möglich, wenn *ATA/IDE Configuration* auf *Enhanced* und *Configure SATA as* auf *RAID* oder *AHCI* eingestelltist.

1.4.9.1 Primary IDE Master

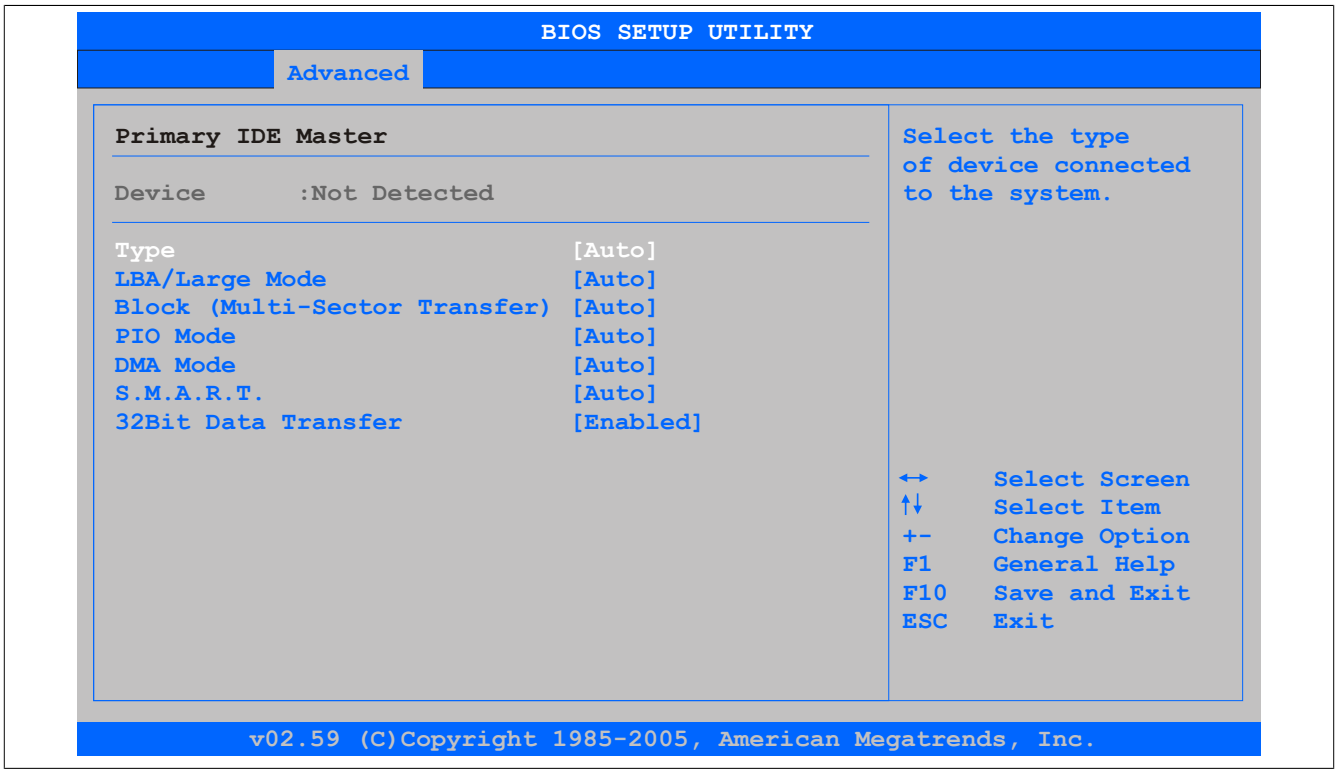


Abbildung 139: 945GME Primary IDE Master

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Type	Hier wird der Typ des am Primary Master angeschlossenen Laufwerks parametriert.	Not Installed	Kein Laufwerk installiert.
		Auto	Automatische Erkennung des Laufwerks und Einstellung der richtigen Werte.
		CD/DVD	CD-/DVD-Laufwerk.
		ARMD	ARMD-Laufwerk (Zip-Laufwerk).
LBA/Large Mode	Mit dieser Option wird der Logical-Block- Addressing/Large Modus für IDE aktiviert.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Auto	Automatische Aktivierung der Funktion wenn es vom System unterstützt wird.
Block (Multi-Sector Transfer)	Mit dieser Option wird der Block-Mode von IDE-Festplatten aktiviert. Bei Aktivierung dieser Option wird die Zahl der Blöcke pro Anforderung aus dem Konfigurationssektor der Festplatte ausgelesen.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Auto	Automatische Aktivierung der Funktion wenn es vom System unterstützt wird.
PIO Mode	Der PIO-Modus bestimmt die Datenrate der Festplatte. **Information:** **Diese Option ist beim APC810 nicht vorhanden. Somit ist diese Einstellung unrelevant.**	Auto	Automatische Einstellung des PIO Modus.
		0, 1, 2, 3, 4	Manuelle Einstellung des PIO Modus.
DMA Mode	Hier wird die Datenübertragungsrate zum und vom Primary Master Laufwerk festgelegt. Der DMA-Mode muss unter Windows im Gerätemanager aktiviert werden, erst dann ist die volle Performance garantiert. Kann nur bei manueller Einstellung des Laufwerkes eingestellt werden.	Auto	Automatische Festlegung der Übertragungsrate.
		Disabled	Manuelle Festlegung der Übertragungsrate.
S.M.A.R.T.	Überwachungsfunktion moderner Festplatten (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology).	Auto	Automatische Erkennung und Aktivierung.
		Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
32 Bit Data Transfer	Diese Funktion ermöglicht den 32-Bit IDE Datentransfer.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.

Tabelle 206: 945GME Primary IDE Master Einstellmöglichkeiten

1.4.9.2 Primary IDE Slave

Abbildung 140: 945GME Primary IDE Slave

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Type	Hier wird der Typ des am Primary Slave angeschlossenen Laufwerks parametriert.	Not Installed	Kein Laufwerk installiert.
		Auto	Automatische Erkennung des Laufwerks und Einstellung der richtigen Werte.
		CD/DVD	CD-/DVD-Laufwerk.
		ARMD	ARMD-Laufwerk (Zip-Laufwerk).
LBA/Large Mode	Mit dieser Option wird das Logical-Block- Addressing/Large Modus für IDE aktiviert.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Auto	Automatische Aktivierung der Funktion wenn es vom System unterstützt wird.
Block (Multi-Sector Transfer)	Mit dieser Option wird der Block-Mode von IDE-Festplatten aktiviert. Bei Aktivierung dieser Option wird die Zahl der Blöcke pro Anforderung aus dem Konfigurationssektor der Festplatte ausgelesen.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Auto	Automatische Aktivierung der Funktion wenn es vom System unterstützt wird.
PIO Mode	Der PIO-Modus bestimmt die Datenrate der Festplatte. **Information:** **Diese Option ist beim APC810 nicht vorhanden. Somit ist diese Einstellung unrelevant.**	Auto	Automatische Einstellung des PIO Modus.
		0, 1, 2, 3, 4	Manuelle Einstellung des PIO Modus.
DMA Mode	Hier wird die Datenübertragungsrate zum und vom Primary Slave Laufwerk festgelegt. Der DMA-Mode muss unter Windows im Gerätemanager aktiviert werden, erst dann ist die volle Performance garantiert. Kann nur bei manueller Einstellung des Laufwerkes eingestellt werden.	Auto	Automatische Festlegung der Übertragungsrate.
		Disabled	Manuelle Festlegung der Übertragungsrate.
S.M.A.R.T.	Überwachungsfunktion moderner Festplatten (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology).	Auto	Automatische Erkennung und Aktivierung.
		Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
32 Bit Data Transfer	Diese Funktion ermöglicht den 32-Bit IDE Datentransfer.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.

Tabelle 207: 945GME Primary IDE Slave Einstellmöglichkeiten

1.4.9.3 Secondary IDE Master

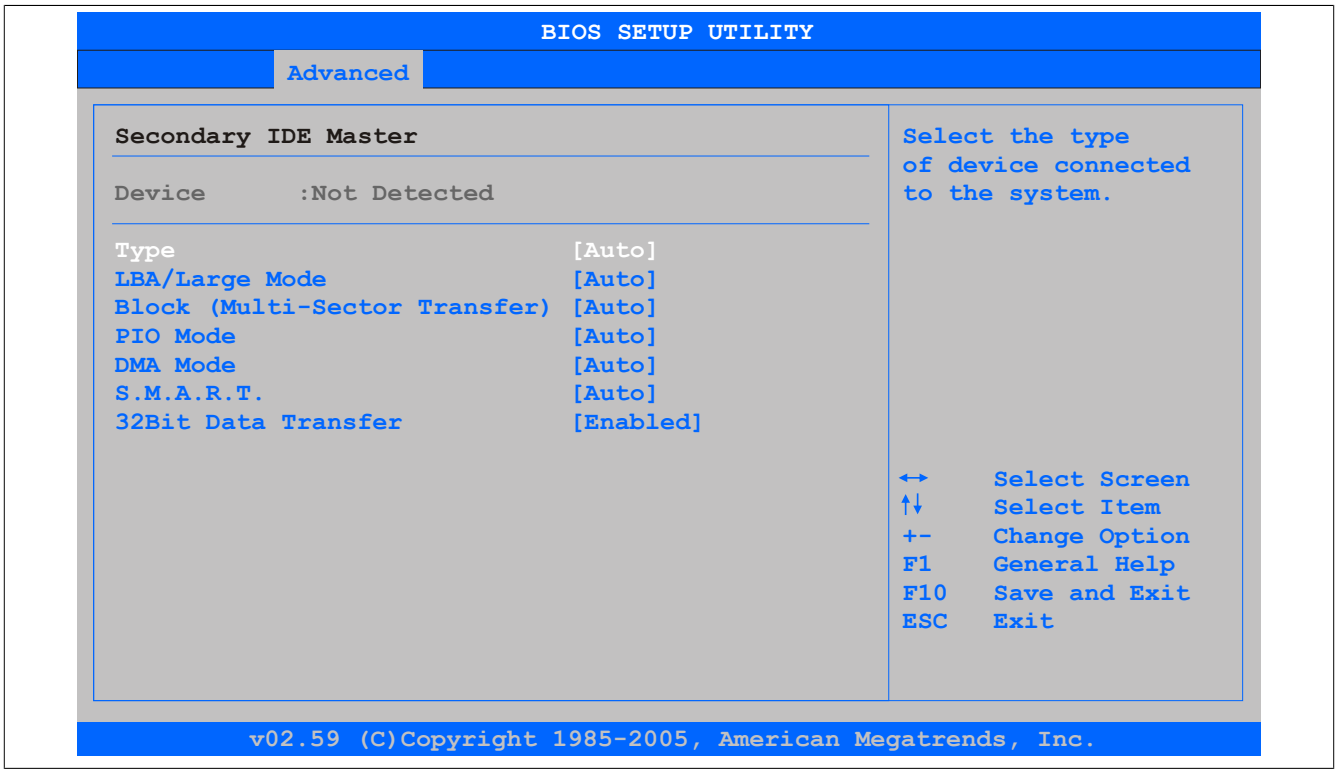


Abbildung 141: 945GME Secondary IDE Master

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Type	Hier wird der Typ des am Secondary Master angeschlossenen Laufwerks parametriert.	Not Installed	Kein Laufwerk installiert.
		Auto	Automatische Erkennung des Laufwerks und Einstellung der richtigen Werte.
		CD/DVD	CD-/DVD-Laufwerk.
		ARMD	ARMD-Laufwerk (Zip-Laufwerk).
LBA/Large Mode	Mit dieser Option wird der Logical-Block- Addressing/Large Modus für IDE aktiviert.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Auto	Automatische Aktivierung der Funktion wenn es vom System unterstützt wird.
Block (Multi-Sector Transfer)	Mit dieser Option wird der Block-Mode von IDE-Festplatten aktiviert. Bei Aktivierung dieser Option wird die Zahl der Blöcke pro Anforderung aus dem Konfigurationssektor der Festplatte ausgelesen.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Auto	Automatische Aktivierung der Funktion wenn es vom System unterstützt wird.
PIO Mode	Der PIO-Modus bestimmt die Datenrate der Festplatte. **Information:** **Diese Option ist beim APC810 nicht vorhanden. Somit ist diese Einstellung unrelevant.**	Auto	Automatische Einstellung des PIO Modus.
		0, 1, 2, 3, 4	Manuelle Einstellung des PIO Modus.
DMA Mode	Hier wird die Datenübertragungsrate zum und vom Secondary Master Laufwerk festgelegt. Der DMA-Mode muss unter Windows im Gerätemanager aktiviert werden, erst dann ist die volle Performance garantiert. Kann nur bei manueller Einstellung des Laufwerkes eingestellt werden.	Auto	Automatische Festlegung der Übertragungsrate.
		Disabled	Manuelle Festlegung der Übertragungsrate.
S.M.A.R.T.	Überwachungsfunktion moderner Festplatten (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology).	Auto	Automatische Erkennung und Aktivierung.
		Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
32 Bit Data Transfer	Diese Funktion ermöglicht den 32-Bit IDE Datentransfer.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.

Tabelle 208: 945GME Secondary IDE Master Einstellmöglichkeiten

1.4.9.4 Secondary IDE Slave

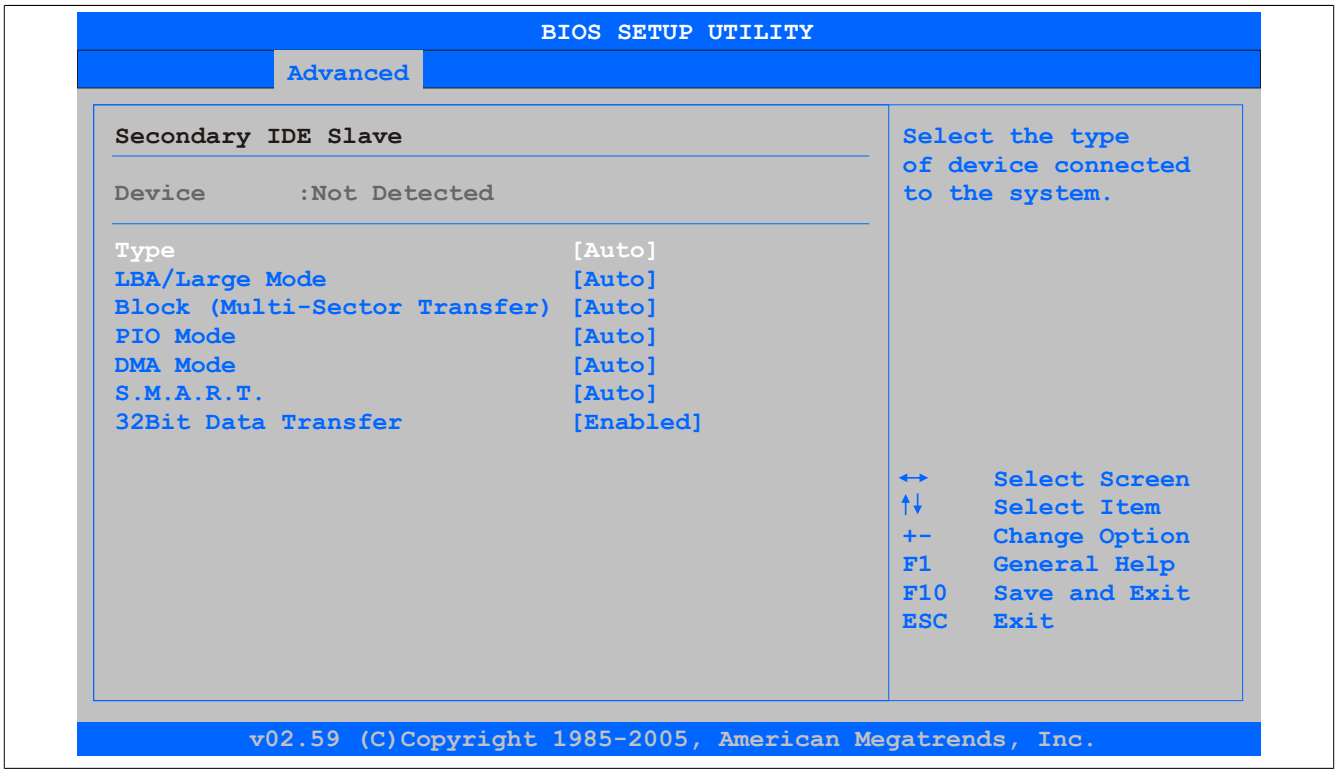


Abbildung 142: 945GME Secondary IDE Slave

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Type	Hier wird der Typ des am Secondary Slave angeschlossenen Laufwerks parametriert.	Not Installed	Kein Laufwerk installiert.
		Auto	Automatische Erkennung des Laufwerks und Einstellung der richtigen Werte.
		CD/DVD	CD-/DVD-Laufwerk.
		ARMD	ARMD-Laufwerk (Zip-Laufwerk).
LBA/Large Mode	Mit dieser Option wird das Logical-Block- Addressing/Large Modus für IDE aktiviert.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Auto	Automatische Aktivierung der Funktion wenn es vom System unterstützt wird.
Block (Multi-Sector Transfer)	Mit dieser Option wird der Block-Mode von IDE-Festplatten aktiviert. Bei Aktivierung dieser Option wird die Zahl der Blöcke pro Anforderung aus dem Konfigurationssektor der Festplatte ausgelesen.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Auto	Automatische Aktivierung der Funktion wenn es vom System unterstützt wird.
PIO Mode	Der PIO-Modus bestimmt die Datenrate der Festplatte. **Information:** **Diese Option ist beim APC810 nicht vorhanden. Somit ist diese Einstellung unrelevant.**	Auto	Automatische Einstellung des PIO Modus.
		0, 1, 2, 3, 4	Manuelle Einstellung des PIO Modus.
DMA Mode	Hier wird die Datenübertragungsrate zum und vom Secondary Slave Laufwerk festgelegt. Der DMA-Mode muss unter Windows im Gerätemanager aktiviert werden, erst dann ist die volle Performance garantiert. Kann nur bei manueller Einstellung des Laufwerkes eingestellt werden.	Auto	Automatische Festlegung der Übertragungsrate.
		Disabled	Manuelle Festlegung der Übertragungsrate.
S.M.A.R.T.	Überwachungsfunktion moderner Festplatten (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology).	Auto	Automatische Erkennung und Aktivierung.
		Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
32 Bit Data Transfer	Diese Funktion ermöglicht den 32-Bit IDE Datentransfer.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.

Tabelle 209: 945GME Secondary IDE Slave Einstellmöglichkeiten

1.4.10 USB Configuration

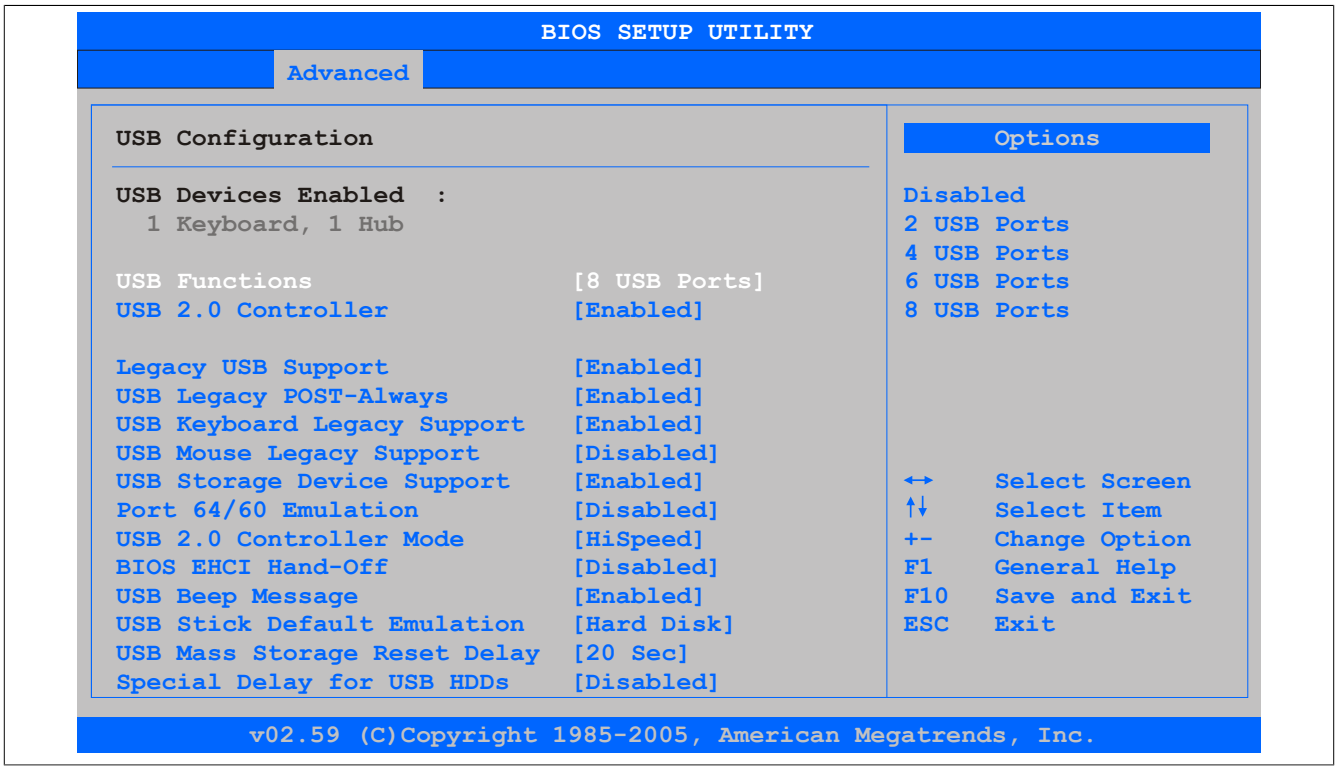


Abbildung 143: 945GME Advanced USB Configuration

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
USB Function	Hier können die USB-Ports aktiviert/deaktiviert werden. Die USB Nummern (z.B. USB1, USB3, usw.) sind am Gehäuse des APC810 aufgedruckt).	Disabled	Deaktivierung der USB-Ports.
		2 USB Ports	USB1, USB3 werden aktiviert.
		4 USB Ports	USB1, USB2, USB3, USB4 werden aktiviert.
		6 USB Ports	USB1, USB2, USB3, USB4, USB5 werden aktiviert.
		8 USB Ports	USB1, USB2, USB3, USB4, USB5, USB an einem AP über SDL werden aktiviert.
USB 2.0 Controller	Option zum Aktivieren bzw. Deaktivieren des USB 2.0 Modus.	Enabled	Alle USB Schnittstellen laufen im USB 2.0 Modus.
		Disabled	Alle USB Schnittstellen laufen im USB 1.1 Modus.
Legacy USB Support	Hier kann der Legacy USB Support aktiviert/deaktiviert werden. Es funktioniert keine USB Schnittstelle während des Startens. Nach dem Betriebssystemstart steht der USB Support wieder zur Verfügung. Eine USB Tastatur wird während des POST noch erkannt.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Auto	Automatische Aktivierung.
USB Legacy POST-Always	Option um den Legacy USB Support während des POST (Power On Self Test) gleichgültig der Legacy USB Support Einstellung zu aktivieren.	Enabled	Das BIOS Setup kann während des POST mittels einer USB Tastatur aufgerufen werden.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
USB Keyboard Legacy Support	Hier kann die USB-Keyboard Unterstützung aktiviert/deaktiviert werden.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
USB Mouse Legacy Support	Hier kann die USB-Mouse Unterstützung aktiviert/deaktiviert werden.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
USB Storage Device Support	Hier kann die USB-Massenspeichergerät Unterstützung aktiviert/deaktiviert werden.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
Port 64/60 Emulation	Hier kann die Port 64/60 Emulation aktiviert/deaktiviert werden.	Enabled	USB-Keyboard funktioniert unter Windows NT.
		Disabled	USB-Keyboard funktioniert unter allen Systemen außer Windows NT.
USB 2.0 Controller Mode	Hier können Einstellungen für den USBController vorgenommen werden.	FullSpeed	12 MBps
		HiSpeed	480 MBps
BIOS EHCI Hand-Off	Hier kann die Unterstützung für Betriebssysteme ohne vollautomatische EHCIFunktion eingerichtet werden.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
USB Beep Message	Option zur Ausgabe jeweils eines Pieptones, wenn ein USB Gerät während des POST vom BIOS erkannt wurde.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
USB Stick Default Emulation	Hier kann eingestellt werden, wie ein USB-Gerät verwendet wird.	Auto	USB-Geräte, deren Speicherkapazität kleiner als 530MB ist werden als Diskettenlaufwerk und die anderen Geräte mit größerer Kapazität als Festplatte simuliert.

Tabelle 210: 945GME Advanced USB Configuration Einstellmöglichkeiten

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
		Hard Disk	Ein als HDD formatiertes Laufwerk als FDD (z.B. ZIP-Laufwerk) kann zum Starten des Systems verwendet werden.
USB Mass Storage Reset Delay	Hier kann die Zeit, die der POST für USB-Speichergeräte nach dem Gerätestartbefehl warten soll, eingestellt werden. **Information:** **Die Meldung "No USB Mass Storage device detected" (Kein USB Massenspeichergerät entdeckt) wird angezeigt, wenn kein USB Massenspeichergerät installiert wurde.**	10 Sec, 20 Sec, 30 Sec, 40 Sec	Manuelle Einstellung des Wertes.
Special Delay for USB HDDs	Option zum Einstellen eines Boot Delay (Bootverzögerung) vor der USB 2.0 Geräteaufzählung, um das Booten von langsam hochlaufenden USB Devices (z.B. USB Hard Disks) zu ermöglichen. **Information:** **Diese Option sollte nur bei Bedarf verwendet werden, da der Bootvorgang dann immer um die eingestellte Zeit länger dauert.**	Disabled	Deaktivierung der Funktion. Es wird kein Boot Delay hinzugefügt.
		1 Sec, 2 Sec, 3 Sec, 4 Sec, 5 Sec, 7 Sec, 10 Sec	Es wird ein Boot Delay von 1, 2, 3, 4, 5, 7 bzw. 10 Sekunden hinzugefügt.

Tabelle 210: 945GME Advanced USB Configuration Einstellmöglichkeiten

1.4.11 Keyboard/Mouse Configuration

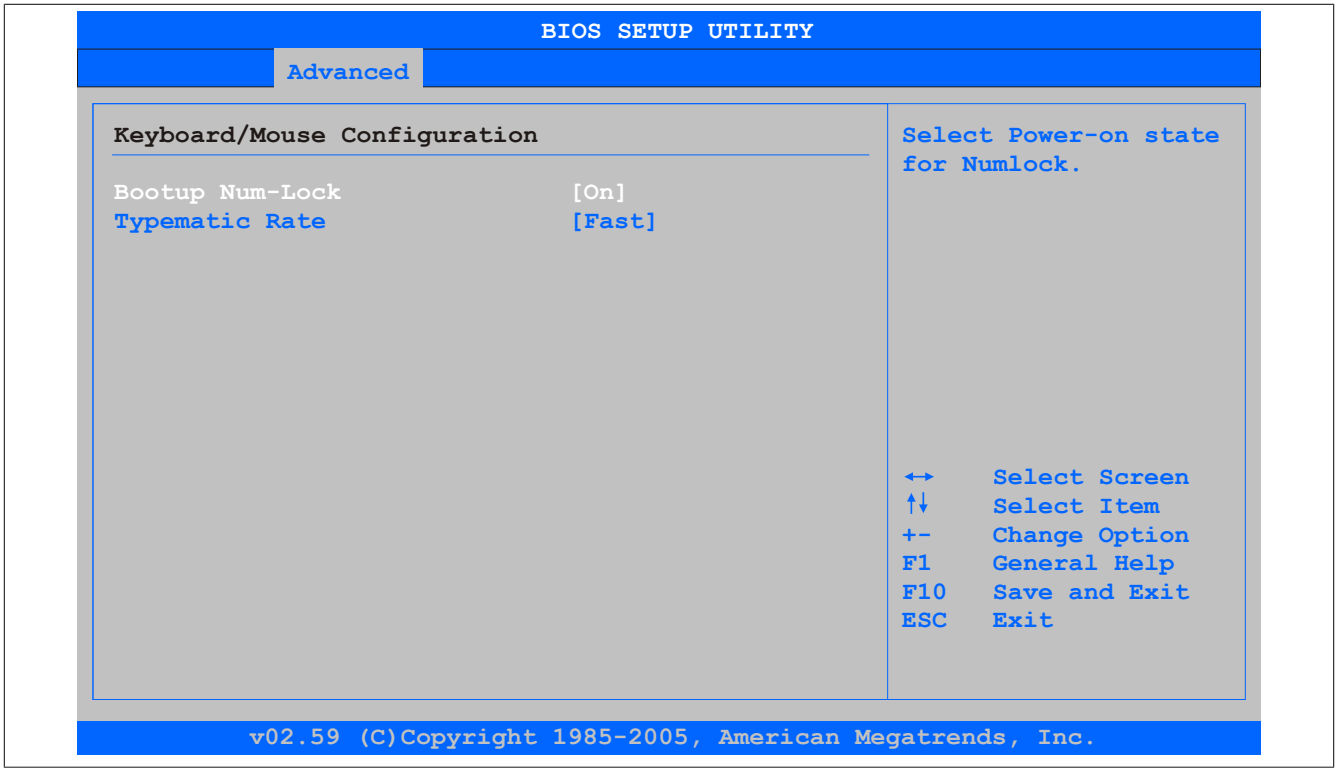


Abbildung 144: 945GME Advanced Keyboard/Mouse Configuration

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Bootup Num-Lock	Mit diesem Feld kann man den Zustand der Zehnertastatur (NumLock) beim Booten des Systems definieren.	Off	Vom numerischen Tastenblock sind lediglich die Cursorfunktionen aktiviert.
		On	Numerischer Tastenblock ist aktiviert.
Typematic Rate	Hier wird die Tastenwiederholfunktion eingestellt.	Slow	Langsame Tastenwiederholung.
		Fast	Schnelle Tastenwiederholung.

Tabelle 211: 945GME Advanced Keyboard/Mouse Configuration Einstellmöglichkeiten

1.4.12 Remote Access Configuration

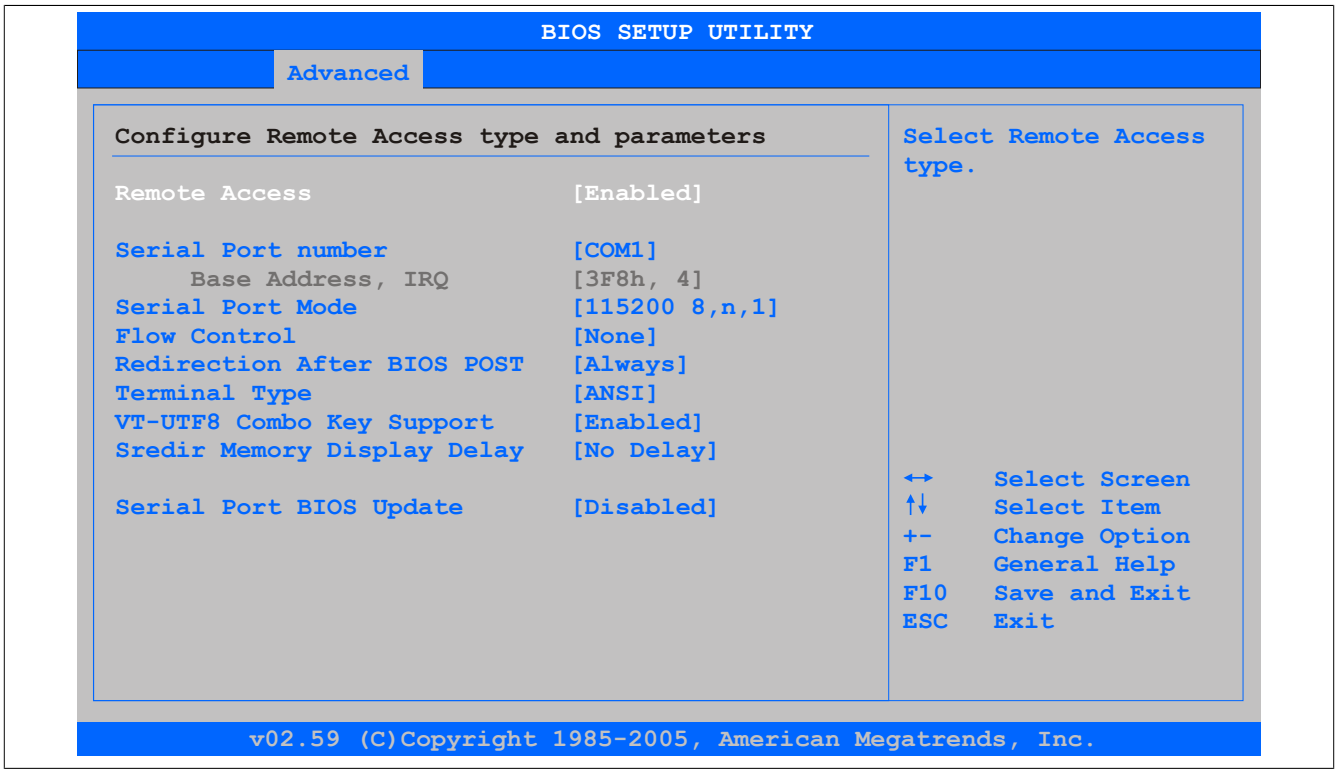


Abbildung 145: 945GME Advanced Remote Access Configuration

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Remote Access	Hier kann die Remote Access Funktion aktiviert/deaktiviert werden.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
Serial Port number	Unter dieser Option kann die serielle Schnittstelle eingestellet werden, vorausgesetzt im Feld *Remote Access* ist nicht Disabled eingetragen.	COM1	Aktivierung der Schnittstelle COM1 als Remote Access Schnittstelle.
		COM2	Aktivierung der Schnittstelle COM2 als Remote Access Schnittstelle.
Base Address, IRQ	Anzeige der logischen Adresse und des Interrupts für den seriellen Anschluss, vorausgesetzt im Feld *Remote Access* ist nicht Disabled eingetragen.	keine	-
Serial Port Mode	Hier kann die Übertragunsrate der seriellen Schnittstelle festgelegt werden, vorausgesetzt im Feld *Remote Access* ist nicht Disabled eingetragen.	115200 8,n,1 57600 8,n,1 38400 8,n,1 19200 8,n,1 09600 8,n,1	Manuelle Einstellung des Wertes.
Flow Control	Diese Einstellung bestimmt, wie die Übertragung über die Schnittstelle gesteuert wird. **Information:** **Die Einstellung muss sowohl am Terminal als auch am Server gleich sein.**	None	Die Schnittstelle wird ohne Übertragungssteuerung betrieben.
		Hardware	Die Übertragungssteuerung der Schnittstelle erfolgt durch Hardware. Dieser Modus muss durch das Kabel unterstützt werden.
		Software	Die Übertragungssteuerung der Schnittstelle erfolgt durch Software.
Redirection After BIOS POST	Hier kann die Umlenkung nach dem Systemstart eingestellt werden, vorausgesetzt im Feld *Remote Access* ist nicht Disabled eingetragen.	Disabled	Die Umlenkung wird nach dem Systemstart abgestellt.
		Boot Loader	Die Umlenkung ist während des Systemstarts und während der Aufladung aktiv.
		Always	Die Umlenkung ist immer aktiviert.
Terminal Type	Hier kann die Anschlussart ausgewählt werden, vorausgesetzt im Feld *Remote Access* ist nicht Disabled eingetragen.	ANSI, VT100, VT-UTF8	Manuelle Einstellung der Anschlussart.
VT-UTF8 Combo Key Support	Mit dieser Option kann die VT-UTF8 Combo Key Support für die Anschlüsse ANSI und VT100 aktiviert werden, vorausgesetzt im Feld *Remote Access* ist nicht Disabled eingetragen.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.

Tabelle 212: 945GME Advanced Remote Access Configuration Einstellmöglichkeiten

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Sredir Memory Display Delay	Mit dieser Option kann die Verzögerung der Speicherausgabe eingestellt werden, vorausgesetzt im Feld *Remote Access* ist nicht Disabled eingetragen (Sredir -> Serialredirection).	No Delay	Keine Verzögerung.
		Delay 1 Sec, Delay 2 Sec, Delay 4 Sec	Manuelle Einstellung des Wertes.
Serial Port BIOS Update	Während dem Systemstart wird das Update über die serielle Schnittstelle in den Prozessor geladen. **Information:** **Ist diese Option auf Disabled wird die Zeit zum booten verkürzt.**	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.

Tabelle 212: 945GME Advanced Remote Access Configuration Einstellmöglichkeiten

1.4.13 CPU Board Monitor

Information:

Die angezeigten Spannungswerte (z.B. Corespannung, Batteriespannung) auf dieser BIOS Setup Seite stellen ungeeichte Informationswerte dar. Daraus können keine Schlüsse über mögliche Alarme bzw. Fehlerzustände der Hardware gezogen werden. Die verwendeten Hardwarekomponenten verfügen über automatische Diagnosefunktionen im Fehlerfalle.

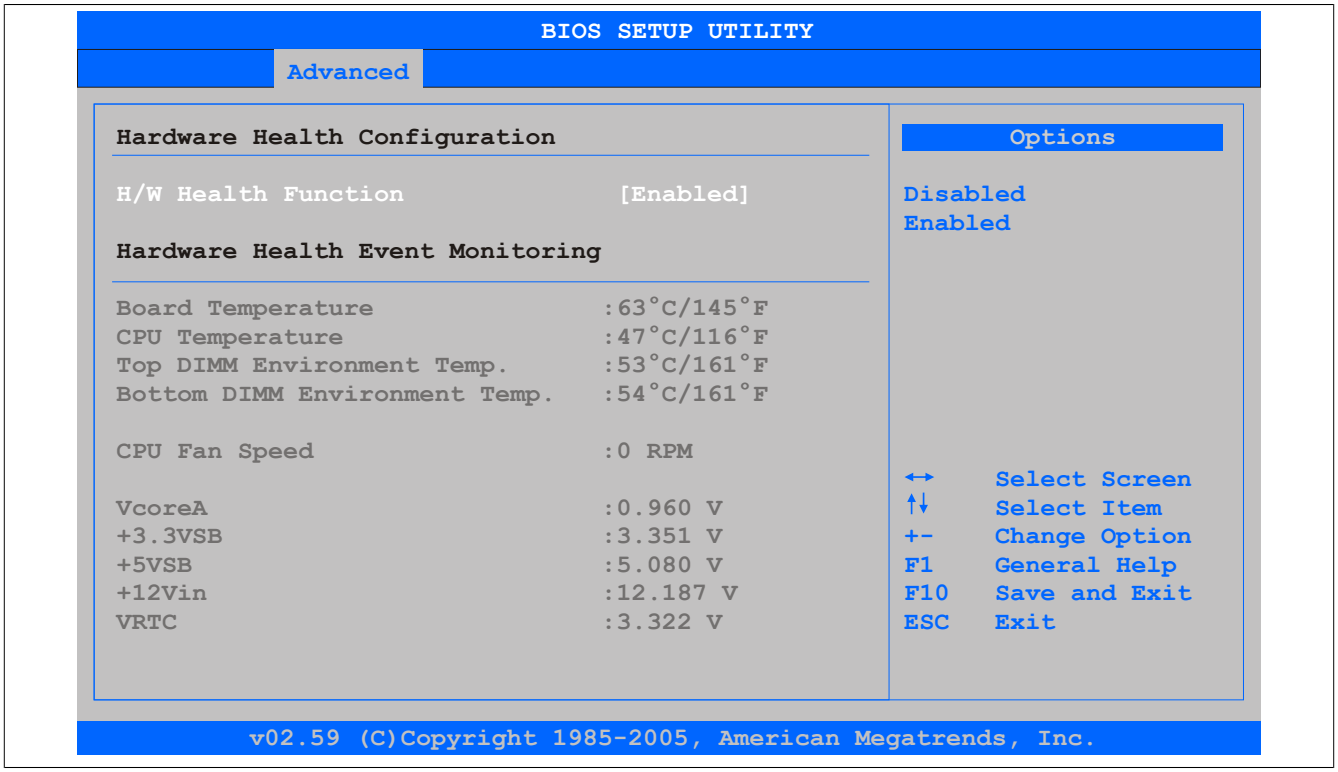


Abbildung 146: 945GME Advanced CPU Board Monitor

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
H/W Health Function	Option zum Anzeigen sämtlicher Werte auf dieser Seite.	Enabled	Anzeigen sämtlicher Werte.
		Disabled	Es werden keine Werte auf dieser Seite angezeigt.
Board Temperature	Anzeige der Boardtemperatur in Grad Celsius und Fahrenheit.	keine	-
CPU Temperature	Anzeige der Prozessortemperatur in Grad Celcius und Fahrenheit.	keine	-
Top DIMM Enviroment Temp.	Anzeige der Temperatur des 1. DRAM Moduls.	keine	-
Bottom DIMM Enviroment Temp.	Anzeige der Temperatur des 2. DRAM Moduls.	keine	-
CPU Fan Speed	Anzeige der Umdrehungsgeschwindigkeit eines Prozessorlüfters.	keine	-
VcoreA	Anzeige der Prozessorkernspannung A in Volt.	keine	-
+3.3VSB	Anzeige der aktuell anliegenden Spannung der 3,3 Volt Versorgung.	keine	-
+5VSB	Anzeige der aktuell anliegenden Spannung der 5 Volt Versorgung.	keine	-
+12Vin	Anzeige der aktuell anliegenden Spannung der 12 Volt Versorgung.	keine	-
VRTC	Anzeige der Batteriespannung in Volt.	keine	-

Tabelle 213: 945GME Advanced CPU Board Monitor Einstellmöglichkeiten

1.4.14 Baseboard/Panel Features

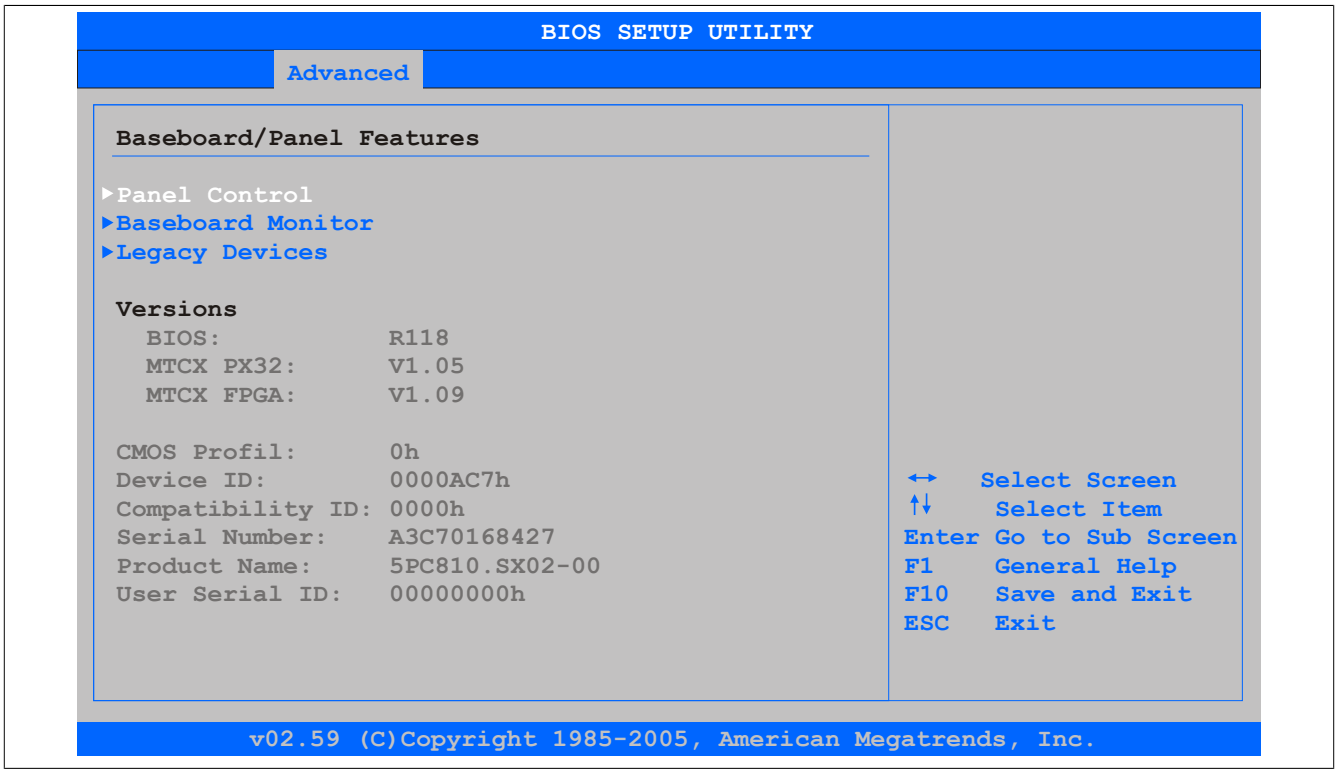


Abbildung 147: 945GME Advanced Baseboard/Panel Features

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Panel Control	Hier können spezielle Einstellungen für angeschlossene Panel (Displayeinheiten) vorgenommen werden.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Panel Control" auf Seite 269
Baseboard Monitor	Anzeige verschiedener Temperaturwerte und Lüfterdrehzahlen.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Baseboard Monitor" auf Seite 270
Legacy Devices	Hier können spezielle Einstellungen für die Schnittstellen vorgenommen werden.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Legacy Devices" auf Seite 271
BIOS	Anzeige der BIOS Version	keine	-
MTCX PX32	Anzeige der MTCX PX32 Firmwareversion.	keine	-
MTCX FPGA	Anzeige der MTCX FPGA Firmwareversion.	keine	-
CMOS Profil	Zeigt die CMOS Profil Nummer an.	keine	-
Device ID	Hexwertanzeige der Hardware-Geräte ID.	keine	-
Compatibility ID	Zeigt die Version des Gerätes innerhalb der gleichen B&R Geräteerkennung an. Diese ID wird für das Automation Runtime benötigt.	keine	-
Serial Number	Anzeige der B&R Serialnummer.	keine	-
Product Name	Anzeige der B&R Bestellnummer.	keine	-
User Serial ID	Anzeige der User Serial ID. Dieser 8-stellige Hexwert steht dem Anwender frei zur Verfügung (um z.B. bei dem Gerät eine eindeutige Identifizierung zu ermöglichen) und kann nur mit dem bei B&R erhältlichen „B&R Control Center“ über den ADI Treiber verändert werden.	keine	-

Tabelle 214: 945GME Advanced Baseboard/Panel Features Einstellmöglichkeiten

1.4.14.1 Panel Control

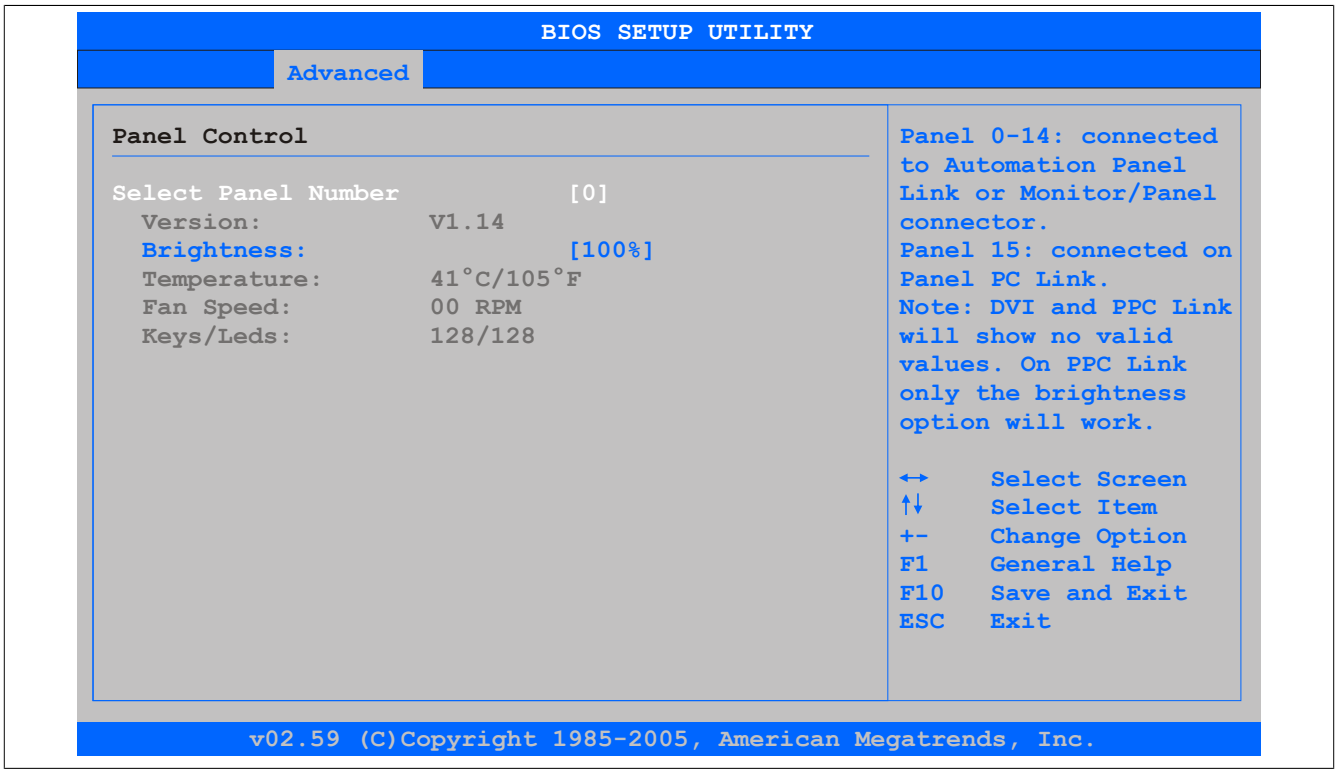


Abbildung 148: 945GME Panel Control

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Select Panel Number	Auswahl der Panelnummer, bei dem Werte ausgelesen bzw. geändert werden sollen.	0...15	Panelauswahl 0 ... 15. Panel 15 ist speziell für Panel PC 800 Systeme vorgesehen.
Version	Anzeige der Firmwareversion des SDLR Controllers.	keine	-
Brightness	Einstellung der Helligkeit beim ausgewählten Panel.	0%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%	Einstellung der Helligkeit in % beim ausgewählten Panel. Wird erst beim Speichern und Neustart des Systems wirksam (z.B. durch Drücken von <F10>).
Temperature	Temperaturanzeige des ausgewählten Panels in Grad Celsius und Fahrenheit.	keine	-
Fan Speed	Lüfterumdrehungsanzeige des ausgewählten Panels.	keine	-
Keys/Leds	Anzeige der vorhandenen Tasten und LEDs des ausgewählten Panels.	keine	-

Tabelle 215: 945GME Panel Control Einstellmöglichkeiten

1.4.14.2 Baseboard Monitor

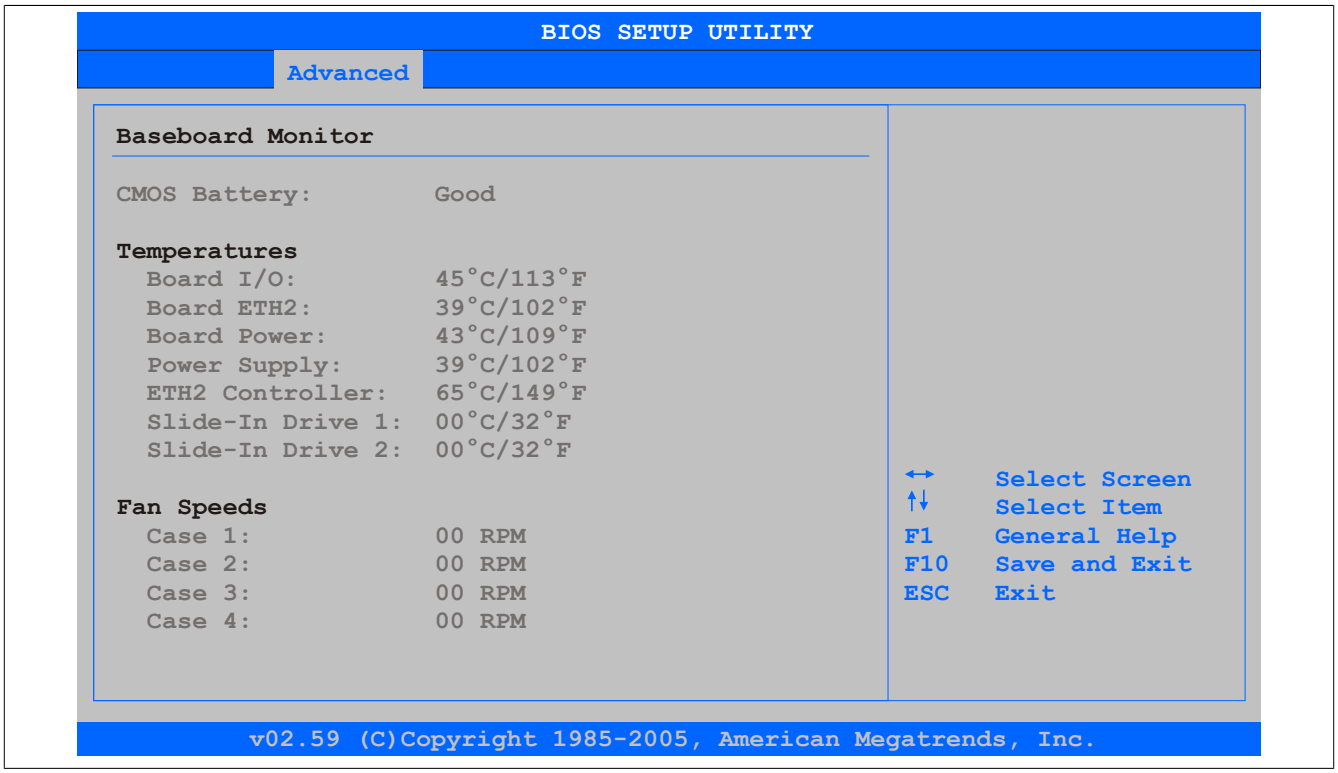


Abbildung 149: 945GME Baseboard Monitor

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
CMOS Battery	Zeigt den Status der Batterie an. **n.a.** - not available **Good** - Batterie ist in Ordnung. **Bad** - Batterie ist kaputt.	keine	-
Board I/O	Anzeige der Temperatur im I/O Bereich in Grad Celsius und Fahrenheit.	keine	-
Board ETH2	Anzeige der Temperatur im ETH2 Controller Chipbereich in Grad Celsius und Fahrenheit.	keine	-
Board Power	Anzeige der Netzteiltemperatur in Grad Celsius und Fahrenheit.	keine	-
Power Supply	Anzeige der Temperatur im Netzteil in Grad Celsius und Fahrenheit.	keine	-
ETH2 Controller	Anzeige der Temperatur des ETH2 Controllers in Grad Celsius und Fahrenheit.	keine	-
Slide-In Drive 1	Anzeige der Temperatur des Slide-in Laufwerks 1 in Grad Celsius und Fahrenheit.	keine	-
Slide-In Drive 2	Anzeige der Temperatur des Slide-in Laufwerks 2 in Grad Celsius und Fahrenheit.	keine	-
Case 1	Anzeige der Lüfterumdrehungsgeschwindigkeit des Gehäuselüfters 1.	keine	-
Case 2	Anzeige der Lüfterumdrehungsgeschwindigkeit des Gehäuselüfters 2.	keine	-
Case 3	Anzeige der Lüfterumdrehungsgeschwindigkeit des Gehäuselüfters 3.	keine	-
Case 4	Anzeige der Lüfterumdrehungsgeschwindigkeit des Gehäuselüfters 4.	keine	-

Tabelle 216: 945GME Baseboard Monitor Einstellmöglichkeiten

1.4.14.3 Legacy Devices

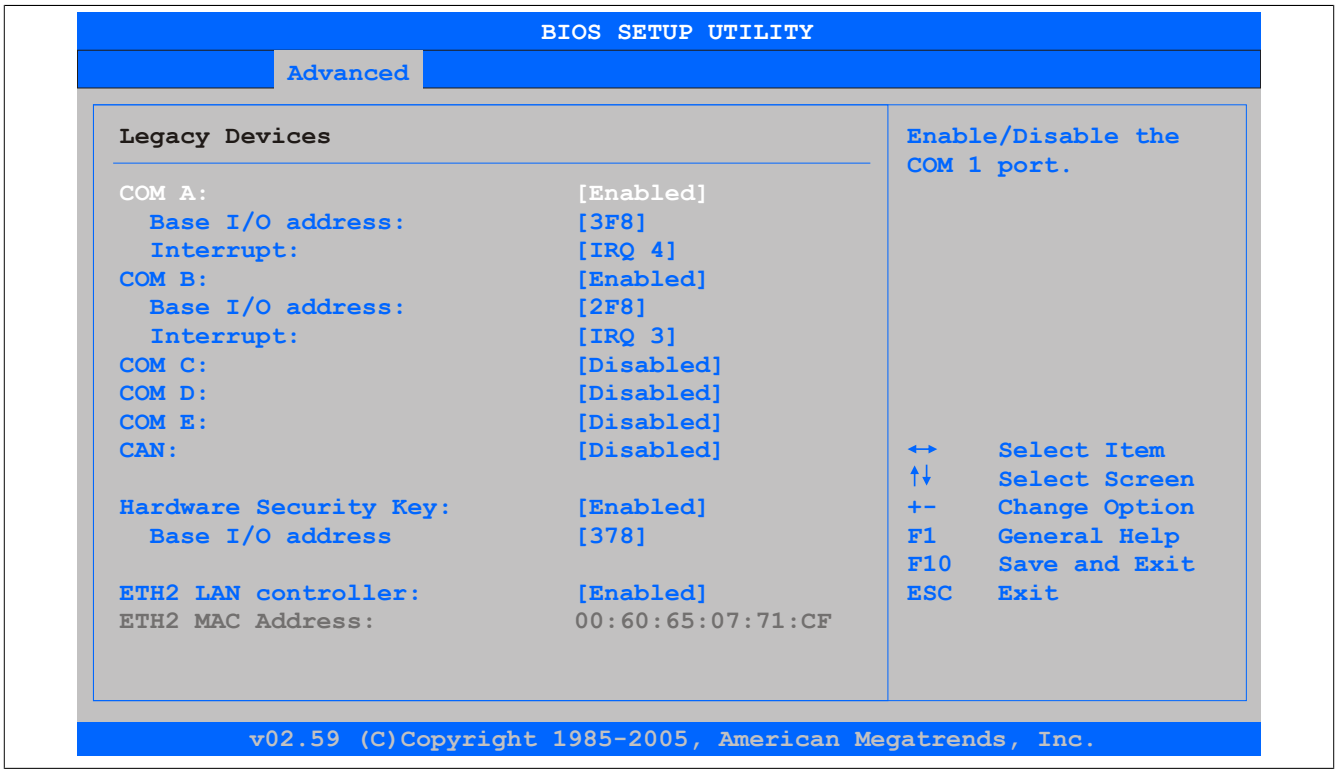


Abbildung 150: 945GME Legacy Devices

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
COM A	Einstellung für die serielle Schnittstelle **COM1** im System.	Enabled	Aktivierung der Schnittstelle.
		Disabled	Deaktivierung der Schnittstelle.
Base I/O address	Auswahl der Base I/O Adresse des COM Ports.	238, 2E8, 2F8, 328, 338, 3E8, 3F8	Zuweisung der ausgewählten Base I/O Adresse.
Interrupt	Auswahl des Interrupts für den COM Port.	IRQ 3, IRQ 4, IRQ 5, IRQ 6, IRQ 7, IRQ 10, IRQ 11, IRQ 12	Zuweisung des ausgewählten Interrupts.
COM B	Einstellung für die serielle Schnittstelle **COM2** im System.	Disabled	Deaktivierung der Schnittstelle.
		Enabled	Aktivierung der Schnittstelle.
Base I/O address	Auswahl der Base I/O Adresse des COM Ports.	238, 2E8, 2F8, 328, 338, 3E8, 3F8	Zuweisung der ausgewählten Base I/O Adresse.
Interrupt	Auswahl des Interrupts für den COM Port.	IRQ 3, IRQ 4, IRQ 5, IRQ 6, IRQ 7, IRQ 10, IRQ 11, IRQ 12	Zuweisung des ausgewählten Interrupts.
COM C	Einstellung des COM Ports für den **Touch Screen am Monitor/Panel** Stecker.	Enabled	Aktivierung der Schnittstelle.
		Disabled	Deaktivierung der Schnittstelle.
Base I/O address	Auswahl der Base I/O Adresse des COM Ports.	238, 2E8, 2F8, 328, 338, 3E8, 3F8	Zuweisung der ausgewählten Base I/O Adresse.
Interrupt	Auswahl des Interrupts für den COM Port.	IRQ 3, IRQ 4, IRQ 5, IRQ 6, IRQ 7, IRQ 10, IRQ 11, IRQ 12	Zuweisung des ausgewählten Interrupts.
COM D	Einstellung des COM Ports für den **Touch Screen am AP Link Stecker**.	Enabled	Aktivierung der Schnittstelle.
		Disabled	Deaktivierung der Schnittstelle.
Base I/O address	Auswahl der Base I/O Adresse des COM Ports.	238, 2E8, 2F8, 328, 338, 3E8, 3F8	Zuweisung der ausgewählten Base I/O Adresse.
Interrupt	Auswahl des Interrupts für den COM Port.	IRQ 3, IRQ 4, IRQ 5, IRQ 6, IRQ 7, IRQ 10, IRQ 11, IRQ 12	Zuweisung des ausgewählten Interrupts.
COM E	Einstellung des COM Ports der **B&R Add-on Schnittstellenoption** 5AC600.485I-00 (IF-Option).	Enabled	Aktivierung der Schnittstelle.
		Disabled	Deaktivierung der Schnittstelle.
Base I/O address	Auswahl der Base I/O Adresse des COM Ports.	238, 2E8, 2F8, 328, 338, 3E8, 3F8	Zuweisung der ausgewählten Base I/O Adresse.
Interrupt	Auswahl des Interrupts für den COM Port.	IRQ 3, IRQ 4, IRQ 5, IRQ 6, IRQ 7, IRQ 10, IRQ 11, IRQ 12	Zuweisung des ausgewählten Interrupts.
CAN	Einstellung des CAN Ports der **B&R Add-on CAN Schnittstellenoption** 5AC600.CANI-00 (IF-Option).	Disabled	Deaktivierung der Schnittstelle.
		Enabled	Aktivierung der Schnittstelle.
Base I/O address	Anzeige der Base I/O Adresse des CAN Ports.	keine	-
Interrupt	Auswahl des Interrupts für den CAN Port.	IRQ 10, NMI	Zuweisung des ausgewählten Interrupts.
Hardware Security Key	Hier werden Einstellungen für den Hardware Security Key (Dongle) vorgenommen.	Disabled	Deaktivierung der Schnittstelle.
		Enabled	Aktivierung der Schnittstelle.

Tabelle 217: 945GME Legacy Devices Einstellmöglichkeiten

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Base I/O adress	Auswahl der Base I/O Adresse der Hardware Security Schnittstelle.	278, 378, 3BC	Zuweisung für die Base I/O Adresse für den parallelen Port.
ETH2 LAN controller	Hier kann der Onboard LAN Controller (ETH2) ein- bzw. ausgeschaltet werden.	Enabled	Aktivierung des Controllers.
		Disabled	Deaktivierung des Controllers.
ETH2 MAC Address	Zeigt die MAC-Adresse des Ethernet 2 Controllers.	keine	-

Tabelle 217: 945GME Legacy Devices Einstellmöglichkeiten

1.5 Boot

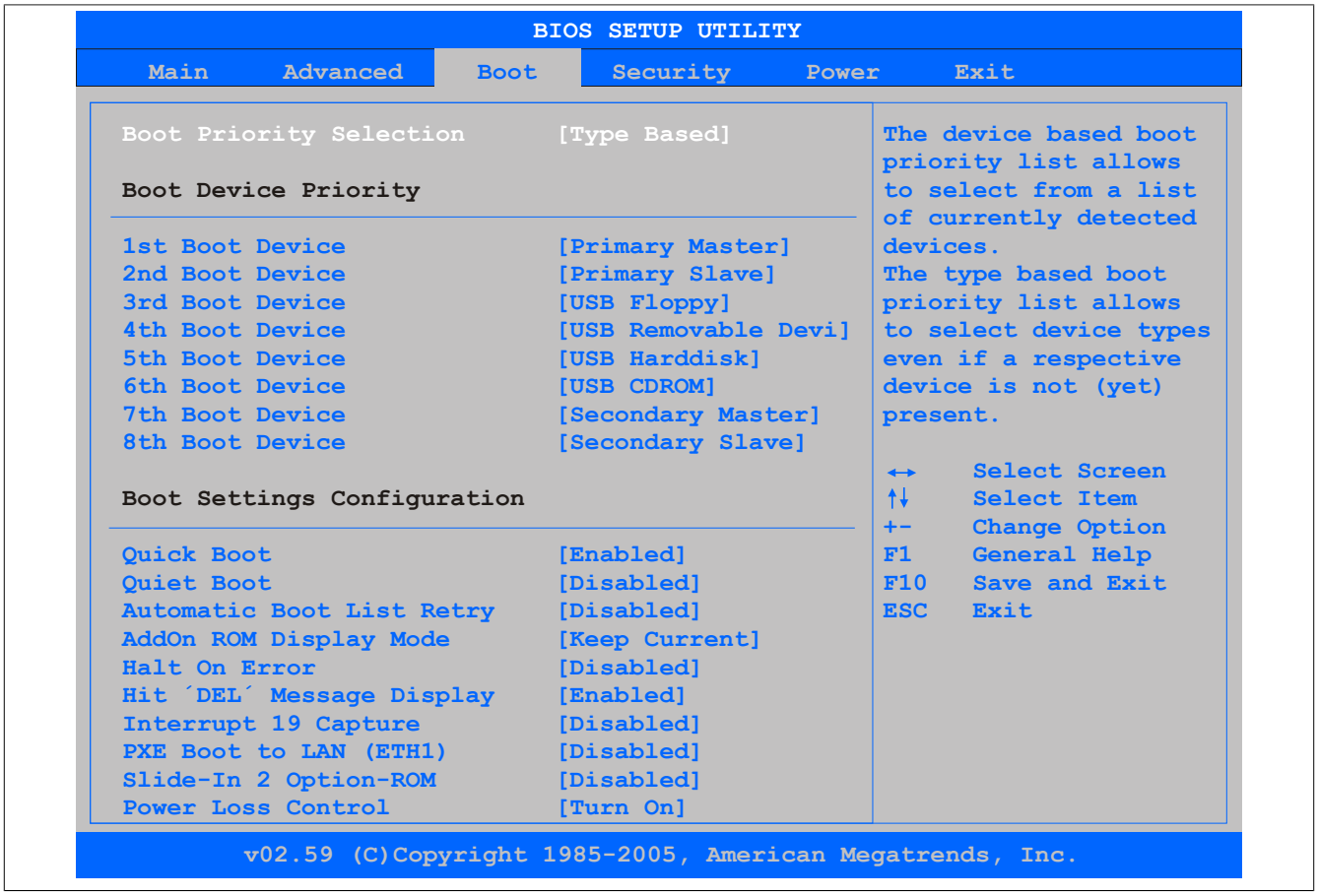


Abbildung 151: 945GME Boot Menü

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Boot Priority Selection	Hier kann eingestellt werden, nach welcher Methode die Laufwerke gebootet werden sollen.	Device Based	Es werden nur die vom System erkannten Geräte aufgelistet. Bei dieser Liste kann danach die Reihenfolge geändert werden. **Information:** **Es ist entweder die Device Based oder die Type Based Methode zu verwenden. Ein Mischbetrieb ist nicht zulässig.**
		Type Based	Man kann die Bootreihenfolge einer Gerätetypenliste ändern. Es ist auch möglich nicht angeschlossene Gerätetypen in dieser Liste anzugeben. **Information:** **Es ist entweder die Device Based oder die Type Based Methode zu verwenden. Ein Mischbetrieb ist nicht zulässig.**
1st Boot Device 2nd Boot Device 3rd Boot Device 4th Boot Device 5th Boot Device 6th Boot Device 7th Boot Device 8th Boot Device	Unter dieser Option können die Boot- Laufwerke eingestellt werden.	Disabled, Primary Master, Primary Slave, Secondary Master, Secondary Slave, Legacy Floppy, USB Floppy, USB Harddisk, USB CDROM, USB Removeable Device, Onboard LAN, External LAN, PCI Mass Storage, PCI SCSI Card, Any PCI BEV Device, Third Master, Third Slave, PCI RAID, Local BEV ROM	Auswahl der gewünschten Reihenfolge.
Quick Boot	Diese Funktion verringert die Zeit zum Booten durch überspringen von einigen POST Vorgängen.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
Quiet Boot	Bestimmt, ob POST Nachricht oder das OEM Logo (Default=schwarzer Hintergrund) angezeigt wird.	Enabled	Anzeige des OEM Logos anstatt der POST Nachricht.
		Disabled	Anzeige der POST Nachricht.
Automatic Boot List Retry	Mit dieser Option wird versucht, das Betriebssystem bei einem Fehlstart automatisch neu zu starten.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
AddOn ROM Display Mode	Setzt das Anzeigemodus für das ROM (während dem Bootvorgang).	Force BIOS	Ein weiterer BIOS Teil kann angezeigt werden.
		Keep Current	BIOS Informationen werden angezeigt.
Halt On Error	Die Option legt fest, ob nach einem Fehler der Systemstart während des Power On Self Test (POST) fortgesetzt werden soll.	Enabled	System hält an. Bei jedem Fehler wird das System angehalten.
		Disabled	System hält nicht an. Alle Fehler werden ignoriert.
Hit 'DEL' Message Display	Hier können Einstellungen für die Anzeige der „Hit 'DEL' Message“ vorgenommen werden. **Information:** **Wenn Quiet Boot aktiviert ist wird die Nachricht nicht angezeigt.**	Enabled	Die Nachricht wird angezeigt.
		Disabled	Die Nachricht wird nicht angezeigt.
Interrupt 19 Capture	Mit dieser Funktion kann die BIOS Unterbrechung eingeschlossen werden.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
PXE Boot to LAN (ETH1)	Aktivierung/Deaktivierung der Funktion vom LAN (ETH1) zu booten.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
Slide-In 2 Option-ROM	Aktivierung/Deaktivierung der Funktion von einem Option ROM für ein Slide-In 2 Laufwerk.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
Power Loss Control	Stellt fest ob das System nach einem Leistungsabfall an/aus ist.	Remain Off	Bleibt ausgeschaltet.
		Turn On	Schaltet ein.
		Last State	Aktiviert den vorherigen Zustand.

Tabelle 218: 945GME Boot Menü Einstellmöglichkeiten

1.6 Security

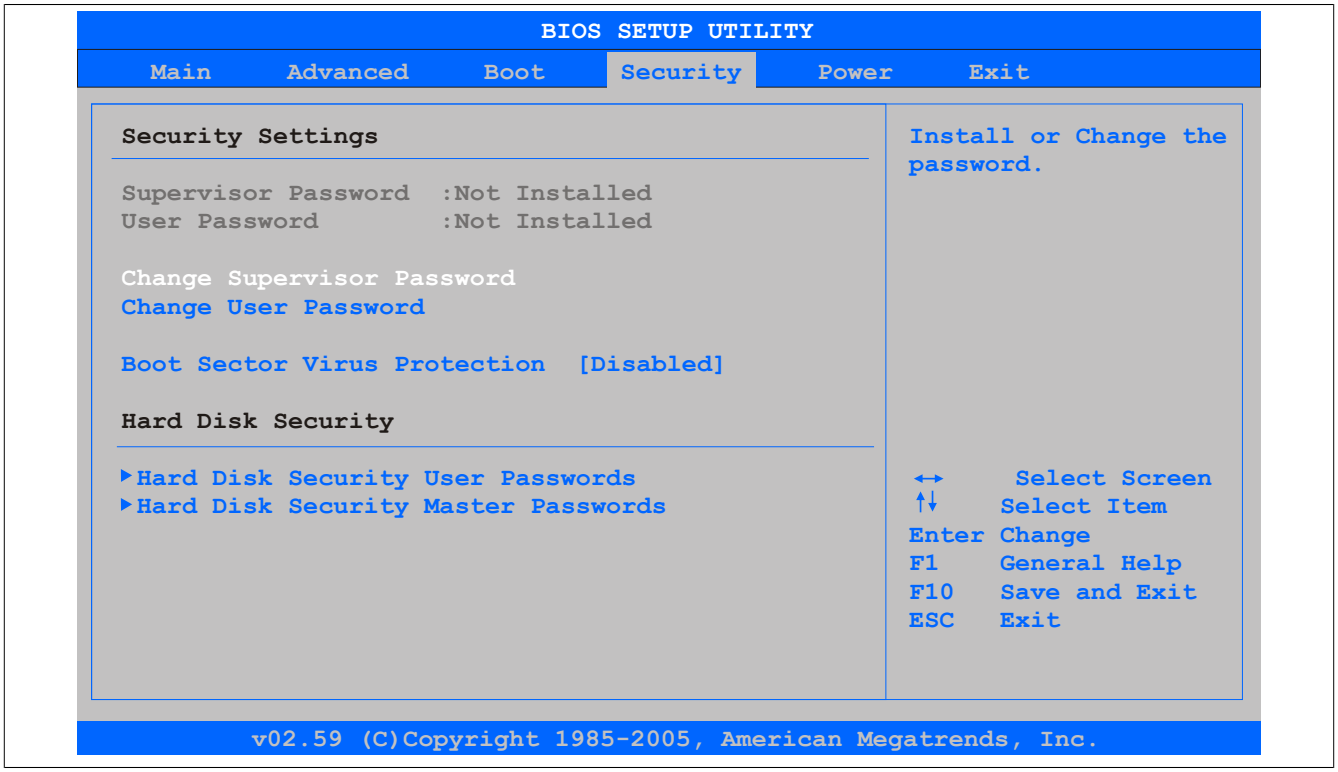


Abbildung 152: 945GME Security Menü

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Supervisor Password	Anzeige ob ein Supervisor Passwort vorhanden ist oder nicht.	keine	-
User Password	Anzeige ob ein User Passwort vorhanden ist oder nicht.	keine	-
Change Supervisor Password	Funktion zum Eingeben/Ändern eines Supervisor Passwortes. Nur mit dem Supervisor Passwort können alle BIOS Einstellungen editiert werden.	Enter	Passwort eingeben.
Change User Password	Funktion zum Eingeben eines User Passwortes. Mit dem User Passwort können nur bestimmte BIOS Einstellungen editiert werden.	Enter	Passwort eingeben.
Boot Sector Virus Protection	Mit dieser Option wird beim Zugriff durch ein Programm oder Virus auf den Bootsektor eine Warnung ausgegeben. **Information:** **Mit dieser Option wird nur der Bootsektor geschützt, nicht aber die gesamte Festplatte.**	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
Hard Disk Security User Passwords	Hier kann das Hard Disk Security User Passwort erstellt werden.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Hard Disk Security User Password" auf Seite 275
Hard Disk Security Master Passwords	Hier kann das Hard Disk Security Master Passwort erstellt werden.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Hard Disk Security Master Password" auf Seite 275

Tabelle 219: 945GME Security Menü Einstellmöglichkeiten

1.6.1 Hard Disk Security User Password

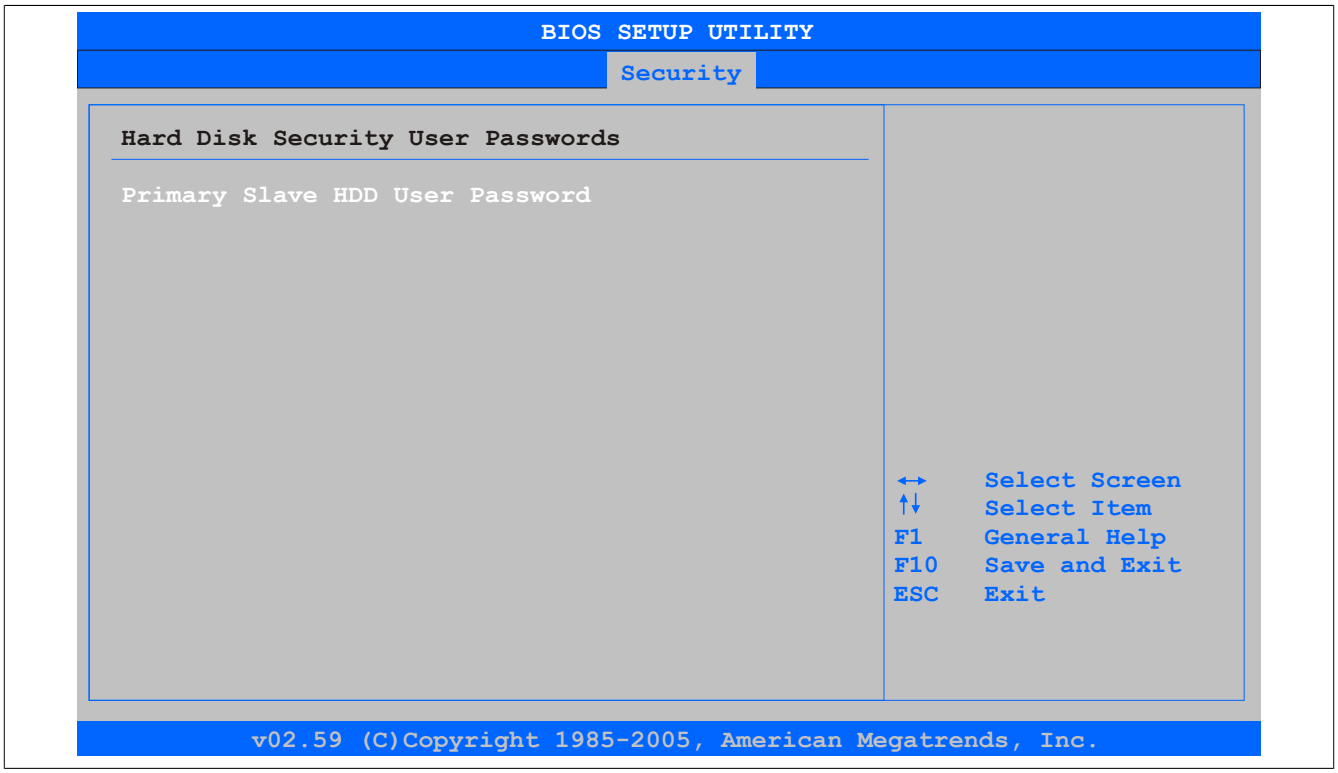


Abbildung 153: 945GME Hard Disk Security User Password

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Primary Slave HDD User Password	Mit dieser Funktion ist es möglich das User Passwort jeder Festplatte einzustellen oder zu ändern ohne das Gerät neu zu booten. Mit dem User Passwort können nur bestimmte BIOS Einstellungen editiert werden.	Enter	Passwort eingeben.

Tabelle 220: 945GME Hard Disk Security User Password

1.6.2 Hard Disk Security Master Password

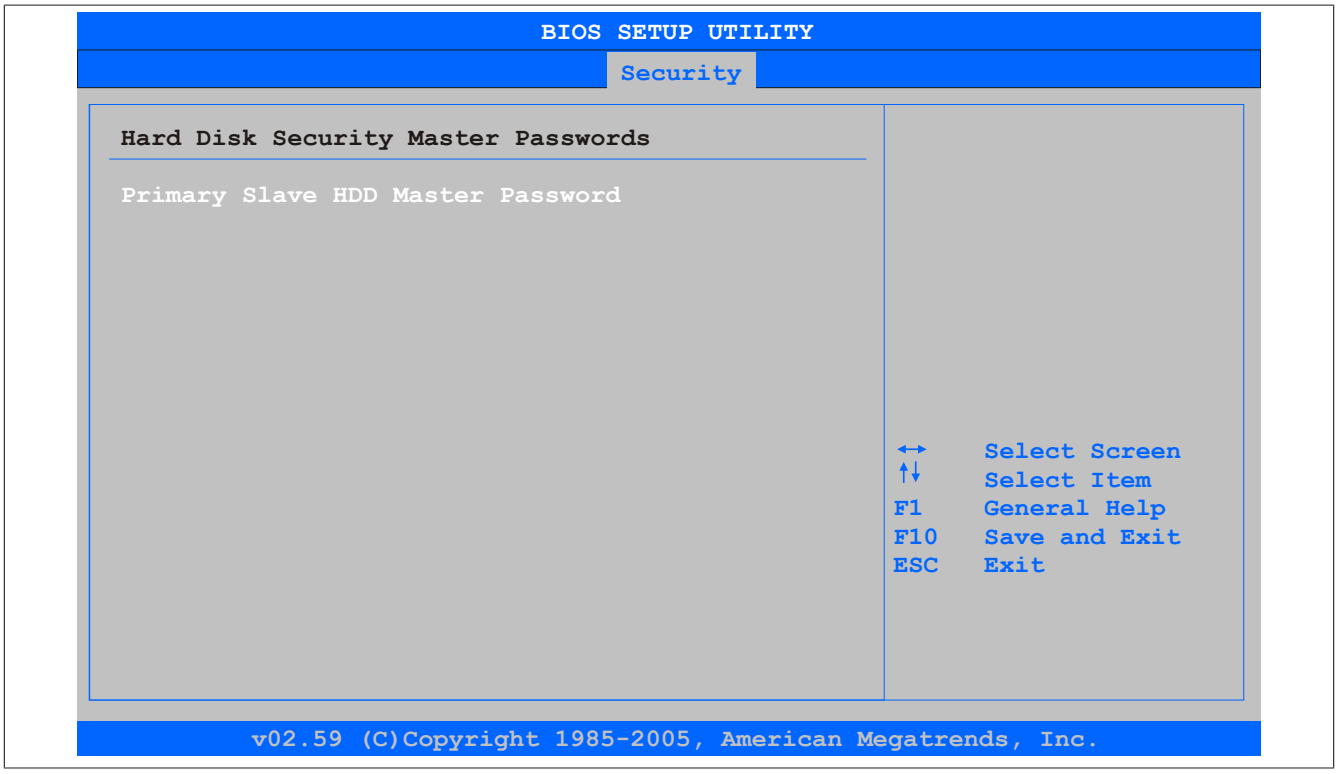


Abbildung 154: 945GME Hard Disk Security Master Password

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Primary Slave HDD Master Password	Mit dieser Funktion ist es möglich das Master Passwort jeder Festplatte einzustellen oder zu ändern ohne das Gerät neu zu booten.	Enter	Passwort eingeben.

Tabelle 221: 945GME Hard Disk Securitiy Master Password

1.7 Power

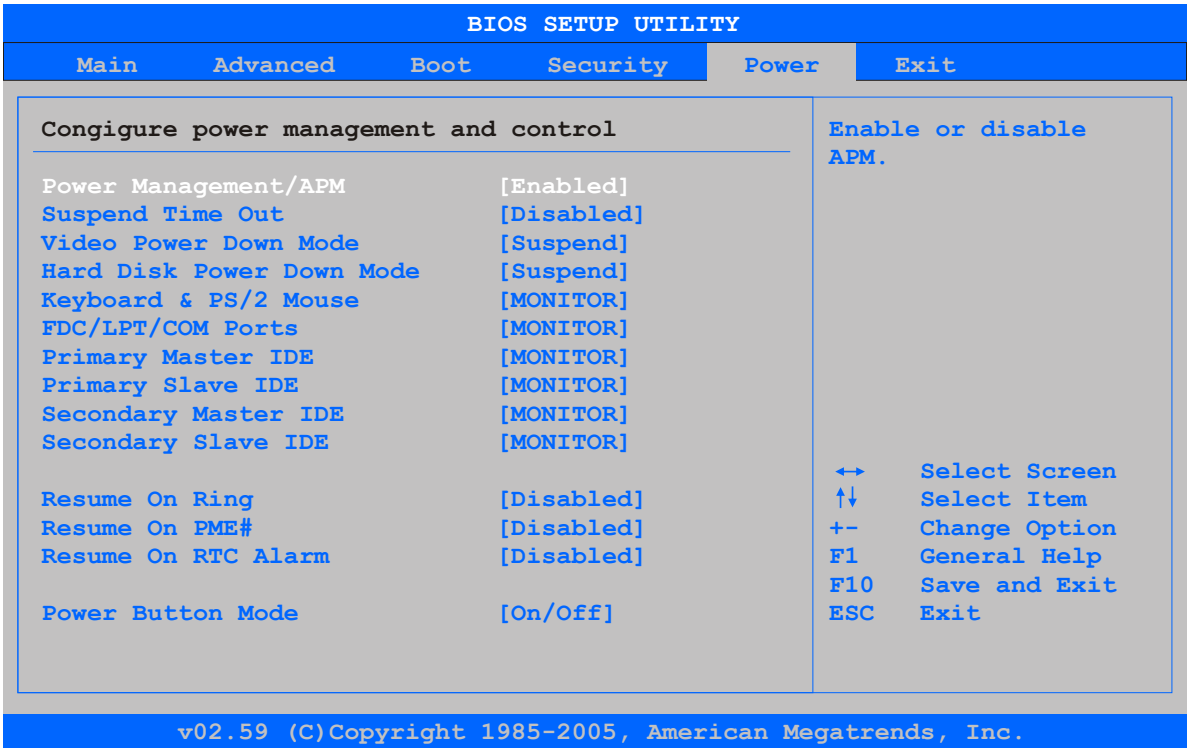


Abbildung 155: 945GME Power Menü

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Power Management/APM	Diese Option schaltet die APM-Funktionalität ein oder aus. Es handelt sich hierbei um eine erweiterte Plug & Play- und Power Management-Funktionalität.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
Suspend Time Out	Unter dieser Option stellen Sie ein, nach welcher Zeitspanne der Inaktivität des Systems, dieses in den Suspend Modus (es werden alle Komponenten, außer der CPU, soweit wie möglich abgeschaltet) gefahren wird.	1 Min, 2 Min, 4 Min, 8 Min, 10 Min, 20 Min, 30 Min, 40 Min, 50 Min, 60 Min;	Manuelle Einstellung des Wertes.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
Video Power Down Mode	Unter dieser Option wird der Energiesparmodus für den Bildschirm festgelegt.	Disabled	Kein Ausschalten des Bildschirms.
		Standby	Bildschirm geht in Standby Modus.
		Suspend	Bildschirm geht in Suspend Modus.
Hard Disk Power Down Mode	Unter dieser Option wird der Energiesparmodus für die Festplatte festgelegt.	Disabled	Kein Ausschalten des Bildschirms.
		Standby	Bildschirm geht in Standby Modus.
		Suspend	Bildschirm geht in Suspend Modus.
Keyboard & PS/2 Mouse	Hier kann die Überwachung von Aktivitäten während des Stromsparmodus festgelegt werden.	MONITOR	Bei Aktivitäten am Keyboard oder der PS/2 Mouse kehrt das System aus dem jeweiligen Stromsparmodus in den Normalzustand zurück.
		IGNORE	Aktivitäten werden ignoriert.
FDC/LPT/COM Ports	Hier kann die Überwachung von Aktivitäten während des Stromsparmodus festgelegt werden.	MONITOR	Bei Aktivitäten am Parallel Port, dem Serial 1&2 Port oder dem Floppy Port kehrt das System aus dem jeweiligen Stromsparmodus in den Normalzustand zurück.
		IGNORE	Aktivitäten werden ignoriert.
Primary Master IDE	Hier kann die Überwachung von Aktivitäten während des Stromsparmodus festgelegt werden.	MONITOR	Bei Aktivitäten am IRQ des jeweiligen Anschlusses bzw. Gerätes kehrt das System aus dem jeweiligen Stromsparmodus in den Normalzustand zurück.
		IGNORE	Aktivitäten werden ignoriert.
Primary Slave IDE	Hier kann die Überwachung von Aktivitäten während des Stromsparmodus festgelegt werden.	MONITOR	Bei Aktivitäten am IRQ des jeweiligen Anschlusses bzw. Gerätes kehrt das System aus dem jeweiligen Stromsparmodus in den Normalzustand zurück.
		IGNORE	Aktivitäten werden ignoriert.

Tabelle 222: 945GME Power Menü Einstellmöglichkeiten

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Secondary Master IDE	Hier kann die Überwachung von Aktivitäten während des Stromsparmodus festgelegt werden.	MONITOR	Bei Aktivitäten am IRQ des jeweiligen Anschlusses bzw. Gerätes kehrt das System aus dem jeweiligen Stromsparmodus in den Normalzustand zurück.
		IGNORE	Aktivitäten werden ignoriert.
Secondary Slave IDE	Hier kann die Überwachung von Aktivitäten während des Stromsparmodus festgelegt werden.	MONITOR	Bei Aktivitäten am IRQ des jeweiligen Anschlusses bzw. Gerätes kehrt das System aus dem jeweiligen Stromsparmodus in den Normalzustand zurück.
		IGNORE	Aktivitäten werden ignoriert.
Resume On Ring	Bei einem eingehenden Anruf am Modem wird der PC aus dem Stromsparmodus geholt.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
Resume On PME#	Unter dieser Option können Sie die PME Weckfunktion ein- bzw. ausschalten.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
Resume On RTC Alarm	Unter dieser Option können Sie den Alarm aktivieren und Datum und Uhrzeit für den Systemstart eingeben.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
Power Button Mode	Diese Funktion legt fest, welche Funktion der Power Taster haben soll.	On/Off	Power Taster schaltet Ein/Aus.
		Suspend	Unterdrückt die Funktion.

Tabelle 222: 945GME Power Menü Einstellmöglichkeiten

1.8 Exit

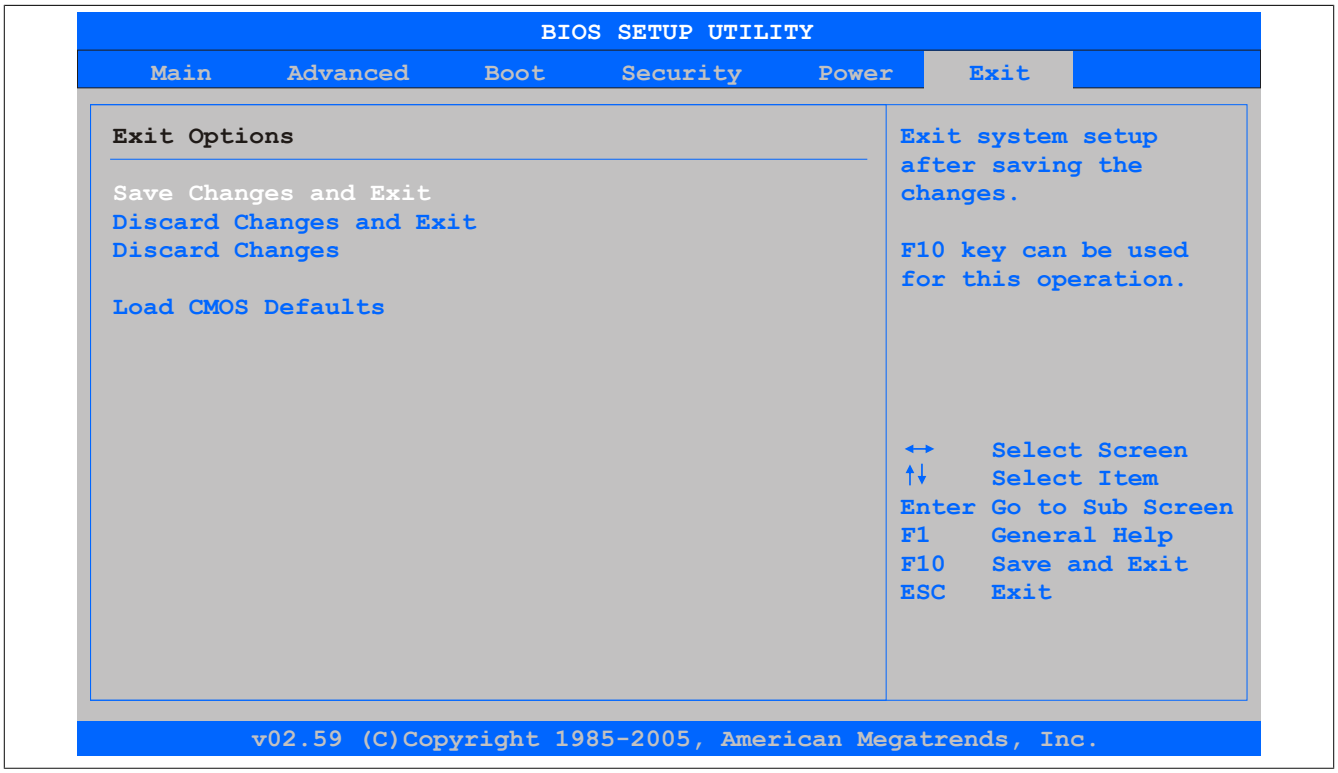


Abbildung 156: 945GME Exit Menü

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Save Changes and Exit	Bei diesem Punkt wird das BIOS Setup beendet. Vorgenommene Änderungen werden nach Bestätigung im CMOS gespeichert und das System wird rebootet.	OK / Cancel	
Discard Changes and Exit	Bei diesem Punkt wird das BIOS Setup beendet, ohne die vorgenommenen Änderungen zu speichern. Der Startvorgang wird fortgesetzt.	OK / Cancel	
Discard Changes	Wurden Einstellungen vorgenommen und man weiß nicht mehr welche, so können diese (sofern sie nicht schon gespeichert wurden) wieder zurückgesetz werden.	OK / Cancel	
Load CMOS Defaults	Bei diesem Punkt werden die in Abhängigkeit der DIP Switch Stellungen definierten CMOS Default Werte geladen. Diese Werte werden für alle BIOS Einstellungen geladen und eingestellt.	OK / Cancel	

Tabelle 223: 855GME (XTX) Exit Menü Einstellmöglichkeiten

1.9 BIOS Defaulteinstellungen

Mit Hilfe des CMOS Profile Hex Schalters lassen sich je nach Stellung vordefinierte BIOS Profileinstellungen laden.

Information:

Die bei der Lieferung eingestellte Position des Schalters stellt die optimalen BIOS Defaultwerte für dieses System dar und sollte daher nicht geändert werden.

Die nachfolgend aufgelisteten BIOS Einstellungen entsprechen jenen Einstellungen, welche nach dem Ausführen der Funktion „Load Setup Defaults“ im BIOS Setup Hauptmenü „Exit“ oder beim Drücken von <F9> bei den einzelnen BIOS Setup Seiten für diese BIOS Setup Seite optimierten Werte.

Profilnummer	Optimiert für	Schalterstellung	Anmerkung
Profil 0	Reserviert	0	
Profil 1	Systemeinheit 5PC810.SX01-00 / 5PC810.SX02-00 / 5PC810.SX03-00	1	Die Defaulteinstellungen für diese Profile befinden sich im APC810 Anwenderhandbuch. Dieses kann kostenlos von der B&R Homepage heruntergeladen werden.
Profil 2	Systemeinheit 5PC810.SX05-00	2	
Profil 3	Systemeinheit 5PC820.SX01-00 / 5PC820.SX01-01	3	Die Defaulteinstellungen für dieses Profil befinden sich im APC820 Anwenderhandbuch. Dieses kann kostenlos von der B&R Homepage heruntergeladen werden.
Profil 4	Reserviert	4	
Profil 5	Systemeinheit 5PC820.1505-00 / 5PC820.1906-00	5	Die Defaulteinstellungen für diese Profile befinden sich im PPC800 Anwenderhandbuch. Dieses kann kostenlos von der B&R Homepage heruntergeladen werden.

Tabelle 224: Profilübersicht

Die nachfolgenden Seiten geben einen Überblick über die BIOS Defaulteinstellungen abhängig von der CMOS Profil Schalterstellung. Gelb eingefärbte Einstellungen stellen die Abweichungen zum BIOS Defaultprofil (=Profil 0) dar.

1.9.1 Main

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Profil 1	Profil 2	Meine Einstellung
System Time	-	-	-	
System Date	-	-	-	
BIOS ID	-	-	-	
Prozessor	-	-	-	
CPU Frequency	-	-	-	
System Memory	-	-	-	
Product Revision	-	-	-	
Serial Number	-	-	-	
BC Firmware Rev.	-	-	-	
MAC Address (ETH1)	-	-	-	
Boot Counter	-	-	-	
Running Time	-	-	-	

Tabelle 225: 945GME Main Profileinstellungsübersicht

1.9.2 Advanced

1.9.2.1 ACPI Configuration

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Profil 1	Profil 2	Meine Einstellung
ACPI Aware O/S	Yes	Yes	Yes	
ACPI Version Features	ACPI v2.0	ACPI v2.0	ACPI v2.0	
ACPI APIC support	Enabled	Enabled	Enabled	
Suspend mode	S1 (POS)	S1 (POS)	S1 (POS)	
USB Device Wakeup from S3/S4	Disabled	Disabled	Disabled	
Active Cooling Trip Point	Disabled	Disabled	Disabled	
Passive Cooling Trip Point	Disabled	Disabled	Disabled	
Critical Trip Point	105°C	105°C	105°C	

Tabelle 226: 945GME Advanced - ACPI Configuration Profileinstellungsübersicht

1.9.2.2 PCI Configuration

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Profil 1	Profil 2	Meine Einstellung
Plug & Play O/S	No	**Yes**	**Yes**	
PCI Latency Timer	64	64	64	
Allocate IRQ to PCI VGA	Yes	Yes	Yes	
Allocate IRQ to SMBUS HC	Yes	Yes	Yes	

Tabelle 227: 945GME Advanced - PCI Configuration Profileinstellungsübersicht

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Profil 1	Profil 2	Meine Einstellung
Allocate IRQ to PCIEX2	Yes	Yes	Yes	
PCI IRQ Resource Exclusion				
IRQ3	Allocated	Allocated	Allocated	
IRQ4	Allocated	Allocated	Allocated	
IRQ5	Available	Available	Available	
IRQ6	Available	Available	Available	
IRQ7	Available	Available	Available	
IRQ9	Allocated	Allocated	Allocated	
IRQ10	Available	Available	Available	
IRQ11	Allocated	**Available**	**Available**	
IRQ12	Available	Available	Available	
IRQ14	Allocated	Allocated	Allocated	
IRQ15	Allocated	Allocated	Allocated	
PCI Interrupt Routing				
PIRQ A (VGA,PCIEX0, ETH2,UHCI2)	Auto	Auto	Auto	
PIRQ B (AC97,PCIEX1, ETH1)	Auto	Auto	Auto	
PIRQ C (PCIEX2)	Auto	Auto	Auto	
PIRQ D (SATA,UHCI1,SMB, PCIEX3)	Auto	Auto	Auto	
PIRQ E (INTD,UHCI3,PATA)	Auto	Auto	Auto	
PIRQ F (INTA)	Auto	Auto	Auto	
PIRQ G (INTB)	Auto	Auto	Auto	
PIRQ H (INTC,UHCI0,EHCI)	Auto	Auto	Auto	
1st Exclusive PCI	-	-	-	
2nd Exclusive PCI	-	-	-	

Tabelle 227: 945GME Advanced - PCI Configuration Profileinstellungsübersicht

1.9.2.3 PCI Express Configuration

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Profil 1	Profil 2	Meine Einstellung
Active State Power-Management	Disabled	Disabled	Disabled	
PCIE Port 0	Auto	Auto	Auto	
PCIE Port 1	Auto	Auto	Auto	
PCIE Port 2 (IF-Slot)	Auto	Auto	Auto	
PCIE Port 3	Auto	Auto	Auto	
PCIE Port 4 (ETH2)	Auto	Auto	Auto	
PCIE Port 5 (ETH1)	Auto	Auto	Auto	
PCIE High Priority Port	Disabled	Disabled	Disabled	
Res. PCIE Hotplug Resource	No	No	No	
PCIE Port 0 IOxAPIC Enable	Disabled	Disabled	Disabled	
PCIE Port 1 IOxAPIC Enable	Disabled	Disabled	Disabled	
PCIE Port 2 IOxAPIC Enable	Disabled	Disabled	Disabled	
PCIE Port 3 IOxAPIC Enable	Disabled	Disabled	Disabled	

Tabelle 228: 945GME Advanced - PCI Express Configuration Profileinstellungsübersicht

1.9.2.4 Graphics Configuration

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Profil 1	Profil 2	Meine Einstellung
Primary Video Device	Internal VGA	Internal VGA	Internal VGA	
Internal Graphics Mode Select	Enabled, 8MB	Enabled, 8MB	Enabled, 8MB	
DVMT Mode Select	DVMT Mode	DVMT Mode	DVMT Mode	
DVMT/FIXED Memory	128MB	128MB	128MB	
Boot Display Device	Auto	Auto	Auto	
Boot Display Preference	SDVO-B SDVO-C LFP	SDVO-B SDVO-C LFP	SDVO-B SDVO-C LFP	
Local Flat Panel Type	Auto	Auto	Auto	
Local Flat Panel Scaling	Centering	Centering	Centering	
SDVO Port B Device	DVI	DVI	DVI	
SDVO Port C Device	DVI	DVI	DVI	
SDVO/DVI Hotplug Support	Enabled	Enabled	Enabled	
Display Mode Persistance	Enabled	Enabled	Enabled	

Tabelle 229: 945GME Advanced - Graphics Configuration Profileinstellungsübersicht

1.9.2.5 CPU Configuration

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Profil 1	Profil 2	Meine Einstellung
MPS Revision	1.4	1.4	1.4	
Max CPUID Value Limit	Disabled	Disabled	Disabled	
Execute Disable Bit	Enabled	Enabled	Enabled	
Core Multi-Processing	Enabled	Enabled	Enabled	
Intel(R) SpeedStep(tm) tech.	Automatic	Automatic	Automatic	
Max. CPU Frequency	xxxx MHz	xxxx MHz	xxxx MHz	
C1 Config.	Standard	Standard	Standard	
C2 Config.	Disabled	Disabled	Disabled	
C3 Config.	Disabled	Disabled	Disabled	
C4 Config.	Disabled	Disabled	Disabled	

Tabelle 230: 945GME Advanced - CPU Configuration Profileinstellungsübersicht

1.9.2.6 Chipset Configuration

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Profil 1	Profil 2	Meine Einstellung
DRAM Frequency	Auto	Auto	Auto	
DRAM Refresh Rate	Auto	Auto	Auto	
Memory Hole	Disabled	Disabled	Disabled	
DIMM Thermal Control	Disabled	Disabled	Disabled	
DT in SPD	Disabled	Disabled	Disabled	
TS on DIMM	Disabled	Disabled	Disabled	
High Precision Event Timer	Disabled	Disabled	Disabled	
IOAPIC	Enabled	Enabled	Enabled	
APIC ACPI SCI IRQ	Disabled	Disabled	Disabled	
C4 On C3	Disabled	Disabled	Disabled	

Tabelle 231: 945GME Advanced - Chipset Configuration Profileinstellungsübersicht

1.9.2.7 I/O Interface Configuration

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Profil 1	Profil 3	Meine Einstellung
Onboard Audio Controller	AC97	AC97	AC97	

Tabelle 232: 945GME Advanced - I/O Interface Configuration Profileinstellungsübersicht

1.9.2.8 Clock Configuration

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Profil 1	Profil 2	Meine Einstellung
Spread Spectrum	Disabled	Disabled	Disabled	

Tabelle 233: 945GME Advanced - Clock Configuration Profileinstellungsübersicht

1.9.2.9 IDE Configuration

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Profil 1	Profil 2	Meine Einstellung
ATA/IDE Configuration	Compatible	Compatible	Compatible	
Legacy IDE Channels	SATA Pri, PATA Sec	SATA Pri, PATA Sec	SATA Pri, PATA Sec	
Configure SATA as	-	-	-	
Configure SATA as Channels	-	-	-	
AHCI/RAID SATA Hotplug	-	-	-	
Hard Disk Write Protect	Disabled	Disabled	Disabled	
IDE Detect TIme Out (Sec)	35	35	35	
ATA(PI) 80Pin Cable Detection	Host & Device	Host & Device	Host & Device	
Primary IDE Master				
Type	Auto	Auto	Auto	
LBA/Large Mode	Auto	Auto	Auto	
Block (Multi-Sector Transfer)	Auto	Auto	Auto	
PIO Mode	Auto	Auto	Auto	
DMA Mode	Auto	Auto	Auto	
S.M.A.R.T.	Auto	Auto	Auto	
32Bit Data Transfer	Enabled	Enabled	Enabled	
Primary IDE Slave				
Type	Auto	Auto	Auto	
LBA/Large Mode	Auto	Auto	Auto	
Block (Multi-Sector Transfer)	Auto	Auto	Auto	
PIO Mode	Auto	Auto	Auto	
DMA Mode	Auto	Auto	Auto	
S.M.A.R.T.	Auto	Auto	Auto	
32Bit Data Transfer	Enabled	Enabled	Enabled	
Secondary IDE Master				
Type	Auto	Auto	Auto	
LBA/Large Mode	Auto	Auto	Auto	
Block (Multi-Sector Transfer)	Auto	Auto	Auto	
PIO Mode	Auto	Auto	Auto	
DMA Mode	Auto	Auto	Auto	
S.M.A.R.T.	Auto	Auto	Auto	
32Bit Data Transfer	Enabled	Enabled	Enabled	
Secondary IDE Slave				
Type	Auto	Auto	Auto	
LBA/Large Mode	Auto	Auto	Auto	
Block (Multi-Sector Transfer)	Auto	Auto	Auto	
PIO Mode	Auto	Auto	Auto	
DMA Mode	Auto	Auto	Auto	
S.M.A.R.T.	Auto	Auto	Auto	
32Bit Data Transfer	Enabled	Enabled	Enabled	

Tabelle 234: 945GME Advanced - IDE Configuration Profileinstellungsübersicht

1.9.2.10 USB Configuration

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Profil 1	Profil 2	Meine Einstellung
USB Function	8 USB Ports	8 USB Ports	8 USB Ports	
USB 2.0 Controller	Enabled	Enabled	Enabled	
Legacy USB Support	Enabled	Enabled	Enabled	
USB Legacy POST-Always	Enabled	Enabled	Enabled	
USB Keyboard Legacy Support	Enabled	Enabled	Enabled	
USB Mouse Legacy Support	Disabled	Disabled	Disabled	
USB Storage Device Support	Enabled	Enabled	Enabled	
Port 64/60 Emulation	Disabled	Disabled	Disabled	
USB 2.0 Controller Mode	HiSpeed	HiSpeed	HiSpeed	
BIOS EHCI Hand-Off	Disabled	Disabled	Disabled	
USB Beep Message	Enabled	Enabled	Enabled	
USB Stick Default Emulation	Hard Disk	Hard Disk	Hard Disk	
USB Mass Storage Reset Delay	20 Sec	20 Sec	20 Sec	

Tabelle 235: 945GME Advanced - USB Configuration Profileinstellungsübersicht

1.9.2.11 Keyboard/Mouse Configuration

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Profil 1	Profil 2	Meine Einstellung
Bootup Num-Lock	On	On	On	
Typematic Rate	Fast	Fast	Fast	

Tabelle 236: 945GME Advanced - Keyboard/Mouse Configuration Profileinstellungsübersicht

1.9.2.12 Remote Access Configuration

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Profil 1	Profil 2	Meine Einstellung
Remote Access	Disabled	Disabled	Disabled	
Serial Port Number	-	-	-	
Base Address, IRQ	-	-	-	
Serial Port Mode	-	-	-	
Flow Control	-	-	-	
Redirection After BIOS POST	-	-	-	
Terminal Type	-	-	-	
VT-UTF8 Combo Key Support	-	-	-	
Sredir Memory Display Delay	-	-	-	
Serial Port BIOS Update	Disabled	Disabled	Disabled	

Tabelle 237: 945GME Advanced - Remote Access Configuration Profileinstellungsübersicht

1.9.2.13 CPU Board Monitor

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Profil 1	Profil 2	Meine Einstellung
H/W Health Function	Enabled	Enabled	Enabled	

Tabelle 238: 945GME Advanced - CPU Board Monitor Profileinstellungsübersicht

1.9.2.14 Baseboard/Panel Features

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Profil 1	Profil 2	Meine Einstellung
Panel Control				
Select Panel Number	-	-	-	
Version	-	-	-	
Brightness	100%	100%	100%	
Temperature	-	-	-	
Fan Speed	-	-	-	
Keys/Leds	-	-	-	
Baseboard Monitor				
CMOS Battery	-	-	-	
Board I/O	-	-	-	
Board ETH2	-	-	-	
Board Power	-	-	-	
Power Supply	-	-	-	
Slide-In Drive 1	-	-	-	
Slide-In Drive 2	-	-	-	
ETH2 Controller	-	-	-	
Case 1	-	-	-	
Case 2	-	-	-	
Case 3	-	-	-	
Case 4	-	-	-	
Legacy Devices				
COM A	Enabled	Enabled	Enabled	
Base I/O address	3F8	3F8	3F8	
Interrupt	IRQ4	IRQ4	IRQ4	
COM B	Enabled	Enabled	Enabled	
Base I/O address	2F8	2F8	2F8	
Interrupt	IRQ3	IRQ3	IRQ3	
COM C	Enabled	**Disabled**	**Disabled**	
Base I/O address	3E8	-	-	
Interrupt	IRQ11	-	-	
COM D	Disabled	Disabled	Disabled	
Base I/O address	-	-	-	
Interrupt	-	-	-	
COM E	Disabled	Disabled	Disabled	
Base I/O address	-	-	-	
Interrupt	-	-	-	
CAN	Disabled	Disabled	Disabled	
Hardware Security Key	Enabled	Enabled	Enabled	
Base I/O address	378	378	378	
ETH2 LAN Controller	Enabled	Enabled	Enabled	
ETH2 MAC Adress	-	-	-	

Tabelle 239: 945GME Advanced - Baseboard/Panel Features Profileinstellungsübersicht

1.9.3 Boot

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Profil 1	Profil 2	Meine Einstellung
Boot Priority Selection	Type Based	Type Based	Type Based	
1st Boot Device	Onboard LAN	**Primary Master**	**Primary Master**	
2nd Boot Device	Primary Master	**Primary Slave**	**Primary Slave**	
3rd Boot Device	Primary Slave	**USB Floppy**	**USB Floppy**	
4th Boot Device	USB Floppy	**USB Removable Device**	**USB Removable Device**	
5th Boot Device	USB Removable Device	**USB Harddisk**	**USB Harddisk**	
6th Boot Device	USB CDROM	USB CDROM	USB CDROM	
7th Boot Device	Secondary Master	Secondary Master	Secondary Master	
8th Boot Device	Secondary Slave	Secondary Slave	Secondary Slave	
Quick Boot	Enabled	Enabled	Enabled	
Quiet Boot	Disabled	Disabled	Disabled	
Automatic Boot List Retry	Disabled	Disabled	Disabled	
Add-on ROM Display Mode	Keep Current	Keep Current	Keep Current	
Halt On Error	Disabled	Disabled	Disabled	
Hit „DEL“ Message Display	Enabled	Enabled	Enabled	
Interrupt 19 Capture	Disabled	Disabled	Disabled	
PXE Boot to LAN (ETH1)	Enabled	**Disabled**	**Disabled**	
Slide-In 2 Option ROM	Enabled	**Disabled**	Enabled	
Power Loss Control	Turn On	Turn On	Turn On	

Tabelle 240: 945GME Main Profileinstellungsübersicht

1.9.4 Security

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Profil 1	Profil 2	Meine Einstellung
Supervisor Password	-	-	-	
User Password	-	-	-	
Boot Sector Virus Protection	Disabled	Disabled	Disabled	
Hard Disk Security User Password	-	-	-	
Hard Disk Security Master Password	-	-	-	

Tabelle 241: 945GME Security Profileinstellungsübersicht

1.9.5 Power

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Profil 1	Profil 2	Meine Einstellung
Power Management/APM	Enabled	Enabled	Enabled	
Suspend Time Out	Disabled	Disabled	Disabled	
Video Power Down Mode	Suspend	Suspend	Suspend	
Hard Disk Power Down Mode	Suspend	Suspend	Suspend	
Keyboard & PS/2 Mouse	MONITOR	MONITOR	MONITOR	
FDC/LPT/COM Ports	MONITOR	MONITOR	MONITOR	
Primary Master IDE	MONITOR	MONITOR	MONITOR	
Primary Slave IDE	MONITOR	MONITOR	MONITOR	
Secondary Master IDE	MONITOR	MONITOR	MONITOR	
Secondary Slave IDE	MONITOR	MONITOR	MONITOR	
Resume On Ring	Disabled	Disabled	Disabled	
Resume On PME#	Disabled	Disabled	Disabled	
Resume On RTC Alarm	Disabled	Disabled	Disabled	
Power Button Mode	On/Off	On/Off	On/Off	

Tabelle 242: 945GME Power Profileinstellungsübersicht

1.10 BIOS Fehlersignale (Beep Codes)

Während des Booten eines B&R Industrie PCs können von Seiten des BIOS folgende Meldungen bzw. Fehler auftreten, die durch verschiedene Piepscodes signalisiert werden.

Piepsintervall	Bedeutung	erforderliche Benutzerreaktion
1x kurz	Speicher - Refresh ausgefallen.	BIOS Default Werte laden. Falls der Fehler weiter besteht Industrie PC zur Überprüfung an B&R schicken.
2x kurz	Parity Error: POST fehlerhaft (eine der Hardwaretestprozeduren ist fehlerhaft).	Den korrekten Sitz der gesteckten Karten überprüfen. Falls der Fehler weiter besteht Industrie PC zur Überprüfung an B&R schicken.
3x kurz	Base 64 KB Memory Failure: Basis - Speicher defekt, RAM-Fehler innerhalb der ersten 64 KB.	Industrie PC zur Überprüfung an B&R schicken.
4x kurz	Timer not Operational: System - Timer.	Industrie PC zur Überprüfung an B&R schicken.
5x kurz	Prozessor Error: Prozessor defekt.	Industrie PC zur Überprüfung an B&R schicken.
6x kurz	8042 Gate A20 Failure: Tastatur-Controller defekt (8042- Baustein/ A20 Gate). Prozessor kann nicht in den Protected Mode schalten.	Industrie PC zur Überprüfung an B&R schicken.
7x kurz	Prozessor Exception Interrupt Error: Virtual Mode Ausnahmefehler (CPU hat einen Interruptfehler generiert).	Industrie PC zur Überprüfung an B&R schicken.
8x kurz	Display Memory Read/Write Error: Videospeicher nicht ansprechbar; Grafikkarte defekt oder nicht eingebaut (kein fataler Fehler).	Bei gesteckter Grafikkarte diese auf korrekten Sitz überprüfen und eventuell austauschen. Falls der Fehler weiter besteht Industrie PC zur Überprüfung an B&R schicken.
9x kurz	ROM-Checksum Error: ROM-BIOS-Checksumme nicht korrekt, EPROM, EEPROM oder Flash-ROM-Baustein defekt, BIOS defekt oder nicht korrekt updated.	Industrie PC zur Überprüfung an B&R schicken.
10x kurz	CMOS Shutdown Register Read/Write Error: CMOS kann nicht gelesen/geschrieben werden.	Industrie PC zur Überprüfung an B&R schicken.
11x kurz	Cache Error / external Cache Bad: L2 - Cache auf dem Mainboard defekt.	Industrie PC zur Überprüfung an B&R schicken.

Tabelle 243: BIOS Postcode Meldungen BIOS 945GME

1.11 Ressourcenaufteilung

1.11.1 RAM-Adressbelegung

RAM Adresse	Adresse in Hex	Ressource
(TOM - 192 kB) – TOM[1)]	N.A.	ACPI reclaim, MPS und NVS area[2)]
(TOM - 8 MB - 192 kB) – (TOM - 192 kB)	N.A.	VGA frame buffer[3)]
1024 kB – (TOM - 8 MB - 192 kB)	100000h - N.A.	Extended memory
869 kB – 1024 kB	0E0000h - 0FFFFFh	Runtime BIOS
832 kB – 869 kB	0D0000h - 0DFFFFh	Upper memory
640 kB – 832 kB	0A0000h - 0CFFFFh	Video memory and BIOS
639 kB – 640 kB	09FC00h - 09FFFFh	Extended BIOS data
0 – 639 kB	000000h - 09FC00h	Conventional memory

Tabelle 244: RAM-Adressbelegung

1) TOM - Top of memory: max. installierter DRAM
2) Nur wenn ACPI Aware OS im Setup auf „YES“ eingestellt ist.
3) Der VGA Grafikspeicher kann im Setup auf 1 MB reduziert werden.

1.11.2 I/O-Adressbelegung

I/O Adresse	Ressource
0000h - 00FFh	Motherboard Resourcen
0170h - 0177h	Secondary IDE Kanal
01F0h - 01F7h	Primary IDE Kanal
0238h - 023Fh	COM5
0278h - 027Fh	Hardware Security Key (LPT2)
02E8h - 02EFh	COM4
02F8h - 02FFh	COM2
0376h - 0376h	Secondary IDE Kanal Kommando Port
0377h - 0377h	Secondary IDE Kanal Status Port
0378h - 037Fh	Hardware Security Key (LPT1)
0384h - 0385h	CAN Controller
03B0h - 03DFh	Video System
03E8h - 03EFh	COM3
03F6h - 03F6h	Primary IDE Kanal Kommando Port
03F7h - 03F7h	Primary IDE Kanal Status Port
03F8h - 03FFh	COM1
0480h - 04BFh	Motherboard Resourcen
04D0h - 04D1h	Motherboard Resourcen
0800h - 087Fh	Motherboard Resourcen
0CF8h - 0CFBh	PCI Config Address Register
0CFCh - 0CFFh	PCI Config Data Register
0D00h - FFFFh	PCI / PCI Express Bus[1)]
4100h - 417Fh	MTCX
FF00h - FF07h	IDE Bus Master Register

Tabelle 245: I/O-Adressbelegung

1) Das BIOS weist dem PCI und PCI Express Bus I/O Resourcen von FFF0h abwärts zu. Nicht PnP/PCI/PCI Express fähige Geräte dürfen die I/O Resourcen in diesem Bereich nicht verwenden.

1.11.3 Interrupt- Zuweisungen in PIC Mode

IRQ		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	NMI	NONE
Systemtimer		●																	
Tastatur			●																
IRQ Kaskade				●															
COM1 (Serial port A)					○	●	○	○	○			○	○	○					
COM2 (Serial port B)					●	○	○	○	○			○	○	○					
ACPI[1)]											●								
Echtzeituhr										●									
Coprozessor (FPU)															●				
Primär IDE Kanal																●			
Secondary IDE Kanal																	●		
B&R	COM3 (COM C)				○	○	○	○	○			○	○	○					●
	COM4 (COM D)				○	○	○	○	○			○	○	○					●
	COM5 (COM E)				○	○	○	○	○			○	○	○					●
	CAN				○	○	○	○	○			○	○	○				○	●

Tabelle 246: IRQ Interrupt Zuweisungen PIC Mode

1) **A**dvanced **C**onfiguration and **P**ower **I**nterface.

● ... Standardeinstellung
○ ... mögliche Einstellung

1.11.4 Interrupt- Zuweisungen in APIC Mode

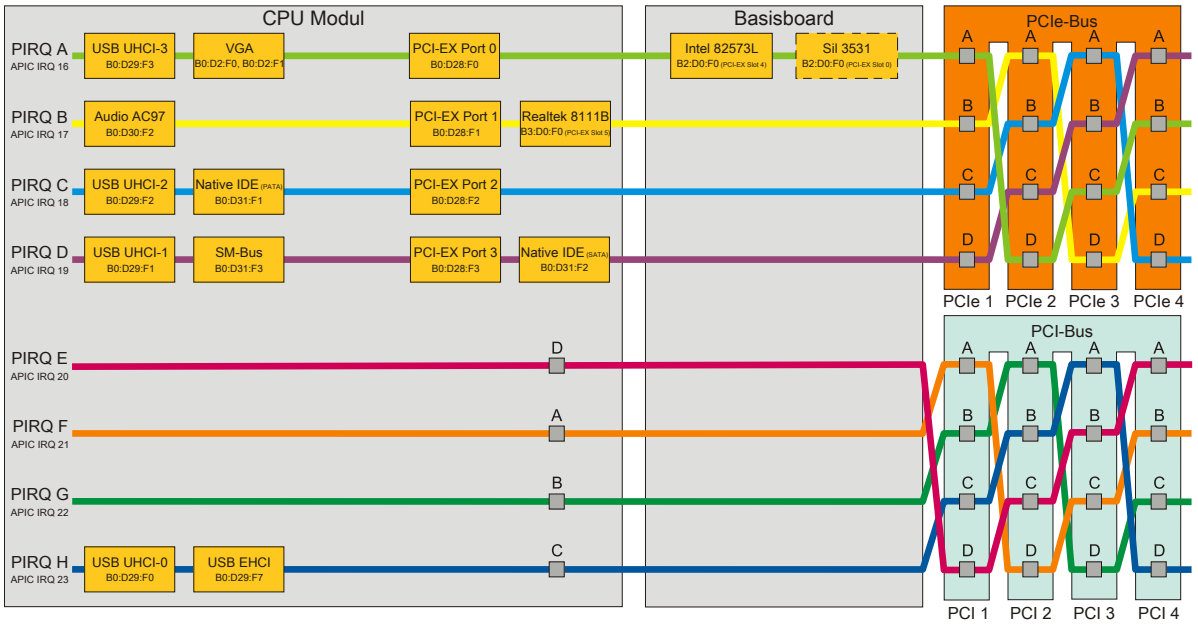
Im APIC (**A**dvanced **P**rogrammable **I**nterrupt **C**ontroller) Mode stehen ingesamt 23 IRQs zur Verfügung. Die Aktivierung der Option wird nur dann wirksam, wenn diese vor der Installation des Windows Betriebssystems aktiviert wird.

IRQ		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	NMI	NO-NE
Systemtimer		●																									
Tastatur			●																								
IRQ Kaskade				●																							
COM1 (Serial port A)					○	●	○	○	○			○	○	○													
COM2 (Serial port B)					●	○	○	○	○			○	○	○													
ACPI[1]											●																
Echtzeituhr										●																	
Coprozessor (FPU)															●												
Primary IDE Kanal																●											
Secondary IDE Kanal																	●										
B&R	COM3 (COM C)				○	○	○	○	○			○	○	○													●
	COM4 (COM D)				○	○	○	○	○			○	○	○													●
	COM5 (COM E)				○	○	○	○	○			○	○	○													●
	CAN				○	○	○	○	○			○	○	○												○	●
PIRQ A[2]																		●									
PIRQ B[3]																			●								
PIRQ C[4]																				●							
PIRQ D[5]																					●						
PIRQ E[6]																						●					
PIRQ F[7]																							●				
PIRQ G[8]																								●			
PIRQ H[9]																									●		

Tabelle 247: IRQ Interrupt Zuweisungen APIC Mode

1) **A**dvanced **C**onfiguration and **P**ower **I**nterface.
2) PIRQ A: für PCIe; UHCI Host Controller 3, VGA Controller, PCI Express Root Port 0, Intel High Definition Audio Controller, PCI-EX to SATA Bridge
3) PIRQ B: für PCIe; AC'97 Audio, PCI Express Root Port 1, onboard Gigabit LAN Controller
4) PIRQ C: für PCIe; UHCI Host Controller 1, SMBus Controller, PCI Express Root Port 3, Serial ATA Controller in enhanced/native Modus
5) PIRQ D: für PCIe; UHCI Host Controller 3, Parallel ATA Controller in enhanced/native Modus
6) PIRQ E: PCI Bus INTD
7) PIRQ F: PCI Bus INTA
8) PIRQ G: PCI Bus INTB
9) PIRQ H: PCI Bus INTC, UHCI Host Controller 0, EHCI Host Controller

● ... Standardeinstellung
○ ... mögliche Einstellung



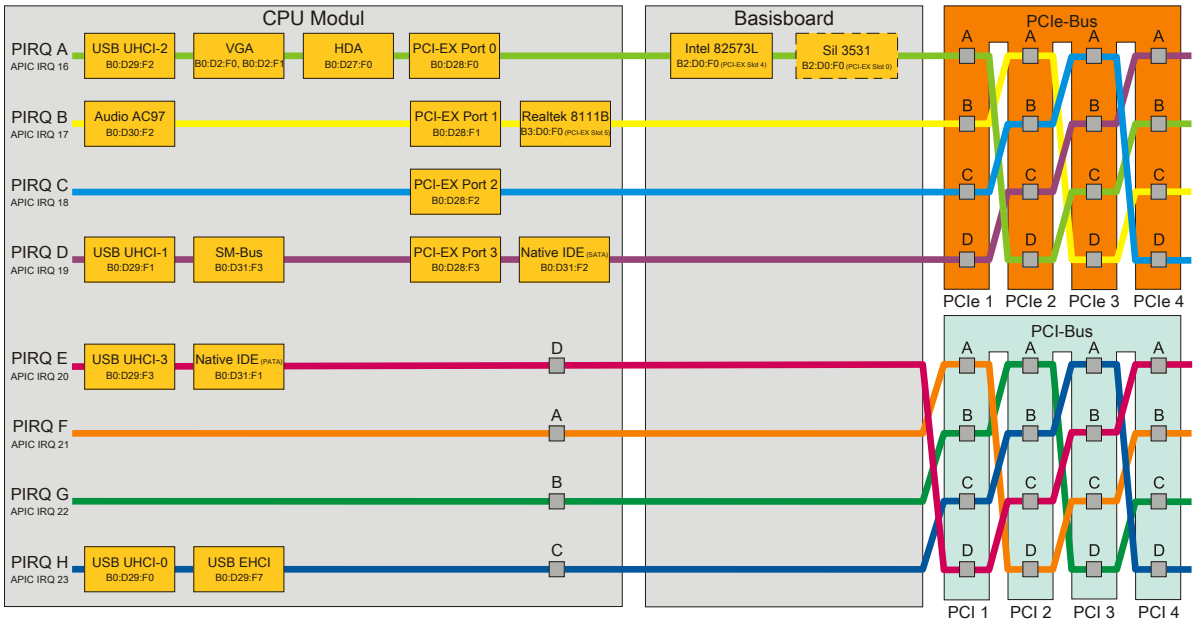
Steckplatzzuordnung APC810

Slot 5	Slot 4	Slot 3	Slot 2	Slot 1	
				PCI 1	5PC810.BX01-00
				PCIe 1	5PC810.BX01-01
			PCI 2	PCI 1	5PC810.BX02-00
			PCIe 1	PCI 1	5PC810.BX02-01
		PCIe 1	PCI 2	PCI 1	5PC810.BX03-00
PCIe 2	PCI 4	PCI 3	PCI 2	PCI 1	5PC810.BX05-00
PCIe 4	PCIe 3	PCIe 2	PCI 2	PCI 1	5PC810.BX05-01

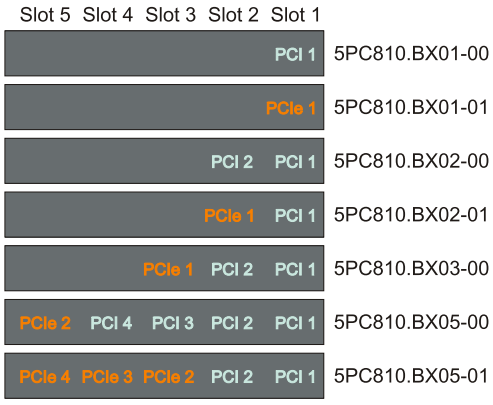
Sil 3531
B2:D0:F0 (PCI-EX Slot 0)

PCI-EX to SATA Bridge für Slide-in 2 Option.
Ist nur bei 5PC810.BX05-00, 5PC810.BX05-01 und 5PC810.BX05-02 bestückt.
Wenn bestückt, verschieben sich die Busnummern des Intel 82573L und Realtek 8111B um 1 Stelle nach hinten.

Abbildung 157: PCI und PCIe Routing mit aktiviertem APIC CPU Board 945GME (COM Express) für BIOS Version ≤ 1.12



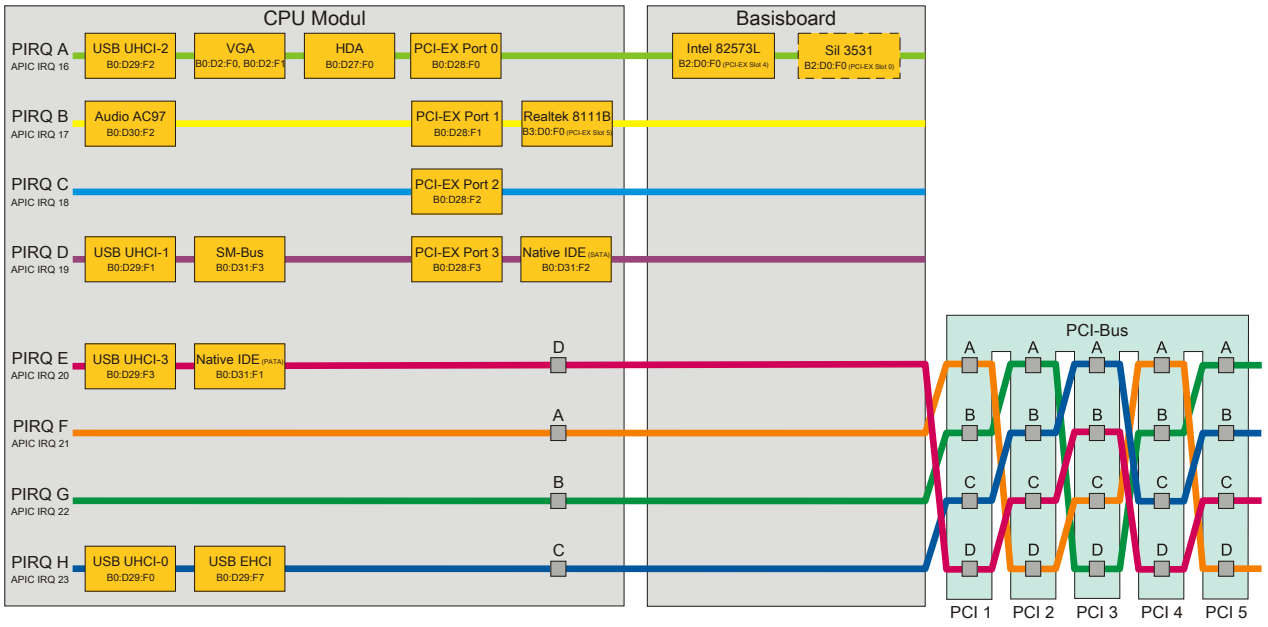
Steckplatzzuordnung APC810



Sil 3531
B2:D0:F0 (PCI-EX Slot 0)

PCI-EX to SATA Bridge für Slide-in 2 Option.
Ist nur bei 5PC810.BX05-00, 5PC810.BX05-01 und 5PC810.BX05-02 bestückt.
Wenn bestückt, verschieben sich die Busnummern des Intel 82573L und Realtek 8111B um 1 Stelle nach hinten.

Abbildung 158: PCI und PCIe Routing mit aktiviertem APIC CPU Board 945GME (COM Express) für BIOS Version ≥ 1.14 (Buseinheiten 5PC810.BX0x-0x)



Steckplatzzuordnung APC810

Slot 5 Slot 4 Slot 3 Slot 2 Slot 1

PCI 5 | PCI 4 | PCI 3 | PCI 2 | PCI 1 — 5PC810.BX05-02

1) 1)

1) Die Steckplätze PCI4 und PCI5 liegen hinter einer zusätzlichen PCI to PCI Bridge. (siehe Blockschaltbild des 5PC810.BX05-02 Bus)

Sil 3531
B2:D0:F0 (PCI-EX Slot 0)

PCI-EX to SATA Bridge für Slide-in 2 Option.
Ist nur bei 5PC810.BX05-00, 5PC810.BX05-01 und 5PC810.BX05-02 bestückt.
Wenn bestückt, verschieben sich die Busnummern des Intel 82573L und Realtek 8111B um 1 Stelle nach hinten.

Abbildung 159: PCI und PCIe Routing mit aktiviertem APIC CPU Boards
945GME (COM Express) für BIOS Version ≥ 1.14 (Buseinheit 5PC810.BX05-02)

2 Upgradeinformationen

Warnung!

Das BIOS und die Firmware von B&R Geräten sind stets auf dem aktuellsten Stand zu halten. Neue Versionen können von der B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen werden.

2.1 BIOS Upgrade

Ein Upgrade kann z.B. aus folgendem Grund notwendig sein:

- Um die im BIOS Setup implementierten Funktionen zu aktualisieren bzw. neu realisierte Funktionen oder Komponenten hinzuzufügen (Informationen über Änderungen können der Liesmich bzw. der Readme Datei des BIOS Upgrades entnommen werden).

2.1.1 Was muss ich wissen?

Information:

Bei einem BIOS Upgrade werden individuell gespeicherte BIOS Einstellungen gelöscht.

Bevor man mit dem Upgrade beginnt, ist es sinnvoll die verschiedenen Softwareversionen festzustellen.

2.1.1.1 Welche BIOS Version und Firmware ist bereits am APC810 installiert?

Diese Informationen sind auf folgender BIOS Setupseite zu finden:

- Nach dem Einschalten des APC810 gelangt man mit „Entf" ins BIOS Setup.
- Unter dem BIOS Hauptmenü „Advanced" den Unterpunkt „Baseboard/Panel Features" auswählen.

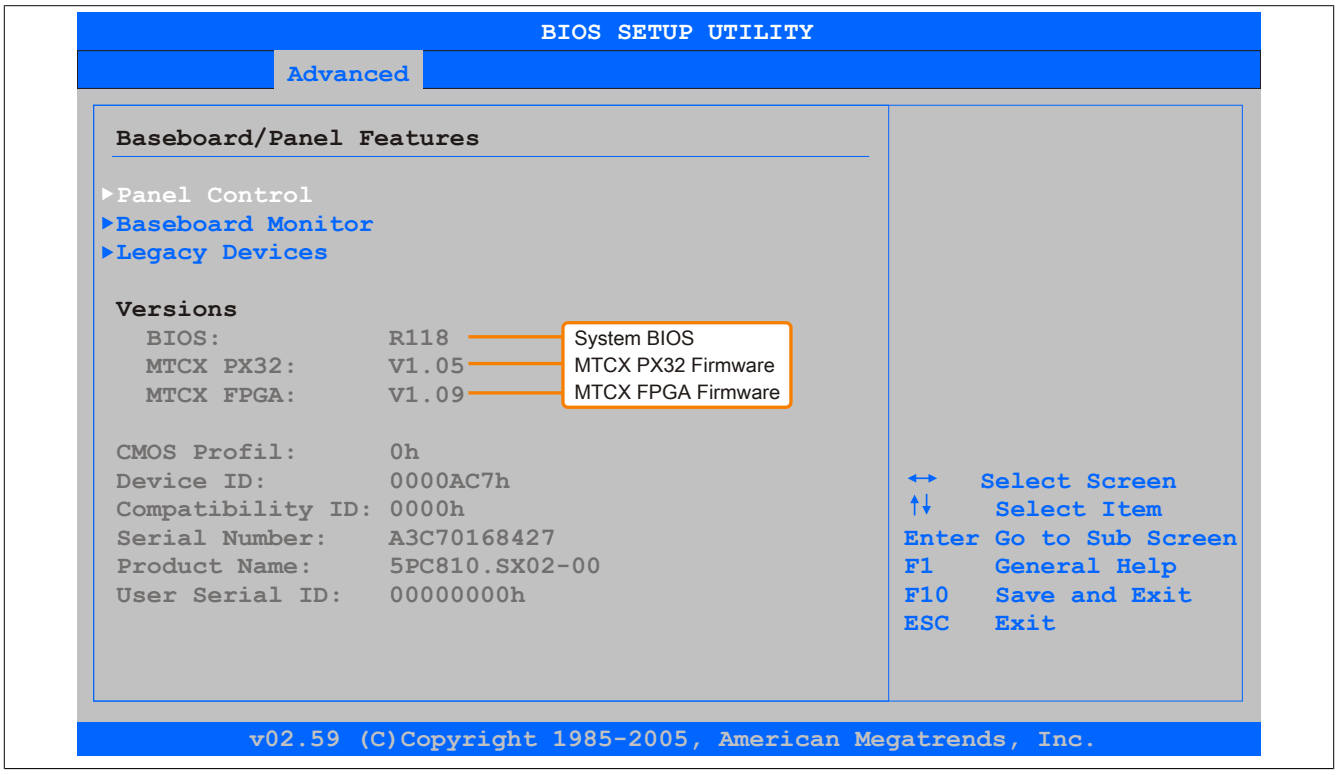


Abbildung 160: Softwareversion

2.1.1.2 Welche Firmware ist am Automation Panel Link Transmitter installiert?

Diese Informationen sind auf folgender BIOS Setupseite zu finden:

- Nach dem Einschalten des APC810 gelangt man mit „Entf" ins BIOS Setup.
- Unter dem BIOS Hauptmenü „Advanced" den Unterpunkt „Baseboard/Panel Features" und danach den Punkt „Panel Control" auswählen.

Information:

Die Version kann nur bei angeschlossenem Automation Panel mit AP Link SDL Transmitter (5AC801.SDL0-00) angezeigt werden.

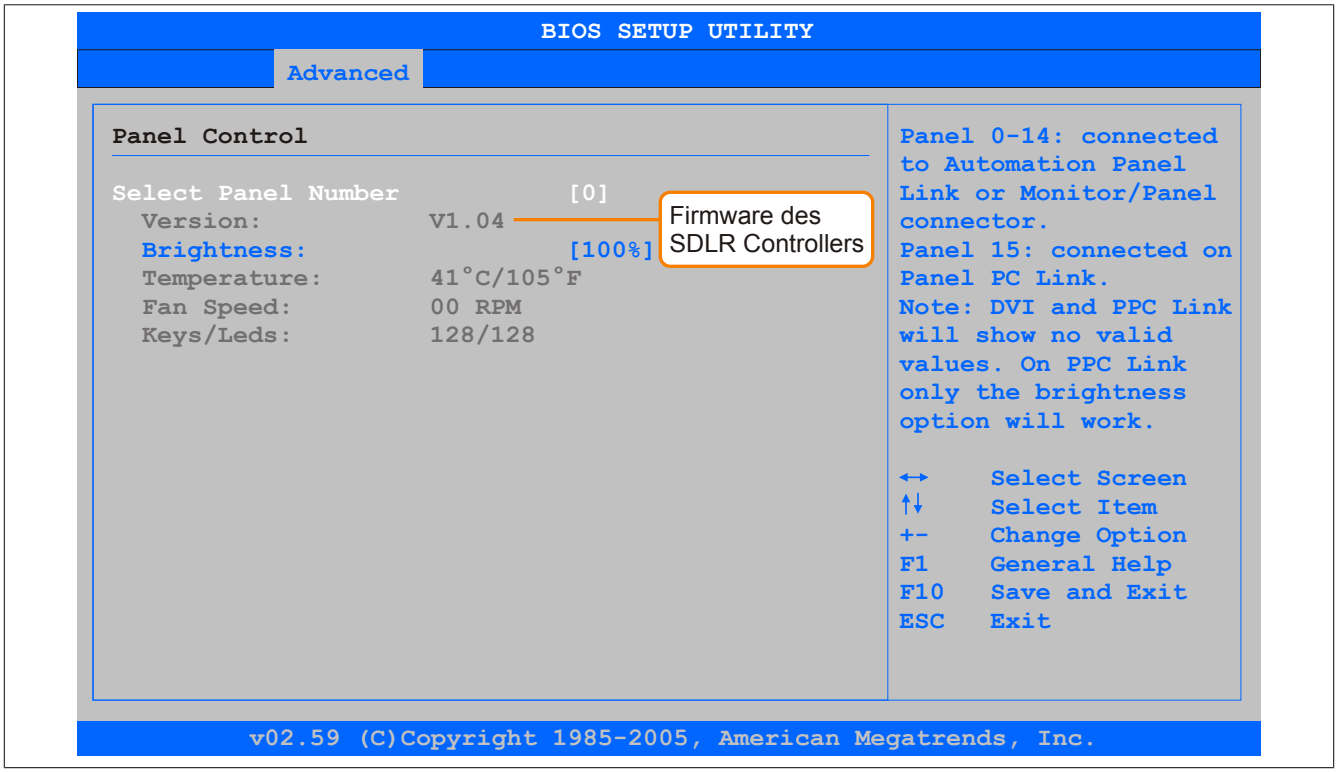


Abbildung 161: Firmwareversion des AP Link SDL Transmitter

2.1.2 Vorgangsweise mit MS-DOS

1. ZIP Datei von der B&R Homepage (www.br-automation.com) downloaden.
2. Bootfähiges Medium erstellen.

Information:

Unter MS-DOS, Win95 und Win98 kann eine leere HD Diskette mit der Kommandozeile „sys a:“ oder „format a: /s“ bootfähig gemacht werden.
Informationen zum Erstellen einer Bootdiskette unter Windows XP siehe Seite 296.

Informationen zum Erstellen eines USB Memory Sticks für ein B&R Upgrade siehe Seite 298.

Informationen zum Erstellen einer CompactFlash Karte für ein B&R Upgrade siehe Seite 299.

3. Den Inhalt der *.zip Datei auf das bootfähige Medium kopieren. Falls der B&R Upgrade bereits beim Erstellen mittels B&R Embedded OS Installer hinzugefügt wurde, entfällt dieser Schritt.
4. Das bootfähige Medium am B&R Gerät anstecken und das Gerät neu booten.
5. Nach dem Start gelangt man in folgendes Bootmenü:

```
1. Upgrade AMI BIOS for B945

2. Exit
```

zu Punkt 1:
Das BIOS wird automatisch aktualisiert (Default nach 5 Sekunden).

zu Punkt 2:
Ausstieg in die Shell (MS-DOS).

Information:

Wird innerhalb von 5 Sekunden keine Taste gedrückt, so wird automatisch der Punkt 1 „Upgrade AMI BIOS for B945“ ausgeführt und der Industrie PC selbstständig aktualisiert.

6. Nach erfolgreichem Upgrade muss das System neu gebootet werden.
7. Reboot und Taste "Del" drücken um in das BIOS Setup Menü zu gelangen und Setup Defaults laden, danach "Save Changes and Exit" anwählen.

2.2 Firmwareupgrade

Mit der „Firmware Upgrade (MTCX, SDLT, SDLR, USV)" Software ist es möglich, je nach Ausführung des APC810 Systems die Firmware mehrerer Controller (MTCX, SDLT, SDLR, UPSI) zu aktualisieren.

Ein aktuelles Firmware Upgrade kann direkt über den Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen werden.

2.2.1 Vorgangsweise

Um einen Firmwareupgrade durchzuführen, sind folgende Schritte auszuführen:

1. ZIP Datei von der B&R Homepage (www.br-automation.com) downloaden.
2. Bootfähiges Medium erstellen.

> **Information:**
>
> **Unter MS-DOS, Win95 und Win98 kann eine leere HD Diskette mit der Kommandozeile „sys a:" oder „format a: /s" bootfähig gemacht werden.**
> **Informationen zum Erstellen einer Bootdiskette unter Windows XP siehe Seite 296.**
>
> **Informationen zum Erstellen eines USB Memory Sticks für ein B&R Upgrade siehe Seite 298.**
>
> **Informationen zum Erstellen einer CompactFlash Karte für ein B&R Upgrade siehe Seite 299.**

3. Den Inhalt der *.zip Datei auf das bootfähige Medium kopieren. Falls der B&R Upgrade bereits beim Erstellen mittels B&R Embedded OS Installer hinzugefügt wurde, entfällt dieser Schritt.
4. Das bootfähige Medium am B&R Gerät anstecken und das Gerät neu booten.
5. Nach dem Start gelangt man in folgendes Bootmenü:

> **Information:**
>
> **Die nachfolgenden Bootmenüoptionen einschließlich Beschreibung beziehen sich auf die Version 1.00 der APC800 Upgrade (MTCX, SDLT, SDLR, UPSI) Disks. Es kann daher vorkommen, dass diese Beschreibungen nicht mit der vorliegenden Version übereinstimmen.**

```
1. Upgrade MTCX (APC810) PX32 and FPGA
2. Upgrade SDLT (APC810) only
3. Upgrade SDLR (AP800/AP900) on Monitor/Panel
3.1 Upgrade SDLR on AP 0 (AP800/AP900)
3.2 Upgrade SDLR on AP 1 (AP800/AP900)
3.3 Upgrade SDLR on AP 2 (AP800/AP900)
3.4 Upgrade SDLR on AP 3 (AP800/AP900)
3.5 Upgrade all SDLR (AP800/AP900)
3.6 Return to Main Menu
4. Upgrade SDLR (AP800/AP900) on AP Link Slot
4.1 Upgrade SDLR on AP 8 (AP800/AP900)
4.2 Upgrade SDLR on AP 9 (AP800/AP900)
4.3 Upgrade SDLR on AP 10 (AP800/AP900)
4.4 Upgrade SDLR on AP 11 (AP800/AP900)
4.5 Upgrade all SDLR (AP800/AP900)
4.6 Return to Main Menu
5. Upgrade Add-on UPS (Firmware and Battery Settings)
5.1 Upgrade Add-on UPS Firmware (5AC600.UPSI-00)
5.2 Upgrade Battery Settings(5AC600.UPSB-00)
5.3 Return to Main Menu
6. Exit
```

zu Punkt 1:
Es wird automatisch der PX32 und FPGA des MTCX aktualisiert (Default nach 5 sec).

zu Punkt 2:
Es wird automatisch der FPGA des SDLT Controllers am AP Link Slot aktualisiert.

zu Punkt 3:
Es wird das Submenü 1 zum Upgrade der SDLR Controller am Monitor/Panel Stecker geöffnet.

3.1 Upgrade SDLR on AP 0 (AP800/AP900)
Es wird automatisch der SDLR Controller auf Automation Panel 0 aktualisiert.

3.2 Upgrade SDLR on AP 1 (AP800/AP900)
Es wird automatisch der SDLR Controller auf Automation Panel 1 aktualisiert.

3.3 Upgrade SDLR on AP 2 (AP800/AP900)
Es wird automatisch der SDLR Controller auf Automation Panel 2 aktualisiert.

3.4 Upgrade SDLR on AP 3 (AP800/AP900)
Es wird automatisch der SDLR Controller auf Automation Panel 3 aktualisiert.

3.5 Upgrade all SDLR (AP800/AP900)
Es werden automatisch alle SDLR Controller auf allen Automation Panels am Monitor/ Panel aktualisiert (Default nach 5 sec).

3.6 Return to Main Menu
Zurück ins Hauptmenü

zu Punkt 4:
Es wird das Submenü 2 zum Upgrade der SDLR Controller am AP Link Slot geöffnet.

4.1 Upgrade SDLR on AP 8 (AP800/AP900)
Es wird automatisch der SDLR Controller auf Automation Panel 8 aktualisiert.

4.2 Upgrade SDLR on AP 9 (AP800/AP900)
Es wird automatisch der SDLR Controller auf Automation Panel 9 aktualisiert.

4.3 Upgrade SDLR on AP 10 (AP800/AP900)
Es wird automatisch der SDLR Controller auf Automation Panel 10 aktualisiert.

4.4 Upgrade SDLR on AP 11 (AP800/AP900)
Es wird automatisch der SDLR Controller auf Automation Panel 11 aktualisiert.

4.5 Upgrade all SDLR (AP800/AP900)
Es werden automatisch alle SDLR Controller auf allen Automation Panels am AP Link Slot aktualisiert (Default nach 5 sec).

4.6 Return to Main Menu
Zurück ins Hauptmenü

zu Punkt 5:
Es wird das Submenü 3 zum Upgrade der Add-on UPS Firmware und Upgrade der Batterie Settings geöffnet.

5.1 Upgrade Add-on UPS Firmware (5AC600.UPSI-00)
Es wird automatisch die Firmware der Add-on UPSI aktualisiert.

5.2 Upgrade Battery Settings (5AC600.UPSB-00)
Es werden automatisch die Battery Settings für 5AC600.UPSB-00 aktualisiert.

5.3 Return to Main Menu
Zurück ins Hauptmenü

zu Punkt 6:
Ausstieg in die Shell (MS-DOS).

Information:

Nach erfolgreichem Upgrade muss ein Power Off/On des Systems durchgeführt werden.

2.2.2 Mögliche Upgradeprobleme und Softwareabhängigkeiten (für V1.00)

- Ein Update der SDLR Firmware ist nur bei angeschlossenem Automation Panel mit Automation Panel Link Transceiver (5DLSDL.1000-01) oder Automation Panel Link Receiver (5DLSDL.1000-00) möglich.
- Automation Panel Link Transceiver (5DLSDL.1000-01) oder Automation Panel Link Receiver (5DLSDL.1000-00) mit Firmware Version kleiner oder gleich V00.10 dürfen nicht mehr mit Automation Panel Link Transceiver (5DLSDL.1000-01) oder Automation Panel Link Receiver (5DLSDL.1000-00) mit Firmware größer oder gleich V01.04 gemischt werden. In dieser Kombination ist ein Daisy Chain Betrieb nicht möglich.

- Ist eine UPS (z.B.: 5AC600.UPSI-00) + Batterieeinheit (z.B.: 5AC600.UPSB-00) am System angeschlossen und einsatzfähig, dann muss nach einem Upgrade des MTCX bzw. SDLT entweder die Batterieeinheit abgeschlossen oder der Power Button betätigt werden (um das System in den Standby Modus zu versetzen), bevor der geforderte PowerOff/ On durchgeführt wird. Wird dies nicht beachtet hat der Firmware Upgrade nicht funktioniert, da ja die UPS das System buffert.
- Die Funktion Legacy Mouse Support und Keyboard Kontroller Reset ist erst ab der Kombination MTCX PX32 V00.12 und MTCX FPGA V00.09 (inkludiert in APC810 MTCX Upgrade Disk V00.05) gegeben.

2.3 MS-DOS Bootdiskette erstellen unter Windows XP

1. Eine leere 1,44MB HD Diskette in das Diskettenlaufwerk stecken
2. Windows Explorer öffnen
3. Mit der rechten Maustaste auf das 3½-Diskettenlaufwerk Symbol klicken und den Punkt „Formatieren...” auswählen.

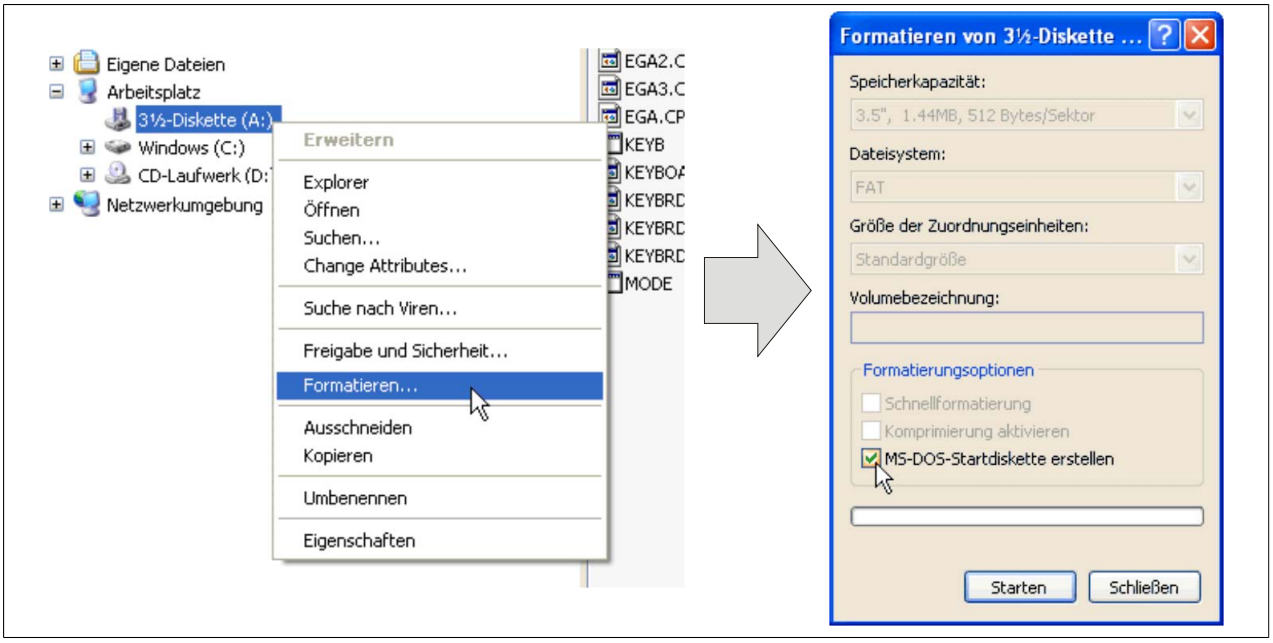


Abbildung 162: Bootdiskette erstellen unter Windows XP Schritt 1

4. Danach die Checkbox **„MS-DOS-Startdiskette erstellen”** anhaken, **„Starten”** drücken und die nachfolgende Warnmeldung mit „OK” bestätigen.

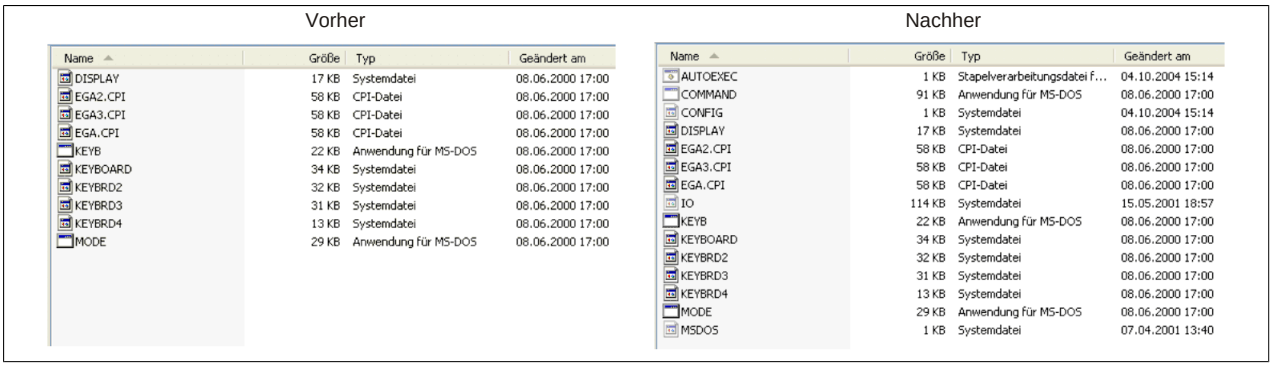
Abbildung 163: Bootdiskette erstellen unter Windows XP Schritt 2

Abbildung 164: Bootdiskette erstellen unter Windows XP Schritt 3

Nach der Erstellung der Startdiskette müssen nun nachträglich einige Dateien dieser Diskette gelöscht werden, da dies wegen der Größe der Updates erforderlich ist.

Dazu müssen alle Dateien (versteckte Systemdateien,...) auf der Diskette angezeigt werden.

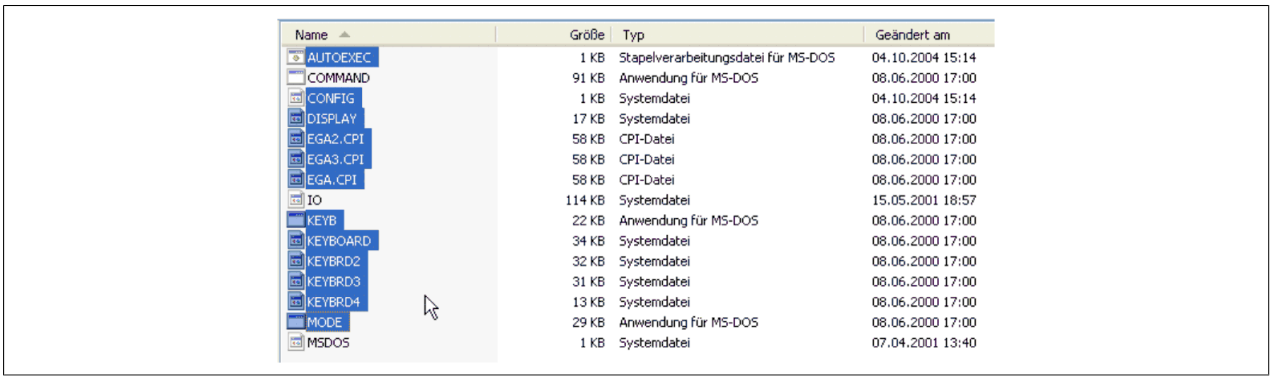
Im Explorer- Menüpunkt „Extras” die Option „Ordneroptionen...”, Registrierkarte „Ansicht”, Punkt „Geschützte Systemdateien ausblenden (empfohlen)" (ist standardmäßig aktiviert) nun deaktivieren und den Punkt „Alle Dateien und Ordner anzeigen” aktivieren.



Name	Größe	Typ	Geändert am
DISPLAY	17 KB	Systemdatei	08.06.2000 17:00
EGA2.CPI	58 KB	CPI-Datei	08.06.2000 17:00
EGA3.CPI	58 KB	CPI-Datei	08.06.2000 17:00
EGA.CPI	58 KB	CPI-Datei	08.06.2000 17:00
KEYB	22 KB	Anwendung für MS-DOS	08.06.2000 17:00
KEYBOARD	34 KB	Systemdatei	08.06.2000 17:00
KEYBRD2	32 KB	Systemdatei	08.06.2000 17:00
KEYBRD3	31 KB	Systemdatei	08.06.2000 17:00
KEYBRD4	13 KB	Systemdatei	08.06.2000 17:00
MODE	29 KB	Anwendung für MS-DOS	08.06.2000 17:00

Name	Größe	Typ	Geändert am
AUTOEXEC	1 KB	Stapelverarbeitungsdatei f...	04.10.2004 15:14
COMMAND	91 KB	Anwendung für MS-DOS	08.06.2000 17:00
CONFIG	1 KB	Systemdatei	04.10.2004 15:14
DISPLAY	17 KB	Systemdatei	08.06.2000 17:00
EGA2.CPI	58 KB	CPI-Datei	08.06.2000 17:00
EGA3.CPI	58 KB	CPI-Datei	08.06.2000 17:00
EGA.CPI	58 KB	CPI-Datei	08.06.2000 17:00
IO	114 KB	Systemdatei	15.05.2001 18:57
KEYB	22 KB	Anwendung für MS-DOS	08.06.2000 17:00
KEYBOARD	34 KB	Systemdatei	08.06.2000 17:00
KEYBRD2	32 KB	Systemdatei	08.06.2000 17:00
KEYBRD3	31 KB	Systemdatei	08.06.2000 17:00
KEYBRD4	13 KB	Systemdatei	08.06.2000 17:00
MODE	29 KB	Anwendung für MS-DOS	08.06.2000 17:00
MSDOS	1 KB	Systemdatei	07.04.2001 13:40

Abbildung 165: Bootdiskette erstellen unter Windows XP Schritt 4



Name	Größe	Typ	Geändert am
AUTOEXEC	1 KB	Stapelverarbeitungsdatei für MS-DOS	04.10.2004 15:14
COMMAND	91 KB	Anwendung für MS-DOS	08.06.2000 17:00
CONFIG	1 KB	Systemdatei	04.10.2004 15:14
DISPLAY	17 KB	Systemdatei	08.06.2000 17:00
EGA2.CPI	58 KB	CPI-Datei	08.06.2000 17:00
EGA3.CPI	58 KB	CPI-Datei	08.06.2000 17:00
EGA.CPI	58 KB	CPI-Datei	08.06.2000 17:00
IO	114 KB	Systemdatei	15.05.2001 18:57
KEYB	22 KB	Anwendung für MS-DOS	08.06.2000 17:00
KEYBOARD	34 KB	Systemdatei	08.06.2000 17:00
KEYBRD2	32 KB	Systemdatei	08.06.2000 17:00
KEYBRD3	31 KB	Systemdatei	08.06.2000 17:00
KEYBRD4	13 KB	Systemdatei	08.06.2000 17:00
MODE	29 KB	Anwendung für MS-DOS	08.06.2000 17:00
MSDOS	1 KB	Systemdatei	07.04.2001 13:40

Abbildung 166: Bootdiskette erstellen unter Windows XP Schritt 5

Es können nun alle Dateien (markiert) bis auf Command.com, IO.sys und MSDOS.sys gelöscht werden.

2.4 So erstellen Sie einen bootfähigen USB Memory Stick für B&R Upgrade Files

Von den bei B&R erhältlichen USB Memory Sticks ist es möglich in Verbindung mit einem B&R Industrie PC ein Upgrade (z.B. BIOS Upgrade) durchzuführen. Dazu muss der USB Memory Stick speziell vorbereitet werden. Dies erfolgt mit dem B&R Embedded OS Installer, welcher von der B&R Homepage (www.br-automation.com) kostenlos heruntergeladen werden kann.

2.4.1 Was wird benötigt

Folgende Peripherie wird für das Erzeugen eines bootfähigen USB Memory Sticks benötigt:

- B&R USB Memory Stick
- B&R Industrie PC
- USB Media Drive
- B&R Embedded OS Installer (mindestens V3.00)

2.4.2 Vorgangsweise

1. Verbinden des USB-Memorysticks mit dem PC.
2. Falls die Laufwerksliste nicht automatisch aktualisiert wird, muss die Liste mit dem Befehl **Laufwerke > Aktualisieren** aktualisiert werden.
3. Markieren des USB-Memorysticks in der Laufwerksliste.
4. Wechseln auf die Registerkarte **Aktion** und als Aktionstyp **Ein B&R Upgrade auf einen USB-Memorystick installieren** auswählen.
5. Den Pfad zu den MS-DOS Betriebssystemdateien angeben. Wenn die Dateien Teil eines ZIP-Archivs sind, auf die Schaltfläche **Aus einer ZIP-Datei...** klicken. Falls die Dateien in einem Verzeichnis auf der Festplatte gespeichert sind, auf die Schaltfläche **Aus einem Verzeichnis...** klicken.
6. In die Textbox **B&R Upgrade** kann optional der Pfad zur ZIP-Datei der B&R Upgrade Disk angegeben und die Datei ausgewählt werden.
7. In der Symbolleiste auf die Schaltfläche **Aktion starten** klicken.

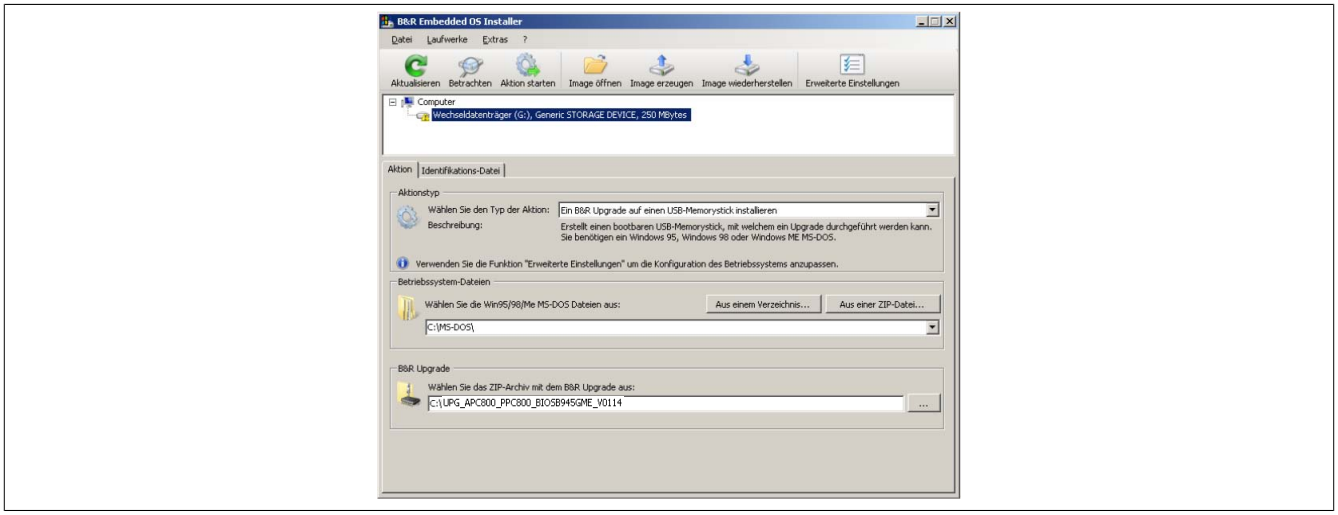


Abbildung 167: Erstellung eines USB Memory Sticks für B&R Upgrade Files

2.4.3 Woher bekomme ich MS-DOS?

Das Erstellen einer MS-DOS Bootdiskette kann im Abschnitt "MS-DOS Bootdiskette erstellen unter Windows XP" auf Seite 296 nachgelesen werden. Abschließend sind die Dateien von der Diskette auf die Festplatte zu kopieren.

2.5 So erstellen Sie eine bootfähige CompactFlash Karte für B&R Upgrade Files

Von den bei B&R erhältlichen CompactFlash Karten ist es möglich in Verbindung mit einem B&R Industrie PC ein Upgrade (z.B. BIOS Upgrade) durchzuführen. Dazu muss die CompactFlash Karte speziell vorbereitet werden. Dies erfolgt mit dem B&R Embedded OS Installer, welcher von der B&R Homepage (www.br-automation.com) kostenlos heruntergeladen werden kann.

2.5.1 Was wird benötigt?

Folgende Peripherie wird für das Erzeugen einer bootfähigen CompactFlash benötigt:

- CompactFlash Karte
- B&R Industrie PC
- USB Media Drive
- B&R Embedded OS Installer (mindestens V3.10)

2.5.2 Vorgangsweise

1. Einstecken der CompactFlash Karte in den CF-Slot des Industrie PCs.
2. Falls die Laufwerksliste nicht automatisch aktualisiert wird, muss die Liste mit dem Befehl **Laufwerke > Aktualisieren** aktualisiert werden.
3. Markieren der CompactFlash Karte in der Laufwerksliste.
4. Wechseln auf die Registerkarte **Aktion** und als Aktionstyp **Ein B&R Upgrade auf eine CompactFlash Karte installieren** auswählen.
5. Den Pfad zu den MS-DOS Betriebssystemdateien angeben. Wenn die Dateien Teil eines ZIP-Archivs sind, auf die Schaltfläche **Aus einer ZIP-Datei...** klicken. Falls die Dateien in einem Verzeichnis auf der Festplatte gespeichert sind, auf die Schaltfläche **Aus einem Verzeichnis...** klicken.
6. In die Textbox **B&R Upgrade** kann optional der Pfad zur ZIP-Datei der B&R Upgrade Disk angegeben und die Datei ausgewählt werden.
7. In der Symbolleiste auf die Schaltfläche **Aktion starten** klicken.

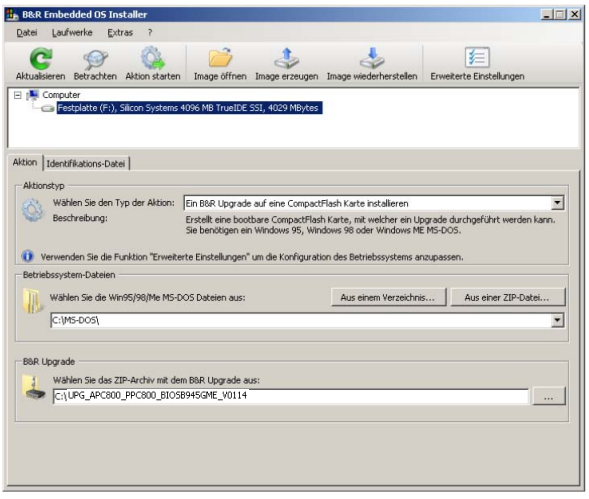


Abbildung 168: Erstellung einer CompactFlash Karte für B&R Upgrade Files

2.5.3 Woher bekomme ich MS-DOS?

Das Erstellen einer MS-DOS Bootdiskette kann im Abschnitt "MS-DOS Bootdiskette erstellen unter Windows XP" auf Seite 296 nachgelesen werden. Abschließend sind die Dateien von der Diskette auf die Festplatte zu kopieren.

2.6 Upgradeprobleme

Mögliche Upgradeprobleme können in den Liesmich.txt bzw. Readme.txt Dateien der Upgrade Disks nachgelesen werden.

3 Microsoft DOS

3.1 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	MS-DOS	
9S0000.01-010	OEM Microsoft MS-DOS 6.22, Deutsch Disketten, Lieferung nur in Verbindung mit einem neuen PC.	
9S0000.01-020	OEM Microsoft MS-DOS 6.22, Englisch Disketten, Lieferung nur in Verbindung mit einem neuen PC.	

Tabelle 248: 9S0000.01-010, 9S0000.01-020 - Bestelldaten

3.2 Bekannte Probleme

Für folgende Hardwarekomponenten stehen keine Treiber zur Verfügung oder es ist mit Einschränkungen zu rechnen:

- AC97 Sound - keine Unterstützung
- USB 2.0 - es kann nur USB 1.1 Geschwindigkeit erreicht werden.
- Ein zweiter Grafikstrang und somit der Erweiterte Desktop Modus kann nicht genutzt werden.
- Einige „ACPI Control“ Funktionen des BIOS können nicht verwendet werden.

3.3 Auflösungen und Farbtiefe

Die nachfolgende Tabelle zeigt die getesteten Auflösungen und Farbtiefen am Monitor / Panel Stecker mit 945GME CPU Boards.

	Farbtiefe		
Auflösungen bei DVI	**8 Bit**	**16 Bit**	**24 Bit**
640 x 480	✓	✓	✓
800 x 600	✓	✓	✓
1024 x 768	✓	✓	✓
1280 x 1024	✓	✓	✓

Tabelle 249: Getestete Auflösungen und Farbtiefen bei DVI Signalen

	Farbtiefe		
Auflösungen bei RGB	**8 Bit**	**16 Bit**	**24 Bit**
640 x 480	✓	✓	✓
800 x 600	✓	✓	✓
1024 x 768	✓	✓	✓
1280 x 1024	✓	✓	✓
1600 x 1200	✓	✓	✓
1920 x 1440	✓	✓	✓

Tabelle 250: Getestete Auflösungen und Farbtiefen bei RGB Signalen

4 Windows XP Professional

4.1 Allgemeines

Information:

Abkündigung des Supportes für Windows XP durch Microsoft:

Ab dem *08. April 2014* werden für Windows XP keine Sicherheitsupdates, Hotfixes, kostenloser oder bezahlter Support sowie technische Ressourcen mehr angeboten.

4.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Windows XP Professional	
5SWWXP.0600-GER	Windows XP Professional SP3 - Deutsch - CD	
5SWWXP.0600-ENG	Windows XP Professional SP3 - Englisch - CD	
5SWWXP.0600-MUL	Windows XP Professional SP3 - Multilanguage - CD	
5SWWXP.0500-GER	Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 2c, CD, Deutsch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	
5SWWXP.0500-ENG	Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 2c, CD, Englisch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	
5SWWXP.0500-MUL	Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 2c, CD, Multilanguage. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	

Tabelle 251: 5SWWXP.0600-GER, 5SWWXP.0600-ENG, 5SWWXP.0600-MUL, 5SWWXP.0500-GER, 5SWWXP.0500-ENG, 5SWWXP.0500-MUL - Bestelldaten

4.3 Übersicht

Bestellnummer	Edition	Zielsystem	Chipsatz	Service Pack	Sprache	Benötigter Speicherplatz auf Datenträger	Mindestgröße Arbeitsspeicher
5SWWXP.0600-GER	Professional	APC510 APC511 APC620 APC810 APC820 APC910 PPC700 PPC725 PPC800 PPC900 PP500	945GME GM45 QM77/HM76 NM10 US15W	SP3	Deutsch	≤ 2,1 GByte	128 MByte
5SWWXP.0600-ENG	Professional	APC510 APC511 APC620 APC810 APC820 APC910 PPC700 PPC725 PPC800 PPC900 PP500	945GME GM45 QM77/HM76 NM10 US15W	SP3	Englisch	≤ 2,1 GByte	128 MByte
5SWWXP.0600-MUL	Professional	APC510 APC511 APC620 APC810 APC820 APC910 PPC700 PPC725 PPC800 PPC900 PP500	945GME GM45 QM77/HM76 NM10 US15W	SP3	Multilanguage	≤ 2,1 GByte	128 MByte
5SWWXP.0500-GER	Professional	APC620 APC810 APC820 PPC700 PPC725 PPC800	945GME GM45	SP2c	Deutsch	≤ 2,1 GByte	128 MByte
5SWWXP.0500-ENG	Professional	APC620 APC810 APC820 PPC700 PPC725 PPC800	945GME GM45	SP2c	Englisch	≤ 2,1 GByte	128 MByte
5SWWXP.0500-MUL	Professional	APC620 APC810 APC820 PPC700 PPC725 PPC800	945GME GM45	SP2c	Multilanguage	≤ 2,1 GByte	128 MByte

4.4 Installation

Windows XP Professional wird schon im Hause B&R auf dem gewünschten Datenträger (z.B. CompactFlash-Karte, etc.) vorinstalliert. Dabei werden auch alle notwendigen Treiber (Grafik, Netzwerk, usw.) für den Betrieb mitinstalliert.

4.4.1 Installation auf PCI SATA RAID Controller - 5ACPCI.RAIC-03, 5ACPCI.RAIC-05, 5ACPCI.RAIC-06

Um Windows XP Professional auf dem PCI SATA RAID Controller zu installieren, sind folgende Schritte notwendig:

1. Herunterladen des RAID-Treibers von der B&R Homepage www.br-automation.com und die Dateien auf eine Diskette kopieren.
2. Das Media Drive (5MD900.USB2-01 oder 5MD900.USB2-00) an die USB-Schnittstelle anstecken.
3. Diskette und Windows XP Professional CD in das Media Drive einlegen und von der CD booten.
4. Im Setup die Taste F6 drücken, um ein Dritthersteller SCSI oder einen Treiber zu installieren.
5. Die Taste „s“ drücken, wenn gefragt wird ob ein zusätzliches Laufwerk installiert werden soll. Die Diskette in das Floppy Laufwerk stecken. „Enter“ drücken und den Treiber auswählen.
6. Den Setup Anweisungen folgen.
7. Das Setup kopiert die Dateien in den Windows XP Professional Ordner und startet den B&R Industrie PC neu.

4.4.2 Besonderheit 5PCI Slot Variante

Bei Installation auf eine Slide-in HDD, welche im Slide-in Slot 2 (liegt hinter der PCI to SATA Bridge) des APC810 betrieben wird, sind folgende Schritte notwendig:

1. Herunterladen des Si3531 SATA Treibers von der B&R Homepage www.br-automation.com und die Dateien auf eine Diskette kopieren.
2. Das Media Drive (5MD900.USB2-01 oder 5MD900.USB2-00) an die USB-Schnittstelle anstecken.
3. Diskette und Windows XP Professional CD in das Media Drive einlegen und von der CD booten.
4. Im Setup die Taste F6 drücken, um ein Dritthersteller SCSI oder einen Treiber zu installieren.
5. Die Taste „s“ drücken, wenn gefragt wird ob ein zusätzliches Laufwerk installiert werden soll. Die Diskette in das Floppy Laufwerk stecken. „Enter“ drücken und den Treiber auswählen.
6. Den Setup Anweisungen folgen.
7. Das Setup kopiert die Dateien in den Windows XP Professional Ordner und startet den Automation PC 810 neu.

Information:

- **Nicht alle USB-FDD Laufwerke werden vom Windows XP Setup unterstützt (siehe Microsoft KB 916196).**
- **Abhängig vom System muss evtl. die Bootreihenfolge im BIOS angepasst werden.**

4.5 Treiber

Aktuelle Treiber für alle freigegebenen Betriebssysteme stehen im Downloadbereich der B&R Homepage www.br-automation.com zum Download bereit.

Information:

Benötigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzuladen.

5 Windows 7

5.1 Allgemeines

Windows 7 bietet eine Vielzahl innovativer Features und Leistungsverbesserungen. Die 64-Bit Varianten nutzen die aktuelle PC Infrastruktur voll aus. Schnelleres Versetzen in den Energiesparmodus, schnelleres Wiederherstellen, geringere Speichernutzung und schnelleres Erkennen von USB-Geräten sind nur einige der Vorteile, die Windows 7 bietet. In der Professional Ausführung steht Windows 7 in den Sprachvarianten Deutsch und Englisch zur Verfügung, während Windows 7 Ultimate bis zu 35 Sprachen (ab Service Pack 1 bis zu 36 Sprachen) unterstützt. Eine Produktaktivierung ist beim Einsatz auf B&R PCs nicht erforderlich, ein großer Vorteil für einfache logistische Abläufe im Zuge der Maschinenautomatisierung.

Alle von B&R angebotenen Windows Betriebssysteme stammen von der Microsoft Embedded Division. Dies bedeutet eine gegenüber dem Consumermarkt erheblich längere Verfügbarkeit.

5.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Windows 7 Professional/Ultimate	
5SWWI7.0100-GER	Windows 7 Professional - 32-Bit - Deutsch - DVD	
5SWWI7.1100-GER	Windows 7 Professional SP1 - 32-Bit - Deutsch - DVD	
5SWWI7.0100-ENG	Windows 7 Professional - 32-Bit - Englisch - DVD	
5SWWI7.1100-ENG	Windows 7 Professional SP1 - 32-Bit - Englisch - DVD	
5SWWI7.0200-GER	Windows 7 Professional - 64-Bit - Deutsch - DVD	
5SWWI7.1200-GER	Windows 7 Professional SP1 - 64-Bit - Deutsch - DVD	
5SWWI7.0200-ENG	Windows 7 Professional - 64-Bit - Englisch - DVD	
5SWWI7.1200-ENG	Windows 7 Professional SP1 - 64-Bit - Englisch - DVD	
5SWWI7.0300-MUL	Windows 7 Professional - 32-Bit - Multilanguage - DVD	
5SWWI7.1300-MUL	Windows 7 Ultimate SP1 - 32-Bit - Multilanguage - DVD	
5SWWI7.0400-MUL	Windows 7 Ultimate - 64-Bit - Multilanguage - DVD	
5SWWI7.1400-MUL	Windows 7 Ultimate SP1 - 64-Bit - Multilanguage - DVD	

Tabelle 252: 5SWWI7.0100-GER, 5SWWI7.1100-GER, 5SWWI7.0100-ENG, 5SWWI7.1100-ENG, 5SWWI7.0200-GER, 5SWWI7.1200-GER, 5SWWI7.0200-ENG, 5SWWI7.1200-ENG, 5SWWI7.0300-MUL, 5SWWI7.1300-MUL, 5SWWI7.0400-MUL, 5SWWI7.1400-MUL - Bestelldaten

5.3 Übersicht

Bestellnummer	Edition	Zielsystem	Chipsatz	Service Pack	Architektur	Sprache	Benötigter Speicherplatz auf Datenträger	Mindestgröße Arbeitsspeicher
5SWWI7.0100-GER	Professional	APC510 APC511 APC810 APC910 PPC800 PP500	945GME GM45 QM77/HM76 US15W		32-Bit	Deutsch	16 GByte	1 GByte [1]
5SWWI7.1100-GER	Professional	APC510 APC511 APC810 APC910 APC2100 PPC800 PPC900 PPC2100 PP500	945GME GM45 QM77/HM76 NM10 US15W Bay Trail	SP1	32-Bit	Deutsch	16 GByte	1 GByte [1]
5SWWI7.0100-ENG	Professional	APC510 APC511 APC810 APC910 PPC800 PP500	945GME GM45 QM77/HM76 US15W		32-Bit	Englisch	16 GByte	1 GByte [1]
5SWWI7.1100-ENG	Professional	APC510 APC511 APC810 APC910 APC2100 PPC800 PPC900 PPC2100 PP500	945GME GM45 QM77/HM76 NM10 US15W Bay Trail	SP1	32-Bit	Englisch	16 GByte	1 GByte [1]
5SWWI7.0200-GER	Professional	APC810 APC910 PPC800	945GME Intel Core2 Duo GM45 QM77/HM76		64-Bit	Deutsch	20 GByte	2 GByte [2]

Bestellnummer	Edition	Zielsystem	Chipsatz	Service Pack	Architektur	Sprache	Benötigter Speicherplatz auf Datenträger	Mindestgröße Arbeitsspeicher
5SWWI7.1200-GER	Professional	APC810 APC910 APC2100 PPC800 PPC900 PPC2100	945GME Intel Core2 Duo GM45 QM77/HM76 Bay Trail	SP1	64-Bit	Deutsch	20 GByte	2 GByte 2)
5SWWI7.0200-ENG	Professional	APC810 APC910 PPC800	945GME Intel Core2 Duo GM45 QM77/HM76		64-Bit	Englisch	20 GByte	2 GByte 2)
5SWWI7.1200-ENG	Professional	APC810 APC910 APC2100 PPC800 PPC900 PPC2100	945GME Intel Core2 Duo GM45 QM77/HM76 Bay Trail	SP1	64-Bit	Englisch	20 GByte	2 GByte 2)
5SWWI7.0300-MUL	Ultimate	APC510 APC511 APC810 APC910 PPC800 PP500	945GME GM45 QM77/HM76 US15W		32-Bit	Multilanguage	16 GByte 3)	1 GByte 1)
5SWWI7.1300-MUL	Ultimate	APC510 APC511 APC810 APC910 APC2100 PPC800 PPC900 PPC2100 PP500	945GME GM45 QM77/HM76 NM10 US15W Bay Trail	SP1	32-Bit	Multilanguage	16 GByte 3)	1 GByte 1)
5SWWI7.0400-MUL	Ultimate	APC810 APC910 PPC800	945GME Intel Core2 Duo GM45 QM77/HM76		64-Bit	Multilanguage	20 GByte 3)	2 GByte 2)
5SWWI7.1400-MUL	Ultimate	APC810 APC910 APC2100 PPC800 PPC900 PPC2100	945GME Intel Core2 Duo GM45 QM77/HM76 Bay Trail	SP1	64-Bit	Multilanguage	20 GByte 3)	2 GByte 2)

1) Die angegebene Speichergröße ist eine Mindestanforderung laut Microsoft. B&R empfiehlt jedoch bei 32-Bit Betriebssystemen den Einsatz von 2 GByte oder mehr Arbeitsspeicher.
2) Die angegebene Speichergröße ist eine Mindestanforderung laut Microsoft. B&R empfiehlt jedoch bei 64-Bit Betriebssystemen den Einsatz von 4 GByte oder mehr Arbeitsspeicher.
3) Bei der Mindestgröße des Datenträgers wird der Speicherbedarf der zusätzlichen Sprachpakete nicht berücksichtigt.

5.4 Installation

Windows 7 wird schon im Hause B&R auf dem gewünschten Datenträger (z.B. CompactFlash-Karte, etc.) vorinstalliert. Dabei werden auch alle notwendigen Treiber (Grafik, Netzwerk, usw.) für den Betrieb mitinstalliert.

5.4.1 Installation auf PCI SATA RAID Controller - 5ACPCI.RAIC-03, 5ACPCI.RAIC-05, 5ACPCI.RAIC-06

Um Windows 7 auf dem PCI SATA RAID Controler zu installieren, sind folgende Schritte notwendig:

1. Herunterladen des Raid-Treibers für Windows 7 von der B&R Homepage www.br-automation.com und die Daten auf ein Verzeichnis eines USB Memory Sticks kopieren.
2. Mit Windows 7 DVD booten.
3. Den Installationsdialogen folgen bis der Dialog "Wo möchten Sie Windows installieren?“ angezeigt wird.
4. Den USB Memory Stick mit den RAID Treibern an einen freien USB-Port anstecken.
5. Auf „Treiber laden“ klicken, und mit dem Durchsuchen Button auf das Verzeichnis mit den RAID-Treibern gehen. Anschließend auf Weiter klicken.
6. Den USB Memory Stick entfernen.
7. Nun kann die Windows 7 Installation wie gewohnt durchgeführt werden.

5.4.2 Besonderheit 5PCI Slot Variante

Bei der Installation auf eine Slide-in HDD, welche im Slide-in Slot 2 (liegt hinter der PCI to SATA Bridge) des APC810 betrieben wird, sind folgende Schritte notwendig:

1. Herunterladen des Sil3531 SATA Treibers für Windows 7 von der B&R Homepage www.br-automation.com und die Daten auf ein Verzeichnis eines USB Memory Sticks kopieren.
2. Mit Windows7 DVD booten.
3. Den Installationsdialogen folgen bis der Dialog "Wo möchten Sie Windows installieren?" angezeigt wird.
4. Den USB Memory Stick mit den RAID Treibern an einen freien USB-Port anstecken.
5. Auf „Treiber laden“ klicken, und mit dem Durchsuchen Button auf das Verzeichnis mit den RAID-Treibern gehen. Anschließend auf Weiter klicken.
6. Den USB Memory Stick entfernen.
7. Nun kann die Windows 7 Installation wie gewohnt durchgeführt werden.

Information:

Abhängig vom System muss evtl. die Bootreihenfolge im BIOS angepasst werden.

5.5 Eigenheiten, Einschränkungen

- In Windows 7 ist kein Beep.sys mehr enthalten, somit ist auch z.B. bei einem Tastendruck kein akustisches Signal mehr hörbar.
- Die Ermittlung der Windows 7 Systembewertung (Systemklassifikation) wird aktuell nicht unterstützt (dies gilt nicht für PP500, APC2100, APC510, APC511, APC910, PPC2100 und PPC800 mit NM10 Chipsatz).

5.6 Treiber

Aktuelle Treiber für alle freigegebenen Betriebssysteme stehen im Downloadbereich der B&R Homepage www.br-automation.com zum Download bereit.

Information:

Benötigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzuladen.

6 Windows XP Embedded

6.1 Allgemeines

Windows XP Embedded ist die modularisierte Version des Desktop Betriebssystems Windows XP Professional. Windows XP Embedded basiert auf den gleichen Binaries wie Windows XP Professional und ist für die verwendete Hardware optimal zugeschnitten, d.h. es sind nur die Funktionen und Module enthalten, die für das jeweilige Gerät benötigt werden. Aufbauend auf der bewährten Codebasis von Windows XP Professional liefert Windows XP Embedded in der Industrie führende Zuverlässigkeit, Sicherheitsverbesserungen und Performance zusammen mit den neuesten Möglichkeiten des Webbrowsing und umfangreiche Geräteunterstützung.

6.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Windows XP Embedded	
5SWWXP.0426-ENG	Microsoft OEM Windows XP Embedded Feature Pack 2007, Englisch; für APC810 mit 945GME Chipsatz; CompactFlash separat bestellen (mind. 512 MByte).	

Tabelle 253: 5SWWXP.0426-ENG - Bestelldaten

6.3 Übersicht

Bestellnummer	Zielsystem	Chipsatz	Sprache	Mindestgröße Datenträger	Mindestgröße Arbeitsspeicher
5SWWXP.0426-ENG	APC810	945GME	Englisch	512 MByte	128 MByte

6.4 Features mit FP2007 (Feature Pack 2007)

Die Feature Liste zeigt die wesentlichen Gerätefunktionen von Windows XP Embedded mit Feature Pack 2007 (FP2007).

Funktion	vorhanden
Enhanced Write Filter (EWF)	✓
File Based Write Filter	✓
Administrator Account	✓
User Account	konfigurierbar
Explorer Shell	✓
Registry Filter	✓
Internet Explorer 6.0 + SP2	✓
Internet Information Service (IIS)	-
Terminal Service	✓
Windows Firewall	✓
MSN-Explorer	-
Outlook Express	-
Administrative Tools	✓
Remote Desktop	✓
Remote Assistance	-
.NET Framework	-
ASP.NET	-
Codepages/User Locale/Keyboard	✓
Disk Management Service	✓
Windows Installer Service	✓
Class Installer	✓
CoDevice Installer	✓
Media Player	-
DirectX	-
Accessorries	✓
Anzahl der Fonts	89

Tabelle 254: Gerätefunktionen unter Windows XP Embedded mit FP2007

6.5 Installation

Windows XP Embedded wird schon im Hause B&R auf einer geeigneten CompactFlash-Karte (mind. 512 MByte) vorinstalliert. Nach dem ersten Einschalten wird das System automatisch konfiguriert. Dieser Vorgang nimmt ca. 30 Minuten in Anspruch und das Gerät wird dabei außerdem einige Male automatisch rebootet.

6.6 Treiber

Das Betriebssystem enthält alle für den Betrieb notwendigen Treiber. Sollte eine ältere Treiberversion installiert sein, kann die aktuellste Version über die B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen und installiert werden. Dabei ist nur auf einen deaktivierten „Enhanced Write Filter (EWF)“ zu achten.

6.6.1 Touchscreentreiber

Sollen Automation Panel 800 bzw. Automation Panel 900 Touchscreen Geräte betrieben werden, so muss der Touchscreentreiber manuell nachinstalliert werden. Der Treiber kann im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen werden. Dabei ist nur auf einen möglich aktivierten „Enhanced Write Filter (EWF)“ zu achten.

Information:

Benötigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzuladen.

7 Windows Embedded Standard 2009

7.1 Allgemeines

Windows Embedded Standard 2009 ist die modulare Variante von Windows XP Professional. Es kommt zum Einsatz wenn XP Applikationen bei minimierter Betriebssystemgröße ablaufen sollen. In Kombination mit CompactFlash Speichern ermöglicht Windows Embedded Standard 2009 den Einsatz des Microsoft Desktop Betriebssystems bei rauen Umgebungsbedingungen. Zusätzlich zu bekannten Features von Windows XP Professional ist Windows Embedded Standard 2009 durch einen Write Filter für einzelne Speicherpartitionen in Bezug auf die Zuverlässigkeit verbessert worden. Durch den Schutz einzelner Partitionen, wie der Bootpartition kann das PC System auch nach einem Stromausfall wieder problemlos gestartet werden. Um den Einstieg bei Windows Embedded Standard 2009 so einfach wie möglich zu gestalten bietet B&R komplette Images für Industrie PCs, Power Panel und Mobile Panel an. Neben Windows Embedded Standard 2009 steht auch das Standard Betriebssystem Windows XP Professional in den Varianten deutsch, englisch und multilanguage zur Verfügung.

Windows Embedded Standard 2009 basiert auf den gleichen Binaries wie Windows XP Professional mit Service Pack 3 und ist für die verwendete Hardware optimal zugeschnitten, d.h. es sind nur die Funktionen und Module enthalten, die für das jeweilige Gerät benötigt werden. Aufbauend auf der bewährten Codebasis von Windows XP Professional mit SP3 liefert Windows Embedded Standard 2009 in der Industrie führende Zuverlässigkeit, Sicherheitsverbesserungen und Performance zusammen mit den neuesten Möglichkeiten des Webbrowsing und umfangreiche Geräteunterstützung.

7.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Windows Embedded Standard 2009	
5SWWXP.0726-ENG	Microsoft OEM Windows Embedded Standard 2009, Englisch; für APC810 mit 945GME Chipsatz; CompactFlash separat bestellen (mind. 1 GByte).	Windows Embedded Standard 2009

Tabelle 255: 5SWWXP.0726-ENG - Bestelldaten

7.3 Übersicht

Bestellnummer	Zielsystem	Chipsatz	Sprache	Mindestgröße Datenträger	Mindestgröße Arbeitsspeicher
5SWWXP.0726-ENG	APC810	945GME	Englisch	1 GByte	256 MByte

7.4 Features mit WES2009 (Windows Embedded Standard 2009)

Die Feature Liste zeigt die wesentlichen Gerätefunktionen von Windows Embedded Standard 2009.

Funktion	vorhanden
Enhanced Write Filter (EWF)	✓
File Based Write Filter (FBWF)	✓
Pagefile	konfigurierbar
Administrator Account	✓
User Account	konfigurierbar
Explorer Shell	✓
Registry Filter	✓
Internet Explorer 7.0	✓
Internet Information Service (IIS)	-
Terminal Service	✓
Windows Firewall	✓
MSN-Explorer	-
Outlook Express	-
Administrative Tools	✓
Remote Desktop	✓
Remote Assistance	-
.NET Framework	-
ASP.NET	-
Local Network Bridge	✓
Codepages/User Locale/Keyboard	✓
Disk Management Service	✓
Windows Installer Service	✓
Class Installer	✓
CoDevice Installer	✓

Tabelle 256: Gerätefunktionen unter Windows Embedded Standard 2009

Funktion	vorhanden
Media Player 6.4	✓
DirectX 9.0c	✓
Accessories	✓
Anzahl der Fonts	89

Tabelle 256: Gerätefunktionen unter Windows Embedded Standard 2009

7.5 Installation

Windows Embedded Standard 2009 wird schon im Hause B&R auf einer geeigneten CompactFlash-Karte (mind. 1 GByte) vorinstalliert. Nach dem ersten Einschalten wird das System automatisch konfiguriert. Dieser Vorgang nimmt ca. 10 Minuten in Anspruch und das Gerät wird dabei einige Male automatisch rebootet.

7.6 Treiber

Das Betriebssystem enthält alle für den Betrieb notwendigen Treiber. Sollte eine ältere Treiberversion installiert sein, kann die aktuellste Version über die B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen und installiert werden. Dabei ist nur auf einen deaktivierten „Enhanced Write Filter (EWF)“ zu achten.

7.6.1 Touch Screen Treiber

Sollen Automation Panel 800 bzw. Automation Panel 900 Touch Screen Geräte betrieben werden, so muss der Touch Screen Treiber manuell nachinstalliert bzw. im Geräte-Manager die Touch Screen Schnittstelle aktualisiert werden. Der Treiber kann im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen werden. Dabei ist nur auf einen aktivierten „Enhanced Write Filter (EWF)“ zu achten.

Information:

Benötigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzuladen.

7.7 Unterstützte Displayauflösungen

Windows Embedded Standard 2009 benötigt gemäß den Microsoft Anforderungen Auflösungen von SVGA (800x600) und größer, um eine vollständige Bedienung der Windows Oberfläche (incl. Systemdialogen etc.) zu ermöglichen. Für Applikationen kann eine kleinere Auflösung gewählt werden.

8 Windows Embedded Standard 7

8.1 Allgemeines

Das Pendant zu Windows XP Embedded heißt in der neuen Variante Windows Embedded Standard 7. Wie bei den Vorgängerversionen bietet das embedded Betriebssystem die volle Systemunterstützung von B&R Industrie PCs. Windows Embedded Standard 7 beinhaltet neben neuen Features, die auch in Windows 7 Professional enthalten sind, die bewährten embedded Komponenten wie Enhanced Write Filter, File-Based Write Filter, Registry Filter und USB Boot. Windows Embedded Standard 7 wird in zwei Versionen geliefert. Der wesentliche Unterschied besteht in der Möglichkeit der mehrsprachigen Ausführung. Die Basisvariante Windows Embedded Standard 7 wird in einer Sprachversion geliefert, während Windows Embedded Standard 7 Premium mehrere gleichzeitig installierte Sprachen unterstützt.

Bei Windows Embedded Standard 7 hat Microsoft beim Thema Sicherheit nochmals nachgelegt. Der AppLocker der Premium Variante kann die Ausführung von unbekannten und möglicherweise unerwünschten Applikationen verhindern, die zum Beispiel über Netzwerk oder direkt angeschlossene Laufwerke installiert werden sollen. Dabei kann abgestuft zwischen Skripten (.ps1, .bat, .cmd, .vbs, and .js), Installer Files (.msi, .msp) und Libraries (.dll, .ocx) unterschieden werden. Der AppLocker kann so konfiguriert werden, dass er verbotene Aktivitäten aufzeichnet und im EventViewer darstellt. Windows Embedded Standard 7 wird sowohl als 32-Bit als auch als 64-Bit Version angeboten.[5)] Damit werden auch anspruchsvolle Applikationen unterstützt, die auf 64-Bit Basis laufen.

8.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Windows Embedded Standard 7	
5SWWI7.1526-ENG	Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 32-Bit, Service Pack 1, Englisch; für APC810 mit 945GME Chipsatz; CompactFlash separat bestellen (mind. 16 GByte).	
5SWWI7.1626-ENG	Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 64-Bit, Service Pack 1, Englisch; für APC810 mit 945GME Chipsatz; CompactFlash separat bestellen (mind. 16 GByte).	
5SWWI7.1726-MUL	Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 Premium 32-Bit, Service Pack 1, Multilanguage; für APC810 mit 945GME Chipsatz; CompactFlash separat bestellen (mind. 16 GByte).	
5SWWI7.1826-MUL	Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 Premium 64-Bit, Service Pack 1, Multilanguage; für APC810 mit 945GME Chipsatz; CompactFlash separat bestellen (mind. 16 GByte).	
	Optionales Zubehör	
	Windows Embedded Standard 7	
5SWWI7.1900-MUL	Windows Embedded Standard 7 SP1 - 32-Bit - Language Pack DVD	
5SWWI7.2000-MUL	Windows Embedded Standard 7 SP1 - 64-Bit - Language Pack DVD	

Tabelle 257: 5SWWI7.1526-ENG, 5SWWI7.1626-ENG, 5SWWI7.1726-MUL, 5SWWI7.1826-MUL - Bestelldaten

8.3 Übersicht

Bestellnummer	Edition	Zielsystem	Chipsatz	Service Pack	Architektur	Sprache	Mindestgröße Datenträger	Mindestgröße Arbeitsspeicher
5SWWI7.1526-ENG	Embedded	APC810	945GME	SP1	32-Bit	Englisch	16 GByte	1 GByte [1)]
5SWWI7.1626-ENG	Embedded	APC810	945GME Intel Core2 Duo	SP1	64-Bit	Englisch	16 GByte	2 GByte [2)]
5SWWI7.1726-MUL	Premium	APC810	945GME	SP1	32-Bit	Multilanguage	16 GByte [3)]	1 GByte [1)]
5SWWI7.1826-MUL	Premium	APC810	945GME Intel Core2 Duo	SP1	64-Bit	Multilanguage	16 GByte [3)]	2 GByte [2)]

1) Die angegebene Speichergröße ist eine Mindestanforderung laut Microsoft. B&R empfiehlt jedoch bei 32-Bit Betriebssystemen den Einsatz von 2 GByte oder mehr Arbeitsspeicher.
2) Die angegebene Speichergröße ist eine Mindestanforderung laut Microsoft. B&R empfiehlt jedoch bei 64-Bit Betriebssystemen den Einsatz von 4 GByte oder mehr Arbeitsspeicher.
3) Bei der Mindestgröße des Datenträgers wird der Speicherbedarf der zusätzlichen Sprachpakete nicht berücksichtigt.

8.4 Features mit WES7 (Windows Embedded Standard 7)

Die Feature Liste zeigt die wesentlichen Gerätefunktionen von Windows Embedded Standard 7.

5) 64-Bit Versionen werden nicht von allen Systmen unterstützt

Funktion	Windows Embedded Standard 7	Windows Embedded Standard 7 Premium
Enhanced Write Filter (EWF)	✓	✓
File Based Write Filter (FBWF)	✓	✓
Administrator Account	✓	✓
User Account	konfigurierbar	konfigurierbar
Windows Explorer Shell	✓	✓
Registry Filter	✓	✓
Internet Explorer 8.0	✓	✓
Internet Information Service (IIS) 7.0	✓	✓
AntiMalware (Windows Defender)	-	✓
Add-ons (Snipping tool, Sticky Notes)	-	✓
Windows Firewall	✓	✓
.NET Framework 3.5	✓	✓
32-Bit und 64-Bit Support	✓	✓
Remote Dektop Protocol 7.0	✓	✓
File Compression Utility	✓	✓
Windows Installer Service	✓	✓
Windows XP Mode	-	-
Media Player 12	✓	✓
DirectX	✓	✓
Multilingual User Interface Packs im selben Image	-	✓
International Components and Language Services	✓	✓
Language Pack Setup	✓	✓
Windows Update	konfigurierbar	konfigurierbar
Windows PowerShell 2.0	✓	✓
Bitlocker	-	✓
Applocker	-	✓
Tablet PC Support	-	✓
Multitouch Support	-	✓
Boot from USB Stick	✓	✓
Accessories	✓	✓
Pagefile	konfigurierbar	konfigurierbar
Anzahl der Fonts	134	134

Tabelle 258: Gerätefunktionen unter Windows Embedded Standard 7

8.5 Installation

Windows Embedded Standard 7 wird schon im Hause B&R auf einer geeigneten CompactFlash-Karte (32-Bit: mind. 8 GByte bzw. 16 GByte; 64-Bit: mind. 16 GByte) vorinstalliert. Nach dem ersten Einschalten wird das System automatisch konfiguriert. Dieser Vorgang nimmt ca. 30 Minuten in Anspruch und das Gerät wird dabei einige Male automatisch rebootet.

Information:

Wenn der EWF (Enhanced Write Filter) verwendet werden soll, sind während des Setup oder SYSPREP alle Massenspeicher (außer dem Bootlaufwerk) aus dem System zu entfernen. Alternativ können die zusätzlichen Massenspeicher auch im BIOS deaktiviert werden.

8.6 Treiber

Das Betriebssystem enthält alle für den Betrieb notwendigen Treiber. Sollte eine ältere Treiberversion installiert sein, kann die aktuellste Version über die B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen und installiert werden. Dabei ist nur auf einen deaktivierten „Enhanced Write Filter (EWF)“ zu achten.

8.6.1 Touch Screen Treiber

Wird während des Windows Embedded Standard 7 Setup ein Touch Controller erkannt, wird der Touch Screen Treiber automatisch installiert. Wurde beim Windows Embedded Standard 7 Setup kein Touch Controller erkannt oder ein B&R Automation Panel nachträglich angeschlossen, muss der Touch Screen Treiber manuell nachinstalliert oder in den Touch Screen Einstellungen in der Windows Systemsteuerung die zusätzliche Touch Screen Schnittstelle ausgewählt werden. Der Treiber kann im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen werden. Dabei ist darauf zu achten, dass kein „Enhanced Write Filter (EWF)“ oder „File Based Write Filter (FBWF)“ aktiviert ist.

Information:

Benötigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzuladen.

8.7 Unterstützte Displayauflösungen

Windows Embedded Standard 7 benötigt gemäß den Microsoft Anforderungen Auflösungen von XGA (1024x768) und größer, um eine vollständige Bedienung der Windows Oberfläche (incl. Systemdialogen etc.) zu ermöglichen. Für Applikationen kann eine kleinere Auflösung gewählt werden.

9 Windows CE

9.1 Allgemeines

B&R Windows CE ist ein Betriebssystem, das für das von B&R angebotene Gerät optimal zugeschnitten ist, d.h. es sind nur die Funktionen und Module enthalten, die für das jeweilige Gerät benötigt werden. Dadurch ist dieses Betriebssystem äußerst robust und stabil. Ein weiterer Vorteil den B&R Windows CE gegenüber anderen Betriebssystemen mit sich bringt sind die geringen Lizenzkosten.

9.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Windows CE 6.0	
5SWWCE.0826-ENG	Microsoft OEM Windows CE 6.0 Professional, Englisch; für APC810 mit 945GME Chipsatz; CompactFlash separat bestellen (mind. 128 MByte).	
	Erforderliches Zubehör	
	CompactFlash-Karten	
5CFCRD.0128-03	CompactFlash 128 MByte Western Digital (SLC)	
5CFCRD.016G-06	CompactFlash 16 GByte B&R (SLC)	
5CFCRD.0256-03	CompactFlash 256 MByte Western Digital (SLC)	
5CFCRD.0512-03	CompactFlash 512 MByte Western Digital (SLC)	
5CFCRD.0512-06	CompactFlash 512 MByte B&R (SLC)	
5CFCRD.1024-03	CompactFlash 1 GByte Western Digital (SLC)	
5CFCRD.1024-06	CompactFlash 1 GByte B&R (SLC)	
5CFCRD.2048-03	CompactFlash 2 GByte Western Digital (SLC)	
5CFCRD.2048-06	CompactFlash 2 GByte B&R (SLC)	
5CFCRD.4096-03	CompactFlash 4 GByte Western Digital (SLC)	
5CFCRD.4096-06	CompactFlash 4 GByte B&R (SLC)	
5CFCRD.8192-03	CompactFlash 8 GByte Western Digital (SLC)	
5CFCRD.8192-06	CompactFlash 8 GByte B&R (SLC)	

Tabelle 259: 5SWWCE.0826-ENG - Bestelldaten

9.3 Übersicht

Bestellnummer	Zielsystem	Chipsatz	Sprache	Mindestgröße Datenträger	Mindestgröße Arbeitsspeicher
5SWWCE.0826-ENG	APC810	945GME	Englisch	128 MByte	128 MByte

9.4 Features Windows CE 6.0

Eine ausführliche Anleitung zu Windows CE für B&R Geräte kann im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen werden.

Ausstattung	Windows CE 6.0
Unterstützte Bildschirmauflösung	VGA (TFT), SVGA (TFT), XGA (TFT)
Chipset	Intel 945GME
Farbtiefe	16 Bit bzw. 65.536 Farben[1)]
Grafikkartentreiber	Intel(R) Embedded Graphics Driver
Hauptspeicher	Automatische Erkennung und Verwendung von bis zu 512 MByte RAM
Bootzeit / Hochlaufzeit	ca. 25 Sekunden
Screenrotation	wird nicht unterstützt
Webbrowser	Internet Explorer
.Net	Compact Framework
Imagegröße	ca. 38 MByte[2)], nicht komprimiert
Kundenspezifische Tasten	werden unterstützt
PVI	wird unterstützt
Automation Device Interface	wird unterstützt
Remote Desktop Protokoll für Thin Client	wird unterstützt
B&R VNC Viewer	wird unterstützt
B&R Task Manager	wird unterstützt
B&R Picture Viewer	wird unterstützt
Kompatibel mit zenOn	Ja
Kompatibel mit Wonderware	Nein
Serielle Schnittstellen zur freien Verwendung	3
DirectX	Nein
Audio Schnittstellen	"Line OUT" und "MIC" werden unterstützt. "Line IN" wird nicht unterstützt

Tabelle 260: Eigenschaften Windows CE 6.0

1) Die Farbtiefe hängt auch vom verwendeten Display ab.
2) Verwenden Sie die Funktion „Windows CE Image komprimieren“ des B&R Embedded OS Installers um die Imagegröße zu reduzieren.

9.5 Was wird benötigt

Das Gerät muss folgende Kriterien erfüllen um das Betriebssystem Windows CE zu betreiben.

- Mindestens 128 MByte Hauptspeicher
- Mindestens eine 128 MByte CompactFlash Karte (Größe ist bei der Bestellung mitanzugeben)

9.6 Installation

Generell wird Windows CE schon im Hause B&R vorinstalliert.

9.7 B&R Embedded OS Installer

Mit dem B&R Embedded OS Installer ist es möglich bestehende B&R Windows CE Images zu installieren. Es müssen dazu die 4 Dateien NK.BIN, BLDR, LOGOXRES.BMP und LOGOQVGA. BMP von einer bereits funktionierenden B&R Windows CE Installation vorliegen.

Der B&R Embedded OS Installer kann im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen werden. Weitere Informationen sind der Online Hilfe des B&R Embedded OS Installers zu entnehmen.

10 Automation Runtime

10.1 Allgemeines

Integraler Bestandteil des Automation Studio ist das Echtzeit Betriebssystem Automation Runtime. Dieses Echtzeit Betriebssystem bildet den Softwarekern um Anwendungen auf einem Zielsystem laufen zu lassen.

- Garantiert höchstmögliche Leistung für die eingesetzte Hardware
- Läuft auf allen B&R Zielsystemen
- Macht die Applikation hardwareunabhängig
- Applikationen können einfach zwischen B&R Zielsystemen portiert werden
- Garantierter Determinismus durch zyklisches System
- Jitter-Toleranz in allen Task-Klassen konfigurierbar
- Unterstützung aller relevanten Programmier-Sprachen, wie IEC-61131-3 und C
- Reiche Funktionsbibliothek nach IEC-61131-3 und zusätzlich die erweiterte B&R Automation Library
- Eingebunden in Automation NET. Zugriff auf alle Netzwerke und Bussysteme über Funktionsaufrufe oder durch Konfiguration im Automation Studio™

Das B&R Automation Runtime ist voll im entsprechenden Zielsystem (Hardware, auf der das Automation Runtime installiert wird) eingebettet. Es ermöglicht damit den Zugriff der Anwenderprogramme auf I/O Systeme (auch via Feldbus) und andere Geräte wie Schnittstellen und Netzwerke.

10.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Technology Guard	
0TG1000.01	Technology Guard (MSD) wird in der USB Geräteklasse MSD (Mass Storage Device) zur Verfügung gestellt	
0TG1000.02	Technology Guard (HID) wird in der USB Geräteklasse HID (Human Interface Device) zur Verfügung gestellt, Automation Runtime unterstützt HID ab der Version D4.09.	
1TG4600.10-5	Automation Runtime Windows TG Lizenz	
1TG4601.06-5	Automation Runtime Embedded TG Lizenz	

Tabelle 261: 0TG1000.01, 0TG1000.02, 1TG4600.10-5, 1TG4601.06-5 - Bestelldaten

10.3 Automation Runtime Windows (ARwin)

Systemvoraussetzungen

Um Automation Runtime Windows am Automation PC 810 zu betreiben sind folgende Softwareversionen mindestens erforderlich:

- ARwin Upgrade AR 2.xx
- Automation Studio V2.7
- Technology Guard

Information:

In ARwin 4.06 ist kein gleichzeitiger ADI-Zugriff aus Windows und ARwin mehr möglich, da die ADI-Schnittstelle von ARwin gesperrt wird.

Um von Windows und ARwin gleichzeitig auf die ADI-Schnittstelle zugreifen zu können sind folgende Komponenten erforderlich:

- **ADI Treiber V1.8 (oder höher)**
- **ARwin I4.06 (oder höher)**

10.4 Automation Runtime Embedded (ARemb)

Systemvoraussetzungen

Um Automation Runtime Embedded am Automation PC 810 zu betreiben sind folgende Softwareversionen mindestens erforderlich:

- ARemb Upgrade AR A4.00
- Automation Studio V3.0.90
- Visual Components Runtime (VC) V3.35.4
- Technology Guard

10.5 Technology Guarding

Technology Guarding ist der Lizenzschutz für einzelne Software-Komponenten. Als Lizenzbehälter dient der sogenannte "Technology Guard" (auch als Dongle bezeichnet), der an eine freie USB-Schnittstelle des Zielsystems gesteckt wird.

Die B&R Software Komponenten Automation Runtime Embedded (ARemb), Automation Runtime Windows (ARwin) und Automation Runtime Embedded Terminal sind lizenzpflichtig und die Verwendung des Technology Guard ist zwingend erforderlich.

Information:

Die Lizenzierung mittels dem Technology Guarding Assistenten erfolgt ab einer Automation Studio Version 4.1 und einer Automation Runtime Version 4.08. In früheren Automation Runtime Versionen ist kein Technology Guard notwendig.

Weitere Informationen zum Technology Guarding sind der Automation Studio Hilfe zu entnehmen.

11 B&R Automation Device Interface (ADI) - Control Center

ADI (Automation Device Interface) ermöglicht den Zugriff auf spezifische Funktionen von B&R Geräten. Die Einstellungen dieser Geräte können mit dem B&R Control Center Applet in der Systemsteuerung ausgelesen und geändert werden.

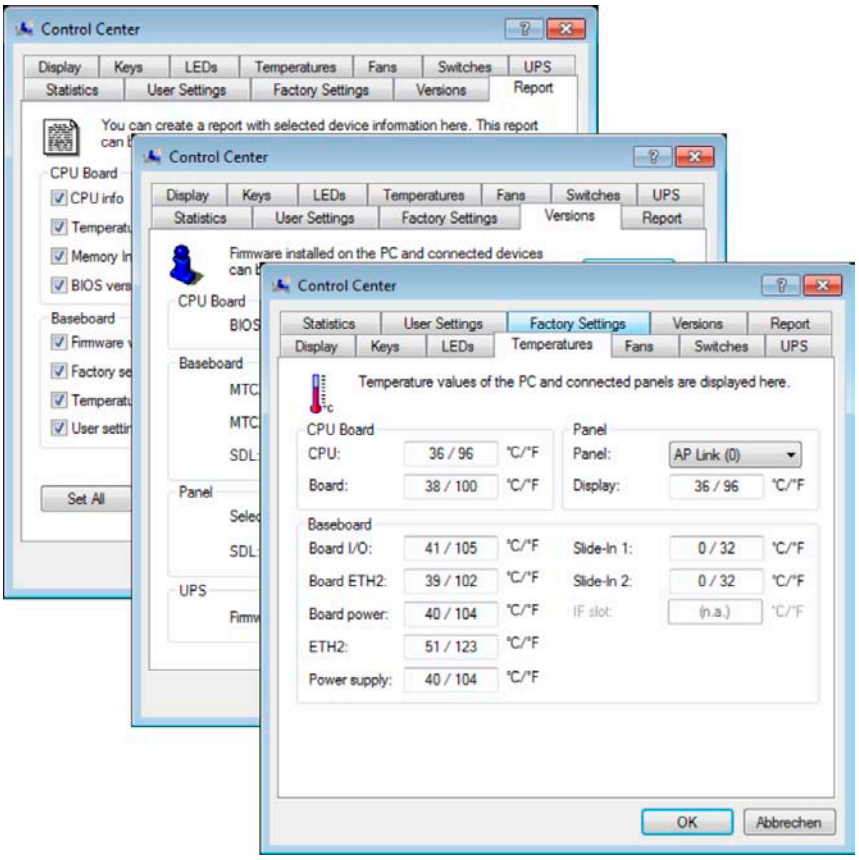


Abbildung 169: ADI Control Center Screenshots - Beispiele (Symbolfoto)

Information:

Die angezeigten Temperatur- und Spannungswerte (z.B. CPU Temperatur, Corespannung, Batteriespannung) auf der entsprechenden ADI Seite stellen ungeeichte Informationswerte dar. Daraus können keine Schlüsse über mögliche Alarme bzw. Fehlzustände der Hardware gezogen werden. Die verwendeten Hardwarekomponenten verfügen über automatische Diagnosefunktionen im Fehlerfalle.

11.1 Funktionen

Information:

Die vom Automation Device Interface (ADI) - Control Center verfügbaren Funktionen sind von der Gerätefamilie abhängig.

- Ändern von displayspezifischen Parametern
- Auslesen von gerätespezifischen Tasten
- Update der Tastenkonfiguration
- Aktivierung von gerätespezifischen LEDs einer Folientastatur bzw. von Tasten
- Auslesen bzw. Kalibrieren von Befehlsgeräten (z.B. Schlüsselschalter, Handrad, Joystick, Potentiometer)
- Auslesen von Temperaturen, Lüftergeschwindigkeiten, Statistikdaten und Schalterstellungen
- Auslesen der Betriebsstunden (Power On hours)
- Auslesen von User Settings und Factory Settings
- Auslesen von Softwareversionen
- Aktualisieren und Sichern von BIOS und Firmware
- Reporterstellung über das aktuelle System (Supportunterstützung)

- Einstellung des SDL Equalizerwertes für die SDL Kabelanpassung
- Ändern der User Serial ID

Unterstützt werden folgende Systeme:

- Automation PC 510
- Automation PC 511
- Automation PC 620
- Automation PC 810
- Automation PC 820
- Automation PC 910
- Automation PC 2100
- Panel PC 300
- Panel PC 700
- Panel PC 725
- Panel PC 800
- Panel PC 900
- Panel PC 2100
- Power Panel 100/200
- Power Panel 300/400
- Power Panel 500
- Mobile Panel 40/50
- Mobile Panel 100/200
- angeschlossene Automation Panel 800
- angeschlossene Automation Panel 900
- angeschlossene Automation Panel 1000

11.2 Installation

Eine detaillierte Beschreibung des Control Centers ist der integrierten Online Hilfe zu entnehmen. Der B&R Automation Device Interface (ADI) Treiber (beinhaltet auch Control Center) kann kostenlos im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen werden.

1. Herunterladen und entpacken des ZIP Archives
2. Schließen aller Anwendungen
3. Starten der Setup.exe Datei (z.B. durch Doppelklick im Explorer)

Information:

In den B&R Images von Embedded Betriebssystemen ist der ADI Treiber bereits enthalten.

Sollte eine aktuellere ADI Treiberversion existieren (siehe Downloadbereich der B&R Homepage), so kann diese nachinstalliert werden. Bei der Installation ist auf einen deaktivierten „Enhanced Write Filter (EWF)“ zu achten.

11.3 SDL Equalizer Einstellung

1. Über die **Systemsteuerung** das **Control Center** öffnen.
2. Die Registerkarte **Display** auswählen
3. Auf **Einstellungen** klicken. Es wird folgender Dialog angezeigt:

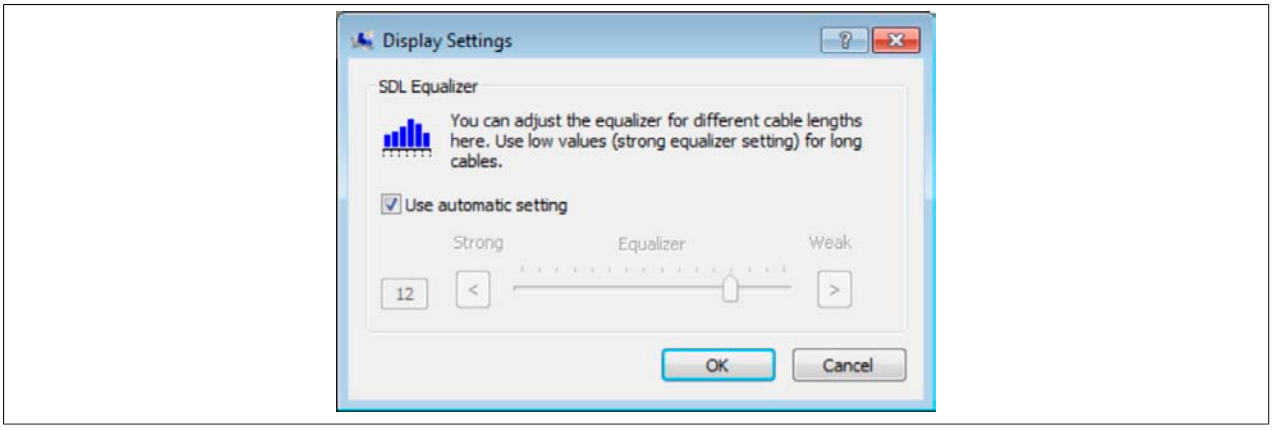


Abbildung 170: ADI Control Center - SDL Equalizer Einstellung

In diesem Dialog können Sie die SDL Equalizereinstellung des Displays ändern. Der Equalizer ist im Automation Panel eingebaut und passt das DVI Signal für unterschiedliche Kabellängen an. Der Equalizerwert wird automatisch anhand der Kabellänge ermittelt. Sie können einen anderen Equalizerwert einstellen, um die beste optische Darstellung auf dem Display zu erreichen (z.B. bei schlechter Kabelqualität oder schlechter DVI Signalqualität).

Bei der „Automatischen Einstellung" wird der Wert anhand der Kabellänge optimal eingestellt.

Der Equalizerwert kann nur geändert werden, wenn die Funktion vom Automation Panel 900 unterstützt wird (ab Panel Firmware Version 1.04 oder höher).

11.4 USV Parametrierung

Hier können die Statuswerte einer optional eingebauten B&R Add-on USV angezeigt und die Batterieeinstellungen der USV bearbeitet, aktualisiert und gesichert werden. Ebenfalls können die Systemeinstellungen der USV konfiguriert werden.

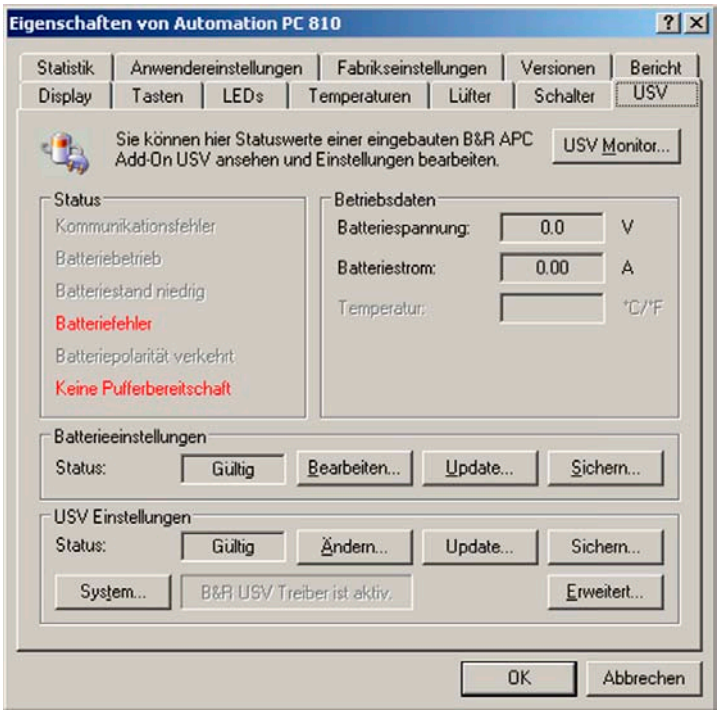


Abbildung 171: ADI Control Center - USV Einstellungen

Vorsicht!

Die eingebaute USV muss in der Systemsteuerung mit Energieoptionen ausgewählt und konfiguriert werden, damit der Batteriebetrieb unterstützt wird.

Information:

Der USV Dienst wird erst mit B&R Windows XP Embedded Version 2.10 oder höher unterstützt.

11.4.1 Installation des USV Dienstes für die B&R Add-on USV

1. Über die **Systemsteuerung** das **Control Center** öffnen.
2. Registerkarte **USV** auswählen.
3. Unter **USV Einstellungen** auf **System** klicken. Die **Energieoptionen** in der Systemsteuerung werden geöffnet. (Die **Energieoptionen** können auch direkt aus der **Systemsteuerung** geöffnet werden.)
4. Registerkarte **USV** auswählen und **Auswählen** klicken.
5. Als Hersteller 'Bernecker + Rainer' und als Modell 'APC Add-on USV' auswählen und auf **Fertig stellen** klicken. Der Wert für den COM Anschluss wird nur für eine seriell angeschlossene USV benötigt und vom APC Add-on USV Treiber ignoriert.
6. Auf **Übernehmen** klicken, um den USV Dienst zu starten. Das dauert ein paar Sekunden und danach werden USV Status und Details angezeigt.
7. Klicken Sie auf **OK**.

Das Textfeld neben **System** (auf der **USV** Registerkarte im **Control Center**) zeigt ebenfalls an, ob der B&R USV Treiber aktiv ist.

Information:

Man benötigt Administratorrechte zum Ändern von Energieoptionen und zum Anzeigen des USV Status.

11.4.2 Statuswerte der USV anzeigen

1. Über die **Systemsteuerung** das **Control Center** öffnen.
2. Registerkarte **USV** auswählen.
   Die angezeigten Werte werden automatisch aktualisiert.

Information:

Der „Batteriepolarität verkehrt" Zustand wird erst mit USV Firmware Version 1.08 oder höher angezeigt.

Bei USV Firmware Version 1.07 oder kleiner kann es beim Wechsel zwischen Batteriebetrieb und Normalbetrieb zu einem Kommunikationsfehler kommen.

3. USV Monitor auswählen, um die Änderungen des USV Status seit dem letzten Start des Systems bzw. des USV Treibers anzuzeigen.

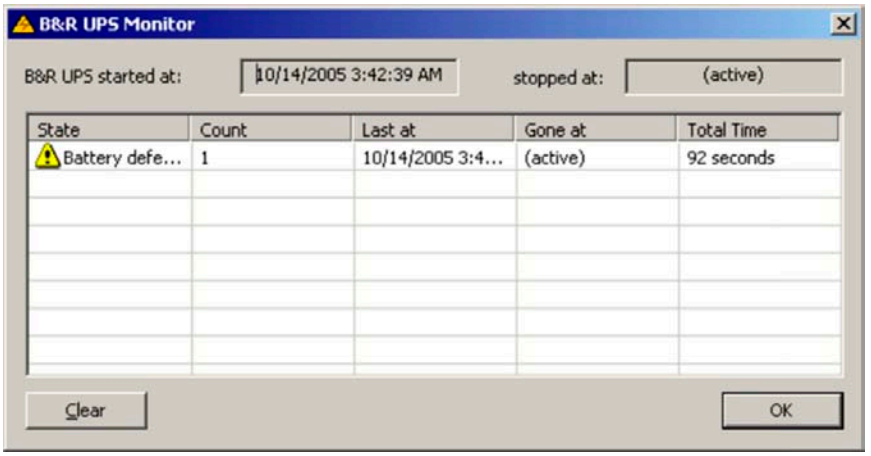


Abbildung 172: ADI Control Center - USV Monitor

Der Dialog wird bei Änderungen des Status automatisch aktualisiert.

Um die angezeigten Zustände aus der Liste zu entfernen, auf **Löschen** klicken.

Information:

Der aktuelle Zustand der USV wird auch bei gestartetem USV Dienst in der Windows Systemsteuerung auf der USV Seite bei den Energieoptionen angezeigt.

Information:

In einer deutschen Windows XP Professional Version wird der Batteriezustand in den Energieoptionen mit "Niedrig" angezeigt, auch wenn die Batterie in Ordnung ist (Windows Fehler). In einer englischen Version werden normalerweise drei Batteriezustände angezeigt: unbekannt, OK, zu ersetzen. Niedriger Batteriestand wird niemals angezeigt.

11.4.3 Batterieeinstellungen der USV bearbeiten

1. Über die **Systemsteuerung** das **Control Center** öffnen.
2. Registerkarte **USV** auswählen.
3. Unter **Batterieeinstellungen** auf **Bearbeiten** klicken. Datei „Öffnen" Dialog wird geöffnet.
4. Auswahl der Datei mit den Batterieeinstellungen und **öffnen** der Datei.

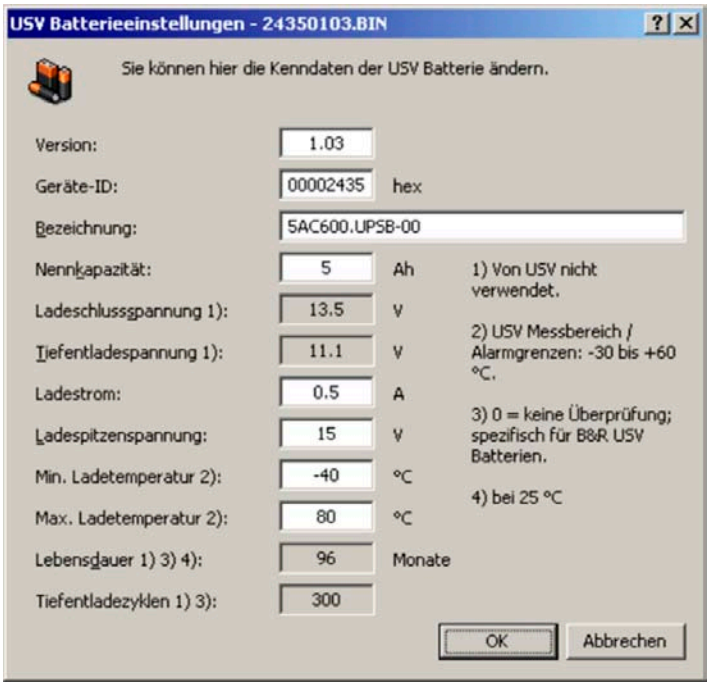


Abbildung 173: ADI Control Center - USV Batterieeinstellungen

In diesem Dialog kann man Einstellungen für die verwendete USV Batterie bearbeiten.

Durch Klicken auf **OK** werden die geänderten Einstellungen in die Datei geschrieben. Anschließend können die Batterieeinstellungen der USV mit dieser Datei aktualisiert werden.

Information:

Wenn Einstellungen für nicht von B&R gelieferte Batterien gemacht werden sollen, kopiert man am Besten eine Datei mit Batterieeinstellungen von B&R mit einem neuen Namen ab und passt die Einstellung dieser Datei für die verwendete Batterie an.

Aktuelle Dateien mit Einstellungen für die von B&R gelieferten Batterien können über die B&R „Upgrade PPC800 MTCX” Software aktualisiert werden.

Information:

- **Ladeschlussspannung, Tiefentladespannung, Lebensdauer und Tiefentladezyklen werden von der aktuellen USV Firmware Version 1.10 nicht verwendet.**
- **Lebensdauer ist erst ab Version 2 der USV Batterieeinstellungen enthalten und nur gültig für B&R USV Batterien bei 25°C Umgebungstemperatur.**
- **Tiefentladezyklen ist erst ab Version 3 der USV Batterieeinstellungen enthalten und nur gültig für B&R USV Batterien.**

Information:

Wenn die auf der USV aktuell vorhandenen Batterieeinstellungen bearbeitet werden sollen, müssen diese vorher in einer Datei gesichert werden.

11.4.4 Batterieeinstellungen der USV aktualisieren

1. Über die **Systemsteuerung** das **Control Center** öffnen.
2. Registerkarte **USV** auswählen.
3. Unter **Batterieeinstellungen** auf **Update** klicken. Datei „Öffnen” Dialog wird geöffnet.
4. Auswahl der Datei mit den Batterieeinstellungen und **öffnen** der Datei. Der „Download” Dialog wird geöffnet.

Die Übertragung kann durch Klicken auf **Abbrechen** im Download Dialog abgebrochen werden. Abbrechen ist während des Schreibens auf den Flashspeicher deaktiviert.

Information:

- **Während der Aktualisierung der Batterieeinstellungen ist kein USV- Betrieb möglich.**
- **Wenn die Übertragung abgebrochen wurde, muss der Vorgang so lange wiederholt werden, bis die Batterieeinstellungen erfolgreich aktualisiert wurden. Andernfalls ist anschließend kein Batteriebetrieb mehr möglich.**

Das Löschen der Daten im Flashspeicher kann, abhängig vom verwendeten Speicherbaustein, mehrere Sekunden dauern. Während dieser Zeit wird die Fortschrittsanzeige nicht aktualisiert.

Information:

Die USV wird nach erfolgreichem Download automatisch neu gestartet. Dabei kann es kurzzeitig zu einem Ausfall der USV- Kommunikation kommen.

11.4.5 Batterieeinstellungen der USV sichern

1. Über die **Systemsteuerung** das **Control Center** öffnen.
2. Registerkarte **USV** auswählen.
3. Unter Batterieeinstellungen auf **Sichern** klicken. „Speichern unter" Dialog wird geöffnet.
4. Dateiname eingeben oder eine bestehende Datei auswählen und auf **Speichern** klicken.

Information:

Das Sichern von USV Einstellungen wird erst ab USV Firmware Version 1.10 unterstützt.

Die Übertragung kann durch klicken auf **Abbrechen** im „Download" Dialog abgebrochen werden.

11.4.6 Systemeinstellungen der USV konfigurieren

1. Über die **Systemsteuerung** das **Control Center** öffnen.
2. Registerkarte **USV** auswählen.
3. Unter **USV Einstellungen** auf **Ändern** klicken. Es wird folgender Dialog angezeigt.

Abbildung 174: ADI Control Center - USV Einstellungen

Weitere Informationen zu den Systemeinstellungen der USV finden Sie in der Windows Hilfe.

Information:

- **Das Ändern von USV Einstellungen wird erst ab USV Firmware Version 1.10 unterstützt. Wenn auf der USV keine geänderten Einstellungen vorhanden sind, werden Fabriks- oder Defaulteinstellungen verwendet.**
- **Die USV wird nach dem Ändern von USV Einstellungen automatisch neu gestartet. Dabei kann es kurzzeitig zu einem Ausfall der Kommunikation mit der USV kommen.**
- **Man benötigt Administratorrechte zum Ändern von Energieoptionen und zum Anzeigen des USV Status.**

11.4.6.1 Ausschalten der 8 A Strombegrenzung

Information:

Ein Ausschalten der 8 A Strombegrenzung bei Geräten im Batteriebetrieb ist nicht UL-konform!

Ein „Low Battery“ Shutdown bei einem Überstrom von > 8 A bei Geräten im Batteriebetrieb ist nicht UL-konform!

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Strombegrenzung (8 A) ausschalten**.

Wenn die Strombegrenzung eingeschaltet ist (Kontrollkästchen ist deaktiviert), prüft die USV im Batteriebetrieb, ob die USV Batterie länger als 16 Sekunden mit mehr als 8 A entladen wird. In diesem Fall wird ein Überstromalarm zum PC signalisiert.

Information:

Die Strombegrenzung wird erst ab USV Firmware Version 1.10 unterstützt.

Durch Aktivieren einer der beiden folgenden Optionen können Sie auswählen, wie sich die USV bei einem Überstromalarm verhält:

Mit innerhalb 1 Minute ausschalten schaltet die USV bei Überstrom innerhalb einer Minute ab.

Warnung!

Das Betriebssystem wird dann bei einem Überstrom Alarm nicht ordnungsgemäß niedergefahren!

Mit **"Low Battery" Shutdown durchführen** signalisiert die USV zusätzlich zum Überstromalarm einen "Low Battery" Alarm und schaltet sich nach der eingestellten **"Low Battery" Abschaltzeit** aus. Dadurch wird das Betriebssystem bei aktiviertem USV Dienst ordnungsgemäß niedergefahren.

11.4.6.2 Ändern der Abschaltzeit der USV bei niedrigem Batteriepegel

Geben Sie die **"Low Battery" Abschaltzeit** in Sekunden an. Das ist die Zeit, die von der USV bei niedrigem Batteriepegel gewartet wird, bevor sie die Stromversorgung abschaltet.

Damit wird verhindert, dass die USV Batterie zu sehr entladen wird, wenn der Windows USV Dienst nicht aktiv ist und die USV daher nicht vom Betriebssystem ausgeschaltet wird.

Wenn der USV Dienst aktiv ist, wird die USV bei niedrigem Batteriepegel vom Betriebssystem mit der Windows USV Dienst **Abschaltzeit** (siehe "Weitere USV Einstellungen ändern" auf Seite 327) abgeschaltet. Die **"Low Battery" Abschaltzeit** wird dann ignoriert.

Information:

- **Die "Low Battery" Abschaltzeit muss mit mindestens 60 Sekunden angegeben werden, damit das Betriebssystem genug Zeit hat, um bei niedrigem Batteriestand den Abschaltbefehl an die USV zu senden (erfolgt normalerweise nach ca. 30 Sekunden).**
- **Die "Low Battery" Abschaltzeit kann erst ab USV Firmware Version 1.10 eingestellt werden. USV Firmware Version 1.08 verwendet fix 180 Sekunden als Abschaltzeit. USV Firmware Versionen kleiner 1.08 schalten bei niedrigem Batteriepegel nicht selbständig ab.**

11.4.7 Weitere USV Einstellungen ändern

1. Über die **Systemsteuerung** das **Control Center** öffnen.
2. Registerkarte **USV** auswählen.
3. Unter **USV Einstellungen** auf **Erweitert** klicken. Es wird folgender Dialog angezeigt.

Abbildung 175: ADI Control Center - Erweiterte USV Einstellungen

Information:

Man benötigt Administratorrechte zum Anzeigen dieses Dialoges.

11.4.7.1 Abschaltzeit der USV ändern

Unter **Windows USV Dienst** kann die **Abschaltzeit** in Sekunden angegeben werden. Das ist die Zeit, in der gewartet wird, bis die USV die Stromversorgung abschaltet. Dazu wird vom Windows USV Dienst bei einem kritischen Alarm (z.B. bei niedrigem Batteriestand) ein Shutdown Kommando mit der Abschaltzeit an die USV gesendet und das System heruntergefahren.

Information:

Diese Zeit wird vom Windows USV Dienst ausgewertet, kann aber in den USV Systemeinstellungen der Energieoptionen nicht eingestellt werden. Dieser Wert sollte nur geändert werden, wenn das System länger als die standardmäßig eingestellten 180 Sekunden zum Niederfahren benötigt.

Vorsicht!

Die angegebene Zeit muss größer sein als die für das Niederfahren des Betriebssystems benötigte Zeit.

11.4.7.2 Benachrichtigungen der USV aktivieren

Unter **B&R USV Treiber** das Kontrollkästchen **Nachrichten für USV Status ausgeben** aktivieren. Es wird dann vom B&R USV Treiber bei jeder Änderung des USV Status eine Meldung ausgegeben.

Information:

Das Niederfahren des Systems wird nur vom Windows USV Dienst gemeldet. Vom USV Dienst werden auch weitere Benachrichtigungen gesendet, wenn diese in den USV Systemeinstellungen der Energieoptionen aktiviert sind. Diese Benachrichtigungen werden nur ausgegeben, wenn der Windows Nachrichtendienst (Messenger)[6] gestartet ist und der PC an einem Netzwerk angeschlossen ist. Außerdem werden einige Zustände der B&R Add-on USV vom Windows USV Dienst nicht erkannt und daher nicht gemeldet, z.B. wenn keine Batterieeinstellungen auf der USV vorhanden sind. Die Windows Dienste sind in der Systemsteuerung unter Verwaltung in Dienste zu finden.

[6] Der Windows Nachrichtendienst wird erst mit B&R Windows XP Embedded Version 2.20 oder höher unterstützt.

Ist zusätzlich das Kontrollkästchen **USV Status mit USV Monitor anzeigen** aktiviert, so wird nicht bei jeder Änderung eine neue Meldung ausgegeben, sondern nur eine allgemeine Meldung und Aufforderung zum Starten des B&R USV Monitors. Solange der USV Monitor aktiv ist, werden keine neuen Meldungen ausgegeben.

Information:

Alle Änderungen des USV Status werden unabhängig von diesen Optionen im Windows Ereignisprotokoll (unter „Anwendung") eingetragen.

11.4.8 Ablauf bei einem Powerfail

11.4.8.1 Over Current Shutdown

Wenn im Batteriebetrieb für eine Dauer von 16 Sekunden ein Überstrom >8 A erreicht wird, wird der Over Current Shutdown eingeleitet. Dem System steht insgesamt eine Abschaltzeit von einer Minute zur Verfügung.

Wird während dieser Zeit die Versorgung wieder hergestellt wird der Abschaltvorgang abgebrochen.

Information:

Der Over Current Shutdown hat die höchste Priorität.

11.4.8.2 Low Battery Shutdown

Wird bei einem Spannungsausfall das LowBatteryFlag gesetzt wird der „Low Battery" Shutdown eingeleitet, er verhindert die Totentladung des Akkus. Nach Ablauf der Ausschaltzeit (per Default 3 Minuten) schaltet die USV aus.

Sollte während dem Abschaltvorgang ein „Overcurrent" Shutdown oder ein „Standard" Shutdown erkannt werden, wird der „Low Battery" Shutdown durch den jeweiligen Vorgang ersetzt.

11.4.8.3 Standard Shutdown

Der Standard Shutdown wird bei aktiviertem USV Dienst schlagend, die Ausschaltzeit beträgt per Default 3 Minuten.

Wenn die Versorgungsspannung während der Ausschaltzeit wiederkehrt, wird der Shutdown abgebrochen.

Wenn die Versorgungsspannung während des Abschaltvorganges wiederkehrt läuft der Shutdowntimer solange bis der B&R Industrie PC den Standby Modus erreicht hat und führt dann einen Reboot des Systems aus.

12 B&R Automation Device Interface (ADI) Development Kit

Mit dieser Software können Funktionen des B&R Automation Device Interface (ADI) aus Windows Anwendungen angesprochen werden, die z.B. mit folgenden Entwicklungsumgebungen erstellt wurden:

- Microsoft Visual C++ 6.0
- Microsoft Visual Basic 6.0
- Microsoft Embedded Visual C++ 4.0
- Microsoft Visual Studio 2008 (oder neuer)

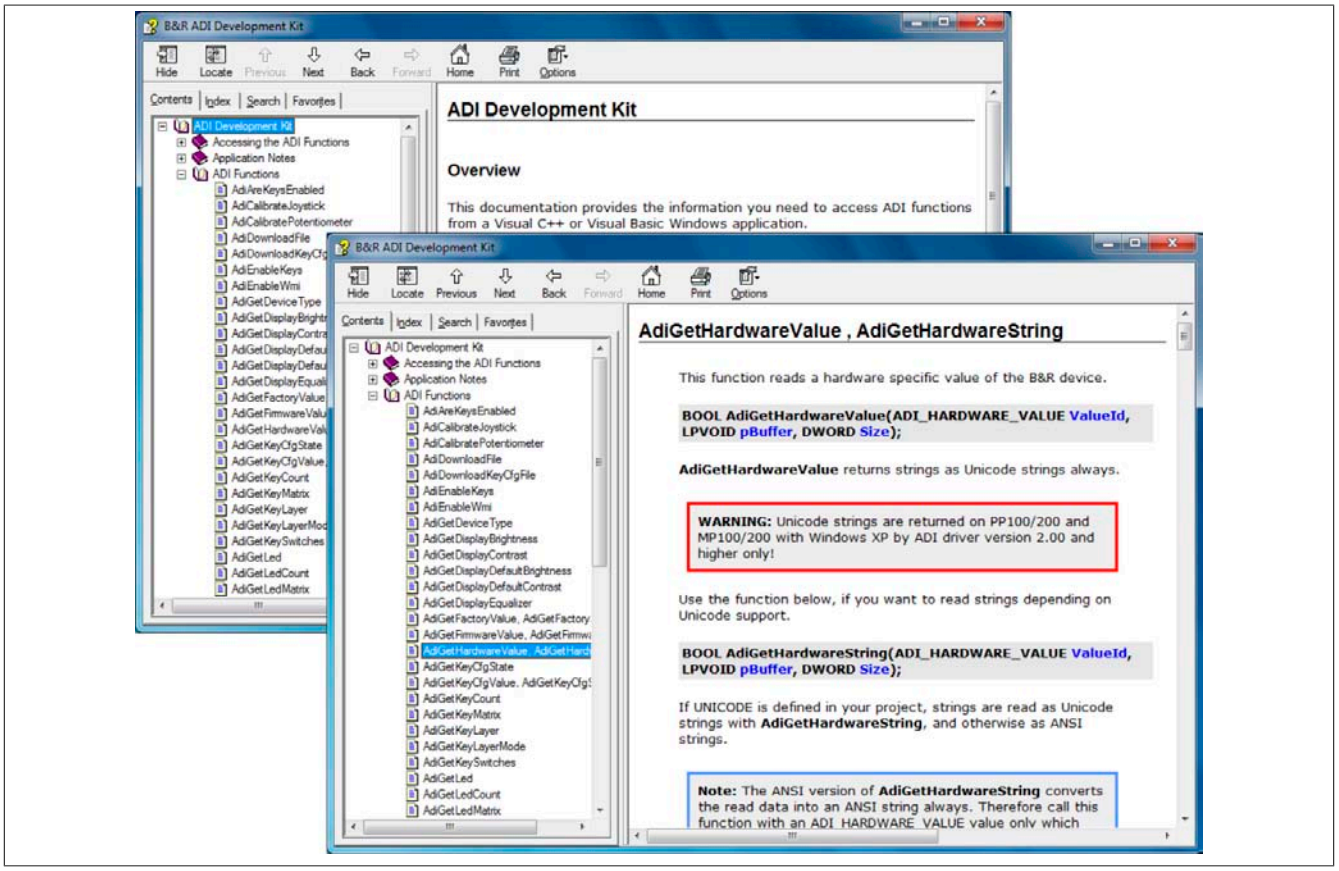


Abbildung 176: ADI Development Kit Screenshots (Version 3.70)

Features:

- Ein Microsoft Visual Basic Modul mit Deklarationen der ADI Funktionen
- Header Dateien und Import Libraries für Microsoft Visual C++
- Hilfedateie für Visual Basic und Visual C++
- Beispielprojekte für Visual Basic und Visual C++
- ADI DLL (für Test der Anwendungen, wenn kein ADI Treiber installiert ist)

Unterstützt werden folgende Systeme (ab Version 3.70):

- Automation PC 510
- Automation PC 511
- Automation PC 620
- Automation PC 810
- Automation PC 820
- Automation PC 910
- Automation PC 2100
- Panel PC 300
- Panel PC 700
- Panel PC 800
- Panel PC 900
- Panel PC 2100

- Power Panel 100/200
- Power Panel 300/400
- Power Panel 500
- Mobile Panel 40/50
- Mobile Panel 100/200

Es muss dazu der für das Gerät passende ADI Treiber auf der genannten Produktfamile installiert sein. In den B&R Images von Embedded Betriebssystemen ist der ADI Treiber bereits enthalten.

Eine detaillierte Beschreibung, wie die ADI Funktionen verwendet werden, ist der Online Hilfe zu entnehmen.

Das B&R Automation Device Interface (ADI) Development Kit kann kostenlos im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen werden.

13 B&R Automation Device Interface (ADI) .NET SDK

Mit dieser Software können Funktionen des B&R Automation Device Interface (ADI) aus .NET Anwendungen angesprochen werden, die mit Microsoft Visual Studio 2005 (oder neuer) erstellt wurden.

Unterstützte Programmiersprachen:

- Visual Basic
- Visual C++
- Visual C#

Systemvoraussetzungen:

- Entwicklungssystem: PC mit Windows XP/7 mit
  - Microsoft Visual Studio 2005 oder neuer
  - Microsoft .NET Framework 2.0 und / oder Microsoft .NET Compact Framework 2.0 oder neuer

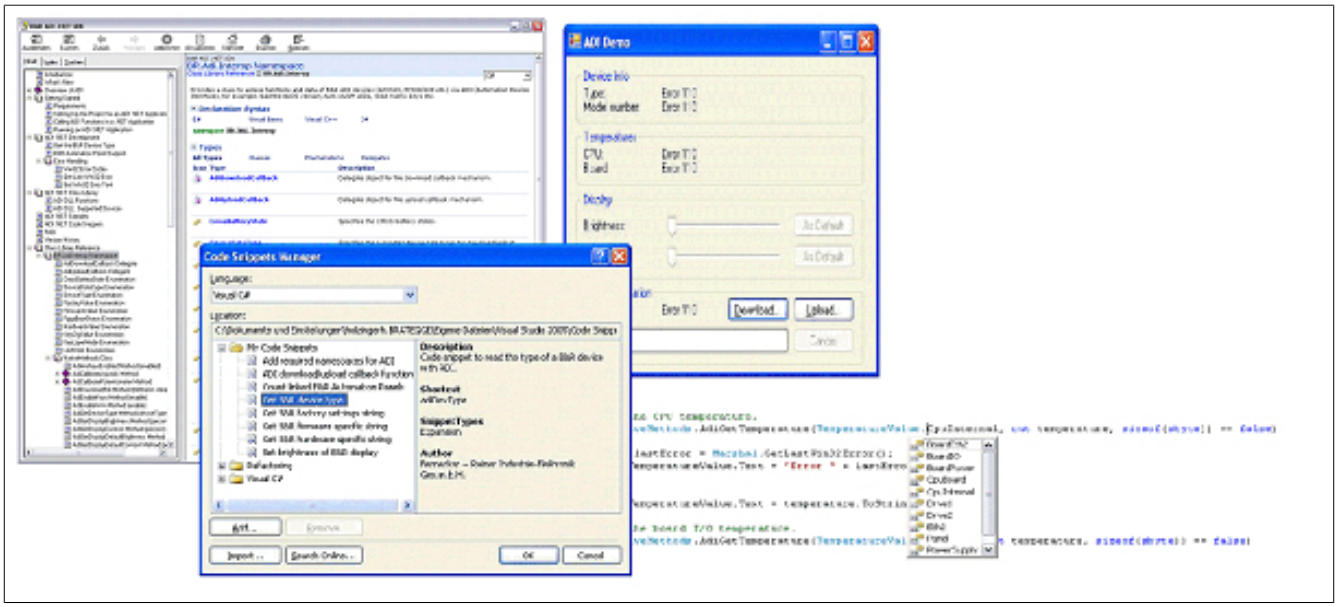


Abbildung 177: ADI .NET SDK Screenshots (Version 2.10)

Features (ab Version 2.10):

- ADI .NET Class Library.
- Hilfedateien im HTML Help 1.0 Format (.chm Datei), MS Help 2.0 Format (.HxS Datei) und MS Help Viewer Format (.MSHC Datei). (Hilfe ist in Englisch)
- Beispielprojekte und Code Snippets für Visual Basic, Visual C++, Visual C#.
- ADI DLL (für Test der Anwendungen, wenn kein ADI Treiber installiert ist).

Unterstützt werden folgende Systeme (ab Version 2.10):

- Automation PC 510
- Automation PC 511
- Automation PC 620
- Automation PC 810
- Automation PC 820
- Automation PC 910
- Automation PC 2100
- Panel PC 300
- Panel PC 700
- Panel PC 800
- Panel PC 900
- Panel PC 2100
- Power Panel 100/200
- Power Panel 300/400

- Power Panel 500
- Mobile Panel 40/50
- Mobile Panel 100/200

Es muss dazu der für das Gerät passende ADI Treiber auf der genannten Produktfamile installiert sein. In den B&R Images von Embedded Betriebssystemen ist der ADI Treiber bereits enthalten.

Eine detaillierte Beschreibung, wie die ADI Funktionen verwendet werden, ist der Online Hilfe zu entnehmen.

Das ADI .NET SDK kann kostenlos im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen werden.

14 B&R Key Editor

Eine häufig auftretende Anforderung bei Displayeinheiten ist die Anpassung der Funktionstasten und LEDs an die Applikationssoftware. Mit dem B&R Key Editor ist die individuelle Anpassung an die Applikation schnell und problemlos möglich.

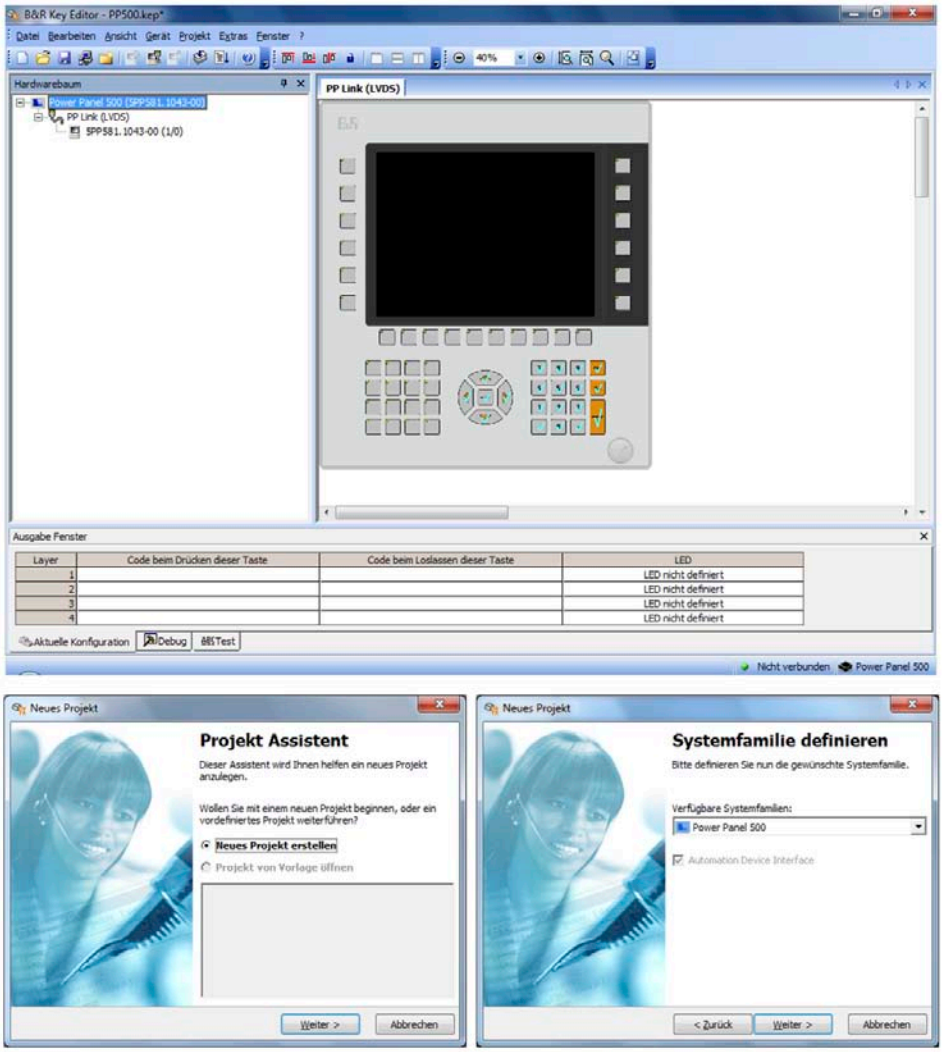


Abbildung 178: B&R Key Editor Screenshots Version 3.60 (Symbolfoto)

Features:

- Parametrierung normaler Tasten wie auf einem Keyboard (A, B, C, etc.)
- Tastenkombinationen (CTRL+C, SHIFT+DEL, etc.) auf einer Taste
- Spezielle Funktion der Taste (Helligkeit ändern, etc.)
- LEDs Funktionen zuweisen (HDD Zugriff, Power, etc.)
- 4-fach Belegung jeder Taste möglich (über Layer)
- Parametrierung der Panel Sperrzeit beim Anschluss mehrerer Automation Panel 900 Geräte bei Automation PCs und Panel PCs.

Unterstützt werden folgende Systeme (Version 3.60):

- Automation PC 510
- Automation PC 511
- Automation PC 620
- Automation PC 810
- Automation PC 820
- Automation PC 910
- Automation PC 2100
- Automation Panel 800

- Automation Panel 830
- Automation Panel 900
- Automation Panel 9x3
- Automation Panel 9xD
- Automation Panel 1000
- IPC2000, IPC2001, IPC2002
- IPC5000, IPC5600
- IPC5000C, IPC5600C
- Mobile Panel 40/50
- Mobile Panel 100/200
- Panel PC 300
- Panel PC 700
- Panel PC 800
- Panel PC 900
- Panel PC 2100
- Power Panel 100/200
- Power Panel 300/400
- Power Panel 500

Eine detaillierte Anleitung zum Parametrieren von Tasten und LEDs und zur Installation der Tastenkonfiguration am Zielsystem ist in der Online Hilfe des B&R Key Editors zu finden. Der B&R Key Editor kann kostenlos im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen werden.

15 B&R KCF Editor

Der B&R KCF Editor kann als einfache Alternative zum B&R Key Editor verwendet werden. Es können damit ebenfalls die Funktionstasten und LEDs an die Applikationssoftware angepasst werden. Im Gegensatz zum B&R Key Editor erfolgt die Bedienung nicht über die grafische Darstellung des Geräts, sondern über einen einfachen Windows Dialog. Der B&R KCF Editor kann daher auch für Geräte verwendet werden, die noch nicht im B&R Key Editor unterstützt werden. Der B&R KCF Editor ist eine „portable“ Anwendung und kann ohne Installation auf dem Zielgerät z.B. direkt von einem USB Memory Stick gestartet werden. Für den vollen Funktionsumfang ist ein installierter ADI-Treiber notwendig.

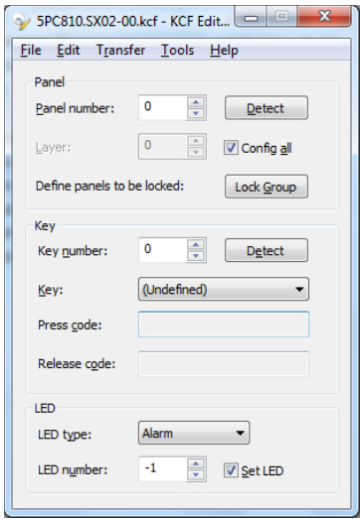


Abbildung 179: B&R KCF Editor Screenshot Version 1.0 (Symbolfoto)

Features

- Parametrierung normaler Tasten wie auf einem Keyboard (A, B, C, etc.)
- Spezielle Funktionen der Taste (Helligkeit ändern, etc.)
- LED Funktionen zuweisen (HDD-Zugriff, Power, etc.)
- 4-fach Belegung jeder Taste möglich (über Layer)
- Parametrierung der Panel-Sperrzeit beim Anschluss mehrerer Automation Panel Geräte an B&R PCs
- Export und Import der Konfiguration (über INI-Dateien)
- Abspeichern der Konfiguration als Bericht (als Textdatei)

Zusätzliche Features, falls der KCF Editor auf dem Zielgerät ausgeführt wird[7)]

- Panel- und Tastenerkennung
- LED-Test
- Download/Upload der Konfiguration

Unterstützt werden folgende Systeme (Version 1.0)

- Automation PCs
- Panel PCs
- Automation Panels
- Power Panels
- Mobile Panels

Eine detaillierte Anleitung zum Parametrieren von Tasten und LEDs ist im Anwenderhandbuch des B&R KCF Editors zu finden. Der B&R KCF Editor und das Anwenderhandbuch können kostenlos im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen werden.

7) Für diese Features muss auf dem B&R PC der ADI-Treiber installiert sein.

16 HMI Service Center

16.1 5SWUTI.0001-000

16.1.1 Allgemeines

Das HMI Service Center ist eine Software zum Testen von B&R Industrie PCs und Automation Panels. Der Test deckt verschiedene Kategorien wie COM, Netzwerk, SRAM usw. ab.

Das Testsystem besteht aus einem USB Memory Stick mit dem darauf installierten Betriebssystem Windows PE 5.1 und dem HMI Service Center.

Details zum HMI Service Center sind im HMI Service Center Anwenderhandbuch nachzulesen. Dieses kann kostenlos von der B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen werden.

16.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Zubehör	
5SWUTI.0001-000	HMI Service Center USB Stick - Hardwarediagnosesoftware - Für APC810/PPC800 - Für APC910/PPC900 - Für APC2100/ PPC2100 - Für APC51x/PP500 - Für Automation Panel 800/900	

Tabelle 262: 5SWUTI.0001-000 - Bestelldaten

Kapitel 5 • Normen und Zulassungen

1 Richtlinien und Erklärungen

1.1 CE-Kennzeichnung

Alle für das jeweilige Produkt geltenden Richtlinien und deren harmonisierte EN-Normen werden erfüllt.

1.2 EMV-Richtlinie

Die Geräte erfüllen die Anforderungen der EG-Richtlinie "2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit" und sind für folgende Einsatzbereiche ausgelegt:

EN 61131-2:2007	Speicherprogrammierbare Steuerungen - Teil 2: Betriebsmittelanforderungen und Prüfungen
EN 61000-6-2:2005	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 6-2: Fachgrundnormen - Störfestigkeit für Industriebereich
EN 61000-6-4:2007	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 6-4: Fachgrundnormen; Fachgrundnorm Störaussendung für Industriebereich

2 Zulassungen

Gefahr!

Ein Gesamtgerät kann nur eine Zulassung erhalten, wenn ALLE darin verbauten und angeschlossenen Einzelkomponenten die entspechende(n) Zulassungen besitzen. Wird eine Einzelkomponente verwendet, welche KEINE entsprechende Zulassung besitzt, so enthält auch das Gesamtgerät KEINE Zulassung.

B&R Produkte und Dienstleistungen entsprechen den zutreffenden Normen. Das sind internationale Normen von Organisationen wie ISO, IEC und CENELEC, sowie nationale Normen von Organisationen wie UL, CSA, FCC, VDE, ÖVE etc. Besondere Aufmerksamkeit widmen wir der Zuverlässigkeit unserer Produkte im Industriebereich.

Sofern nicht anders angegeben liegen folgende Zulassungen vor:

2.1 UL-Zulassung

Produkte mit dieser Kennzeichnung sind von Underwriters Laboratories geprüft und als "Industrial Control Equiment" gelistet. Das Prüfzeichen gilt für die USA und Kanada und erleichtert die Zulassung Ihrer Maschinen und Anlagen in diesem Wirtschaftsraum.

Underwriters Laboratories (UL) nach Standard UL508 - 17th Edition
Kanadischer (CSA) Standard nach C22.2 No. 142-M1987

Ind.Cont.Eq.
E115267

2.2 Zulassungen für die Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen

2.2.1 UL Haz. Loc. Zulassung

Produkte mit dieser Kennzeichnung sind von Underwriters Laboratories geprüft und als "Industrial Control Equiment for Use in Hazardous Loactions" gelistet. Das Prüfzeichen gilt für die USA und Kanada und erleichtert die Zulassung Ihrer Maschinen und Anlagen in diesem Wirtschaftsraum.

Underwriters Laboratories (UL) nach Standard ANSI/ISA 12.12.01:2011
Kanadischer (CSA) Standard nach C22.2 No. 213-M1987

Ind.Cont.Eq.
for Haz.Locs.
Cl. I, Div. 2,
Groups ABCD
E180196

2.2.2 ATEX Zulassung

Produkte mit dieser Kennzeichnung sind von einer zugelassenen Zertifizierungsstelle geprüft und für die Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen zugelassen.

II 3D Ex tc IIIA T85°C Dc
IP20 Tamb: 0°C to 55°C
FTZU 11 E 0001U

2.2.3 Anforderungen zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen

Allgemeine Sicherheitshinweise

Geräte des Systems Automation PC 810 sind für den Einsatz in der oben beschriebenen Umgebung oder an nicht explosionsgefährdeten Orten geeignet. Die Verdrahtung muss gemäß den nationalen Vorschriften und den Anforderungen der Behörde ausgeführt werden. Geräte müssen in geeigneten Schutzgehäusen eingebaut werden und die Endmontage muss von der zuständigen lokalen Behörde abgenommen werden. Zusatzausrüstung muss für den Einsatzort geeignet sein.

Explosionsgeschützte Geräte sind bestimmungsgemäß einzusetzen und dürfen nur von unterwiesenen Fachkräften gemäß dieser Anleitung und dem zugehörigen Manual betrieben werden. Ein anderer Betrieb gefährdet die Sicherheit und Funktion der Geräte und der angeschlossenen Systeme. Die Verantwortung für das Einhalten der gültigen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften, sowie Normen liegt beim Betreiber.

Montage und Installation

Geräte des Systems Automation PC 810 sind gemäß dem Anwenderhandbuch zu montieren. Um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten, sind die spezifizierten Freiräume einzuhalten. Die maximale Umgebungstemperatur beträgt 55ºC. Bei Verwendung eines Prozessor Boards Kat. Nr. 5PC800.BM45-xxx ist ein Lüfterkit zu verwenden. Das Anzugsdrehmoment für Versorgungsklemmen beträgt 0,5 Nm. Kabel müssen für eine Oberflächentemperatur von 75ºC geeignet sein. Geräte müssen bis zum Abschluss der Installationsarbeiten spannungsfrei sein. Geräte sind innerhalb eines Potenzialausgleichssystems einzusetzen und an den Potenzialausgleich anzuschließen. ATEX: Geräte sind in Schutzgehäuse einzubauen, die den Mindestschutzgrad IP54 nach EN 60529 und die Schutzart „tc“ gemäß EN 60079-31 aufweisen.

Wartung

Staubablagerungen sind regelmäßig zu entfernen.

Störung und Demontage

Geräte sind außer Betrieb zu setzen und gegen versehentliche Inbetriebnahme zu schützen. Defekte Geräte sind von unterwiesenen Fachkräften auszutauschen.

Die Batterie (Renata CR2477N) oder Sicherungen nicht unter Spannung oder nur in ungefährlichen Bereichen trennen!

Gefahr!

Explosionsgefahr - Der Austausch von Komponenten kann die Eignung für Class I, Division 2 beeinträchtigen!

Explosionsgefahr - Steckverbindungen nicht unter Spannung oder nur in ungefährlichen Bereichen trennen!

Warnung!

Es dürfen nur nichtfunkende USB-Geräte gemäß Bedienungsanleitung verwendet werden!

Konformitätsprüfung und Zertifizierung

Die mit „Ex“ gekennzeichneten Geräte entsprechen den Richtlinien 2004/108/EG und 94/9/EWG, sowie den harmonisierten Normen EN 61131-2:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007, cl. 5.3 EN 60079-0:2009, cl. 6.1.2 EN 60079-31:2009.

Die mit “c-UL-us” gekennzeichneten Geräte entsprechen den Normen CSA Std C22.2 No. 213-M1987, CSA Std C22.2 No. 142-M1987, UL Std 508 - 17th Edition, ANSI/ISA 12.12.01:2011.

Produktdokumentation im Detail

Weitere Informationen zu Produkten können der B&R Homepage www.br-automation.com oder den Anwenderhandbüchern entnommen werden.

2.3 GOST-R

Produkte mit dieser Kennzeichnung sind von einem akkreditierten Testlabor geprüft und dürfen in die Russische Föderation eingeführt werden (basierend auf der CE-Konformität).

2.4 GL-Zulassung (Germanischer Lloyd)

Einige der B&R Produkte sind durch den Germanischen Lloyd geprüft und für den Maritime-Bereich zugelassen. Die GL-Zertifikate (Baumusterprüfungen) werden in der Regel bei der Schiffsabnahme anderer Klassifizierungsgesellschaften akzeptiert.

Germanischer Llyod (GL) nach Standard GL 2003 (Kategorie C EMC 1)

Die Kategorie C betrifft Geräte, die vor Wettereinflüssen geschützt sind. EMC 1 beschreibt die Leitungs- und Strahlungsemissionsbegrenzungen für Geräte, die auf der Brücke eines Schiffs installiert sind.

Information:

HDD bzw. CD/DVD Laufwerke dürfen nur für Service Zwecke verwendet werden.

Für den Einsatz im Maritime-Bereich ist der Netzfilter 5AC804.MFLT-00 in der Versorgungsleitung zwingend erforderlich. Informationen dazu sind im Abschnitt "Anschluss an das Endgerät" auf Seite 389 zu finden.

Folgende Tabelle listet auf, ab welcher Revision die Einzelkomponenten eine GL- Zulassung besitzen.

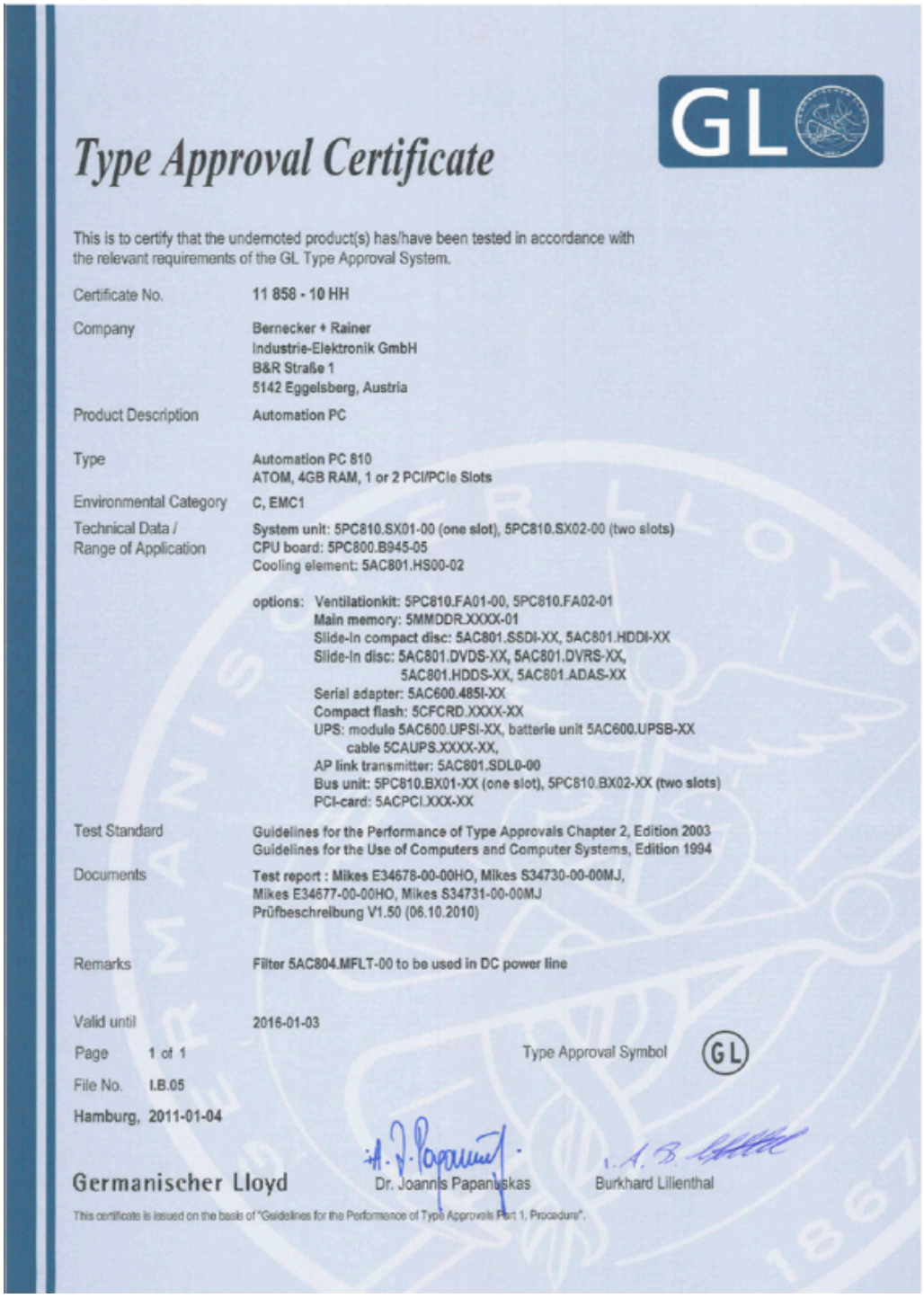
Bestellnummer	Beschreibung	GL ab Rev.
5PC810.SX01-00	APC810 Systemeinheit 1 Slot (PCI Express, PCI, abhängig vom Bus); 1 Slide-in compact Steckplatz; Smart Display Link/ DVI/Monitor, 2x RS232, 5x USB 2.0, 2x ETH 10/100/1000, 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzug- klemme 0TB103.91 gesondert bestellen)	G0
5PC810.SX02-00	APC810 Systemeinheit 2 Slots (PCI Ex- press, PCI, abhängig vom Bus); 1 Slot für Automation Panel Link Transmitter; 1 Slide-in compact und 1 Slide-in Steckplatz; Smart Display Link/ DVI/Monitor, 2x RS232, 5x USB 2.0, 2x ETH 10/100/1000, 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Feder- zugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen)	G0
5PC810.BX01-00	APC810 Bus, 1 PCI	D0
5PC810.BX01-01	APC810 Bus, 1 PCI Express (x4)	D0
5PC810.BX02-00	APC810 Bus, 2 PCI	D0
5PC810.BX02-01	APC810 Bus, 1 PCI, 1 PCI Express (x4)	D0
5PC800.B945-05	Intel Atom N270 CPU Board, 1,6 GHz, Single-Core, 533 MHz FSB, 512 kByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	E0
5MMDDR.0512-01	SO-DIMM DDR2 RAM 512 MByte PC2-5300	D0
5MMDDR.1024-01	SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MByte PC2-5300	D0
5MMDDR.2048-01	SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MByte PC2-5300	D0
5AC801.HS00-02	APC810 Kühlkörper für CPU Board mit Atom Prozessor N270.	D0
5PC810.FA01-00	APC810 Lüfterkit für Systemeinheit 5PC810.SX01-00.	D0
5PC810.FA02-01	APC810 Lüfterkit für Systemeinheit 5PC810.SX02-00 ab Revision D0.	D0
5AC600.485I-00	RS232/422/485 Interface; zum Einbau in einen APC620, APC810 oder PPC700.	D0
5AC600.UPSB-00	Batterieeinheit 5Ah; für APC620, APC810 oder PPC800 USV.	D0
5AC600.UPSI-00	USV Modul für APC620, APC810, PPC800; für Systemeinheiten 5PC600.SX01-00 (ab Rev. H0), 5PC600.SX02-00 (ab Rev. G0), 5PC600.SX02-01 (ab Rev. H0), 5PC600.SX05-00 (ab Rev. F0), 5PC600.SX05-01 (ab Rev. F0), 5PC600.SF03-00 (ab Rev. A0), 5PC810.SX*. 5PC820.1505-00, 5PC820.1906-00. Kabel (5CAUPS.0005-00 bzw. 5CAUPS.0030-00) und Batterieeinheit (5AC600.UPSB-00) sind separat zu bestellen.	E0
5CAUPS.0005-00	USV Kabel 0,5 m; für USV 5AC600.UPSI-00.	D0
5CAUPS.0030-00	USV Kabel 3 m; für USV 5AC600.UPSI-00.	D0
5AC801.ADAS-00	SATA Hard Disk Adapter zum Betrieb einer Slide-in compact Hard Disk in einem Slide-in Slot.	D0
5AC801.DVDS-00	DVD-ROM SATA Laufwerk, Slide-in.	D0
5AC801.DVRS-00	DVD-R/RW DVD+R/RW SATA Laufwerk, Slide-in.	D0
5AC801.HDDI-00	40 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	D0
5AC801.HDDI-02	160 GByte SATA Hard Disk (Slide-in compact); 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.	C0
5AC801.HDDI-03	250 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	D0

Tabelle 263: Revision der Einzelkomponenten mit GL- Zulassung

Bestellnummer	Beschreibung	GL ab Rev.
5AC801.HDDI-04	500 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	C0
5AC801.HDDI-99	APC810 Slide-in compact HDD Kit	D0
5AC801.HDDS-00	40 GByte SATA Hard Disk, Slide-in; 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	D0
5AC801.SSDI-00	32 GByte SATA SSD (SLC), Slide-in compact.	E0
5AC801.SSDI-01	60 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.	C0
5AC801.SSDI-02	180 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.	C0
5AC801.SSDI-03	60 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.	A0
5AC801.SSDI-04	128 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.	A0
5AC801.SSDI-05	256 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.	A0
5AC801.SDL0-00	Smart Display Link/DVI-D Transmitter	D0
5ACPCI.ETH1-01	PCI Ethernet Card 1x 10/100	D0
5ACPCI.ETH3-01	PCI Ethernet Card 3x 10/100	D0
5AC804.MFLT-00	Netzfilter	D0
0TB103.9	Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Schraubklemme 3,31 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch	D0
0TB103.91	Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Federzugklemme 3,31 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch	D0
5CFCRD.0064-03	CompactFlash 64 MByte Western Digital (SLC)	E0
5CFCRD.0128-03	CompactFlash 128 MByte Western Digital (SLC)	E0
5CFCRD.0256-03	CompactFlash 256 MByte Western Digital (SLC)	E0
5CFCRD.0512-03	CompactFlash 512 MByte Western Digital (SLC)	E0
5CFCRD.1024-03	CompactFlash 1 GByte Western Digital (SLC)	E0
5CFCRD.2048-03	CompactFlash 2 GByte Western Digital (SLC)	F0
5CFCRD.4096-03	CompactFlash 4 GByte Western Digital (SLC)	E0
5CFCRD.8192-03	CompactFlash 8 GByte Western Digital (SLC)	E0
5CFCRD.0512-04	CompactFlash 512 MByte B&R (SLC)	D0
5CFCRD.1024-04	CompactFlash 1 GByte B&R (SLC)	D0
5CFCRD.2048-04	CompactFlash 2 GByte B&R (SLC)	D0
5CFCRD.4096-04	CompactFlash 4 GByte B&R (SLC)	D0
5CFCRD.8192-04	CompactFlash 8 GByte B&R (SLC)	D0
5CFCRD.016G-04	CompactFlash 16 GByte B&R (SLC)	E0
5CFCRD.0512-06	CompactFlash 512 MByte B&R (SLC)	D0
5CFCRD.1024-06	CompactFlash 1 GByte B&R (SLC)	D0
5CFCRD.2048-06	CompactFlash 2 GByte B&R (SLC)	D0
5CFCRD.4096-06	CompactFlash 4 GByte B&R (SLC)	D0
5CFCRD.8192-06	CompactFlash 8 GByte B&R (SLC)	D0
5CFCRD.016G-06	CompactFlash 16 GByte B&R (SLC)	D0
5CFCRD.032G-06	CompactFlash 32 GByte B&R (SLC)	C0
5AC900.1000-00	Adapter DVI (Stift) auf CRT (Buchse). Zum Anschluss eines Standard-Monitors an eine DVI-I Schnittstelle.	C0

Tabelle 263: Revision der Einzelkomponenten mit GL- Zulassung

Zertifikat Nr. 11 858 – 10 HH



Type Approval Certificate

This is to certify that the undernoted product(s) has/have been tested in accordance with the relevant requirements of the GL Type Approval System.

Certificate No.	11 858 - 10 HH
Company	Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik GmbH B&R Straße 1 5142 Eggelsberg, Austria
Product Description	Automation PC
Type	Automation PC 810 ATOM, 4GB RAM, 1 or 2 PCI/PCIe Slots
Environmental Category	C, EMC1
Technical Data / Range of Application	System unit: 5PC810.SX01-00 (one slot), 5PC810.SX02-00 (two slots) CPU board: 5PC800.B945-05 Cooling element: 5AC801.HS00-02 options: Ventilationkit: 5PC810.FA01-00, 5PC810.FA02-01 Main memory: 5MMDDR.XXXX-01 Slide-In compact disc: 5AC801.SSDI-XX, 5AC801.HDDI-XX Slide-In disc: 5AC801.DVDS-XX, 5AC801.DVRS-XX, 5AC801.HDDS-XX, 5AC801.ADAS-XX Serial adapter: 5AC600.485I-XX Compact flash: 5CFCRD.XXXX-XX UPS: module 5AC600.UPSI-XX, batterie unit 5AC600.UPSB-XX cable 5CAUPS.XXXX-XX, AP link transmitter: 5AC801.SDL0-00 Bus unit: 5PC810.BX01-XX (one slot), 5PC810.BX02-XX (two slots) PCI-card: 5ACPCI.XXX-XX
Test Standard	Guidelines for the Performance of Type Approvals Chapter 2, Edition 2003 Guidelines for the Use of Computers and Computer Systems, Edition 1994
Documents	Test report : Mikes E34678-00-00HO, Mikes S34730-00-00MJ, Mikes E34677-00-00HO, Mikes S34731-00-00MJ Prüfbeschreibung V1.50 (06.10.2010)
Remarks	Filter 5AC804.MFLT-00 to be used in DC power line
Valid until	2016-01-03

Page 1 of 1

Type Approval Symbol GL

File No. I.B.05

Hamburg, 2011-01-04

Germanischer Lloyd

Dr. Joannis Papanikolas

Burkhard Lilienthal

This certificate is issued on the basis of "Guidelines for the Performance of Type Approvals Part 1, Procedure".

Abbildung 180: GL Zertifikat Nr. 11 858 – 10 HH

Kapitel 6 • Zubehör

Nachfolgendes Zubehör ist von B&R in Zusammenhang mit dem verwendeten Gerät funktionsgeprüft und kann mit diesem betrieben werden. Hierbei ist jedoch auf mögliche Einschränkungen hinsichtlich des Betriebs mit anderen Einzelkomponenten als Gesamtgerät zu achten. Für den Betrieb des Gesamtgerätes gilt, dass sämtliche Einzelspezifikationen der Komponenten einzuhalten sind.

Alle Komponenten, die in diesem Handbuch aufgeführt sind, wurden intensiven System- und Kompatibilitätstests unterzogen und sind entsprechend freigegeben. Für nicht freigegegebenes Zubehör kann B&R keine Funktionsgarantie übernehmen.

1 Ersatz CMOS Batterien

1.1 0AC201.91 / 4A0006.00-000

1.1.1 Allgemeines

Die Lithiumbatterie wird zur Pufferung der BIOS CMOS Daten und der Echtzeituhr (RTC) benötigt.

Die Batterie stellt ein Verschleißteil dar und muss bei nicht ausreichender Batteriekapazität, Status „Bad“, ausgetauscht werden.

1.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Batterien	
0AC201.91	Lithium Batterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle Hereby we declare that the Lithium cells contained in this shipmentqualify as „partly regulated“. Handle with care. If the package is damaged, inspect cells, repack intact cells and protect cells against short circuits. For emergencyinformation, call RENATA SA at + 41 61 319 28 27	
4A0006.00-000	Lithiumbatterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle	

Tabelle 264: 0AC201.91, 4A0006.00-000 - Bestelldaten

1.1.3 Technische Daten

Warnung!

Die Batterie darf nur durch eine Renata Batterie vom Typ CR2477N ersetzt werden. Die Verwendung einer anderen Batterie kann eine Feuer- oder Explosionsgefahr darstellen.

Die Batterie kann bei falscher Handhabung explodieren. Batterie nicht aufladen, zerlegen oder in einem Feuer entsorgen.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	0AC201.91	4A0006.00-000
Allgemeines		
Lagerzeit	max. 3 Jahre bei 30°C	
Zertifizierungen		
CE	Ja	
cULus	Ja	
Elektrische Eigenschaften		
Kapazität	950 mAh	

Tabelle 265: 0AC201.91, 4A0006.00-000 - Technische Daten

Produktbezeichnung	0AC201.91	4A0006.00-000
Selbstentladung	<1% pro Jahr (bei 23°C)	
Spannungsbereich	3V	
Umgebungsbedingungen		
Temperatur		
Lagerung	-20 bis 60°C	
Luftfeuchtigkeit		
Betrieb	0 bis 95%	
Lagerung	0 bis 95%	
Transport	0 bis 95%	

Tabelle 265: 0AC201.91, 4A0006.00-000 - Technische Daten

2 Spannungsversorgungsstecker

2.1 0TB103.9x

2.1.1 Allgemeines

Die einreihige 3-polige Feldklemme 0TB103 wird zur Spannungsversorgung verwendet.

2.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Feldklemmen	
0TB103.9	Stecker 24 VDC - 3-polig female - Schraubklemme 3,31 mm²	
0TB103.91	Stecker 24 VDC - 3-polig female - Federzugklemme 3,31 mm²	

Tabelle 266: 0TB103.9, 0TB103.91 - Bestelldaten

2.1.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	0TB103.9	0TB103.91
Allgemeines		
Zertifizierungen		
CE	Ja	
cULus	Ja	
cULus HazLoc Class 1 Division 2	Ja [1]	
GL	Ja [2]	
Feldklemme		
Anmerkung	Vibrationsschutz durch Schraubflansch Nenndaten nach UL	
Anzahl der Pole	3 (female)	
Art der Klemmung	Ausführung als Schraubklemme	Ausführung als Federzugklemme [3]
Kabelart	Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!)	
Kontaktabstand	5,08 mm	
Anschlussquerschnitt		
AWG-Leiter	AWG 26 bis 14	AWG 26 bis 12
Aderendhülse mit Kunststoffkragen	0,20 bis 1,50 mm²	
eindrähtig	0,20 bis 2,50 mm²	
feindrähtig	0,20 bis 1,50 mm²	0,20 bis 2,50 mm²
mit Aderendhülse	0,20 bis 1,50 mm²	
Anzugsmoment	0,4 Nm	-
Elektrische Eigenschaften		
Nennspannung	300 V	
Nennstrom [4]	10 A / Kontakt	
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ	

Tabelle 267: 0TB103.9, 0TB103.91 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben und das Gesamtgerät die entsprechende Kennzeichnung trägt.
2) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
3) Die Feldklemme in Federzugausführung ist nicht anreihbar.
4) Die jeweiligen Grenzdaten der I/O Module sind zu berücksichtigen!

3 Ersatz Lüfterfilter

3.1 Allgemeines

Information:

Die Lüfterfilter stellen ein Verschleißteil dar und müssen in einem angemessenen Zeitabstand kontrolliert werden, ob noch genügend Luftdurchlass für die Kühlung gewährleistet ist. Ein Austausch bzw. die Reinigung des Luftfilters ist dann sinngemäß.

3.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Zubehör	
5AC801.FA01-00	APC810 Ersatz Lüfterfilter für 5PC810.SX01-00; 5 Stk.	
5AC801.FA02-00	APC810 Ersatz Lüfterfilter für 5PC810.SX02-00; 5 Stk.	
5AC801.FA03-00	APC810 Ersatz Lüfterfilter für 5PC810.SX03-00; 5 Stk.	
5AC801.FA05-00	APC810 Ersatz Lüfterfilter für 5PC810.SX05-00; 5 Stk.	

Tabelle 268: 5AC801.FA01-00, 5AC801.FA02-00, 5AC801.FA03-00, 5AC801.FA05-00 - Bestelldaten

4 DVI - Monitor Adapter

4.1 5AC900.1000-00

4.2 Allgemeines

Mit diesem Adapter ist es möglich, an der DVI-I Schnittstelle einen Standard-Monitor anzuschließen.

4.3 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Sonstiges	
5AC900.1000-00	Adapter DVI (Stift) auf CRT (Buchse). Zum Anschluss eines Standard-Monitors an eine DVI-I Schnittstelle.	

Tabelle 269: 5AC900.1000-00 - Bestelldaten

5 CompactFlash-Karten

5.1 Allgemeines

CompactFlash-Karten sind leicht zu tauschende Speichermedien. Auf Grund der Robustheit gegenüber Umwelt- (Temperatur) und Umgebungseinflüssen (Schock, Vibration, etc...) bieten CompactFlash-Karten optimale Werte für den Einsatz als Speichermedium in Industrieumgebung.

5.2 Grundlagen

CompactFlash-Karten, welche für den Einsatz in der Industrieautomation geeignet sind, müssen eine besonders hohe Zuverlässigkeit haben. Um diese erreichen zu können sind folgende Punkte sehr wichtig:

- Verwendete Flashtechnologie
- Effizienter Algorithmus zur Maximierung der Lebenszeit
- Gute Mechanismen zur Erkennung und Behebung von Fehlern des Flash-Speichers

5.2.1 Flashtechnologie

Aktuell sind CompactFlash-Karten mit MLC- (Multi-Level Cell) und SLC- (Single-Level Cell) Flashbausteinen erhältlich.
SLC-Flashes haben eine um Faktor 10 höhere garantierte Lebenszeit als MLC-Flashes, wodurch für den industriellen Einsatz nur CompactFlash-Karten mit SLC-Flashbausteinen zum Einsatz kommen.

5.2.2 Wear Leveling

Unter Wear Leveling versteht man einen Algorithmus, welcher zur Maximierung der Lebenszeit einer CompactFlash eingesetzt werden kann. Zwischen folgenden Algorithmen wird unterschieden:

- Kein Wear Leveling
- Dynamic Wear Leveling
- Static Wear Leveling

Der grundlegende Gedanke von Wear Leveling ist, dass Daten über einen breiten Bereich an Blöcken bzw. Zellen auf dem Datenträger verteilt werden, damit nicht immer die gleichen Bereiche gelöscht und neu programmiert werden müssen.

5.2.2.1 Kein Wear Leveling

Erste CompactFlash-Karten hatten keinen Algorithmus implementiert welcher zur Maximierung der Lebenszeit beitrug. Die Lebenszeit der CompactFlash war hier einzig und allein durch die garantierte Lebenszeit der Flashblöcke definiert.

5.2.2.2 Dynamic Wear Leveling

Dynamisches Wear Leveling bietet die Möglichkeit beim Schreiben auf ein File, noch nicht benutzte Flashblöcke für die Verteilung zu verwenden.
Wenn der Datenträger schon zu 80% mit Files voll ist, können nur 20% für das Wear Leveling verwendet werden. Die Lebensdauer der CompactFlash hängt hier also ursächlich von nicht benutzten Flashblöcken ab.

5.2.2.3 Static Wear Leveling

Statisches Wear Leveling überwacht zusätzlich, welche Daten nur selten verändert werden. Diese werden dann vom Controller von Zeit zu Zeit in Blöcke verschoben, welche schon häufig programmiert wurden um eine weitere Abnutzung der Zellen zu vermeiden.

5.2.3 Fehlerkorrektur ECC

Bei Inaktivität oder Betrieb einer bestimmten Zelle können Bitfehler entstehen. Durch ein per Hard- oder Software implementiertes Error Correction Coding (ECC) lassen sich viele derartige Fehler erkennen und korrigieren.

5.2.4 S.M.A.R.T. -Support

Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology (kurz S.M.A.R.T., System zur Selbstüberwachung, Analyse und Statusmeldung) ist ein Industriestandard für Massenspeicher der eingeführt wurde, um wichtige Parameter zu überwachen und drohende Ausfälle frühzeitig zu erkennen. Durch die Überwachung und Speicherung von kritischen Leistungs- und Kalibrierdaten wird versucht, die Wahrscheinlichkeit von Fehlerzuständen vorherzusagen.

5.2.5 Maximale Zuverlässigkeit

CompactFlash-Karten welche von B&R eingesetzt werden, erzielen durch Verwendung von SLC-Flashes in Verbindung mit statischem Wear Leveling gemeinsam mit einem performanten ECC-Algorithmus einen Maximalwert an Zuverlässigkeit.

5.3 5CFCRD.xxxx-06

5.3.1 Allgemeines

Information:

Der gleichzeitige Betrieb von B&R CompactFlash-Karten 5CFCRD.xxxx-06 und CompactFlash-Karten anderer Hersteller in einem System ist nicht erlaubt. Aufgrund von Technologieunterschieden (ältere, neuere Technologien) kann es beim Systemstart zu Problemen kommen, was auf die unterschiedlichen Hochlaufzeiten zurückzuführen ist.

siehe "Bekannte Probleme / Eigenheiten" auf Seite 364

Information:

Die CompactFlash-Karten 5CFCRD.xxxx-06 werden auf B&R Geräten unter WinCE ab der Version ≥ 6.0 unterstützt.

5.3.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	CompactFlash-Karten	
5CFCRD.0512-06	CompactFlash 512 MByte B&R (SLC) ≥ Rev. F0	
5CFCRD.1024-06	CompactFlash 1 GByte B&R (SLC) ≥ Rev. F0	
5CFCRD.2048-06	CompactFlash 2 GByte B&R (SLC) ≥ Rev. F0	
5CFCRD.4096-06	CompactFlash 4 GByte B&R (SLC) ≥ Rev. F0	
5CFCRD.8192-06	CompactFlash 8 GByte B&R (SLC) ≥ Rev. F0	
5CFCRD.016G-06	CompactFlash 16 GByte B&R (SLC) ≥ Rev. E0	
5CFCRD.032G-06	CompactFlash 32 GByte B&R (SLC) ≥ Rev. D0	

Tabelle 270: 5CFCRD.0512-06, 5CFCRD.1024-06, 5CFCRD.2048-06, 5CFCRD.4096-06, 5CFCRD.8192-06, 5CFCRD.016G-06, 5CFCRD.032G-06 - Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	CompactFlash-Karten	
5CFCRD.0512-06	CompactFlash 512 MByte B&R (SLC) ≤ Rev. E0	
5CFCRD.1024-06	CompactFlash 1 GByte B&R (SLC) ≤ Rev. E0	
5CFCRD.2048-06	CompactFlash 2 GByte B&R (SLC) ≤ Rev. E0	
5CFCRD.4096-06	CompactFlash 4 GByte B&R (SLC) ≤ Rev. E0	
5CFCRD.8192-06	CompactFlash 8 GByte B&R (SLC) ≤ Rev. E0	
5CFCRD.016G-06	CompactFlash 16 GByte B&R (SLC) ≤ Rev. D0	
5CFCRD.032G-06	CompactFlash 32 GByte B&R (SLC) ≤ Rev. C0	

Tabelle 271: 5CFCRD.0512-06, 5CFCRD.1024-06, 5CFCRD.2048-06, 5CFCRD.4096-06, 5CFCRD.8192-06, 5CFCRD.016G-06, 5CFCRD.032G-06 - Bestelldaten

5.3.3 Technische Daten

Vorsicht!

Ein plötzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust führen! In sehr seltenen Fällen kann es darüber hinaus zu einer Beschädigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschädigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwendung einer USV empfohlen.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5CFCRD.0512-06 ≥ Rev. F0	5CFCRD.1024-06 ≥ Rev. F0	5CFCRD.2048-06 ≥ Rev. F0	5CFCRD.4096-06 ≥ Rev. F0	5CFCRD.8192-06 ≥ Rev. F0	5CFCRD.016G-06 ≥ Rev. E0	5CFCRD.032G-06 ≥ Rev. D0
Allgemeines							
Kapazität	512 MByte	1 GByte	2 GByte	4 GByte	8 GByte	16 GByte	32 GByte
Datenerhaltung	10 Jahre						
Datenverlässlichkeit	< 1 nichtbehebbarer Fehler in 10^{14} Bit Lesezugriffen						
Lifetime Monitoring	Ja						
MTBF	> 3.000.000 Stunden (bei 25°C)						
Wartung	keine						
unterstützte Betriebsmodi	PIO Mode 0-6, Multiword DMA Mode 0-4, Ultra DMA Mode 0-4						
kontinuierliches Lesen							
typisch	50 MByte/s	50 MByte/s	59 MByte/s	59 MByte/s	59 MByte/s	59 MByte/s	58 MByte/s
maximal	53 MByte/s	53 MByte/s	65 MByte/s	65 MByte/s	65 MByte/s	65 MByte/s	65 MByte/s
kontinuierliches Schreiben							
typisch	25 MByte/s	25 MByte/s	31 MByte/s	31 MByte/s	31 MByte/s	31 MByte/s	31 MByte/s
maximal	27 MByte/s	27 MByte/s	35 MByte/s	35 MByte/s	35 MByte/s	35 MByte/s	35 MByte/s
Zertifizierungen							
CE	Ja						
cULus	Ja						
cULus HazLoc Class 1 Division 2	-	-	-	-	-	Ja [1]	-
ATEX Zone 22	-	-	-	-	-	Ja [1]	-
GOST-R	Ja						
GL	Ja [2]						
Endurance							
SLC-Flash	Ja						
garantierte Datenmenge							
garantiert [3]	50 TByte	100 TByte	200 TByte	400 TByte	800 TByte	1600 TByte	3200 TByte
ergibt bei 5 Jahren [3]	27,40 GByte/Tag	54,79 GByte/Tag	109,59 GByte/Tag	219,18 GByte/Tag	438,36 GByte/Tag	876,72 GByte/Tag	1753,44 GByte/Tag
Lösch- / Schreibzyklen							
garantiert	100.000						
Wear Leveling	statisch						
Error Correction Coding (ECC)	Ja						
S.M.A.R.T. Support	Ja						
Unterstützung							
Hardware	PP300/400, PP500, PPC300, PPC700, PPC725, PPC800, APC620, APC810, APC820						
Betriebssysteme							
Windows 7 32-Bit	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
Windows 7 64-Bit	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
Windows Embedded Standard 7 32-Bit	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
Windows Embedded Standard 7 64-Bit	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
Windows XP Professional	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
Windows XP Embedded	Ja						
Windows Embedded Standard 2009	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Windows CE 6.0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja [4]	Ja [4]
Windows CE 5.0	Nein						
Software							
PVI Transfer Tool	≥ V3.2.3.8 (Teil von PVI Development Setup ≥ V2.06.00.3011)	≥ V3.2.3.8 (Teil von PVI Development Setup ≥ V2.06.00.3011)	≥ V3.2.3.8 (Teil von PVI Development Setup ≥ V2.06.00.3011)	≥ V3.2.3.8 (Teil von PVI Development Setup ≥ V2.06.00.3011)	≥ V3.2.3.8 (Teil von PVI Development Setup ≥ V2.06.00.3011)	≥ V3.6.8.40 (Teil von PVI Development Setup ≥ V3.0.0.3020)	≥ V4.0.0.8 (Teil von PVI Development Setup ≥ V3.0.2.3014)
B&R Embedded OS Installer	≥ V3.10	≥ V3.10	≥ V3.10	≥ V3.10	≥ V3.10	≥ V3.20	≥ V3.21

Tabelle 272: 5CFCRD.0512-06, 5CFCRD.1024-06, 5CFCRD.2048-06, 5CFCRD.4096-06, 5CFCRD.8192-06, 5CFCRD.016G-06, 5CFCRD.032G-06 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5CFCRD. 0512-06 ≥ Rev. F0	5CFCRD. 1024-06 ≥ Rev. F0	5CFCRD. 2048-06 ≥ Rev. F0	5CFCRD. 4096-06 ≥ Rev. F0	5CFCRD. 8192-06 ≥ Rev. F0	5CFCRD. 016G-06 ≥ Rev. E0	5CFCRD. 032G-06 ≥ Rev. D0
Umgebungsbedingungen							
Temperatur							
Betrieb	0 bis 70°C						
Lagerung	-50 bis 100°C						
Transport	-50 bis 100°C						
Luftfeuchtigkeit							
Betrieb	max. 85% bei 85°C						
Lagerung	max. 85% bei 85°C						
Transport	max. 85% bei 85°C						
Vibration							
Betrieb	20 g peak, 20 bis 2000 Hz, 4 pro Richtung (JEDEC JESD22, Methode B103) 5,35 g RMS, 15 min pro Ebene (IEC 68-2-6)						
Lagerung	20 g peak, 20 bis 2000 Hz, 4 pro Richtung (JEDEC JESD22, Methode B103) 5,35 g RMS, 15 min pro Ebene (IEC 68-2-6)						
Transport	20 g peak, 20 bis 2000 Hz, 4 pro Richtung (JEDEC JESD22, Methode B103) 5,35 g RMS, 15 min pro Ebene (IEC 68-2-6)						
Schock							
Betrieb	1500 g peak, 0,5 ms 5 mal (JEDEC JESD22, Methode B110) 30 g, 11 ms 1 mal (IEC 68-2-27)						
Lagerung	1500 g peak, 0,5 ms 5 mal (JEDEC JESD22, Methode B110) 30 g, 11 ms 1 mal (IEC 68-2-27)						
Transport	1500 g peak, 0,5 ms 5 mal (JEDEC JESD22, Methode B110) 30 g, 11 ms 1 mal (IEC 68-2-27)						
Meereshöhe							
Betrieb	max. 4.572 m						
Mechanische Eigenschaften							
Abmessungen							
Breite	42,8 ±0,10 mm						
Länge	36,4 ±0,15 mm						
Höhe	3,3 ±0,10 mm						
Gewicht	10 g						

Tabelle 272: 5CFCRD.0512-06, 5CFCRD.1024-06, 5CFCRD.2048-06, 5CFCRD.4096-06, 5CFCRD.8192-06, 5CFCRD.016G-06, 5CFCRD.032G-06 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben und das Gesamtgerät die entsprechende Kennzeichnung trägt.
2) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
3) Endurance bei B&R CFs (Bei linear geschriebener Blockgröße mit ≥ 128 kB)
4) Wird vom B&R Embedded OS Installer nicht unterstützt.

Vorsicht!

Ein plötzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust führen! In sehr seltenen Fällen kann es darüber hinaus zu einer Beschädigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschädigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwendung einer USV empfohlen.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5CFCRD. 0512-06 ≤ Rev. E0	5CFCRD. 1024-06 ≤ Rev. E0	5CFCRD. 2048-06 ≤ Rev. E0	5CFCRD. 4096-06 ≤ Rev. E0	5CFCRD. 8192-06 ≤ Rev. E0	5CFCRD. 016G-06 ≤ Rev. D0	5CFCRD. 032G-06 ≤ Rev. C0
Allgemeines							
Kapazität	512 MByte	1 GByte	2 GByte	4 GByte	8 GByte	16 GByte	32 GByte
Datenerhaltung	10 Jahre						
Datenverlässlichkeit	< 1 nichtbehebbarer Fehler in 10^{14} Bit Lesezugriffen						
Lifetime Monitoring	Ja						
MTBF	> 3.000.000 Stunden (bei 25°C)						
Wartung	keine						
unterstützte Betriebsmodi	PIO Mode 0-6, Multiword DMA Mode 0-4, Ultra DMA Mode 0-4						
kontinuierliches Lesen							
typisch	33 MByte/s	33 MByte/s	33 MByte/s	33 MByte/s	33 MByte/s	36 MByte/s	36 MByte/s
maximal	35 MByte/s	35 MByte/s	35 MByte/s	34 MByte/s	34 MByte/s	37 MByte/s	37 MByte/s
kontinuierliches Schreiben							
typisch	15 MByte/s	15 MByte/s	15 MByte/s	14 MByte/s	14 MByte/s	28 MByte/s	28 MByte/s
maximal	18 MByte/s	18 MByte/s	18 MByte/s	17 MByte/s	17 MByte/s	30 MByte/s	30 MByte/s

Tabelle 273: 5CFCRD.0512-06, 5CFCRD.1024-06, 5CFCRD.2048-06, 5CFCRD.4096-06, 5CFCRD.8192-06, 5CFCRD.016G-06, 5CFCRD.032G-06 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5CFCRD.0512-06 ≤ Rev. E0	5CFCRD.1024-06 ≤ Rev. E0	5CFCRD.2048-06 ≤ Rev. E0	5CFCRD.4096-06 ≤ Rev. E0	5CFCRD.8192-06 ≤ Rev. E0	5CFCRD.016G-06 ≤ Rev. D0	5CFCRD.032G-06 ≤ Rev. C0
Zertifizierungen							
CE				Ja			
cULus				Ja			
cULus HazLoc Class 1 Division 2	-	-	-	-	-	Ja [1]	-
ATEX Zone 22	-	-	-	-	-	Ja [1]	-
GOST-R				Ja			
GL				Ja [2]			
Endurance							
SLC-Flash				Ja			
garantierte Datenmenge							
garantiert [3]	50 TByte	100 TByte	200 TByte	400 TByte	800 TByte	1600 TByte	3200 TByte
ergibt bei 5 Jahren [3]	27,40 GByte/Tag	54,79 GByte/Tag	109,59 GByte/Tag	219,18 GByte/Tag	438,36 GByte/Tag	876,72 GByte/Tag	1753,44 GByte/Tag
Lösch- / Schreibzyklen							
garantiert				100.000			
Wear Leveling				statisch			
Error Correction Coding (ECC)				Ja			
S.M.A.R.T. Support				Ja			
Unterstützung							
Hardware				PP300/400, PP500, PPC300, PPC700, PPC725, PPC800, APC620, APC810, APC820			
Betriebssysteme							
Windows 7 32-Bit	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
Windows 7 64-Bit	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
Windows Embedded Standard 7 32-Bit	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
Windows Embedded Standard 7 64-Bit	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
Windows XP Professional	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
Windows XP Embedded				Ja			
Windows Embedded Standard 2009	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Windows CE 6.0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja [4]	Ja [4]
Windows CE 5.0				Nein			
Software							
PVI Transfer Tool	≥ V3.2.3.8 (Teil von PVI Development Setup ≥ V2.06.00.3011)	≥ V3.2.3.8 (Teil von PVI Development Setup ≥ V2.06.00.3011)	≥ V3.2.3.8 (Teil von PVI Development Setup ≥ V2.06.00.3011)	≥ V3.2.3.8 (Teil von PVI Development Setup ≥ V2.06.00.3011)	≥ V3.2.3.8 (Teil von PVI Development Setup ≥ V2.06.00.3011)	≥ V3.6.8.40 (Teil von PVI Development Setup ≥ V3.0.0.3020)	≥ V4.0.0.8 (Teil von PVI Development Setup ≥ V3.0.2.3014)
B&R Embedded OS Installer	≥ V3.10	≥ V3.10	≥ V3.10	≥ V3.10	≥ V3.10	≥ V3.20	≥ V3.21
Umgebungsbedingungen							
Temperatur							
Betrieb				0 bis 70°C			
Lagerung				-50 bis 100°C			
Transport				-50 bis 100°C			
Luftfeuchtigkeit							
Betrieb				max. 85% bei 85°C			
Lagerung				max. 85% bei 85°C			
Transport				max. 85% bei 85°C			
Vibration							
Betrieb				20 g peak, 20 bis 2000 Hz, 4 pro Richtung (JEDEC JESD22, Methode B103) 5,35 g RMS, 15 min pro Ebene (IEC 68-2-6)			
Lagerung				20 g peak, 20 bis 2000 Hz, 4 pro Richtung (JEDEC JESD22, Methode B103) 5,35 g RMS, 15 min pro Ebene (IEC 68-2-6)			
Transport				20 g peak, 20 bis 2000 Hz, 4 pro Richtung (JEDEC JESD22, Methode B103) 5,35 g RMS, 15 min pro Ebene (IEC 68-2-6)			
Schock							
Betrieb				1500 g peak, 0,5 ms 5 mal (JEDEC JESD22, Methode B110) 30 g, 11 ms 1 mal (IEC 68-2-27)			
Lagerung				1500 g peak, 0,5 ms 5 mal (JEDEC JESD22, Methode B110) 30 g, 11 ms 1 mal (IEC 68-2-27)			
Transport				1500 g peak, 0,5 ms 5 mal (JEDEC JESD22, Methode B110) 30 g, 11 ms 1 mal (IEC 68-2-27)			
Meereshöhe							
Betrieb				max. 4.572 m			

Tabelle 273: 5CFCRD.0512-06, 5CFCRD.1024-06, 5CFCRD.2048-06, 5CFCRD.4096-06, 5CFCRD.8192-06, 5CFCRD.016G-06, 5CFCRD.032G-06 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5CFCRD. 0512-06 ≤ Rev. E0	5CFCRD. 1024-06 ≤ Rev. E0	5CFCRD. 2048-06 ≤ Rev. E0	5CFCRD. 4096-06 ≤ Rev. E0	5CFCRD. 8192-06 ≤ Rev. E0	5CFCRD. 016G-06 ≤ Rev. D0	5CFCRD. 032G-06 ≤ Rev. C0
Mechanische Eigenschaften							
Abmessungen							
Breite	42,8 ±0,10 mm						
Länge	36,4 ±0,15 mm						
Höhe	3,3 ±0,10 mm						
Gewicht	10 g						

Tabelle 273: 5CFCRD.0512-06, 5CFCRD.1024-06, 5CFCRD.2048-06, 5CFCRD.4096-06, 5CFCRD.8192-06, 5CFCRD.016G-06, 5CFCRD.032G-06 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben und das Gesamtgerät die entsprechende Kennzeichnung trägt.
2) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
3) Endurance bei B&R CFs (Bei linear geschriebener Blockgröße mit ≥ 128 kB)
4) Wird vom B&R Embedded OS Installer nicht unterstützt.

5.3.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm

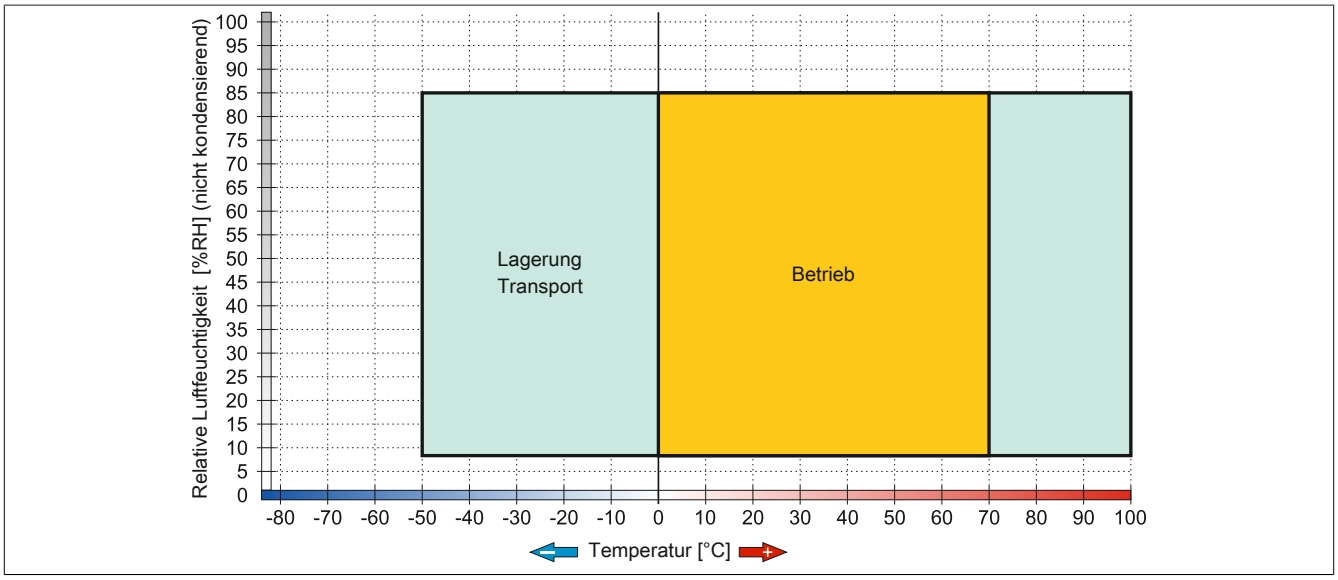


Abbildung 181: 5CFCRD.xxxx-06 - Temperatur Luftfeuchtediagramm CompactFlash-Karten

5.3.5 Abmessungen

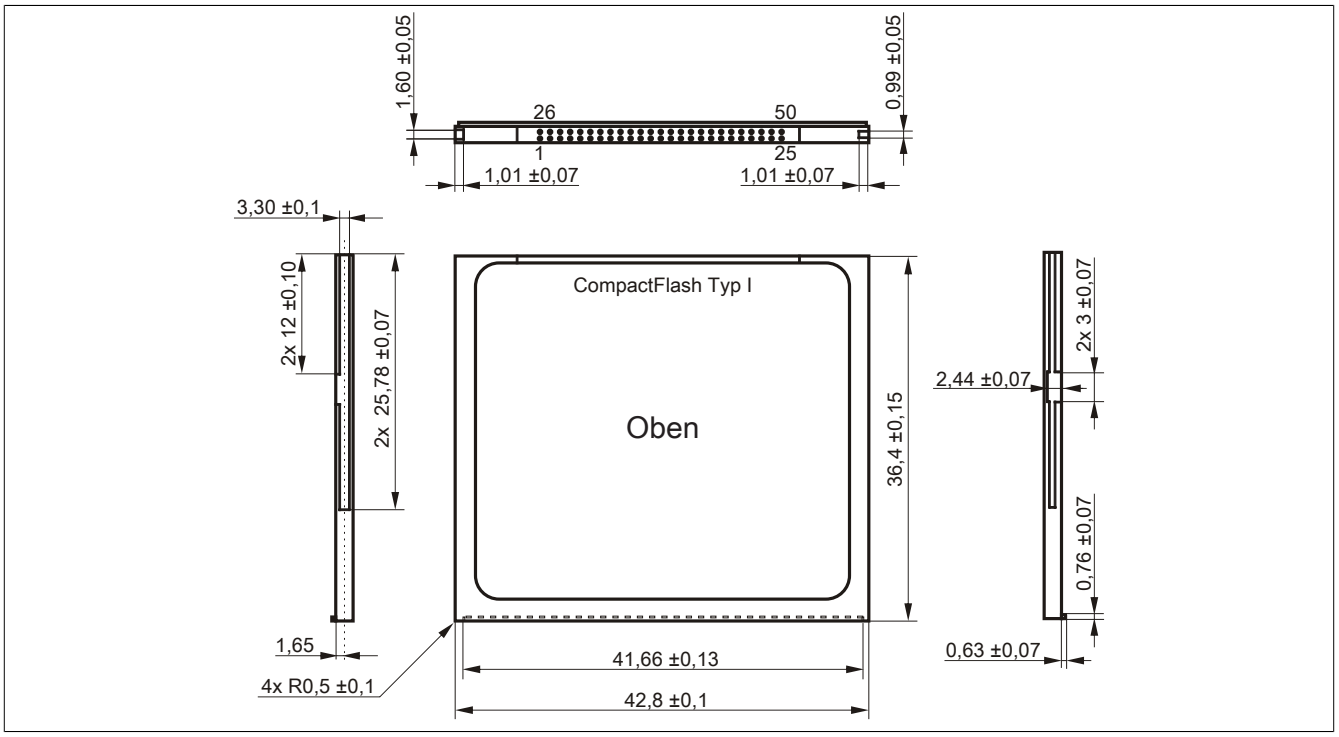


Abbildung 182: Abmessungen CompactFlash-Karte Typ I

5.3.6 Benchmark

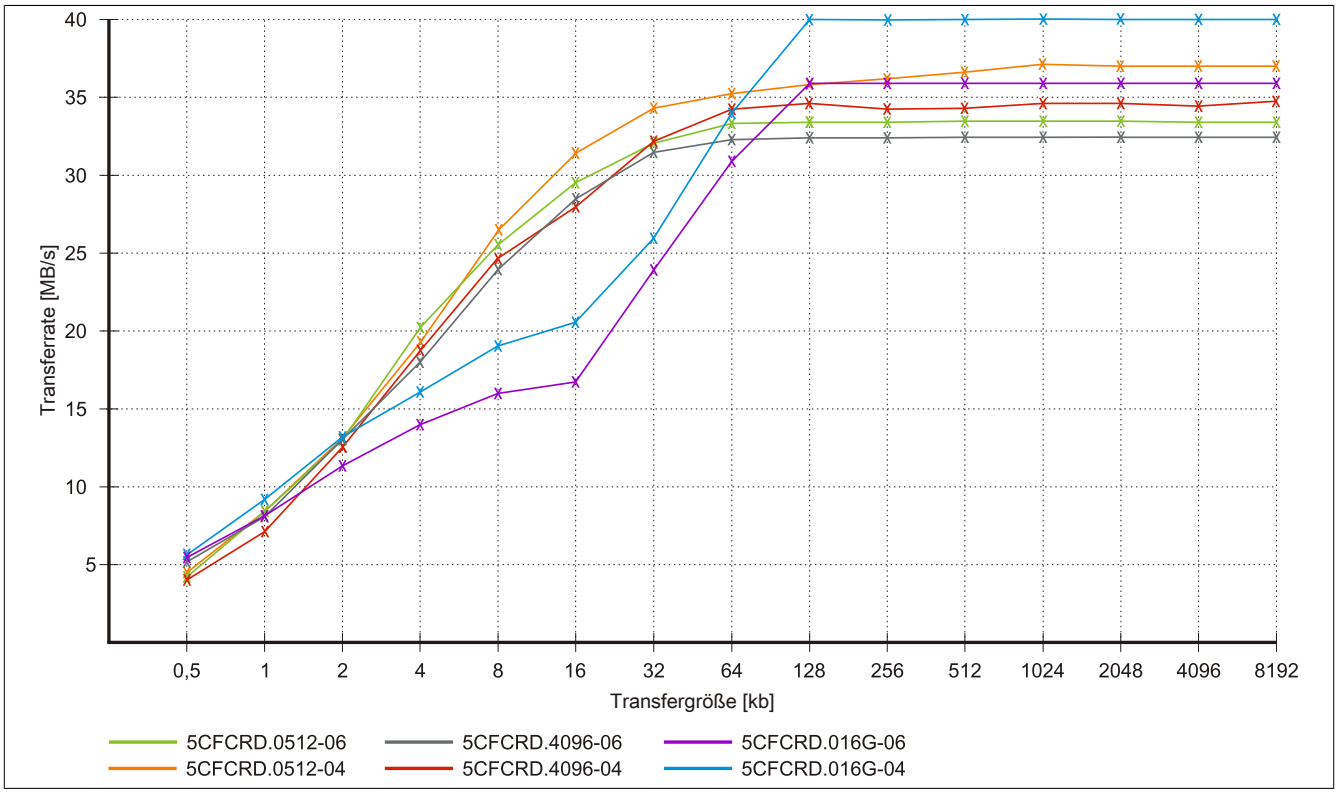


Abbildung 183: ATTO Disk Benchmark v2.34 Vergleich Lesen - 5CFCRD.xxxx-04 mit 5CFCRD.xxxx-06

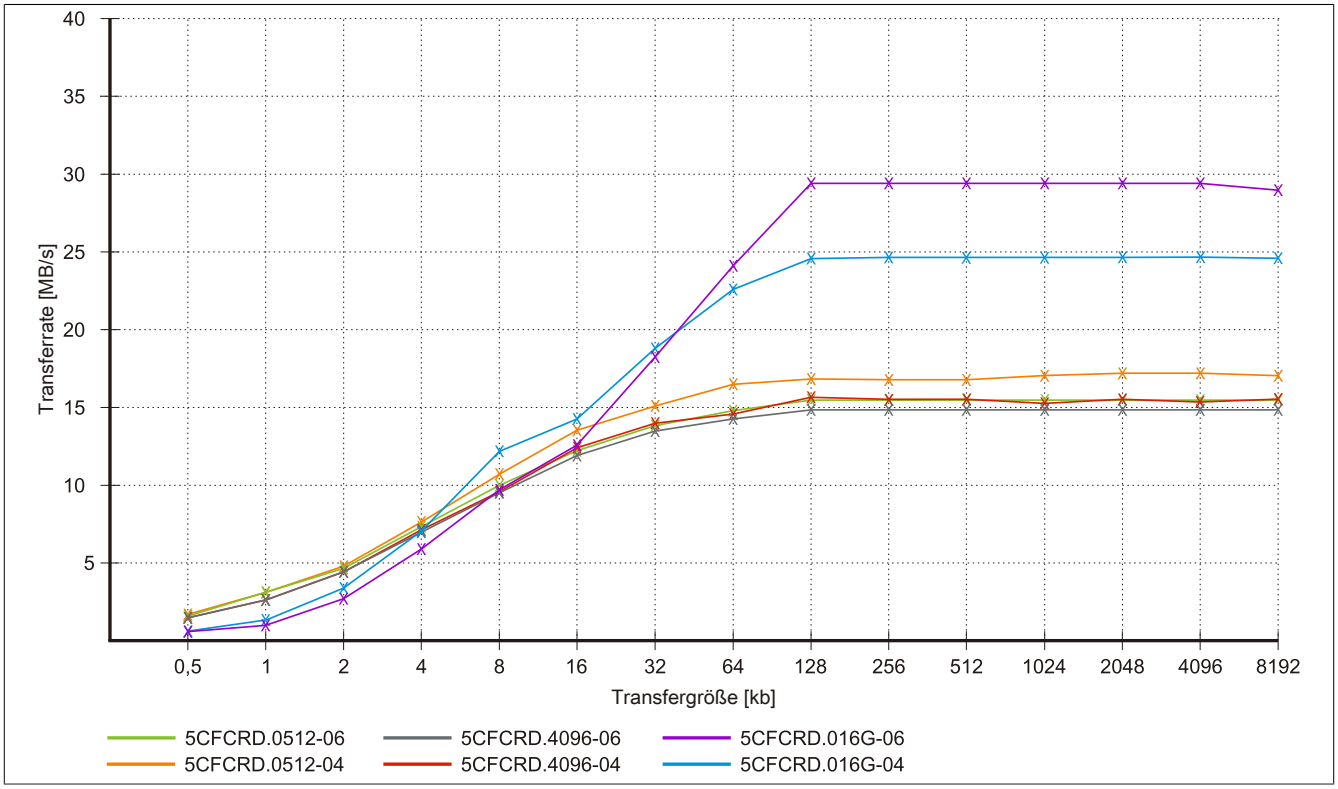


Abbildung 184: ATTO Disk Benchmark v2.34 Vergleich Schreiben - 5CFCRD.xxxx-04 mit 5CFCRD.xxxx-06

5.4 5CFCRD.xxxx-04

5.4.1 Allgemeines

Information:

Der gleichzeitige Betrieb von B&R CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx-04 und CompactFlash Karten anderer Hersteller in einem System ist nicht erlaubt. Aufgrund von Technologieunterschieden (ältere, neuere Technologien) kann es beim Systemstart zu Problemen kommen, was auf die unterschiedlichen Hochlaufzeiten zurückzuführen ist.

siehe "Bekannte Probleme / Eigenheiten" auf Seite 364

Information:

Die CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx-04 werden auf B&R Geräten unter WinCE ab der Version ≥ 6.0 unterstützt.

5.4.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	CompactFlash-Karten	
5CFCRD.0512-04	CompactFlash 512 MByte B&R (SLC)	
5CFCRD.1024-04	CompactFlash 1 GByte B&R (SLC)	
5CFCRD.2048-04	CompactFlash 2 GByte B&R (SLC)	
5CFCRD.4096-04	CompactFlash 4 GByte B&R (SLC)	
5CFCRD.8192-04	CompactFlash 8 GByte B&R (SLC)	
5CFCRD.016G-04	CompactFlash 16 GByte B&R (SLC)	

Tabelle 274: 5CFCRD.0512-04, 5CFCRD.1024-04, 5CFCRD.2048-04, 5CFCRD.4096-04, 5CFCRD.8192-04, 5CFCRD.016G-04 - Bestelldaten

5.4.3 Technische Daten

Vorsicht!

Ein plötzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust führen! In sehr seltenen Fällen kann es darüber hinaus zu einer Beschädigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschädigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwendung einer USV empfohlen.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5CFCRD.0512-04	5CFCRD.1024-04	5CFCRD.2048-04	5CFCRD.4096-04	5CFCRD.8192-04	5CFCRD.016G-04
Allgemeines						
Kapazität	512 MByte	1 GByte	2 GByte	4 GByte	8 GByte	16 GByte
Datenerhaltung	10 Jahre					
Datenverlässlichkeit	< 1 nichtbehebbarer Fehler in 10^{14} Bit Lesezugriffen					
Lifetime Monitoring	Ja					
MTBF	> 3.000.000 Stunden (bei 25°C)					
Wartung	keine					
unterstützte Betriebsmodi	PIO Mode 0-6, Multiword DMA Mode 0-4, Ultra DMA Mode 0-4					

Tabelle 275: 5CFCRD.0512-04, 5CFCRD.1024-04, 5CFCRD.2048-04, 5CFCRD.4096-04, 5CFCRD.8192-04, 5CFCRD.016G-04 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5CFCRD.0512-04	5CFCRD.1024-04	5CFCRD.2048-04	5CFCRD.4096-04	5CFCRD.8192-04	5CFCRD.016G-04
kontinuierliches Lesen						
typisch	35 MByte/s (240X) [1]	35 MByte/s (240X) [1]	35 MByte/s (240X) [1]	33 MByte/s (220X) [1]	27 MByte/s (180X) [1]	36 MByte/s (240X) [1]
maximal	37 MByte/s (260X) [1]	37 MByte/s (260X) [1]	37 MByte/s (260X) [1]	34 MByte/s (226X) [1]	28 MByte/s (186X) [1]	37 MByte/s (247X) [1]
kontinuierliches Schreiben						
typisch	17 MByte/s (110X)	17 MByte/s (110X)	17 MByte/s (110X)	16 MByte/s (106X)	15 MByte/s (100X)	18 MByte/s (120X)
maximal	20 MByte/s (133X)	20 MByte/s (133X)	20 MByte/s (133X)	18 MByte/s (120X)	17 MByte/s (110X)	19 MByte/s (126X)
Zertifizierungen						
CE	Ja					
cULus	Ja					
GOST-R	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
GL	Ja [2]					
Endurance						
SLC-Flash	Ja					
garantierte Datenmenge						
garantiert [3]	50 TByte	100 TByte	200 TByte	400 TByte	800 TByte	1600 TByte
ergibt bei 5 Jahren [3]	27,40 GByte/Tag	54,79 GByte/Tag	109,59 GByte/Tag	219,18 GByte/Tag	438,36 GByte/Tag	876,72 GByte/Tag
Lösch- / Schreibzyklen						
typisch [4]	2.000.000					
garantiert	100.000					
Wear Leveling	statisch					
Error Correction Coding (ECC)	Ja					
S.M.A.R.T. Support	Nein					
Unterstützung						
Hardware	PP300/400, PP500, PPC300, PPC700, PPC725, PPC800, APC620, APC810, APC820					
Betriebssysteme						
Windows 7 32-Bit	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
Windows 7 64-Bit	Nein					
Windows Embedded Standard 7 32-Bit	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
Windows Embedded Standard 7 64-Bit	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
Windows XP Professional	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
Windows XP Embedded	Ja					
Windows Embedded Standard 2009	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Windows CE 6.0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja [5]
Windows CE 5.0	Nein					
Software						
PVI Transfer Tool	≥ V3.2.3.8 (Teil von PVI Development Setup ≥ V2.06.00.3011)	≥ V3.2.3.8 (Teil von PVI Development Setup ≥ V2.06.00.3011)	≥ V3.2.3.8 (Teil von PVI Development Setup ≥ V2.06.00.3011)	≥ V3.2.3.8 (Teil von PVI Development Setup ≥ V2.06.00.3011)	≥ V3.2.3.8 (Teil von PVI Development Setup ≥ V2.06.00.3011)	≥ V3.6.8.40 (Teil von PVI Development Setup ≥ V3.0.0.3020)
B&R Embedded OS Installer	≥ V3.10	≥ V3.10	≥ V3.10	≥ V3.10	≥ V3.10	≥ V3.20
Umgebungsbedingungen						
Temperatur						
Betrieb	0 bis 70°C					
Lagerung	-65 bis 150°C					
Transport	-65 bis 150°C					
Luftfeuchtigkeit						
Betrieb	max. 85% bei 85°C					
Lagerung	max. 85% bei 85°C					
Transport	max. 85% bei 85°C					
Vibration						
Betrieb	20 g peak, 20 bis 2000 Hz, 4 pro Richtung (JEDEC JESD22, Methode B103) 5,35 g RMS, 15 min pro Ebene (IEC 68-2-6)					
Lagerung	20 g peak, 20 bis 2000 Hz, 4 pro Richtung (JEDEC JESD22, Methode B103) 5,35 g RMS, 15 min pro Ebene (IEC 68-2-6)					
Transport	20 g peak, 20 bis 2000 Hz, 4 pro Richtung (JEDEC JESD22, Methode B103) 5,35 g RMS, 15 min pro Ebene (IEC 68-2-6)					
Schock						
Betrieb	1500 g peak, 0,5 ms 5 mal (JEDEC JESD22, Methode B110) 30 g, 11 ms 1 mal (IEC 68-2-27)					
Lagerung	1500 g peak, 0,5 ms 5 mal (JEDEC JESD22, Methode B110) 30 g, 11 ms 1 mal (IEC 68-2-27)					
Transport	1500 g peak, 0,5 ms 5 mal (JEDEC JESD22, Methode B110) 30 g, 11 ms 1 mal (IEC 68-2-27)					
Meereshöhe						
Betrieb	max. 4.572 m					

Tabelle 275: 5CFCRD.0512-04, 5CFCRD.1024-04, 5CFCRD.2048-04, 5CFCRD.4096-04, 5CFCRD.8192-04, 5CFCRD.016G-04 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5CFCRD.0512-04	5CFCRD.1024-04	5CFCRD.2048-04	5CFCRD.4096-04	5CFCRD.8192-04	5CFCRD.016G-04
Mechanische Eigenschaften						
Abmessungen						
Breite	42,8 ±0,10 mm					
Länge	36,4 ±0,15 mm					
Höhe	3,3 ±0,10 mm					
Gewicht	10 g					

Tabelle 275: 5CFCRD.0512-04, 5CFCRD.1024-04, 5CFCRD.2048-04, 5CFCRD.4096-04, 5CFCRD.8192-04, 5CFCRD.016G-04 - Technische Daten

1) Geschwindigkeitsangaben mit 1X = 150 kByte/s. Alle Angaben beziehen sich auf die Samsung Flash Chips, CompactFlash Karte in UDMA Mode 4, Zykluszeit 30 ns in True-IDE Mode mit sequentiellem Schreiben/Lesen- Test.
2) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
3) Endurance bei B&R CFs (Bei linear geschriebener Blockgröße mit ≥ 128 kB)
4) Abhängig von der durchschnittlichen Filegröße.
5) Wird vom B&R Embedded OS Installer nicht unterstützt.

5.4.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm

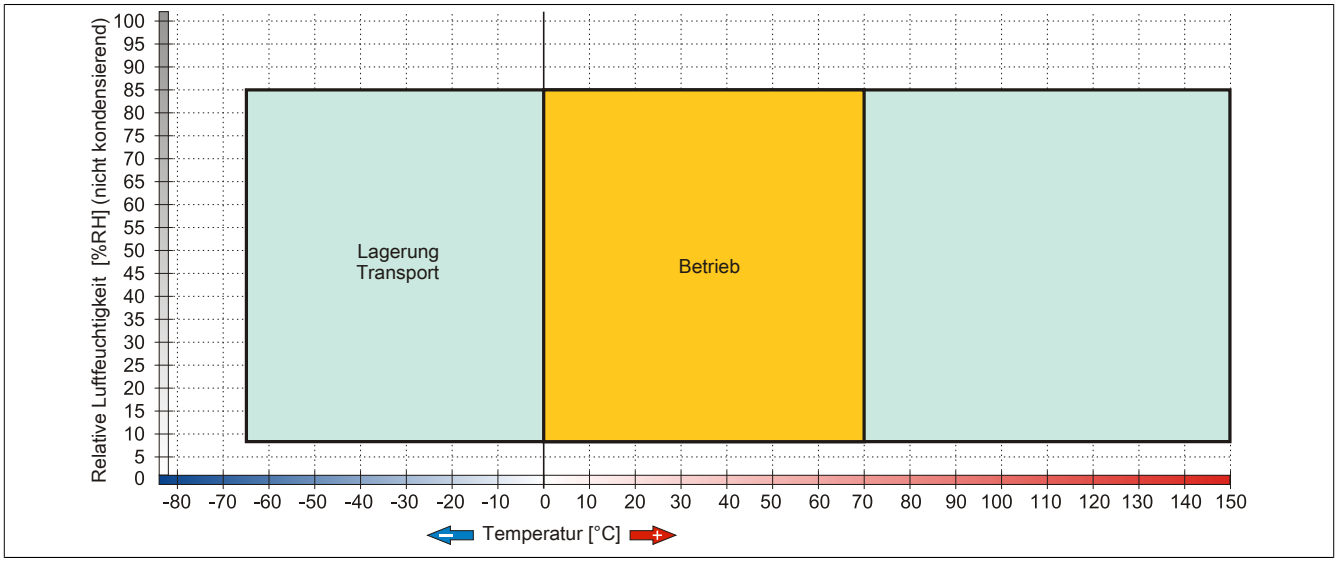


Abbildung 185: 5CFCRD.xxxx-04 - Temperatur Luftfeuchtediagramm CompactFlash-Karten

5.4.5 Abmessungen

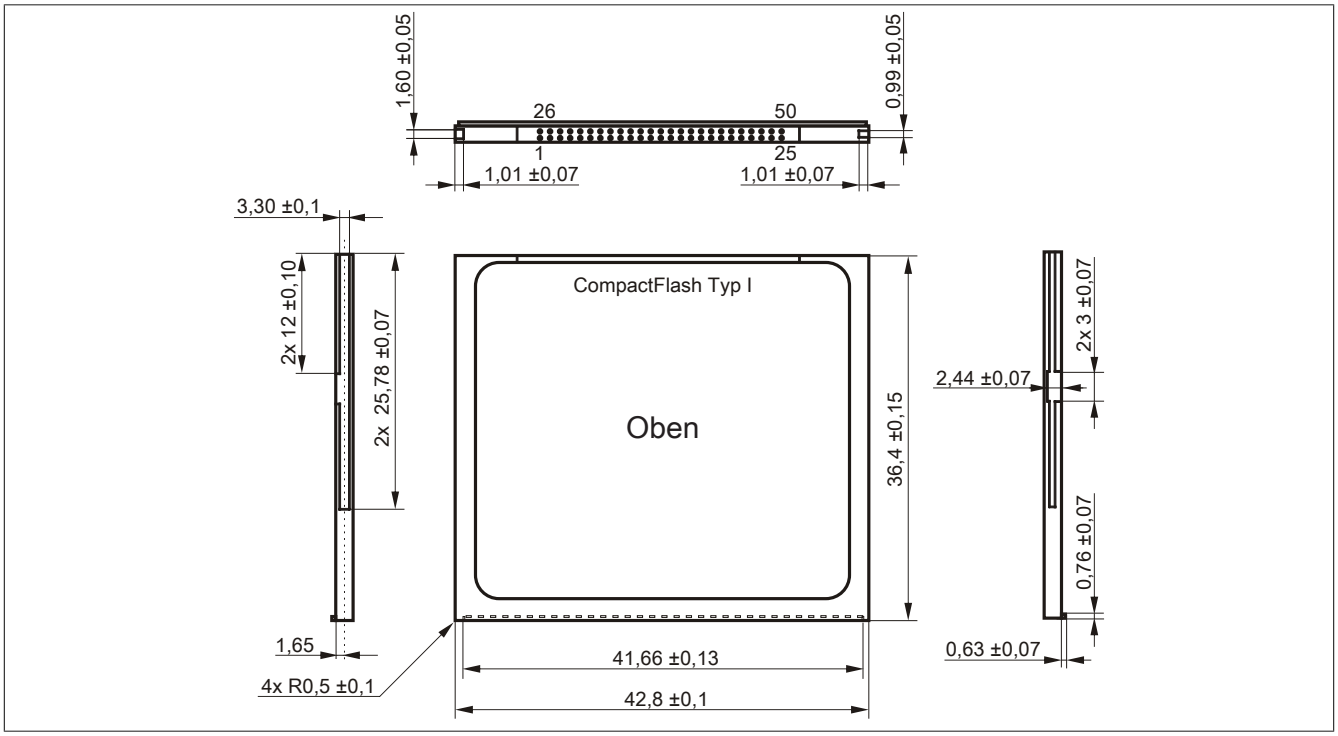


Abbildung 186: Abmessungen CompactFlash-Karte Typ I

5.4.6 Benchmark

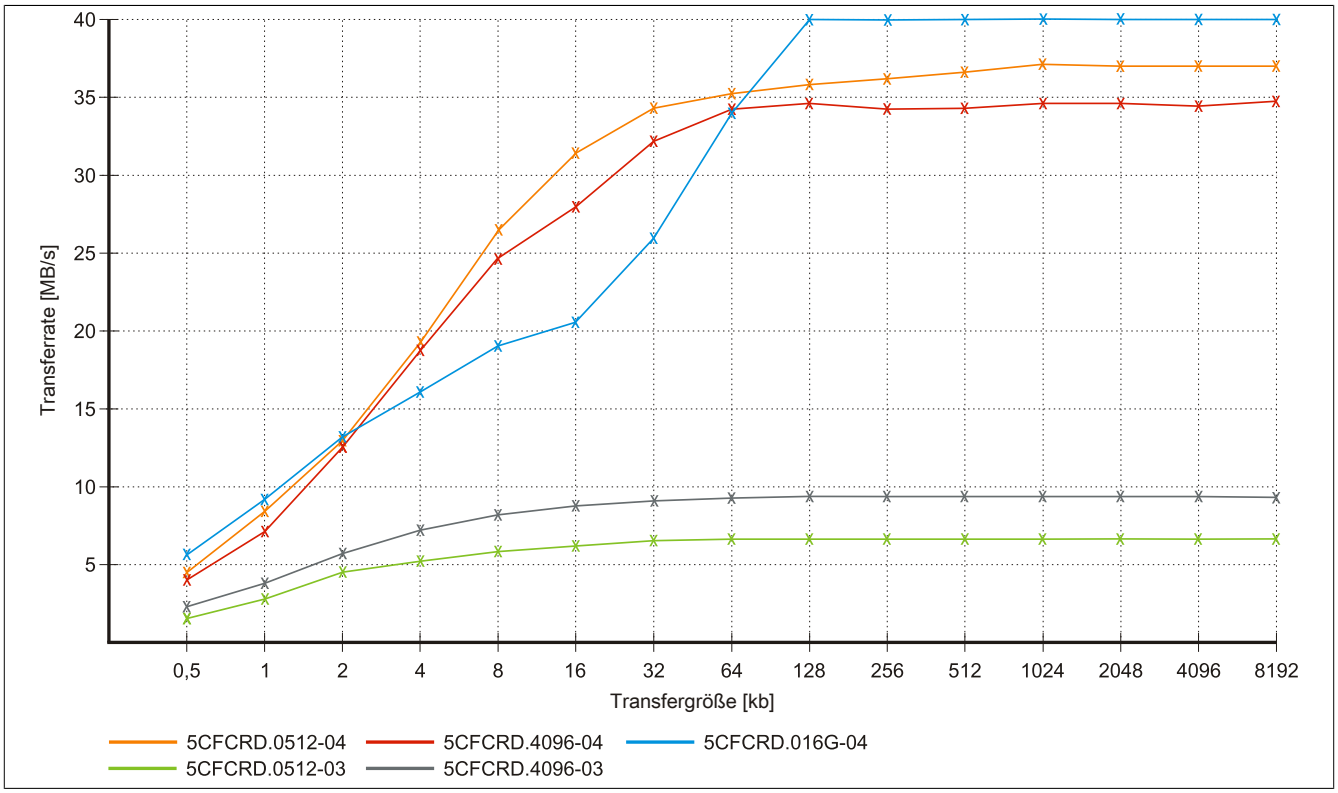


Abbildung 187: ATTO Disk Benchmark v2.34 Vergleich Lesen - 5CFCRD.xxxx-03 mit 5CFCRD.xxxx-04

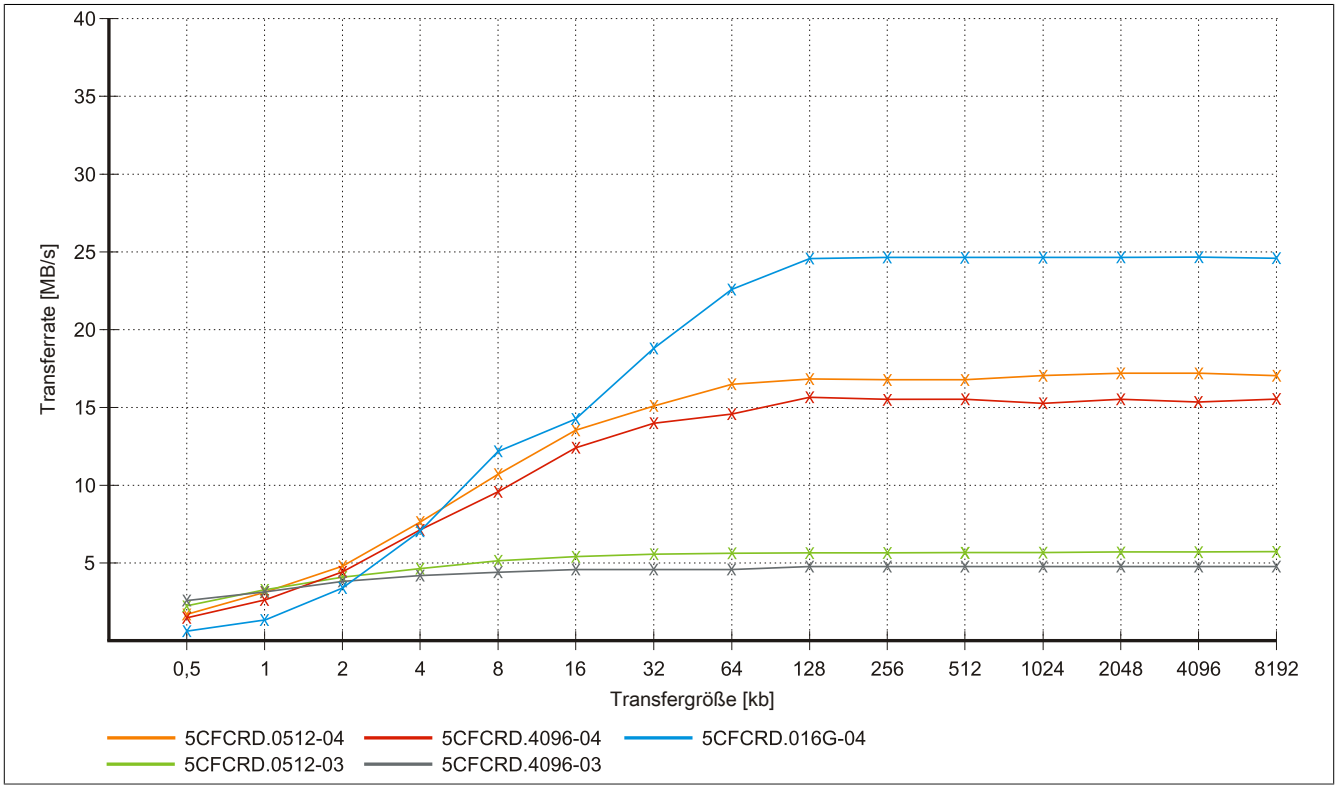


Abbildung 188: ATTO Disk Benchmark v2.34 Vergleich Schreiben - 5CFCRD.xxxx-03 mit 5CFCRD.xxxx-04

5.5 5CFCRD.xxxx-03

5.5.1 Allgemeines

Information:

Der gleichzeitige Betrieb von Western Digital CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx- 03 und CompactFlash Karten anderer Hersteller in einem System ist nicht erlaubt. Aufgrund von Technologieunterschieden (ältere, neuere Technologien) kann es beim Systemstart zu Problemen kommen, was auf die unterschiedlichen Hochlaufzeiten zurückzuführen ist.

siehe "Bekannte Probleme / Eigenheiten" auf Seite 364

Information:

Auf Windows CE 5.0 Geräten werden die CompactFlash-Karten 5CFCRD.xxxx-03 bis zu 1 GByte unterstützt.

Information:

Bei den CompactFlash-Karten 5CFCRD.xxxx-03 hat sich lediglich der Aufkleber und die Beschreibung geändert. Die technischen Daten sind unverändert.

5.5.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	CompactFlash-Karten	
5CFCRD.0064-03	CompactFlash 64 MByte Western Digital (SLC)	
5CFCRD.0128-03	CompactFlash 128 MByte Western Digital (SLC)	
5CFCRD.0256-03	CompactFlash 256 MByte Western Digital (SLC)	
5CFCRD.0512-03	CompactFlash 512 MByte Western Digital (SLC)	
5CFCRD.1024-03	CompactFlash 1 GByte Western Digital (SLC)	
5CFCRD.2048-03	CompactFlash 2 GByte Western Digital (SLC)	
5CFCRD.4096-03	CompactFlash 4 GByte Western Digital (SLC)	
5CFCRD.8192-03	CompactFlash 8 GByte Western Digital (SLC)	

Tabelle 276: 5CFCRD.0064-03, 5CFCRD.0128-03, 5CFCRD.0256-03, 5CFCRD.0512-03, 5CFCRD.1024-03, 5CFCRD.2048-03, 5CFCRD.4096-03, 5CFCRD.8192-03 - Bestelldaten

5.5.3 Technische Daten

Vorsicht!

Ein plötzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust führen! In sehr seltenen Fällen kann es zu einer Beschädigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschädigung vorbeugend entgegen zu wirken, empfiehlt B&R die Verwendung einer USV.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5CFCRD. 0064-03	5CFCRD. 0128-03	5CFCRD. 0256-03	5CFCRD. 0512-03	5CFCRD. 1024-03	5CFCRD. 2048-03	5CFCRD. 4096-03	5CFCRD. 8192-03
Allgemeines								
Kapazität	64 MByte	128 MByte	256 MByte	512 MByte	1 GByte	2 GByte	4 GByte	8 GByte
Datenerhaltung	10 Jahre							
Datenverlässlichkeit	< 1 nichtbehebbarer Fehler in 10^{14} Bit Lesezugriffen							
Lifetime Monitoring	Ja							
MTBF	> 4.000.000 Stunden (bei 25°C)							
Wartung	keine							
unterstützte Betriebsmodi	PIO Mode 0-4, Multiword DMA Mode 0-2							
kontinuierliches Lesen typisch	8 MByte/s							
kontinuierliches Schreiben typisch	6 MByte/s							
Zertifizierungen								
CE	Ja							
cULus	Ja							
GOST-R	Ja							
GL	Ja [1]							
Endurance								
SLC-Flash	Ja							
Lösch- / Schreibzyklen typisch	> 2.000.000							
Wear Leveling	statisch							
Error Correction Coding (ECC)	Ja							
S.M.A.R.T. Support	Nein							
Unterstützung								
Hardware	MP100/200, PP100/200, PP300/400, PP500, PPC300, PPC700, PPC725, PPC800, Provit 2000, Provit 5000, APC620, APC680, APC810, APC820							
Betriebssysteme								
Windows 7 32-Bit	Nein							
Windows 7 64-Bit	Nein							
Windows Embedded Standard 7 32-Bit	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
Windows Embedded Standard 7 64-Bit	Nein							
Windows XP Professional	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
Windows XP Embedded	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Windows Embedded Standard 2009	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
Windows CE 6.0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja [2]
Windows CE 5.0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
Software								
PVI Transfer Tool	≥ V2.57 (Teil von PVI Development Setup ≥ V2.5.3.3005)							
B&R Embedded OS Installer	≥ V2.21							
Umgebungsbedingungen								
Temperatur								
Betrieb	0 bis 70°C							
Lagerung	-50 bis 100°C							
Transport	-50 bis 100°C							
Luftfeuchtigkeit								
Betrieb	8 bis 95%, nicht kondensierend							
Lagerung	8 bis 95%, nicht kondensierend							
Transport	8 bis 95%, nicht kondensierend							
Vibration								
Betrieb	max. 16,3 g (159 m/s² 0-peak)							
Lagerung	max. 30 g (294 m/s² 0-peak)							
Transport	max. 30 g (294 m/s² 0-peak)							
Schock								
Betrieb	max. 1000 g (9810 m/s² 0-peak)							
Lagerung	max. 3000 g (29430 m/s² 0-peak)							
Transport	max. 3000 g (29430 m/s² 0-peak)							
Meereshöhe								
Betrieb	max. 24.383 m							
Mechanische Eigenschaften								
Abmessungen								
Breite	42,8 ±0,10 mm							
Länge	36,4 ±0,15 mm							
Höhe	3,3 ±0,10 mm							
Gewicht	11,4 g							

Tabelle 277: 5CFCRD.0064-03, 5CFCRD.0128-03, 5CFCRD.0256-03, 5CFCRD.0512-03, 5CFCRD.1024-03, 5CFCRD.2048-03, 5CFCRD.4096-03, 5CFCRD.8192-03 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
2) Wird vom B&R Embedded OS Installer nicht unterstützt.

5.5.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm

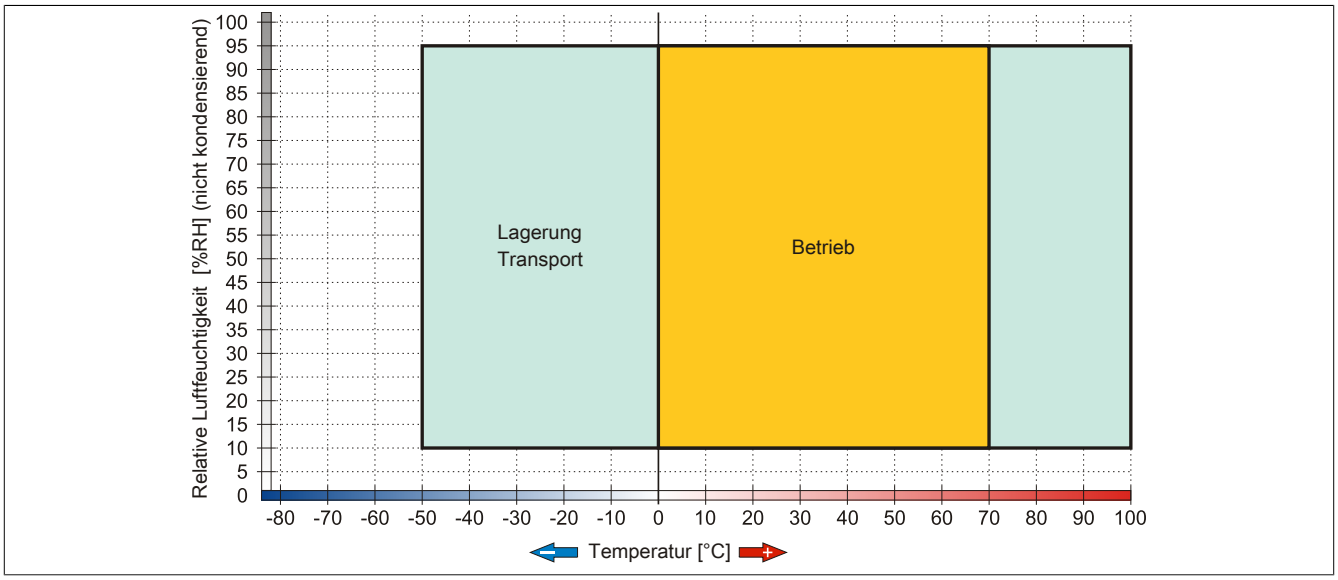


Abbildung 189: 5CFCRD.xxxx-03 - Temperatur Luftfeuchtediagramm CompactFlash-Karten

5.5.5 Abmessungen

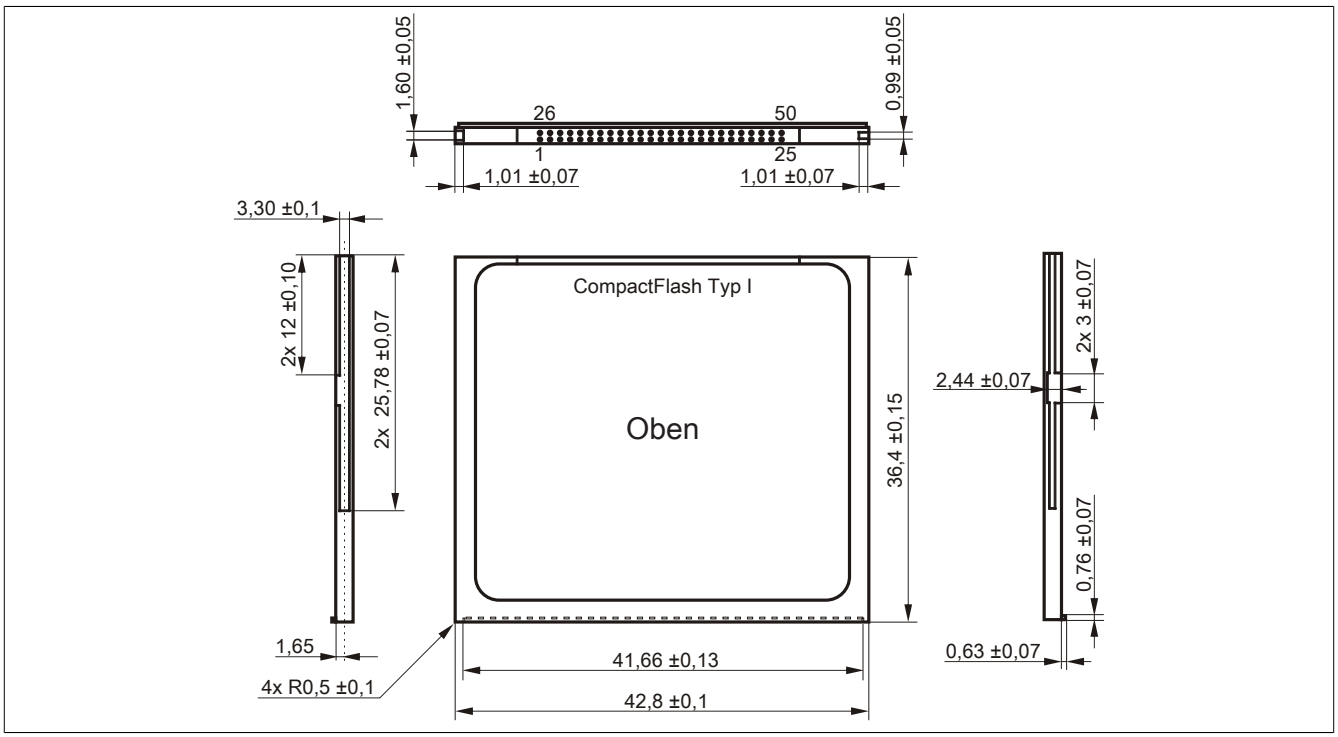


Abbildung 190: Abmessungen CompactFlash-Karte Typ I

5.6 Bekannte Probleme / Eigenheiten

Der nachfolgende Punkt ist bei Geräten mit zwei CompactFlash Slots bekannt:

- Der Betrieb von zwei CompactFlash-Karten unterschiedlicher Type kann in Automation PCs und Panel PCs zu Problemen führen. Es kann vorkommen, dass beim Systemstart eine der beiden Karten nicht erkannt wird. Der Grund hierfür liegt in dem unterschiedlich schnellen Hochlaufverhalten. Die CompactFlash-Karten älterer Technologie benötigen beim Systemstart erheblich mehr Zeit als CompactFlash-Karten mit neuerer Technologie. Dieses Verhalten liegt im Grenzbereich des hierfür während des Hochlaufs zur Verfügung stehenden Zeitfensters. Da die Hochlaufzeit bei den CompactFlash-Karten durch die Streuung der verwendeten Bauteile schwankt kann es daher zu dem beschriebenen Problem kommen. Je nach verwendeten CompactFlash-Karten kann der Fehler nie, selten oder immer auftreten.

6 USB Media Drive

6.1 5MD900.USB2-01

6.1.1 Allgemeines

Das USB Media Drive ist eine Laufwerkskombination aus Disketten-, DVD-RW/CD-RW- Laufwerk, CompactFlash Slot und rück- und frontseitigem USB Anschluss. Es wird an den USB Anschluss des B&R Industrie PCs angeschlossen.

- Betrieb als Tisch- bzw. Einbaugerät (Hutschienenwinkel)
- Integriertes USB Diskettenlaufwerk
- Integriertes DVD-RW/CD-RW Laufwerk
- Integrierter CompactFlash Slot IDE/ATAPI (Hot Plug fähig)
- Integrierter USB 2.0 Anschluss (bis zu 480 MBit High Speed)
- Versorgung, +24 VDC rückseitig
- USB/B 2.0 Anschluss rückseitig
- optionale Frontklappe

6.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	USB Zubehör	
5MD900.USB2-01	USB 2.0 Laufwerkskombination, bestehend aus DVD-R/RW DVD+R/RW, FDD, CompactFlash Slot (Typ II), USB Anschluss (Typ A frontseitig, Typ B rückseitig); 24 VDC, (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen)	
	Erforderliches Zubehör	
	Feldklemmen	
0TB103.9	Stecker 24 VDC - 3-polig female - Schraubklemme 3,31 mm²	
0TB103.91	Stecker 24 VDC - 3-polig female - Federzugklemme 3,31 mm²	
	Sonstiges	
5SWUTI.0000-00	OEM Nero CD-RW Software, nur in Verbindung mit einem CD-RW Laufwerk erhältlich.	
	USB-Kabel	
5CAUSB.0018-00	USB 2.0 Verbindungskabel - Typ A - Typ B Stecker - 1,8 m	
5CAUSB.0050-00	USB 2.0 Verbindungskabel - Typ A - Typ B Stecker - 5 m	
	USB Zubehör	
5A5003.03	Frontklappe für Laufwerke - 5A5003.02 - 5MD900.USB2	

Tabelle 278: 5MD900.USB2-01 - Bestelldaten

6.1.3 Schnittstellen

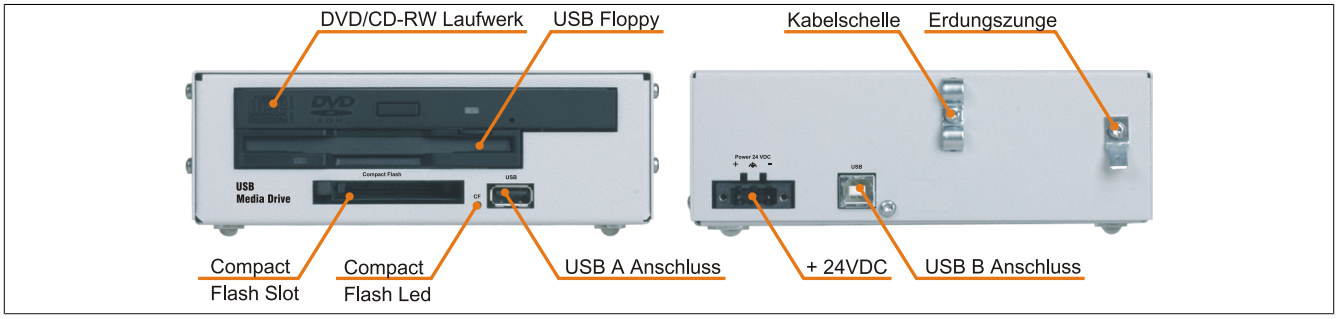


Abbildung 191: 5MD900.USB2-01 - Schnittstellen

6.1.4 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für diese Einzelkomponente alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5MD900.USB2-01
Allgemeines	
max. Kabellänge	5 m (ohne Hub)
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
Schnittstellen	
CompactFlash Slot 1	
Typ	Typ I
Anschluss	IDE/ATAPI
Activity-LED	signalisiert einen Lese- bzw. Schreibzugriff auf einer gesteckten CompactFlash Karte
USB	
Typ	USB 2.0
Ausführung	Typ A frontseitig Typ B rückseitig
Übertragungsrate	Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
Strombelastbarkeit	max. 500 mA
CD / DVD Laufwerk	
Datenpufferkapazität	8 MByte
Datentransferrate	max. 33,3 MByte/s
Drehzahl	max. 5090 rpm ±1%
Geräuschpegel	ca. 48 dBA in 50 cm Entfernung (voller Lesezugriff)
Kompatible Formate	CD-DA, CD-ROM Mode 1/ Mode 2 CD-ROM XA Mode 2 (Form 1, Form 2) Photo CD (single/multi-session), Enhanced CD, CD-Text DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD-Video DVD-RAM (4,7 GB, 2,6 GB) DVD+R, DVD+R (Double Layer), DVD+RW
Laserklasse	Class 1 Laser
Lebensdauer	60.000 POH (Power On Hours)
Schnittstelle	IDE (ATAPI)
Hochlaufzeit	
CD	max. 14 Sekunden (von 0 rpm auf Lesezugriff)
DVD	max. 15 Sekunden (von 0 rpm auf Lesezugriff)
Zugriffszeit	
CD	130 ms (24x)
DVD	130 ms (8x)
Lesbare Medien	
CD	CD/CD-ROM (12 cm, 8 cm), CD-R, CD-RW
DVD	DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW. DVD-RAM, DVD+R, DVD+R (Double Layer), DVD+RW
Beschreibbare Medien	
CD	CD-R, CD-RW
DVD	DVD-R/RW, DVD-RAM (4,7 GB), DVD+R/RW, DVD+R (Double Layer)
Lesegeschwindigkeit	
CD	24x
DVD	8x
Schreibgeschwindigkeit	
CD-R	10 bis 24x
CD-RW	10 bis 24x
DVD+R	3,3 - 8x
DVD+R (Double Layer)	2,4 - 4x
DVD+RW	3,3 - 8x
DVD-R	2 - 6x
DVD-R (Double Layer)	2 - 4x
DVD-RAM	3 - 5x
DVD-RW	2 - 6x
Schreibmethoden	
CD	Disc at once, Session at once, Packet write, Track at once
DVD	Disc at once, Incremental, Over write, Sequential, Multi-session
Diskettenlaufwerk	
Datentransferrate	250 kBit/s (720 KByte) bzw. 500 kBit/s (1.25 MByte und 1.44 MByte)
Diskettenmedien	High Density (2HD) oder Normal Density (2DD) 3.5" Disketten
Kapazität	720 kByte / 1.25 MByte / 1.44 MByte (formatiert)
MTBF	30.000 POH (Power on Hours)
Rotationsgeschwindigkeit	bis zu 360 rpm
Elektrische Eigenschaften	
Nennspannung	24 VDC ±25%, SELV [1]
Überspannungskategorie nach EN 61131-2	II
Einsatzbedingungen	
Schutzart nach EN 60529	IP65 frontseitig (nur mit optionaler Frontklappe), IP20 rückseitig
Umgebungsbedingungen	
Temperatur [2]	
Betrieb	5 bis 45°C
Lagerung	-20 bis 60°C
Transport	-40 bis 60°C

Tabelle 279: 5MD900.USB2-01 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5MD900.USB2-01
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	20 bis 80%
Lagerung	5 bis 90%
Transport	5 bis 95%
Vibration	
Betrieb	5 bis 500 Hz: 0,3 g (2,9 m/s² 0-peak)
Lagerung	10 bis 100 Hz: 2 g (19,6 m/s² 0-peak)
Transport	10 bis 100 Hz: 2 g (19,6 m/s² 0-peak)
Schock	
Betrieb	5 g, 11 ms
Lagerung	60 g, 11 ms
Transport	60 g, 11 ms
Meereshöhe	
Betrieb	max. 3000 m
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen	
Breite	156 mm
Höhe	52 mm
Tiefe	140 mm
Gewicht	ca. 1100 g (ohne Frontklappe)

Tabelle 279: 5MD900.USB2-01 - Technische Daten

1) Die Anforderungen sind gemäß EN 60950 einzuhalten, siehe Kapitel 2.6.1 Spannungsversorgung +24 VDC.
2) Die Temperaturangaben entsprechen einer Angabe bei 500 Metern. Herabsenkung (Derating) der max. Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 Meter ü. NN.

6.1.5 Abmessungen

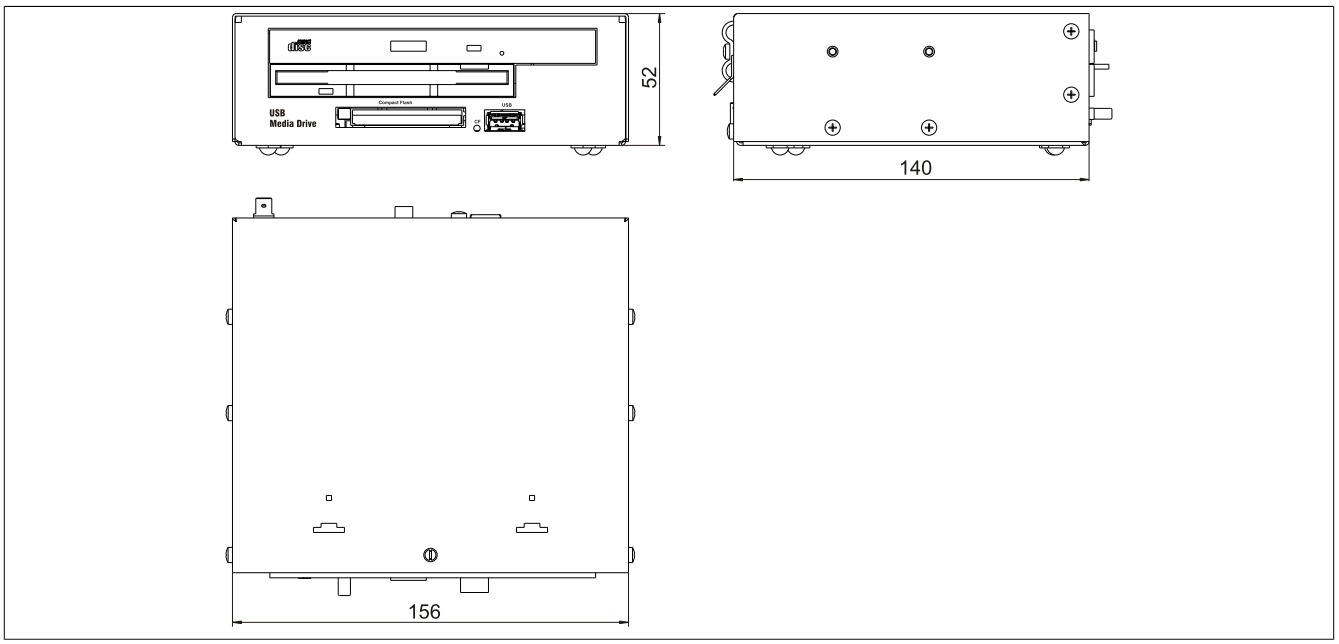


Abbildung 192: 5MD900.USB2-01 - Abmessungen

6.1.6 Abmessungen mit Frontklappe

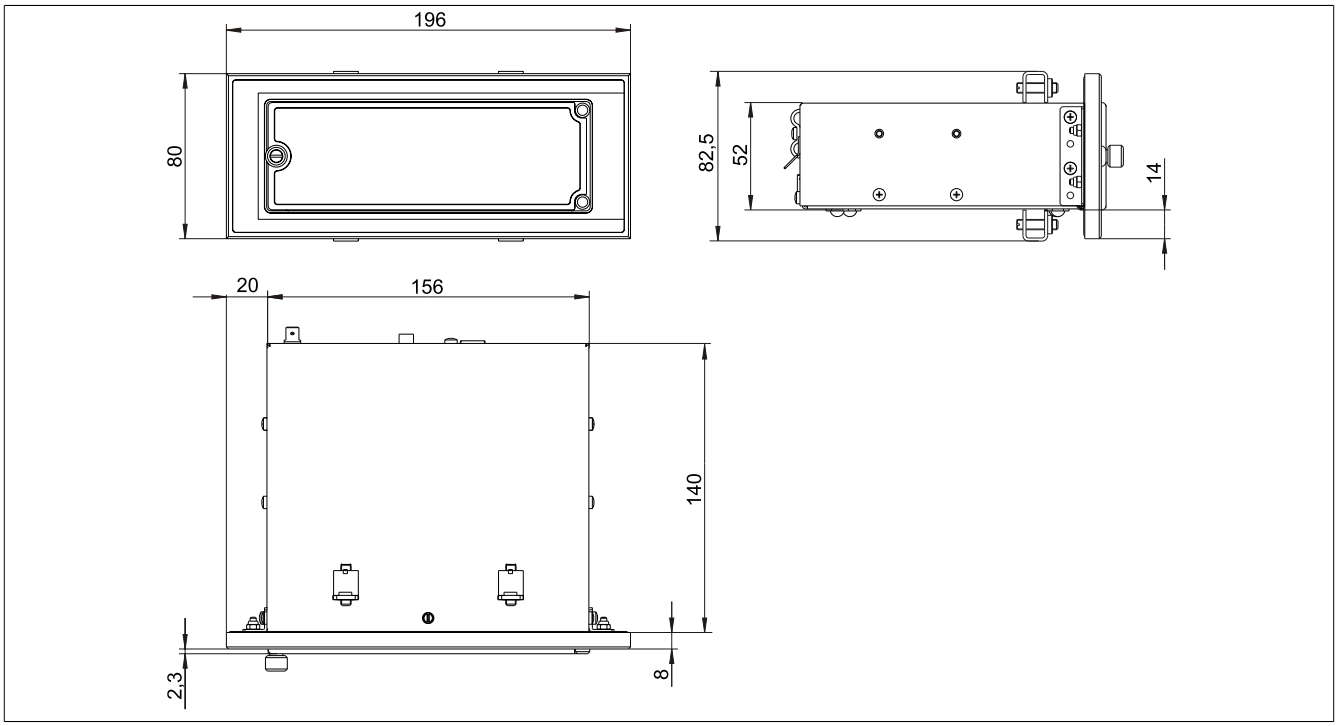


Abbildung 193: Abmessungen USB Media Drive mit Frontklappe

6.1.7 Einbau in Wanddurchbrüche

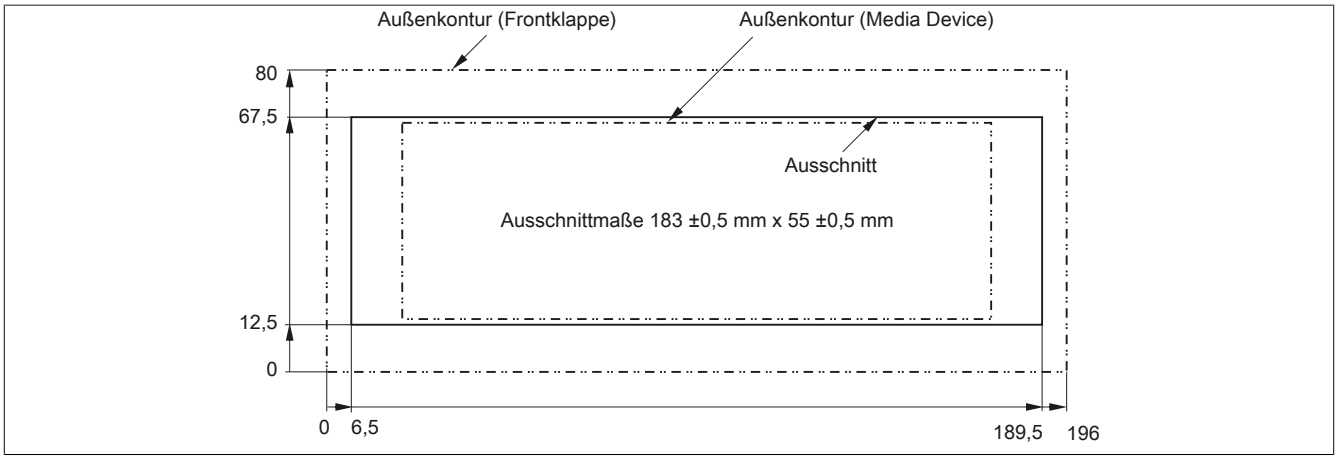


Abbildung 194: Einbauausschnitt USB Media Drive mit Frontklappe

6.1.8 Lieferumfang

Anzahl	Komponente
1	USB Media Drive Gesamtgerät
2	Hutschienenwinkel

Tabelle 280: 5MD900.USB2-01 - Lieferumfang

6.1.9 Montage

Das USB Media Drive Laufwerk ist sowohl für den Tischbetrieb (aufgeklebte Gummifüße) als auch für den Betrieb als Einbaugerät (2 Hutschienenwinkel werden beigepackt) geeignet.

6.1.9.1 Einbaulagen

Aufgrund der beschränkten Einbaulage bei den verwendeten Komponenten (Floppy, DVDCDRW Laufwerk) darf das USB Media Drive Laufwerk nur wie folgt abgebildet montiert und betrieben werden.

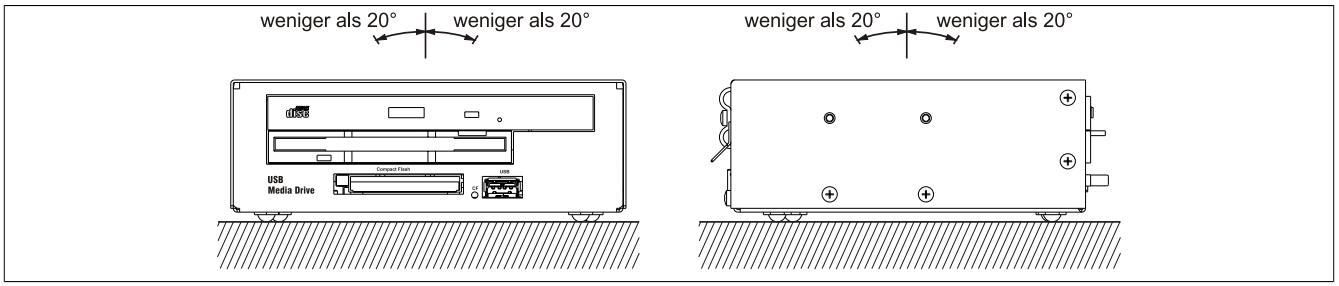


Abbildung 195: 5MD900.USB2-01 - Einbaulage

6.2 5MD900.USB2-02

6.2.1 Allgemeines

Das USB Media Drive besitzt ein DVD-R/RW DVD+R/RW- Laufwerk, einen CompactFlash Slot sowie einen rück- und frontseitigen USB Anschluss. Es wird an den USB Anschluss des B&R Industrie PCs angeschlossen.

- Betrieb als Tisch- bzw. Einbaugerät (Hutschienenwinkel)
- Integriertes DVD-R/RW DVD+R/RW Laufwerk
- Integrierter CompactFlash Slot IDE/ATAPI (Hot Plug fähig)
- Integrierter USB 2.0 Anschluss
- Versorgung, +24 VDC rückseitig
- USB 2.0 Anschluss rückseitig
- optionale Frontklappe

6.2.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	USB Zubehör	
5MD900.USB2-02	USB 2.0 Laufwerkskombination - DVD-R/RW DVD+R/RW - CompactFlash Slot	
	Erforderliches Zubehör	
	Feldklemmen	
0TB103.9	Stecker 24 VDC - 3-polig female - Schraubklemme 3,31 mm²	
0TB103.91	Stecker 24 VDC - 3-polig female - Federzugklemme 3,31 mm²	
	Sonstiges	
5SWUTI.0000-00	OEM Nero CD-RW Software, nur in Verbindung mit einem CD-RW Laufwerk erhältlich.	
	USB-Kabel	
5CAUSB.0018-00	USB 2.0 Verbindungskabel - Typ A - Typ B Stecker - 1,8 m	
5CAUSB.0050-00	USB 2.0 Verbindungskabel - Typ A - Typ B Stecker - 5 m	

Tabelle 281: 5MD900.USB2-02 - Bestelldaten

6.2.3 Schnittstellen

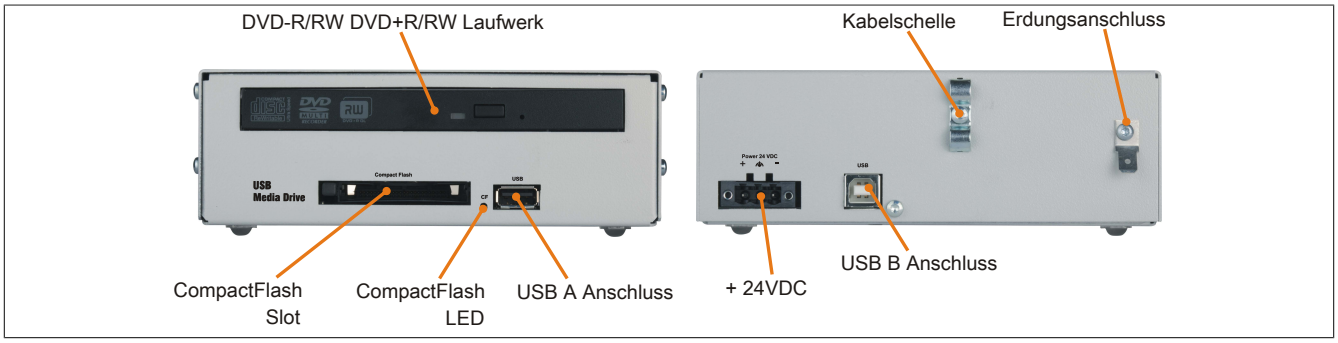


Abbildung 196: 5MD900.USB2-02 - Schnittstellen

6.2.4 Technische Daten

Produktbezeichnung	5MD900.USB2-02
Allgemeines	
max. Kabellänge	5 m (ohne Hub)
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
GOST-R	Ja
Schnittstellen	
CompactFlash Slot 1	
Typ	Typ I
Anschluss	IDE/ATAPI
Activity-LED	signalisiert einen Lese- bzw. Schreibzugriff auf einer gesteckten CompactFlash Karte

Tabelle 282: 5MD900.USB2-02 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5MD900.USB2-02
USB	
Typ	USB 2.0
Ausführung	Typ A frontseitig Typ B rückseitig
Übertragungsrate	Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
Strombelastbarkeit	max. 500 mA
CD / DVD Laufwerk	
Datenpufferkapazität	2 MByte
Datentransferrate	max. 33,3 MByte/s
Drehzahl	max. 5090 rpm ±1%
Geräuschpegel	ca. 45 dBA in 50 cm Entfernung (voller Lesezugriff)
Kompatible Formate	CD-DA, CD-ROM Mode 1/ Mode 2 CD-ROM XA Mode 2 (Form 1, Form 2) Photo CD (single/multi-session), Enhanced CD, CD-Text DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD-Video DVD-RAM (4,7 GB, 2,6 GB) DVD+R, DVD+R (Double Layer), DVD+RW
Laserklasse	Class 1 Laser
Lebensdauer	60.000 POH (Power On Hours)
Schnittstelle	IDE (ATAPI)
Hochlaufzeit	
CD	max. 14 Sekunden (von 0 rpm auf Lesezugriff)
DVD	max. 15 Sekunden (von 0 rpm auf Lesezugriff)
Zugriffszeit	
CD	typ. 140 ms (24x)
DVD	typ. 150 ms (8x)
Lesbare Medien	
CD	CD/CD-ROM (12 cm, 8 cm), CD-R, CD-RW
DVD	DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW. DVD-RAM, DVD+R, DVD+R (Double Layer), DVD+RW
Beschreibbare Medien	
CD	CD-R, CD-RW
DVD	DVD-R/RW, DVD-RAM (4,7 GB), DVD+R/RW, DVD+R (Double Layer)
Lesegeschwindigkeit	
CD	24x
DVD	8x
Schreibgeschwindigkeit	
CD-R	10 bis 24x
CD-RW	10 bis 24x
DVD+R	3,3 bis 8x
DVD+R (Double Layer)	2,4 bis 4x
DVD+RW	3,3 bis 8x
DVD-R	2 bis 6x
DVD-R (Double Layer)	2 bis 4x
DVD-RAM	3 bis 5x
DVD-RW	2 bis 6x
Schreibmethoden	
CD	Disc at once, Session at once, Packet write, Track at once
DVD	Disc at once, Incremental, Over write, Sequential
Elektrische Eigenschaften	
Nennspannung	24 VDC ±25%, SELV [1]
Überspannungskategorie nach EN 61131-2	II
Einsatzbedingungen	
Schutzart nach EN 60529	IP65 frontseitig (nur mit optionaler Frontklappe), IP20 rückseitig
Umgebungsbedingungen	
Temperatur [2]	
Betrieb	5 bis 45°C
Lagerung	-20 bis 60°C
Transport	-40 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	20 bis 80%
Lagerung	5 bis 90%
Transport	5 bis 95%
Vibration	
Betrieb	5 bis 500 Hz: 0,3 g (2,9 m/s² 0-peak)
Lagerung	10 bis 100 Hz: 2 g (19,6 m/s² 0-peak)
Transport	10 bis 100 Hz: 2 g (19,6 m/s² 0-peak)
Schock	
Betrieb	5 g, 11 ms
Lagerung	60 g, 11 ms
Transport	60 g, 11 ms
Meereshöhe	
Betrieb	max. 3000 m

Tabelle 282: 5MD900.USB2-02 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5MD900.USB2-02
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen	
Breite	156 mm
Höhe	52 mm
Tiefe	140 mm
Gewicht	ca. 1100 g (ohne Frontklappe)

Tabelle 282: 5MD900.USB2-02 - Technische Daten

1) Die Anforderungen sind gemäß EN 60950 einzuhalten, siehe Kapitel 2.6.1 Spannungsversorgung +24 VDC.
2) Die Temperaturangaben entsprechen einer Angabe bei 500 Metern. Herabsenkung (Derating) der max. Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 Meter ü. NN.

6.2.5 Abmessungen

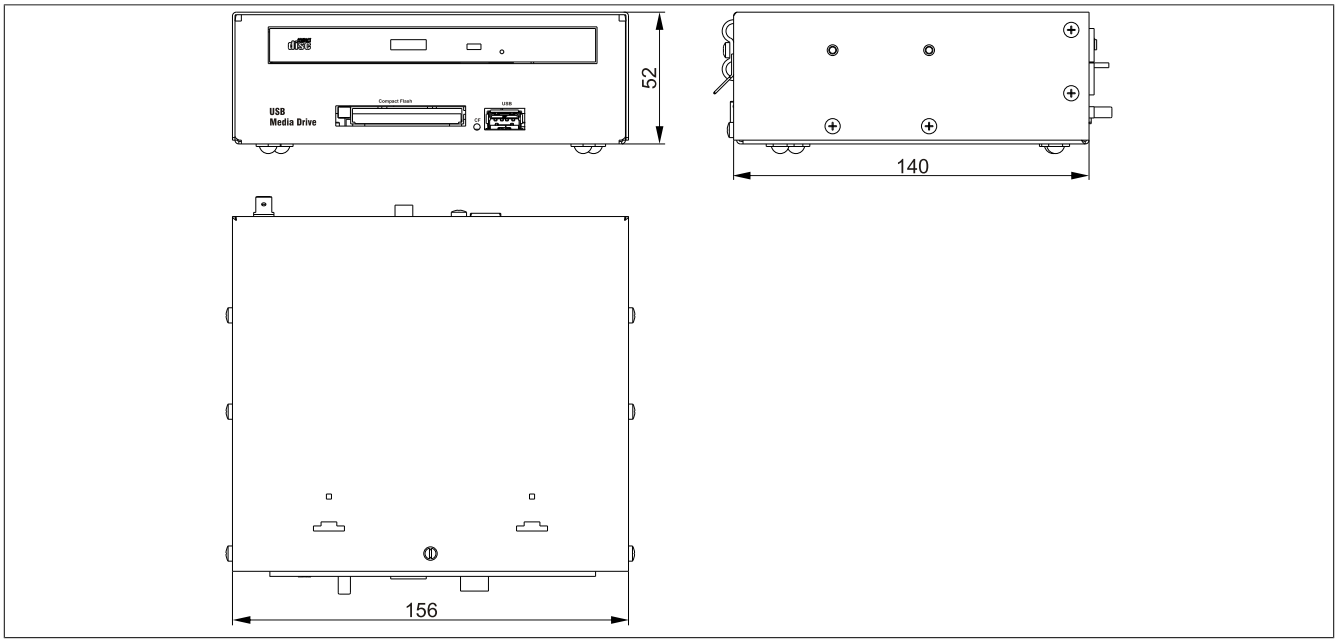


Abbildung 197: 5MD900.USB2-02 - Abmessungen

6.2.6 Abmessungen mit Frontklappe

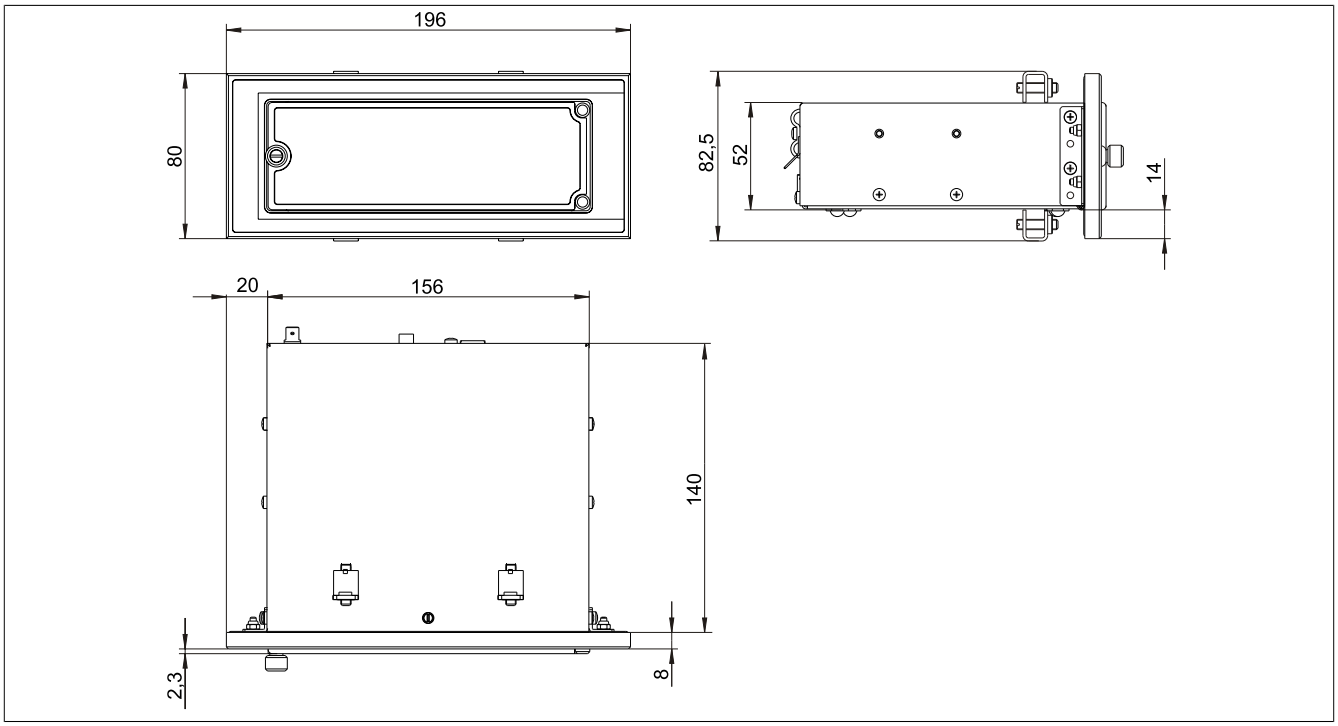


Abbildung 198: Abmessungen USB Media Drive mit Frontklappe

6.2.7 Einbau in Wanddurchbrüche

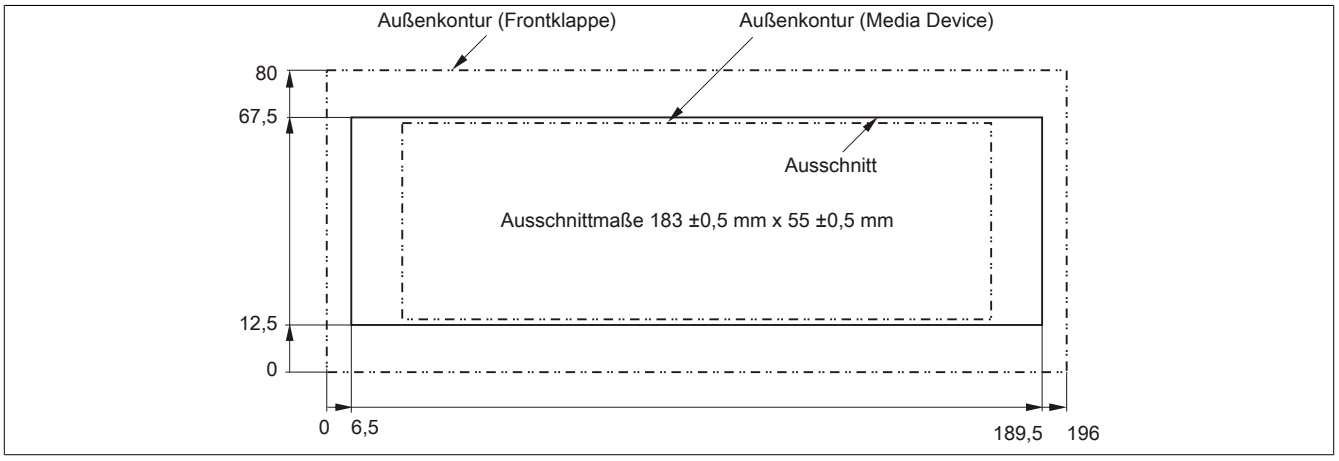


Abbildung 199: Einbauausschnitt USB Media Drive mit Frontklappe

6.2.8 Lieferumfang

Anzahl	Komponente
1	USB Media Drive Gesamtgerät
2	Hutschienenwinkel

Tabelle 283: 5MD900.USB2-02 - Lieferumfang

6.2.9 Montage

Das USB Media Drive Laufwerk ist sowohl für den Tischbetrieb (aufgeklebte Gummifüße) als auch für den Betrieb als Einbaugerät (2 Hutschienenwinkel werden beigepackt) geeignet.

6.2.9.1 Einbaulagen

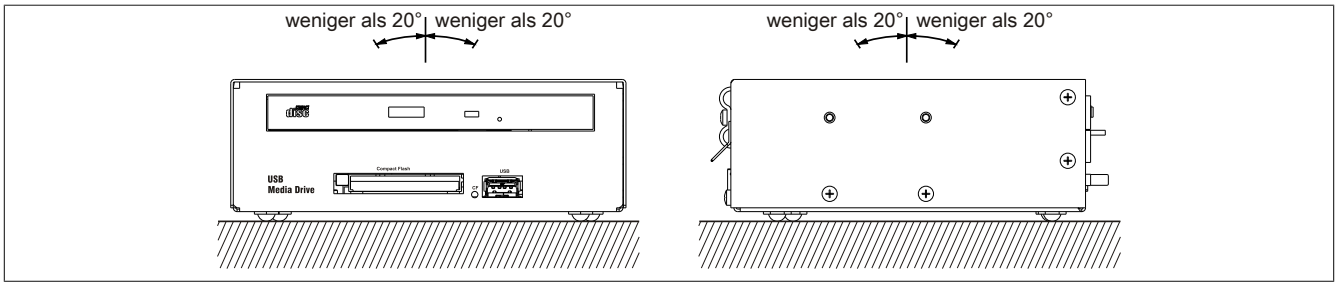


Abbildung 200: 5MD900.USB2-02 - Einbaulage

6.3 5A5003.03

6.3.1 Allgemeines

Diese Frontklappe kann optional an der Vorderseite des USB Media Drive Laufwerks (Best.Nr. 5MD900.USB2-00, 5MD900.USB2-01 bzw. 5MD900.USB2-02) zum Schutz der Schnittstellen montiert werden.

6.3.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	USB Zubehör	
5A5003.03	Frontklappe für Laufwerke - 5A5003.02 - 5MD900.USB2	

Tabelle 284: 5A5003.03 - Bestelldaten

6.3.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5A5003.03
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
GOST-R	Ja
Mechanische Eigenschaften	
Front	
Dekorfolie	
Farbe heller Hintergrund	ähnlich Pantone 427CV
Abmessungen	
Breite	196 mm
Höhe	80 mm
Tiefe	8 mm

Tabelle 285: 5A5003.03 - Technische Daten

6.3.4 Abmessungen

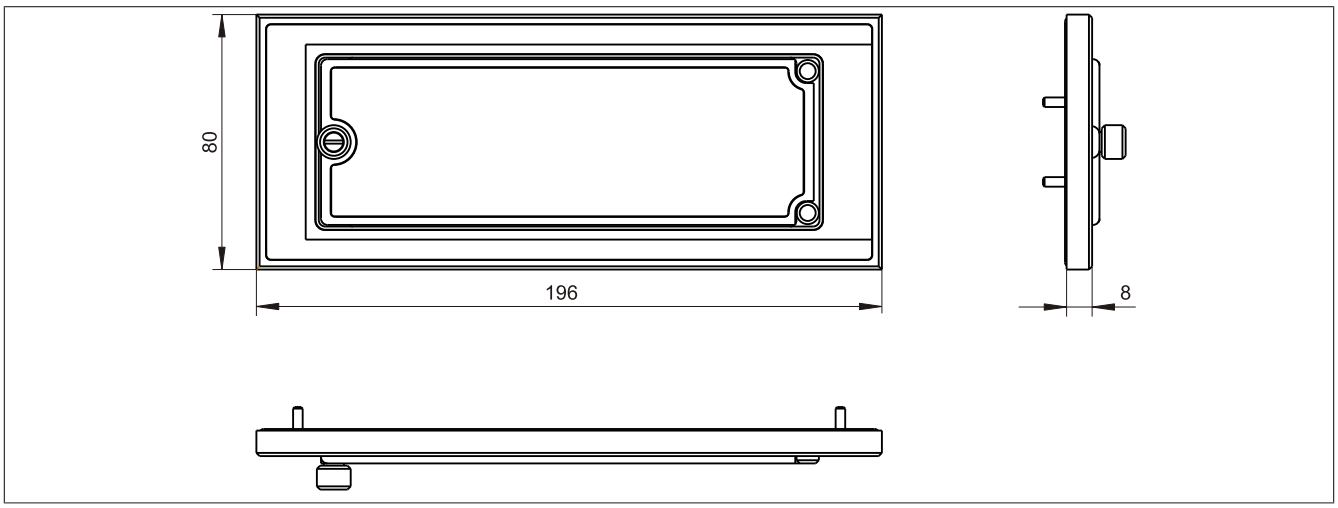


Abbildung 201: 5A5003.03 - Abmessungen

6.3.5 Lieferumfang

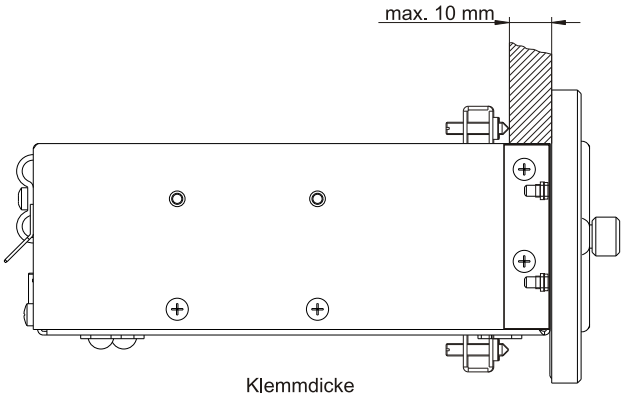
Anzahl	Komponente
1	Frontklappe 5A5003.03 für das USB Media Drive
4	M3 Sicherungsmutter
4	Haube Halteklammer

Tabelle 286: 5A5003.03 - Lieferumfang

6.3.6 Montage

Die Frontklappe wird mittels den 2 Hutschienenwinkel (beigepackt beim USB Media Drive) und den 4 M3 Sicherungsmuttern befestigt. Mit den 4 beiliegenden Halteklammern kann das Gesamtgerät (USB Media Drive + Frontklappe) z.B. in einer Schaltschranktür montiert werden.

Montage



Klemmdicke

Abbildung 202: Frontklappenmontage und Klemmdicke

6.3.6.1 Einbau in Wanddurchbrüche

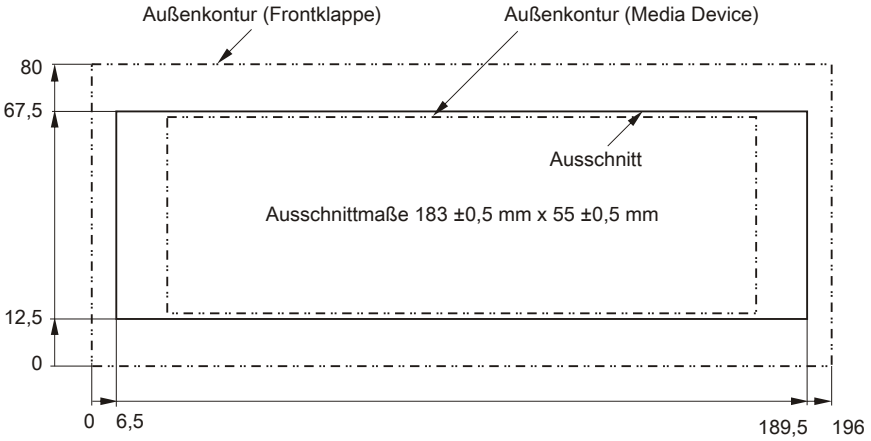


Abbildung 203: Einbauausschnitt USB Media Drive mit Frontklappe

7 USB Memory Sticks

7.1 5MMUSB.2048-00

7.1.1 Allgemeines

USB Memory Sticks sind leicht zu tauschende Speichermedien. Aufgrund des schnellen Datentransfers (USB 2.0) bieten die USB Memory Sticks optimale Werte für den Einsatz als portables Speichermedium. "Hot-PLUG & PLAY" - ohne weitere Treiber (außer bei Windows 98SE) meldet sich der USB Memory Stick sofort als ein weiteres Laufwerk, von dem Daten gelesen oder auf das Daten geschrieben werden können.

Information:

Auf Grund der Vielzahl der am Markt verfügbaren USB Memory Sticks, bzw. deren kurzen Lebenszyklen, behalten wir uns das Recht vor Alternativprodukte zu liefern. Es kann daher notwendig sein, folgende Maßnahmen zu treffen um auch von diesen USB Sticks booten zu können:

- **Der USB Stick muss neu formatiert bzw. in manchen Fällen auch neu partitioniert werden (Partition aktiv schalten).**
- **Der USB Stick muss in der Bootorder des BIOS an erster Stelle stehen oder es können auch alternativ die IDE Kontroller im BIOS deaktiviert werden. In den meisten Fällen kann dies umgangen werden, wenn noch zusätzlich ein „fdisk / mbr“ auf dem USB Memory Stick ausgeführt wird.**

7.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	USB Zubehör	
5MMUSB.2048-00	USB 2.0 Memory Stick, 2048 MByte	

Tabelle 287: 5MMUSB.2048-00 - Bestelldaten

7.1.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5MMUSB.2048-00
Allgemeines	
Datenerhaltung	10 Jahre
LEDs	1 LED (grün) [1)]
MTBF	100.000 Stunden (bei 25°C)
Typ	USB 1.1, USB 2.0
Wartung	keine
Zertifizierungen	
CE	Ja
Schnittstellen	
USB	
Typ	USB 1.1, USB 2.0
Anschluss	an jede USB Typ A Schnittstelle
Übertragungsrate	Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
sequentielles Lesen	max. 8,7 MByte/s
sequentielles Schreiben	max. 1,7 MByte/s
Unterstützung	
Betriebssysteme	
Windows XP Professional	Ja
Windows XP Embedded	Ja
Windows ME	Ja
Windows 2000	Ja
Windows CE 5.0	Ja
Windows CE 4.2	Ja
Elektrische Eigenschaften	
Stromaufnahme	650 µA Schlafmodus, 150 mA Lesen/Schreiben

Tabelle 288: 5MMUSB.2048-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5MMUSB.2048-00
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	
Betrieb	0 bis 45°C
Lagerung	-20 bis 60°C
Transport	-20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	10 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung	5 bis 90%, nicht kondensierend
Transport	5 bis 90%, nicht kondensierend
Vibration	
Betrieb	10 bis 500 Hz: 2 g (19,6 m/s² 0-peak), Schwingungsrate 1/Minute
Lagerung	10 bis 500 Hz: 2 g (19,6 m/s² 0-peak), Schwingungsrate 1/Minute
Transport	10 bis 500 Hz: 2 g (19,6 m/s² 0-peak), Schwingungsrate 1/Minute
Schock	
Betrieb	max. 40 g (392 m/s² 0-peak) und 11 ms Dauer
Lagerung	max. 80 g (784 m/s² 0-peak) und 11 ms Dauer
Transport	max. 80 g (784 m/s² 0-peak) und 11 ms Dauer
Meereshöhe	
Betrieb	max. 3048 m
Lagerung	max. 12192 m
Transport	max. 12192 m
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen	
Breite	19 mm
Länge	52,2 mm
Höhe	7,9 mm

Tabelle 288: 5MMUSB.2048-00 - Technische Daten

1) Signalisiert Datenübertragung (Empfang und Sendung).

7.1.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm

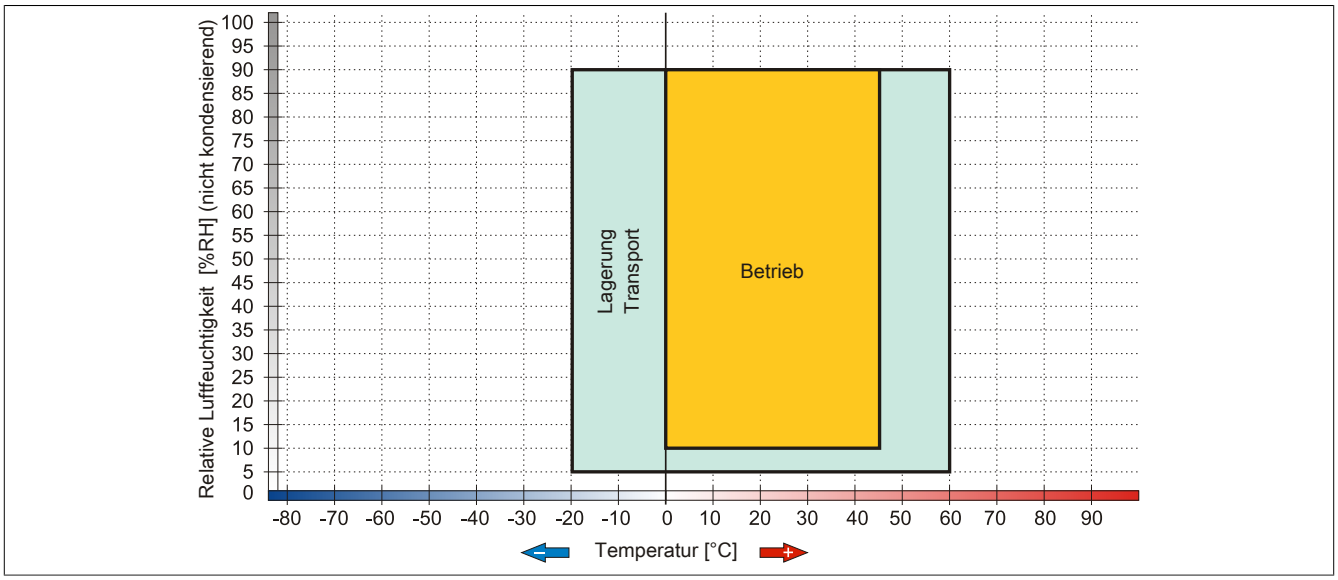


Abbildung 204: 5MMUSB.2048-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

7.2 5MMUSB.xxxx-01

7.2.1 Allgemeines

USB Memory Sticks sind leicht zu tauschende Speichermedien. Aufgrund des schnellen Datentransfers (USB 2.0) bieten die USB Memory Sticks optimale Werte für den Einsatz als portables Speichermedium. "Hot-PLUG & PLAY" - ohne weitere Treiber (außer bei Windows 98SE) meldet sich der USB Memory Stick sofort als ein weiteres Laufwerk, von dem Daten gelesen oder auf das Daten geschrieben werden können.

Information:

Auf Grund der Vielzahl der am Markt verfügbaren USB Memory Sticks, bzw. deren kurzen Lebenszyklen, behalten wir uns das Recht vor Alternativprodukte zu liefern. Es kann daher notwendig sein, folgende Maßnahmen zu treffen um auch von diesen USB Sticks booten zu können:

- **Der USB Stick muss neu formatiert bzw. in manchen Fällen auch neu partitioniert werden (Partition aktiv schalten).**
- **Der USB Stick muss in der Bootorder des BIOS an erster Stelle stehen oder es können auch alternativ die IDE Kontroller im BIOS deaktiviert werden. In den meisten Fällen kann dies umgangen werden, wenn noch zusätzlich ein „fdisk / mbr“ auf dem USB Memory Stick ausgeführt wird.**

7.2.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	USB Zubehör	
5MMUSB.2048-01	USB 2.0 Memory Stick, 2048 MByte, B&R	
5MMUSB.4096-01	USB 2.0 Memory Stick, 4096 MByte, B&R	

Tabelle 289: 5MMUSB.2048-01, 5MMUSB.4096-01 - Bestelldaten

7.2.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5MMUSB.2048-01	5MMUSB.4096-01
Allgemeines		
Kapazität	2 GByte	4 GByte
LEDs	1 LED (grün) [1)]	
MTBF	> 3.000.000 Stunden	
Typ	USB 1.1, USB 2.0	
Wartung	keine	
Formatierung ab Werk	FAT16	FAT32
Zertifizierungen		
CE	Ja	
GOST-R	Ja	
Schnittstellen		
USB		
Typ	USB 1.1, USB 2.0	
Anschluss	an jede USB Typ A Schnittstelle	
Übertragungsrate	Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)	
sequentielles Lesen	Full Speed max. 1 MByte/s, High Speed max. 32 MByte/s	
sequentielles Schreiben	Full Speed max. 0,9 MByte/s, High Speed max. 23 MByte/s	
Endurance		
SLC-Flash	Ja	
Datenerhaltung	> 10 Jahre	
Datenverlässlichkeit	< 1 nichtbehebbarer Fehler in 10^{14} Bit Lesezugriffen	
Steckzyklen	> 1500	
Unterstützung		
Betriebssysteme		
Windows 7	Ja	
Windows XP Professional	Ja	
Windows XP Embedded	Ja	
Windows ME	Ja	
Windows 2000	Ja	
Windows CE 5.0	Ja	
Windows CE 4.2	Ja	
Elektrische Eigenschaften		
Stromaufnahme	max. 500 µA Schlafmodus, max. 120 mA Lesen/Schreiben	

Tabelle 290: 5MMUSB.2048-01, 5MMUSB.4096-01 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5MMUSB.2048-01	5MMUSB.4096-01
Umgebungsbedingungen		
Temperatur		
Betrieb	0 bis 70°C	
Lagerung	-50 bis 100°C	
Transport	-50 bis 100°C	
Luftfeuchtigkeit		
Betrieb	85%, nicht kondensierend	
Lagerung	85%, nicht kondensierend	
Transport	85%, nicht kondensierend	
Vibration		
Betrieb	20 bis 2000 Hz: 20 g (peak)	
Lagerung	20 bis 2000 Hz: 20 g (peak)	
Transport	20 bis 2000 Hz: 20 g (peak)	
Schock		
Betrieb	max. 1500 g (peak)	
Lagerung	max. 1500 g (peak)	
Transport	max. 1500 g (peak)	
Meereshöhe		
Betrieb	max. 3048 m	
Lagerung	max. 12192 m	
Transport	max. 12192 m	
Mechanische Eigenschaften		
Abmessungen		
Breite	17,97 mm	
Länge	67,85 mm	
Höhe	8,35 mm	

Tabelle 290: 5MMUSB.2048-01, 5MMUSB.4096-01 - Technische Daten

1) Signalisiert Datenübertragung (Empfang und Sendung).

7.2.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm

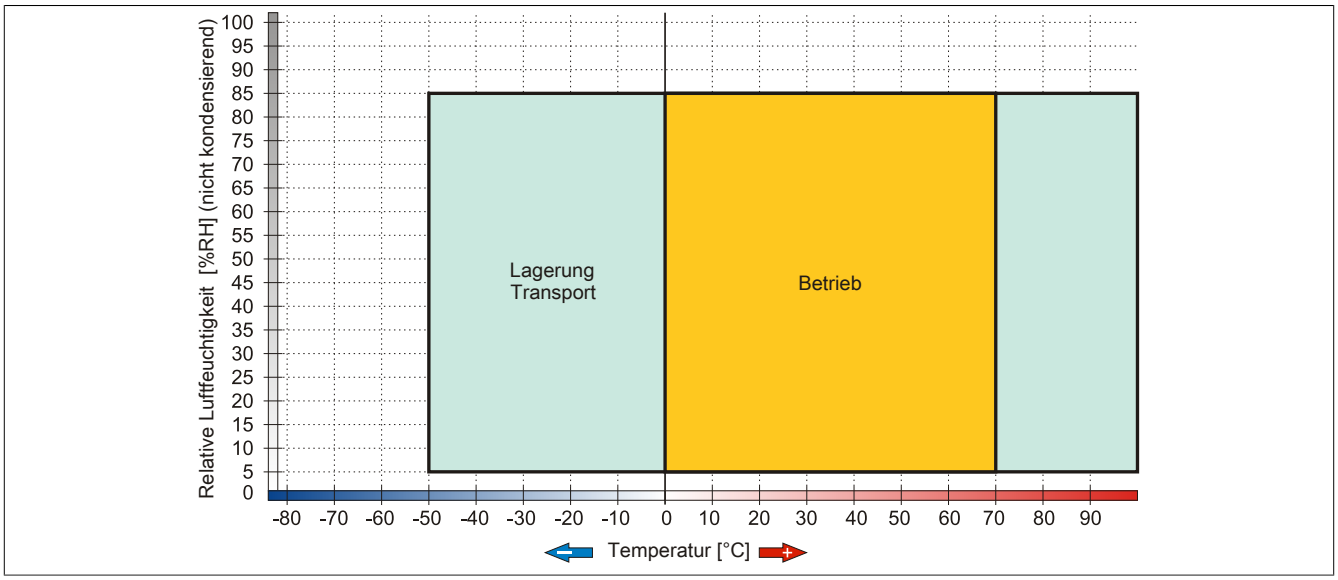


Abbildung 205: 5MMUSB.xxxx-01 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

8 Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Der B&R Industrie PC sorgt mit der optionalen integrierten USV dafür, dass das PC System auch nach einem Spannungsausfall Schreibvorgänge zu Ende führen kann. Erkennt die USV einen Spannungsausfall wird unterbrechungsfrei auf Batteriebetrieb umgeschaltet. Alle laufenden Programme werden durch die USV Software korrekt beendet. Inkonsistente Daten sind damit ausgeschlossen (funktioniert nur wenn die USV bereits konfiguriert wurde und der Treiber aktiviert ist).

Information:

- **Das Panel / der Monitor wird von der USV nicht gepuffert und fällt somit bei einem Stromausfall aus.**
- **Genauere Informationen zur Unterbrechungsfreien Stromversorgung können im USV-Anwenderhandbuch (der externen USV) nachgelesen werden. Dieses kann von der B&R Homepage heruntergeladen werden.**

Durch die Integration der Ladeschaltung in das Gehäuse des B&R Industrie PC, reduziert sich die Installation auf das Anschließen des Verbindungskabels zur Batterieeinheit die neben dem PC montiert wird.

Bei der Konstruktion der Batterieeinheit wurde auf die Wartungsfreundlichkeit besonderer Wert gelegt. Die Batterien sind frontseitig optimal zugänglich und im Servicefall in wenigen Augenblicken getauscht.

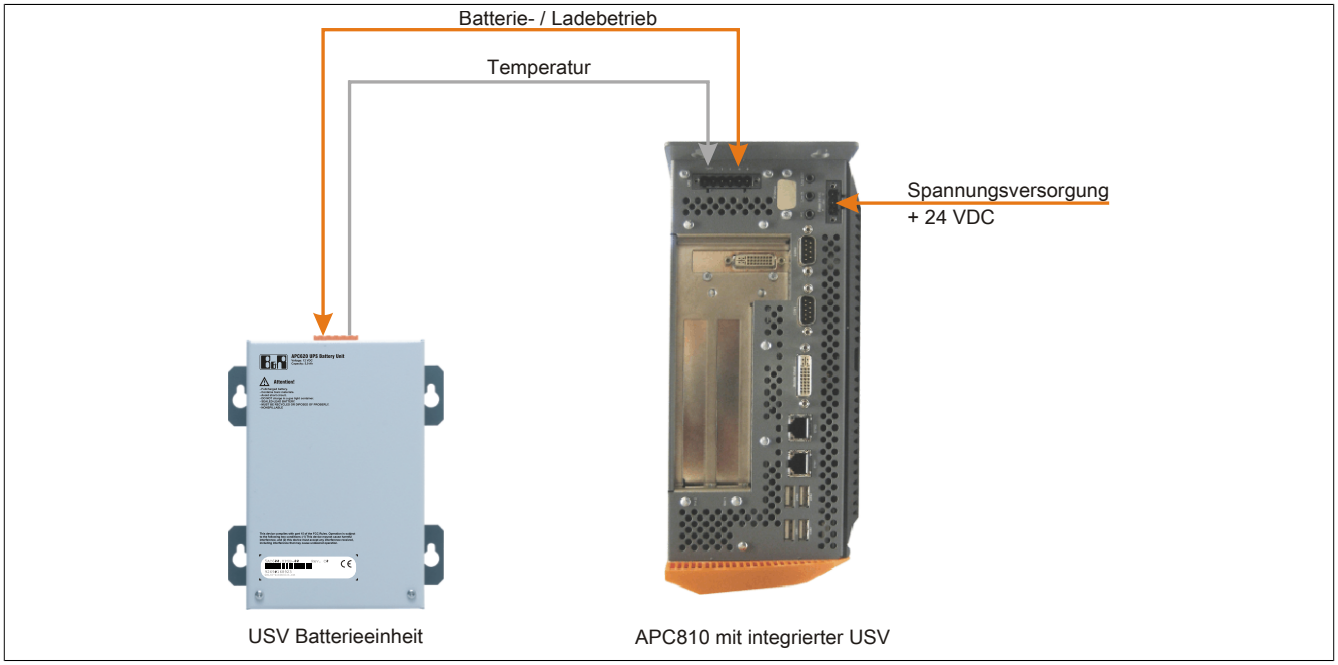


Abbildung 206: USV Prinzip

8.1 Features

- Wartungsfreie Akkus mit langer Lebensdauer
- Kommunikation über integrierte Schnittstelle
- Temperatursensor
- Treibersoftware
- Tiefentladeschutz

8.2 Was wird benötigt

- Eine passende Systemeinheit.
- Add-on USV Modul 5AC600.UPSI-00
- Batterieeinheit 5AC600.UPSB-00
- USV Verbindungskabel 0,5 Meter (5CAUPS.0005-00) oder 3 Meter (5CAUPS.0030-00)
- Parametrierung der B&R USV mittels ADI Control Center.

8.3 5AC600.UPSI-00

8.3.1 Allgemeines

Das Add-on USV Modul kann leicht bei einer geeigneten Systemeinheit (benötigte Revision siehe Abschnitt 8.2 "Was wird benötigt" auf Seite 380) integriert werden.

8.3.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Unterbrechungsfreie Stromversorgung	
5AC600.UPSI-00	USV Modul für APC620, APC810, PPC800; für Systemeinheiten 5PC600.SX01-00 (ab Rev. H0), 5PC600.SX02-00 (ab Rev. G0), 5PC600.SX02-01 (ab Rev. H0), 5PC600.SX05-00 (ab Rev. F0), 5PC600.SX05-01 (ab Rev. F0), 5PC600.SF03-00 (ab Rev. A0), 5PC810.SX*. 5PC820.1505-00, 5PC820.1906-00. Kabel (5CAUPS.0005-00 bzw. 5CAUPS.0030-00) und Batterieeinheit (5AC600.UPSB-00) sind separat zu bestellen.	
	Erforderliches Zubehör	
	Unterbrechungsfreie Stromversorgung	
5AC600.UPSB-00	Batterieeinheit 5Ah; für APC620, APC810 oder PPC800 USV.	
5CAUPS.0005-00	USV Kabel 0,5 m; für USV 5AC600.UPSI-00.	
5CAUPS.0030-00	USV Kabel - 3 m. - Für 5AC600.IUPS-00	

Tabelle 291: 5AC600.UPSI-00 - Bestelldaten

8.3.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5AC600.UPSI-00
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
GOST-R	Ja
GL	Ja [1)]
Elektrische Eigenschaften	
Leistungsaufnahme	max. 7,5 Watt
Netzausfallüberbrückung	max. 20 min bei 150 W Last
Tiefentladeschutz	Ja, bei 10 V der Batterieeinheit
kurzschlussfest	Nein
Ladekenndaten Batterie	
Ladestrom	max. 0,5 A
Umschaltschwelle	
Batteriebetrieb	13 V
Netzbetrieb	15 V

Tabelle 292: 5AC600.UPSI-00 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

8.3.4 Montage

Die Montage erfolgt mit dem mitgeliefertem Montagematerial. Weitere Informationen zur Montage sind im Kapitel 7 "Wartung / Instandhaltung" zu finden.

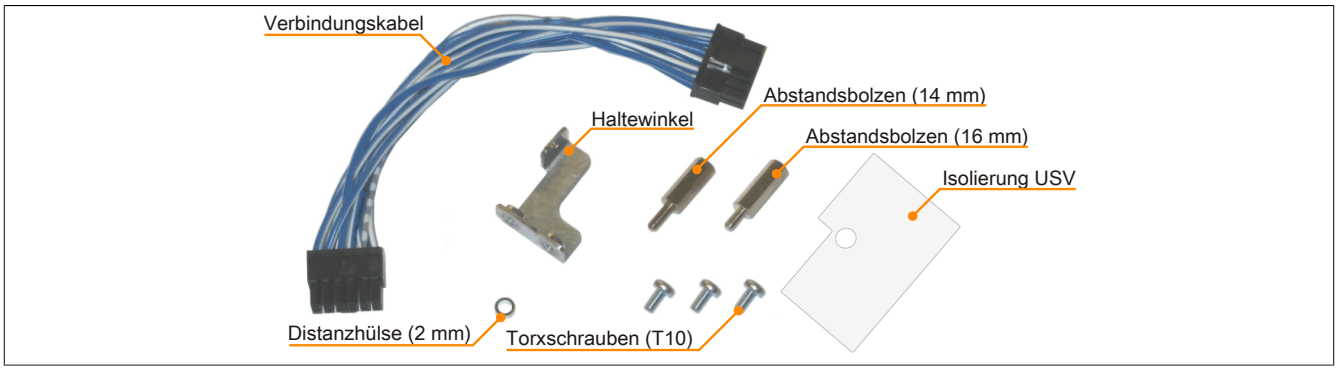


Abbildung 207: 5AC600.UPSI-00 Add-on USV Modul Montagematerial

8.4 5AC600.UPSB-00

8.4.1 Allgemeines

Die Batterieeinheit stellt ein Verschleißteil dar und sollte regelmäßig (mindestens nach der angegebenen Lebensdauer) erneuert werden.

8.4.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Unterbrechungsfreie Stromversorgung	
5AC600.UPSB-00	Batterieeinheit 5Ah; für APC620, APC810 oder PPC800 USV.	

Tabelle 293: 5AC600.UPSB-00 - Bestelldaten

8.4.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5AC600.UPSB-00	
Revision	**D0**	**E0**
Allgemeines		
Batterie		
Typ	Enersys Cyclon 12 V 5 Ah (6 Stk. in Serie geschaltet)	
Lebensdauer	bis zu 15 Jahre bei 20°C / bis zu 10 Jahre bei 25°C [1]	
Ausführung	Single Cell	
Temperatursensor	NTC Widerstand	
Wartungsintervall bei Lagerung	alle 6 Monate 1 mal laden	
Zertifizierungen		
CE	Ja	
cULus	Ja	
GOST-R	Ja	
GL	Ja [2]	
Ladedauer bei Low Battery	typ. 15 Stunden	
Elektrische Eigenschaften		
Nennspannung	12 V	
Batteriestrom	max. 8 A	
Kapazität	5 Ah	
Sicherung [3]	nein [4]	ja [4]
Tiefentladespannung	10 V	
Umgebungsbedingungen		
Temperatur		
Ladebetrieb	-30 bis 60°C	
Betrieb	-40 bis 80°C	
Lagerung	-65 bis 80°C	
Transport	-65 bis 80°C	
Luftfeuchtigkeit		
Betrieb	5 bis 95%, nicht kondensierend	
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend	
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend	
Meereshöhe		
Betrieb	max. 3000 m	

Tabelle 294: 5AC600.UPSB-00, 5AC600.UPSB-00 - Technische Daten

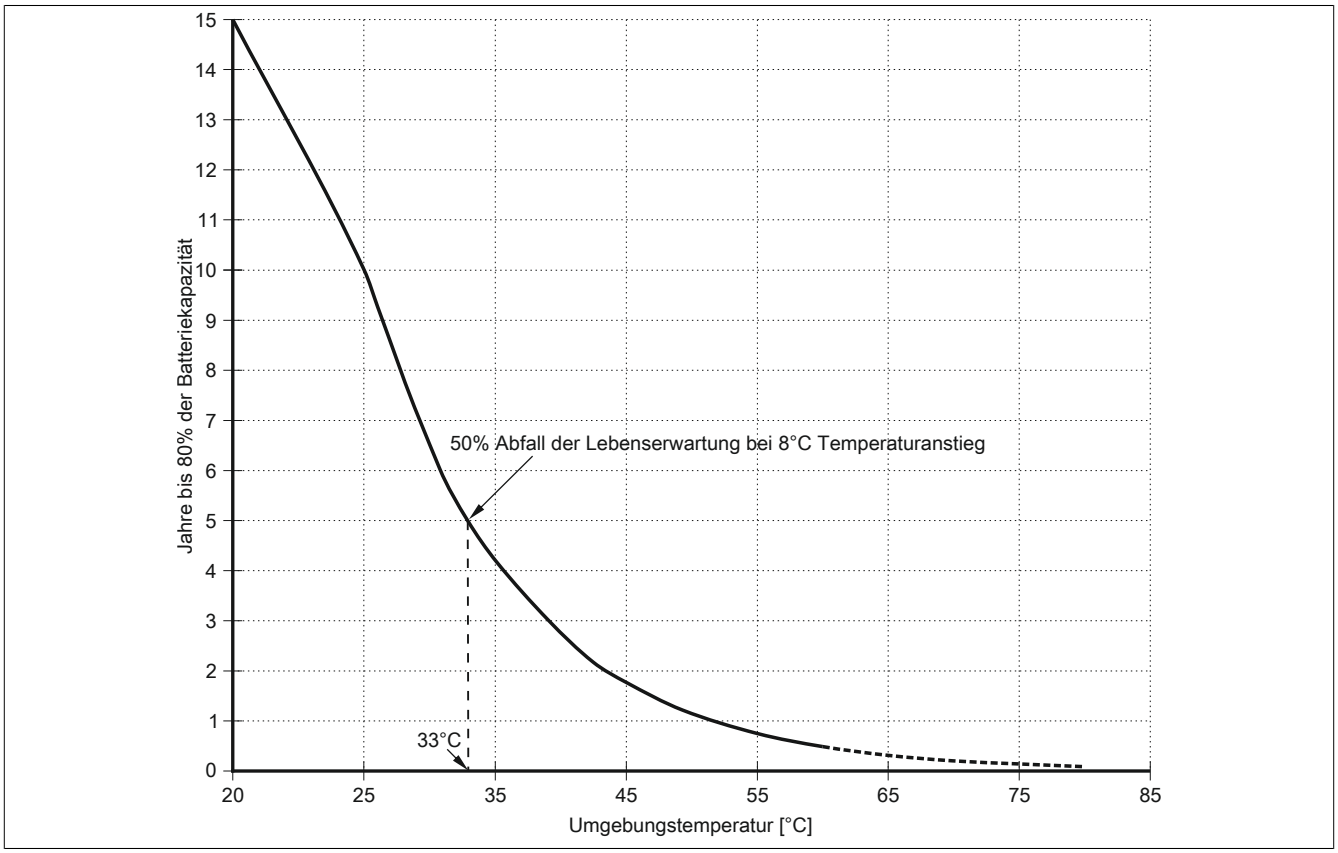
Produktbezeichnung	5AC600.UPSB-00	
Revision	**D0**	**E0**
Mechanische Eigenschaften		
Abmessungen		
Breite	104 mm [5)]	
Länge	170,5 mm	
Höhe	87,5 mm	
Gewicht	ca. 3200 g	

Tabelle 294: 5AC600.UPSB-00, 5AC600.UPSB-00 - Technische Daten

1) Abhängig von den Lade- und Entladezyklen (bis 80% Batteriekapazität).
2) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
3) 25 A Sicherung. Ersatzsicherungen können bei Bedarf separat nachbestellt werden.
4) Bei Revisionen bis einschließlich D0 kann die Sicherung nachträglich montiert werden. Mehr dazu im APC810 und PPC800 Anwenderhandbuch, Kapitel "Wartung / Instandhaltung".
5) Abmessung ohne Montagelaschen.

8.4.4 Lebensdauer

Nachfolgendes Diagramm zeigt den Zusammenhang zwischen Umgebungstemperatur und Lebensdauer.



8.4.5 Tiefentladezyklen

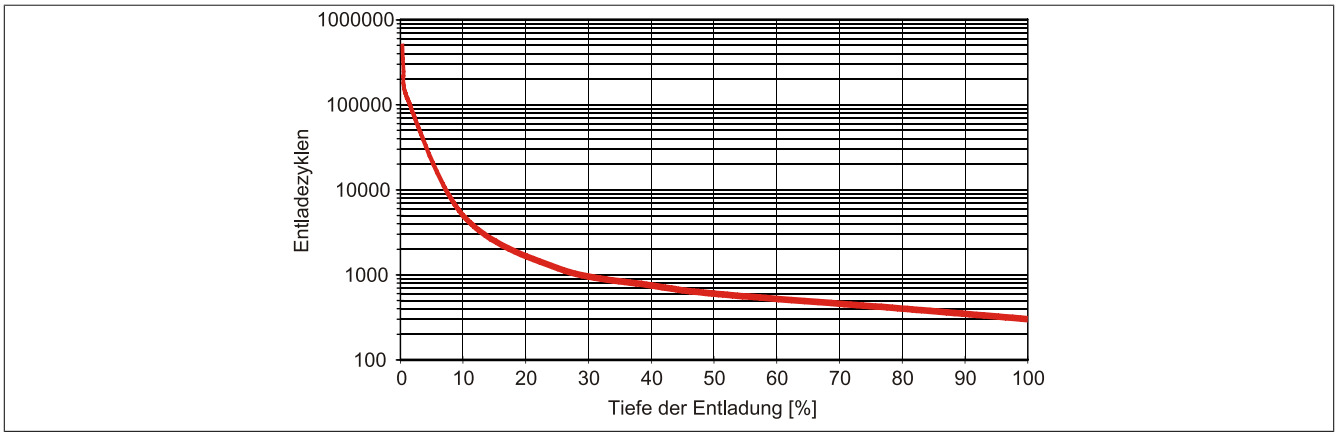


Abbildung 208: Tiefentladezyklen

8.4.6 Abmessungen

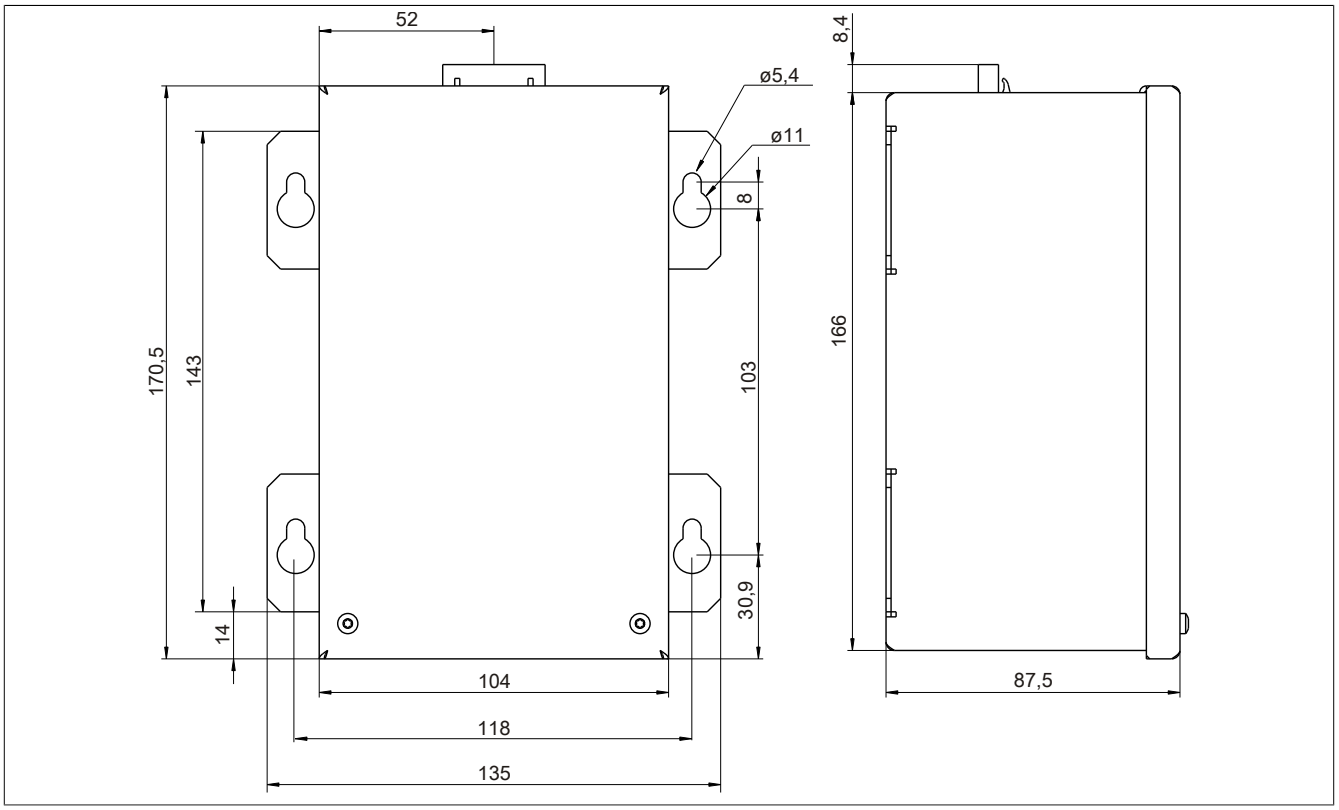


Abbildung 209: 5PC600.UPSB-00 - Abmessungen

8.4.7 Bohrschablone

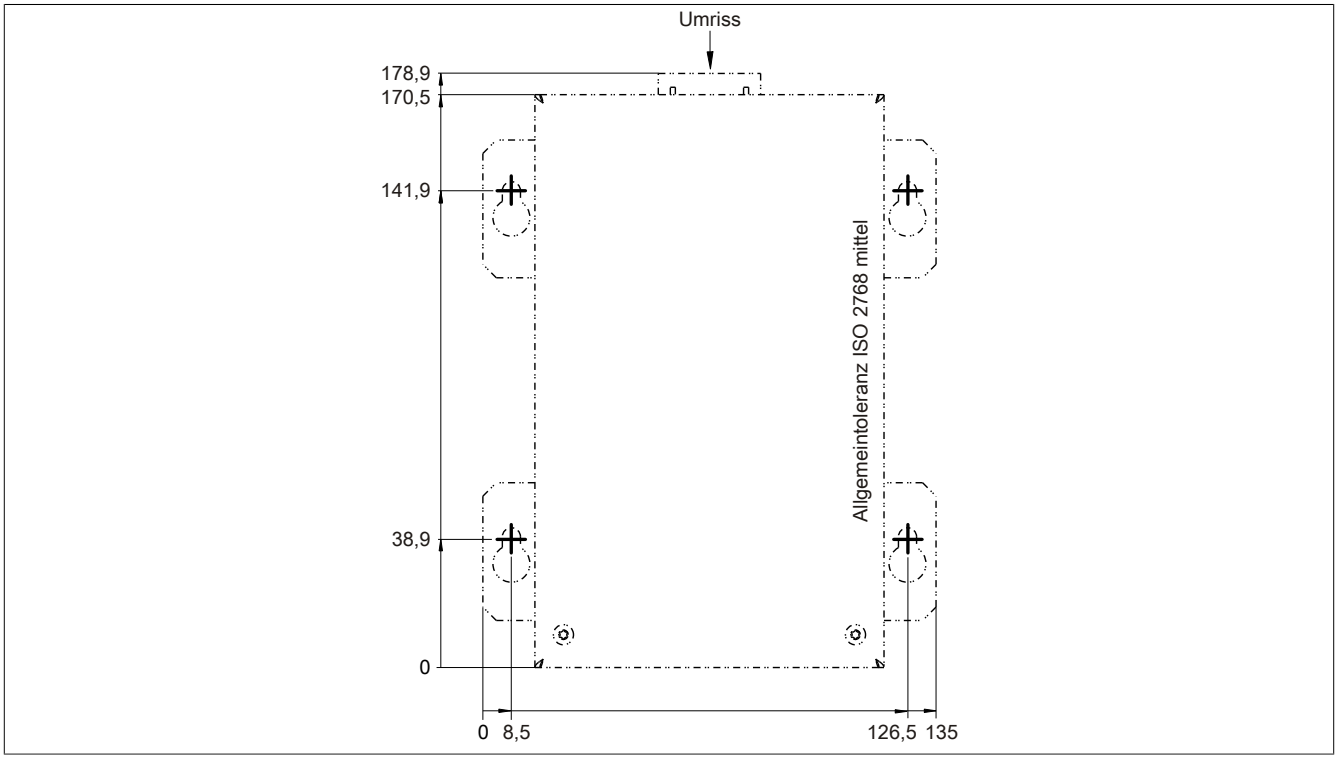


Abbildung 210: 5PC600.UPSB-00 - Bohrschablone

8.4.8 Montagevorschriften

Auf Grund der speziellen Bauweise dieser Akkumulatoren können diese in jeder beliebigen Lage betrieben so wie auch gelagert werden.

8.5 5CAUPS.00xx-00

8.5.1 Allgemeines

Das USV Verbindungskabel stellt die Verbindung zwischen dem Add-on USV Modul 5AC600.UPSI-00 und der Batterieeinheit 5AC600.UPSB-00 her. Es ist in den Längen 0,5 m und 3 m erhältlich.

8.5.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Unterbrechungsfreie Stromversorgung	
5CAUPS.0005-00	USV Kabel 0,5 m; für USV 5AC600.UPSI-00.	
5CAUPS.0030-00	USV Kabel - 3 m. - Für 5AC600.IUPS-00	

Tabelle 295: 5CAUPS.0005-00, 5CAUPS.0030-00 - Bestelldaten

8.5.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5CAUPS.0005-00	5CAUPS.0030-00
Allgemeines		
Zertifizierungen		
CE	Ja	
cULus	Ja	
GOST-R	Ja	
GL	Ja [1]	
Kabelaufbau		
Drahtquerschnitt	2x 0,5 mm² (AWG 20) 4x 2,5 mm² (AWG 13)	
Leiterwiderstand	bei 0,5 mm² max. 39 Ω/km bei 2,5 mm² max. 7,98 Ω/km	
Außenmantel		
Material	thermoplastischer Kunststoff auf PVC Basis	
Farbe	fenstergrau (ähnlich RAL 7040)	
Steckverbindung		
Typ	Stiftstecker Zugbügel-Schraubanschluss 6-polig / Buchsenleiste Zugbügel-Schraubanschluss 6-polig	
Elektrische Eigenschaften		
Betriebsspannung	max. 300 V	
Betriebsspitzenspannung	typ. 12 VDC / max. 15 VDC	
Prüfspannung		
Ader/Ader	1500 V	
Strombelastbarkeit	10 A bei 20°C	
Umgebungsbedingungen		
Temperatur		
bewegt	-5 bis 80°C	
ruhend	-30 bis 80°C	
Mechanische Eigenschaften		
Abmessungen		
Länge	0,5 m	3 m
Durchmesser	8,5 mm ±0,2 mm	
Biegeradius		
bewegt	10x Leitungsdurchmesser	
feste Verlegung	5x Leitungsdurchmesser	
Gewicht	ca. 100 g	ca. 470 g

Tabelle 296: 5CAUPS.0005-00, 5CAUPS.0030-00 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

8.6 5AC600.UPSF-00

8.6.1 Allgemeines

Das USV Sicherungs Kit dient zur Nachrüstung einer Sicherung für die Batterieeinheit 5AC600.UPSB-00.

Eine Montageanleitung des Sicherungs Kit 5AC600.UPSF-00 findet sich unter "Montage des USV Sicherungs Kit an der Batterieeinheit" auf Seite 439.

Information:

Das USV Sicherungs Kit 5AC600.UPSF-00 wird nur für Batterieeinheiten bis einschließlich Revision D0 benötigt. Ab Revision E0 ist bereits eine 25 A Sicherung auf der Steckerpaltine der Batterieeinheit integriert.

8.6.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Unterbrechungsfreie Stromversorgung	
5AC600.UPSF-00	USV Sicherungs Kit für Batterieeinheit 5AC600.UPSB-00 bis Revision D0.	
	Optionales Zubehör	
	Unterbrechungsfreie Stromversorgung	
5AC600.UPSF-01	USV Sicherung, 5 Stück	

Tabelle 297: 5AC600.UPSF-00 - Bestelldaten

8.7 5AC600.UPSF-01

8.7.1 Allgemeines

Diese 25 A Sicherungen dienen als Ersatzteil für die Batterieeinheit 5AC600.UPSB-00 ab Revision E0 sowie für das Sicherungs Kit 5AC600.UPSF-00.

8.7.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Unterbrechungsfreie Stromversorgung	
5AC600.UPSF-01	USV Sicherung, 5 Stück	

Tabelle 298: 5AC600.UPSF-01 - Bestelldaten

9 Netzfilter

9.1 5AC804.MFLT-00

9.1.1 Allgemeines

Der Netzfilter 5AC804.MFLT-00 kann nötig sein, um die Anforderungen hinsichtlich leitungsgebundener Störaussendungen nach GL (Germanischer Lloyd) EMC1 Auflage 2003 in Versorgungsleitungen zu erfüllen.

Der Netzfilter sollte möglichst nahe am Endgerät montiert und die Versorgungsleitung vom Endgerät zum Netzfilter so kurz als möglich gehalten werden.

9.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Zubehör	
5AC804.MFLT-00	Netzfilter	

Tabelle 299: 5AC804.MFLT-00 - Bestelldaten

9.1.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5AC804.MFLT-00
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
cULus HazLoc Class 1 Division 2	Ja [1]
GOST-R	Ja
GL	Ja [2]
Feldklemme	
Anschlussquerschnitt	
mit Aderendhülse	1,5 mm²
flexibel	0,2 bis 1,5 mm²
starr	0,2 bis 2,5 mm²
Elektrische Eigenschaften	
Nennspannung	24 VDC -25% / +30%, SELV [3]
Nennstrom	8 A
Überspannungskategorie nach EN 61131-2	II
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	
Betrieb	-25 bis 65°C
Lagerung	-25 bis 65°C
Transport	-25 bis 65°C
Mechanische Eigenschaften	
Gehäuse	
Material	verzinktes Blech
Abmessungen	
Breite	54 mm
Länge	94 mm
Tiefe	32,15 mm
Gewicht	205 g

Tabelle 300: 5AC804.MFLT-00 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben und das Gesamtgerät die entsprechende Kennzeichnung trägt.
2) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
3) Die Anforderungen sind gemäß EN 60950 einzuhalten, siehe Kapitel 2.6.1 Spannungsversorgung +24 VDC.

9.1.4 Abmessungen

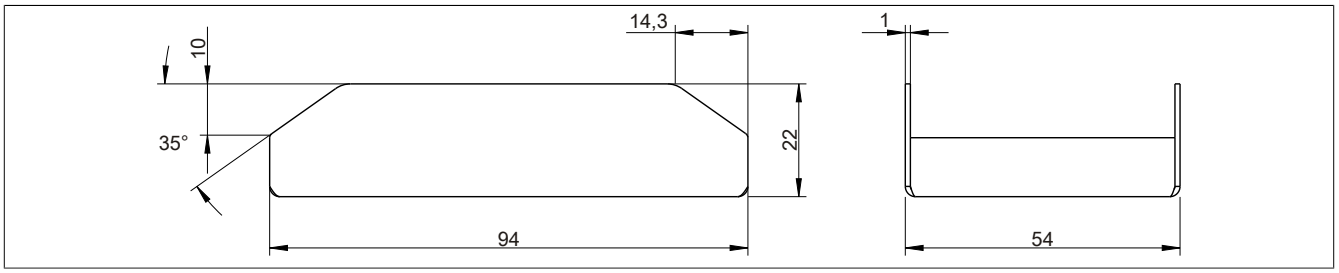


Abbildung 211: 5AC804.MFLT-00 - Abmessungen

9.1.5 Bohrschablone

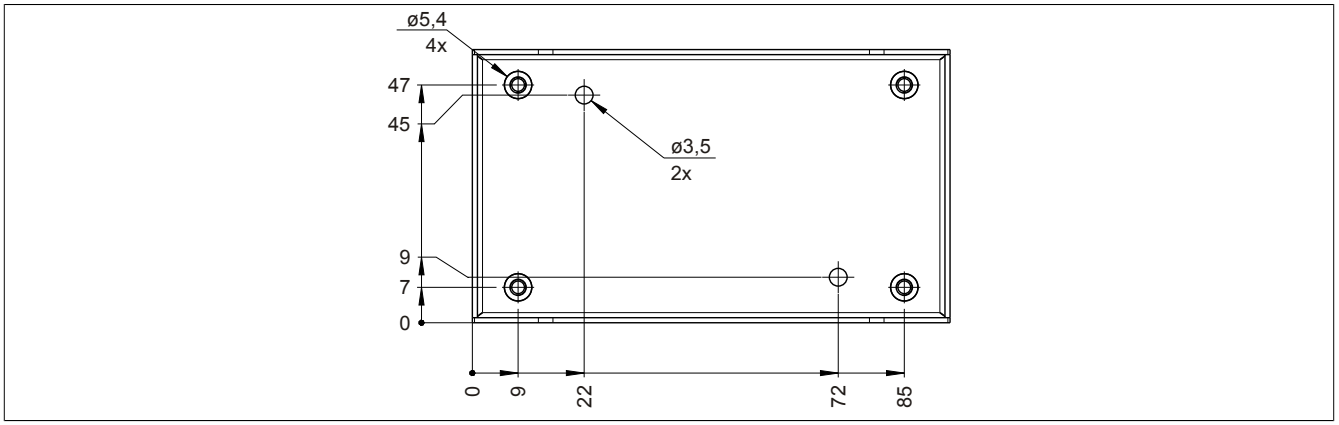


Abbildung 212: 5AC804.MFLT-00 - Bohrschablone

9.1.6 Anschluss an das Endgerät

Der Netzfilter muss zwischen der Spannungsversorgung und dem Endgerät geschaltet sein.

Folgendes muss beachtet werden:

- verdrillte und geschirmte Leitungen verwenden
- die Leitungen so kurz wie möglich halten (Spannungsversorgung - Netzfilter - Endgerät)
- der Netzfilter muss auf einer metallischen lack- und ölfreien Fläche montiert werden

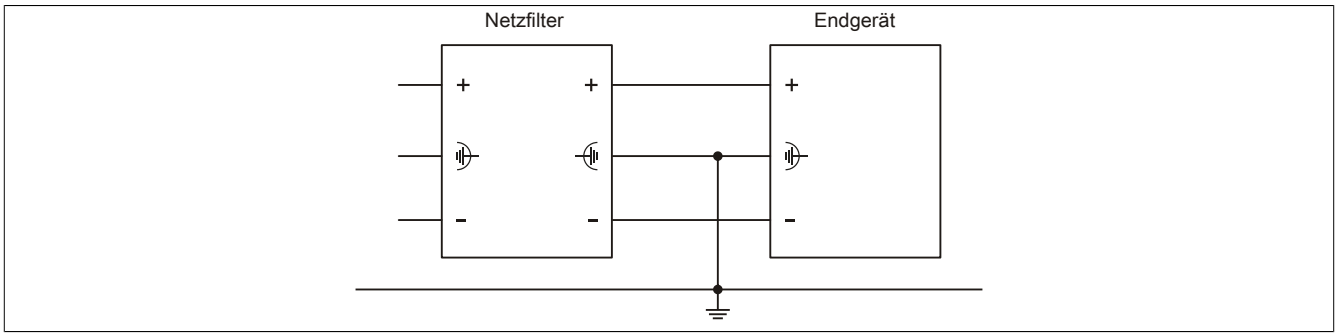


Abbildung 213: Schematisches Anschlussbeispiel

10 PCI Einsteckkarten

10.1 5ACPCI.ETH1-01

10.1.1 Allgemeines

Die universal (3,3V bzw. 5V) half size PCI Ethernet Karte verfügt über einen 10/100 MBit/s Netzwerkanschluss und kann als ergänzende Netzwerkschnittstelle in einem Standard 16 Bit PCI Steckplatz gesteckt und betrieben werden.

- PCI Ethernet Karte
- 1x Ethernet-Schnittstelle (10/100 MBit/s)

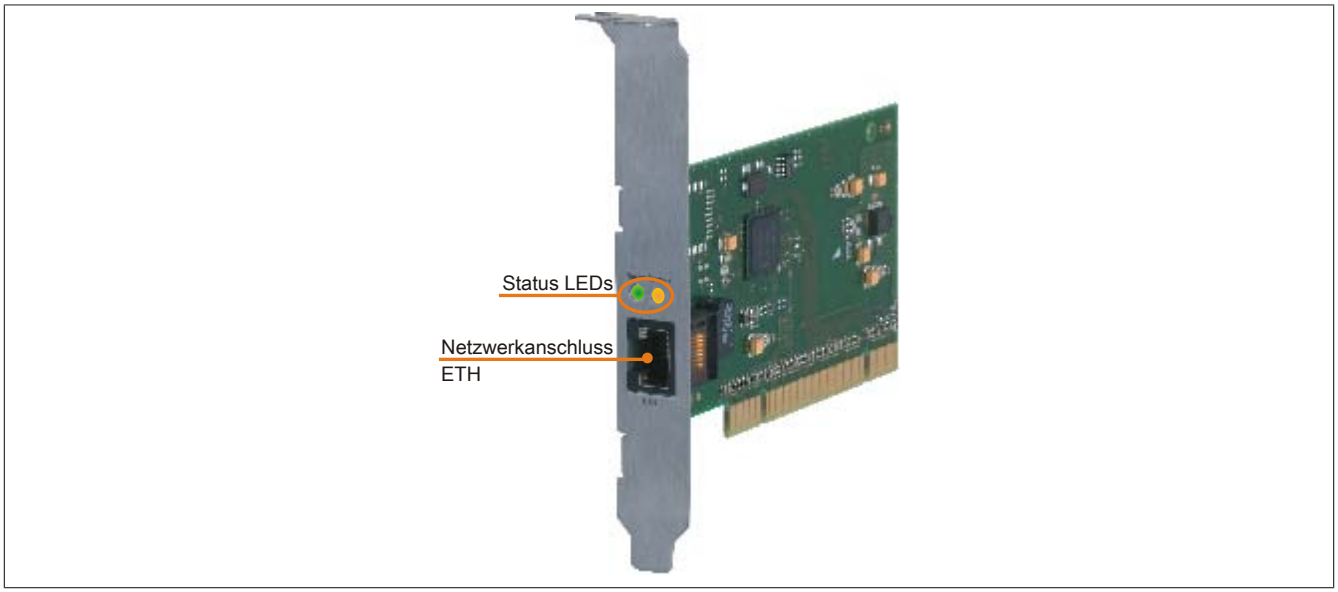


Abbildung 214: 5ACPCI.ETH1-01 - PCI Ethernet Card 10/100

10.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Zubehör	
5ACPCI.ETH1-01	PCI Ethernet Card 1x 10/100	

Tabelle 301: 5ACPCI.ETH1-01 - Bestelldaten

10.1.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5ACPCI.ETH1-01
Allgemeines	
B&R ID-Code	0xA58A
Diagnose Datenübertragung	 Ja, per Status LED

Tabelle 302: 5ACPCI.ETH1-01 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5ACPCI.ETH1-01
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
cULus HazLoc Class 1 Division 2	Ja [1]
GOST-R	Ja
GL	Ja [2]
Schnittstellen	
Ethernet	
Anzahl	1
Controller	Intel 82551ER
Ausführung	RJ45, geschirmt
Übertragungsrate	10/100 MBit/s
Leitungslänge	max. 100 m zwischen zwei Stationen (Segmentlänge)

Tabelle 302: 5ACPCI.ETH1-01 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben und das Gesamtgerät die entsprechende Kennzeichnung trägt.
2) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

10.1.3.1 Ethernet Schnittstelle

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für diese Einzelkomponente alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Ethernet Anschluss		
Controller	Intel 82551ER	
Versorgung	Universalkarte (2 Kerben) für 3,3V bzw. 5V	
Verkabelung	S/STP (Cat5e)	
Übertragungsgeschwindigkeit	10/100 MBit/s	
Kabellänge	max. 100 m (min. Cat5e)	
LED	**Ein**	**Aus**
Grün	100 MBit/s	10 MBit/s
Orange	Link (Eine Verbindung zu einem Ethernet Netzwerk ist vorhanden)	Activity (Blinkt) (Daten werden übertragen)

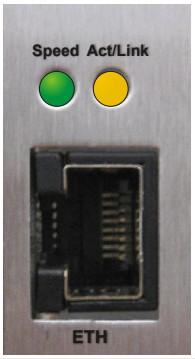


Tabelle 303: 5ACPCI.ETH1-01 - Technische Daten

10.1.4 Treibersupport

Für den Betrieb des Intel Ethernet-Controllers 82551ER ist ein spezieller Treiber notwendig. Es stehen für die freigegebenen Betriebssysteme (Windows XP Professional, Windows XP Embedded und DOS) im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) Treiber zum Download bereit.

Information:

Benötigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzuladen.

10.1.5 Abmessungen

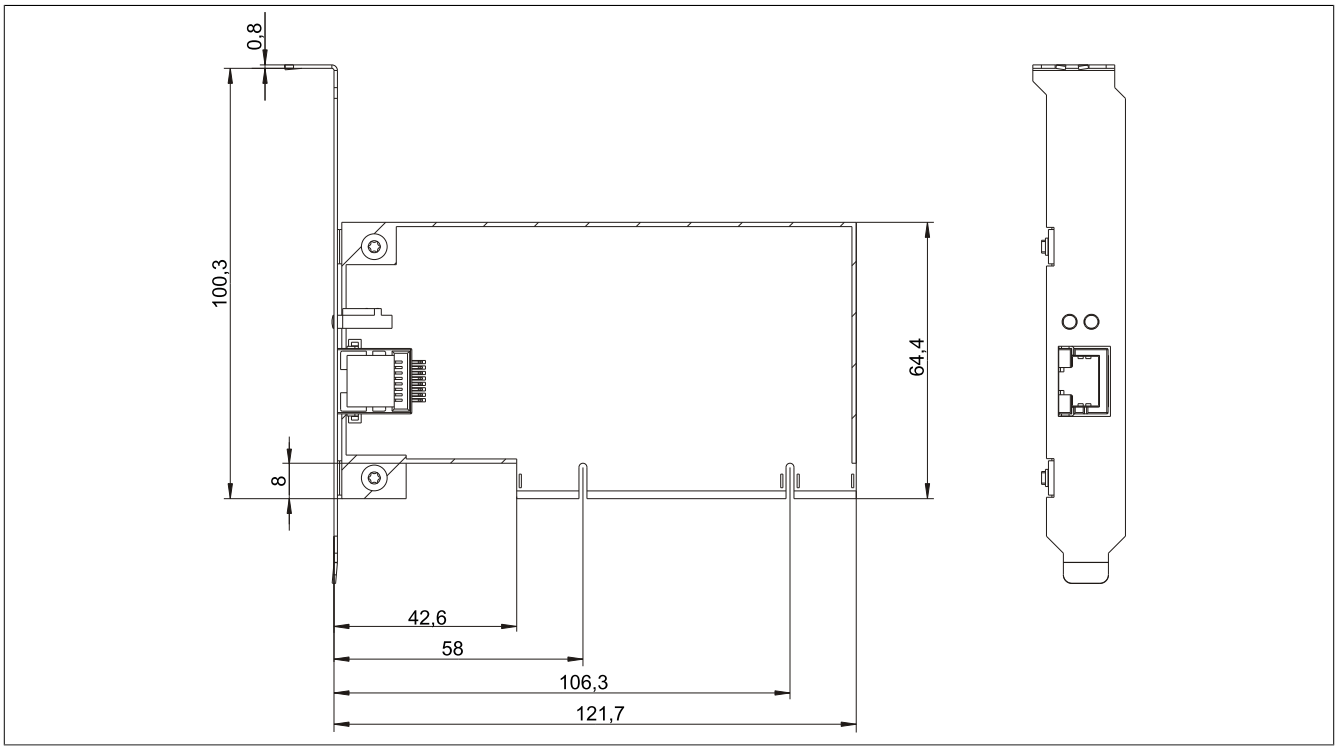


Abbildung 215: 5ACPCI.ETH1-01 - Abmessungen

10.2 5ACPCI.ETH3-01

10.2.1 Allgemeines

Die universal (3,3V bzw. 5V) half size PCI Ethernet Karte verfügt über drei 10/100 MBit/s Netzwerkanschlüsse und kann als ergänzende Netzwerkschnittstelle in einem Standard 16 Bit PCI Steckplatz gesteckt und betrieben werden.

- PCI Ethernet Karte
- 3x Ethernet-Schnittstellen (10/100 MBit/s)

Abbildung 216: 5ACPCI.ETH3-01 - PCI Ethernet Card 10/100

10.2.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Zubehör	
5ACPCI.ETH3-01	PCI Ethernet Card 3x 10/100	

Tabelle 304: 5ACPCI.ETH3-01 - Bestelldaten

10.2.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5ACPCI.ETH3-01
Allgemeines	
B&R ID-Code	0xA58B
Diagnose	
Datenübertragung	Ja, per Status LED
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
cULus HazLoc Class 1 Division 2	Ja [1]
GOST-R	Ja
GL	Ja [2]

Tabelle 305: 5ACPCI.ETH3-01 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5ACPCI.ETH3-01
Schnittstellen	
Ethernet	
Anzahl	3
Controller	Intel 82551ER
Ausführung	RJ45, geschirmt
Übertragungsrate	10/100 MBit/s
Leitungslänge	max. 100 m zwischen zwei Stationen (Segmentlänge)

Tabelle 305: 5ACPCI.ETH3-01 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben und das Gesamtgerät die entsprechende Kennzeichnung trägt.
2) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

10.2.3.1 Ethernet Schnittstelle

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für diese Einzelkomponente alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

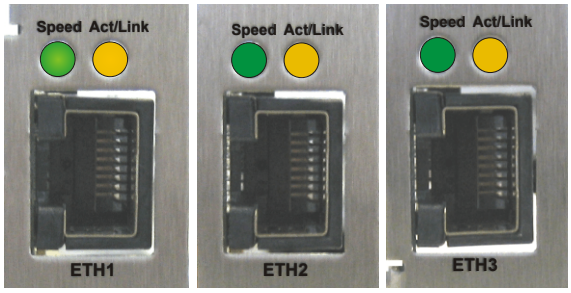
Ethernet Anschlüsse			
Controller	jeweils Intel 82551ER		
Versorgung	Universalkarte (2 Kerben) für 3,3V bzw. 5V		
Verkabelung	S/STP (Cat5e)		
Übertragungsgeschwindigkeit	10/100 MBit/s		
Kabellänge	max. 100 m (min. Cat5e)		
LED	**Ein**	**Aus**	
Grün	100 MBit/s	10 MBit/s	
Orange	Link (Eine Verbindung zu einem Ethernet Netzwerk ist vorhanden)	Activity (Blinkt) (Daten werden übertragen)	

Tabelle 306: 5ACPCI.ETH3-01 - Technische Daten

10.2.4 Treibersupport

Für den Betrieb des Intel Ethernet-Controllers 82551ER ist ein spezieller Treiber notwendig. Es stehen für die freigegebenen Betriebssysteme (Windows XP Professional, Windows XP Embedded und DOS) im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) Treiber zum Download bereit.

Information:

Benötigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzuladen.

10.2.5 Abmessungen

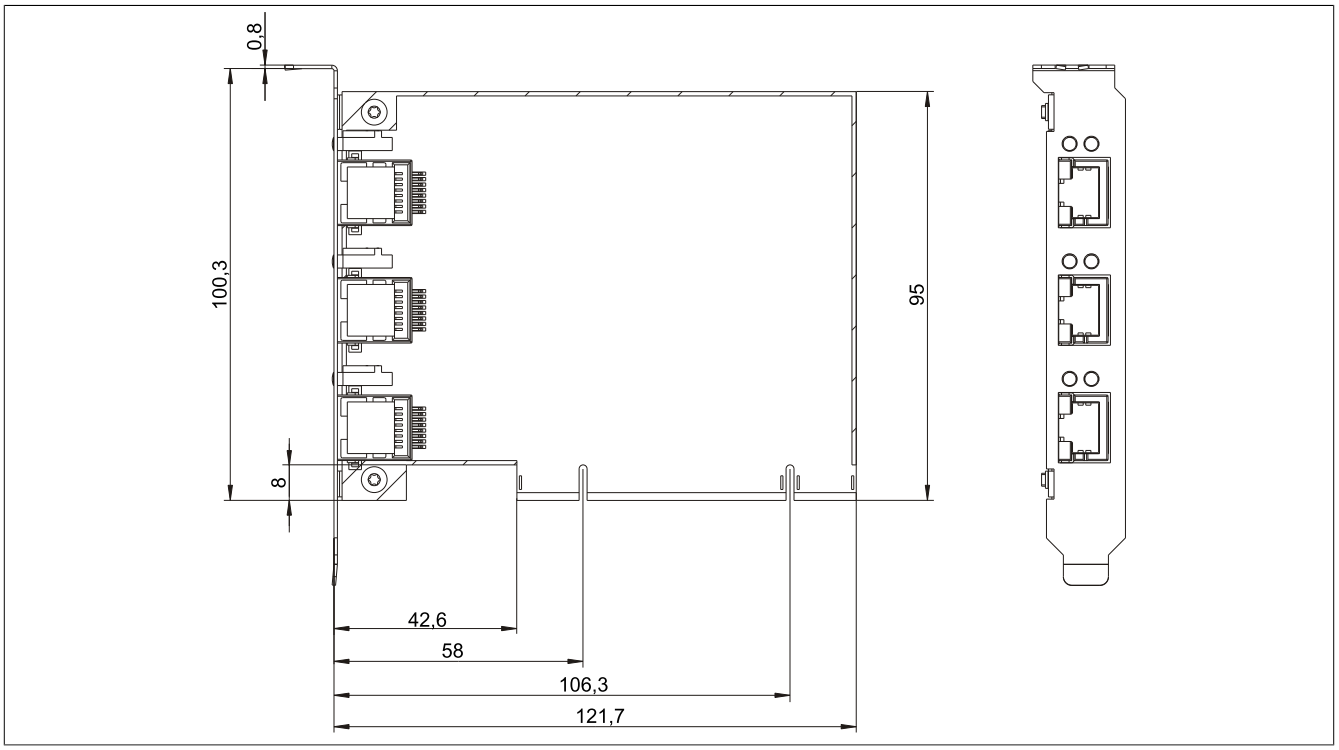


Abbildung 217: 5ACPCI.ETH3-01 - Abmessungen

11 Kabel

11.1 DVI-Kabel

11.1.1 5CADVI.0xxx-00

11.1.1.1 Allgemeines

Die DVI-Kabel 5CADVI.0xxx-00 sind für den Anwendungsfall einer starren Verlegung konzipiert.

> **Vorsicht!**
>
> **An- und Abstecken des Kabels darf nur in spannungslosem Zustand erfolgen.**

11.1.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	DVI-Kabel	
5CADVI.0018-00	DVI-D Kabel - 1,8 m	
5CADVI.0050-00	DVI-D Kabel - 5 m	
5CADVI.0100-00	DVI-D Kabel - 10 m	

Tabelle 307: 5CADVI.0018-00, 5CADVI.0050-00, 5CADVI.0100-00 - Bestelldaten

11.1.1.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5CADVI.0018-00	5CADVI.0050-00	5CADVI.0100-00
Allgemeines			
Zertifizierungen			
CE	Ja		
cULus	Ja		
GOST-R	Ja		
GL	Ja [1]		
Kabelaufbau			
Drahtquerschnitt	AWG 28		
Schirm	Kabelpaare einzeln, Kabel gesamt		
Gesamtschirmung	verzinntes Kupfergeflecht, optische Bedeckung > 86%		
Außenmantel			
Material	PVC		
Farbe	beige		
Bedruckung	AWM STYLE 20276 80°C 30V VW1 DVI DIGITAL SINGLE LINK DER AN		
Steckverbindung			
Typ	2x DVI-D (18+1), male		
Steckzyklen	100		
Anzugsdrehmoment Fixierschrauben	max. 0,5 Nm		
Elektrische Eigenschaften			
Leiterwiderstand	max. 237 Ω/km		
Isolationswiderstand	min. 100 MΩ/km		
Mechanische Eigenschaften			
Abmessungen			
Länge	1,8 m ±50 mm	5 m ±80 mm	10 m ±100 mm
Durchmesser	max. 8,5 mm		
Biegeradius	≥ 5x Kabeldurchmesser (Stecker - Ferrit und Ferrit - Ferrit)		
Gewicht	ca. 260 g	ca. 460 g	ca. 790 g

Tabelle 308: 5CADVI.0018-00, 5CADVI.0050-00, 5CADVI.0100-00 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

11.1.1.4 Biegeradiusspezifikation

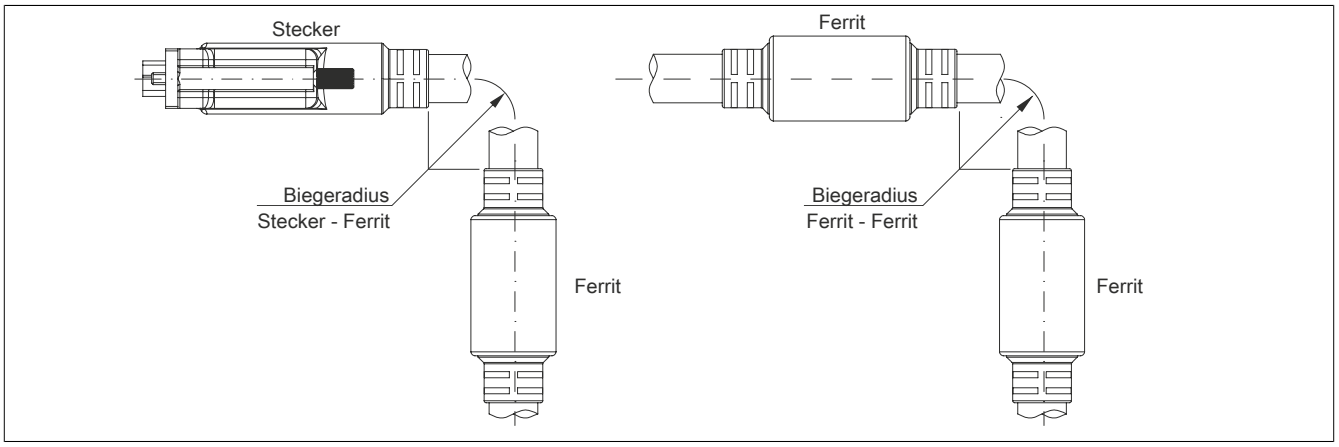


Abbildung 218: Biegeradiusspezifikation

11.1.1.5 Abmessungen

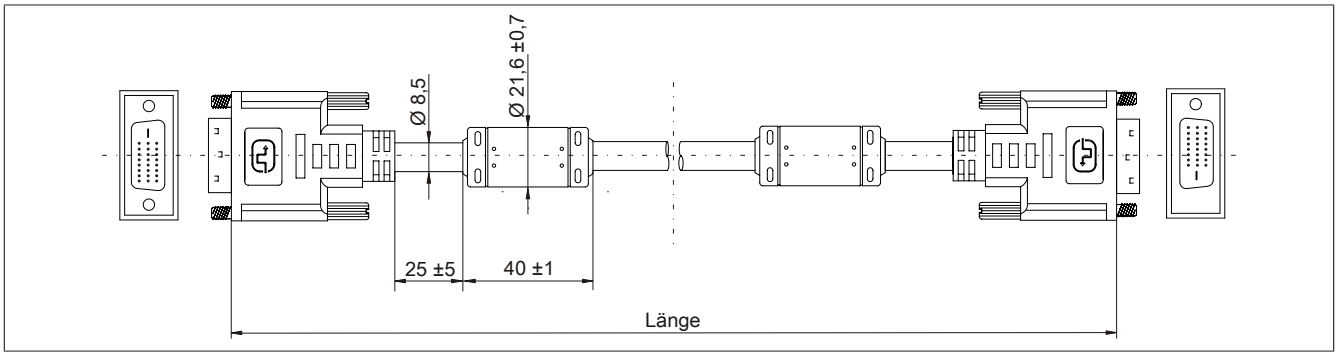


Abbildung 219: 5CADVI.0xxx-00 - Abmessungen

11.1.1.6 Kabelbelegung

Warnung!

Besteht der Wunsch sich selbst ein passendes Kabel zu konfektionieren, so ist das Kabel gemäß dieser Belegung zu verdrahten.

Wird ein selbst konfektioniertes Kabel verwendet, kann B&R keine Garantie für dessen Funktion übernehmen. Die Funktion wird ausschließlich für die bei B&R erhältlichen Kabel gewährleistet.

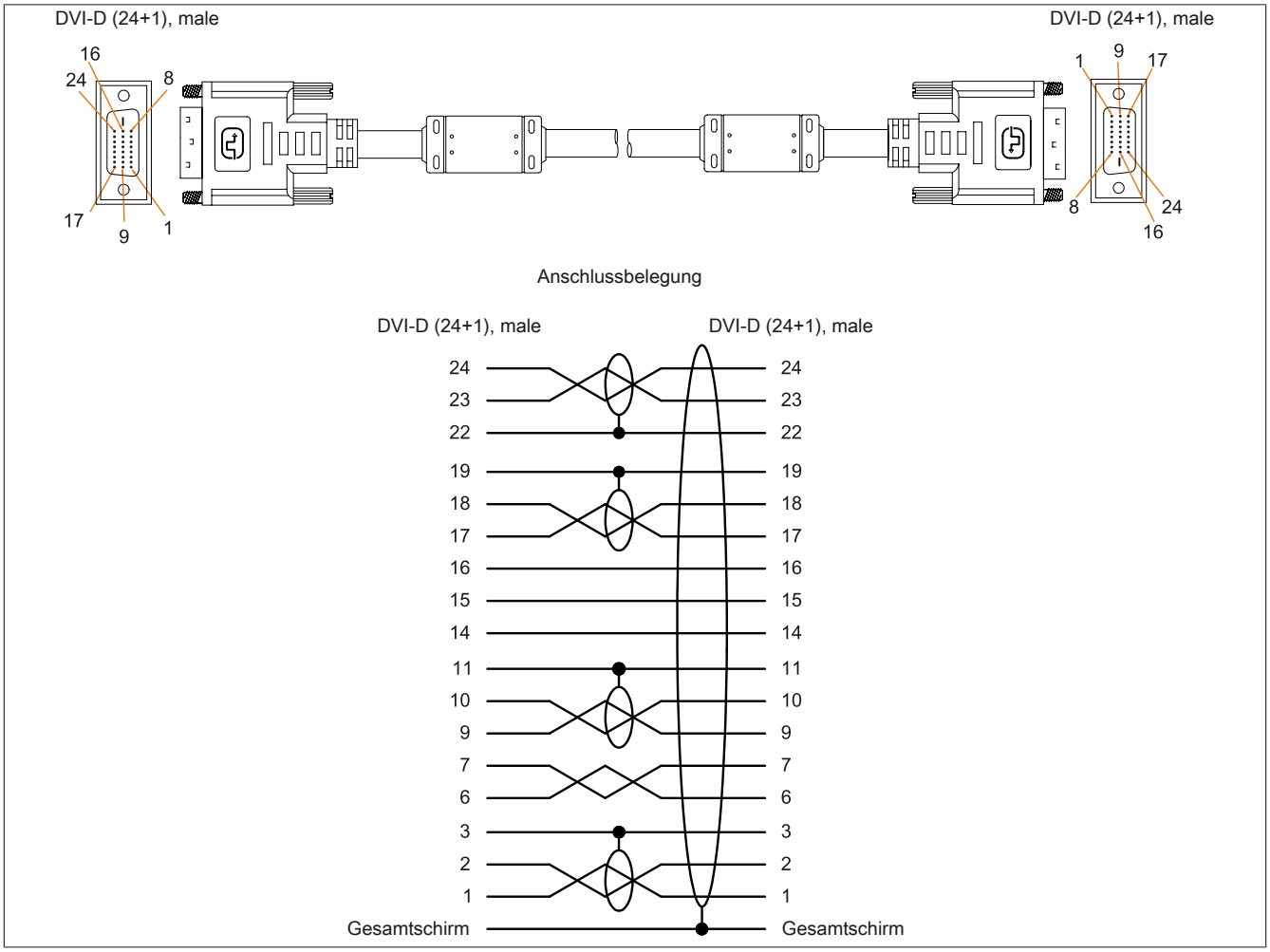


Abbildung 220: 5CADVI.0xxx-00 - Belegung

11.2 SDL-Kabel

11.2.1 5CASDL.0xxx-00

11.2.1.1 Allgemeines

Die SDL-Kabel 5CASDL.0xxx-00 sind für den Anwendungsfall einer starren Verlegung konzipiert. Für eine flexible Verlegungsart (z.B. bei Tragarmsystemen) ist der Einsatz der SDL-Kabel flex 5CASDL.0xxx-03 erforderlich.

Vorsicht!

An- und Abstecken des Kabels darf nur in spannungslosem Zustand erfolgen.

11.2.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	SDL-Kabel	
5CASDL.0008-00	SDL Kabel - 0,8 m	
5CASDL.0018-00	SDL Kabel - 1,8 m	
5CASDL.0050-00	SDL Kabel - 5 m	
5CASDL.0100-00	SDL Kabel - 10 m	
5CASDL.0150-00	SDL Kabel - 15 m	
5CASDL.0200-00	SDL Kabel - 20 m	
5CASDL.0250-00	SDL Kabel - 25 m	
5CASDL.0300-00	SDL Kabel - 30 m	

Tabelle 309: 5CASDL.0008-00, 5CASDL.0018-00, 5CASDL.0050-00, 5CASDL.0100-00, 5CASDL.0150-00, 5CASDL.0200-00, 5CASDL.0250-00, 5CASDL.0300-00 - Bestelldaten

11.2.1.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5CASDL. 0008-00	5CASDL. 0018-00	5CASDL. 0050-00	5CASDL. 0100-00	5CASDL. 0150-00	5CASDL. 0200-00	5CASDL. 0250-00	5CASDL. 0300-00
Allgemeines								
Zertifizierungen								
CE	Ja							
cULus	Ja							
GOST-R	-	Ja						
GL	Ja [1]							
Kabelaufbau								
Drahtquerschnitt	AWG 28			AWG 24				
Schirm	Kabelpaare einzeln, Kabel gesamt							
Gesamtschirmung	verzinntes Kupfergeflecht, optische Bedeckung > 85%							
Außenmantel								
Material	PVC							
Farbe	schwarz							
Bedruckung	E74020-C (UL) AWM STYLE 20176 80°C 30V VW-1 DVI DIGITAL LINK							
Steckverbindung								
Typ	2x DVI-D (24+1), male							
Steckzyklen	100							
Kontakte	vergoldet							
mechanischer Schutz	Metallhaube mit vercrimpter Zugentlastung							
Anzugsdrehmoment Fixierschrauben	max. 0,5 Nm							
Elektrische Eigenschaften								
Leiterwiderstand								
AWG 24	-			≤ 93 Ω/km				
AWG 28	≤ 237 Ω/km			-				
Isolationswiderstand	min. 10 MΩ/km							
Mechanische Eigenschaften								
Abmessungen								
Länge	0,8 m ±25 mm	1,8 m ±30 mm	5 m ±30 mm	10 m ±50 mm	15 m ±100 mm	20 m ±100 mm	25 m ±100 mm	30 m ±100 mm
Durchmesser	typ. 8,6 ±0,2 mm max. 9 mm			typ. 11 ±0,2 mm max. 11,5 mm				
Biegeradius	≥ 5x Kabeldurchmesser (Stecker - Ferrit und Ferrit - Ferrit)							
Beweglichkeit	bedingt flexibel; gilt von Ferrit - Ferrit (getestet 100 Zyklen bei 5x Kabeldurchmesser, 20 Zyklen/Minute)							
Gewicht	ca. 206 g	ca. 300 g	ca. 580 g	ca. 1500 g	ca. 2250 g	ca. 2880 g	ca. 4800 g	ca. 5520 g

Tabelle 310: 5CASDL.0008-00, 5CASDL.0018-00, 5CASDL.0050-00, 5CASDL.0100-00, 5CASDL.0150-00, 5CASDL.0200-00, 5CASDL.0250-00, 5CASDL.0300-00 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

11.2.1.4 Biegeradiusspezifikation

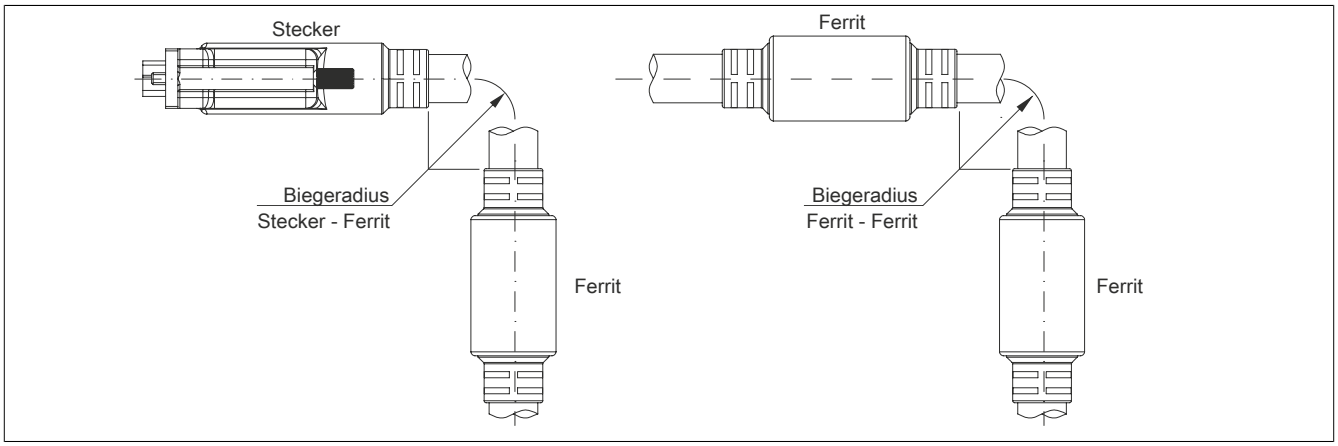


Abbildung 221: Biegeradiusspezifikation

11.2.1.5 Abmessungen

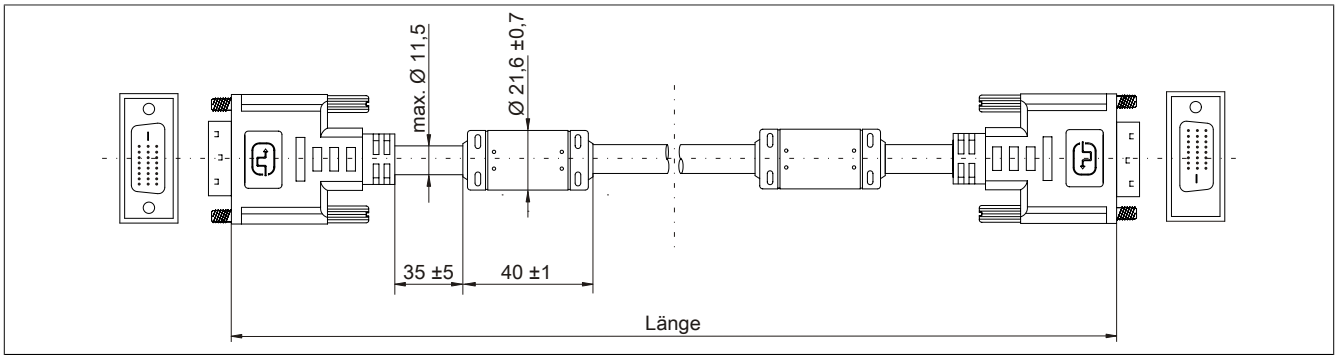


Abbildung 222: 5CASDL.0xxx-00 - Abmessungen

11.2.1.6 Kabelbelegung

Warnung!

Besteht der Wunsch sich selbst ein passendes Kabel zu konfektionieren, so ist das Kabel gemäß dieser Belegung zu verdrahten.

Wird ein selbst konfektioniertes Kabel verwendet, kann B&R keine Garantie für dessen Funktion übernehmen. Die Funktion wird ausschließlich für die bei B&R erhältlichen Kabel gewährleistet.

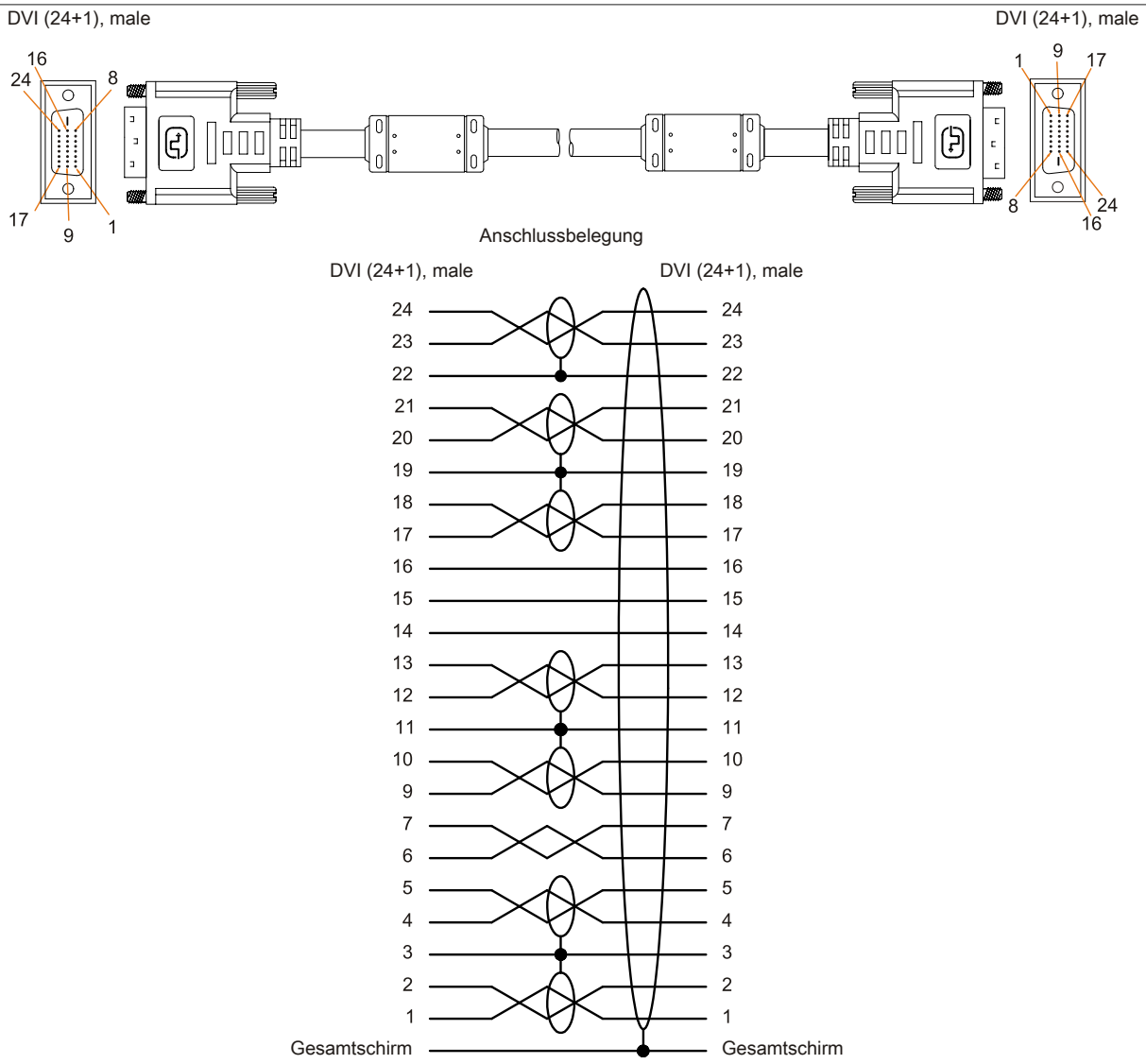


Abbildung 223: 5CASDL.0xxx-00 - Belegung

11.3 SDL-Kabel mit 45°-Stecker

11.3.1 5CASDL.0xxx-01

11.3.1.1 Allgemeines

Die SDL-Kabel mit 45°-Stecker 5CASDL.0xxx-01 sind für den Anwendungsfall einer starren Verlegung konzipiert.

Vorsicht!

An- und Abstecken des Kabels darf nur in spannungslosem Zustand erfolgen.

11.3.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	SDL-Kabel 45°-Anschluss	
5CASDL.0018-01	SDL Kabel - 45 Grad Anschluss - 1,8 m	
5CASDL.0050-01	SDL Kabel - 45 Grad Anschluss - 5 m	
5CASDL.0100-01	SDL Kabel - 45 Grad Anschluss - 10 m	
5CASDL.0150-01	SDL Kabel - 45 Grad Anschluss - 15 m	

Tabelle 311: 5CASDL.0018-01, 5CASDL.0050-01, 5CASDL.0100-01, 5CASDL.0150-01 - Bestelldaten

11.3.1.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5CASDL.0018-01	5CASDL.0050-01	5CASDL.0100-01	5CASDL.0150-01
Allgemeines				
Zertifizierungen				
CE	Ja			
cULus	Ja			
GOST-R	Ja			
GL	Ja [1]			
Kabelaufbau				
Drahtquerschnitt	AWG 28		AWG 24	
Schirm	Kabelpaare einzeln, Kabel gesamt			
Gesamtschirmung	verzinntes Kupfergeflecht, optische Bedeckung > 85%			
Außenmantel				
Material	PVC			
Farbe	schwarz			
Steckverbindung				
Typ	2x DVI-D (24+1), male			
Steckzyklen	100			
Kontakte	vergoldet			
mechanischer Schutz	Metallhaube mit vercrimpter Zugentlastung			
Anzugsdrehmoment Fixierschrauben	max. 0,5 Nm			
Elektrische Eigenschaften				
Leiterwiderstand				
AWG 24	-		≤ 93 Ω/km	
AWG 28	≤ 237 Ω/km		-	
Isolationswiderstand	min. 10 MΩ/km			
Mechanische Eigenschaften				
Abmessungen				
Länge	1,8 m ±30 mm	5 m ±50 mm	10 m ±100 mm	15 m ±100 mm
Durchmesser	max. 9 mm		max. 11,5 mm	
Biegeradius				
feste Verlegung	≥ 5x Kabeldurchmesser (Stecker - Ferrit und Ferrit - Ferrit)			
Beweglichkeit	bedingt flexibel; gilt von Ferrit - Ferrit (getestet 100 Zyklen bei 5x Kabeldurchmesser, 20 Zyklen/Minute)			
Gewicht	ca. 300 g	ca. 590 g	ca. 2800 g	ca. 2860 g

Tabelle 312: 5CASDL.0018-01, 5CASDL.0050-01, 5CASDL.0100-01, 5CASDL.0150-01 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

11.3.1.4 Biegeradiusspezifikation

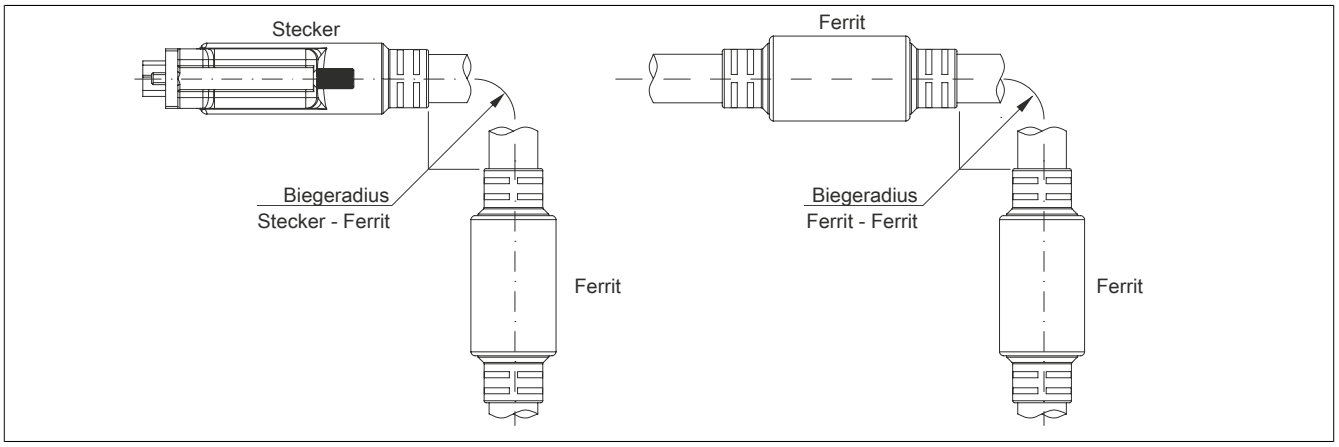


Abbildung 224: Biegeradiusspezifikation

11.3.1.5 Abmessungen

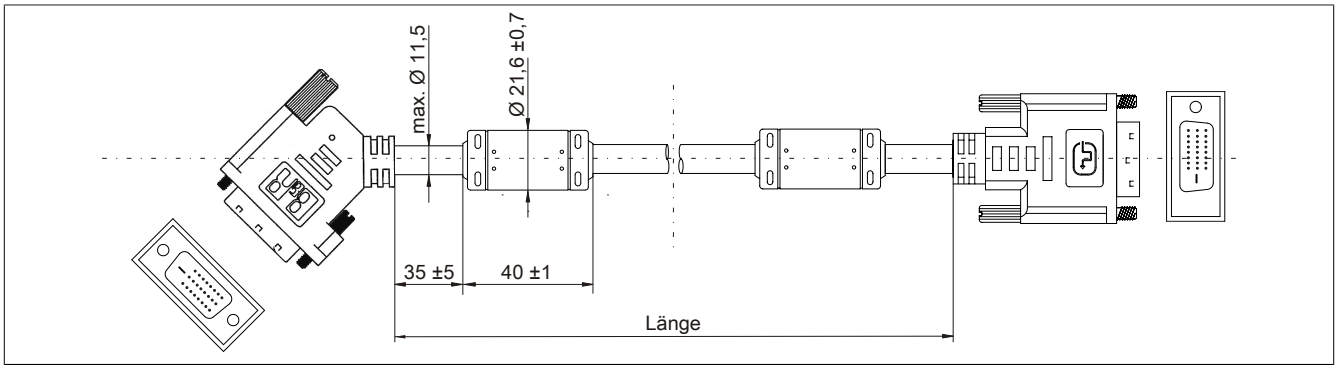


Abbildung 225: 5CASDL.0xxx-01 - Abmessungen

11.3.1.6 Kabelbelegung

Warnung!

Besteht der Wunsch sich selbst ein passendes Kabel zu konfektionieren, so ist das Kabel gemäß dieser Belegung zu verdrahten.

Wird ein selbst konfektioniertes Kabel verwendet, kann B&R keine Garantie für dessen Funktion übernehmen. Die Funktion wird ausschließlich für die bei B&R erhältlichen Kabel gewährleistet.

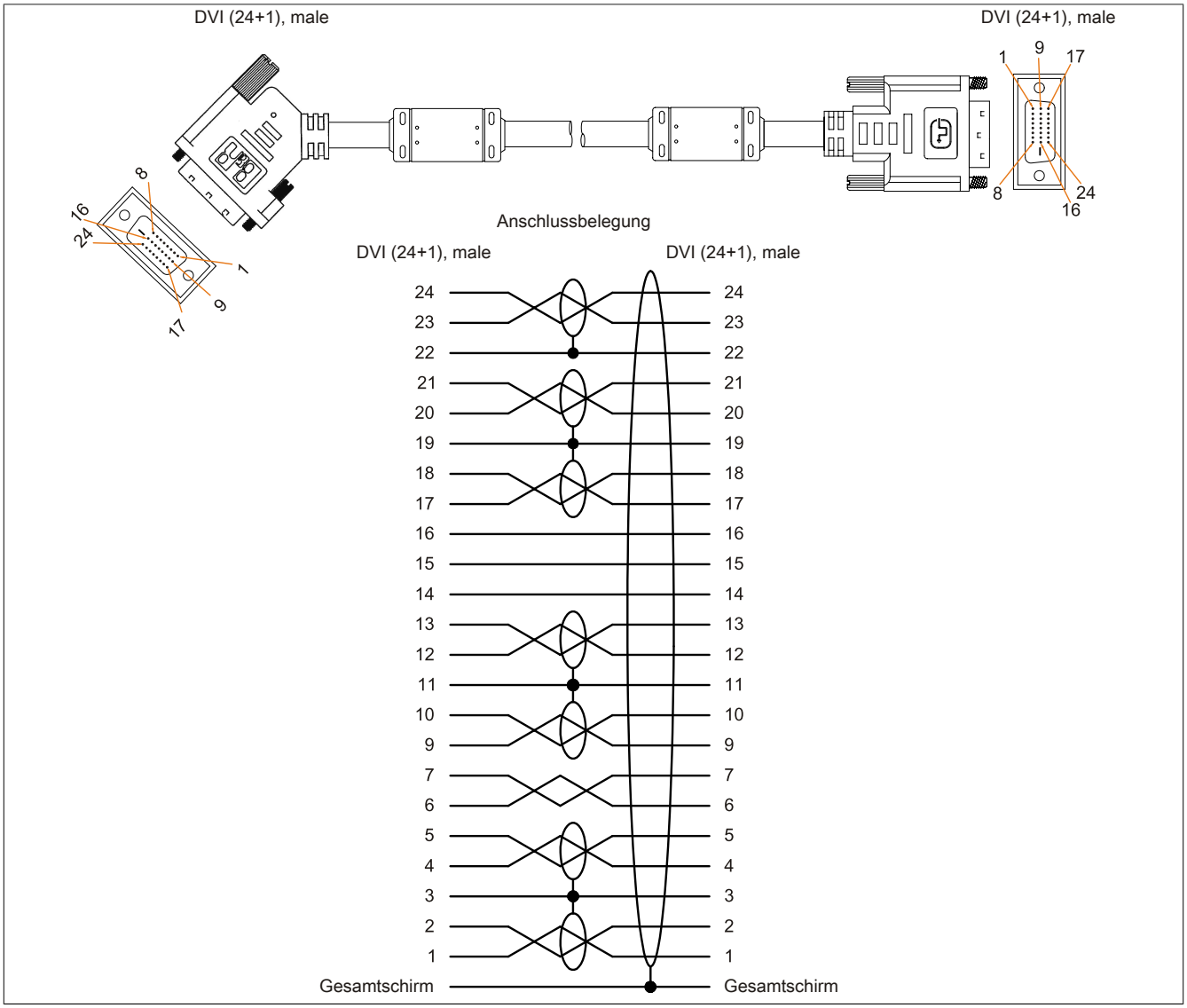


Abbildung 226: 5CASDL.0xxx-01 - Belegung

11.4 SDL-Kabel flex

11.4.1 5CASDL.0xxx-03

11.4.1.1 Allgemeines

Die SDL-Kabel flex 5CASDL.0xxx-03 sind für den Anwendungsfall einer starren wie auch flexiblen Verlegungsart (z.B. bei Tragarmsystemen) konzipiert.

Vorsicht!

An- und Abstecken des Kabels darf nur in spannungslosem Zustand erfolgen.

11.4.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	SDL-Kabel flex	
5CASDL.0018-03	SDL Kabel flex - 1,8 m	
5CASDL.0050-03	SDL Kabel flex - 5 m	
5CASDL.0100-03	SDL Kabel flex - 10 m	
5CASDL.0150-03	SDL Kabel flex - 15 m	
5CASDL.0200-03	SDL Kabel flex - 20 m	
5CASDL.0250-03	SDL Kabel flex - 25 m	
5CASDL.0300-03	SDL Kabel flex - 30 m	

Tabelle 313: 5CASDL.0018-03, 5CASDL.0050-03, 5CASDL.0100-03, 5CASDL.0150-03, 5CASDL.0200-03, 5CASDL.0250-03, 5CASDL.0300-03 - Bestelldaten

11.4.1.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5CASDL. 0018-03	5CASDL. 0050-03	5CASDL. 0100-03	5CASDL. 0150-03	5CASDL. 0200-03	5CASDL. 0250-03	5CASDL. 0300-03
Allgemeines							
Zertifizierungen							
CE	Ja						
cULus	Ja						
GOST-R	Ja						
GL	Ja [1)]						
Kabelaufbau							
Drahtquerschnitt	AWG 24 (Steueradern) AWG 26 (DVI, USB, Daten)						
Eigenschaften	halogen- und silikonfrei						
Schirm	Kabelpaare einzeln, Kabel gesamt						
Gesamtschirmung	alukaschierte Folie und verzinntes Kupfergeflecht						
Außenmantel							
Material	Spezial-TMPU - seidenmatt						
Farbe	schwarz						
Bedruckung	(B&R) SDL Cable (UL) AWM 20236 80°C 30V E 63216						
Steckverbindung							
Typ	2x DVI-D (24+1), male						
Steckzyklen	min. 200						
Kontakte	vergoldet						
mechanischer Schutz	Metallhaube mit vercrimpter Zugentlastung						
Anzugsdrehmoment Fixierschrauben	max. 0,5 Nm						
Elektrische Eigenschaften							
Betriebsspannung	≤ 30 V						
Prüfspannung							
Ader/Ader	1 kV						
Ader/Schirm	0,5 kV						
Wellenwiderstand	100 ±10 Ω						
Leiterwiderstand							
AWG 24	≤ 95 Ω/km						
AWG 26	≤ 145 Ω/km						
Isolationswiderstand	> 200 MΩ/km						
Einsatzbedingungen							
Approbation	UL AWM 20236 80°C 30V						
Flammwidrigkeit	gemäß UL758 (cable vertical flame test)						
Öl- und Hydrolysebeständigkeit	gemäß VDE 0282-10						

Tabelle 314: 5CASDL.0018-03, 5CASDL.0050-03, 5CASDL.0100-03, 5CASDL.0150-03, 5CASDL.0200-03, 5CASDL.0250-03, 5CASDL.0300-03 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5CASDL. 0018-03	5CASDL. 0050-03	5CASDL. 0100-03	5CASDL. 0150-03	5CASDL. 0200-03	5CASDL. 0250-03	5CASDL. 0300-03
Umgebungsbedingungen							
Temperatur							
Lagerung	-20 bis 80°C						
feste Verlegung	-20 bis 80°C						
flexible Verlegung	-5 bis 60°C						
Mechanische Eigenschaften							
Abmessungen							
Länge	1,8 m ±20 mm	5 m ±45 mm	10 m ±90 mm	15 m ±135 mm	20 m ±180 mm	25 m ±225 mm	30 m ±270 mm
Durchmesser	max. 12 mm						
Biegeradius							
feste Verlegung	≥ 3,5x Kabeldurchmesser (von Stecker - Ferrit) ≥ 10x Kabeldurchmesser (von Ferrit - Ferrit)						
flexible Verlegung	≥ 15x Kabeldurchmesser (von Ferrit - Ferrit)						
Beweglichkeit	flexibel; gilt von Ferrit - Ferrit (getestet 300000 Zyklen bei 15x Kabeldurchmesser, 4800 Zyklen/Stunde)						
Schleppkettendaten							
Biegewechsel	300.000						
Geschwindigkeit	4800 Zyklen/Stunde						
Biegeradius	180 mm; 15x Kabeldurchmesser						
Hub	460 mm						
Gewicht	ca. 460 g	ca. 1020 g	ca. 1940 g	ca. 2840 g	ca. 3740 g	ca. 4560 g	ca. 5590 g
Zugbelastbarkeit							
in Betrieb	≤ 50 N						
bei Verlegung	≤ 400 N						

Tabelle 314: 5CASDL.0018-03, 5CASDL.0050-03, 5CASDL.0100-03, 5CASDL.0150-03, 5CASDL.0200-03, 5CASDL.0250-03, 5CASDL.0300-03 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

11.4.1.4 Biegeradiusspezifikation

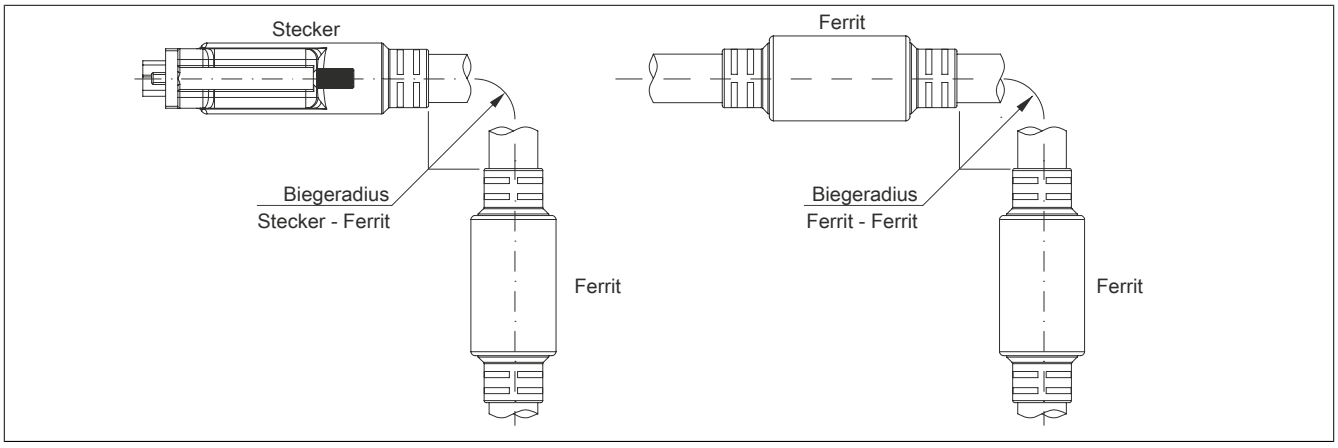


Abbildung 227: Biegeradiusspezifikation

11.4.1.5 Abmessungen

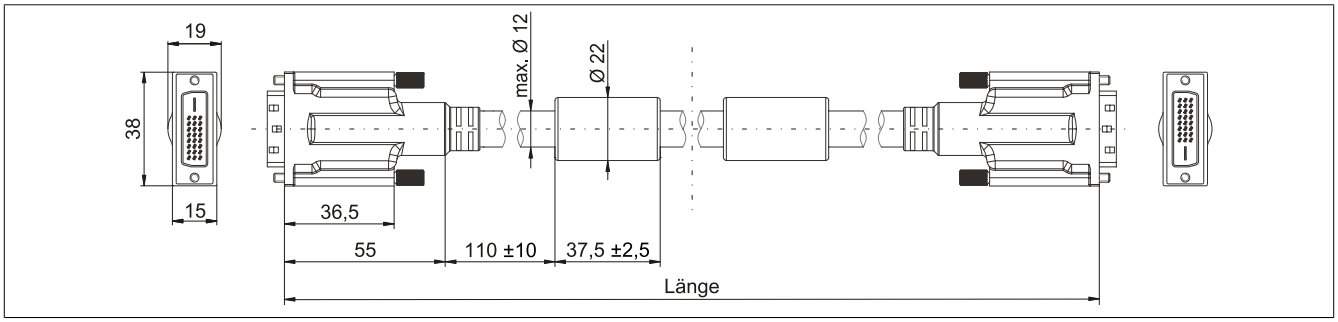


Abbildung 228: 5CASDL.0xxx-03 - Abmessungen

11.4.1.6 Aufbau

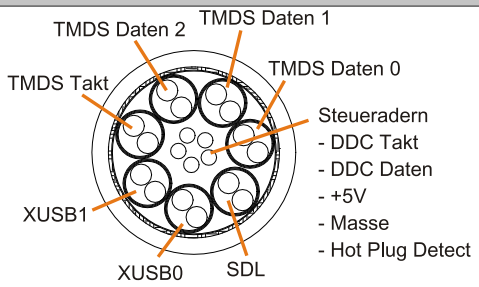
Element	Belegung	Querschnitt	
DVI	TMDS Daten 0	26 AWG	
	TMDS Daten 1	26 AWG	
	TMDS Daten 2	26 AWG	
	TMDS Takt	26 AWG	
USB	XUSB0	26 AWG	
	XUSB1	26 AWG	
Daten	SDL	26 AWG	
Steueradern	DDC Takt	24 AWG	
	DDC Daten	24 AWG	
	+5 V	24 AWG	
	Masse	24 AWG	
	Hot Plug Detect	24 AWG	

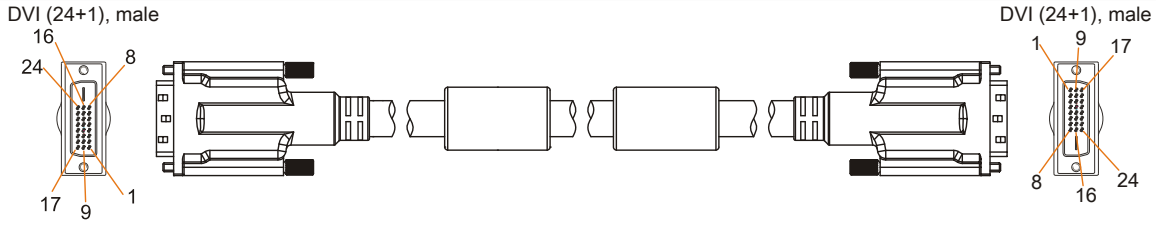
Tabelle 315: Aufbau SDL Kabel flex 5CASDL.0xxx-03

11.4.1.7 Kabelbelegung

Warnung!

Besteht der Wunsch sich selbst ein passendes Kabel zu konfektionieren, so ist das Kabel gemäß dieser Belegung zu verdrahten.

Wird ein selbst konfektioniertes Kabel verwendet, kann B&R keine Garantie für dessen Funktion übernehmen. Die Funktion wird ausschließlich für die bei B&R erhältlichen Kabel gewährleistet.



Anschlussbelegung

DVI (24+1), male			DVI (24+1), male
TMDS Takt -	24	24	TMDS Takt -
TMDS Takt +	23	23	TMDS Takt +
TMDS Takt Abschirmung	22	22	TMDS Takt Abschirmung
XUSB1+	21	21	XUSB1+
XUSB1-	20	20	XUSB1-
TMDS Daten 0/XUSB1 Abschirmung	19	19	TMDS Daten 0/XUSB1 Abschirmung
TMDS Daten 0+	18	18	TMDS Daten 0+
TMDS Daten 0-	17	17	TMDS Daten 0-
Hot Plug Detect	16	16	Hot Plug Detect
Masse	15	15	Masse
+5V	14	14	+5V
XUSB0+	13	13	XUSB0+
XUSB0-	12	12	XUSB0-
TMDS Daten 1/XUSB0 Abschirmung	11	11	TMDS Daten 1/XUSB0 Abschirmung
TMDS Daten 1+	10	10	TMDS Daten 1+
TMDS Daten 1-	9	9	TMDS Daten 1-
DDC Takt	7	7	DDC Takt
DDC Daten	6	6	DDC Daten
SDL+	5	5	SDL+
SDL-	4	4	SDL-
TMDS Daten 2/SDL Abschirmung	3	3	TMDS Daten 2/SDL Abschirmung
TMDS Daten 2+	2	2	TMDS Daten 2+
TMDS Daten 2-	1	1	TMDS Daten 2-
Gesamtschirm			Gesamtschirm

Abbildung 229: 5CASDL.0xxx-03 - Belegung

11.5 SDL-Kabel flex mit Extender

11.5.1 5CASDL.0xx0-13

11.5.1.1 Allgemeines

Die SDL-Kabel flex mit Extender 5CASDL.0xx0-13 sind für den Anwendungsfall einer starren wie auch flexiblen Verlegungsart (z.B. bei Tragarmsystemen) konzipiert.

Vorsicht!

An- und Abstecken des Kabels darf nur in spannungslosem Zustand erfolgen.

11.5.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	SDL-Kabel flex	
5CASDL.0300-13	SDL Kabel flex mit Extender - 30 m	
5CASDL.0400-13	SDL Kabel flex mit Extender - 40 m	
5CASDL.0430-13	SDL Kabel flex mit Extender - 43 m	

Tabelle 316: 5CASDL.0300-13, 5CASDL.0400-13, 5CASDL.0430-13 - Bestelldaten

11.5.1.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5CASDL.0300-13	5CASDL.0400-13	5CASDL.0430-13
Allgemeines			
Zertifizierungen			
CE	Ja		
cULus	Ja		
GOST-R	Ja		
GL	Ja [1)]		
Kabelaufbau			
Drahtquerschnitt	AWG 24 (Steueradern) AWG 26 (DVI, USB, Daten)		
Eigenschaften	halogen- und silikonfrei		
Schirm	Kabelpaare einzeln, Kabel gesamt		
Gesamtschirmung	alukaschierte Folie und verzinntes Kupfergeflecht		
Außenmantel			
Material	Spezial-TMPU - seidenmatt		
Farbe	schwarz		
Bedruckung	(B&R) SDL Cable (UL) AWM 20236 80°C 30V E63216		
Steckverbindung			
Typ	2x DVI-D (24+1), male		
Steckzyklen	min. 200		
Kontakte	vergoldet		
mechanischer Schutz	Metallhaube mit vercrimpter Zugentlastung		
Anzugsdrehmoment Fixierschrauben	max. 0,5 Nm		
Elektrische Eigenschaften			
Betriebsspannung	≤ 30 V		
Prüfspannung			
Ader/Ader	1 kV		
Ader/Schirm	0,5 kV		
Wellenwiderstand	100 ±10 Ω		
Leiterwiderstand			
AWG 24	≤ 95 Ω/km		
AWG 26	≤ 145 Ω/km		
Isolationswiderstand	> 200 MΩ/km		
Einsatzbedingungen			
Approbation	UL AWM 20236 80°C 30V		
Flammwidrigkeit	gemäß UL758 (cable vertical flame test)		
Öl- und Hydrolysebeständigkeit	gemäß VDE 0282-10		
Umgebungsbedingungen			
Temperatur			
Lagerung	-20 bis 60°C		
feste Verlegung	-20 bis 60°C		
flexible Verlegung	-5 bis 60°C		

Tabelle 317: 5CASDL.0300-13, 5CASDL.0400-13, 5CASDL.0430-13 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5CASDL.0300-13	5CASDL.0400-13	5CASDL.0430-13
Mechanische Eigenschaften			
Abmessungen			
Länge	30 m ±280 mm	40 m ±380 mm	43 m ±410 mm
Durchmesser		max. 12 mm	
Extender Box			
Breite		35 mm	
Länge		125 mm	
Höhe		18,5 mm	
Biegeradius			
feste Verlegung		≥ 6x Kabeldurchmesser (von Stecker - Ferrit) ≥ 10x Kabeldurchmesser (von Ferrit - Ferrit)	
flexible Verlegung		≥ 15x Kabeldurchmesser (von Ferrit - Ferrit)	
Beweglichkeit		flexibel; gilt von Ferrit - Ferrit (getestet 300000 Zyklen bei 15x Kabeldurchmesser, 4800 Zyklen/Stunde)	
Schleppkettendaten			
Biegewechsel		300.000	
Geschwindigkeit		4800 Zyklen/Stunde	
Biegeradius		180 mm; 15x Kabeldurchmesser	
Hub		460 mm	
Gewicht	ca. 5430 g	ca. 7200 g	ca. 7790 g
Zugbelastbarkeit			
in Betrieb		≤ 50 N	
bei Verlegung		≤ 400 N	

Tabelle 317: 5CASDL.0300-13, 5CASDL.0400-13, 5CASDL.0430-13 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

11.5.1.4 Biegeradiusspezifikation

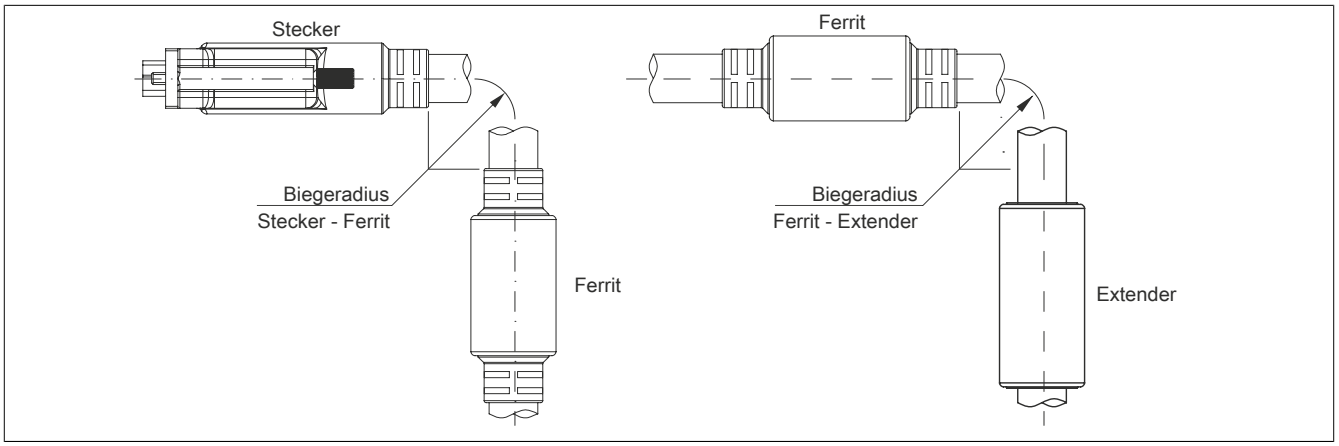


Abbildung 230: Biegeradiusspezifikation mit Extender

11.5.1.5 Abmessungen

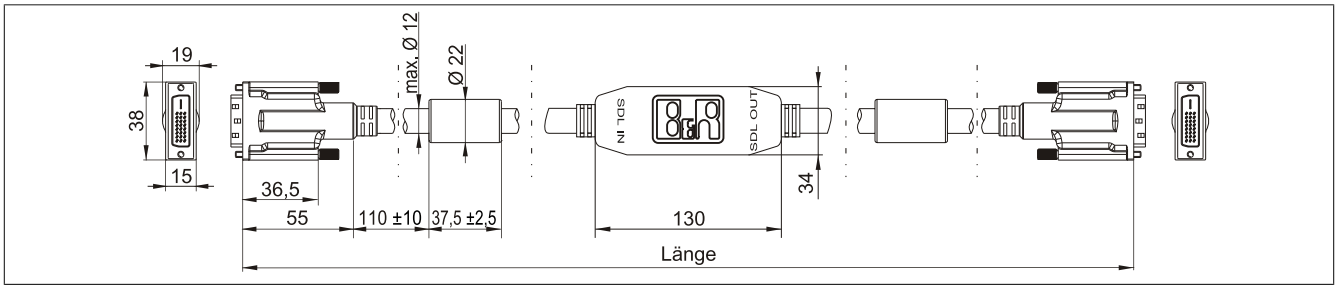


Abbildung 231: 5CASDL.0xx0-13 - Abmessungen

11.5.1.6 Kabelbelegung

Warnung!

Besteht der Wunsch sich selbst ein passendes Kabel zu konfektionieren, so ist das Kabel gemäß dieser Belegung zu verdrahten.

Wird ein selbst konfektioniertes Kabel verwendet, kann B&R keine Garantie für dessen Funktion übernehmen. Die Funktion wird ausschließlich für die bei B&R erhältlichen Kabel gewährleistet.

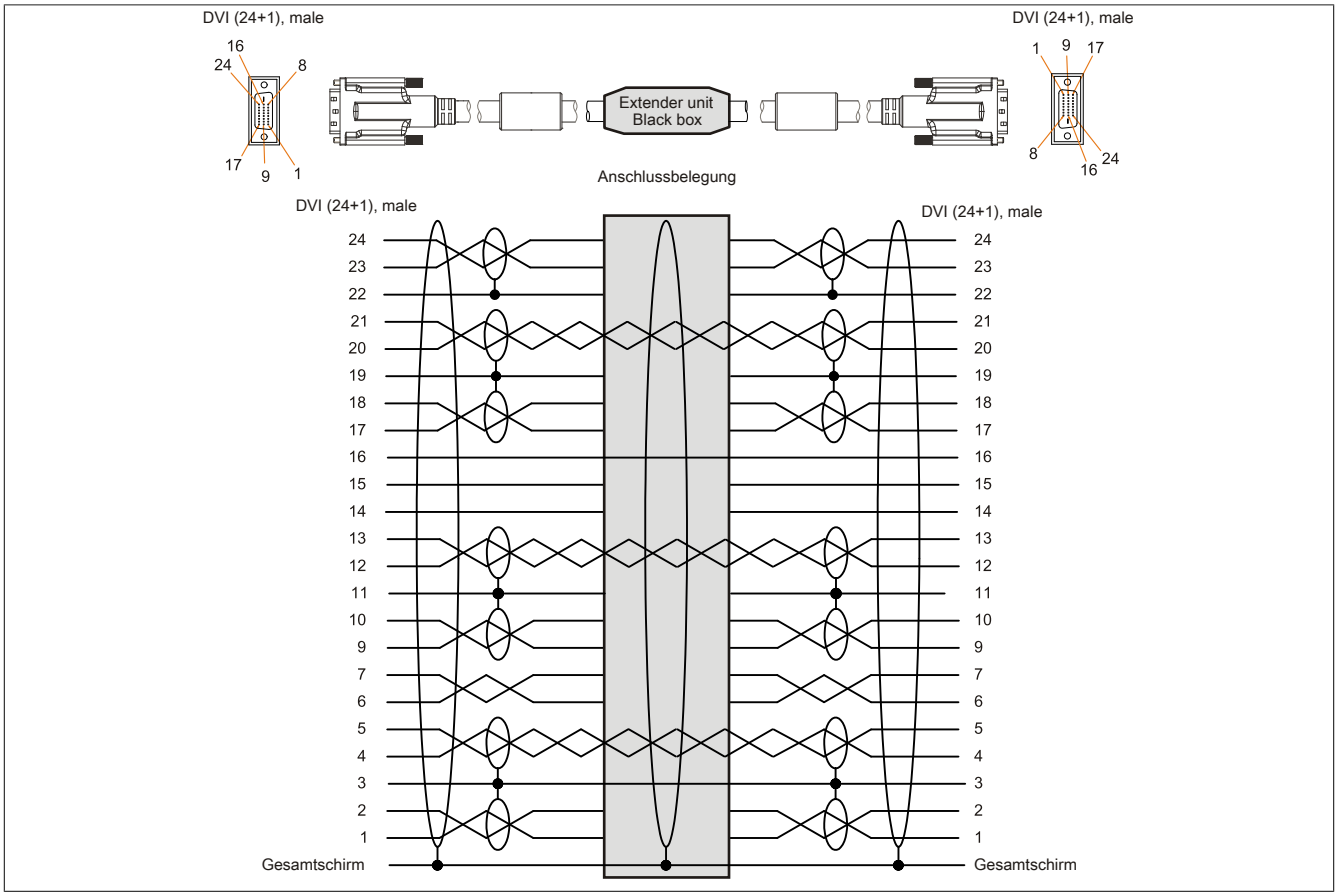


Abbildung 232: 5CASDL.0xx0-13 - Belegung

11.5.1.7 Kabelanschluss

Das SDL-Kabel flex mit Extender muss in richtiger Richtung zwischen B&R Industrie PC und Automation Panel Displayeinheit angeschlossen werden. Zu diesem Zweck ist die Signalrichtung auf der Extender Unit abgebildet.

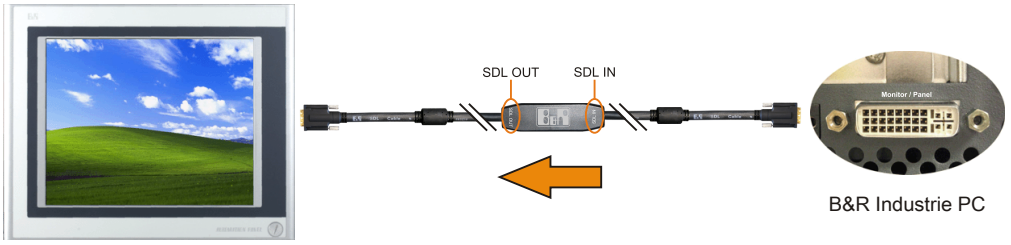


Abbildung 233: Beispiel für die Signalrichtung für das SDL Kabel flex mit Extender

11.6 USB-Kabel

11.6.1 5CAUSB.00xx-00

11.6.1.1 Allgemeines

Die USB-Kabel sind für eine Übertragungsgeschwindigkeit von USB 2.0 konzipiert.

11.6.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	USB-Kabel	
5CAUSB.0018-00	USB 2.0 Verbindungskabel - Typ A - Typ B Stecker - 1,8 m	
5CAUSB.0050-00	USB 2.0 Verbindungskabel - Typ A - Typ B Stecker - 5 m	

Tabelle 318: 5CAUSB.0018-00, 5CAUSB.0050-00 - Bestelldaten

11.6.1.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5CAUSB.0018-00	5CAUSB.0050-00
Allgemeines		
Zertifizierungen		
CE	Ja	
cULus	Ja	
GOST-R	Ja	
GL	Ja	
Kabelaufbau		
Drahtquerschnitt	AWG 24, 28	
Schirm	Kabel gesamt	
Außenmantel		
Farbe	beige	
Steckverbindung		
Typ	USB Typ A male und USB Typ B male	
Mechanische Eigenschaften		
Abmessungen		
Länge	1,8 m ±30 mm	5 m ±50 mm
Durchmesser	max. 5 mm	
Biegeradius	min. 100 mm	

Tabelle 319: 5CAUSB.0018-00, 5CAUSB.0050-00 - Technische Daten

11.6.1.4 Kabelbelegung

Warnung!

Besteht der Wunsch sich selbst ein passendes Kabel zu konfektionieren, so ist das Kabel gemäß dieser Belegung zu verdrahten.

Wird ein selbst konfektioniertes Kabel verwendet, kann B&R keine Garantie für dessen Funktion übernehmen. Die Funktion wird ausschließlich für die bei B&R erhältlichen Kabel gewährleistet.

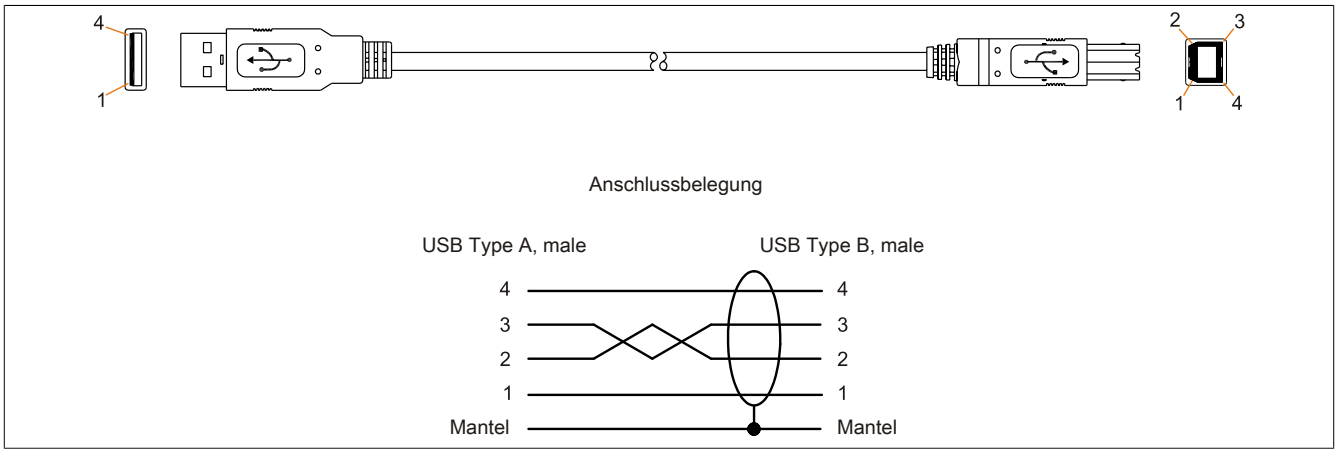


Abbildung 234: 5CAUSB.00xx-00 - Belegung USB Kabel

11.7 RS232-Kabel

11.7.1 9A0014.xx

11.7.1.1 Allgemeines

Die RS232-Kabel dienen als Verlängerungskabel zwischen zwei RS232-Schnittstellen.

11.7.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	RS232-Kabel	
9A0014.02	RS232 Verlängerungskabel zum Betrieb einer abgesetzten Displayeinheit mit Touch Screen, 1,8 m.	
9A0014.05	RS232 Verlängerungskabel zum Betrieb einer abgesetzten Displayeinheit mit Touch Screen, 5 m.	
9A0014.10	RS232 Verlängerungskabel zum Betrieb einer abgesetzten Displayeinheit mit Touch Screen, 10 m.	

Tabelle 320: 9A0014.02, 9A0014.05, 9A0014.10 - Bestelldaten

11.7.1.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	9A0014.02	9A0014.05	9A0014.10
Allgemeines			
Zertifizierungen			
CE		Ja	
GOST-R	-	Ja	
Kabelaufbau			
Drahtquerschnitt		AWG 26	
Schirm		Kabel gesamt	
Außenmantel			
Farbe		beige	
Steckverbindung			
Typ		9-polige DSUB Buchse, male / female	
Anzugsdrehmoment Fixierschrauben		max. 0,5 Nm	
Mechanische Eigenschaften			
Abmessungen			
Länge	1,8 m ±50 mm	5 m ±80 mm	10 m ±100 mm
Durchmesser		max. 5 mm	
Biegeradius		min. 70 mm	

Tabelle 321: 9A0014.02, 9A0014.05, 9A0014.10 - Technische Daten

11.7.1.4 Kabelbelegung

Warnung!

Besteht der Wunsch sich selbst ein passendes Kabel zu konfektionieren, so ist das Kabel gemäß dieser Belegung zu verdrahten.

Wird ein selbst konfektioniertes Kabel verwendet, kann B&R keine Garantie für dessen Funktion übernehmen. Die Funktion wird ausschließlich für die bei B&R erhältlichen Kabel gewährleistet.

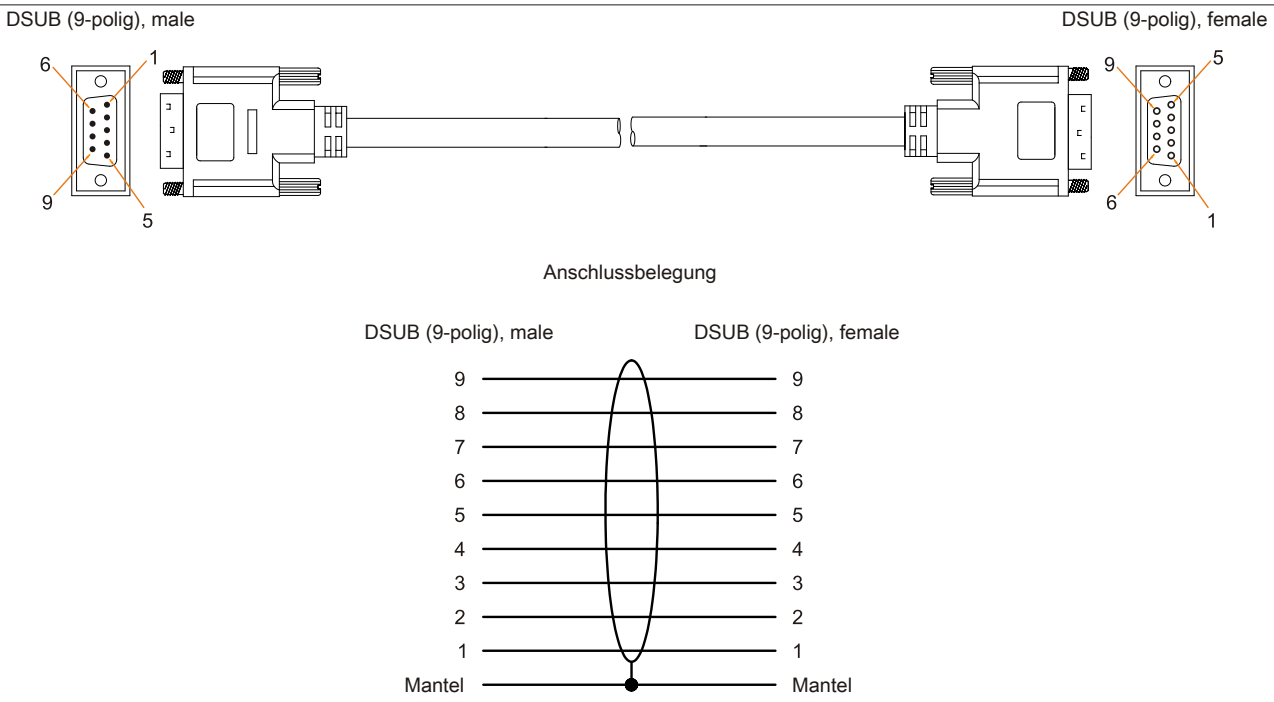


Abbildung 235: 9A0014.xx - Belegung RS232 Kabel

11.8 Versorgungskabel intern

11.8.1 5CAMSC.0001-00

11.8.1.1 Allgemeines

Dieses Versorgungskabel dient zur internen Versorgung von z.B. speziellen PCI Karten. Es wird dabei an das Basisboard angesteckt.

Vorraussetzungen und Vorgangsweise siehe dazu "Anschluss eines externen Verbrauchers an das Basisboard" auf Seite 451.

Vorsicht!

An- und Abstecken des Kabels darf nur in spannungslosem Zustand erfolgen.

11.8.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Zubehör	
5CAMSC.0001-00	Versorgungskabel intern	

Tabelle 322: 5CAMSC.0001-00 - Bestelldaten

11.8.1.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5CAMSC.0001-00
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
GOST-R	Ja
Kabelaufbau	
Drahtquerschnitt	AWG 22
Steckverbindung	
Typ	1x Disk Drive Power Stecker 4-polig male, 1x Steckergehäuse 4-polig female
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen	
Länge	100 mm ±5 mm
Beweglichkeit	flexibel

Tabelle 323: 5CAMSC.0001-00 - Technische Daten

12 HDD Ersatzdiskablage

12.1 5AC801.FRAM-00

12.1.1 Allgemeines

Um eine Hard Disk so schnell wie möglich mit einer Ersatz Hard Disk wechseln zu können, gibt es die Möglichkeit ein Gehäuse am APC810 zu montieren, in dem die Erstaz HDD aufbewahrt werden kann.

Nähere Informationen zur Montage der HDD Ersatzdiskablage siehe Kapitel Wartung / Instandhaltung.

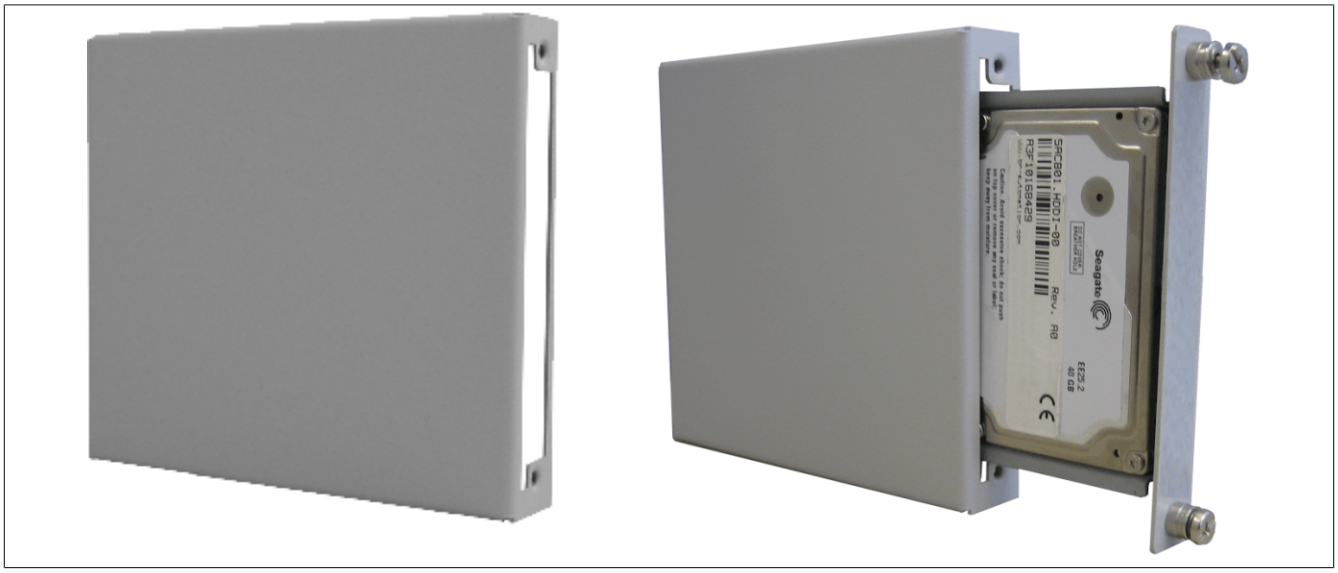


Abbildung 236: HDD Ersatzdiskablage - 5AC801.FRAM-00

12.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Zubehör	
5AC801.FRAM-00	APC810 SATA Hard Disk Ersatzablage	

Tabelle 324: 5AC801.FRAM-00 - Bestelldaten

12.1.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5AC801.FRAM-00
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
GOST-R	Ja
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen	
Breite	106 mm
Höhe	101 mm
Tiefe	18 mm

Tabelle 325: 5AC801.FRAM-00 - Technische Daten

12.1.4 Abmessungen

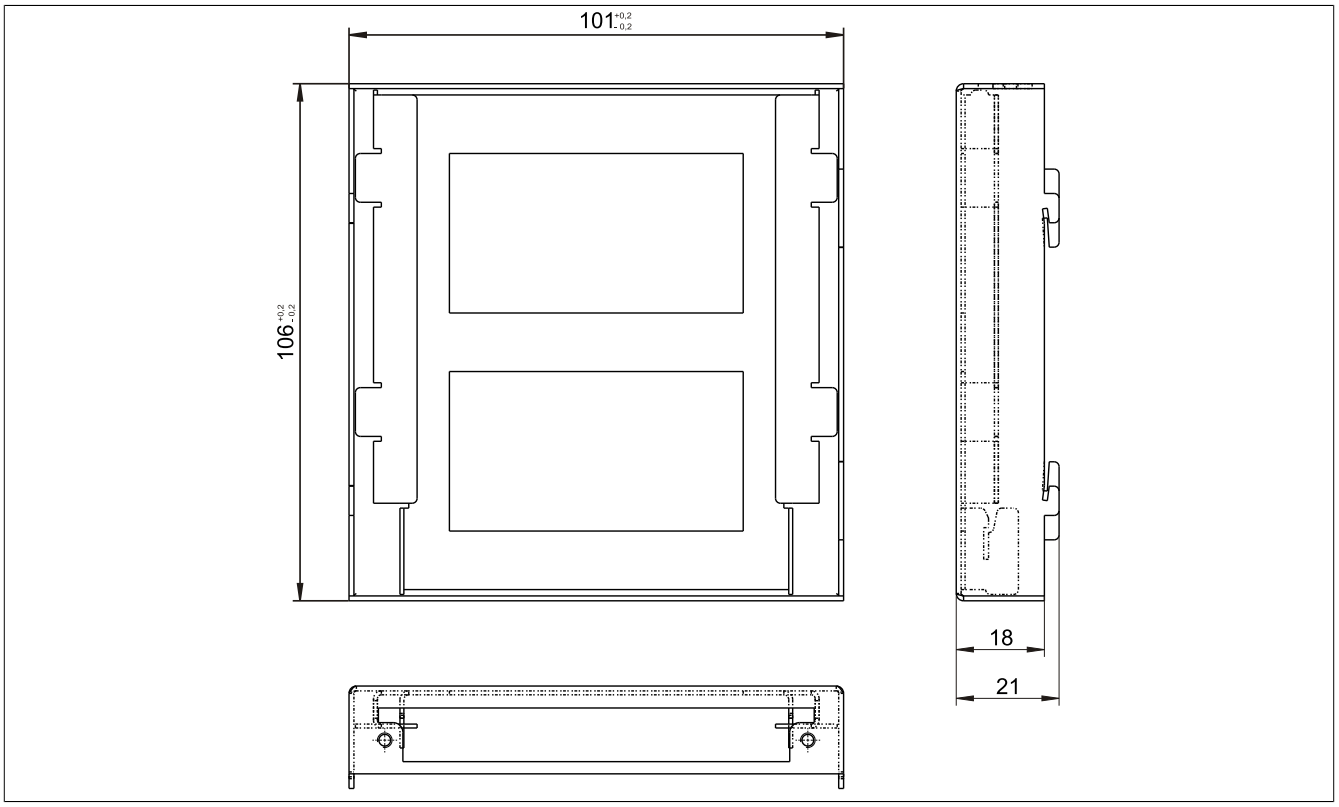


Abbildung 237: 5AC801.FRAM-00 - Abmessungen

Kapitel 7 • Wartung / Instandhaltung

In folgendem Kapitel werden jene Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten beschrieben, die von einem qualifizierten und eingeschulten Endanwender selbst vorgenommen werden können.

1 Batteriewechsel

Die Lithiumbatterie stellt die Pufferung der internen Echtzeituhr (RTC) und der CMOS Daten sicher.

Information:

- **Das Design des Produktes gestattet das Wechseln der Batterie sowohl in spannungslosem Zustand als auch bei eingeschaltetem B&R Gerät. In manchen Ländern ist der Wechsel unter Betriebsspannung jedoch nicht erlaubt.**
- **Beim Wechseln der Batterie in spannungslosem Zustand bleiben vorgenommene BIOS Einstellungen erhalten (werden in einem spannungssicheren EEPROM gespeichert). Datum und Uhrzeit sind nachträglich wieder einzustellen, da diese Daten beim Wechseln verloren gehen.**
- **Der Batteriewechsel darf nur von qualifiziertem Personal ausgeführt werden.**

Warnung!

Die Batterie darf nur durch eine Renata Batterie vom Typ CR2477N ersetzt werden. Die Verwendung einer anderen Batterie kann eine Feuer- oder Explosionsgefahr darstellen.

Die Batterie kann bei falscher Handhabung explodieren. Batterie nicht aufladen, zerlegen oder in einem Feuer entsorgen.

Es sind folgende Lithium Ersatzbatterien verfügbar: 4A0006.00-000 (1 Stk.) und 0AC201.91 (4 Stk.).

1.1 Batteriestatusermittlung

Der Batteriestatus wird sofort nach dem Einschalten des Gerätes und in weiterer Folge alle 24 Stunden vom System ermittelt. Bei der Messung wird kurzzeitig (ca. 1 Sekunde) die Batterie belastet und anschließend bewertet. Der ermittelte Batteriestatus wird in den BIOS Setup Seiten (unter Advanced - Baseboard/Panel Features - Baseboard Monitor) und im B&R Control Center (ADI Treiber) angezeigt, kann aber auch in einer Kundenapplikation über die ADI Library ausgelesen werden.

Batteriestatus	Bedeutung
N/A	Es wird eine zu alte Hardware bzw. Firmware verwendet die das Auslesen nicht unterstützt.
GOOD	Pufferung der Daten ist gewährleistet.
BAD	Ab dem Zeitpunkt, ab dem die Batteriekapazität als BAD (nicht ausreichend) erkannt wird, ist eine Pufferung der Daten noch für ca. 500 Stunden gewährleistet.

Tabelle 326: Bedeutung Batteriestatus

Ab dem Zeitpunkt, ab dem die Batteriekapazität als nicht ausreichend erkannt wird, ist eine Pufferung der Daten noch für ca. 500 Stunden gewährleistet. Beim Wechseln der Batterie werden die Daten noch ca. 10 Minuten durch einen Goldfolienkondensator gepuffert.

1.2 Vorgangsweise

- Zuleitung zum B&R Industrie PC spannungslos (Netzkabel abstecken) machen.
- Elektrostatische Entladung am Gehäuse bzw. am Erdungsanschluss vornehmen.
- Abdeckung des Batteriefaches entfernen und Batterie mittels Ausziehstreifen vorsichtig herausziehen.

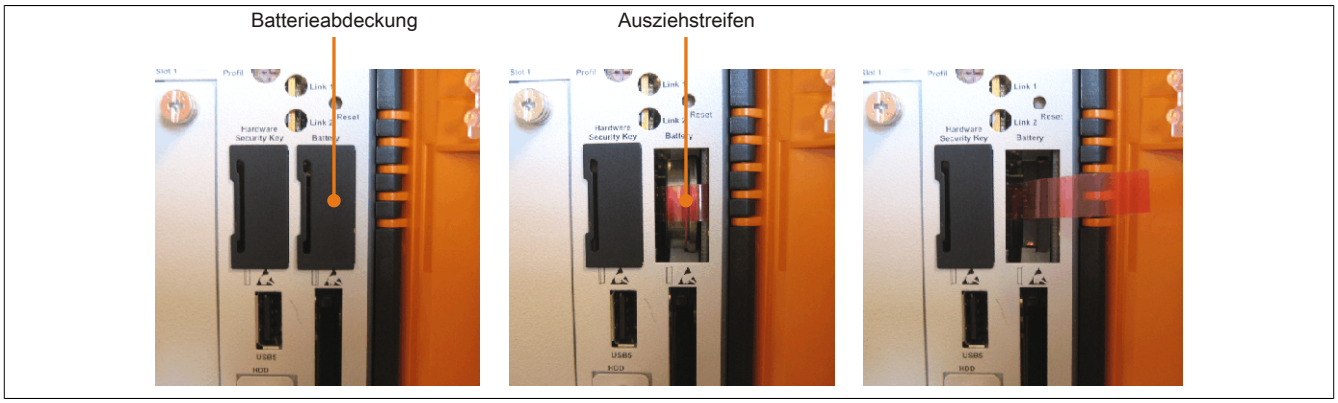


Abbildung 238: Batterie entfernen

- Die Batterie darf mit der Hand nur an den Stirnseiten berührt werden. Zum Einsetzen kann auch eine isolierte Pinzette verwendet werden.

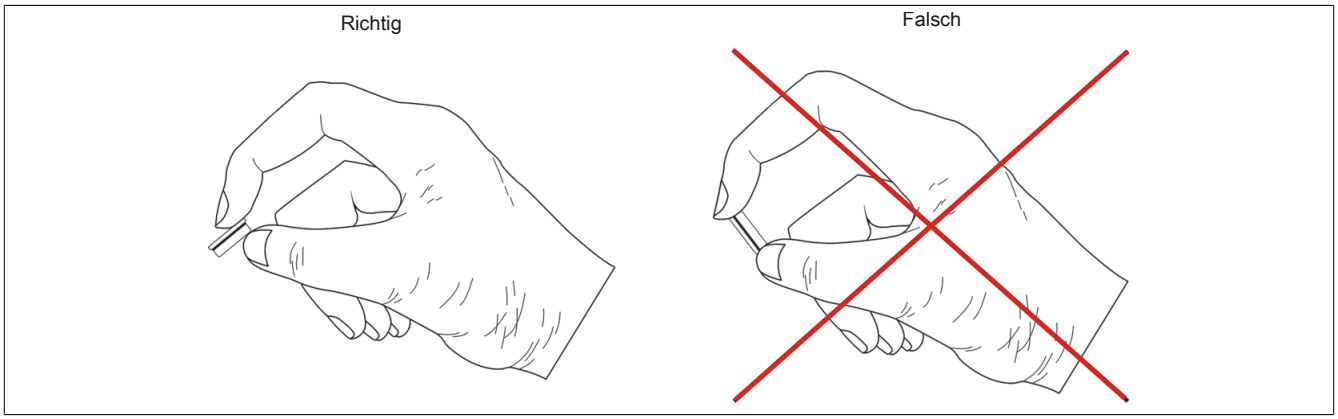


Abbildung 239: Batteriehandhabung

- Neue Batterie in richtiger Polarität einstecken.

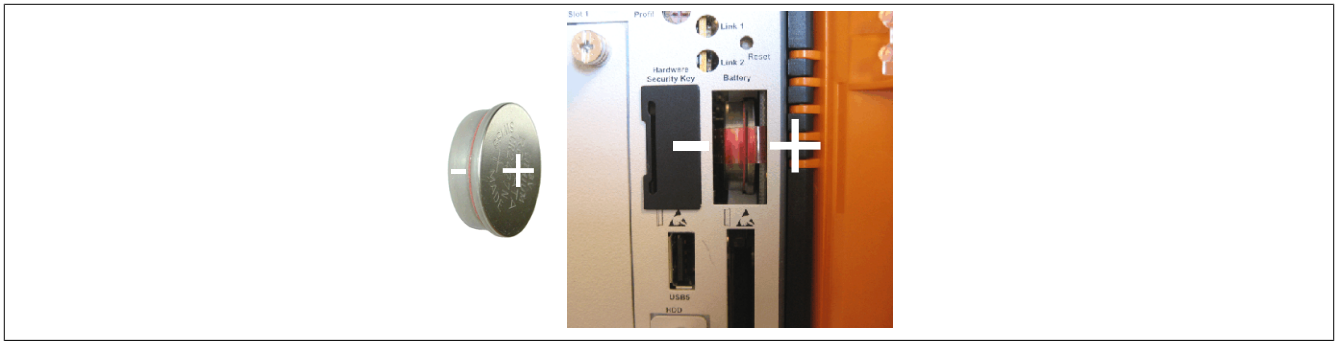


Abbildung 240: Batteriepolarität

- Beim Einstecken auf den korrekten Sitz des Ausziehstreifens achten, damit ein erneuter Tausch einfach zu bewerkstelligen ist!
- Den B&R Industrie PC wieder unter Spannung setzen - Netzstecker anstecken.
- Datum und Uhrzeit im BIOS neu einstellen.

Warnung!

Bei Lithium-Batterien handelt es sich um Sondermüll! Verbrauchte Batterien müssen nach den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.

2 CompactFlash Tausch

Vorsicht!

Ein Tauschen der CompactFlash Karte darf nur in spannungslosem Zustand erfolgen!

Das Tauschen der CompactFlash Karte ist durch Betätigung des Auswerfers (siehe Abbildung) mit einem spitzen Gegenstand (z.B. Kugelschreiber) schnell und sicher möglich.

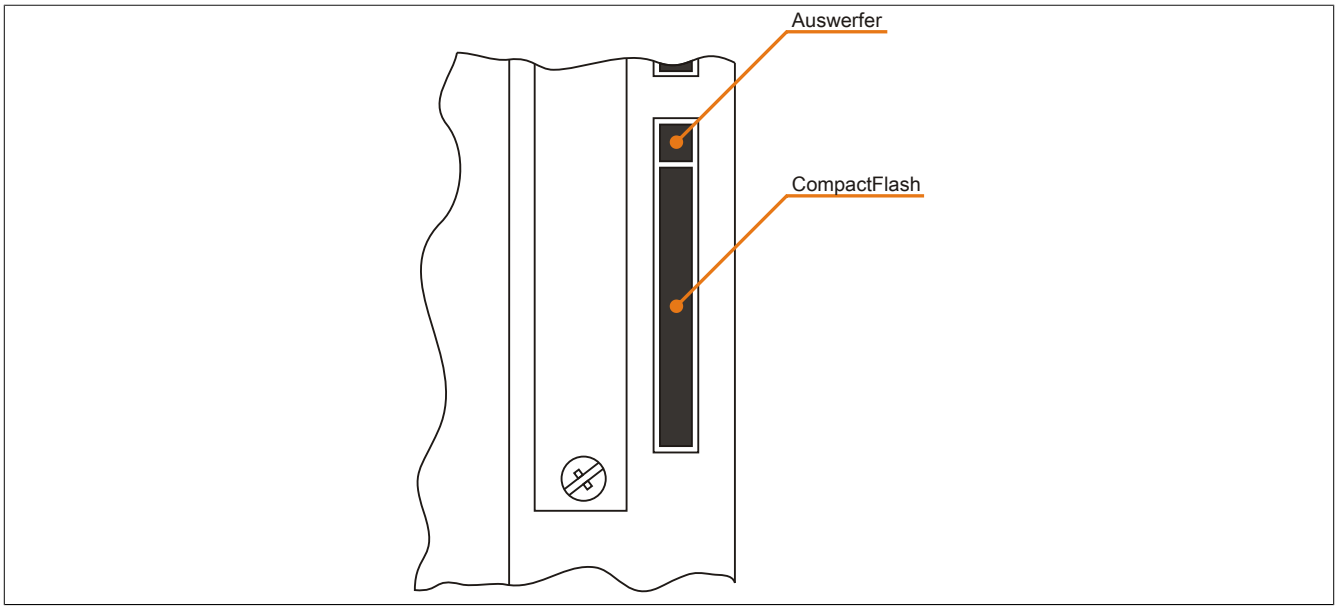


Abbildung 241: CompactFlash + Auswerfer (Symbolfoto)

3 Slide-in compact Laufwerkseinbau bzw. -tausch

Information:

Die SATA I Schnittstelle besitzt die Fähigkeit zum Austausch von Datenträgern im laufenden Betrieb (Hot-Plug). Um diese Eigenschaft nutzen zu können, muss dies vom Betriebssystem unterstützt werden.

3.1 Vorgangsweise

1. 2 Schnellverschlussschrauben der Schutzabdeckung bzw. des Slide-in compact Laufwerks lösen und entfernen.

Abbildung 242: Schnellverschlussschrauben lösen

2. Compact SATA Laufwerk einschieben und mit den Schnellverschlussschrauben befestigen.

Abbildung 243: Compact SATA Laufwerk einschieben

4 Slide-in Slot Laufwerkseinbau bzw. -tausch

Slide-in Laufwerke können bei Systemeinheiten mit 2, 3 oder 5 Card Slots eingebaut und getauscht werden.

4.1 Vorgangsweise

1. Zuleitung zum B&R Industrie PC spannungslos machen.
2. Elektrostatische Entladung am Gehäuse bzw. am Erdungsanschluss vornehmen.
3. Entfernung des Slide-in Blindmodules bzw. Slide-in Laufwerks durch Lösen der 2 Schnellverschlussschrauben.

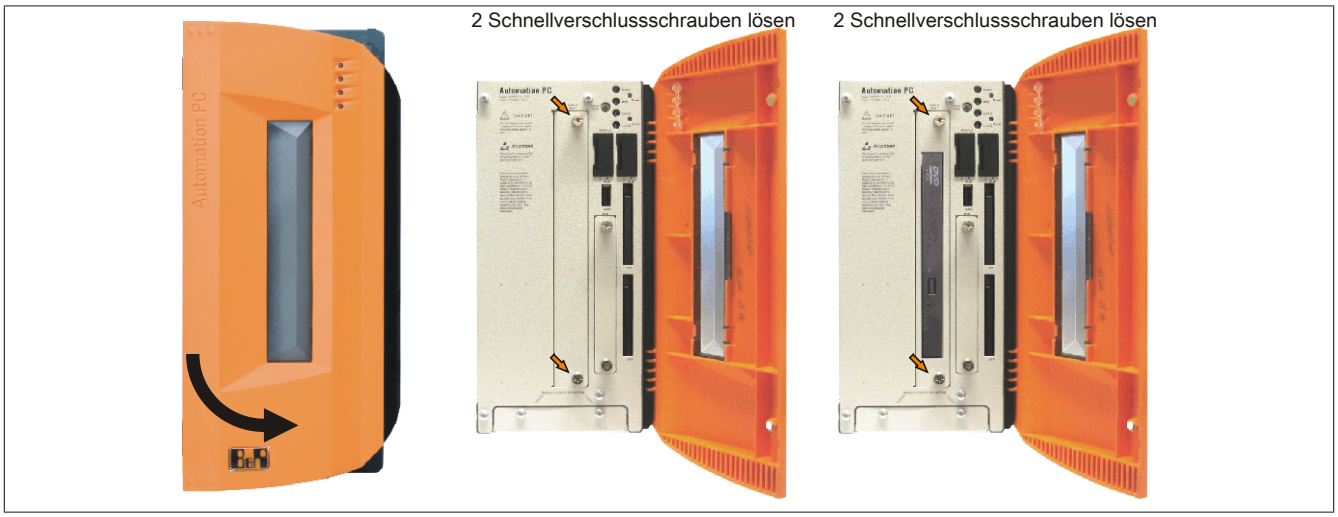


Abbildung 244: Schnellverschlussschrauben lösen

4. Slide-in Laufwerk einstecken und mit den beiden Schnellverschlussschrauben fixieren.

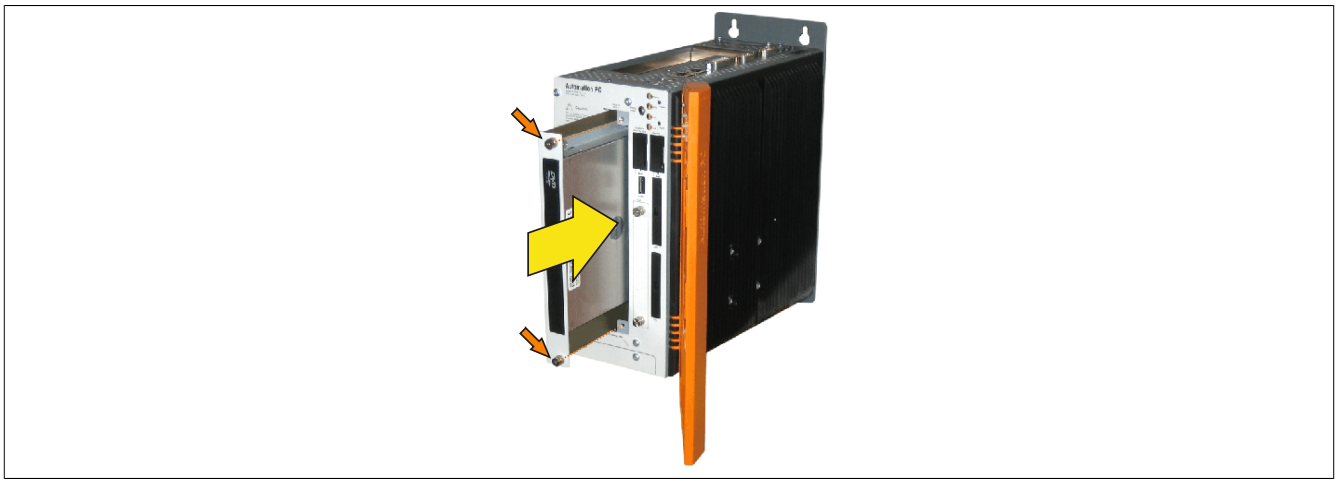


Abbildung 245: Slide-in Laufwerkseinbau

5 Slide-in compact Adapter Montage

Slide-in compact Adapter können bei Systemeinheiten mit 2, 3 oder 5 Card Slots eingebaut und getauscht werden. Mit dem Slide-in compact Adapter kann ein Slide-in compact Laufwerk (z.B. Slide-in compact HDD) in einem Slide-in Slot montiert werden.

5.1 Vorgangsweise

1. Zuleitung zum B&R Industrie PC spannungslos machen.
2. Elektrostatische Entladung am Gehäuse bzw. am Erdungsanschluss vornehmen.
3. Entfernung des Slide-in Blindmodules bzw. Slide-in Laufwerks durch Lösen der 2 Schnellverschlussschrauben.

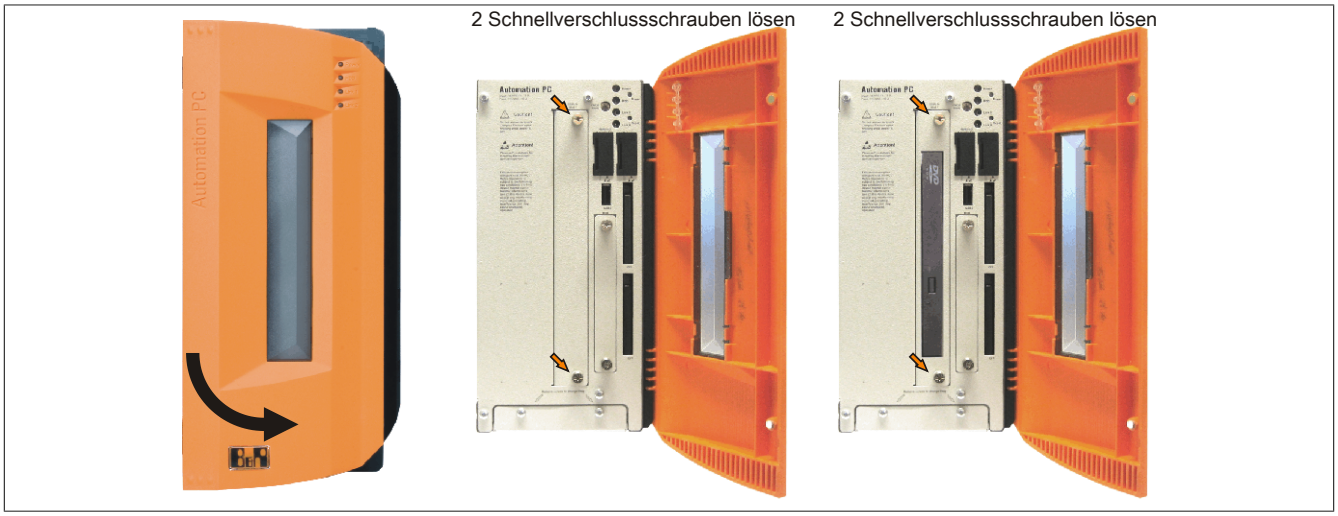


Abbildung 246: Schnellverschlussschrauben lösen

4. Silde-in compact Adapter einstecken und mit den beiden Schnellverschlussschrauben fixieren.

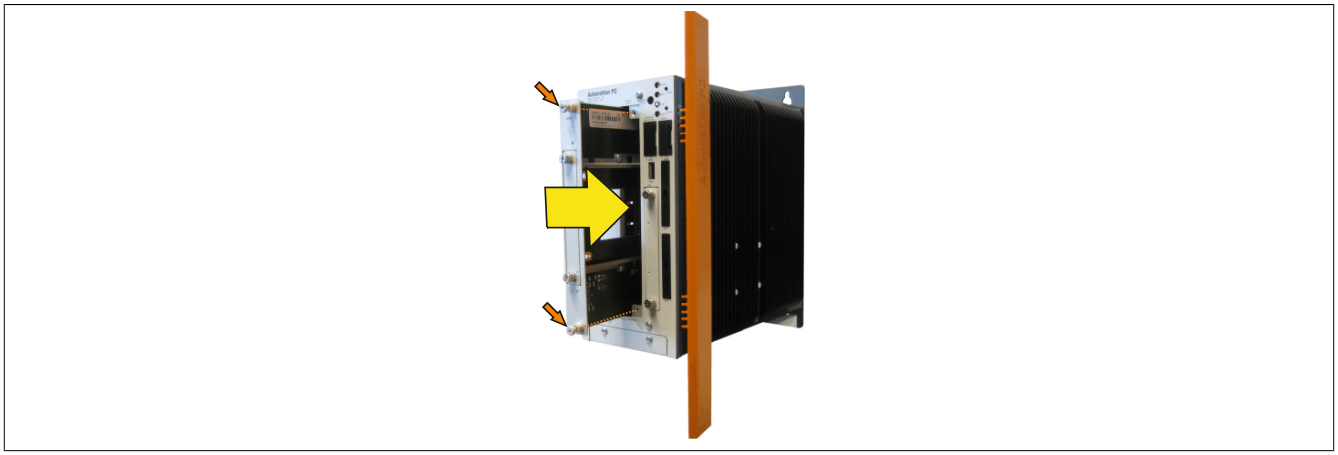


Abbildung 247: Slide-in compact Adapter Einbau

5. Nach der Montage kann ein Slide-in compact Laufwerk montiert werden.

Abbildung 248: Slide-in compact Laufwerk montieren

6 Lüfter Kit Einbau / Tausch

6.1 Vorgangsweise

1. Lüfter Kit Abdeckung entfernen. Torx (T10) Schrauben lösen und Abdeckung nach vorne schieben.

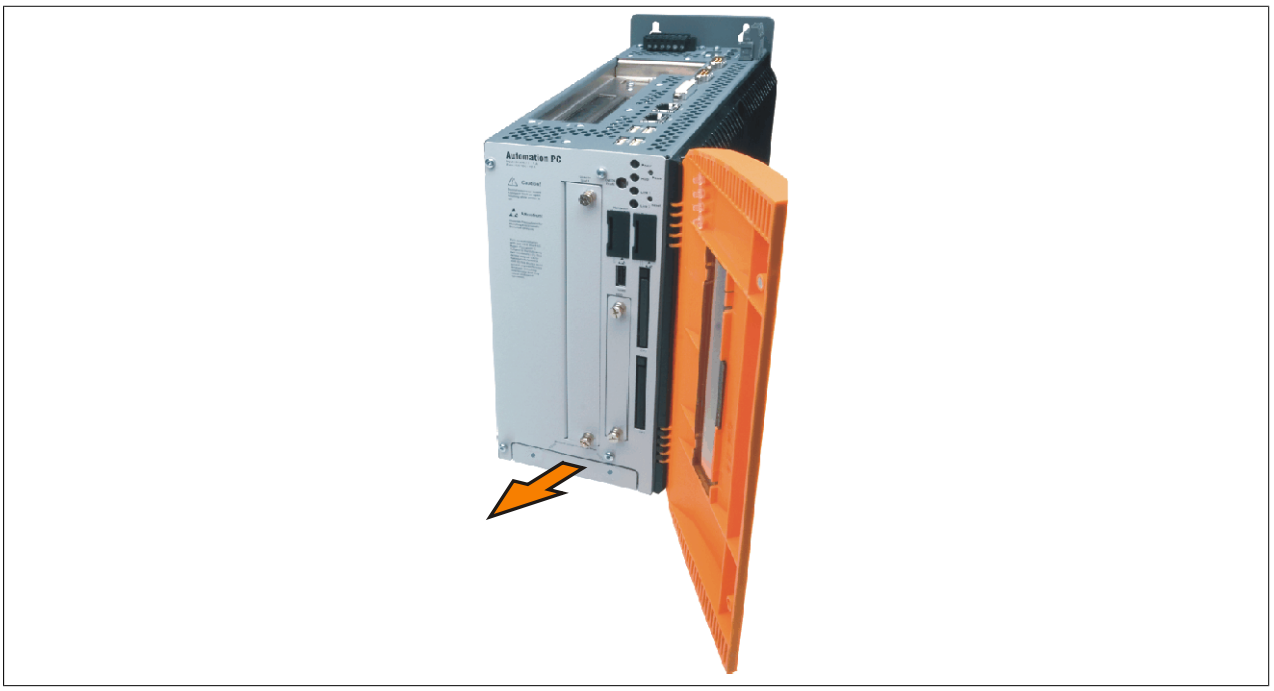


Abbildung 249: Lüfter Kit Einschub entfernen

2. Den Rahmen einlegen - Kontaktplatinenseite auf die Schleifkontakte an der Systemeinheit - und mit den Schnellverschlussschrauben befestigen.

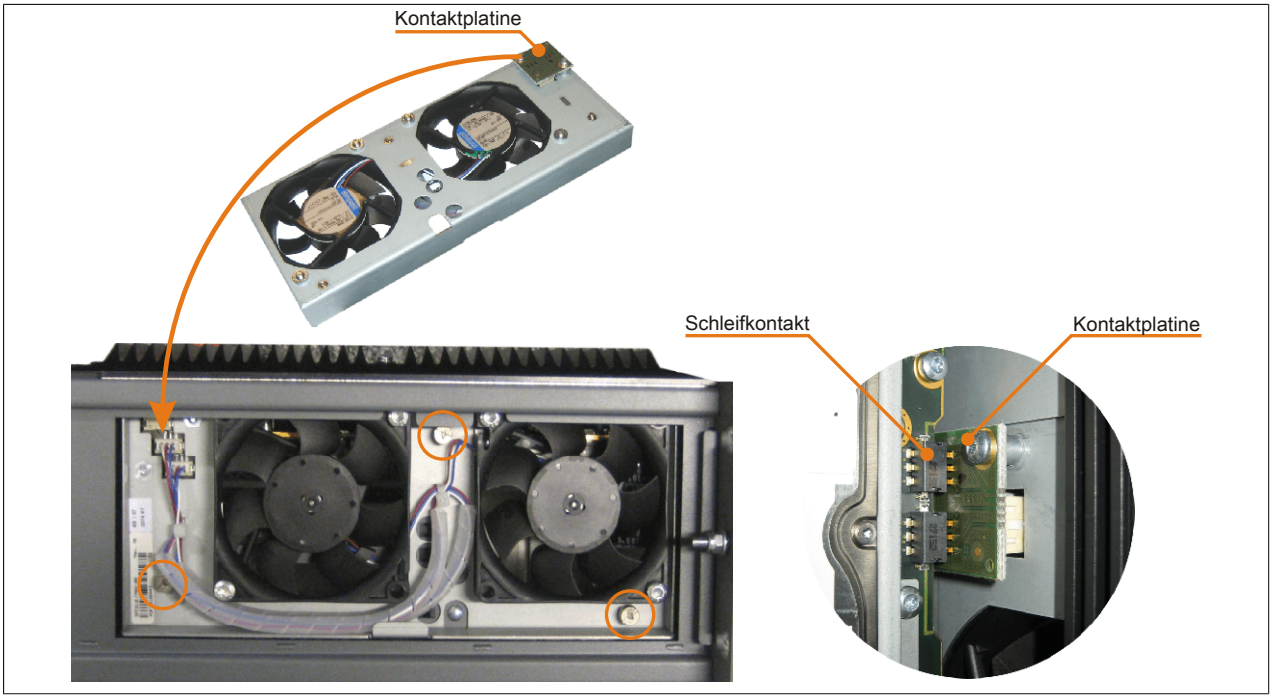


Abbildung 250: Lüfter Kit einlegen und befestigen

3. Staubfilter in die Lüfter Kit Abdeckung einlegen und mit der Filterspange fixieren.

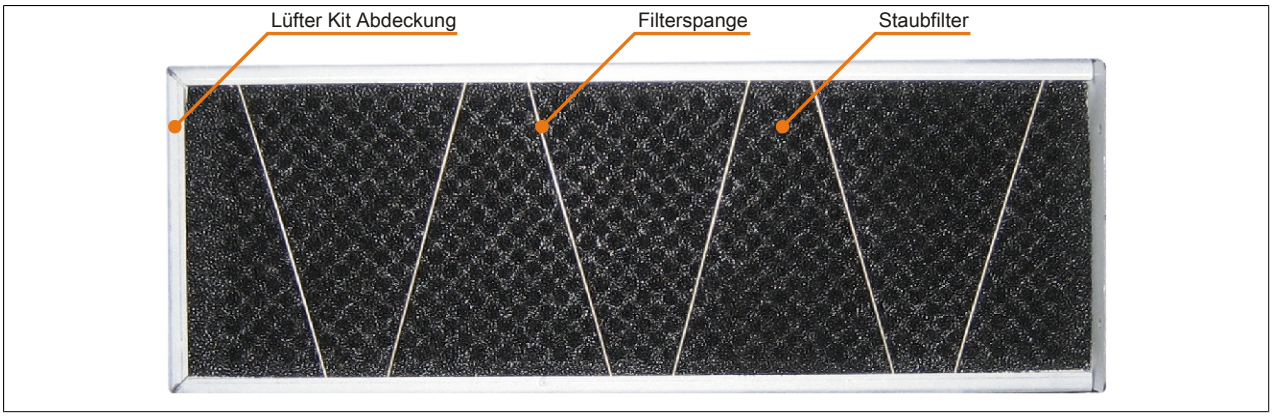


Abbildung 251: Staubfilter mit Filterspange fixieren

4. Lüfter Kit Abdeckung im Gehäuse einsetzen und mit den zuvor gelösten Torxschrauben befestigen.

Information:

Regelmäßige Kontrolle des Staubfilters je nach Einsatzgebiet und Verschmutzungsgrad.

Der Einbau ist bei allen APC810 Modellen ähnlich vorzunehmen.

7 Montage des USV Moduls

Die Montage erfolgt mit dem beigelegten Montagematerial beim USV Modul.

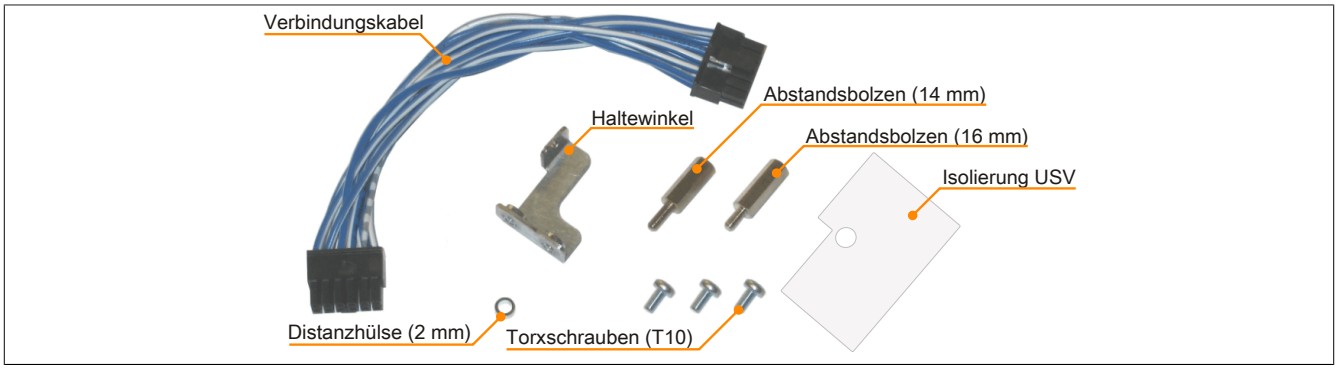


Abbildung 252: 5AC600.UPSI-00 Add-on USV Modul Montagematerial

Die Montage unterscheidet sich je nach Systemeinheitenvariante (1,2,3 oder 5 Card Slots) bzw. auch ob ein Add-on Schnittstellenmodul (IF Option) im APC810 montiert ist.

7.1 Montage ohne montiertem Add-on Schnittstellenmodul

Je nach Systemeinheitenvariante und montiertem oder nicht montiertem Add-on Interfacemodul sind unterschiedliche Teile zu verwenden.

7.1.1 APC810 1 Card Slot

1. Seitendeckel entfernen (siehe "Seitendeckeldemontage" auf Seite 441).
2. USV Modulabdeckung durch lösen von den 2 markierten Torxschrauben (T10) entfernen.

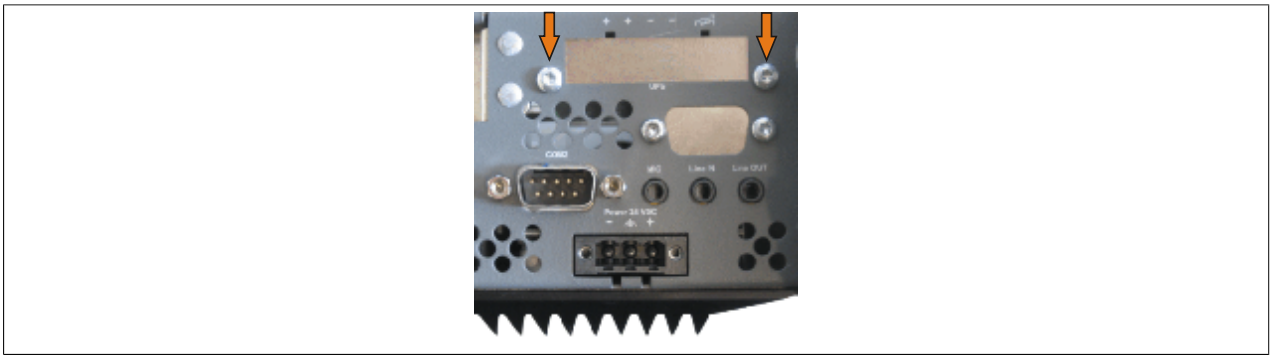


Abbildung 253: USV Modulabdeckung entfernen

3. Distanzbolzen und Distanzring am Basisboard montieren (mittels Innensechskant- Schraubendreher Größe 5).

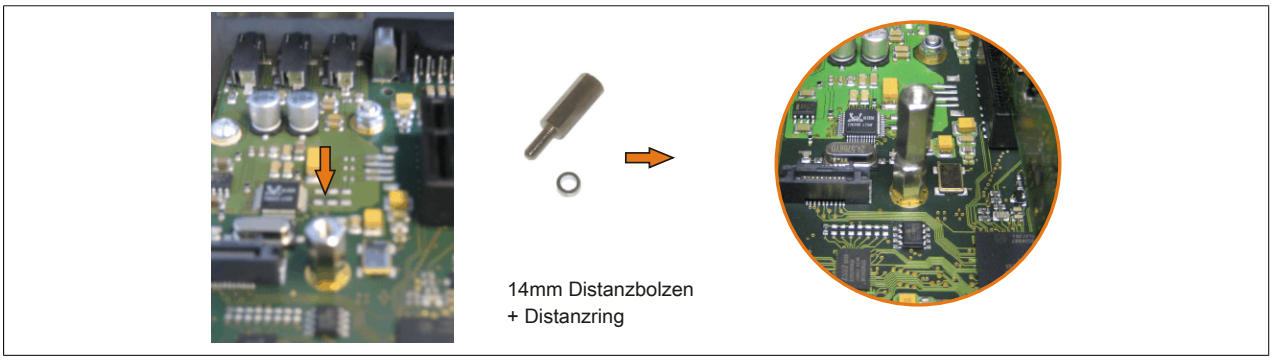


Abbildung 254: Distanzbolzen und Distanzring montieren

4. Isolierung USV an die Unter-/Rückseite des USV Moduls anlegen und beides mit 2 Torxschrauben (T10) am Gehäuse und 1 Torxschraube (T10) am Basisboard (Distanzbolzen) montieren. Es sind die zuvor entfernten Torxschrauben aus dem Montagematerial zu verwenden.

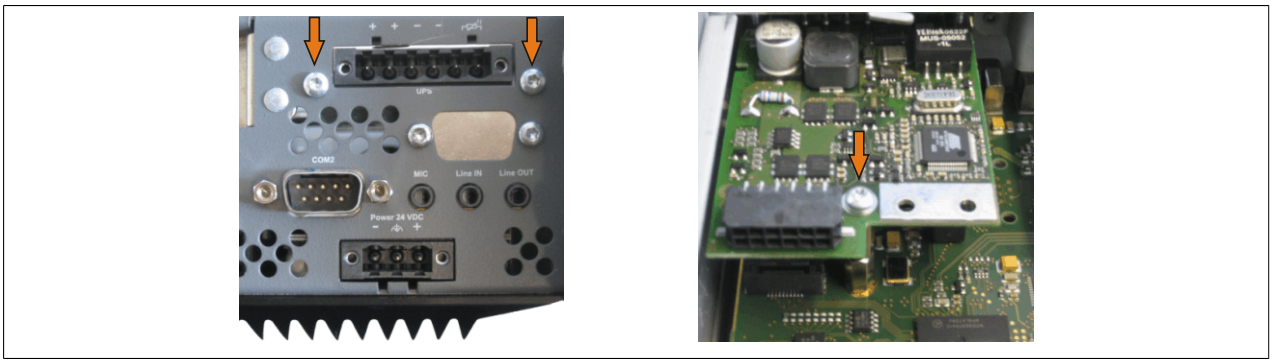


Abbildung 255: USV Modul montieren

5. Verbindungskabel anstecken (siehe markierte Buchsen).

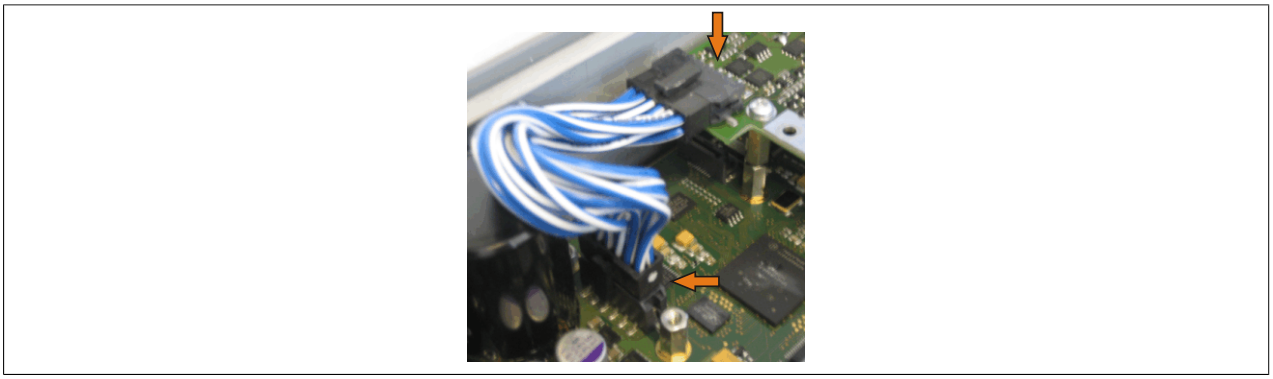


Abbildung 256: Verbindungskabel anstecken

Information:

Beim Anschluss des Verbindungskabels ist darauf zu achten, dass dabei die Verriegelung der Stecker einrastet.

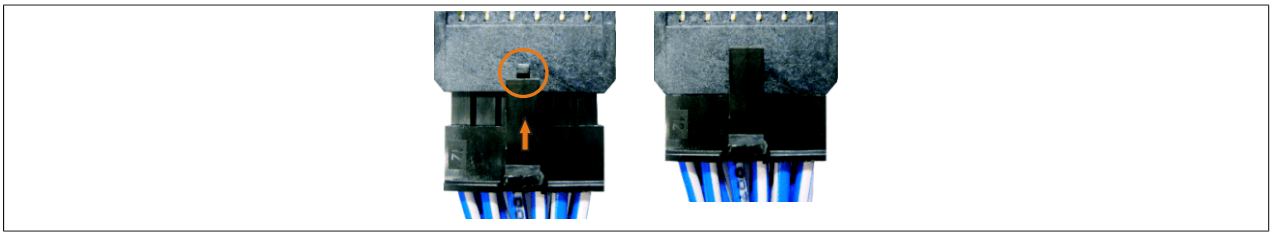


Abbildung 257: Steckerverriegelung

6. Seitendeckel montieren.

7.1.2 APC810 2 und 3 Card Slot

1. Seitendeckel entfernen (siehe "Seitendeckeldemontage" auf Seite 441).
2. USV Modulabdeckung durch lösen von den 2 markierten Torxschrauben (T10) entfernen.

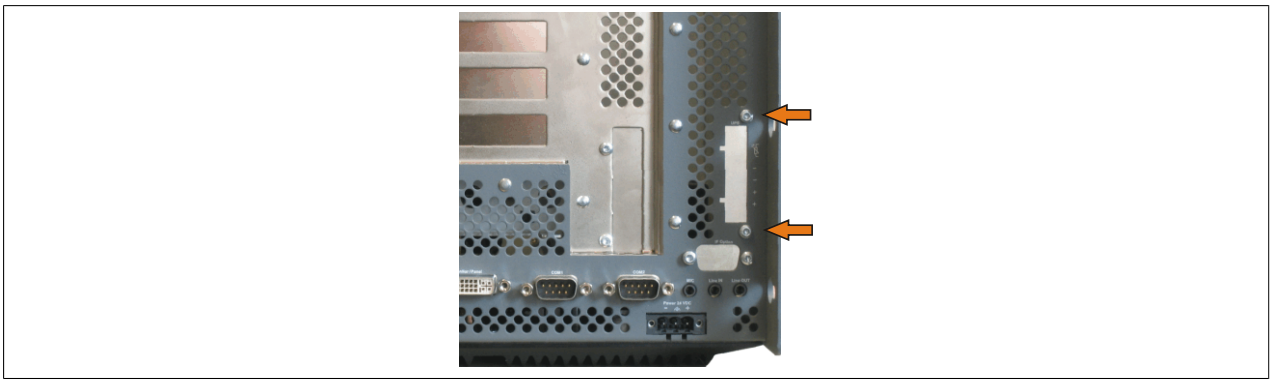


Abbildung 258: USV Modulabdeckung entfernen

3. Distanzbolzen und Distanzring am Basisboard montieren (mittels Innensechskant- Schraubendreher Größe 5).

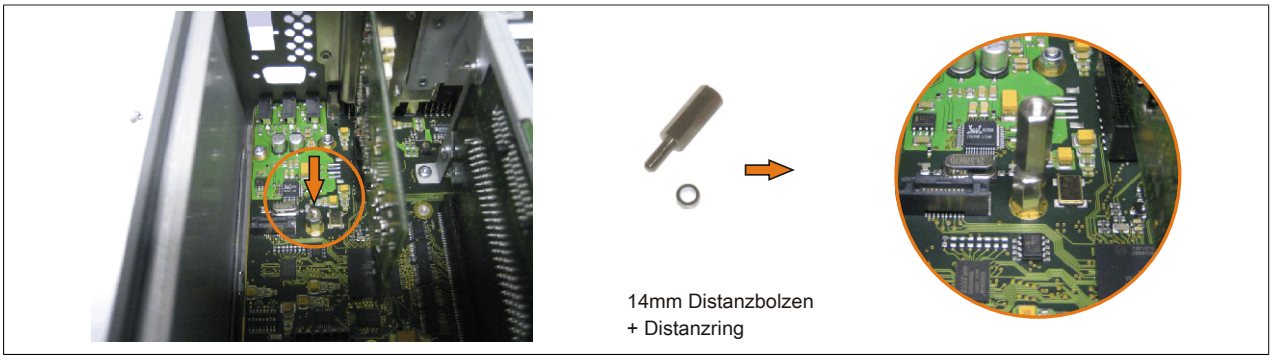


Abbildung 259: Distanzbolzen und Distanzring montieren

4. Haltewinkel mit 2 Torxschrauben (T10) am USV Modul montieren.

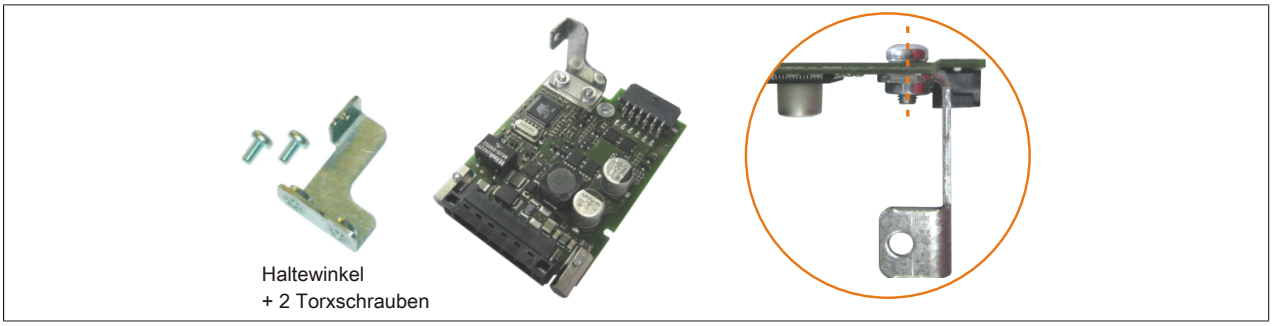


Abbildung 260: Haltewinkel montieren

5. Isolierung USV an die Unter-/Rückseite des USV Moduls anlegen und beides mit 2 Torxschrauben (T10) am Gehäuse und 1 Torxschraube (T10) am Basisboard (Distanzbolzen) montieren. Es sind die zuvor entfernten Torxschrauben aus dem Montagematerial zu verwenden.

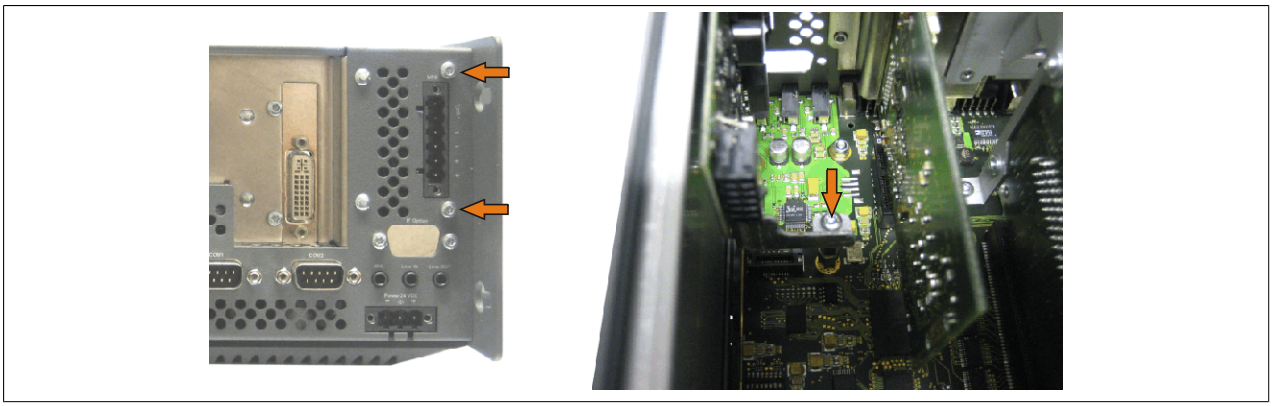


Abbildung 261: USV Modul montieren

6. Verbindungskabel anstecken (siehe markierte Buchsen).

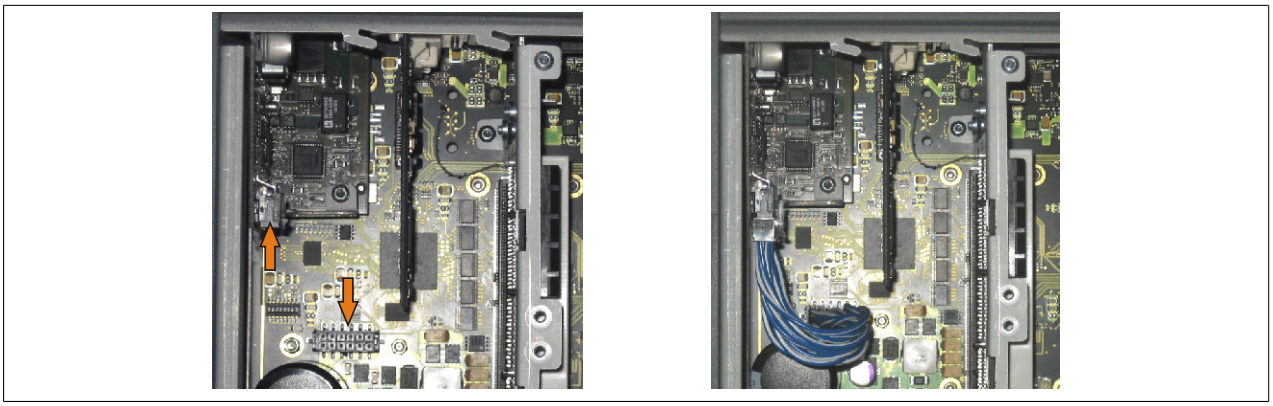


Abbildung 262: Verbindungskabel anstecken

Information:

Beim Anschluss des Verbindungskabels ist darauf zu achten, dass dabei die Verriegelung der Stecker einrastet.

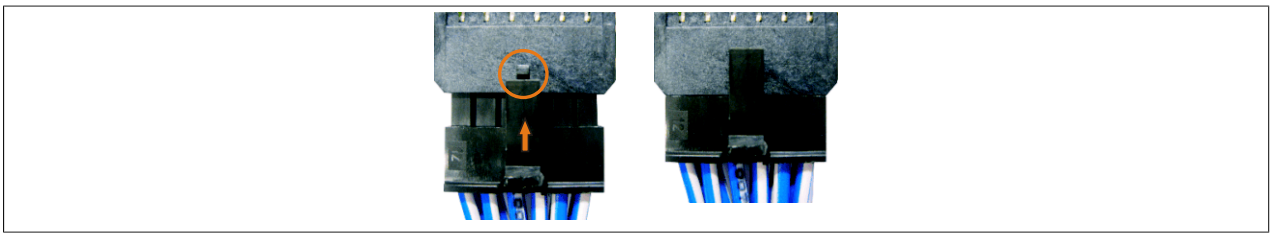


Abbildung 263: Steckerverriegelung

7. Seitendeckel montieren.

7.1.3 APC810 5 Card Slot

1. Seitendeckel entfernen (siehe "Seitendeckeldemontage" auf Seite 441).
2. USV Modulabdeckung durch lösen von den 2 markierten Torxschrauben (T10) entfernen.

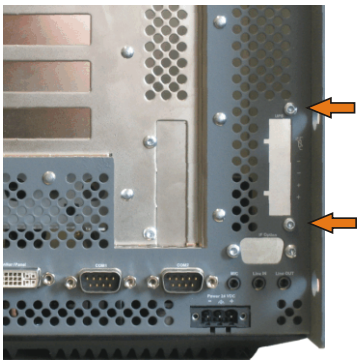


Abbildung 264: USV Modulabdeckung entfernen

3. Distanzbolzen und Distanzring montieren (mittels Innensechskant Schraubendreher Größe 5).

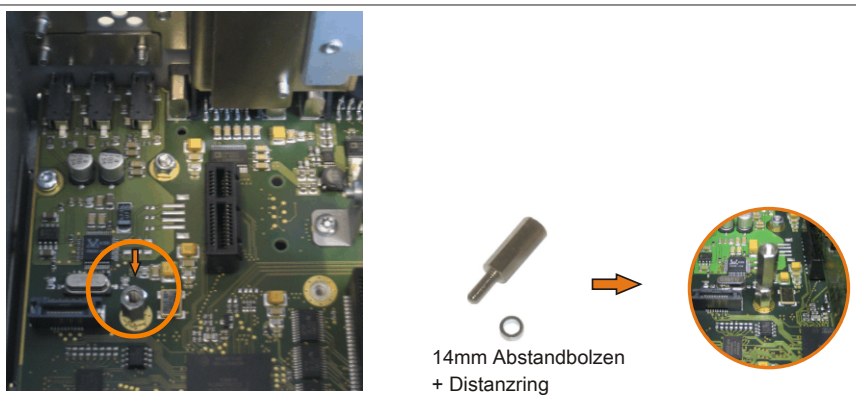


Abbildung 265: Distanzbolzen und Distanzrig montieren

4. Haltewinkel mit 2 Torxsschrauben (T10) am USV Modul montieren.

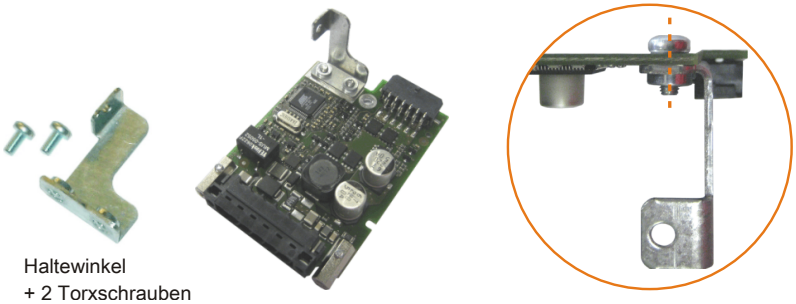


Abbildung 266: Haltewinkel montieren

5. Isolierung USV an die Unter-/Rückseite des USV Moduls anlegen und beides mit 2 Torxschrauben (T10) am Gehäuse und 1 Torxschraube (T10) am Basisboard (Distanzbolzen) montieren. Es sind die zuvor entfernten Torxschrauben aus dem Montagematerial zu verwenden.

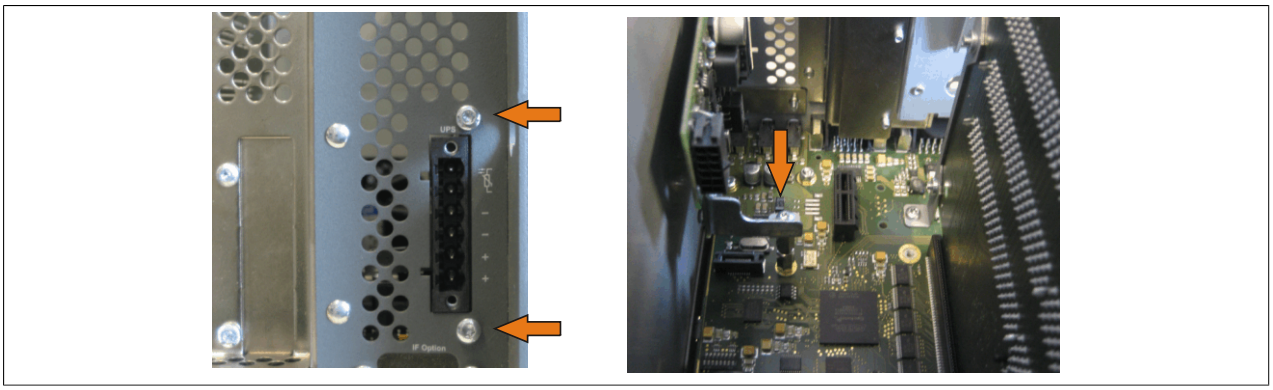


Abbildung 267: USV Modul montieren

6. Verbindungskabel anbringen (siehe markierte Buchsen)

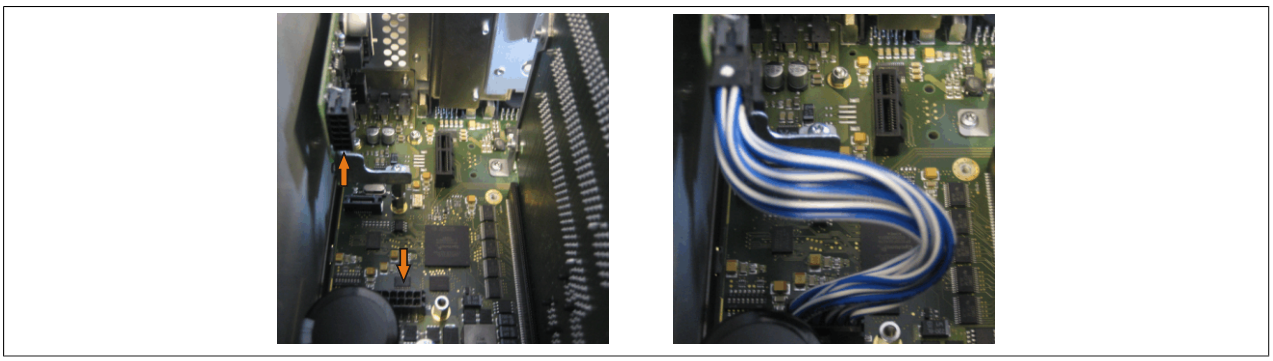


Abbildung 268: Verbindungskabel anstecken

Information:

Beim Anschluss des Verbindungskabels ist darauf zu achten, dass dabei die Verriegelung der Stecker einrastet.

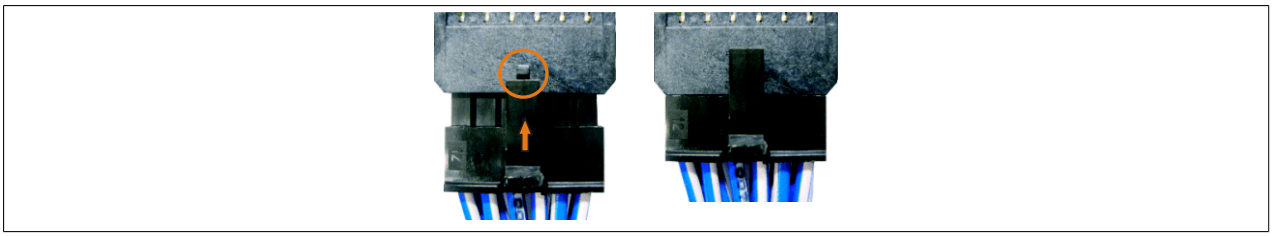


Abbildung 269: Steckerverriegelung

7. Seitendeckel montieren

7.2 Montage mit montiertem Add-on Schnittstellenmodul

7.2.1 APC810 1 Card Slot

1. Seitendeckel entfernen (siehe "Seitendeckeldemontage" auf Seite 441).
2. USV Modulabdeckung durch lösen von den 2 markierten Torxschrauben (T10) entfernen.

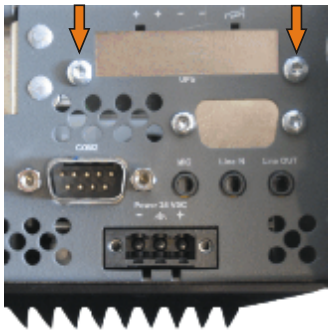


Abbildung 270: USV Modulabdeckung entfernen

3. Distanzbolzen montieren (mittels Innensechskant Schraubendreher Größe 5).

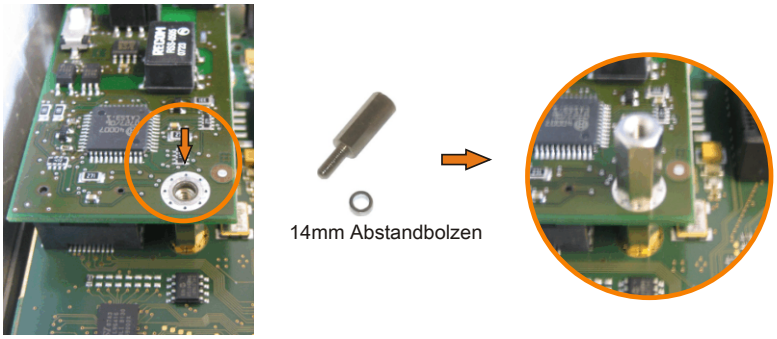


Abbildung 271: Distanzbolzen montieren

4. Isolierung USV an die Unter-/Rückseite des USV Moduls anlegen und beides mit 3 Torxschrauben (T10) montieren. Es sind die zuvor entfernten Torxschrauben und eine Torxschraube aus dem Montagematerial zu verwenden.

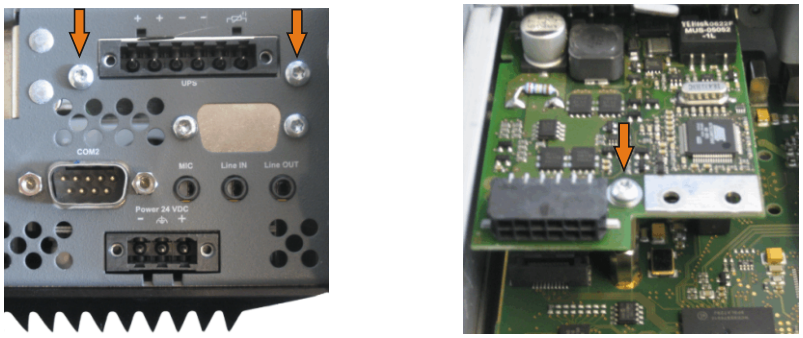


Abbildung 272: USV Modul montieren

5. Verbindungskabel anstecken (siehe markierte Buchsen).

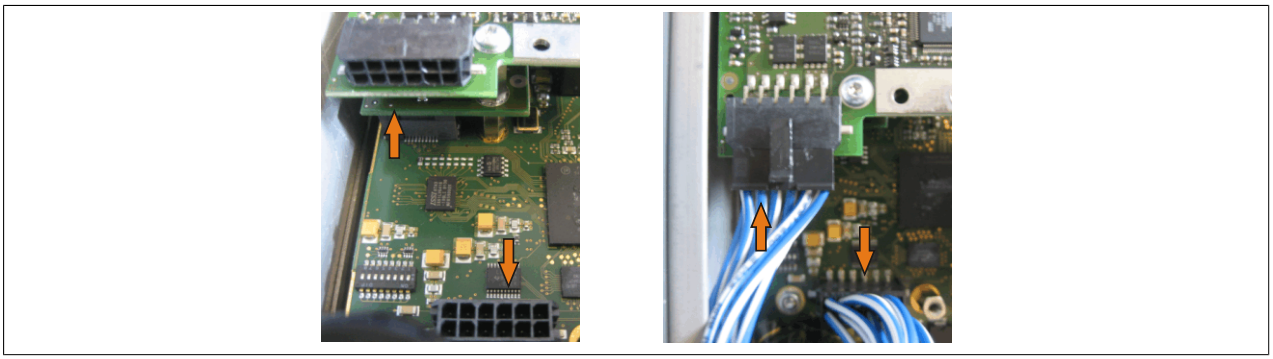


Abbildung 273: Verbindungskabel anstecken

Information:

Beim Anschluss des Verbindungskabels ist darauf zu achten, dass dabei die Verriegelung der Stecker einrastet.

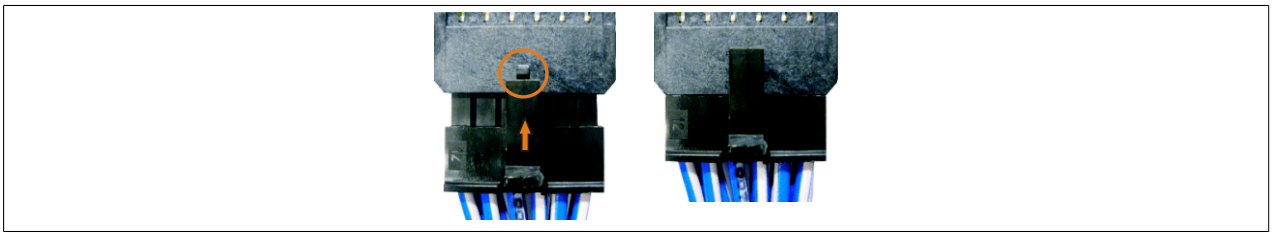


Abbildung 274: Steckerverriegelung

6. Abdeckblech und Seitendeckel montieren.

7.2.2 APC810 2 und 3 Card Slot

1. Seitendeckel entfernen (siehe "Seitendeckeldemontage" auf Seite 441).
2. USV Modulabdeckung durch lösen von den 2 markierten Torxschrauben (T10) entfernen.

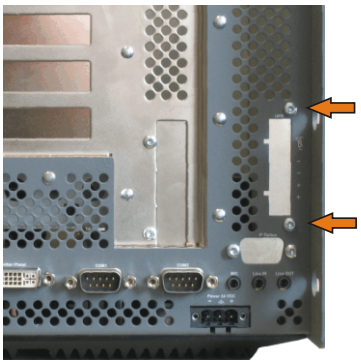
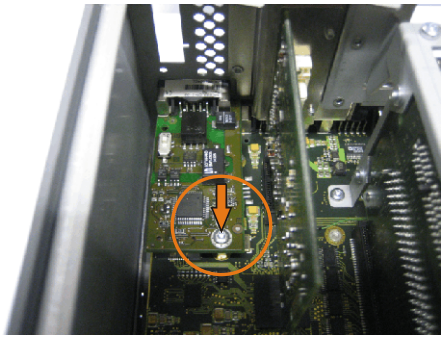
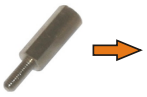


Abbildung 275: USV Modulabdeckung entfernen

3. Distanzbolzen montieren (mittels Innensechskant Schraubendreher Größe 5).





14 mm Distanzbolzen

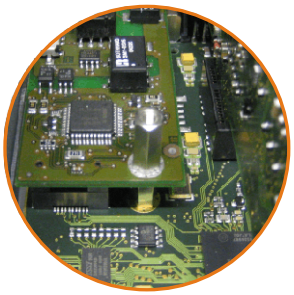


Abbildung 276: Distanzbolzen montieren

4. Haltewinkel mit 2 Torxschrauben (T10) am USV Modul montieren.

Haltewinkel
+ 2 Torxschrauben

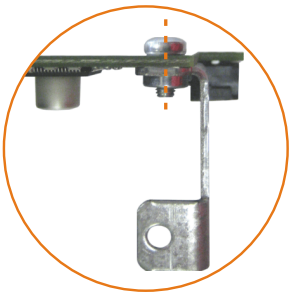


Abbildung 277: Haltewinkel montieren

5. Isolierung USV an die Unter-/Rückseite des USV Moduls anlegen und beides mit 3 Torxschrauben (T10) montieren. Es sind die zuvor entfernten Torxschrauben und eine Torxschraube aus dem Montagematerial zu verwenden.

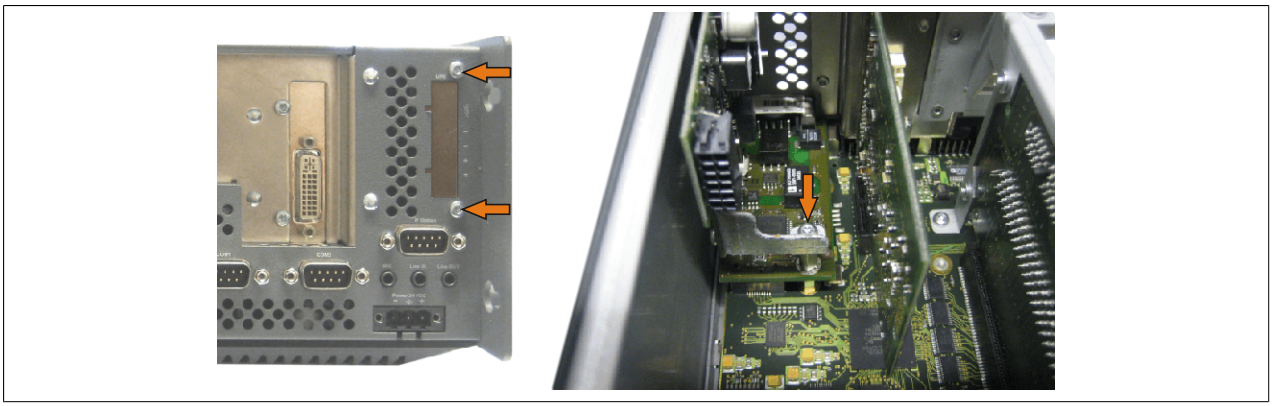


Abbildung 278: USV Modul montieren

6. Verbindungskabel anstecken (siehe markierte Buchsen).

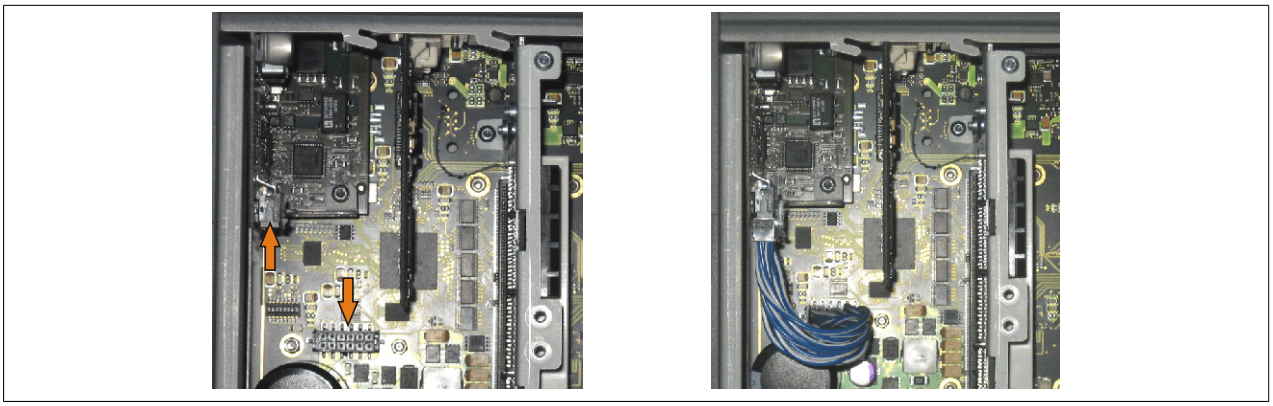


Abbildung 279: Verbindungskabel anstecken

Information:

Beim Anschluss des Verbindungskabels ist darauf zu achten, dass dabei die Verriegelung der Stecker einrastet.

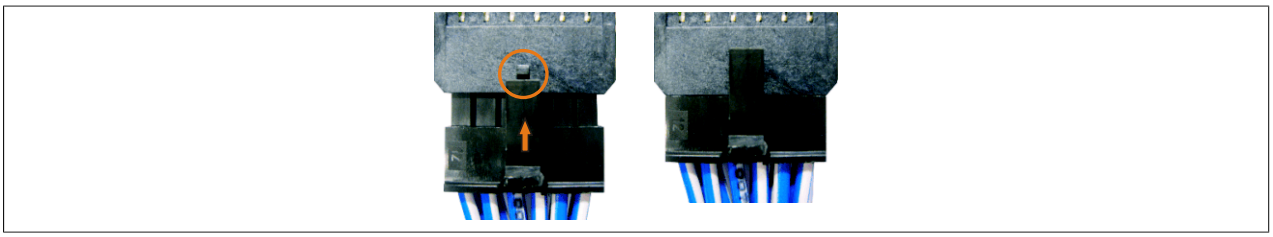


Abbildung 280: Steckerverriegelung

7. Abdeckblech und Seitendeckel montieren.

7.2.3 APC810 5 Card Slot

1. Seitendeckel entfernen (siehe "Seitendeckeldemontage" auf Seite 441).
2. USV Modulabdeckung durch lösen von den 2 markierten Torxschrauben (T10) entfernen.

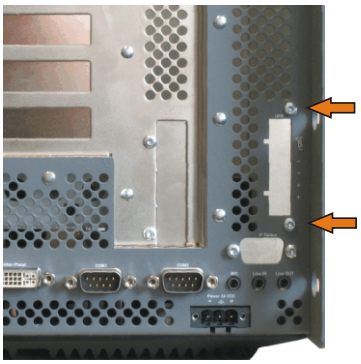


Abbildung 281: USV Modulabdeckung entfernen

3. Distanzbolzen montieren (mittels Innensechskant Schraubendreher Größe 5).

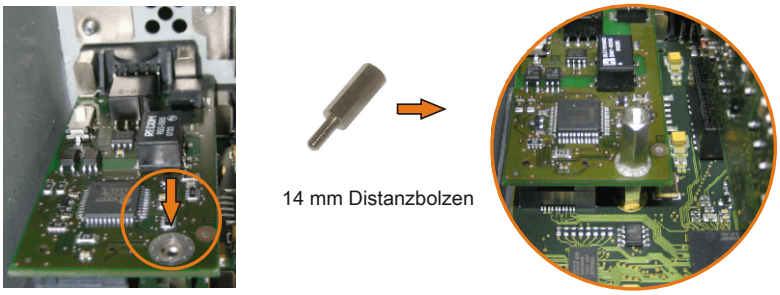


Abbildung 282: Distanzbolzen montieren

4. Haltewinkel mit 2 Torxschrauben (T10) am USV Modul montieren.

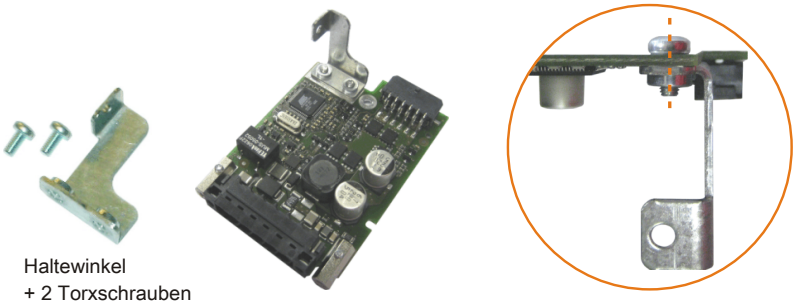


Abbildung 283: Haltewinkel montieren

5. Isolierung USV an die Unter-/Rückseite des USV Moduls anlegen und beides mit 3 Torxschrauben (T10) montieren. Es sind die zuvor entfernten Torxschrauben und eine Torxschraube aus dem Montagematerial zu verwenden.

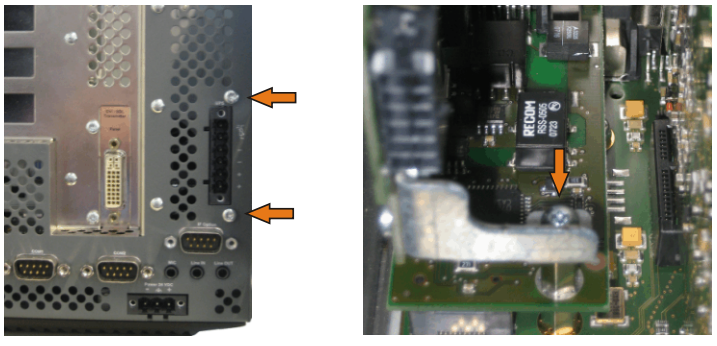


Abbildung 284: USV Modul montieren

6. Verbindungskabel anstecken (siehe markierte Buchsen).

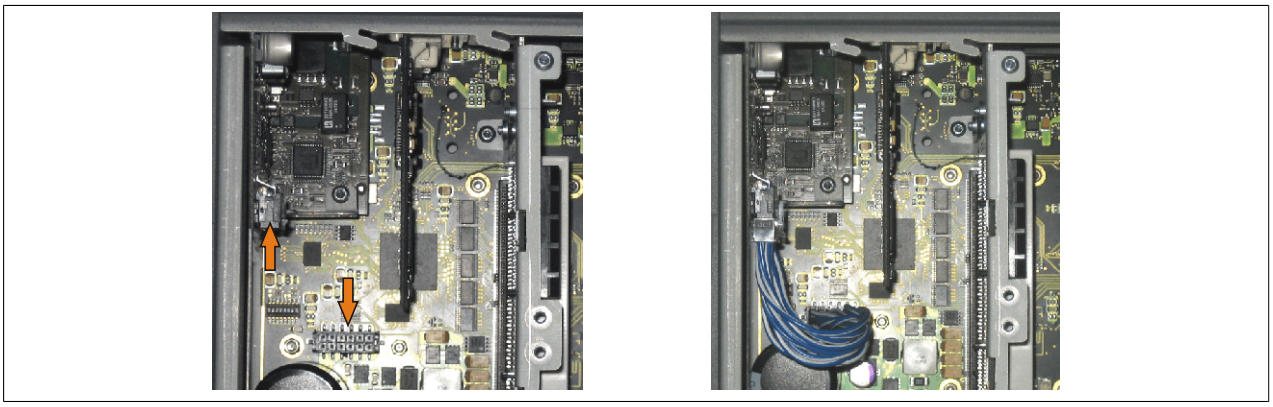


Abbildung 285: Verbindungskabel anstecken

Information:

Beim Anschluss des Verbindungskabels ist darauf zu achten, dass dabei die Verriegelung der Stecker einrastet.

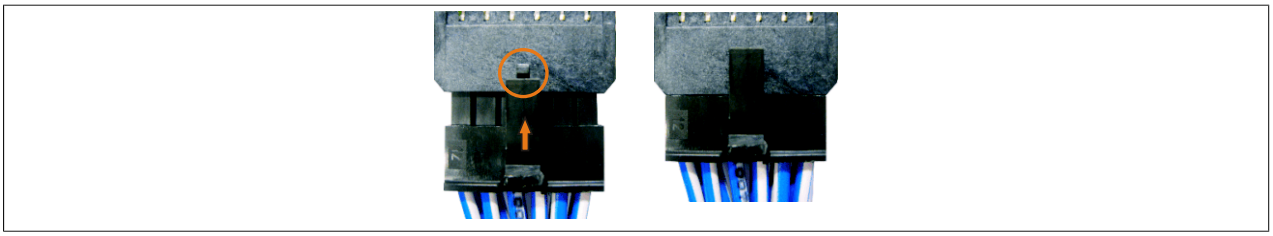


Abbildung 286: Steckerverriegelung

7. Abdeckblech und Seitendeckel montieren.

8 Montage des USV Sicherungs Kit an der Batterieeinheit

Information:

Das USV Sicherungs Kit 5AC600.UPSF-00 wird nur für Batterieeinheiten bis einschließlich Revision D0 benötigt. Ab Revision E0 ist bereits eine 25 A Sicherung auf der Steckerpaltine der Batterieeinheit integriert.

8.1 Vorgangsweise

1. Die Batterieeinheit 5AC600.UPSB-00 durch Abstecken des USV Verbindungskabel vom B&R Industrie PC trennen.
2. Die Abdeckung der Batterieeinheit entfernen. Dazu sind die beiden gekennzeichneten Torxschrauben (T10) zu lösen und anschließend die Abdeckung durch Schieben in Richtung des orangen Steckers abzunehmen.

Abbildung 287: Abdeckung der Batterieeinheit entfernen

3. Um die Sicherung montieren zu können muss das rote Kabel von der Batterieplatine gelöst werden.

Abbildung 288: Kabel abstecken

4. Der Stecker des Sicherungs Kit ist mit der Buchse des roten Kabels zu verbinden (1). Die Buchse des Sicherungs Kit muss an dem Stecker der Batterieplatine angeschlossen werden (2).

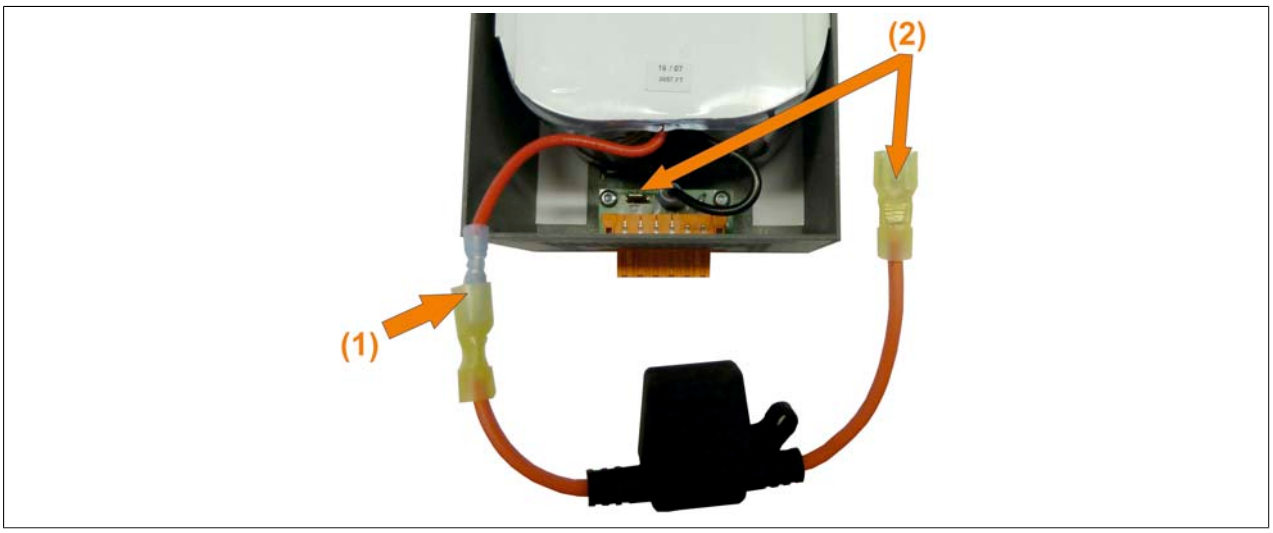


Abbildung 289: Sicherung anschließen

5. Anschließend kann die Sicherung in der Batterieeinheit verstaut werden.

Abbildung 290: Sicherung verstauen

6. Die Abdeckung der Batterieeinheit wieder montieren. Dazu die Zapfen der Abdeckung in die Nut der Batterieeinheit stecken und die Abdeckung mit den zu Beginn gelösten Torxschrauben befestigen.
7. Abschließend die Batterieeinheit 5AC600.UPSB-00 wieder mit dem B&R Industrie PC verbinden.

9 Seitendeckeldemontage

Die Seitenabdeckung kann einfach durch lösen von Torx (T10) Schrauben entfernt werden. Je nach System variiert die Anzahl der Torxschrauben.

9.1 APC810 mit 1 Card Slot

1. Zuleitung zum Automation PC 810 spannungslos machen.
2. Elektrostatische Entladung am Gehäuse bzw. am Erdungsanschluss vornehmen.
3. Öffnen der orangen Frontabdeckung . Hinter der Abdeckung müssen die in der nachfolgenden Abbildung markierten Kombitorxschrauben (T10) gelöst werden.
4. Nach dem Lösen der Schrauben ist die Seitenabdeckung durch schieben nach vorne zu entfernen.

Abbildung 291: APC810 1 Card Slot Seitendeckeldemontage

9.2 APC810 mit 2 und 3 Card Slot

1. Zuleitung zum Automation PC 810 spannungslos machen.
2. Elektrostatische Entladung am Gehäuse bzw. am Erdungsanschluss vornehmen.
3. Öffnen der orangen Frontabdeckung . Hinter der Abdeckung müssen die in der nachfolgenden Abbildung markierten Kombitorxschrauben (T10) gelöst werden.
4. Nach dem Lösen der Schrauben ist die Seitenabdeckung durch schieben nach vorne zu entfernen.

Abbildung 292: APC810 2 Card Slot Seitendeckeldemontage

9.3 APC810 mit 5 Card Slot

1. Zuleitung zum Automation PC 810 spannungslos machen.
2. Elektrostatische Entladung am Gehäuse bzw. am Erdungsanschluss vornehmen.
3. Öffnen der orangen Frontabdeckung . Hinter der Abdeckung müssen die in der nachfolgenden Abbildung markierten Kombitorxschrauben (T10) gelöst werden.
4. Nach dem Lösen der Schrauben ist die Seitenabdeckung durch schieben nach vorne zu entfernen.

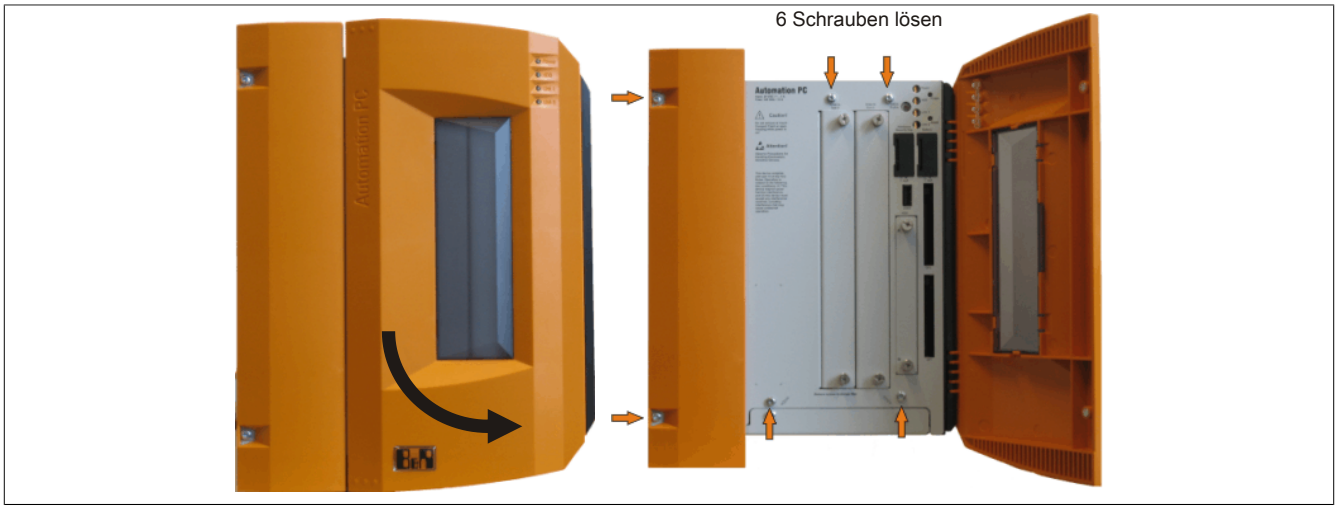


Abbildung 293: APC810 5 Card Slot Seitendeckeldemontage

10 AP Link Montage

10.1 Vorgangsweise

1. Seitendeckel entfernen (siehe "Seitendeckeldemontage" auf Seite 441).
2. AP Link Modulabdeckung durch Lösen von den 2 markierten Torxschrauben (T10) entfernen.

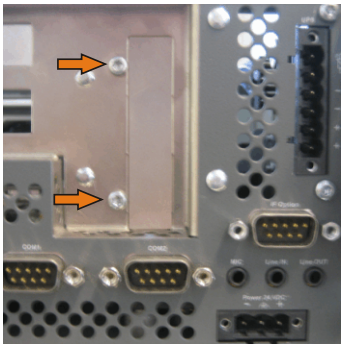


Abbildung 294: AP Link Modulabdeckung entfernen

3. Die AP Link Karte in den dafür vorgesehenen Slot stecken.

> **Warnung!**
>
> **Beim Einstecken der AP Link Karte ist darauf zu achten, dass diese richtig in den AP Link Slot einrastet.**
>
> **Die Karte nicht mit Gewalt in den Slot drücken.**

4. AP Link Modul mit 3 Torxschrauben (T10) montieren. Es sind die zuvor entfernten Torxschrauben aus dem Montagematerial sowie eine zusätzliche Torxschraube zu verwenden.

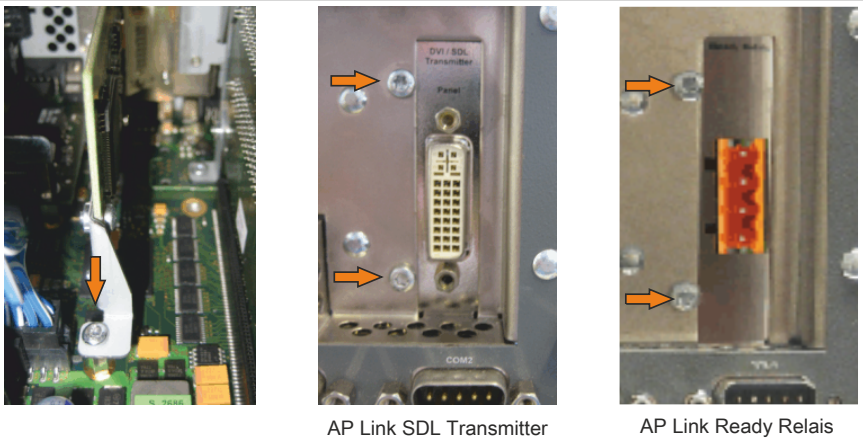


Abbildung 295: AP Link Modul montieren

5. Abdeckblech und Seitendeckel montieren.

11 Tauschen einer PCI SATA RAID Hard Disk bei RAID 1

Als Beispiel wird angenommen, dass bei einer RAID 1 Konfiguration die Secondary Hard Disk (HDD1) defekt ist. In diesem Fall ist es möglich, die defekte Hard Disk durch eine Ersatz SATA Hard Disk zu ersetzen.

Bestellnummer PCI SATA RAID Controller	Bestellnummer benötigte Ersatz SATA-HDD	Anmerkung
5ACPCI.RAIC-01	5ACPCI.RAIC-02	60 GByte Hard Disk
5ACPCI.RAIC-03	5ACPCI.RAIC-04	160 GByte Hard Disk
5ACPCI.RAIC-05	5MMHDD.0250-00	250 GByte Hard Disk
5ACPCI.RAIC-06	5MMHDD.0500-00	500 GByte Hard Disk

Tabelle 327: Übersicht benötigte Ersatz SATA-HDD für PCI SATA HDD RAID Controller

Für den Tausch der Hard Disk wird ein Torx Schraubendreher der Größe 10 benötigt.

11.1 Vorgangsweise

1. Zuleitung zum Gerät spannungslos machen.
2. Elektrostatische Entladung am Gehäuse bzw. am Erdungsanschluss vornehmen.
3. Entfernung des Seitendeckels.
4. Entfernung des SATA RAID Einschubes.
5. Lösen der richtigen 4 Befestigungsschrauben (M3x5).

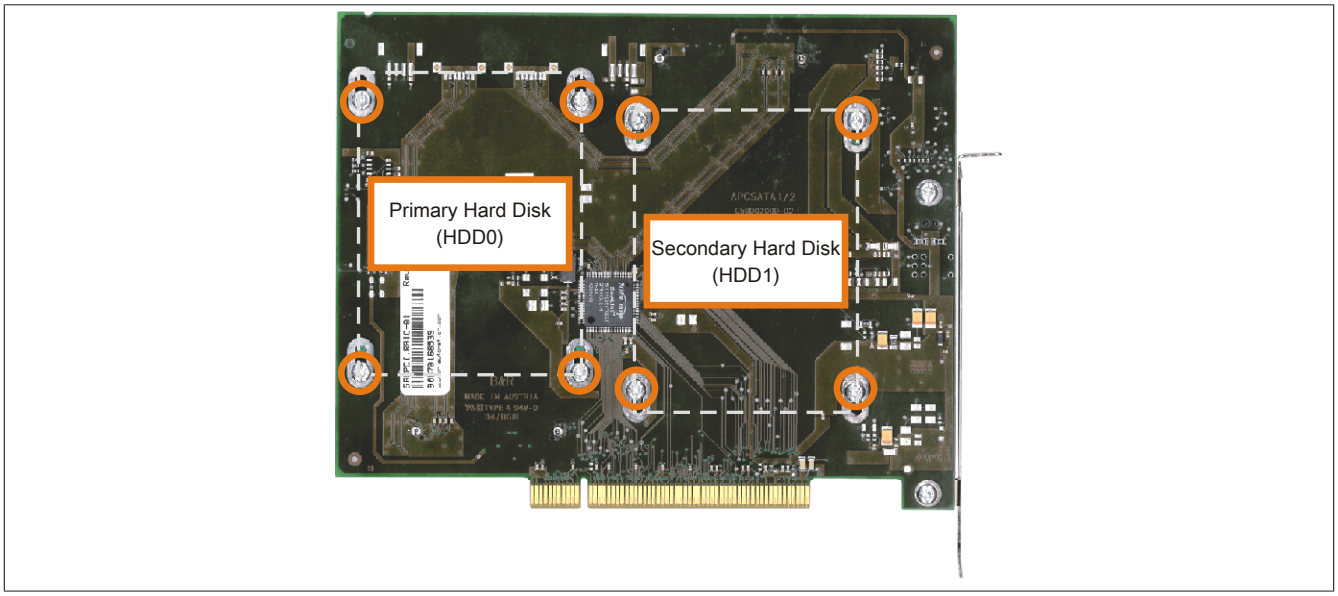


Abbildung 296: Rückseite des SATA RAID Controllers 5ACPCI.RAIC-03 Schraubenzuordnung

6. Vorderseitig die Hard Disk nach unten hin wegschieben (Hard Disk Tausch - linkes Bild).
7. Neue Hard Disk vorsichtig in die Steckverbindung (Hard Disk Tausch - rechtes Bild) aufstecken und dabei die Hard Disk nur an der Stirnseite, nicht an der Oberseite, berühren.

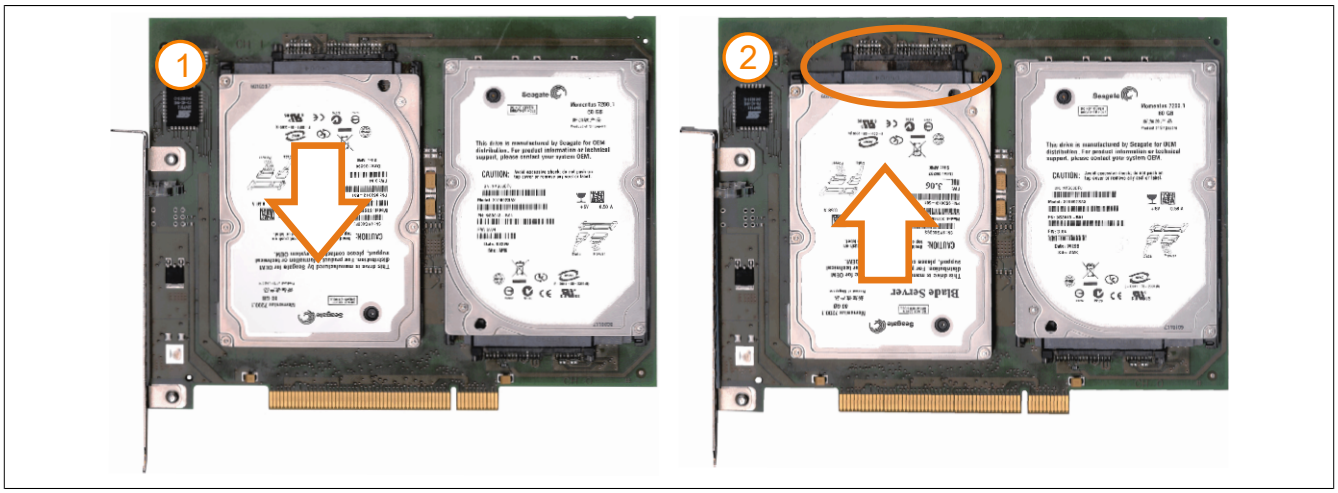


Abbildung 297: Hard Disk Tausch

8. Hard Disk mit den zuvor gelösten 4 Befestigungsschrauben (M3x5) wieder fixieren.
9. Gerät in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.
10. Nach dem Starten des Systems wird eine Fehlermeldung durch das RAID BIOS ausgegeben „RAID1 set is in Rebuild status The rebuild will continue after boot sequence is complete“.
11. Es kann über das SATA RAID BIOS sofort ein Rebuild durchgeführt werden, oder der Rebuild wird nach dem Hochstarten des PCs automatisch durchgeführt - siehe "Rebuild Mirrored Set" auf Seite 237.

12 Montage der HDD Ersatzdiskablage

12.1 Vorgangsweise

1. Seitendeckel entfernen (siehe "Seitendeckeldemontage" auf Seite 441).
2. Die Ersatz HDD in die Ersatzdiskablage einschieben und mit den Schnellverschlussschrauben befestigen.

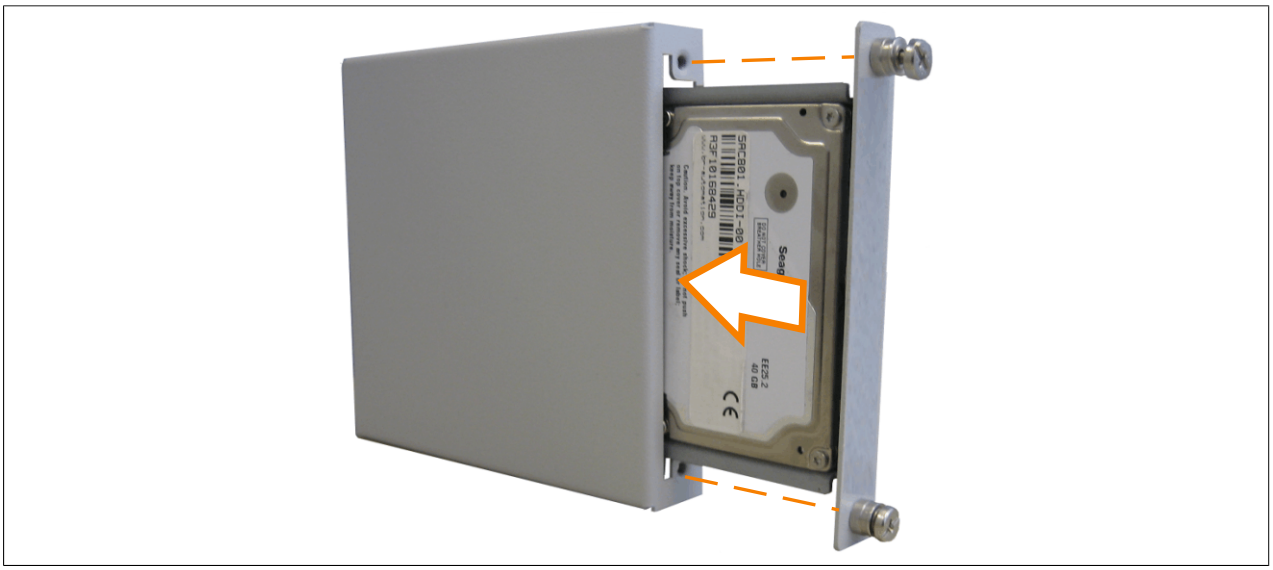


Abbildung 298: Montage der Ersatz Hard Disk an der Ersatzdiskablage

3. Die HDD Ersatzdiskablage mit den dafür vorgesehnen Haken am Gehäuse des APC810 an den Lüftungsschlitzen des Seitendeckels einschieben.
4. Durch leichtes Umbiegen der Haken mit einem geeigneten Werkzeug (z.B. Kombinationszange) innen am Seitendeckel fixieren.

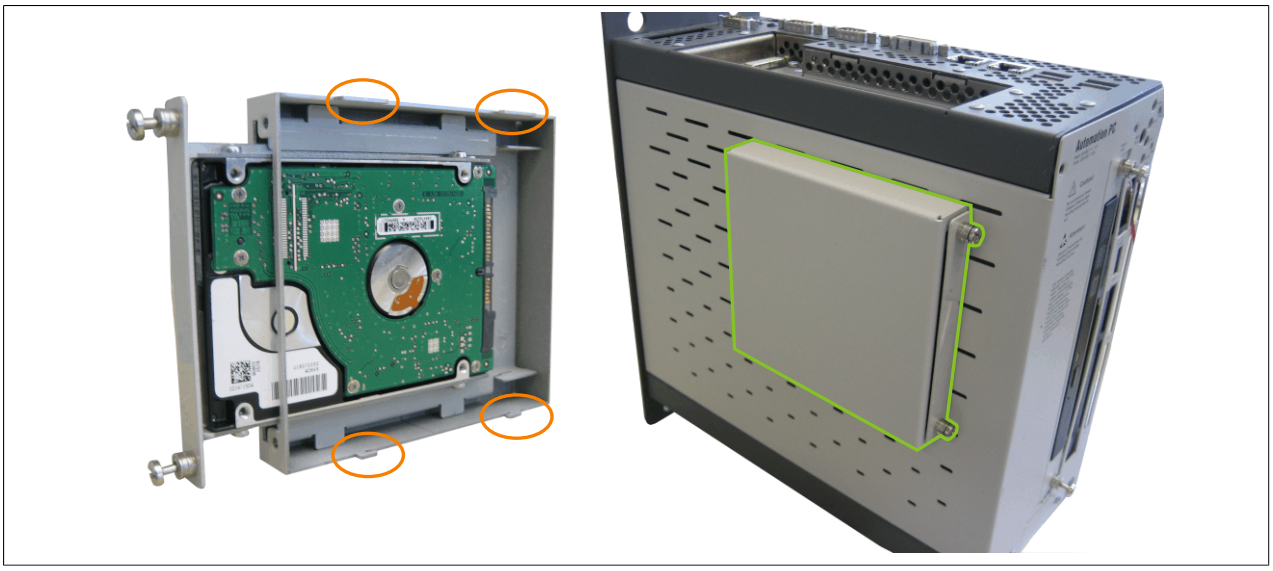


Abbildung 299: Montage der Ersatzdiskablage am APC810

5. Seitendeckel montieren.

13 Montage des Ready Relais /2 am Add-on USV Steckplatz

13.1 Vorgangsweise

1. Seitendeckel entfernen (siehe Abschnitt 9 "Seitendeckeldemontage" auf Seite 441).
2. USV Modulabdeckung oder montierte USV durch lösen der 2 markierten Torxschrauben (T10) entfernen.

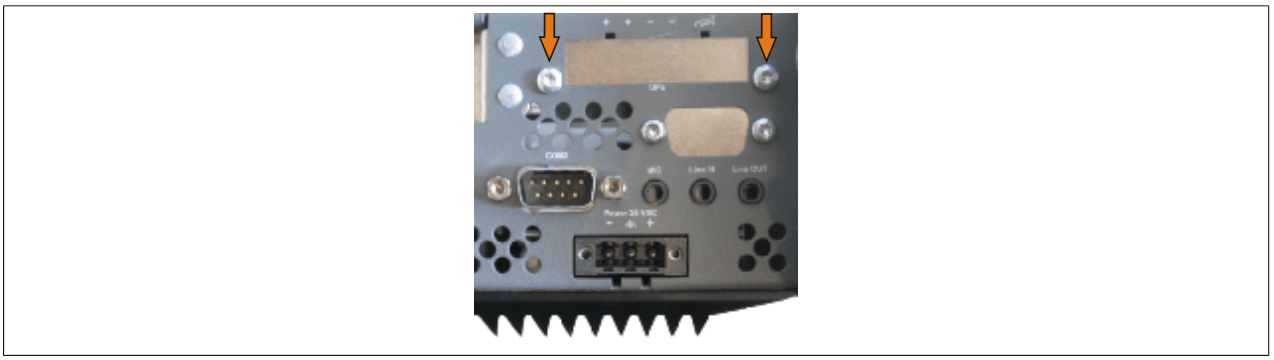


Abbildung 300: USV Modulabdeckung entfernen

3. Distanzbolzen und Distanzring (sofern nicht schon von der USV montiert) am Basisboard anbringen (mittels Innensechskant-Schraubendreher Größe 5). Bei den APC810 Systemeinheiten 5PC810.SX01-00, 5PC810.SX02-00 und 5PC810.SX03-00 ist der Distanzbolzen mit einer Länge von 14 mm zu verwenden, bei der Systemeinheit 5PC810.SX05-00 ist der Distanzbolzen mit einer Länge von 16 mm zu verwenden.

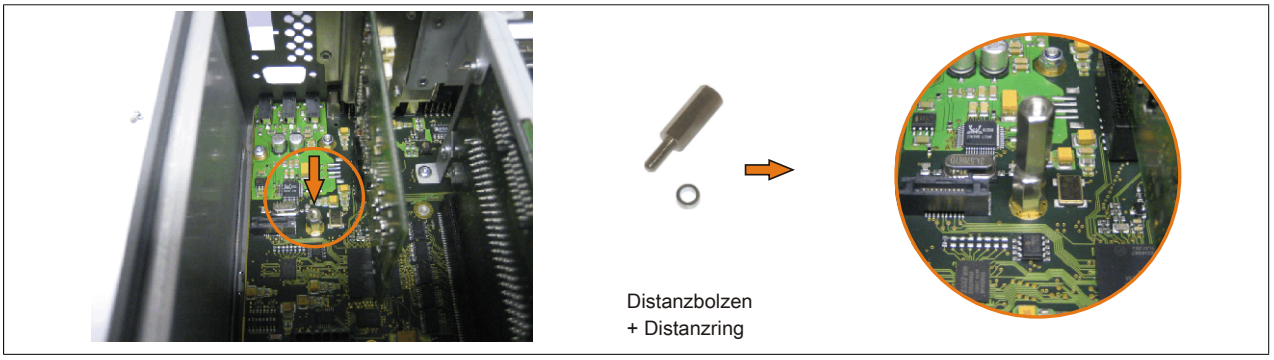


Abbildung 301: Distanzbolzen und Distanzring montieren

4. Ready Relais mit 2 Torxschrauben (T6) und dem Haltewinkel am Gehäuse und 1 Torxschraube (T6) am Basisboard (Distanzbolzen) montieren.

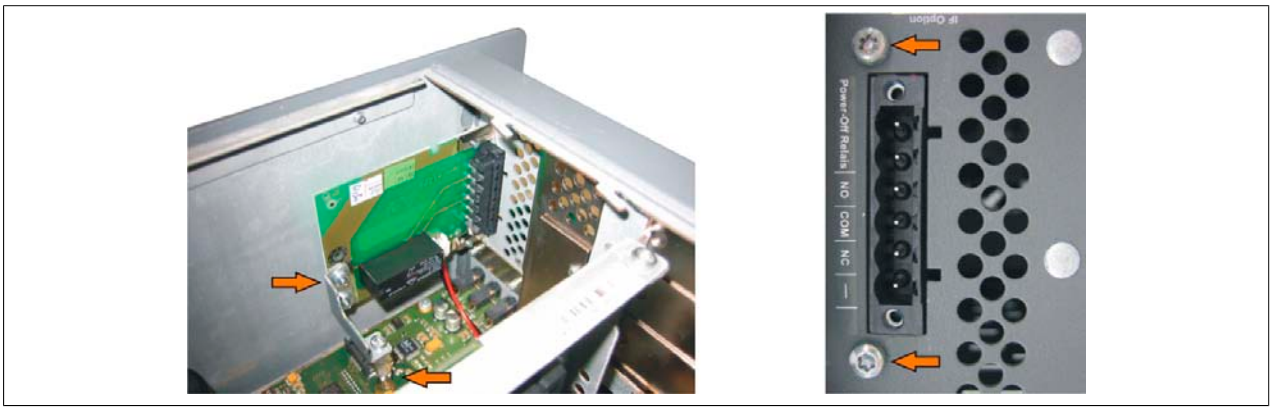


Abbildung 302: Ready Relais montieren

5. Verbindungskabel anstecken

> ## Information:
>
> **Beim Anschluss des internen Spannungsversorgungskabels ist darauf zu achten, dass dabei die Verriegelung der Stecker einrastet.**

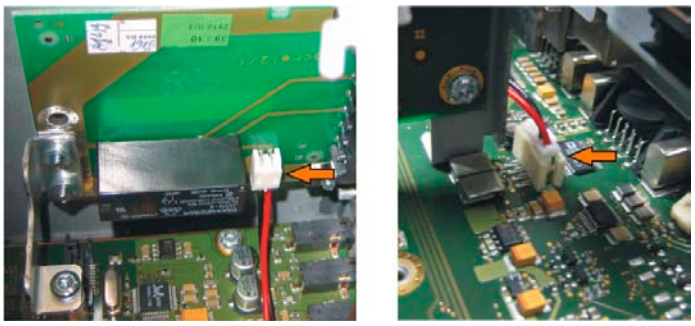


Abbildung 303: Verbindungskabel anstecken

6. Seitendeckel montieren

Anhang A

1 Maintenance Controller Extended (MTCX)

Der MTCX Controller (FPGA-Prozessor) befindet sich auf der Basisboardplatine (Bestandteil jeder Systemeinheit) des APC810 Gerätes.

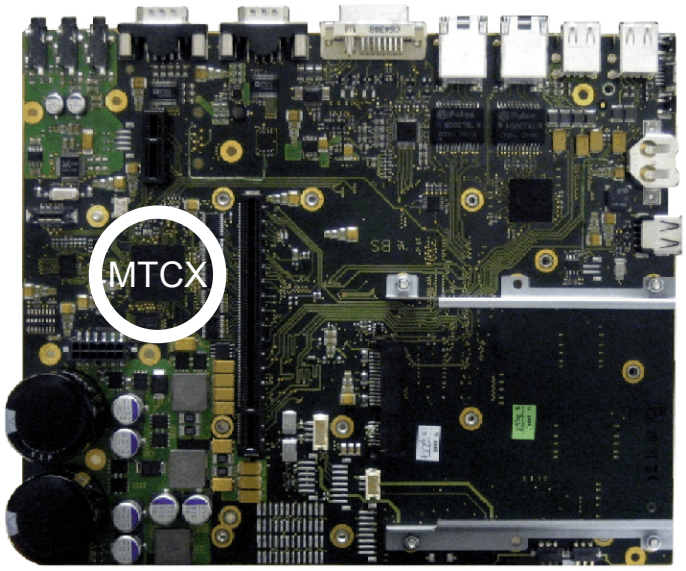


Abbildung 304: Position des MTCX Controllers

Der MTCX ist für folgende Überwachungs- und Steuerfunktionen zuständig:

- Power On (Power OK Sequencing) und Power Fail Logik
- Watch Dog Handling (NMI und Resethandling)
- Temperaturüberwachung (I/O Bereich, Power Supply, Slide-in Laufwerk 1/2)
- Lüfterregelung
- Tasten und LED Behandlung/Koordination (Matrixtastatur von B&R Displayeinheiten)
- Erweiterter Desktop Betrieb (Tasten, USB Weiterleitung)
- Daisy Chain Display Betrieb (Touch Screen, USB Weiterleitung)
- Panel Sperrmechanismus (konfigurierbar über B&R Control Center - ADI Treiber)
- Backlight Steuerung eines angeschlossenen B&R Displays
- Statistikdatenermittlung (Power Cycles - jedes Einschalten, Power On und Lüfterstunden werden ermittelt - jede volle Stunde wird gezählt z.B. 50 Minuten keine Erhöhung)
- SDL Datenübertragung (Display, Matrixtastatur, Touch Screen, Servicedaten, USB)
- Status LEDs (Power, HDD, Link 1, Link 2)

Die Funktionen des MTCX können per Firmwareupgrade[8)] erweitert werden. Die Version kann im BIOS (Menüpunkt Advanced - Baseboard/Panel Features) oder unter freigegebenen Microsoft Windows Betriebssystemen mittels B&R Control Center ausgelesen werden.

1.1 Temperaturüberwachung Lüfterregelung

Der MTCX überwacht mit Hilfe von Temperatursensoren (siehe "Temperatursensorpositionen" auf Seite 39) ständig die Temperatur, in deren Abhängigkeit die Lüfter geregelt werden. Die Drehzahl ist von der gemessenen Temperatur abhängig. Die Grenzwerte können von der verwendeten MTCX Firmware Version abhängig sein.

8) Kann im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen werden.

Sensorbereich	Einschalttemperatur	Max Lüfterdrehzahl bei:
CPU	65°C	81°C
Board CPU	65°C	81°C
Board I/O	60°C	76°C
Board ETH2	60°C	76°C
Board Power	60°C	76°C
Power Supply	60°C	76°C
ETH2 Controller	70°C	86°C
Slide-in 1/2	44°C	60°C

Tabelle 328: Temperaturgrenzen der Lüfterregelung (MTCX PX32 ≥ V0.06)

Ab der Einschalttemperatur wird mit minimaler Lüfterdrehzahl gestartet. Die maximale Lüfterdrehzahl wird bei Einschalttemperatur + 16°C erreicht. In diesem Bereich wird die Lüfterdrehzahl in Abhängigkeit der Temperatur geregelt.

z.B. bei Slide-in 1/2: 44°C + 16°C = 60°C --> maximale Lüfterdrehzahl

Die Lüfter werden erst wieder ausgeschaltet, wenn die Bewertungstemperatur im Zeitraum von 4 Stunden (=Nachlaufzeit) mehr als 6°C unter der Einschalttemperatur liegt.

2 Anschluss eines externen Verbrauchers an das Basisboard

Ein Stecker auf dem Basisboard ermöglicht zur internen Versorgung von z.B. speziellen PCI Karten die Abzweigung von +5 VDC und +12 VDC.

Mit dem "5CAMSC.0001-00" auf Seite 415 kann die Spannung abgegriffen werden. Der Stecker liegt in der Nähe der Buseinheit(en) und kann an dieser mit einem Kabelbinder fixiert werden (siehe Pfeil in Abbildung). Zum Erreichen des Steckers sind der APC810 Seitendeckel (siehe "Seitendeckeldemontage" auf Seite 441) sowie eventuelle Slide-in Laufwerke und PCI Steckkarten zu entfernen.

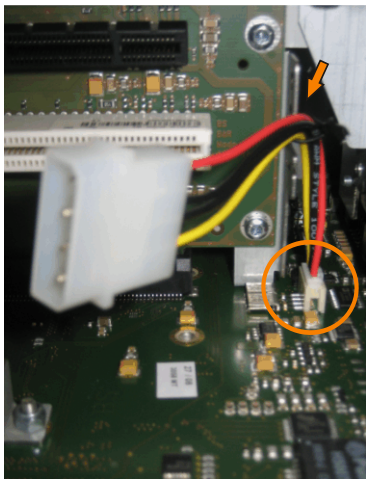


Abbildung 305: Position Stecker für externen Verbraucher

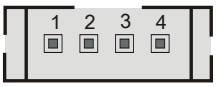
Stecker für den externen Verbraucher			
Pin	Belegung	Leistung	4-polige Stiftleiste, male
1	+12 VDC	max. 10 Watt	
2	GND		
3	GND	max. 5 Watt	
4	+5 VDC		

Tabelle 329: Pinbelegung Stecker am Basisboard

Anschlüsse sind über eine 1A Multifuse abgesichert.

Abbildung 1: Konfiguration - Grundsystem....30
Abbildung 2: Konfiguration - optionale Komponenten....31
Abbildung 3: Temperatursensorpositionen....39
Abbildung 4: Spannungsversorgung für Systemeinheiten....41
Abbildung 5: Serialnummernaufkleber Vorderseite....48
Abbildung 6: Serialnummernaufkleber Rückseite....48
Abbildung 7: Beispiel Serialnummernsuche - A3C70168444....49
Abbildung 8: 5PC810.SX01-00 + 5PC810.BX01-00 Blockschaltbild....50
Abbildung 9: 5PC810.SX01-00 + 5PC810.BX01-01 Blockschaltbild....51
Abbildung 10: 5PC810.SX02-00 + 5PC810.BX02-00 Blockschaltbild....52
Abbildung 11: 5PC810.SX02-00 + 5PC810.BX02-01 Blockschaltbild....53
Abbildung 12: 5PC810.SX03-00 + 5PC810.BX03-00 Blockschaltbild....54
Abbildung 13: 5PC810.SX05-00 + 5PC810.BX05-00 Blockschaltbild....55
Abbildung 14: 5PC810.SX05-00 + 5PC810.BX05-01 Blockschaltbild....56
Abbildung 15: 5PC810.SX05-00 + 5PC810.BX05-02 Blockschaltbild....57
Abbildung 16: Abmessungen Standard half-size 32-Bit PCI-Karte....67
Abbildung 17: Abmessungen Standard half-size PCIe-Karte....67
Abbildung 18: Status LEDs Vorderseite....69
Abbildung 19: 5PC810.SX01-00 - Schnittstellen Oberseite....77
Abbildung 20: 5PC810.SX01-00 - Schnittstellen Vorderseite....78
Abbildung 21: 5PC810.SX01-00 - Abmessungen....81
Abbildung 22: 5PC810.SX01-00 - Bohrschablone....82
Abbildung 23: 5PC810.SX02-00 - Schnittstellen Oberseite....84
Abbildung 24: 5PC810.SX02-00 - Schnittstellen Vorderseite....85
Abbildung 25: 5PC810.SX02-00 - Abmessungen....88
Abbildung 26: 5PC810.SX02-00 - Bohrschablone....89
Abbildung 27: 5PC810.SX03-00 - Schnittstellen Oberseite....91
Abbildung 28: 5PC810.SX03-00 - Schnittstellen Vorderseite....92
Abbildung 29: 5PC810.SX03-00 - Abmessungen....95
Abbildung 30: 5PC810.SX03-00 - Bohrschablone....96
Abbildung 31: 5PC810.SX05-00 - Schnittstellen Oberseite....98
Abbildung 32: 5PC810.SX05-00 - Schnittstellen Vorderseite....99
Abbildung 33: 5PC810.SX05-00 - Abmessungen....101
Abbildung 34: 5PC810.SX05-00 - Bohrschablone....102
Abbildung 35: 1 Slot Buseinheiten....103
Abbildung 36: 2 Slot Buseinheiten....103
Abbildung 37: 3 Slot Buseinheit....103
Abbildung 38: 5 Slot Buseinheiten....104
Abbildung 39: 5AC801.HDDI-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm....113
Abbildung 40: 5AC801.HDDI-01 - Temperatur Luftfeuchtediagramm....115
Abbildung 41: 5AC801.HDDI-02 - Temperatur Luftfeuchtediagramm....117
Abbildung 42: 5AC801.HDDI-03 - Temperatur Luftfeuchtediagramm....119
Abbildung 43: 5AC801.HDDI-04 - Temperatur Luftfeuchtediagramm....121
Abbildung 44: 5AC801.SSDI-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm....124
Abbildung 45: 5AC801.SSDI-00 - ATTO Disk Benchmark v2.34 zyklisches Lesen....125
Abbildung 46: 5AC801.SSDI-00 - ATTO Disk Benchmark v2.34 zyklisches Schreiben....125
Abbildung 47: 5AC801.SSDI-01 - Temperatur Luftfeuchtediagramm....127
Abbildung 48: 5AC801.SSDI-02 - Temperatur Luftfeuchtediagramm....129
Abbildung 49: 5AC801.SSDI-03 ≤ Rev. C0 - Temperatur Luftfeuchtediagramm....131
Abbildung 50: 5AC801.SSDI-03 Rev. D0 - Temperatur Luftfeuchtediagramm....132
Abbildung 51: 5AC801.SSDI-03 ≥ Rev. E0 - Temperatur Luftfeuchtediagramm....132
Abbildung 52: 5AC801.SSDI-04 ≤ Rev. C0 - Temperatur Luftfeuchtediagramm....134
Abbildung 53: 5AC801.SSDI-04 Rev. D0 - Temperatur Luftfeuchtediagramm....135
Abbildung 54: 5AC801.SSDI-04 ≥ Rev. E0 - Temperatur Luftfeuchtediagramm....135
Abbildung 55: 5AC801.SSDI-05 ≤ Rev. C0 - Temperatur Luftfeuchtediagramm....137
Abbildung 56: 5AC801.SSDI-05 ≥ Rev. D0 - Temperatur Luftfeuchtediagramm....138
Abbildung 57: 5MMSSD.0060-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm....140

Abbildung 58: 5MMSSD.0060-01 ≤ Rev. C0 - Temperatur Luftfeuchtediagramm....142
Abbildung 59: 5MMSSD.0060-01 Rev. D0 - Temperatur Luftfeuchtediagramm....143
Abbildung 60: 5MMSSD.0060-01 ≥ Rev. E0 - Temperatur Luftfeuchtediagramm....143
Abbildung 61: 5MMSSD.0128-01 ≤ Rev. C0 - Temperatur Luftfeuchtediagramm....145
Abbildung 62: 5MMSSD.0128-01 Rev. D0 - Temperatur Luftfeuchtediagramm....146
Abbildung 63: 5MMSSD.0128-01 ≥ Rev. E0 - Temperatur Luftfeuchtediagramm....146
Abbildung 64: 5MMSSD.0180-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm....148
Abbildung 65: 5MMSSD.0256-00 ≤ C0 - Temperatur Luftfeuchtediagramm....150
Abbildung 66: 5MMSSD.0256-00 ≥ D0 - Temperatur Luftfeuchtediagramm....151
Abbildung 67: 5AC801.HDDS-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm....154
Abbildung 68: 5AC801.DVDS-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm....156
Abbildung 69: 5AC801.DVRS-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm....159
Abbildung 70: PCI SATA RAID Controller....160
Abbildung 71: 5ACPCI.RAIC-01 - Temperatur Luftfeuchtediagramm....162
Abbildung 72: 5ACPCI.RAIC-02 - Temperatur Luftfeuchtediagramm....164
Abbildung 73: PCI SATA RAID Controller....165
Abbildung 74: 5ACPCI.RAIC-03 - Temperatur Luftfeuchtediagramm....167
Abbildung 75: 5ACPCI.RAIC-04 - Temperatur Luftfeuchtediagramm....169
Abbildung 76: PCI SATA RAID Controller....170
Abbildung 77: 5ACPCI.RAIC-05 - Temperatur Luftfeuchtediagramm....172
Abbildung 78: PCI SATA RAID Controller....173
Abbildung 79: 5ACPCI.RAIC-06 - Temperatur Luftfeuchtediagramm....175
Abbildung 80: 5MMHDD.0250-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm....177
Abbildung 81: 5MMHDD.0500-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm....179
Abbildung 82: 5PC810.FA01-00 - Lüfter Kit....180
Abbildung 83: 5PC810.FA02-00 und 5PC810.FA02-01 - Lüfter Kit....181
Abbildung 84: 5PC810.FA03-00 - Lüfter Kit....182
Abbildung 85: 5PC810.FA05-00 - Lüfter Kit....184
Abbildung 86: 5PC810.SX02-00 - Montagebeispiel mit der Systemeinheit....185
Abbildung 87: Montagebeispiel mit der Systemeinheit 5PC810.SX02-00....188
Abbildung 88: 5AC801.RDYR-01 - Lieferumfang....190
Abbildung 89: Schnittstellenoptionen (IF Option)....191
Abbildung 90: 5AC600.CANI-00 - Abschlusswiderstand Add-on CAN Interface....193
Abbildung 91: 5AC600.CANI-00 - Lieferumfang / Montagematerial....193
Abbildung 92: Add-on RS232/422/485 Interface - Betrieb im RS485 Modus....196
Abbildung 93: 5AC600.485I-00 - Lieferumfang / Montagematerial....196
Abbildung 94: Befestigungslasche....197
Abbildung 95: Einbaulage - senkrecht....198
Abbildung 96: Einbaulage - waagrecht....198
Abbildung 97: Standardmontage - Montageabstände....199
Abbildung 98: Biegeradius Kabelanschluss (Symbolbild)....200
Abbildung 99: Erdungskonzept....201
Abbildung 100: Auswertung mit B&R Control Center anhand eines APC810 2 Slot mit DVD....202
Abbildung 101: Einstellungen für Passmark BurnIn Pro V4 anhand eines APC810 2 Slot mit DVD....203
Abbildung 102: Testübersicht eines APC810 2 Slot mit DVD....203
Abbildung 103: Ein Automation Panel 900 über DVI onboard (Symbolfoto)....207
Abbildung 104: Ein Automation Panel 900 über SDL onboard (Symbolfoto)....209
Abbildung 105: Ein Automation Panel 800 über SDL onboard (Symbolfoto)....211
Abbildung 106: Ein AP900 und ein AP800 über SDL onboard (Symbolfoto)....213
Abbildung 107: Vier Automation Panel 900 über SDL onboard (Symbolfoto)....215
Abbildung 108: Ein Automation Panel 900 über SDL AP Link (Symbolfoto)....218
Abbildung 109: Vier Automation Panel 900 über SDL AP Link (Symbolfoto)....220
Abbildung 110: Zwei Automation Panel 900 über SDL onboard und SDL AP Link (Symbolfoto)....223
Abbildung 111: Acht Automation Panel 900 über SDL onboard und SDL AP Link (Symbolfoto)....226
Abbildung 112: Sechs AP900 und zwei AP800 über SDL onboard und SDL AP Link (Symbolfoto)....229
Abbildung 113: Anschluss von USB Peripheriegeräten lokal am APC810....232
Abbildung 114: Anschluss von USB Peripheriegeräten remote am AP900 über DVI....233

Abbildung 115: Anschluss von USB Peripheriegeräten remote am AP800/900 über SDL ... 233
Abbildung 116: Einstieg in das RAID Configuration Utility ... 234
Abbildung 117: RAID Configuration Utility - Menü ... 234
Abbildung 118: RAID Configuration Utility - Menü ... 235
Abbildung 119: RAID Configuration Utility - Create RAID set - Striped ... 235
Abbildung 120: RAID Configuration Utility - Create RAID set - Mirrored ... 236
Abbildung 121: RAID Configuration Utility - Delete RAID set ... 236
Abbildung 122: RAID Configuration Utility - Rebuild Mirrored set ... 237
Abbildung 123: RAID Configuration Utility - Resolve Conflicts ... 237
Abbildung 124: RAID Configuration Utility - Low Level Format ... 238
Abbildung 125: Boot Screen ... 242
Abbildung 126: 945GME BIOS Main Menü ... 244
Abbildung 127: 945GME Advanced Menü ... 245
Abbildung 128: 945GME Advanced ACPI Configuration ... 246
Abbildung 129: 945GME Advanced PCI Configuration ... 247
Abbildung 130: 945GME Advanced PCI IRQ Resource Exclusion ... 248
Abbildung 131: 945GME Advanced PCI Interrupt Routing ... 249
Abbildung 132: 945GME Advanced PCI Express Configuration ... 250
Abbildung 133: 945GME Advanced Graphics Configuration ... 252
Abbildung 134: 945GME Advanced CPU Configuration ... 254
Abbildung 135: 945GME Advanced Chipset Configuration ... 255
Abbildung 136: 945GME Advanced I/O Interface Configuration ... 256
Abbildung 137: 945GME Advanced Clock Configuration ... 257
Abbildung 138: 945GME Advanced IDE Configuration ... 257
Abbildung 139: 945GME Primary IDE Master ... 259
Abbildung 140: 945GME Primary IDE Slave ... 260
Abbildung 141: 945GME Secondary IDE Master ... 261
Abbildung 142: 945GME Secondary IDE Slave ... 262
Abbildung 143: 945GME Advanced USB Configuration ... 263
Abbildung 144: 945GME Advanced Keyboard/Mouse Configuration ... 264
Abbildung 145: 945GME Advanced Remote Access Configuration ... 265
Abbildung 146: 945GME Advanced CPU Board Monitor ... 267
Abbildung 147: 945GME Advanced Baseboard/Panel Features ... 268
Abbildung 148: 945GME Panel Control ... 269
Abbildung 149: 945GME Baseboard Monitor ... 270
Abbildung 150: 945GME Legacy Devices ... 271
Abbildung 151: 945GME Boot Menü ... 272
Abbildung 152: 945GME Security Menü ... 274
Abbildung 153: 945GME Hard Disk Security User Password ... 275
Abbildung 154: 945GME Hard Disk Security Master Password ... 275
Abbildung 155: 945GME Power Menü ... 276
Abbildung 156: 945GME Exit Menü ... 277
Abbildung 157: PCI und PCIe Routing mit aktiviertem APIC CPU Board 945GME (COM Express) für BIOS Version ≤ 1.12 ... 287
Abbildung 158: PCI und PCIe Routing mit aktiviertem APIC CPU Board 945GME (COM Express) für BIOS Version ≥ 1.14 (Buseinheiten 5PC810.BX0x-0x) ... 288
Abbildung 159: PCI und PCIe Routing mit aktiviertem APIC CPU Boards 945GME (COM Express) für BIOS Version ≥ 1.14 (Buseinheit 5PC810.BX05-02) ... 289
Abbildung 160: Softwareversion ... 290
Abbildung 161: Firmwareversion des AP Link SDL Transmitter ... 291
Abbildung 162: Bootdiskette erstellen unter Windows XP Schritt 1 ... 296
Abbildung 163: Bootdiskette erstellen unter Windows XP Schritt 2 ... 296
Abbildung 164: Bootdiskette erstellen unter Windows XP Schritt 3 ... 296
Abbildung 165: Bootdiskette erstellen unter Windows XP Schritt 4 ... 297
Abbildung 166: Bootdiskette erstellen unter Windows XP Schritt 5 ... 297
Abbildung 167: Erstellung eines USB Memory Sticks für B&R Upgrade Files ... 298
Abbildung 168: Erstellung einer CompactFlash Karte für B&R Upgrade Files ... 299
Abbildung 169: ADI Control Center Screenshots - Beispiele (Symbolfoto) ... 319

Abbildung 170: ADI Control Center - SDL Equalizer Einstellung....321
Abbildung 171: ADI Control Center - USV Einstellungen....322
Abbildung 172: ADI Control Center - USV Monitor....323
Abbildung 173: ADI Control Center - USV Batterieeinstellungen....324
Abbildung 174: ADI Control Center - USV Einstellungen....325
Abbildung 175: ADI Control Center - Erweiterte USV Einstellungen....327
Abbildung 176: ADI Development Kit Screenshots (Version 3.70)....329
Abbildung 177: ADI .NET SDK Screenshots (Version 2.10)....331
Abbildung 178: B&R Key Editor Screenshots Version 3.60 (Symbolfoto)....333
Abbildung 179: B&R KCF Editor Screenshot Version 1.0 (Symbolfoto)....335
Abbildung 180: GL Zertifikat Nr. 11 858 – 10 HH....342
Abbildung 181: 5CFCRD.xxxx-06 - Temperatur Luftfeuchtediagramm CompactFlash-Karten....354
Abbildung 182: Abmessungen CompactFlash-Karte Typ I....355
Abbildung 183: ATTO Disk Benchmark v2.34 Vergleich Lesen - 5CFCRD.xxxx-04 mit 5CFCRD.xxxx-06...356
Abbildung 184: ATTO Disk Benchmark v2.34 Vergleich Schreiben - 5CFCRD.xxxx-04 mit 5CFCRD.xxxx-06....356
Abbildung 185: 5CFCRD.xxxx-04 - Temperatur Luftfeuchtediagramm CompactFlash-Karten....359
Abbildung 186: Abmessungen CompactFlash-Karte Typ I....359
Abbildung 187: ATTO Disk Benchmark v2.34 Vergleich Lesen - 5CFCRD.xxxx-03 mit 5CFCRD.xxxx-04...360
Abbildung 188: ATTO Disk Benchmark v2.34 Vergleich Schreiben - 5CFCRD.xxxx-03 mit 5CFCRD.xxxx-04....360
Abbildung 189: 5CFCRD.xxxx-03 - Temperatur Luftfeuchtediagramm CompactFlash-Karten....363
Abbildung 190: Abmessungen CompactFlash-Karte Typ I....363
Abbildung 191: 5MD900.USB2-01 - Schnittstellen....365
Abbildung 192: 5MD900.USB2-01 - Abmessungen....367
Abbildung 193: Abmessungen USB Media Drive mit Frontklappe....368
Abbildung 194: Einbauausschnitt USB Media Drive mit Frontklappe....368
Abbildung 195: 5MD900.USB2-01 - Einbaulage....369
Abbildung 196: 5MD900.USB2-02 - Schnittstellen....370
Abbildung 197: 5MD900.USB2-02 - Abmessungen....372
Abbildung 198: Abmessungen USB Media Drive mit Frontklappe....372
Abbildung 199: Einbauausschnitt USB Media Drive mit Frontklappe....373
Abbildung 200: 5MD900.USB2-02 - Einbaulage....373
Abbildung 201: 5A5003.03 - Abmessungen....374
Abbildung 202: Frontklappenmontage und Klemmdicke....375
Abbildung 203: Einbauausschnitt USB Media Drive mit Frontklappe....375
Abbildung 204: 5MMUSB.2048-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm....377
Abbildung 205: 5MMUSB.xxxx-01 - Temperatur Luftfeuchtediagramm....379
Abbildung 206: USV Prinzip....380
Abbildung 207: 5AC600.UPSI-00 Add-on USV Modul Montagematerial....382
Abbildung 208: Tiefentladezyklen....384
Abbildung 209: 5PC600.UPSB-00 - Abmessungen....385
Abbildung 210: 5PC600.UPSB-00 - Bohrschablone....385
Abbildung 211: 5AC804.MFLT-00 - Abmessungen....389
Abbildung 212: 5AC804.MFLT-00 - Bohrschablone....389
Abbildung 213: Schematisches Anschlussbeispiel....389
Abbildung 214: 5ACPCI.ETH1-01 - PCI Ethernet Card 10/100....390
Abbildung 215: 5ACPCI.ETH1-01 - Abmessungen....392
Abbildung 216: 5ACPCI.ETH3-01 - PCI Ethernet Card 10/100....393
Abbildung 217: 5ACPCI.ETH3-01 - Abmessungen....395
Abbildung 218: Biegeradiusspezifikation....397
Abbildung 219: 5CADVI.0xxx-00 - Abmessungen....397
Abbildung 220: 5CADVI.0xxx-00 - Belegung....398
Abbildung 221: Biegeradiusspezifikation....400
Abbildung 222: 5CASDL.0xxx-00 - Abmessungen....400
Abbildung 223: 5CASDL.0xxx-00 - Belegung....401
Abbildung 224: Biegeradiusspezifikation....403

Abbildung 225: 5CASDL.0xxx-01 - Abmessungen....403
Abbildung 226: 5CASDL.0xxx-01 - Belegung....404
Abbildung 227: Biegeradiusspezifikation....406
Abbildung 228: 5CASDL.0xxx-03 - Abmessungen....406
Abbildung 229: 5CASDL.0xxx-03 - Belegung....407
Abbildung 230: Biegeradiusspezifikation mit Extender....409
Abbildung 231: 5CASDL.0xx0-13 - Abmessungen....409
Abbildung 232: 5CASDL.0xx0-13 - Belegung....410
Abbildung 233: Beispiel für die Signalrichtung für das SDL Kabel flex mit Extender....411
Abbildung 234: 5CAUSB.00xx-00 - Belegung USB Kabel....412
Abbildung 235: 9A0014.xx - Belegung RS232 Kabel....414
Abbildung 236: HDD Ersatzdiskablage - 5AC801.FRAM-00....416
Abbildung 237: 5AC801.FRAM-00 - Abmessungen....417
Abbildung 238: Batterie entfernen....419
Abbildung 239: Batteriehandhabung....419
Abbildung 240: Batteriepolarität....419
Abbildung 241: CompactFlash + Auswerfer (Symbolfoto)....420
Abbildung 242: Schnellverschlussschrauben lösen....421
Abbildung 243: Compact SATA Laufwerk einschieben....421
Abbildung 244: Schnellverschlussschrauben lösen....422
Abbildung 245: Slide-in Laufwerkseinbau....422
Abbildung 246: Schnellverschlussschrauben lösen....423
Abbildung 247: Slide-in compact Adapter Einbau....423
Abbildung 248: Slide-in compact Laufwerk montieren....424
Abbildung 249: Lüfter Kit Einschub entfernen....425
Abbildung 250: Lüfter Kit einlegen und befestigen....425
Abbildung 251: Staubfilter mit Filterspange fixieren....426
Abbildung 252: 5AC600.UPSI-00 Add-on USV Modul Montagematerial....427
Abbildung 253: USV Modulabdeckung entfernen....427
Abbildung 254: Distanzbolzen und Distanzring montieren....427
Abbildung 255: USV Modul montieren....428
Abbildung 256: Verbindungskabel anstecken....428
Abbildung 257: Steckerverriegelung....428
Abbildung 258: USV Modulabdeckung entfernen....429
Abbildung 259: Distanzbolzen und Distanzring montieren....429
Abbildung 260: Haltewinkel montieren....429
Abbildung 261: USV Modul montieren....430
Abbildung 262: Verbindungskabel anstecken....430
Abbildung 263: Steckerverriegelung....430
Abbildung 264: USV Modulabdeckung entfernen....431
Abbildung 265: Distanzbolzen und Distanzrig montieren....431
Abbildung 266: Haltewinkel montieren....431
Abbildung 267: USV Modul montieren....432
Abbildung 268: Verbindungskabel anstecken....432
Abbildung 269: Steckerverriegelung....432
Abbildung 270: USV Modulabdeckung entfernen....433
Abbildung 271: Distanzbolzen montieren....433
Abbildung 272: USV Modul montieren....433
Abbildung 273: Verbindungskabel anstecken....434
Abbildung 274: Steckerverriegelung....434
Abbildung 275: USV Modulabdeckung entfernen....435
Abbildung 276: Distanzbolzen montieren....435
Abbildung 277: Haltewinkel montieren....435
Abbildung 278: USV Modul montieren....436
Abbildung 279: Verbindungskabel anstecken....436
Abbildung 280: Steckerverriegelung....436
Abbildung 281: USV Modulabdeckung entfernen....437

Abbildung 282: Distanzbolzen montieren ... 437
Abbildung 283: Haltewinkel montieren ... 437
Abbildung 284: USV Modul montieren ... 437
Abbildung 285: Verbindungskabel anstecken ... 438
Abbildung 286: Steckerverriegelung ... 438
Abbildung 287: Abdeckung der Batterieeinheit entfernen ... 439
Abbildung 288: Kabel abstecken ... 439
Abbildung 289: Sicherung anschließen ... 440
Abbildung 290: Sicherung verstauen ... 440
Abbildung 291: APC810 1 Card Slot Seitendeckeldemontage ... 441
Abbildung 292: APC810 2 Card Slot Seitendeckeldemontage ... 441
Abbildung 293: APC810 5 Card Slot Seitendeckeldemontage ... 442
Abbildung 294: AP Link Modulabdeckung entfernen ... 443
Abbildung 295: AP Link Modul montieren ... 443
Abbildung 296: Rückseite des SATA RAID Controllers 5ACPCI.RAIC-03 Schraubenzuordnung ... 444
Abbildung 297: Hard Disk Tausch ... 445
Abbildung 298: Montage der Ersatz Hard Disk an der Ersatzdiskablage ... 446
Abbildung 299: Montage der Ersatzdiskablage am APC810 ... 446
Abbildung 300: USV Modulabdeckung entfernen ... 447
Abbildung 301: Distanzbolzen und Distanzring montieren ... 447
Abbildung 302: Ready Relais montieren ... 447
Abbildung 303: Verbindungskabel anstecken ... 448
Abbildung 304: Position des MTCX Controllers ... 449
Abbildung 305: Position Stecker für externen Verbraucher ... 451

Tabelle 1: Handbuchhistorie....14
Tabelle 2: Umweltgerechte Werkstofftrennung....22
Tabelle 3: Beschreibung der verwendeten Sicherheitshinweise....23
Tabelle 4: Nennmaßbereiche....23
Tabelle 5: Umgebungstemperatur ohne Lüfter....33
Tabelle 6: Umgebungstemperatur ohne Lüfter....34
Tabelle 7: Umgebungstemperatur ohne Lüfter....35
Tabelle 8: Umgebungstemperatur mit Lüfter....36
Tabelle 9: Umgebungstemperatur mit Lüfter....37
Tabelle 10: Temperatursensorpositionen....39
Tabelle 11: Übersicht Luftfeuchtigkeitsangaben der Einzelkomponenten....40
Tabelle 12: Leistungskalkulation APC 1 Slot....42
Tabelle 13: Leistungskalkulation APC 1 Slot....43
Tabelle 14: Leistungskalkulation APC 2 Slot....44
Tabelle 15: Leistungskalkulation APC 2 Slot....45
Tabelle 16: Leistungskalkulation APC 3 Slot....46
Tabelle 17: Leistungskalkulation APC 5 Slot....47
Tabelle 18: Spannungsversorgungsanschluss Power 24 VDC....58
Tabelle 19: Pinbelegung COM1....59
Tabelle 20: Pinbelegung COM2....59
Tabelle 21: Monitor / Panel Anschluss - RGB, DVI, SDL....60
Tabelle 22: Pinbelegung DVI-Schnittstelle....60
Tabelle 23: Kabellängen und Auflösungen bei SDL-Übertragung....61
Tabelle 24: Kabellängen und Auflösungen bei DVI-Übertragung....61
Tabelle 25: Ethernet Anschluss (ETH1)....62
Tabelle 26: Ethernet Anschluss (ETH2)....63
Tabelle 27: USB1, USB2, USB3, USB4 Anschluss....64
Tabelle 28: USB5 Anschluss....64
Tabelle 29: MIC, Line IN, Line OUT....65
Tabelle 30: Add-on Schnittstellensteckplatz....65
Tabelle 31: Add-on USV Steckplatz (ohne und mit montierter USV)....66
Tabelle 32: Übersicht 64-Bit Karten....67
Tabelle 33: Daten Status LEDs....69
Tabelle 34: CMOS Profile Schalter....69
Tabelle 35: Power Taster....70
Tabelle 36: Reset Taster....70
Tabelle 37: Batterie....71
Tabelle 38: Bedeutung Batteriestatus....71
Tabelle 39: Hardware Security Key....72
Tabelle 40: CompactFlash Slot (CF1)....73
Tabelle 41: CompactFlash Slot (CF2)....73
Tabelle 42: Slide-in Slot 1....74
Tabelle 43: Slide-in Slot 2....74
Tabelle 44: Slide-in compact Slot....75
Tabelle 45: 5PC810.SX01-00 - Bestelldaten....76
Tabelle 46: 5PC810.SX01-00 - Technische Daten....78
Tabelle 47: 5PC810.SX02-00 - Bestelldaten....83
Tabelle 48: 5PC810.SX02-00 - Technische Daten....85
Tabelle 49: 5PC810.SX03-00 - Bestelldaten....90
Tabelle 50: 5PC810.SX03-00 - Technische Daten....92
Tabelle 51: 5PC810.SX05-00 - Bestelldaten....97
Tabelle 52: 5PC810.SX05-00 - Technische Daten....99
Tabelle 53: 5PC810.BX01-00, 5PC810.BX01-01, 5PC810.BX02-00, 5PC810.BX02-01, 5PC810.BX03-00, 5PC810.BX05-00, 5PC810.BX05-01, 5PC810.BX05-02 - Bestelldaten....104
Tabelle 54: 5PC810.BX01-00, 5PC810.BX01-01, 5PC810.BX02-00, 5PC810.BX02-01, 5PC810.BX03-00, 5PC810.BX05-00, 5PC810.BX05-01, 5PC810.BX05-02 - Technische Daten....104
Tabelle 55: 5PC800.B945-00, 5PC800.B945-01, 5PC800.B945-02, 5PC800.B945-03, 5PC800.B945-04, 5PC800.B945-05 - Bestelldaten....106

Tabelle 56: 5PC800.B945-10, 5PC800.B945-11, 5PC800.B945-12, 5PC800.B945-13, 5PC800.B945-14 - Bestelldaten ... 106
Tabelle 57: 5PC800.B945-00, 5PC800.B945-01, 5PC800.B945-02, 5PC800.B945-03, 5PC800.B945-04, 5PC800.B945-05 - Technische Daten ... 107
Tabelle 58: 5PC800.B945-10, 5PC800.B945-11, 5PC800.B945-12, 5PC800.B945-13, 5PC800.B945-14 - Technische Daten ... 107
Tabelle 59: 5AC801.HS00-00, 5AC801.HS00-01, 5AC801.HS00-02 - Bestelldaten ... 109
Tabelle 60: 5AC801.HS00-00, 5AC801.HS00-01, 5AC801.HS00-02 - Technical data ... 109
Tabelle 61: 5MMDDR.0512-01, 5MMDDR.1024-01, 5MMDDR.2048-01 - Bestelldaten ... 111
Tabelle 62: 5MMDDR.0512-01, 5MMDDR.1024-01, 5MMDDR.2048-01 - Technische Daten ... 111
Tabelle 63: 5AC801.HDDI-00 - Bestelldaten ... 112
Tabelle 64: 5AC801.HDDI-00 - Technische Daten ... 112
Tabelle 65: 5AC801.HDDI-01 - Bestelldaten ... 114
Tabelle 66: 5AC801.HDDI-01 - Technische Daten ... 114
Tabelle 67: 5AC801.HDDI-02 - Bestelldaten ... 116
Tabelle 68: 5AC801.HDDI-02 - Technische Daten ... 116
Tabelle 69: 5AC801.HDDI-03 - Bestelldaten ... 118
Tabelle 70: 5AC801.HDDI-03 - Technische Daten ... 118
Tabelle 71: 5AC801.HDDI-04 - Bestelldaten ... 120
Tabelle 72: 5AC801.HDDI-04 - Technische Daten ... 120
Tabelle 73: 5AC801.SSDI-00 - Bestelldaten ... 122
Tabelle 74: 5AC801.SSDI-00 - Technische Daten ... 122
Tabelle 75: 5AC801.SSDI-01 - Bestelldaten ... 126
Tabelle 76: 5AC801.SSDI-01 - Technische Daten ... 126
Tabelle 77: 5AC801.SSDI-02 - Bestelldaten ... 128
Tabelle 78: 5AC801.SSDI-02 - Technische Daten ... 128
Tabelle 79: 5AC801.SSDI-03 - Bestelldaten ... 130
Tabelle 80: 5AC801.SSDI-03, 5AC801.SSDI-03, 5AC801.SSDI-03 - Technische Daten ... 130
Tabelle 81: 5AC801.SSDI-04 - Bestelldaten ... 133
Tabelle 82: 5AC801.SSDI-04, 5AC801.SSDI-04, 5AC801.SSDI-04 - Technische Daten ... 133
Tabelle 83: 5AC801.SSDI-05 - Bestelldaten ... 136
Tabelle 84: 5AC801.SSDI-05, 5AC801.SSDI-05 - Technische Daten ... 136
Tabelle 85: 5MMSSD.0060-00 - Bestelldaten ... 139
Tabelle 86: 5MMSSD.0060-00 - Technische Daten ... 139
Tabelle 87: 5MMSSD.0060-01 - Bestelldaten ... 141
Tabelle 88: 5MMSSD.0060-01, 5MMSSD.0060-01, 5MMSSD.0060-01 - Technische Daten ... 141
Tabelle 89: 5MMSSD.0128-01 - Bestelldaten ... 144
Tabelle 90: 5MMSSD.0128-01, 5MMSSD.0128-01, 5MMSSD.0128-01 - Technische Daten ... 144
Tabelle 91: 5MMSSD.0180-00 - Bestelldaten ... 147
Tabelle 92: 5MMSSD.0180-00 - Technische Daten ... 147
Tabelle 93: 5MMSSD.0256-00 - Bestelldaten ... 149
Tabelle 94: 5MMSSD.0256-00, 5MMSSD.0256-00 - Technische Daten ... 149
Tabelle 95: 5AC801.ADAS-00 - Bestelldaten ... 152
Tabelle 96: 5AC801.ADAS-00 - Technische Daten ... 152
Tabelle 97: 5AC801.HDDS-00 - Bestelldaten ... 153
Tabelle 98: 5AC801.HDDS-00 - Technische Daten ... 153
Tabelle 99: 5AC801.DVDS-00 - Bestelldaten ... 155
Tabelle 100: 5AC801.DVDS-00 - Technische Daten ... 155
Tabelle 101: 5AC801.DVRS-00 - Bestelldaten ... 157
Tabelle 102: 5AC801.DVRS-00 - Technische Daten ... 157
Tabelle 103: 5ACPCI.RAIC-01 - Bestelldaten ... 160
Tabelle 104: 5ACPCI.RAIC-01 - Technische Daten ... 161
Tabelle 105: 5ACPCI.RAIC-02 - Bestelldaten ... 163
Tabelle 106: 5ACPCI.RAIC-02 - Technische Daten ... 163
Tabelle 107: 5ACPCI.RAIC-03 - Bestelldaten ... 165
Tabelle 108: 5ACPCI.RAIC-03 - Technische Daten ... 166
Tabelle 109: 5ACPCI.RAIC-04 - Bestelldaten ... 168
Tabelle 110: 5ACPCI.RAIC-04 - Technische Daten ... 168

Tabelle 111: 5ACPCI.RAIC-05 - Bestelldaten ... 170
Tabelle 112: 5ACPCI.RAIC-05 - Technische Daten ... 171
Tabelle 113: 5ACPCI.RAIC-06 - Bestelldaten ... 173
Tabelle 114: 5ACPCI.RAIC-06 - Technische Daten ... 174
Tabelle 115: 5MMHDD.0250-00 - Bestelldaten ... 176
Tabelle 116: 5MMHDD.0250-00 - Technische Daten ... 176
Tabelle 117: 5MMHDD.0500-00 - Bestelldaten ... 178
Tabelle 118: 5MMHDD.0500-00 - Technische Daten ... 178
Tabelle 119: 5PC810.FA01-00 - Bestelldaten ... 180
Tabelle 120: 5PC810.FA01-00 - Technische Daten ... 180
Tabelle 121: 5PC810.FA02-00, 5PC810.FA02-01 - Bestelldaten ... 181
Tabelle 122: 5PC810.FA02-00, 5PC810.FA02-01 - Technische Daten ... 182
Tabelle 123: 5PC810.FA03-00 - Bestelldaten ... 183
Tabelle 124: 5PC810.FA03-00 - Technische Daten ... 183
Tabelle 125: 5PC810.FA05-00 - Bestelldaten ... 184
Tabelle 126: 5PC810.FA05-00 - Technische Daten ... 184
Tabelle 127: 5AC801.SDL0-00 - Bestelldaten ... 185
Tabelle 128: 5AC801.SDL0-00 - Technische Daten ... 185
Tabelle 129: Pinbelegung DVI-Schnittstelle ... 186
Tabelle 130: Kabellängen und Auflösungen bei SDL-Übertragung ... 186
Tabelle 131: Kabellängen und Auflösungen bei DVI-Übertragung ... 187
Tabelle 132: 5AC801.RDYR-00 - Bestelldaten ... 188
Tabelle 133: 5AC801.RDYR-00 - Pinbelegung Ready Relais ... 188
Tabelle 134: 5AC801.RDYR-01 - Bestelldaten ... 189
Tabelle 135: 5AC801.RDYR-01 - Pinbelegung ... 189
Tabelle 136: 5AC600.CANI-00 - Bestelldaten ... 191
Tabelle 137: 5AC600.CANI-00 - Technische Daten ... 191
Tabelle 138: Pinbelegung CAN ... 192
Tabelle 139: Add-on CAN - I/O Adresse und IRQ ... 192
Tabelle 140: CAN Buslänge und Übertragungsrate ... 192
Tabelle 141: CAN Kabel Anforderungen ... 192
Tabelle 142: 5AC600.485I-00 - Bestelldaten ... 194
Tabelle 143: 5AC600.485I-00 - Technische Daten ... 194
Tabelle 144: Pinbelegung RS232/RS422 ... 194
Tabelle 145: Add-on RS232/422/485 - I/O Adresse und IRQ ... 194
Tabelle 146: RS232 Buslänge und Übertragungsrate ... 195
Tabelle 147: RS232 Kabel Anforderungen ... 195
Tabelle 148: RS422 Buslänge und Übertragungsraten ... 195
Tabelle 149: RS422 Kabel Anforderungen ... 195
Tabelle 150: RS485 Buslänge und Übertragungsraten ... 196
Tabelle 151: RS422 Kabel Anforderungen ... 196
Tabelle 152: Auswertungsbeispiel anhand eines APC810 2 Slot ... 205
Tabelle 153: Auswahl der Displayeinheiten ... 206
Tabelle 154: Mögliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board ... 207
Tabelle 155: Linkbaugruppen ... 207
Tabelle 156: Kabel für DVI Konfigurationen ... 208
Tabelle 157: Mögliche Automation Panel Geräte, Auflösungen und Segmentlängen ... 208
Tabelle 158: Mögliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board ... 209
Tabelle 159: Linkbaugruppen ... 209
Tabelle 160: Kabel für SDL Konfigurationen ... 209
Tabelle 161: Kabellängen und Auflösungen bei SDL-Übertragung ... 210
Tabelle 162: Mögliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board ... 211
Tabelle 163: Kabel für SDL Konfigurationen ... 211
Tabelle 164: Kabellängen und Auflösungen bei SDL-Übertragung ... 212
Tabelle 165: Mögliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board ... 213
Tabelle 166: Linkbaugruppen ... 213
Tabelle 167: Mögliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board ... 215

Tabelle 168: Linkbaugruppen....215
Tabelle 169: Kabel für SDL Konfigurationen....216
Tabelle 170: Kabellängen und Auflösungen bei SDL-Übertragung....217
Tabelle 171: Mögliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board....218
Tabelle 172: Linkbaugruppen....218
Tabelle 173: Kabel für SDL Konfigurationen....218
Tabelle 174: Kabellängen und Auflösungen bei SDL-Übertragung....219
Tabelle 175: Mögliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board....220
Tabelle 176: Linkbaugruppen....221
Tabelle 177: Kabel für SDL Konfigurationen....221
Tabelle 178: Kabellängen und Auflösungen bei SDL-Übertragung....222
Tabelle 179: Mögliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board....223
Tabelle 180: Linkbaugruppen....223
Tabelle 181: Kabel für SDL Konfigurationen....224
Tabelle 182: Kabellängen und Auflösungen bei SDL-Übertragung....224
Tabelle 183: Mögliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board....226
Tabelle 184: Linkbaugruppen....227
Tabelle 185: Kabel für SDL Konfigurationen....227
Tabelle 186: Kabellängen und Auflösungen bei SDL-Übertragung....228
Tabelle 187: Mögliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board....230
Tabelle 188: Linkbaugruppen....230
Tabelle 189: Segmentlängen, Auflösungen und SDL Kabel....230
Tabelle 190: BIOS relevante Tasten im RAID Configuration Utility....234
Tabelle 191: Biosrelevante Tasten beim POST....243
Tabelle 192: Biosrelevante Tasten im BIOS Menü....243
Tabelle 193: 945GME Main Menü Einstellmöglichkeiten....244
Tabelle 194: 945GME Advanced Menü Einstellmöglichkeiten....245
Tabelle 195: 945GME Advanced ACPI Configuration Einstellmöglichkeiten....246
Tabelle 196: 945GME Advanced PCI Configuration Einstellmöglichkeiten....247
Tabelle 197: 945GME Advanced PCI IRQ Resource Exclusion Einstellmöglichkeiten....248
Tabelle 198: 945GME Advanced PCI Interrupt Routing Einstellmöglichkeiten....249
Tabelle 199: 945GME Advanced PCI Express Configuration Einstellmöglichkeiten....250
Tabelle 200: 945GME Advanced Graphics Configuration Einstellmöglichkeiten....252
Tabelle 201: 945GME Advanced CPU Configuration Einstellmöglichkeiten....254
Tabelle 202: 945GME Advanced Chipset Einstellmöglichkeiten....255
Tabelle 203: 945GME Advanced I/O Interface Configuration Einstellmöglichkeiten....256
Tabelle 204: 945GME Advanced Clock Configuration Einstellmöglichkeiten....257
Tabelle 205: 945GME Advanced IDE Configuration Einstellmöglichkeiten....258
Tabelle 206: 945GME Primary IDE Master Einstellmöglichkeiten....259
Tabelle 207: 945GME Primary IDE Slave Einstellmöglichkeiten....260
Tabelle 208: 945GME Secondary IDE Master Einstellmöglichkeiten....261
Tabelle 209: 945GME Secondary IDE Slave Einstellmöglichkeiten....262
Tabelle 210: 945GME Advanced USB Configuration Einstellmöglichkeiten....263
Tabelle 211: 945GME Advanced Keyboard/Mouse Configuration Einstellmöglichkeiten....264
Tabelle 212: 945GME Advanced Remote Access Configuration Einstellmöglichkeiten....265
Tabelle 213: 945GME Advanced CPU Board Monitor Einstellmöglichkeiten....267
Tabelle 214: 945GME Advanced Baseboard/Panel Features Einstellmöglichkeiten....268
Tabelle 215: 945GME Panel Control Einstellmöglichkeiten....269
Tabelle 216: 945GME Baseboard Monitor Einstellmöglichkeiten....270
Tabelle 217: 945GME Legacy Devices Einstellmöglichkeiten....271
Tabelle 218: 945GME Boot Menü Einstellmöglichkeiten....273
Tabelle 219: 945GME Security Menü Einstellmöglichkeiten....274
Tabelle 220: 945GME Hard Disk Security User Password....275
Tabelle 221: 945GME Hard Disk Securitiy Master Password....276
Tabelle 222: 945GME Power Menü Einstellmöglichkeiten....276
Tabelle 223: 855GME (XTX) Exit Menü Einstellmöglichkeiten....277
Tabelle 224: Profilübersicht....278

Tabelle 225: 945GME Main Profileinstellungsübersicht... 278
Tabelle 226: 945GME Advanced - ACPI Configuration Profileinstellungsübersicht... 278
Tabelle 227: 945GME Advanced - PCI Configuration Profileinstellungsübersicht... 278
Tabelle 228: 945GME Advanced - PCI Express Configuration Profileinstellungsübersicht... 279
Tabelle 229: 945GME Advanced - Graphics Configuration Profileinstellungsübersicht... 279
Tabelle 230: 945GME Advanced - CPU Configuration Profileinstellungsübersicht... 280
Tabelle 231: 945GME Advanced - Chipset Configuration Profileinstellungsübersicht... 280
Tabelle 232: 945GME Advanced - I/O Interface Configuration Profileinstellungsübersicht... 280
Tabelle 233: 945GME Advanced - Clock Configuration Profileinstellungsübersicht... 280
Tabelle 234: 945GME Advanced - IDE Configuration Profileinstellungsübersicht... 281
Tabelle 235: 945GME Advanced - USB Configuration Profileinstellungsübersicht... 281
Tabelle 236: 945GME Advanced - Keyboard/Mouse Configuration Profileinstellungsübersicht... 281
Tabelle 237: 945GME Advanced - Remote Access Configuration Profileinstellungsübersicht... 282
Tabelle 238: 945GME Advanced - CPU Board Monitor Profileinstellungsübersicht... 282
Tabelle 239: 945GME Advanced - Baseboard/Panel Features Profileinstellungsübersicht... 282
Tabelle 240: 945GME Main Profileinstellungsübersicht... 283
Tabelle 241: 945GME Security Profileinstellungsübersicht... 283
Tabelle 242: 945GME Power Profileinstellungsübersicht... 283
Tabelle 243: BIOS Postcode Meldungen BIOS 945GME... 284
Tabelle 244: RAM-Adressbelegung... 285
Tabelle 245: I/O-Adressbelegung... 285
Tabelle 246: IRQ Interrupt Zuweisungen PIC Mode... 285
Tabelle 247: IRQ Interrupt Zuweisungen APIC Mode... 286
Tabelle 248: 9S0000.01-010, 9S0000.01-020 - Bestelldaten... 300
Tabelle 249: Getestete Auflösungen und Farbtiefen bei DVI Signalen... 300
Tabelle 250: Getestete Auflösungen und Farbtiefen bei RGB Signalen... 300
Tabelle 251: 5SWWXP.0600-GER, 5SWWXP.0600-ENG, 5SWWXP.0600-MUL, 5SWWXP.0500-GER, 5SWWXP.0500-ENG, 5SWWXP.0500-MUL - Bestelldaten... 301
Tabelle 252: 5SWWI7.0100-GER, 5SWWI7.1100-GER, 5SWWI7.0100-ENG, 5SWWI7.1100-ENG, 5SWWI7.0200-GER, 5SWWI7.1200-GER, 5SWWI7.0200-ENG, 5SWWI7.1200-ENG, 5SWWI7.0300-MUL, 5SWWI7.1300-MUL, 5SWWI7.0400-MUL, 5SWWI7.1400-MUL - Bestelldaten... 305
Tabelle 253: 5SWWXP.0426-ENG - Bestelldaten... 308
Tabelle 254: Gerätefunktionen unter Windows XP Embedded mit FP2007... 308
Tabelle 255: 5SWWXP.0726-ENG - Bestelldaten... 310
Tabelle 256: Gerätefunktionen unter Windows Embedded Standard 2009... 310
Tabelle 257: 5SWWI7.1526-ENG, 5SWWI7.1626-ENG, 5SWWI7.1726-MUL, 5SWWI7.1826-MUL - Bestelldaten... 312
Tabelle 258: Gerätefunktionen unter Windows Embedded Standard 7... 313
Tabelle 259: 5SWWCE.0826-ENG - Bestelldaten... 315
Tabelle 260: Eigenschaften Windows CE 6.0... 315
Tabelle 261: 0TG1000.01, 0TG1000.02, 1TG4600.10-5, 1TG4601.06-5 - Bestelldaten... 317
Tabelle 262: 5SWUTI.0001-000 - Bestelldaten... 336
Tabelle 263: Revision der Einzelkomponenten mit GL- Zulassung... 340
Tabelle 264: 0AC201.91, 4A0006.00-000 - Bestelldaten... 343
Tabelle 265: 0AC201.91, 4A0006.00-000 - Technische Daten... 343
Tabelle 266: 0TB103.9, 0TB103.91 - Bestelldaten... 345
Tabelle 267: 0TB103.9, 0TB103.91 - Technische Daten... 345
Tabelle 268: 5AC801.FA01-00, 5AC801.FA02-00, 5AC801.FA03-00, 5AC801.FA05-00 - Bestelldaten... 346
Tabelle 269: 5AC900.1000-00 - Bestelldaten... 347
Tabelle 270: 5CFCRD.0512-06, 5CFCRD.1024-06, 5CFCRD.2048-06, 5CFCRD.4096-06, 5CFCRD.8192-06, 5CFCRD.016G-06, 5CFCRD.032G-06 - Bestelldaten... 350
Tabelle 271: 5CFCRD.0512-06, 5CFCRD.1024-06, 5CFCRD.2048-06, 5CFCRD.4096-06, 5CFCRD.8192-06, 5CFCRD.016G-06, 5CFCRD.032G-06 - Bestelldaten... 350
Tabelle 272: 5CFCRD.0512-06, 5CFCRD.1024-06, 5CFCRD.2048-06, 5CFCRD.4096-06, 5CFCRD.8192-06, 5CFCRD.016G-06, 5CFCRD.032G-06 - Technische Daten... 351
Tabelle 273: 5CFCRD.0512-06, 5CFCRD.1024-06, 5CFCRD.2048-06, 5CFCRD.4096-06, 5CFCRD.8192-06, 5CFCRD.016G-06, 5CFCRD.032G-06 - Technische Daten... 352

Tabelle 274: 5CFCRD.0512-04, 5CFCRD.1024-04, 5CFCRD.2048-04, 5CFCRD.4096-04, 5CFCRD.8192-04, 5CFCRD.016G-04 - Bestelldaten....357
Tabelle 275: 5CFCRD.0512-04, 5CFCRD.1024-04, 5CFCRD.2048-04, 5CFCRD.4096-04, 5CFCRD.8192-04, 5CFCRD.016G-04 - Technische Daten....357
Tabelle 276: 5CFCRD.0064-03, 5CFCRD.0128-03, 5CFCRD.0256-03, 5CFCRD.0512-03, 5CFCRD.1024-03, 5CFCRD.2048-03, 5CFCRD.4096-03, 5CFCRD.8192-03 - Bestelldaten....361
Tabelle 277: 5CFCRD.0064-03, 5CFCRD.0128-03, 5CFCRD.0256-03, 5CFCRD.0512-03, 5CFCRD.1024-03, 5CFCRD.2048-03, 5CFCRD.4096-03, 5CFCRD.8192-03 - Technische Daten....362
Tabelle 278: 5MD900.USB2-01 - Bestelldaten....365
Tabelle 279: 5MD900.USB2-01 - Technische Daten....366
Tabelle 280: 5MD900.USB2-01 - Lieferumfang....368
Tabelle 281: 5MD900.USB2-02 - Bestelldaten....370
Tabelle 282: 5MD900.USB2-02 - Technische Daten....370
Tabelle 283: 5MD900.USB2-02 - Lieferumfang....373
Tabelle 284: 5A5003.03 - Bestelldaten....374
Tabelle 285: 5A5003.03 - Technische Daten....374
Tabelle 286: 5A5003.03 - Lieferumfang....374
Tabelle 287: 5MMUSB.2048-00 - Bestelldaten....376
Tabelle 288: 5MMUSB.2048-00 - Technische Daten....376
Tabelle 289: 5MMUSB.2048-01, 5MMUSB.4096-01 - Bestelldaten....378
Tabelle 290: 5MMUSB.2048-01, 5MMUSB.4096-01 - Technische Daten....378
Tabelle 291: 5AC600.UPSI-00 - Bestelldaten....381
Tabelle 292: 5AC600.UPSI-00 - Technische Daten....381
Tabelle 293: 5AC600.UPSB-00 - Bestelldaten....383
Tabelle 294: 5AC600.UPSB-00, 5AC600.UPSB-00 - Technische Daten....383
Tabelle 295: 5CAUPS.0005-00, 5CAUPS.0030-00 - Bestelldaten....386
Tabelle 296: 5CAUPS.0005-00, 5CAUPS.0030-00 - Technische Daten....386
Tabelle 297: 5AC600.UPSF-00 - Bestelldaten....387
Tabelle 298: 5AC600.UPSF-01 - Bestelldaten....387
Tabelle 299: 5AC804.MFLT-00 - Bestelldaten....388
Tabelle 300: 5AC804.MFLT-00 - Technische Daten....388
Tabelle 301: 5ACPCI.ETH1-01 - Bestelldaten....390
Tabelle 302: 5ACPCI.ETH1-01 - Technische Daten....390
Tabelle 303: 5ACPCI.ETH1-01 - Technische Daten....391
Tabelle 304: 5ACPCI.ETH3-01 - Bestelldaten....393
Tabelle 305: 5ACPCI.ETH3-01 - Technische Daten....393
Tabelle 306: 5ACPCI.ETH3-01 - Technische Daten....394
Tabelle 307: 5CADVI.0018-00, 5CADVI.0050-00, 5CADVI.0100-00 - Bestelldaten....396
Tabelle 308: 5CADVI.0018-00, 5CADVI.0050-00, 5CADVI.0100-00 - Technische Daten....396
Tabelle 309: 5CASDL.0008-00, 5CASDL.0018-00, 5CASDL.0050-00, 5CASDL.0100-00, 5CASDL.0150-00, 5CASDL.0200-00, 5CASDL.0250-00, 5CASDL.0300-00 - Bestelldaten....399
Tabelle 310: 5CASDL.0008-00, 5CASDL.0018-00, 5CASDL.0050-00, 5CASDL.0100-00, 5CASDL.0150-00, 5CASDL.0200-00, 5CASDL.0250-00, 5CASDL.0300-00 - Technische Daten....399
Tabelle 311: 5CASDL.0018-01, 5CASDL.0050-01, 5CASDL.0100-01, 5CASDL.0150-01 - Bestelldaten....402
Tabelle 312: 5CASDL.0018-01, 5CASDL.0050-01, 5CASDL.0100-01, 5CASDL.0150-01 - Technische Daten....402
Tabelle 313: 5CASDL.0018-03, 5CASDL.0050-03, 5CASDL.0100-03, 5CASDL.0150-03, 5CASDL.0200-03, 5CASDL.0250-03, 5CASDL.0300-03 - Bestelldaten....405
Tabelle 314: 5CASDL.0018-03, 5CASDL.0050-03, 5CASDL.0100-03, 5CASDL.0150-03, 5CASDL.0200-03, 5CASDL.0250-03, 5CASDL.0300-03 - Technische Daten....405
Tabelle 315: Aufbau SDL Kabel flex 5CASDL.0xxx-03....407
Tabelle 316: 5CASDL.0300-13, 5CASDL.0400-13, 5CASDL.0430-13 - Bestelldaten....408
Tabelle 317: 5CASDL.0300-13, 5CASDL.0400-13, 5CASDL.0430-13 - Technische Daten....408
Tabelle 318: 5CAUSB.0018-00, 5CAUSB.0050-00 - Bestelldaten....412
Tabelle 319: 5CAUSB.0018-00, 5CAUSB.0050-00 - Technische Daten....412
Tabelle 320: 9A0014.02, 9A0014.05, 9A0014.10 - Bestelldaten....413
Tabelle 321: 9A0014.02, 9A0014.05, 9A0014.10 - Technische Daten....413
Tabelle 322: 5CAMSC.0001-00 - Bestelldaten....415

Tabelle 323: 5CAMSC.0001-00 - Technische Daten....415
Tabelle 324: 5AC801.FRAM-00 - Bestelldaten....416
Tabelle 325: 5AC801.FRAM-00 - Technische Daten....416
Tabelle 326: Bedeutung Batteriestatus....418
Tabelle 327: Übersicht benötigte Ersatz SATA-HDD für PCI SATA HDD RAID Controller....444
Tabelle 328: Temperaturgrenzen der Lüfterregelung (MTCX PX32 ≥ V0.06)....450
Tabelle 329: Pinbelegung Stecker am Basisboard....451

0AC201.91 ... 343
0TB103.9 ... 345
0TB103.91 ... 345
0TG1000.01 ... 317
0TG1000.02 ... 317
1TG4600.10-5 ... 317
1TG4601.06-5 ... 317
4A0006.00-000 ... 343
5A5003.03 ... 374
5AC600.485I-00 ... 194
5AC600.CANI-00 ... 191
5AC600.UPSB-00 ... 383
5AC600.UPSF-00 ... 387
5AC600.UPSF-01 ... 387
5AC600.UPSI-00 ... 381
5AC801.ADAS-00 ... 152
5AC801.DVDS-00 ... 155
5AC801.DVRS-00 ... 157
5AC801.FA01-00 ... 346
5AC801.FA02-00 ... 346
5AC801.FA03-00 ... 346
5AC801.FA05-00 ... 346
5AC801.FRAM-00 ... 416
5AC801.HDDI-00 ... 112
5AC801.HDDI-01 ... 114
5AC801.HDDI-02 ... 116
5AC801.HDDI-03 ... 118
5AC801.HDDI-04 ... 120
5AC801.HDDS-00 ... 153
5AC801.HS00-00 ... 109
5AC801.HS00-01 ... 109
5AC801.HS00-02 ... 109
5AC801.RDYR-00 ... 188
5AC801.RDYR-01 ... 189
5AC801.SDL0-00 ... 185
5AC801.SSDI-00 ... 122
5AC801.SSDI-01 ... 126
5AC801.SSDI-02 ... 128
5AC801.SSDI-03 ... 130
5AC801.SSDI-04 ... 133
5AC801.SSDI-05 ... 136
5AC804.MFLT-00 ... 388
5AC900.1000-00 ... 347
5ACPCI.ETH1-01 ... 390
5ACPCI.ETH3-01 ... 393
5ACPCI.RAIC-01 ... 160
5ACPCI.RAIC-02 ... 163
5ACPCI.RAIC-03 ... 165
5ACPCI.RAIC-04 ... 168
5ACPCI.RAIC-05 ... 170
5ACPCI.RAIC-06 ... 173
5CADVI.0018-00 ... 396
5CADVI.0050-00 ... 396
5CADVI.0100-00 ... 396
5CAMSC.0001-00 ... 415
5CASDL.0008-00 ... 399
5CASDL.0018-00 ... 399
5CASDL.0018-01 ... 402
5CASDL.0018-03 ... 405
5CASDL.0050-00 ... 399
5CASDL.0050-01 ... 402
5CASDL.0050-03 ... 405

5CASDL.0100-00 ... 399
5CASDL.0100-01 ... 402
5CASDL.0100-03 ... 405
5CASDL.0150-00 ... 399
5CASDL.0150-01 ... 402
5CASDL.0150-03 ... 405
5CASDL.0200-00 ... 399
5CASDL.0200-03 ... 405
5CASDL.0250-00 ... 399
5CASDL.0250-03 ... 405
5CASDL.0300-00 ... 399
5CASDL.0300-03 ... 405
5CASDL.0300-13 ... 408
5CASDL.0400-13 ... 408
5CASDL.0430-13 ... 408
5CAUPS.0005-00 ... 386
5CAUPS.0030-00 ... 386
5CAUSB.0018-00 ... 412
5CAUSB.0050-00 ... 412
5CFCRD.0064-03 ... 361
5CFCRD.0128-03 ... 361
5CFCRD.016G-04 ... 357
5CFCRD.016G-06 ... 350
5CFCRD.0256-03 ... 361
5CFCRD.032G-06 ... 350
5CFCRD.0512-03 ... 361
5CFCRD.0512-04 ... 357
5CFCRD.0512-06 ... 350
5CFCRD.1024-03 ... 361
5CFCRD.1024-04 ... 357
5CFCRD.1024-06 ... 350
5CFCRD.2048-03 ... 361
5CFCRD.2048-04 ... 357
5CFCRD.2048-06 ... 350
5CFCRD.4096-03 ... 361
5CFCRD.4096-04 ... 357
5CFCRD.4096-06 ... 350
5CFCRD.8192-03 ... 361
5CFCRD.8192-04 ... 357
5CFCRD.8192-06 ... 350
5MD900.USB2-01 ... 365
5MD900.USB2-02 ... 370
5MMDDR.0512-01 ... 111
5MMDDR.1024-01 ... 111
5MMDDR.2048-01 ... 111
5MMHDD.0250-00 ... 176
5MMHDD.0500-00 ... 178
5MMSSD.0060-00 ... 139
5MMSSD.0060-01 ... 141
5MMSSD.0128-01 ... 144
5MMSSD.0180-00 ... 147
5MMSSD.0256-00 ... 149
5MMUSB.2048-00 ... 376
5MMUSB.2048-01 ... 378
5MMUSB.4096-01 ... 378
5PC800.B945-00 ... 106
5PC800.B945-01 ... 106
5PC800.B945-02 ... 106
5PC800.B945-03 ... 106
5PC800.B945-04 ... 106
5PC800.B945-05 ... 106
5PC800.B945-10 ... 106

5PC800.B945-11 106
5PC800.B945-12 106
5PC800.B945-13 106
5PC800.B945-14 106
5PC810.BX01-00 104
5PC810.BX01-01 104
5PC810.BX02-00 104
5PC810.BX02-01 104
5PC810.BX03-00 104
5PC810.BX05-00 104
5PC810.BX05-01 104
5PC810.BX05-02 104
5PC810.FA01-00 180
5PC810.FA02-00 181
5PC810.FA02-01 181
5PC810.FA03-00 183
5PC810.FA05-00 184
5PC810.SX01-00 76
5PC810.SX02-00 83
5PC810.SX03-00 90
5PC810.SX05-00 97
5SWUTI.0001-000 336
5SWWCE.0826-ENG 315
5SWWI7.0100-ENG 305
5SWWI7.0100-GER 305
5SWWI7.0200-ENG 305
5SWWI7.0200-GER 305
5SWWI7.0300-MUL 305
5SWWI7.0400-MUL 305
5SWWI7.1100-ENG 305
5SWWI7.1100-GER 305
5SWWI7.1200-ENG 305
5SWWI7.1200-GER 305
5SWWI7.1300-MUL 305
5SWWI7.1400-MUL 305
5SWWI7.1526-ENG 312
5SWWI7.1626-ENG 312
5SWWI7.1726-MUL 312
5SWWI7.1826-MUL 312
5SWWXP.0426-ENG 308
5SWWXP.0500-ENG 301
5SWWXP.0500-GER 301
5SWWXP.0500-MUL 301
5SWWXP.0600-ENG 301
5SWWXP.0600-GER 301
5SWWXP.0600-MUL 301
5SWWXP.0726-ENG 310
9A0014.02 413
9A0014.05 413
9A0014.10 413
9S0000.01-010 300
9S0000.01-020 300

9

945GME ... 106

A

Abmessungen
5A5003.03 ... 374
5MD900.USB2-02 ... 372
APC810 1 Card Slot ... 81
APC810 2 Card Slot ... 88
APC810 3 Card Slot ... 95
APC810 5 Card Slot ... 101
Standard half-size PCIe Karte ... 67
Standard half-size PCI Karte ... 67
ACPI ... 285, 286
Add-on Schnittstellensteckplatz ... 65
Add-on USV Modul ... 381
Add-on USV Steckplatz ... 66
ADI ... 319
.NET SDK ... 331
Development Kit ... 329
SDL Equalizer Einstellung ... 321
Allgemeintoleranz ... 23
Anleitung Temperaturtest ... 201
Anschluss externer Verbraucher ... 451
Anschluss von Kabeln ... 200
APC810 1 Card Slot
Abmessungen ... 81
Bohrschablone ... 82
Schnittstellen ... 77
Technische Daten ... 78
APC810 2 Card Slot
Abmessungen ... 88
Bohrschablone ... 89
Schnittstellen ... 84
Technische Daten ... 85
APC810 3 Card Slot
Abmessungen ... 95
Bohrschablone ... 96
Schnittstellen ... 91
Technische Daten ... 92
APC810 5 Card Slot
Abmessungen ... 101
Bohrschablone ... 102
Schnittstellen ... 98
Technische Daten ... 99
AP Link Montage ... 443
AP Link Steckplatz ... 66
ARemb ... 318
ARwin ... 317
ATEX Zulassung ... 338
Auflösung ... 106
Auflösung DVI-Übertragung ... 61, 187
Auflösung SDL-Übertragung ... 61, 186, 210, 217, 219, 222, 224, 228
Auswertung Temperaturen ... 202
Automation Runtime ... 317
Automation Runtime Embedded ... 318
Automation Runtime Windows ... 317

B

B&R Automation Device Interface ... 319
B&R CompactFlash ... 357
B&R Control Center ... 319
B&R Embedded OS Installer ... 299, 316
B&R KCF Editor ... 335
B&R Key Editor ... 333
Batteriepolarität verkehrt ... 323
Batteriestatusermittlung ... 71, 418
Batteriewechsel ... 418
Beep Codes ... 284
Befestigungslasche ... 197
Beispielprogramme ... 204
Bemaßungsnorm ... 23
Betriebssystem
  Windows 7 ... 305
  Windows CE ... 315
  Windows Embedded Standard 2009 ... 310
  Windows Embedded Standard 7 ... 312
  Windows XP Embedded ... 308
  Windows XP Professional ... 301
Biegeradius ... 200
Biegeradiusspezifikation ... 200
BIOS 945GME
  ACPI Configuration ... 246
  Advanced ... 245
  Baseboard/Panel Features ... 268
  Baseboard Monitor ... 270
  Boot ... 272
  Chipset Configuration ... 255
  Clock Configuration ... 257
  CPU Board Monitor ... 267
  CPU Configuration ... 254
  Exit ... 277
  Graphics Configuration ... 252
  Hard Disk Security Master Password ... 275
  Hard Disk Security User Password ... 275
  I/O Interface Configuration ... 256
  IDE Configuration ... 257
  Keyboard/Mouse Configuration ... 264
  Legacy Devices ... 271
  Main ... 244
  Panel Control ... 269
  PCI Configuration ... 247
  PCI Express Configuration ... 250
  Power ... 276
  Remote Access Configuration ... 265
  Security ... 274
  USB Configuration ... 263
BIOS Defaulteinstellungen ... 278
BIOS Fehlersignale ... 284
BIOS Setup Tasten ... 243
BIOS Upgrade ... 290
Blockschaltbild Spannungsversorgung ... 41

C

Card Slot Steckplatz ... 67
CE-Kennzeichnung ... 337
CMOS Profile Schalter ... 69
COM1 ... 59, 59

COM2 ..... 59, 59
CompactFlash
  Benchmark 360
CompactFlash-Karten 348
CompactFlash Slot 73, 73
CompactFlash Tausch 420
Control Center 202, 319
CPU Board 106
CPU Board 945GME 106

D

Dongle 72, 318
Dual-Channel Memory 111
DVI 60
DVI-Kabel 396
DVI-Übertragung 61, 187, 61, 187
Dynamic Wear Leveling 348

E

Einbaulagen 198
Einschübe 58
Einsteckkarte 390
Elektromagnetische Verträglichkeit 337
Embedded OS Installer 299
EMV-Richtlinie 337
Entsorgung 22, 22
Erdung 58, 201
Erdungsanschluss 201
ESD 20
  Einzelbauteile 20
  Elektrische Baugruppen mit Gehäuse 20
  Elektrische Baugruppen ohne Gehäuse 20
  gerechte Handhabung 20
  Verpackung 20
ETH1 62
ETH2 63
Ethernet 62, 63
Externer Verbraucher 451

F

Features Windows CE 6.0 315
Firmwareupgrade 293
Freiraum 199
Funktionserde 201

G

Geräteschnittstellen und Einschübe 58
Germanischer Lloyd 340
Gesamtgerät 32
GL-Zulassung 340
GOST-R 340
Gosudarstwenny Standart 340

H

Handbuchhistorie 14
Hardware Security Key 72

Hauptspeicher ... 111
HMI Service Center ... 336

I

I/O-Adressbelegung ... 471

1 I/O-Adressbelegung

I/O-Adressbelegung ... 285
Implementierungsanleitung ... 204
Interrupt- Zuweisung ... 285

K

Kabel ... 396
  DVI ... 396
  RS232 ... 413
  SDL ... 399
  SDL flex ... 405
  SDL flex mit Extender ... 408
  SDL mit 45°-Stecker ... 402
  USB ... 412
Kabellängen ... 61, 61, 186, 187, 210, 217, 219, 222, 224, 228
KCF Editor ... 335
Key Editor ... 333
Klimakammer ... 204
Konfiguration
  Grundsystem ... 30
  optionale Komponenten ... 31
Kühlkörper ... 109

L

Laufwerke ... 112
LED ... 69
Loopback Adapter ... 203
Low Battery ... 326, 328
Lüfter Kit ... 180
Lüfter Kit Einbau / Tausch ... 425
Lüfterregelung ... 449
Luftfeuchtigkeitsangaben ... 40
Luftzirkulation ... 199, 199

M

Maintenance Controller Extended ... 449
MIC, Line IN, Line OUT ... 65
Monitor / Panel Anschluss ... 60
Montage ... 197
Montage der HDD Ersatzdiskablage ... 446
Montage des Ready Relais /2 ... 447
Montage des USV Moduls ... 427
Montage USV Sicherungs Kit ... 439
MS-DOS ... 300
MTCX ... 449

N

Netzfilter ... 388

P

Parity Error ... 284
PCI ... 390
PCI / PCIe ... 67
Powerfail ... 328
Power Taster ... 70

R

RAM-Adressbelegung ... 285
Relative Luftfeuchtigkeit ... 40
Reporterstellung ... 319
Reset Taster ... 70
Ressourcenaufteilung
  I/O-Adressbelegung ... 285
Richtlinien ... 23
Richtlinien und Erklärungen ... 337
RS232-Kabel ... 413

S

Schnittstellen ... 58
SDL ... 60
SDL-Kabel ... 399
SDL-Kabel flex ... 405
SDL-Kabel flex mit Extender ... 408
SDL-Kabel mit 45°-Stecker ... 402
SDL-Übertragung ... 61, 186, 210, 217, 219, 222, 224, 228, 61, 186, 210, 217, 219, 222, 224, 228
Security Key ... 72
Seitendeckeldemontage ... 441
Sensor ... 39
Serialnummernaufkleber ... 48, 48
Serielle Schnittstelle ... 59, 59
Service Center ... 336
Sicherheitshinweise ... 20
  Bestimmungsgemäße Verwendung ... 20
  Betrieb ... 21
  Montage ... 21
  Schutz vor elektrostatischen Entladungen ... 20
  Transport und Lagerung ... 21
  Umgebungsbedingungen ... 21
  Umweltgerechte Entsorgung ... 22
  Vorschriften und Maßnahmen ... 20
  Werkstofftrennung ... 22
Sicherungs Kit USV ... 439
Slide-in compact Adapter Montage ... 423
Slide-in compact Laufwerkseinbau bzw. -tausch ... 421
Slide-in Slot ... 74, 74
Slide-in Slot Laufwerkseinbau bzw. -tausch ... 422
Smart Display Link ... 60
Softwareversionen ... 319
Spannungsversorgung ... 58, 201
Spannungsversorgungsstecker ... 345
Static Wear Leveling ... 348
Status LEDs ... 69
Störfestigkeit ... 201
Störungsableitung ... 201

T

Tauschen einer PCI SATA RAID Hard Disk... 444
Technology Guarding... 318
Temperaturangaben... 3, 3
Temperaturauswertung... 202
Temperatursensorpositionen... 3, 3
Temperaturtest... 201
Temperaturüberwachung... 449
Temperaturüberwachung Lüfterregelung... 449

U

UL Haz. Loc. Zulassung... 338
UL-Zulassung... 338
Umgebungstemperatur
  maximal... 33
  maximal mit Lüfter Kit... 36
  maximal ohne Lüfter Kit... 33
  minimal... 38
Unterbrechungsfreie Stromversorgung... 380
Upgrade
  BIOS... 290
  Firmware... 293
Upgradeinformationen... 290
Upgradeprobleme... 299
USB-Kabel... 412
USB Media Drive... 365
USB Memory Stick... 376
USB Peripheriegeräte... 232
USB Schnittstellen... 64
User Serial ID... 320
USV... 380
  Abschaltzeit der USV... 327
  Ändern der Abschaltzeit... 326
  Batterieeinstellungen aktualisieren... 324
  Batterieeinstellungen bearbeiten... 323
  Batterieeinstellungen sichern... 325
  Installation des USV Dienstes... 322
  Low Battery Shutdown... 328
  Over Current Shutdown... 328
  Powerfail... 328
  Standard Shutdown... 328
  Statuswerte der USV anzeigen... 323
  Systemeinstellungen der USV... 325
  USV Parametrierung... 322
USV Parametrierung... 322
USV Sicherungs Kit... 439

V

Vorgehensweise Temperaturtest... 201

W

WES2009... 310
WES7... 312
Win7... 305
WinCE... 315
Windows 7... 305
Windows CE... 315

Windows Embedded Standard 2009 ... 310
Windows Embedded Standard 7 ... 312
Windows XP Embedded ... 308
Windows XP Professional ... 301
WinXP Pro ... 301

Z

Zubehör ... 343
Zulassungen ... 338
  ATEX ... 338
  Germanischer Lloyd ... 340
  GOST-R ... 340
  UL ... 338
  UL Haz. Loc ... 338